

证券代码：300223

证券简称：北京君正

上市地点：深圳证券交易所



北京君正集成电路股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

发行股份及支付现金购买资产的交易对方			
1	北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)	8	厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）
2	北京华创芯原科技有限公司	9	上海集岑企业管理中心（有限合伙）
3	上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）	10	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
4	青岛民和志威投资中心（有限合伙）	11	北京青禾投资基金（有限合伙）
5	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	12	黑龙江万丰投资担保有限公司
6	Worldwide Memory Co., Limited	13	上海承裕投资管理有限公司
7	Asia-Pacific Memory Co., Limited		
募集配套资金的交易对方			
包括北京四海君芯有限公司在内的不超过 5 名符合条件的特定投资者			

独立财务顾问



中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号

二〇一九年十一月

交易各方声明

一、公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次重组信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份。

本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次重大资产重组产生的投资风险，由投资者自行负责。本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。

投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

根据相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具以下承诺与声明：

本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书

面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本承诺人及本承诺人相关人员保证不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

三、相关证券服务机构声明

本次重大资产重组的证券服务机构已出具如下声明：

国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、北京市金杜律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司及相关经办人员保证出具文件的真实性、准确性及完整性。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。

修订说明

根据中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（192433 号）》，公司对本报告书进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：

1、补充披露了本次交易不会导致上市公司控制权发生变更的情况，具体参见“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司股权结构的影响分析”、“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司股权结构的影响分析”。

2、补充披露了拟支付现金对价对上市公司后续生产经营和财务状况的影响情况，具体参见“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（八）拟支付现金对价对上市公司后续生产经营和财务状况的影响”、“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易对上市公司的影响”之“（八）拟支付现金对价对上市公司后续生产经营和财务状况的影响”。

3、补充披露了 CFIUS 及台湾投审会审查进展等事宜，具体参见“重大事项提示”之“十、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第一章 本次交易概况”之“八、本次交易的报批事项”。

4、补充披露了本次交易前控股股东、实际控制人及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排情况，具体参见“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”、“第二章 上市公司基本情况”之“七、上市公司控股股东和实际控制人情况”之“（三）上市公司实际控制人情况”。

5、补充披露了商誉减值风险对上市公司未来生产经营的影响，具体参见“重大风险提示”与“第十二章 风险因素”之“一、本次交易的相关风险”之“（八）商誉减值风险”。

6、补充披露了业绩承诺补偿安排的原因及合理性、业绩承诺不考虑北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销的合规性和可操作性，具体参见“第一章 本次交易概况”之“七、业绩承诺与补偿安排”之“（五）业绩承诺合理性及减值测试说明”。

7、补充披露了认定刘强和李杰为一致行动人的依据、一致行动关系的期限及稳定性，具体参见“第二章 上市公司基本情况”之“七、上市公司控股股东和实际控制人情况”之“（三）上市公司实际控制人情况”。

8、补充披露了厦门芯华财产份额代持情况，具体参见“第三章 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（八）厦门芯华”、“第三章 交易对方基本情况”之“十、交易对方股权代持情况”。

9、补充披露了各交易对方最终出资人变动情况、持有股权或财产份额的锁定安排、结构化安排情况，具体参见“第三章 交易对方基本情况”之“七、交易对方最终出资人变动情况”、“八、仅持有标的公司股权或财产份额的交易对方最终出资人持有股权或财产份额的锁定安排”、“九、本次重组交易对方的合伙企业中存在结构化安排的情况”。

10、补充披露了本次交易后上市公司对北京矽成的控制情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（四）北京矽成股权结构及控制关系情况”。

11、补充披露了本次交易完成的补充质押安排或其他增信措施，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。

12、补充披露了北京矽成报告期主要采购项目及供应商的相关情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（八）北京矽成主营业务情况”。

13、补充披露了对北京矽成境外经营真实性核查情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（八）北京矽成主营业务情况”。

14、补充披露了本次收购不会对北京矽成在主要资产及业务所在国家和地区持续开展业务产生不利影响相关情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（八）北京矽成主营业务情况”。

15、补充披露了北京矽成核心技术人员、研发人员相关情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（八）北京矽成主营业务情况”。

16、补充披露了报告期内北京矽成增资和股权转让相关情况、本次作价整体估值相比兆易创新拟收购时增长的合理性，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（十四）北京矽成最近三年股权转让、增资及评估情况说明”。

17、补充披露了北京矽成因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形符合相关税收、外汇监管要求情况，具体参见“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（十六）北京矽成因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形符合相关税收、外汇监管要求，有利于维护上市公司及中小股东利益”。

18、补充披露了未来营业成本预测中考虑存货减值损失相关情况、预测中间费用占比情况、最低现金保有量的预测依据和过程、溢余资金余额的合理性，具体参见“第五章 标的资产评估情况”之“二、北京矽成评估情况”之“（一）收益法评估具体情况”。

19、补充披露了北京矽成预测期 DRAM 毛利率情况、报告期及预测期内北京矽成研发费用情况、最新业绩情况、业绩承诺可实现性情况、承诺期净利润较报告期净利润有大幅增长的合理性及可实现性，具体参见“第五章 标的资产评估情况”之“四、董事会对资产评估的合理性及定价的公允性分析”之“（二）财务预测的合理性分析”。

20、补充披露了本次作价整体估值相比私有化时期增长的合理性、本次交易调整前后估值差异的原因及合理性，具体参见“第五章 标的资产评估情况”之“四、董事会对资产评估的合理性及定价的公允性分析”之“（九）本次作价整体估值相比私有化时期增长的合理性”、“（十）本次交易调整前后估值差异的原因及合理性”。

21、更新了募投项目备案情况，具体参见“第六章 发行股份情况”之“二、本次发行股份募集配套资金情况说明”之“（二）募集配套资金投资项目介绍”。

22、补充披露了上市公司使用募集资金的情况，具体参见“第六章 发行股份情况”之“二、本次发行股份募集配套资金情况说明”之“（三）上市公司前次募集资金情况”。

23、补充披露了国际经济环境、行业竞争格局、行业供需情况对产品价格及成本的影响，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）行业整体发展情况”。

24、补充披露了北京矽成的核心竞争力和持续盈利能力情况，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（八）标的公司核心竞争力及行业地位”。

25、补充披露了北京矽成未来保持盈利水平稳定的具体措施，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）北京矽成未来保持盈利水平稳定的具体措施”。

26、补充披露了北京矽成主要供应商产线更新及技术升级的情形及影响、2018 年原材料增长情况、各类存货的可变现净值测算依据、不存在主要订单合同为亏损合同的情况、销售环节内控的有效性情况、北京矽成与力晶科技的融资租赁交易情况、DRAM 及 SRAM 产品研发费用资本化账面价值增长情况、研发费用资本化符合资本化条件和《企业会计准则》相关规定的情况、北京矽成私有化商誉确认情况、预计负债具体情况、ISSI(Israel)预计负债未考虑在 ISSI(Israel)评估值的合理性，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“三、北京矽成的财务分析”之“（一）财务状况分析”。

27、补充披露了北京矽成与境外可比公司毛利率对比分析、北京矽成收入及业绩波动合理性、北京矽成 2017 年确认所得税相关情况，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“三、北京矽成的财务分析”之“（三）盈利能力分析”。

28、补充披露了未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施，具体参见“第九章 管理层讨论与分析”之“八、未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施”。

上述补充披露内容均以楷体加粗字体显示。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

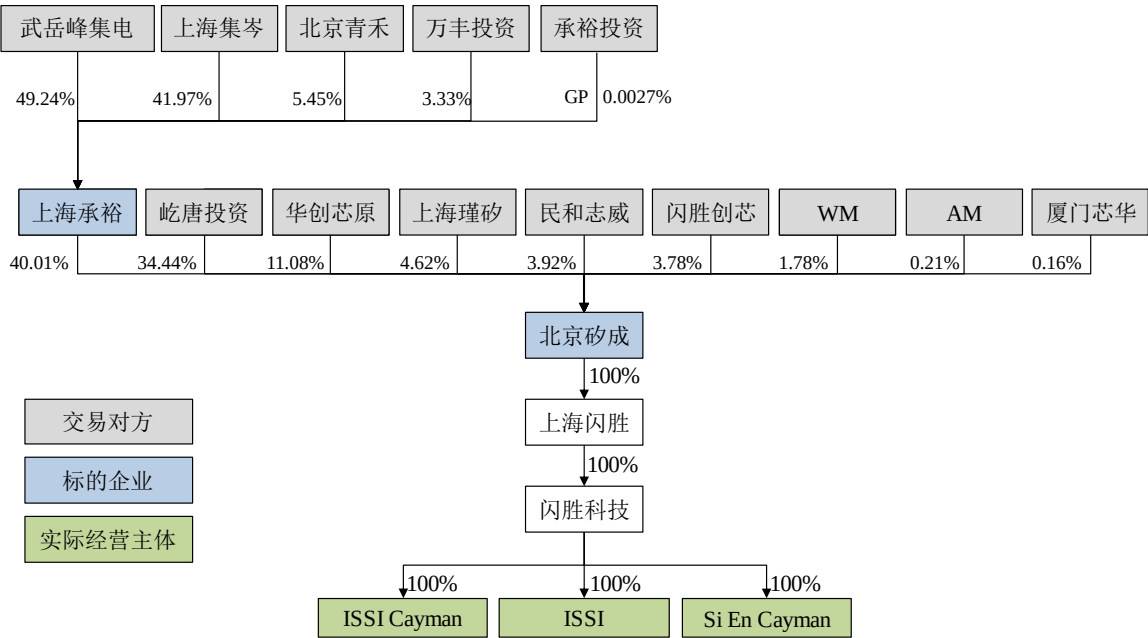
一、本次交易方案概述

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分。发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。

（一）本次收购方案概述

本次收购方案为北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成 59.99%股权，以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕 100%财产份额，合计交易作价 72 亿元。

本次收购的交易架构如下：



本次收购的具体情况如下：

序号	标的企业	权益比例	转让方	受让方	支付方式

序号	标的企业	权益比例	转让方	受让方	支付方式
1	北京矽成	34.44%	屹唐投资	上市公司	股份+现金
		11.08%	华创芯原	上市公司	股份+现金
		4.62%	上海瑾矽	上市公司	股份
		3.92%	民和志威	上市公司	股份
		3.78%	闪胜创芯	上市公司	股份
		1.78%	WM	上市公司	股份
		0.21%	AM	上市公司	股份
		0.16%	厦门芯华	上市公司	股份
2	上海承裕	49.24%	武岳峰集电	上市公司	股份+现金
		41.97%	上海集岑	上市公司	股份
		5.45%	北京青禾	上市公司	现金
		3.33%	万丰投资	上市公司	股份+现金
		0.0027%	承裕投资	合肥君正	现金

本次收购完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。

北京矽成于 2015 年以 7.8 亿美元（按照 2018 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 6.8632 折算约 53.7 亿元人民币）对美国纳斯达克上市公司 ISSI 实施私有化收购。ISSI 主营各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH 存储芯片及 ANALOG 模拟芯片的研发和销售。本次交易系对集成电路产业同行业公司产业并购，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。

（二）配套融资方案概述

公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的部分现金对价、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项

目。其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。

二、本次交易支付方式、募集配套资金安排

（一）发行股份及支付现金购买资产

根据东洲评估出具的《北京矽成评估报告》、《上海承裕评估报告》，截至评估基准日（2018 年 12 月 31 日），北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，上海承裕 100%财产份额评估值为 281,217.81 万元。参考上述评估值，经交易各方协商一致确定北京矽成 59.99%股权的交易作价为 431,929.02 万元，上海承裕 100%财产份额的交易作价为 288,102.84 万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，股份发行价格为 22.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量）。上市公司 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年 4 月 10 日总股本向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2019 年 5 月 27 日，上市公司 2018 年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格由 22.49 元/股调整为 22.46 元/股。

定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将作相应调整。除此之外，本次发行股份购买资产的股份发行价格不再调整。如果本次发行股份购买资产的股份发行价格发生调整，本次发行股份购买资产的股份发行数量也将做出相应处理。

按照本次交易的交易价格以及本次发行股份购买资产的发行价格，本次交易上市公司将向交易对方支付股份对价金额共计 558,469.55 万元，发行数量共计 248,650,730 股，具体如下：

交易对方	权益比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票发行数量 (股)
			股份对价	股份对	现金对价	现金对	

			（万元）	价占比	（万元）	价占比	
购买北京矽成 59.99%股权							
屹唐投资	34.44%	247,967.83	136,010.36	54.85%	111,957.48	45.15%	60,556,704
华创芯原	11.08%	79,781.46	51,781.46	64.90%	28,000.00	35.10%	23,054,968
上海瑾矽	4.62%	33,230.77	33,230.77	100.00%	-	-	14,795,533
民和志威	3.92%	28,248.33	28,248.33	100.00%	-	-	12,577,174
闪胜创芯	3.78%	27,252.00	27,252.00	100.00%	-	-	12,133,570
Worldwide Memory	1.78%	12,806.75	12,806.75	100.00%	-	-	5,702,027
Asia Memory	0.21%	1,491.80	1,491.80	100.00%	-	-	664,200
厦门芯华	0.16%	1,150.07	1,150.07	100.00%	-	-	512,053
小计	59.99%	431,929.02	291,971.54	67.60%	139,957.48	32.40%	129,996,229
购买上海承裕 100%财产份额							
武岳峰集电	49.24%	141,870.13	135,982.52	95.85%	5,887.61	4.15%	60,544,310
上海集岑	41.97%	120,915.49	120,915.49	100.00%	-	-	53,835,926
北京青禾	5.45%	15,708.30	-	-	15,708.30	100.00%	-
万丰投资	3.33%	9,601.06	9,600.00	99.99%	1.06	0.01%	4,274,265
承裕投资	0.0027%	7.85	-	-	7.85	100.00%	-
小计	100.00%	288,102.84	266,498.01	92.50%	21,604.82	7.50%	118,654,501
合计	-	720,031.86	558,469.55	77.56%	161,562.30	22.44%	248,650,730

注：以上股份发行数量以股份对价除以发行价格计算，若不为整数，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。下同。

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的股数为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。

（二）募集配套资金

为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，公司拟采取询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过150,000.00万元的配套资金。其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的50%。

本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）的 100%，且根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。刘强控制的企业四海君芯不参与询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量 = 募集配套资金总金额 ÷ 发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易部分现金对价、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。截至 2019 年 5 月 31 日，公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及相关利息和现金管理收益余额为 48,365.53 万元。其中，公司除尚需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金 2,124.17 万元外，剩余募集资金和超募资金无明确使用计划。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息

（含现金管理收益）合计 45,613.30 万元用以支付本次交易的部分现金对价。该事项已经上市公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）本次交易中发行股份的锁定安排

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的锁定期

（1）业绩承诺方的锁定期安排

作为业绩承诺方，屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电在本次购买资产项下取得的公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量－第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

（2）非业绩承诺方的锁定期安排

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登

记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

2、募集配套资金所涉发行股份的锁定期

刘强控制的企业四海君芯认购的募集配套资金发行的新增股份自发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的募集配套资金发行的新增股份自发行完成之日起 12 个月内不得转让。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

三、标的资产的评估情况

根据东洲评估出具的《北京矽成评估报告》，东洲评估分别采用收益法和市场法两种方法对北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法的评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日，北京矽成股东权益账面值为 580,494.44 万元，评估值 702,791.68 万元，评估增值 122,297.24 万元，增值率 21.07%。

根据东洲评估出具的《上海承裕评估报告》，东洲评估采用资产基础法对上海承裕在评估基准日的全部财产份额价值进行评估，截至评估基准日，上海承裕全部财产份额账面值 2,812,178,119.19 元，评估值 2,812,178,119.19 元，评估增值 0 元，评估增值率 0%。

四、本次交易构成重大资产重组

本次交易中，标的资产为北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额，合计交易价格为 720,031.86 万元。此外，本次重大资产重组前 12 个月，公司投资了深圳吉迪思电子科技有限公司。吉迪思主要从事智能设备显示主控芯片的设计、研发及相关电子产品的销售，与本次重组的标的公司北京矽成下属企业属于同一行业。根据《重组管理办法》，公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算，相关财务指标占比情况计算如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	营业收入	资产净额与交易金额孰高
本次交易-购买北京矽成 59.99%股权及上海承裕 100%财产份额	720,031.86	287,724.41	720,031.86
前次交易-投资吉迪思 5.8824%股权	1,000.00	3.11	1,000.00
合计	721,031.86	287,727.52	721,031.86
上市公司财务数据	115,676.00	18,446.70	112,482.76
财务指标占比	623.32%	1,559.78%	641.02%
是否构成重大资产重组	是	是	是

根据《重组管理办法》及上表，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的情形，因此需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

五、本次交易构成关联交易

本次交易/本次收购完成后，发行股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

因此，本次交易构成关联交易。

六、本次交易不构成重组上市

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03% 和 12.73% 股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77% 股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、四海君芯认购配套融资的 50% 测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24% 股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

因此，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司实际控制人不会发生变化，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

七、业绩承诺与补偿安排

上市公司与业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，主要内容如下：

（一）业绩承诺期

本次交易中，业绩承诺方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即 2019 年、2020 年和 2021 年。如监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，双方协商后签署补充协议予以确认。

（二）承诺净利润数及实际净利润数

业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元（以下简称“承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承诺净利润累计数”）。

如监管部门在审核中要求对业绩承诺期及承诺净利润数进行调整，由双方另行协商并签署补充协议。

在业绩承诺期内的每个年度单独披露北京矽成经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“实际净利润数”，业绩承诺期内各年度的实际净利润数合计称“实际净利润累计数”）及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。

为避免争议，双方理解并确认，本协议项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

双方同意，承诺净利润数和实际净利润数应考虑以下事项的影响：（1）Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；（2）北京矽成因实施股权激励所产生的费用；（3）北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；（4）配套募集资金投资项目损益。

（三）盈利补偿及其方案

业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，即视为未实现业绩承诺，则业绩承诺方承诺将根据本协议约定的条款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分，以股份、现金或股份与现金相结合的方式补偿。

补偿计算公式：

（1）业绩承诺期届满后，若北京矽成未实现业绩承诺，业绩承诺方中各方应补偿金额及应补偿股份数量的计算方式具体为：

应补偿金额=（承诺净利润累计数－实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×业绩承诺方中各方对应的交易对价

应补偿股份数量=（应补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

其中，“发行价格”为本次发行股份购买资产的发行价格；“业绩承诺方中各方对应的交易对价”为于本次交易项下向业绩承诺方支付的对价金额；依据上述公式计算应补偿股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

（2）业绩承诺方中各方以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，独立、非连带地履行补偿义务。

若业绩承诺方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且已就该等股份于业绩承诺期内自上市公司获得了现金股利，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量；若上市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按前述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。

其中，依据上述公式计算回购股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

（四）减值测试及补偿

业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请由双方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产（为本协议之目的，具体指北京矽成 100%股权，下同）进行减值测试，并出具专项审核意见。

经减值测试，如标的资产期末减值额>已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），业绩承诺方应对上市公司另行补偿。另需补偿的金额为：标的资产期末减值额－已补偿股份总数×发行价格－现金补偿金额。业绩承诺方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体业绩承诺方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。业绩承诺方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式且独立、非连带地履行补偿义务；另需补偿的股份数量为：（另需补偿的金额－另需现金补偿金额）÷发行价格。

其中，依据上述公式计算另需补偿的股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

“标的资产期末减值额”为本次交易项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

为免歧义，双方确认，业绩承诺方中各方在本协议项下的补偿总额以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，业绩承诺方中各方均独立、非连带地履行

补偿义务。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析

1、本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应及互补效应。报告期内，上市公司致力于在中国研制自主创新 CPU 技术和产品，基于自主 CPU 技术发展了面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的两条产品线，并且已形成可持续发展的梯队化产品布局。北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。在质量管控方面，北京矽成已基于产品研发、晶圆采购、封测代工、品质验证及售后服务各环节形成了整套经营模式及管控体系，上市公司在业务性质、内部流程上相类似，在质量管控方面可以进行有效对接，从而保持长期的稳健发展。在技术研发方面，上市公司可借鉴北京矽成多年的研发经验及团队实力，夯实其在芯片设计领域的综合研发能力，有利于更好地立足本土、着眼全球，开拓新兴的市场机会。在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。在客户及市场规模方面，本次交易完成后公司可充分利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源，增加彼此合作机会，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力。

2、本次交易对上市公司业务的影响

（1）本次交易对上市公司业务构成的影响

本次交易前，北京君正主营微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发与销售，本次交易标的公司北京矽成主营存储芯片、模拟芯片的研发与销售。

根据信永中和会计师出具的北京君正备考财务报表审阅报告，假设北京君正于 2018 年 1 月 1 日完成对北京矽成及上海承裕的合并，北京君正 2018 年、2019 年 1-5 月的主营业务收入构成及占比情况如下：

单位：万元

交易前				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
微处理器芯片	5,442.94	47.65%	14,482.46	58.16%
智能视频芯片	5,799.22	50.77%	9,948.55	39.95%
技术服务	119.19	1.04%	115.22	0.46%
其他	60.74	0.53%	354.47	1.42%
合计	11,422.08	100.00%	24,900.70	100.00%
交易后				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
存储芯片	105,537.40	82.49%	259,691.21	83.07%
模拟芯片	10,983.52	8.58%	28,033.20	8.97%
微处理器芯片	5,442.94	4.25%	14,482.46	4.63%
智能视频芯片	5,799.22	4.53%	9,948.55	3.18%
技术服务	119.19	0.09%	115.22	0.04%
其他	60.74	0.05%	354.47	0.11%
合计	127,943.00	100.00%	312,625.11	100.00%

本次交易完成后，北京君正将新增存储芯片和模拟芯片的研发和销售。由于北京矽成的芯片主要运用于汽车电子、工业制造、消费电子等领域，因此，本次交易既将丰富上市公司的产品类别，带动公司芯片设计整体技术水平的提升，又将为上市公司带来新领域的优质客户资源。

（2）本次交易对上市公司经营发展战略的影响

上市公司坚持“创新技术、自主研发”的技术战略和“开放平台、纵横扩展”

的市场战略。在技术上，公司将不断加强研发力度，持续进行技术创新，密切关注产业发展动向，及时布局产业的关键性核心技术，根据市场变化进行新产品的规划与研发。在市场上，充分发挥自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，积极寻找和拓展适合公司产品的市场领域，及时跟进新市场，抓住未来新兴产业机会，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

未来，公司将统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。上市公司业务具体发展规划如下：

①公司将持续加大研发投入，不断加强技术研发和技术创新能力，根据市场的需求情况持续进行相关核心技术的开发，适时展开新兴领域新技术的跟踪与研究工作，进行相应的产品设计、研发。

②公司将不断加强市场宣传与推广力度，深入挖掘各类市场的发展机会，结合公司产品优势与特点，在各个应用领域积极进行产品推广和客户拓展，及时跟进市场变动和客户产品的需求情况，根据市场需求情况对新产品进行规划和定义。

③公司将不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，努力提高公司研发工作效率、提高公司整体管理水平。

（3）本次交易对上市公司业务管理模式的影响

本次交易完成后，在维持上市公司现有管理模式、决策程序及发展规划不变的前提下，公司将以符合上市公司规范运作的相关要求对标的公司进行管理，完善北京矽成的公司治理。同时，上市公司在企业文化、团队管理、业务和技术以及财务与管理体系等方面进行整合，促使上市公司与标的公司在本次交易完成后快速实现内部整合，尽快实现彼此的协同效应，保证本次重组后上市公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

3、本次交易对上市公司的资产负债及财务安全性影响

（1）本次交易对上市公司的资产负债的影响

本次交易前，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资，其合计分别占报告期各期末总资产的 85.79%、85.34%和 85.78%；主要负债为应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、递延收益，其合计分别占报告期各期末总负债的 100.00%、100.00%、97.34%；报告期各期末，上市公司的资产负债率分别为 2.76%、4.68%、4.84%。

根据信永中和出具的北京君正备考财务报表审阅报告，本次交易完成后，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、无形资产和商誉，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总资产的 81.15%和 88.43%；主要负债为应付账款、其他应付款和递延所得税负债，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总负债的 88.51%和 88.89%；截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日，上市公司的资产负债率分别为 27.18%和 26.97%。

截至 2018 年 12 月 31 日，可比公司紫光国微、全志科技、国科微和兆易创新的平均资产负债率为 29.58%，中位数为 33.65%。由此可见，本次交易完成后，上市公司的资产负债率仍低于行业平均水平，长期偿债能力较强。

（2）本次交易对上市公司的财务安全性影响

根据备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司资产负债率低于行业平均水平，偿债能力较强；上市公司及标的公司不存在大额预计负债或或有负债，无短期借款、长期借款等有息债务，财务安全性较高。

同时，本次交易拟募集配套募集资金不超过 15 亿元，若能足额募集，则上市公司可利用部分募集配套资金优化上市公司的资本结构；若无法足额募集，则可能为支付现金对价及建设标的公司募投项目而新增负债，进而加大财务风险。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响分析

1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面对上市公司未来发展的影响

根据上市公司的发展规划，未来 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 仍将保持其作为独立的境外法人经营实体存续，并由其原核心管理团队继续经营管理，上市公司将在认真客观地分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文

化的基础上，完善各项管理流程，力争做到既能保持各自原有的竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。上市公司拟将采取以下措施：

（1）业务整合

本次交易完成后，上市公司将整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术、客户资源和销售渠道的共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与北京矽成相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强整体的盈利能力和持续竞争力。

（2）资产整合

本次交易完成后，标的公司将继续保持资产的独立性，上市公司将通过完善的管理机制和风控体系促进标的公司资产的优化配置，提高资产的使用效率。

（3）财务及管理体系整合

本次交易完成后上市公司取得北京矽成及上海承裕的控制权，上市公司将在保持标的公司独立运营、核心团队稳定的基础上将其纳入整体经营管理体系和财务管理体系，实现优势互补，提高上市公司整体的资金使用效率，实现内部资源的统一管理和优化配置。

（4）人员及机构整合

北京矽成下属经营实体拥有经验丰富的经营管理团队和成熟稳定的业务团队，上市公司将努力维持其原有经营管理团队和业务团队的稳定，为管理层保留较大程度的自主经营权，以使北京矽成经营管理团队的能力得到充分发挥。

2、交易当年和未来两年拟执行的发展计划

本次交易完成后，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力。

（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析

1、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据信永中和会计师出具的北京君正备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务指标比较如下：

项目	2019年5月31日 /2019年1-5月		2018年12月31日 /2018年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考)	本次交易前	本次交易后 (备考)
资产总额（万元）	124,785.26	920,630.99	119,798.02	909,860.44
归属于母公司股东权益 （万元）	118,743.58	671,083.71	114,192.69	661,321.91
营业收入（万元）	11,788.38	128,309.30	25,967.01	313,691.42
利润总额（万元）	3,200.68	10,063.41	1,381.76	10,108.61
归属母公司所有者的净利润 （万元）	3,183.71	8,766.68	1,351.54	8,506.51
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.1950	0.0674	0.1894

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、每股收益均将有所提升，上市公司财务状况、盈利能力得以增强。

2、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，其未来的资本性支出计划将纳入上市公司未来的年度计划、发展规划中统筹考虑。为实现顺利整合或业务的进一步发展，可能需要新增与标的公司相关的资本性支出，上市公司将按照《公司章程》履行必要的决策和信息披露程序。

3、本次交易职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及标的公司的职工安置方案。

4、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易成本主要包括与本次交易相关的税费以及聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构费用。本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，处于合理区间。

5、本次交易预计形成的商誉金额

本次交易系北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金方式购买北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，合计交易作价 720,031.86 万元。本次收购完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成归属于母公司可辨认净资产公允价值为 368,684.95 万元（不含北京矽成账面商誉，含北京矽成可辨认资产及负债公允价值增值部分），考虑递延所得税负债 8,203.23 万元的影响，本次重组交易之合并成本与对应享有北京矽成可辨认净资产公允价值并考虑递延所得税后之间的差额 359,550.13 万元，即为上市公司本次收购预计形成的商誉。

（四）本次交易对上市公司股权结构的影响分析

1、本次交易不会变更上市公司实际控制人

本次交易前，上市公司的总股本为 202,037,984 股（截至 2019 年 9 月 30 日上市公司总股本），刘强、李杰为公司控股股东和实际控制人。本次交易上市公司拟向交易对方发行 248,650,730 股股份，同时按照北京君正发行前总股本 20% 考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 491,096,310 股。本次交易完成前后公司的股权结构如下：

股东名称	交易前		交易后（不考虑募集配套资金）		交易后（考虑募集配套资金）	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘强	4,047.55	20.03	4,047.55	8.98	4,047.55	8.24
四海君芯	-	-	-	-	2,020.38	4.11
刘强及四海君芯持股小计	4,047.55	20.03	4,047.55	8.98	6,067.93	12.36
李杰	2,572.80	12.73	2,572.80	5.71	2,572.80	5.24
实际控制人小计	6,620.36	32.77	6,620.36	14.69	8,640.74	17.59
屹唐投资	-	-	6,055.67	13.44	6,055.67	12.33
武岳峰集电	-	-	6,054.43	13.43	6,054.43	12.33
上海集岑	-	-	5,383.59	11.95	5,383.59	10.96
华创芯原	-	-	2,305.50	5.12	2,305.50	4.69

股东名称	交易前		交易后（不考虑募集配套资金）		交易后（考虑募集配套资金）	
	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量 （万股）	持股比例 （%）
上海瑾矽	-	-	1,479.55	3.28	1,479.55	3.01
民和志威	-	-	1,257.72	2.79	1,257.72	2.56
闪胜创芯	-	-	1,213.36	2.69	1,213.36	2.47
Worldwide Memory	-	-	570.20	1.27	570.20	1.16
万丰投资	-	-	427.43	0.95	427.43	0.87
Asia Memory	-	-	66.42	0.15	66.42	0.14
厦门芯华	-	-	51.21	0.11	51.21	0.10
其他上市公司 股东	13,583.44	67.23	13,583.44	30.14	15,603.82	31.77
合计	20,203.80	100.00	45,068.87	100.00	49,109.63	100.00

注 1：以上测算以截至 2019 年 9 月 30 日上市公司的股权结构为依据。下同。

注 2：以上测算按照配套募集资金发行数量为发行前的 20%（4,040.76 万股）、四海君芯认购配套融资的 50%进行。

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03%和 12.73%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、四海君芯认购配套融资的 50%测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

2、交易对方无意谋求上市公司控制权

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方主要为财务性投资者，无意谋求上市公司控制权，其均出具了关于不谋求上市公司控制权的声明及承诺，具体承诺内容详见重大事项提示“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”。交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

3、实际控制人承诺不主动放弃控制权

为维护上市公司的控制权稳定，实际控制人刘强和李杰出具承诺（具体承诺

内容详见重大事项提示“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”), 将在本次交易完成后 60 个月内, 不主动放弃上市公司控制权, 也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权; 将积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利等, 努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力, 如有必要将不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份, 以维护上市公司控制权稳定。

4、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更, 刘强和李杰仍为上市公司实际控制人

(1) 本次交易前后, 刘强和李杰始终为上市公司持股比例最高的股东

本次交易前, 刘强和李杰两人作为一致行动人共同拥有公司的实际控制权, 两人合计持有北京君正 32.77%股份, 为北京君正的控股股东和实际控制人。

本次交易完成后, 不考虑配套融资情形, 刘强和李杰将持有、实际支配上市公司 14.69%股份; 考虑配套融资情形(按照北京君正发行前总股本 20%暨发行股份上限测算), 刘强和李杰将持有、实际支配上市公司 17.59%股份。

基于上述, 且根据《重组监管问答》有关规定, 本次交易完成后, 无论是否考虑配套融资情形, 上市公司实际控制人刘强和李杰持有、实际支配的股份均高于其他股东。

(2) 本次交易前后, 刘强和李杰始终对上市公司董事会及高管、重大事项决策及经营管理等有决定性影响

根据北京君正《公司章程》等上市公司内部规章制度、股东大会决议、董事会决议等文件资料, 以及北京君正、刘强、李杰及各交易对方出具的书面说明及确认, 本次交易前后, 刘强和李杰始终对上市公司董事会及高管、重大事项决策及经营管理等有决定性影响, 具体说明如下:

①刘强和李杰对上市公司董事会及高级管理人员有重大及实质性影响

A. 交易前刘强、李杰的影响情况

本次交易前, 北京君正董事会由 6 名董事组成, 非独立董事为刘强、李杰、张紧、冼永辉, 独立董事为王艳辉、梁云凤, 该等董事均由北京君正上一届董事

会提名。非独立董事中，刘强和李杰为北京君正控股股东、实际控制人，张紧、冼永辉为跟随刘强创办北京君正的核心人员，四人均自北京君正创立之初即担任董事或副经理职务，其中，刘强作为北京君正创始人，始终担任北京君正董事长。

本次交易前，北京君正设总经理 1 名、副总经理 7 名（包括董事会秘书 1 名，财务总监 1 名），其中，总经理、董事会秘书由董事会聘任，副总经理、财务总监经总经理提名，由董事会聘任。其中，刘强作为北京君正创始人，始终担任北京君正总经理，是北京君正最核心的管理、技术人员，全面负责北京君正日常的经营管理及技术研发，对北京君正的业务经营发挥着至关重要的作用。刘强作为总经理，可提名北京君正历任副总经理、财务负责人等高级管理人员。截至本报告书出具日，北京君正的高级管理人员为张紧、冼永辉、张敏（兼任董事会秘书）、周生雷、叶飞（兼任财务总监）、黄磊和刘将，其中，张紧、冼永辉自北京君正创立以来一直受聘任公司副总经理。

B. 交易相关方对于交易完成后北京君正治理情况的说明

交易对方、上市公司以及刘强、李杰已就交易完成后北京君正治理相关情况出具书面说明，主要内容如下：

本次交易完成后，1) 董事会构成方面，公司本届董事会成员拟由 6 名调整至 9 名（含 3 名独立董事），其中刘强提名 1 名增补独立董事，交易对方合计提名 2 名增补非独立董事，刘强和李杰担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3；

就公司下一届董事会，刘强和李杰拟提名 7 名董事，其中非独立董事不少于 4 名，全体交易对方合计提名 2 名董事，即刘强和李杰提名的董事人数超过董事会总人数的 2/3、提名的非独立董事人数达到董事会非独立董事总人数的 2/3，且公司董事长仍由刘强担任。

2) 高级管理人员提名及聘任方面，现行《公司章程》中关于高级管理人员提名、聘任、解聘的相关规定保持不变，且北京君正总经理仍由刘强担任，刘强有权根据实际经营需要提名公司副总经理、财务总监等高级管理人员。

C. 交易完成后刘强、李杰的影响情况

基于上述，本次交易完成后，上市公司董事会成员将新增交易对方提名人员，

刘强和李杰担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3，其中刘强仍任公司董事长，能够对北京君正董事会一般及重大事项表决、日常经营管理活动形成控制及决定性影响；此外，刘强仍兼任公司总经理，可提名除董事会秘书以外的全部高级管理人员，公司董事会决定高级管理人员的聘任和解聘，因此，刘强和李杰对北京君正高级管理人员的提名及任免也具有重大及实质性影响。

②刘强和李杰对上市公司重大事项决策有重大及实质性影响

本次交易前，北京君正已根据相关法律法规的要求依法建立股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等内部规章制度，形成了较为规范的公司运作体系，并严格按照上市规则和内部规章及治理制度进行重大事项审议和决策。

本次交易完成后，北京君正仍将保持及沿用现行的公司治理体系及规章制度。如前所述，本次交易完成后，在股东大会层面，刘强和李杰持有、实际支配的公司股份表决权比例最高，仍为北京君正控股股东、实际控制人；在董事会层面，担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3，且刘强仍担任董事长；在高级管理人员层面，刘强仍担任公司总经理，有权提名除董事会秘书以外的全部高级管理人员。

因此，本次交易完成后，刘强和李杰将继续保持对上市公司重大事项决策的重大及实质性影响。

③刘强和李杰对上市公司经营和财务管理机制有重大及实质性影响

A. 经营机制

本次交易前，北京君正已根据业务运作的需要设置了相应的内部职能部门，包括董事会办公室、审计部、财务部、商务部、公共关系部、人力资源部、行政部、专利办公室、供应链管理部和 IT 部等，各职能部门职责明确，相互分工协作，相关职能部门向分管的公司高级管理人员汇报工作，高级管理人员向董事会汇报工作。

本次交易完成后，北京矽成将成为北京君正的全资子公司，北京君正主要通过行使股东权利、参与北京矽成董事会及监事会等方式对其行使管理、协调、监

督及考核。北京君正将结合北京矽成的组织架构、境内外业务及经营特点等，在给予现有管理团队一定独立运营权基础上，对原有管理制度进行适当地调整，并纳入北京君正整体经营管理机制。同时，北京君正还将充分利用 A 股上市平台优势、规范的管理经验及对国内市场环境的深入了解支持北京矽成业务发展，充分发挥现有管理团队的经营管理水平，继续保障各项主营业务持续稳定发展，加大国内市场的拓展，提升经营业绩，实现北京君正股东利益最大化的经营目标。

B. 财务管理机制

本次交易前，北京君正已根据相关法律法规的要求配备了专业的财务人员，并建立了符合有关会计制度要求的财务核算体系和财务管理制度。本次交易完成后，北京君正将对北京矽成的财务制度体系、会计核算体系等实行统一管理和监控，对其日常财务活动等重大事件进行监督控制；通过财务整合，将北京矽成纳入公司财务管理体系，确保符合上市公司要求。

因此，本次交易完成后，北京君正现行重大事项决策机制及经营和财务管理机制保持不变，并将北京矽成纳入公司管理体系；在此基础上，公司治理制度及生产经营活动保持延续及稳定，刘强和李杰继续保持对上市公司日常管理和业务运营的重大及实质性影响。

（3）本次交易后，屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑不拥有控制权

如前所述，本次交易完成后（考虑配套融资情形），除刘强和李杰外，上市公司持股 5%以上股东为屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑，结合其股东身份和属性、对董事和高管人员任免的影响等客观情况，上述各方不拥有上市公司控制权，具体说明如下：

①作为专业投资机构主观上无控制上市公司的意图或动机

根据屹唐投资的书面说明，屹唐投资为北京亦庄国际投资发展有限公司（北京经济技术开发区国有投资公司）下属集成电路和半导体行业的专业投资机构、且为私有化 ISSI 之目的设立的特殊目的实体，其设立及运营的宗旨及目的为响应国家发展集成电路和半导体行业的号召，开展特定领域与行业的战略投资及海外并购活动，促进产业发展。

根据武岳峰集电、上海集岑的书面说明，武岳峰集电为自然人武平、潘建岳

及 Bernard Anthony Xavier 控制的实体担任普通合伙人及管理人、专业投资集成电路和半导体行业的私募基金，已经基金业协会备案；上海集岑为自然人张赛美、何君琦、戴思元控制的实体担任普通合伙人及管理人、与思源电气、双创系基金等共同设立，主要投资汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业的私募基金，已经基金业协会备案。作为私募基金和专业投资机构，武岳峰集电、上海集岑设立及运营的宗旨及目的为管理与运作合伙人资金进行半导体等特定行业的财务投资，以最大化投资收益。

因此，基于股东属性、设立及运营宗旨及目的等，屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑投资北京矽成并参与本次交易，实质属于财务投资行为，以获取投资收益为目的，不存在谋求上市公司控制权的主观意图和动机，同时其亦明确承诺尊重刘强和李杰的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

②客观上对股东大会和董事会决策、高管任免等不具有重大及决定性影响，对上市公司无实际控制力

如前所述，本次交易完成后，在股东大会层面，刘强和李杰持有、实际支配的上市公司股份比例最高，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑均无法单独对股东大会重大事项决策产生重大及实质性影响；在公司董事会层面，全体交易对方向上市公司提名 2 名董事，无法对董事会一般及重大事项决策产生实质性影响，同时也无法决定上市公司高级管理人员的聘任或解聘。

因此，本次交易完成后，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑对上市公司股东大会和董事会一般及重大事项决策、高管任免等不具有重大及决定性影响，客观上无法对上市公司进行实际控制。

（4）本次交易后，成为上市公司股东的相关交易对方不存在一致行动关系

尽管交易对方之间存在关联方担保及反担保、共同投资、关联方间接参股/出资等经济利益关系，但基于私有化收购整体融资安排、北京矽成业务发展及引进战略投资者、员工持股平台、私募基金/专项投融资平台等客观因素，并结合交易对方出具的相关说明及承诺，相关交易对方¹之间不构成一致行动关系。

¹ 武岳峰集电与承裕投资存在股权控制关系。本次交易项下，交易对方中承裕投资和北京青禾

此外，各交易对方于 2019 年 7 月分别作出承诺：“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。”

因此，相关交易对方之间存在的共同投资、关联方出资、关联方担保及反担保、穿透后部分最终出资人相同、间接持股等关系并不会导致相关交易对方之间构成一致行动关系；各交易对方已分别作出书面说明，确认未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排，亦承诺不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。因此，交易对方彼此之间不存在其他一致行动关系。

基于上述，本次交易前后，（1）刘强和李杰始终为上市公司持股比例最高的股东；（2）刘强和李杰始终能对上市公司董事会、经营管理层有重大及决定性影响，始终保持对上市公司重大事项决策、日常经营和财务管理有重大及决定性影响；（3）屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑无论在主观意图或客观上均不会对上市公司进行控制，且交易对方之间不存在一致行动关系，不存在共同控制上市公司的主观意愿或客观基础。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，刘强和李杰仍为上市公司实际控制人。

5、相关方保持上市公司控制权稳定性的具体措施

（1）刘强和李杰保持上市公司控制权的具体措施

①刘强和李杰的资信状况

根据刘强和李杰提供的股份登记凭证、不动产登记证明、其他股权投资凭证、相关被投资公司的财务报表、《个人信用报告》等文件资料及书面说明：截至本报告书出具日，刘强和李杰个人资信状况良好，不存在重大逾期负债；刘强和李

仅获得现金对价，在本次交易完成后不持有上市公司股份，因此，在论证及认定上市公司股东/投资者是否构成一致行动人情境下，“交易对方”不包括承裕投资和北京青禾。

杰分别持有北京君正 4,047.55 万股和 2,572.80 万股股票,对应市值分别约为 22.37 亿元及 14.22 亿元;除持有北京君正股票外,李杰持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京华如科技股份有限公司 22.84%股份,该公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的总资产为 44,086.83 万元,净资产为 37,759.52 万元,营业收入为 24,566.69 万元,净利润为 5,646.33 万元。

此外,刘强和李杰还持有部分银行存款、其他对外权益投资、不动产等资产,同时作为上市公司的控股股东、实际控制人,刘强和李杰资信状况良好,可通过借款或其他法律法规允许的方式筹集资金。

②刘强和李杰关于维持上市公司控制权稳定的承诺

刘强和李杰于 2019 年 7 月出具《关于维持上市公司控制权稳定的承诺》:“本承诺人作为上市公司的实际控制人,为本次重组之目的,现就维持上市公司控制权稳定作出声明、确认与承诺如下:1.本次交易完成后 60 个月内,本承诺人不会主动放弃上市公司控制权,也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。2.本次交易完成后 60 个月内,本承诺人不会主动辞任上市公司董事、高级管理人员的职务(如有)。3.本次交易完成后 60 个月内,根据资本市场情况与实际需要,本承诺人不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份,以维护上市公司控制权稳定。4.本次交易完成后,上市公司董事会成员由六名调整至九名,本承诺人向上市公司提名的董事人数合计不少于四名。5.本承诺人将严格履行股份锁定义务,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定及监管要求,结合已作出的公开承诺,安排及规范股份减持行为,并及时履行信息披露义务。6.本承诺人将根据相关法律法规及公司章程,积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利,不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利,努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力。7.本承诺函自作出之日起生效且不可撤销,生效后即构成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺,承诺人愿意承担相应的法律责任。”

③四海君芯参与本次配套融资的确定性

本次交易中，上市公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。

上市公司与刘强于 2019 年 5 月签署《股份认购协议》，上市公司与四海君芯于 2019 年 7 月签署《股份认购协议之补充协议》，该等协议就四海君芯参与认购本次配套融资相关事宜进行明确约定，包括相关方违反协议应承担的违约责任。

2019 年 8 月，刘强、四海君芯进一步出具《关于参与认购本次配套融资的承诺函》，四海君芯承诺参与本次配套融资，认购配套融资金额不低于本次配套融资总额的 50%，将根据本次配套融资相关安排，按期、足额认购本次配套融资相应股份，于上市公司向认购方发出《缴款通知书》前，通过自有及/或自筹（包括但不限于通过借款或其他法律法规允许的方式筹集）方式，将认购本次配套融资所需的资金准备到位。

一方面，如前所述，刘强作为北京君正的控股股东、实际控制人之一，整体信用资质良好，可通过借款或其他法律法规允许的方式筹集所需资金用于四海君芯认购本次重组配套募集资金。刘强拥有 20 年集成电路和信息技术行业经验，联合创立北京君正后一直担任公司董事长、总经理职务，带领北京君正进行国产创新 CPU 技术和嵌入式处理器芯片的研制与产业化，较为深厚的行业背景及资源将进一步增强其融资能力。而由于本次重组属于集成电路领域的同行业收购，既顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业的行业背景，又能优化上市公司未来的业务结构、发挥协同效应，因此，资本市场及相关机构对本次重组给予较大期望，有利于刘强在必要时筹措所需资金。

另一方面，四海君芯拟引入第三方投资者，进一步增强认购配套融资的确定性。2019 年 9 月，四海君芯及其股东青岛君品、冼永辉与北京中关村科学城创新发展有限公司、北京汇诚兴海科技中心（有限合伙）签署《股权转让及投资协议》，中关村科学城和汇诚兴海下设科学城基金，并通过科学城基金受让青岛君品、冼永辉分别持有的四海君芯 45.67%、3.33% 的股权。该等股权转让完成后，青岛君品将持有四海君芯 51% 股权，科学城基金将持有四海君芯 49% 股权。北京中关村科学城创新发展有限公司的股东为北京市海淀区国有资本经营管理中心，国资股东的支持增强了四海君芯认购配套融资的确定性。同时，刘强及四海

君芯出具了《关于北京四海君芯有限公司引入投资人的声明》，四海君芯拟引入第三方投资者，该等引资完成后，青岛君品投资合伙企业（有限合伙）持有四海君芯的股权比例将不低于 51%，仍为四海君芯的控股股东，刘强仍为四海君芯的实际控制人。

此外，截至本报告书出具日，招商银行北京分行已向四海君芯出具了贷款意向书，同意为四海君芯认购本次重组配套募集资金提供不超过 8 亿元的贷款额度意向，进一步增强了四海君芯认购本次重组配套募集资金的确定性。

基于上述，刘强及四海君芯已就参与本次配套融资相关事宜与上市公司签署书面协议，并出具书面承诺，确认将根据本次配套融资相关安排，按期、足额认购本次配套融资相应股份，并承诺于上市公司向认购方发出《缴款通知书》前将认购本次配套融资所需的资金准备到位；刘强个人资信状况良好，同时四海君芯拟引入第三方投资者，能够保证四海君芯按期、足额认购本次配套融资相关金额。因此，四海君芯参与本次配套融资具有确定性。

（2）交易对方保持上市公司控制权的承诺

根据全体交易对方于 2019 年 7 月出具的《关于不构成一致行动关系及不谋求上市公司控制权的声明及承诺函》：

“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。

2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。

3.本次交易完成后，交易对方将不会联合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事会、监事会成员等改变上市公司董事会、监事会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员组成结构产生实质性影响。交易对方进一步确认，

本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总数的四分之一，但不得低于两名。

4.交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

5.如违反上述承诺，上市公司有权要求承诺人根据上述承诺予以改正，承诺人拒绝改正的，上市公司有权拒绝承诺人的相应要求。”

基于上述，刘强和李杰及交易对方已就维持上市公司控制权稳定的具体措施做出相关承诺；刘强和李杰资信状况良好，能够保证其维持上市公司控制权稳定相关承诺措施的实施。

（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响分析

本次交易前，上市公司主要经营嵌入式 CPU 芯片业务，本次交易后，随着上市公司取得北京矽成的控制权，上市公司可通过北京矽成将业务拓展至高端存储芯片业务。截至本报告书出具日，刘强、李杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未经营与上市公司和北京矽成主营业务相同或类似的业务，避免与上市公司及北京矽成构成同业竞争。

此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保持上市公司独立性，保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（六）本次交易对上市公司关联交易的影响分析

本次交易/本次收购完成后，发行股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。

上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

因此，本次交易构成关联交易。

为规范和减少上市公司的关联交易，上市公司控股股东和实际控制人刘强、李杰，以及交易对方中的屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

（七）本次交易对上市公司治理结构和独立性的影响分析

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易完成后，上市公司实际控制人的持股比例有所下降，但对公司实际控制人的控制权及现有的公司治理结构不会产生重大不利影响。

本次交易完成后，公司各项经营活动（包括但不限于采购、销售、技术、商标等）对控股股东、实际控制人以及其他第三方不存在重大依赖。

（八）拟支付现金对价对上市公司后续生产经营和财务状况的影响

本次交易的现金对价为 161,562.30 万元，其中以北京君正 IPO 时的结余募集资金（含超募及利息）合计 45,613.30 万元进行支付部分现金对价外，剩余现金对价 115,949 万元拟使用本次交易的募集配套资金支付。

1、上市公司偿债能力

截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，北京君正主要偿债指标情况如下：

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率	4.24%	4.68%	2.76%
流动比率	50.17	39.45	49.63
速动比率	45.76	36.00	43.51

截至 2019 年 6 月末，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务；2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，北京君正的资产负债率均保持较低水平，分别为 2.76%、4.68%和 4.24%，偿债

压力较小；流动比率、速动比率均维持较高水平，截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月，流动比率分别为 49.63、39.45 和 50.17，速动比率分别为 43.51、36.00 和 45.76，短期偿债能力较强。同时，本次交易现金对价的支付预计不会采用银行借款的方式筹措资金。综合而言，北京君正的偿债能力较强，财务风险较小。

2、上市公司筹资能力

除通过资本市场进行股权融资外，北京君正的其他主要融资渠道为银行借款。截至本报告书出具日，北京君正及其子公司在国内主要合作商业银行获得的银行授信总额为 7,000 万元，且尚未使用该授信额度。同时，招商银行北京分行向北京君正出具了贷款意向书，同意为本次重组项目提供不超过 9.6 亿元的贷款额度意向。此外，如前所述，截至 2019 年 6 月末，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务，偿债能力较强，存在较大的债务融资空间。

综上所述，北京君正具备较强的筹资能力。

3、利息费用支出

截至 2019 年 6 月 30 日，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务，无利息费用。本次交易的现金对价除以前次 IPO 结余募集资金（含超募及利息）支付外，剩余现金对价将以募集配套资金筹集，将不会新增借款等情形，亦不会产生利息费用，不会新增财务性支出。

4、营运资本预算计划

2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月，北京君正分别实现营业收入 18,446.70 万元、25,967.01 万元和 14,397.96 万元，经营活动产生的现净流量净额分别为 -3,069.40 万元、3,637.07 万元和 2,189.90 万元，整体收入水平和现金流水平呈现上升趋势。根据上市公司的业务经营特点，公司自有资金的储备预计可满足日常经营的营运资金需求；同时，在不考虑本次收购的情况下，伴随着公司智能视频芯片和微处理器芯片业务的发展，未来公司的收入水平和盈利能力有望持续增长，公司的资金储备也将不断增加。此外，公司的应收账款回款情况较好，坏账率较低，2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末的坏账准备分别仅为 55.71 元、

167.14 元、0.00 元，应收账款周转率分别为 12.72、14.60 和 15.56（2019 年 6 月末的应收账款周转率为年化数值），应收账款周转率较高且保持增长。此外，除本次收购事项外，公司未来暂无进行大规模资产并购的资本支出计划。因此，公司未来的营业收入和持续良好的现金流能为日常营运提供较为充足的资金来源。

5、生产经营计划

根据公司业务发展需求及战略规划，除日常业务经营事项外，未来公司将继续推进全资子公司合肥君正研发基地二期的建设工作，公司使用前次 IPO 的超募资金 9,500 万元向合肥君正增资的事项已获得第三届董事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，上述增资款也已向合肥君正完成划款。因此，本次现金对价的支付不会对未来的生产经营计划产生重大不利影响。

6、利润分配政策

根据北京君正《公司章程》的相关规定，在当年盈利的前提下，每年度至少进行一次利润分配；在满足现金分红条件的情况下，每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 5%，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。公司现金分红的条件如下：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司当年可不进行现金分红；（5）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

最近三年，北京君正按照《公司章程》规定的利润分配政策进行分红。本次收购完成后，北京君正亦将结合公司实际情况和发展目标，严格按照《公司章程》的规定进行利润分配。因此，本次现金对价的支付预计不会对未来利润分配产生重大不利影响。

综上所述，本次现金支付对价预计不会对上市公司未来生产经营和财务状况产生重大不利影响。

九、本次交易完成后公司仍符合上市条件

本次交易完成后，预计公司总股本将超过 4 亿股，社会公众股东股份比例不低于 10%，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件。本次交易完成后，公司依然满足《公司法》、《证券法》及《创业板上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

十、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的审批程序

1、上市公司及合肥君正决策过程

2018 年 11 月 9 日，上市公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2018 年 11 月 9 日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组事宜。

2019 年 5 月 16 日，上市公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整的相关议案。

2019 年 5 月 16 日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组方案调整的事宜。

2019 年 7 月 31 日，上市公司召开第四届董事会第七次会议审议了本次重大资产重组方案的相关议案，相关董事回避表决相关议案后，剩余非关联董事人数不足 3 人，根据北京君正《公司章程》的规定，相关议案直接提交公司股东大会审议。

2019 年 7 月 31 日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组事宜。

2019 年 9 月 9 日，上市公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2、标的企业决策过程

本次交易的方案已经北京矽成、上海承裕内部权力机构审议通过。

3、交易对方决策过程

本次交易的方案已经全部交易对方的内部权力机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及《购买资产协议》，截至本报告书出具日，本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、中国证监会核准本次交易事项；
- 2、其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。

根据《购买资产协议》《股份认购协议》及本次交易方案，并结合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规，截至本报告书出具日，本次交易的生效除尚需取得中国证监会的核准外，不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。

（三）其他程序

1、CFIUS 及台湾投审会审查进展情况

根据境外律师就 CFIUS 及台湾投审会审查事宜出具的备忘录，本次交易不属于提交强制性 CFIUS 申报的交易、不属于适用法律明确规定应向台湾投审会提出事前申报的交易，即 CFIUS 及台湾投审会审查不属于本次交易的生效条件。为降低本次交易的不确定性，经交易各方协商，北京君正和北京矽成已就本次交易向 CFIUS、台湾投审会提交自愿性申报及审查。

根据 CFIUS 出具的案件审结函（Closing Letter）、台湾投审会出具的收文印章以及境外律师出具的备忘录：

CFIUS 已于 2019 年 10 月 23 日完成对本次交易的安全审查（action with respect to this transaction is concluded），确认不存在尚未解决的国家安全担忧（there are no unresolved national security concerns）；

台湾投审会已于 2019 年 10 月 18 日正式受理 ISSI 及 ISSI Cayman 提交的有关 ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司上层陆资股东架构变动申请，截至本报告书出具日，台湾投审会审查正在进展过程中；台湾投审会陆资案件审查视个

案复杂度通常需时 3 至 6 个月。

本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

2、台湾投审会审查不存在可合理预见的实质性障碍

（1）私有化收购 ISSI 时已取得台湾投审会的批准

2015 年，北京矽成完成私有化收购 ISSI 交易，私有化收购涉及的 ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司上层股东变动事项已取得台湾投审会的批准。根据台湾投审会出具的核准函，ISSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司被准予经营电子材料批发及零售业务。

根据北京矽成出具的书面说明及确认：“自私有化收购完成后，ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司均在台湾投审会核准的业务经营范围开展经营活动，未开展或从事核准函准予业务之外的经营活动，符合陆资投资的有关规定及要求。同时，结合本次交易已通过 CFIUS 安全审查等客观事实，北京矽成合理预计，本次交易通过台湾投审会审查不存在可合理预见的实质性障碍。”

同时，根据境外律师出具的备忘录：“台湾投审会审批的目的与事项主要着重被投资公司（如台湾矽成）是否属于陆资正面表列之项目，亦会对于投资方背景及被投资公司未来营运计划进行相关了解。……由于本件卖方亦为陆资，鉴于前次私有化收购时已通过台湾投审会审查，且假设投资方在本交易案完成后，并无实质性改变台湾矽成业务范围及营业项目之计划，在台湾地区相关政策不发生重大调整的情况下，本交易案通过台湾投审会审查应不存在可合理预见的实质性障碍，除非台湾投审会对于新陆资投资人即投资方北京君正集成电路股份有限公司之身份（如股东结构是否有大陆官方机构、基金及其投资比例）有任何疑虑。”

（2）台湾地区经营主体的业务定位

北京矽成在台湾地区的主要经营主体包括 ISSI Cayman 台湾分公司及 ICSI TW。其中，ISSI Cayman 台湾分公司主要负责组织和实施北京矽成在台湾地区进行的相关采购、整理、暂存和运输等业务，不存在研发业务及对外销售。具体而言，ISSI Cayman 台湾分公司委托相应的供应商提供原材料、加工原材料或者加工半成品，然后将相应的原材料和半成品暂存，之后将其销售给北京矽成在开

曼的子公司。ICSI TW 主要负责为 ISSI Cayman 台湾分公司提供人力资源，以便 ISSI Cayman 台湾分公司实施上述业务，同时 ICSI TW 也负责 ISSI 的芯片在台湾地区的销售及客户服务。北京矽成台湾经营主体的上述业务属于台湾投审会核准函准予经营的业务。

（3）台湾地区经营主体的主要经营情况

报告期内，上述北京矽成在台湾地区经营主体合计的资产规模、采购规模、销售规模、员工人数及所占北京矽成比例情况如下：

单位：万美元、人

项目	2019 年 1-5 月/2019.5.31		2018 年/2018.12.31		2017 年/2017.12.31	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
总资产	25,072.80	26.27%	24,606.02	25.87%	25,995.22	28.31%
净资产	19,165.55	22.46%	18,736.34	22.11%	20,718.68	25.31%
销售金额	1,699.85	9.85%	4,863.25	11.21%	4,080.06	10.95%
采购金额	15,543.10	85.90%	37,499.77	84.01%	28,909.54	79.08%
员工人数	140	27.03%	137	27.08%	141	33.25%

由上表可知，北京矽成下属位于台湾的 ISSI Cayman 台湾分公司及 ICSI TW 主要职能为采购、整理、暂存、运输及部分销售服务，主要系北京矽成考虑晶圆代工等供应商主要分布在台湾、为方便业务沟通协调所致，人员、资产系根据采购及销售服务业务进行配置，涉及的对外销售占比较小。

（4）未通过台湾投审会审查对本次交易的影响

根据境外律师出具的备忘录：“投审会对陆资投资设有正面表列，该正面表列规定了陆资投资的业务范围，包括批发、零售等。倘投审会对案件有疑虑，通常会要求申请人提供更多信息或到会说明，亦有可能要求申请人签署相关承诺书或声明书，或者最终作成附条件之核准。就某些较为复杂之案件，投审会亦有可能与申请人讨论投审会能接受之方案，比如对申请人在台湾地区的投资方式和业务范围进行调整和变更，以继续其在台湾地区的投资和业务活动。若投审会认为相关补充信息、说明或承诺、声明不适当，则其有权暂停或者否决交易；若投审会做出暂停或者否决交易的决定，则可能导致申请人须暂定或终止在台湾地区的投资和业务活动。”

根据北京君正及北京矽成于 2019 年 10 月出具书面说明及承诺：“若台湾投审会在审查本次交易过程中提出相关要求，北京君正及北京矽成将尽最大努力予以配合，包括但不限于补充提供文件资料、回复问题、签署必要文件、作出相关承诺或说明以及采取认可的相关业务调整措施等，尽力促使本次交易通过台湾投审会审查。”

此外，根据北京君正的书面说明，若本次交易未通过台湾投审会审核，上市公司将及时进行相关业务布局调整，鉴于 ISSI 在台湾的业务主要为采购和市场销售，相关调整预计不会对本次交易完成后上市公司及 ISSI 的业务经营造成重大不利影响。

综上所述，本次交易的生效除需取得中国证监会的核准外，不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。截至本报告书出具日，CFIUS 审查已经完成，台湾投审会审查正在进展过程中，结合境外律师出具的备忘录，该等审查应不存在可合理预见的实质性障碍；北京君正及北京矽成已承诺尽最大努力配合，尽力促使本次交易通过台湾投审会审查。但如果发生极端情况，本次交易最终未通过台湾投审会审核，可能会影响北京矽成在台湾地区的业务经营活动，公司和北京矽成已确认将根据相关要求采取适用和可行措施对业务进行调整，前述调整不会对本次交易构成重大不利影响。

十一、本次交易相关方作出的重要承诺

本次重组相关方作出的重要承诺如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容
关于信息真实、准确和完整的承诺	交易标的	北京矽成：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因

承诺事项	承诺方	承诺内容
		提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。 上海承裕：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。
	交易对方	屹唐投资：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		华创芯原：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 上海瑾砂：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 民和志威：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 闪胜创芯：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人

承诺事项	承诺方	承诺内容
		已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 WM: 1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代

承诺事项	承诺方	承诺内容
		本承诺人向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 AM: 1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 厦门芯华: 1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容
		承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 武岳峰集电：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容
		人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 上海集岑：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 北京青禾：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、

承诺事项	承诺方	承诺内容
		误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 万丰投资：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 承裕投资：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和

承诺事项	承诺方	承诺内容
		文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 4. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
	上市公司及董事、监事、高级管理人员	上市公司：1. 本承诺人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2. 本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 3. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。 上市公司董事、监事、高级管理人员：1. 本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面

承诺事项	承诺方	承诺内容
		材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 2. 在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证本次重组信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。 3. 本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于合法、合规及诚信的声明及承诺	上市公司及董事、监事、高级管理人员	上市公司：1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。 3.截至本函出具日，本承诺人不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得发行证券的情形。 上市公司董事、监事、高级管理人员：1.本承诺人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。 2.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 3.截至本函出具日，本承诺人最近3年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；最近3年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴责。 4.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌与任何重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在因与任何重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

承诺事项	承诺方	承诺内容
		的暂行规定》第十三条规定中不得参与上市公司重大资产重组情形。 5.本承诺人承诺，自上市公司本次重组首次董事会召开之日起至本次重组实施完毕或终止期间，暂不存在减持上市公司股份的计划。
关于本次重组有关事项的声明及承诺函	交易标的	北京矽成：1.本企业为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及章程规定需予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。 2.本企业全体股东的认缴出资额均已实缴到位；本企业股东的历次股权变动均已履行或正在履行相应的程序；本企业的现有股东及持股比例均合法有效。 3.本企业股东合法持有本企业股权，不存在出资不实、虚假出资或抽逃出资的情形；该等股权不存在纠纷或潜在纠纷，除北京华创芯原科技有限公司将其持有的相应股权质押予北京亦庄国际投资发展有限公司外，不存在其他质押、查封、冻结及其他任何限制性权利或任何权利负担导致限制转让的情形，亦不存在与权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 4.本企业及下属企业（合并报表范围内企业，下同）自设立起至今均守法经营，在登记或核准（如有）的经营范围内开展业务活动，不存在违反法律、法规从事经营活动的情况。 5.本企业及下属企业拥有的自有土地/自有土地使用权和房屋/房屋所有权权属清晰、使用的租赁土地和房屋均已与出租人签署相关租赁协议，本公司及子公司可以合法占有及使用相关物业资产，不存在重大产权纠纷或潜在纠纷。 6.本企业及下属企业的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押等强制性措施的情形，本企业使用生产经营性资产不存在法律障碍。 7.本企业及下属企业近三年不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权利等原因而产生的侵权之债。 8.本企业会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税款。 9.本企业及下属企业近三年不存在因违反工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。 10.本企业及下属企业不存在尚未了结或可预见的、足以影响企业存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案件。 11.除已向上市公司披露的情形外，本企业及下属企业不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在对外担保或为关联方提供担保的情形。 12.本企业有效存续并正常、持续运营，不存在任何第三方向法院或者政府主管部门申请破产、清算、解散、接管或者其他足以导致本企业终止或者丧失经营能力的情形。 13.本承诺人及子公司不存在可能对本次重组产生影响的相关投资协议。本承诺人及子公司不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。 上海承裕：1.本企业为依法设立并有效存续的有限合伙企业，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及合伙协议规定需予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。 2.本企业全体合伙人的认缴出资额均已实缴到位；本企业合伙人的历次财产份额变动均已履行或正在履行相应的程序；本企业的现有合伙人及财产份额比例均合法有效。 3.本企业合伙人合法持有本企业财产份额，不存在任何形式的委托持

承诺事项	承诺方	承诺内容
		股、信托持股、收益权安排、代持等情形，不存在出资不实、虚假出资或抽逃出资的情形；该等财产份额不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结及其他任何限制性权利或任何权利负担导致限制转让的情形，亦不存在与权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 4.本企业及下属企业（合并报表范围内企业，下同）自设立起至今除持有北京矽成半导体有限公司股权及上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）财产份额外，未开展实际经营活动，不存在违反法律、法规从事经营活动的情况。 5.本企业及下属企业无自有土地使用权和房屋所有权，所有办公及经营场所均通过租赁方式使用。本企业及下属企业已与出租人签署相关租赁协议，可以合法占有及使用该等租赁房屋，不存在任何现时或可预见的限制或障碍。 6.本企业及下属企业的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押等强制性措施的情形，本企业使用生产经营性资产不存在法律障碍。 7.本企业及下属企业近三年不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全和人身权利等原因而产生的侵权之债。 8.本企业会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税款。 9.本企业及下属企业近三年不存在因违反工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。 10.本企业及下属企业不存在尚未了结或可预见的、足以影响企业存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案件。 11.本企业及下属企业不存在资金被合伙人及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在对外担保或为关联方提供担保的情形。 12.本企业有效存续并正常、持续运营，不存在任何第三方向法院或者政府主管部门申请破产、清算、解散、接管或者其他足以导致本企业终止或者丧失经营能力的情形。 13.本承诺人已履行北京矽成章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响北京矽成合法存续的情况。 14.本承诺人依法拥有所持北京矽成相应股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持北京矽成相应股权权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 15.本承诺人真实持有北京矽成相应股权，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持北京矽成相应股权行使表决权的协议或类似安排。 16.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让北京矽成相应股权，从而获取北京矽成相应股权或对应的利润分配权的情形。 17.本承诺人用于认缴北京矽成出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		18.本承诺人将尽最大努力保持北京矽成股权结构的完整性，促使北京矽成不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使北京矽成现有相关负责人和主要员工继续为北京矽成提供服务，并保持北京矽成同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保北京矽成的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 19.本承诺人未享有与北京矽成相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等。 20.本承诺人不存在可能对本次重组产生影响的相关投资协议。本承诺人不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。
	交易对方	屹唐投资：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 华创芯原：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保北京矽成的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 上海瑾砂：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 除本承诺人上层出资人存在渤海国际信托股份有限公司（代表其受托管理的单一资金信托计划）外，本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持本承诺人对标的企业出资的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不

承诺事项	承诺方	承诺内容
		限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 民和志威： 1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 闪胜创芯： 1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、

承诺事项	承诺方	承诺内容
		规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人员和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 WM: 1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及章程性文件需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的

承诺事项	承诺方	承诺内容
		企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）的出资架构中均不存在委托持股、资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业出资结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 AM: 1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及章程性文件需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）的出资架构中均不

承诺事项	承诺方	承诺内容
		存在委托持股、资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业出资结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人员和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 厦门芯华：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，用于认缴标北京矽成出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营

承诺事项	承诺方	承诺内容
		本承诺人将尽最大努力保持标的企业股权结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于股东特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 武岳峰集电：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 除本承诺人上层出资人存在德邦创新资本·上海集成电路信息产业专项资产管理计划外，本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持本承诺人对标的企业出资的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利

承诺事项	承诺方	承诺内容
		润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐其他董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 上海集岑：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 除本承诺人上层出资人存在上银瑞金资本管理有限公司-上银瑞金上海银行 2 号专项资产管理计划、博时资本管理有限公司-博时上海永宣新经济专项资产管理计划和博时上海永宣新经济二期专项资产管理计划外，本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持本承诺人对标的企业出资的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要

承诺事项	承诺方	承诺内容
		员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐其他董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人未享有与标的企业相关的特殊权利（如有），包括股权回购请求权、优先认购权、随售权等对本次重组具有影响的权利。 北京青禾：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业出资结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上

承诺事项	承诺方	承诺内容
		股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐其他董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近5年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 万丰投资：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业出资结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐其他董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。 承裕投资：1.关于主体资格 本承诺人为依法设立并有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。 2.关于标的企业出资及资金来源 本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，用于认缴标的企业出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。 除本承诺人上层出资人存在德邦创新资本·上海集成电路信息产业专项资产管理计划外，本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在资产管理计划、信托计划、契约型基金或其他具有杠杆融资性质的结构化产品等安排。 3.关于标的企业业务经营 本承诺人将尽最大努力保持标的企业出资结构的完整性，促使标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的企业现有相关负责人和主要员工继续为标的企业提供服务，并保持标的企业同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的企业的商誉和业务的连续性不会受到破坏。 4.关于关联关系情况 截至本函出具日，本承诺人与上市公司及其控股股东、持股 5%以上股东之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系；本承诺人没有向上市公司推荐其他董事、监事或者高级管理人员；本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系。 截至本函出具日，本承诺人与本次重组的独立财务顾问、评估机构、会计师事务所、律师事务所无关联关系，亦不存在现实的及预期的

承诺事项	承诺方	承诺内容
		利益或冲突，相关中介机构具有独立性。 5.关于合法合规情况 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。 6.关于内幕交易情况 本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。 7.关于特殊权利 本承诺人享有的与标的企业相关的特殊权利（如有），包括但不限于回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。
	上市公司控股股东及一致行动人	一、对本次重组的原则性意见 本承诺人原则性同意本次重组。 二、上市公司控制权稳定 本次重组前，刘强及一致行动人李杰合计持有上市公司 32.90%股份表决权，刘强、李杰为公司实际控制人。本次重组完成后（不考虑配套融资），刘强、李杰仍为公司的实际控制人。本次重组前后，刘强、李杰持有及实际支配公司股份表决权比例最高，且未发生变化，刘强、李杰仍为公司实际控制人。 三、未损害上市公司利益 本承诺人作为上市公司实际控制人期间，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第一款第（二）项规定的严重侵害上市公司权益且尚未消除的情况。 四、履行保密义务 本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。 五、股份减持计划 自上市公司本次重组董事会召开之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持上市公司股份的计划。 如违反上述承诺，由此给上市公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》	交易对方	屹唐投资：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 华创芯原：本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有），本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与

承诺事项	承诺方	承诺内容
第 13 条情形之承诺		本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 上海瑾矽：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 民和志威：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 闪胜创芯：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 WM：本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有），本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业（如适用）均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 AM：本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有），本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业（如适用）均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 厦门芯华：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂

承诺事项	承诺方	承诺内容
		行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 武岳峰集电：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 上海集岑：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 北京青禾：本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 万丰投资：本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有），本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。 承裕投资：本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有），本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
	上市公司	本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员，本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与重大资产重组的情形。
关于标的资产完整权利的承诺	交易对方	屹唐投资：1.本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占

承诺事项	承诺方	承诺内容
		有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 华创芯原：1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，除本承诺人将持有的标的企业 11.08%股权质押予北京亦庄国际投资发展有限公司外，标的资产不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 就本承诺人所持标的资产质押事项，本承诺人将于本次重组交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 上海瑾矽：1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议

承诺事项	承诺方	承诺内容
		或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 民和志威： 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 闪胜创芯： 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 WM： 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占

承诺事项	承诺方	承诺内容
		有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股或存在其他第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程性文件规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 AM: 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、股权代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的股权，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 厦门芯华: 1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买

承诺事项	承诺方	承诺内容
		权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产,从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业章程规定,并已获得必要的许可、授权及批准,不存在实质障碍。 武岳峰集电: 1.本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为合伙人应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利;本承诺人所持标的资产权属清晰,不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议,不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产,不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形,亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认,截至本函出具之日,不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产,从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定,并已获得必要的许可、授权及批准,不存在实质障碍。 上海集岑: 1.本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为合伙人应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利;本承诺人所持标的资产权属清晰,不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议,不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产,不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形,亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认,截至本函出具之日,不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产,从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定,并已获得必要的许可、授权及批准,不存在实质障碍。 北京青禾: 1.本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为合伙人应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利;本承诺人所持标的资产权属清

承诺事项	承诺方	承诺内容
		晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 万丰投资：1.本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。 承裕投资：1.本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为合伙人应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原

承诺事项	承诺方	承诺内容
		因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。 5.本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。
关于股份锁定的承诺函	交易对方	屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电：1.作为业绩承诺方，本承诺人在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月期满后，本承诺人根据业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下： 第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，本承诺人可解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×本承诺人获得的对价股份数量 第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，本承诺人可解锁的股份数按如下公式计算： 本承诺人可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×本承诺人获得的对价股份数量 - 第一期解锁股份数 第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，本承诺人于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务(如有)履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。 《专项审核报告》应于上市公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经上市公司与本承诺人同意并确认延期的，则视为本承诺人已满足上述相应阶段的解锁条件，可自上市公司相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。 2.本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 若中国证监会等监管机构对本承诺人本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，本承诺人将根据相关监管机构的监管意见及要求相应调整。 上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华、上海集岑、万丰投资：1.本承诺人取得新增股份时(以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同)，如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间(以工商变更登记完成之日起算，下同)已超过 12 个月，则其在本本次购买资产项下取得的上市公司新增股份(即对价股份)自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		2.本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 若中国证监会等监管机构对本承诺人本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，本承诺人将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整。
	刘强、李杰	本承诺人于本次交易前持有的上市公司股份，自本次配套融资项下股份发行完成日起 12 个月届满之日前不得转让。
	四海君芯	1.本承诺人在本次配套融资项下取得的上市公司股份自股份发行完成之日起 36 个月内不得转让，亦不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式处置尚处于锁定期的股份。 2.本次配套融资完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
关于不谋求上市公司控制权的声明及承诺	交易对方	1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。 2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。 3.本次交易完成后，交易对方将不会联合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事会、监事会成员等改变上市公司董事会、监事会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员组成结构产生实质性影响。 交易对方进一步确认，本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总数的四分之一，但不低于两名。 4.交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。 5.如违反上述承诺，上市公司有权要求承诺人根据上述承诺予以改正，承诺人拒绝改正的，上市公司有权拒绝承诺人的相应要求。
关于股份质押的声明及承诺函	业绩承诺方	本承诺人承诺，将以股份、现金或股份与现金相结合的方式进行履行业绩补偿义务；若选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，本承诺人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺。本承诺人保证，不通过质押股份等方式逃废补偿义务，未来在业绩承诺期内质押对价股份时，将书面告知质权人根据《盈利补偿协议》及其补充协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
关于参与认购本次配套融资的承诺	刘强	1.本承诺人承诺，由本承诺人实际控制的北京四海君芯有限公司（以下简称“认购方”）参与本次配套融资，认购配套融资金额不低于本次配套融资总额的 50%。 2.本承诺人承诺，认购方将根据本次配套融资相关安排，按期、足额

承诺事项	承诺方	承诺内容
		认购本次配套融资相应股份，并承诺于上市公司向认购方发出《缴款通知书》前，通过自有及/或自筹（包括但不限于通过借款或其他法律法规允许的方式筹集）方式，将认购本次配套融资所需的资金准备到位。 3.本承诺人承诺，认购方用于认购本次配套融资的资金不存在对外募集行为，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排方式进行融资的情形。 4.本承诺人承诺，认购方认购本次配套融资不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他任何代持的情形。 5.本承诺人承诺，认购方不存在直接或间接使用上市公司资金用于认购本次配套融资的情形，也不存在上市公司就本次配套融资向认购方提供财务资助或补偿的情形。 6.本承诺人承诺，认购方在本次配套融资项下获得的上市公司股份锁定期为自股份发行结束之日起 36 个月；认购方不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式处置尚处于锁定期的股份。本次重组完成后，认购方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增加的股份亦应遵守前述股份锁定安排。 7.本承诺函自作出之日起即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。
关于参与认购本次配套融资的承诺	四海君芯	1.本承诺人承诺参与本次配套融资，认购配套融资金额不低于本次配套融资总额的 50%。 2. 本承诺人承诺，将根据本次配套融资相关安排，按期、足额认购本次配套融资相应股份，并承诺于上市公司向本承诺人发出《缴款通知书》前，通过自有及/或自筹（包括但不限于通过借款或其他法律法规允许的方式筹集）方式，将认购本次配套融资所需的资金准备到位。 3. 本承诺人承诺，用于认购本次配套融资的资金不存在对外募集行为，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排方式进行融资的情形。 4. 本承诺人承诺，认购本次配套融资不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他任何代持的情形。 5. 本承诺人承诺，不存在直接或间接使用上市公司资金用于认购本次配套融资的情形，也不存在上市公司就本次配套融资向本承诺人提供财务资助或补偿的情形。 6.本承诺人承诺，在本次配套融资项下获得的上市公司股份锁定期为自股份发行结束之日起 36 个月；本承诺人不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式处置尚处于锁定期的股份。本次重组完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增加的股份亦应遵守前述股份锁定安排。 7.本承诺函自作出之日起即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。
关于维持上市公司控制权稳定的承诺	上市公司实际控制人刘强、李杰	本承诺人作为上市公司的实际控制人，为本次重组之目的，现就维持上市公司控制权稳定作出声明、确认与承诺如下： 1.本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃上市公司控制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。 2.本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动辞任上市公司董事、高级管理人员的职务（如有）。 3.本次交易完成后 60 个月内，根据资本市场情况与实际需要，本承

承诺事项	承诺方	承诺内容
		诺人不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维护上市公司控制权稳定。 4.本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，本承诺人向上市公司提名的董事人数合计不少于四名。 5.本承诺人将严格履行股份锁定义务，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定及监管要求，结合已作出的公开承诺，安排及规范股份减持行为，并及时履行信息披露义务。 6.本承诺人将根据相关法律法规及公司章程，积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利，不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利，努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力。 7.本承诺函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。
关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	上市公司董事、高级管理人员	1.本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益； 2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束； 3.本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4.本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）； 5.本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
	上市公司控股股东、实际控制人	在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

除上述与本次交易相关出具的承诺事项外，相关各方长期履行的承诺事项情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容
关于减少及规范关联交易的承诺函	控股股东及实际控制人刘强、李杰	本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实际控制人。就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简

承诺事项	承诺方	承诺内容
		称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规章制度等有关 规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺 人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制 的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企 业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生 的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按 照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法 规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联 交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与北京君正 及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合 法权益。 3.在持有上市公司股份期间,不利用控股股东地位影响 或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优 于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与北 京君正及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法 占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再作为北京君正的控股股东及实际控 制人,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而 给北京君正或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人 承担赔偿责任。
	交易对方	屹唐投资:作为本次重组的交易对方,本承诺人将持 有上市公司5%以上股份,就减少及规范与上市公司关联 交易事宜,本承诺人现作出声明、确认及承诺如下: 1.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制 的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性 文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规章制度等有 关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承 诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时, 履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承诺人控制 的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企 业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生 的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按 照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法 规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联 交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与北京君正 及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合 法权益。 3.在持有上市公司股份期间,不利用持股5%以上股东地 位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面 给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋 求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法 占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再持有北京君正5%以上股份,本承诺始

承诺事项	承诺方	承诺内容
		终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 华创芯原：作为本次重组的交易对方，本承诺人将持有上市公司 5%以上股份，就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。 3.在持有上市公司股份期间，不利用持股 5%以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再持有北京君正 5%以上股份，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 武岳峰集电：作为本次重组的交易对方，本承诺人将持有上市公司 5%以上股份，就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。

承诺事项	承诺方	承诺内容
		3.在持有上市公司股份期间，不利用持股 5%以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再持有北京君正 5%以上股份，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。 上海集岑：作为本次重组的交易对方，本承诺人将持有上市公司 5%以上股份，就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 1.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2.在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。 3.在持有上市公司股份期间，不利用持股 5%以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。 4.在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 除非本承诺人不再持有北京君正 5%以上股份，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
关于避免同业竞争的承诺	控股股东及实际控制人刘强、李杰	本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实际控制人。就避免同业竞争事项，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司及北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司及北京矽成不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。 2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资

承诺事项	承诺方	承诺内容
		产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。 3、如因其未履行本承诺而给上市公司造成损失的，其因此给上市公司造成的损失予以赔偿。
	交易对方	屹唐投资：作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将持有北京君正 5%以上股份，现就本次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下： 1、在本次重组业绩承诺期内，本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为，则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。 “控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。 2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承诺限制。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人对北京君正持股比例首次低于 5%；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。 华创芯原：作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将持有北京君正 5%以上股份，现就本次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下： 1、在本次重组业绩承诺期 内，本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为，则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。 “控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。 2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承诺限制。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人对北京君正持股比例首次低于 5%；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。 武岳峰集电：作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将持有北京君正 5%以上股份，现就本次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下： 1、在本次重组业绩承诺期内，本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为，

承诺事项	承诺方	承诺内容
		则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。 “控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。 2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承诺限制。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人对北京君正持股比例首次低于 5%；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。 上海集岑：作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将持有北京君正 5%以上股份，现就本次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下： 1、在本次重组业绩承诺期内，本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为，则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。 “控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。 2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承诺限制。 2、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人对北京君正持股比例首次低于 5%；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。
关于保证上市公司独立性的承诺	控股股东及实际控制人刘强、李杰	本次重组完成后，刘强、李杰仍为北京君正的实际控制人。为了保持北京君正的独立性，保护北京君正其他股东尤其是中小股东的合法权益，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下： 一、关于上市公司人员独立 1.保证北京君正的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在北京君正工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。 2.保证北京君正的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。 3.保证本承诺人推荐出任北京君正董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预北京君正董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 二、关于上市公司财务独立 1.保证北京君正建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。 2.保证北京君正具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3.保证北京君正及其子公司能够独立做出财务决策，本

承诺事项	承诺方	承诺内容
		承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预北京君正的资金使用、调度。 4.保证北京君正及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。 5.保证北京君正及其子公司依法独立纳税。 三、关于上市公司机构独立 1.保证北京君正依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。 2.保证北京君正的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）独立行使职权。 3.保证北京君正及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。 4.保证北京君正及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 四、关于上市公司资产独立、完整 1.保证北京君正具有独立、完整的经营性资产。 2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用北京君正的资金、资产及其他资源。 3.保证不以北京君正的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。 五、关于上市公司业务独立 1.保证北京君正拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少北京君正与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。 3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与北京君正主营业务直接相竞争的业务。 本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预北京君正的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证北京君正在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。 除非本承诺人不再作为北京君正的控股股东及实际控制人，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给北京君正及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。

十二、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划

（一）控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

北京君正的控股股东及其一致行动人刘强和李杰已出具承诺，原则性同意本次重组。

（二）控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

自北京君正审议本次重组复牌之日（2019年5月17日）起至实施完毕期间，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员暂不存在减持上市公司股份的计划，并已出具对应承诺。

十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务

上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《重组管理办法》等相关法律、法规的规定对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，上市公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本报告书在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易聘请国泰君安、中德证券作为上市公司独立财务顾问出具独立财务顾问报告，聘请金杜律师出具法律意见书，聘请具有证券期货业务资格的东洲评估进行评估并出具相关报告，聘请具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所进行审计并出具相关报告。根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

（三）网络投票安排

上市公司公布正式重组方案后，在审议本次交易的股东大会上，公司严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，切实保护了股东的合法权益。同时，公司对中小投资者投票情况单独统计并予以披露。

（四）资产定价公允性

上市公司聘请会计师、评估机构对本次交易的标的资产进行了审计、评估，标的资产的交易价格由交易各方以经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告的评估结果为基础协商确定，本次交易的定价公允、合理。

同时，公司独立董事对本次交易涉及资产评估定价的公允性发表了独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。

（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、本次重组对上市公司预期每股收益的影响

本次重大资产重组中，上市公司拟向交易对方发行 248,650,730 股股份，不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本规模将由 248,650,730 股增加至 450,688,714 股。

基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本次重大资产重组在 2019 年 10 月完成）主要财务指标，关于测算过程的主要假设说明如下：

（1）以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（2）假设公司于 2019 年 10 月 31 日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），本次重大资产重组最终完成时间以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）假设宏观经济环境、集成电路芯片行业的情况没有发生重大不利变化；

（4）不考虑配套融资发行股份的数量，假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为 248,650,730 股，未扣除本次重组相关的发行及中介费用的影响；

（5）根据业绩承诺方承诺的北京矽成净利润数据，北京矽成 2019 年净利润为 4,900 万美元（未包含 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益、北京矽成因实施股权激励所产生的费用、北京矽成因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销以及配套募集资金投资项目损益），按照 2018 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 6.8632 换算即为 33,629.68 万元，假设以该承诺业绩作为北京矽成 2019 年归属于母公司股东的净利润指标进行测算；

（6）根据上市公司 2018 年年度报告财务数据，2018 年归属于母公司股东的净利润为 1,351.54 万元，假设 2019 年预计归属于母公司股东的净利润与 2018 年持平，即为 1,351.54 万元；

（7）不考虑公司股权激励计划在 2019 年度对股份数的影响，假设公司 2019 年不存在其他公积金转增股本、股票股利分配等对股份数有影响的事项；

（8）公司经营环境未发生重大不利变化；

（9）不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响。

经测算，公司本次重大资产重组前后每股收益指标具体影响如下：

项目	2019 年	
	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)
归属母公司所有者的净利润（单位：万元）	1,351.54	6,956.49
基本每股收益（单位：元/股）	0.07	0.15
稀释每股收益（单位：元/股）	0.07	0.15

基于上述假定，本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2019 年归属母公司所有者的净利润较发行前增长 5,604.95 万元，上市公司 2019 年基本每股收益 0.15 元/股，较 2019 年重组完成前的基本每股收益增加 0.08 元/股，增幅为 130.21%，重组后上市公司盈利能力有所上升。

综上，本次交易完成后，上市公司不存在重组完成当年因本次交易导致即期

每股收益被摊薄的情形。

2、报告期上市公司备考报表每股收益情况

根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上市公司 2018 年度财务报告、经信永中和审阅的上市公司 2018 年度、2019 年 1-5 月期间备考财务报告及上市公司出具的 2019 年 1-5 月财务报告，上市公司重组前后每股收益指标如下：

项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套 融资)	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套 融资)
归属母公司所有者的净利润(单位:万元)	3,183.71	8,766.68	1,351.54	8,506.51
基本每股收益(单位:元/股)	0.16	0.20	0.07	0.19
稀释每股收益(单位:元/股)	0.16	0.20	0.07	0.19

上述重组完成后的数据基于以下假设：

(1)本次发行股份及支付现金购买资产交易已于 2018 年 1 月 1 日实施完成。上市公司实现与北京矽成、上海承裕的企业合并的公司架构于 2018 年 1 月 1 日业已存在，并按照此架构持续经营。

(2) 未考虑发行股份购买资产过程中可能发生的交易费用支出以及所涉及的各项税费，亦未考虑本次非公开发行股份配套募集资金事项。

基于上述假定，重组完成后上市公司 2018 年、2019 年 1-5 月归属母公司所有者的净利润分别为 8,506.51 万元、8,766.68 万元，基本每股收益分别为 0.19 元/股、0.20 元/股，较重组完成前增幅较大。

3、上市公司填补摊薄即期回报并增强公司持续回报能力的具体措施

在前述假设条件下，本次重大资产重组不会摊薄上市公司即期回报。若因经营环境等的变化导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

(1) 加强收购整合，提升盈利能力

本次交易完成后，上市公司将实现对北京矽成企业文化、研发、采购、营销

和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司将通过整合力争保证对北京矽成的控制力又保持其原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至北京矽成，充分实现本次交易的预期效益。上市公司将帮助北京矽成尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。

（2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

（3）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

（4）加强募集资金的管理和运用

本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

4、公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司本次重组关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（1）全体董事、高级管理人员承诺

本次重大资产重组完成后，全体公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：

“1.本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；

2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；

3.本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4.本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

5.本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员

工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。”

（2）公司控股股东、实际控制人承诺

公司的控股股东和实际控制人刘强、李杰先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

（六）其他保护投资者权益的安排

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，公司将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，继续规范运作。

十四、独立财务顾问的保荐机构资格

公司聘请国泰君安、中德证券担任本次交易的独立财务顾问，国泰君安、中德证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

十五、其他重大事项

（一）除本次重大资产重组所涉及的行政审批不确定性外，本报告书根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出特别说明。提醒投资者认真阅读本报告书的风险提示内容，注意投资风险。

（二）公司提示投资者应到中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浏览本报告书的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价公司此次重大资产重组交易时，除本报告书提供的其它各项资料外，还应特别关注下述各项风险因素。

一、本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括中国证监会核准本次交易事项；其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。截至本报告书出具日，上述审批事项尚未完成。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

其中，北京君正及北京矽成自愿将本次交易提交 CFIUS、台湾投审会审查。受到目前中美贸易摩擦以及大陆台湾两岸关系等政策性影响，CFIUS 及台湾投审会对于中方直接或间接收购的审查或将趋于严格。上市公司不能排除相关政府和监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动，从而延迟本次交易的交割或导致本次交易终止的风险。

综上，本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意相关审批风险。

（二）交易调整或终止的风险

在本次交易过程中，交易各方可能需根据中国证监会等监管机构的要求不断完善交易方案，本次交易方案存在此类调整风险。若交易各方无法就监管机构审核要求进行方案调整达成一致，则本次交易存在终止的风险。同时如北京矽成供应商或客户因本次交易而调整或终止其与北京矽成的业务，则可能导致本次交易调整或终止。提请投资者注意风险。

此外，公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存

在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止本次交易的风险。

（三）上市公司实际控制人稳定性风险

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03%和 12.73%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、刘强控制的企业四海君芯认购配套融资的50%测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。若相关交易对方构成一致行动关系且其合计持股比例或表决权比例高于刘强，或者刘强未能足额认购募集配套资金导致其持股比例或表决权比例低于其他交易对方，则存在上市公司实际控制人变更的风险，从而给本次交易带来不利影响。若发生上述情形，则本次交易存在调整交易方案或终止的风险。

（四）北京矽成业绩承诺不能达标的风险

根据上市公司与业绩承诺方上海承裕、屹唐投资和华创芯原签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元。

经上市公司与业绩承诺方协商一致，北京矽成业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为实际净利润数。在计算实际利润数时，不考虑：1、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；2、北京矽成因实施股权激励所产生的费用；3、北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；4、配套募集资金投资项目损益。

若北京矽成在盈利补偿期间内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数低于承诺净利润累计数的 85%，业绩承诺方应对上市公司进行补偿。

同时，业绩承诺期届满时，经减值测试，如北京矽成期末减值额>已补偿金额，则业绩承诺方应对上市公司另行补偿。

上述业绩承诺系业绩承诺方基于北京矽成目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，北京矽成经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。因此本次交易存在承诺期内北京矽成实现的实际净利润达不到承诺净利润的风险。

（五）业绩补偿及减值补偿不足的风险

根据上市公司与本次交易业绩承诺方上海承裕、屹唐投资和华创芯原签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，双方约定若北京矽成在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数达到承诺净利润累计数的 85%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿。同时，在计算北京矽成在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的净利润数时，不考虑：1、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；2、北京矽成因实施股权激励所产生的费用；3、北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；4、配套募集资金投资项目损益。

同时，业绩承诺期届满时，经减值测试，如北京矽成期末减值额>已补偿金额，则业绩承诺方应对上市公司另行补偿。

在充分考虑业绩承诺方对北京矽成未来经营的作用、未来承担的业绩补偿责任和风险、北京矽成对上市公司的战略意义等因素的基础上，上市公司与业绩承诺方约定了业绩补偿及减值补偿的最高限额，即业绩承诺方业绩补偿及减值补偿总额以本次交易项下取得的交易对价金额为限，如有超出部分，业绩承诺方无需进一步补偿。若北京矽成在承诺期间累计实现的净利润低于承诺净利润累计数的 85%，或业绩承诺期届满北京矽成期末减值额>已补偿金额，则各业

绩承诺方在向上市公司支付其最高限额的补偿后，无须再对上市公司进行额外的股票或现金补偿。

此外，根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号），截至评估基准日，北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，较评估值增加 2.45%。本次交易存在溢价收购导致业绩补偿不足的风险。

提请投资者关注相关业绩补偿及减值补偿不足的风险。

（六）收购整合风险

在发展过程中，上市公司已建立了高效的管理体系和经营管理团队。本次交易完成后，公司的资产、业务规模和范围都将有较大幅度的增长，企业规模增长对企业经营管理提出更高的要求。

本次收购属于对同行业优质资产的整合，上市公司对于北京矽成实际经营实体所处行业的特点和发展规律有深入了解，积累了大量发展经验。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，上市公司与北京矽成实际经营实体仍需在企业文化、团队管理、销售渠道、客户资源等方面进行进一步的融合。但是，本次交易完成后，上市公司能否对北京矽成实际经营实体实施有效整合，以及本次交易能否充分发挥协同效应，均存在不确定性，进而可能影响本次收购的最终效果。

本次交易完成后，北京矽成在管理经营、销售扩展、产品研发领域等个方面将继续保持其独立性，现有的管理团队、销售组织架构、研发技术人员将不会因本次重组而发生变化。鉴于北京矽成在经历前次私有化收购后，经营业绩仍保持稳健增长的良好态势，同时继续保持与原主要客户之间的稳定合作关系和紧密联系，未影响消费者的购买意向。但是，考虑到北京矽成的主要经营活动在美国和台湾地区等地开展，主要客户亦广泛分布于欧美及亚太地区，不排除本次收购会影响部分客户消费意向，从而导致对北京矽成未来经营业绩产生不利影响的可能性。同时，考虑到全球集成电路产业竞争格局及不同国家地区经济贸易政策，亦存在本次收购会影响部分供应商的供货意向，从而对北京矽成未来经营业绩产生不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

（七）募集配套资金不足或失败带来的资金压力风险

本次交易的现金对价为 16.16 亿元，公司拟募集配套资金不超过 15 亿元用于支付本次交易的部分现金对价、投入标的资产的项目建设。受北京矽成经营情况、财务状况变化、监管机构政策以及资本市场影响，本次募集配套资金存在募集金额不足乃至募集失败的可能。若募集配套资金不足或失败，公司将以更多自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价及项目建设，从而进一步增加资金压力。在此情形下，公司的财务风险和融资风险将进一步增加，且将提高公司的资产负债率水平，增加公司未来的偿债压力，提请投资者注意相关风险。

（八）商誉减值风险

本次交易属于非同一控制下的企业合并，上市公司对本次合并成本与评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。根据信永中和会计师事务所出具的上市公司备考财务报表审阅报告，假设本次重组在 2018 年 1 月 1 日完成，上市公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日合并报表商誉金额分别为 359,550.13 万元和 360,855.29 万元，占备考报表总资产的比例分别为 39.52%和 39.20%，占备考报表归属于母公司股东净资产的比例分别为 54.37%和 53.77%。

本次交易完成后，在上市公司合并报表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。本次交易所形成的商誉在减值测试中会分摊至相关资产组，这些相关的资产组能够从企业合并的协同效应中受益，收购完成后上市公司与北京矽成具有较强的协同效应，如果未来市场环境发生不利变化，上市公司及北京矽成未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失，对上市公司商誉减值当年的业绩带来重大不利影响，亦会导致上市公司存在较大的未弥补亏损，提请广大投资者注意上述商誉减值对上市公司业绩造成不利影响的风险。

二、标的资产相关风险

（一）行业周期性风险

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，属于集成电路产业的上游环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。全球范围内，集成电路产业规模一直保持稳步增长趋势，随着新的技术进步导致旧技术产品逐渐淘汰，作为集成电路行业不断地追求新技术发展的特征，使产品周期时间越来越短，以此产生了集成电路行业特有的周期性波动特点，且行业周期性波动的频率要较经济周期更为频繁，在经济周期的上行或下行过程中，都可能出现相反的集成电路产业周期。在经历了多年增长周期之后，2018 年底半导体行业发展行情放缓，全球芯片销售额自 2018 年底至 2019 年初出现下降趋势。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则北京矽成的经营业绩可能受到负面影响，提请投资者注意行业周期性波动的风险。

（二）人才流失风险

北京矽成作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成北京矽成拥有行业领先地位的重要保障。目前，北京矽成拥有高素质的稳定管理设计团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素，虽然北京矽成向管理团队和核心技术人员提供了较为合适的激励机制，然而随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，若没有跟进相适应的激励机制，则管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面可能出现下降，或产生人员流失、经营运作不利、盈利水平下滑等不利影响，提请投资者注意相关风险。

（三）供应商风险

北京矽成采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，作为集成电路设计领域内通常采用的经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来在全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以

轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中因供应商的供货所产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障北京矽成的采购需求，存在不确定的风险。同时随着行业中晶圆代工厂和封装测试厂在不同产品中产能的切换，以及产线的升级，或带来的北京矽成采购单价的变动，若代工服务的采购单价上升，会对北京矽成的毛利率造成下滑的影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆代工和封装测试厂向北京矽成的正常供货。提请投资者注意相关风险。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。我国政府目前已通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，陆续颁布了一系列政策及法律法规，拟从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业企业的发展。2015 年国务院颁布的《中国制造 2025》中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点照顾的领域。政府对集成电路产业的支持政策为我国各类型的高新科技集成电路企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响，提请投资者注意相关风险。

（五）外汇风险

北京矽成下属实际经营主体大多注册在中国大陆地区以外，日常经营活动中涉及美元、欧元、台币等货币，而且该等子公司根据其经营所处的主要经济环境以其本国或本地区货币作为记账本位币。一方面，各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给北京矽成未来运营带来汇兑风险；另一方面，随着人民币日趋国

际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对美元等货币的汇率变化将导致北京矽成及上市公司的外币折算风险。

（六）税务风险

北京矽成主要经营实体分布在全球不同国家和地区，在不同国家和地区承担纳税义务，其主要经营主体的实际税率受到管辖区域内税率变化及其他税法变化的影响。未来，各个国家和地区的税务机构存在对管辖区内企业税收规则及其应用做出重大变更的可能性，此类变更可能导致北京矽成的税负增加，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的子公司，所在经营区域的税率变化或其他税收规则变化，或对上市公司未来合并报表财务数据造成一定的影响。

（七）标的资产的估值风险

根据东洲评估出具的《北京矽成评估报告》《上海承裕评估报告》，北京矽成 100%股权、上海承裕 100%财产份额截至评估基准日的评估值分别为 70.28 亿元和 28.12 亿元，增值率分别为 21.07%和 0%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照估值的相关规定，勤勉、尽责，但由于评估和估值工作是基于一定的假设前提，如未来情况较预期发生较大变化，可能存在资产估值与实际情况不符的风险。提请投资者注意本次交易标的资产的估值风险。

（八）所在国政治经济环境和政策变化风险

北京矽成的产品研发和销售涉及较多的国家和地区，若相关国家和地区的政治局势、经济状况出现较大波动，或不同国家和地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，则可能对北京矽成业务经营和盈利能力造成不利影响，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

此外，各个国家和地区的产业政策和经济贸易政策也对北京矽成的生产经营具有重要影响。诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，均会对北京矽成在相关国家和地区的经营活动和盈利能力

力造成不利影响。自 2018 年以来，美国政府针对中国企业出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，中美贸易摩擦加剧将在一定程度上影响北京矽成的经营活动和盈利能力，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《创业板上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

（二）其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

交易各方声明	1
一、公司声明	1
二、交易对方声明	1
三、相关证券服务机构声明	3
重大事项提示	8
一、本次交易方案概述	8
二、本次交易支付方式、募集配套资金安排	10
三、标的资产的评估情况	14
四、本次交易构成重大资产重组	15
五、本次交易构成关联交易	15
六、本次交易不构成重组上市	16
七、业绩承诺与补偿安排	16
八、本次交易对上市公司的影响	19
九、本次交易完成后公司仍符合上市条件	40
十、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序	40
十一、本次交易相关方作出的重要承诺	44
十二、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划	87
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排	87
十四、独立财务顾问的保荐机构资格	93
十五、其他重大事项	93
重大风险提示	94
一、本次交易相关的风险	94
二、标的资产相关风险	99
三、其他风险	102
释 义	108
一、一般释义	108
二、专业释义	111
第一章 本次交易概况	113

一、本次交易的背景	113
二、本次交易的目的	115
三、本次交易方案	117
四、本次交易构成重大资产重组	122
五、本次交易构成关联交易	123
六、本次交易不构成重组上市	123
七、业绩承诺与补偿安排	123
八、本次交易的报批事项	137
九、本次交易对上市公司的影响	138
第二章 上市公司基本情况	163
一、上市公司基本情况	163
二、历史沿革及股本变动情况	163
三、最近六十个月控制权变动情况	166
四、重大资产重组情况	166
五、主营业务发展情况	166
六、主要财务数据及财务指标	167
七、上市公司控股股东和实际控制人情况	168
八、最近三年合法合规情况	171
第三章 交易对方基本情况	172
一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况	172
二、发行股份募集配套资金之交易对方概况	257
三、交易对方之间的关联关系	265
四、交易对方与上市公司之间的关联关系说明及交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况	275
五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明	276
六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况	276
七、各交易对方最终出资人方变动情况	276
八、仅持有标的公司股权或财产份额的交易对方最终出资人持有股权或财产份额的锁定安排	283

九、本次重组交易对方存在结构化安排的情况	289
十、交易对方股权代持情况	290
第四章 标的资产情况	291
一、交易标的之北京矽成	291
二、交易标的之上海承裕	414
第五章 标的资产评估情况	428
一、标的资产评估的基本情况	428
二、北京矽成评估情况	432
三、上海承裕评估情况	491
四、董事会对资产评估的合理性及定价的公允性分析	498
五、独立董事对本次交易评估事项的意见	524
第六章 发行股份情况	526
一、发行股份购买资产并募集配套资金具体情况	526
二、本次发行股份募集配套资金情况说明	531
第七章 本次交易相关合同主要内容	550
一、发行股份购买资产协议及其补充协议	550
二、盈利补偿协议	590
三、股份认购协议	597
第八章 本次交易的合规性分析	603
一、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定	603
二、本次交易不存在《创业板发行管理办法》第十条规定的不得发行证券的情形	616
第九章 管理层讨论与分析	618
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	618
二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析	626
三、北京矽成的财务分析	661
四、上海承裕的财务分析	737
五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析	742
六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响分析	746
七、本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析	747

八、未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施.....	749
第十章 财务会计信息	618
一、北京矽成最近两年及一期合并财务报告	752
二、上海承裕最近两年及一期合并财务报告	756
三、上市公司最近一年及一期备考合并财务报告	757
第十一章 同业竞争与关联交易	761
一、同业竞争情况	761
二、关联交易情况	762
第十二章 风险因素	769
一、本次交易相关的风险	769
二、标的资产相关风险	774
三、其他风险	777
第十三章 其他重要事项	778
一、交易完成后上市公司资金、资产占用与担保情况	778
二、上市公司负债情况	778
三、上市公司最近十二个月内资产交易情况	778
四、本次交易对上市公司治理机制的影响	778
五、公司停牌前股价存在异常波动的说明	778
六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况	780
七、利润分配政策与股东回报计划	784
八、关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明....	791
九、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见	791
十、律师事务所对本次交易出具的结论性意见	792
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排	793
第十四章 本次交易的有关中介机构情况	800
一、独立财务顾问	800
二、法律顾问	800
三、审计机构	801

四、评估机构	801
第十五章 本次交易相关各方的声明	802
董事声明	802
监事声明	803
高级管理人员声明	804
独立财务顾问声明	805
独立财务顾问声明	806
法律顾问声明	807
审计机构声明	808
评估机构声明	809
第十六章 备查文件及备查地点	810
一、备查文件	810
二、备查地点	810
三、备查网址	811

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

北京君正、上市公司、公司	指	北京君正集成电路股份有限公司
合肥君正	指	合肥君正科技有限公司，上市公司全资子公司
交易标的、标的资产	指	北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额
标的公司、标的企业	指	北京矽成、上海承裕
发行股份及支付现金购买资产、本次收购	指	北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额
发行股份募集配套资金、募集配套资金、配套融资	指	向包括刘强控制的企业四海君芯在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金
本次重大资产重组、本次重组、本次交易	指	上述发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金
交易对方	指	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）、青岛民和志威投资中心（有限合伙）、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）、Worldwide Memory Co., Limited、Asia-Pacific Memory Co., Limited、厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、上海集岑企业管理中心（有限合伙）、北京青禾投资基金（有限合伙）、黑龙江万丰投资担保有限公司、上海承裕投资管理有限公司
控股股东、实际控制人	指	刘强、李杰
本报告书	指	《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
君正有限	指	北京君正集成电路有限公司
四海君芯	指	北京四海君芯有限公司
北京矽成	指	北京矽成半导体有限公司
北京闪胜	指	北京闪胜投资有限公司，系北京矽成曾用名
上海承裕	指	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）
屹唐投资	指	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）
华创芯原	指	北京华创芯原科技有限公司
上海瑾矽	指	上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）
民和志威	指	青岛民和志威投资中心（有限合伙），曾用名为烟台民和志威投资中心（有限合伙）
闪胜创芯	指	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）

Worldwide Memory、WM	指	Worldwide Memory Co., Limited
Asia Memory、AM	指	Asia-Pacific Memory Co., Limited
厦门芯华	指	厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）
上海集岑	指	上海集岑企业管理中心（有限合伙）
武岳峰集电	指	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
万丰投资	指	黑龙江万丰投资担保有限公司
北京青禾	指	北京青禾投资基金（有限合伙）
承裕投资	指	上海承裕投资管理有限公司
青岛君品	指	青岛君品投资合伙企业（有限合伙）
拉萨君品	指	拉萨君品创业投资有限公司
中关村科学城	指	北京中关村科学城创新发展有限公司
汇诚兴海	指	北京汇诚兴海科技中心（有限合伙）
上海闪胜	指	上海闪胜集成电路有限公司
闪胜科技	指	Uphill Technology Inc.
ISSI、芯成半导体	指	Integrated Silicon Solution, Inc.
ISSI Cayman	指	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.
Si En Cayman	指	Si En Integration Holdings Limited
ICSI TW	指	矽成积体电路股份有限公司
Chingis(US)	指	Chingis Technology Corporation
Winston	指	Winston Inc.
Sofwin	指	Sofwin Inc.
ISSI (HK)	指	Integrated Silicon Solution Inc. (Hong Kong) Limited （芯成积体电路（香港）有限公司）
EKI (Korea)	指	Enable Korea Co.,Ltd
ISSI (Israel)	指	Integrated Silicon Solution Israel Ltd
ISSI (Japan)	指	日本 ISSI 合同会社
ISSI (Singapore)	指	Integrated Silicon Solution, Inc. (Singapore) Pte. Limited
ISSI Cayman 台湾分公司	指	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc. Taiwan Branch
ISSI Holding (HK)	指	ISSI Hong Kong Holding Limited.
芯成半导体（上海）	指	芯成半导体（上海）有限公司
Enchida (HK)	指	Enchida International Limited
矽恩微电子（厦门）	指	矽恩微电子（厦门）有限公司
Chiefmax (BVI)	指	Chiefmax Venture Ltd.
武汉群茂	指	武汉群茂科技有限公司

Saint Tai Group	指	Saint Tai Group Limited
华清闪胜	指	北京华清闪胜科技有限公司
亦庄国投	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
北京集成	指	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）
北京京存	指	北京京存技术有限公司
武岳峰浦江	指	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）
华清基业	指	华清基业投资管理有限公司
CFIUS	指	美国外资投资委员会
台湾投审会	指	台湾地区经济部投资审议委员会
吉迪思	指	深圳吉迪思电子科技有限公司
LP	指	Limited partner，有限合伙人
GP	指	General partner，普通合伙人
《购买资产协议》	指	北京君正及/或合肥君正与交易对方、标的企业签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议
《盈利补偿协议》	指	北京君正与屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署的《盈利补偿协议》及补充协议
业绩承诺方	指	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
《专项审核报告》	指	为本次交易项下盈利补偿之目的，上市公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对北京矽成业绩承诺期内每个年度实现的税后净利润数及其与承诺净利润数的差异情况进行专项审核并出具的报告/意见
《北京矽成评估报告》	指	《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司 59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号）
《上海承裕评估报告》	指	《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额所涉及的全部财产份额价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0741 号）
审计基准日	指	2019 年 5 月 31 日
评估基准日	指	2018 年 12 月 31 日
交割日	指	《购买资产协议》约定的有关资产交割的先决条件全部得到满足后，各方协商确定的日期
过渡期间	指	自评估基准日 2018 年 12 月 31 日（不含基准日当日）至资产交割日（含交割日当日）
最近两年及一期、报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年 1-5 月
最近一年及一期	指	2018 年、2019 年 1-5 月
国泰君安、独立财务顾问、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司

中德证券、独立财务顾问、联席主承销商	指	中德证券有限责任公司
金杜律师、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
东洲评估、评估机构	指	上海东洲资产评估有限公司
信永中和会计师、会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
兴华会计师	指	北京兴华会计师事务所有限责任公司/北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《重组暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《创业板发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》	指	《北京君正集成电路股份有限公司章程》
《募集资金管理办法》	指	《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》
128 号文	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文）
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）
元/万元/亿元	指	元/万元/亿元人民币

二、专业释义

集成电路	指	一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的电路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。CPU 的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器芯片
SRAM	指	Static Random Access Memory，静态随机存取存储器芯片
FLASH	指	FLASH Memory，一般简称 FLASH，即闪存芯片

ANALOG	指	Integrated Circuit ANALOG Memory，一般简称 ANALOG，即集成电路模拟芯片
NOR FLASH	指	代码型闪存芯片
NAND FLASH	指	数据型闪存芯片
XBurst CPU	指	北京君正针对移动多媒体便携产品推出的一种创新的32位嵌入式CPU技术。它重新定义了32位嵌入式微处理器核心的性能、多媒体能力、功耗和尺寸标准。
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路，指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
Fabless 模式	指	无晶圆生产线集成电路设计模式，指仅仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。
IDM 模式	指	集成整合制造模式，指企业业务范围涵盖集成电路设计、制造、封装和测试等所有环节的经营模式
Connectivity	指	互联芯片
LIN	指	Local Interconnect Network，一种低成本的串行通讯网络
CAN	指	Controller Area Network，控制器区域网络
MCU	指	Microcontroller Unit，微控制单元

本报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

本报告中除特别说明外，关于上市公司股份比例相关测算以截至**2019年9月30日**股份数量为依据。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景

（一）我国集成电路产业发展迅速

集成电路产业作为信息技术产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。

国家高度重视集成电路产业的发展，自 2000 年以来，相继出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《集成电路产业“十二五”发展规划》、《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策文件，从政策、资金等方面大力扶持国内集成电路产业，推动国内集成电路产业的快速发展。

在市场推动和政策支持下，近年来我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2018 年销售规模达到 6,532 亿元，受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及智能手机等消费电子产品的普及，2016 年至 2018 年行业销售规模增速为 20.10%、24.81%和 21.50%，行业市场增速明显高于全球水平。

（二）新形势下，我国集成电路产业发展既面临巨大的挑战，也迎来难得的机遇

虽然我国集成电路产业从发展初期至今已经取得了较大进步，但是产业中仍然存在持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求脱节等突出问题，产业发展水平与先进国家和地区相比依然存在较大差距。同时在高端集成电路产品领域，对进口依赖程度仍旧较高，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有

力支撑。此外，中美贸易摩擦不断，美国在其占绝对优势的集成电路等产业上对中国进行制裁。我国集成电路产业发展正面临巨大的挑战。

当前，全球集成电路产业正面临先进制程技术节点的突破瓶颈，以及长期大额投入后对利润回报的考验，整体产业正进入阶段性调整变革时期。一方面，全球市场格局处于加快调整，龙头企业投资规模继续攀升，市场份额加速向优势企业集中。另一方面，随着移动智能终端及芯片呈现的爆发式增长，以及云计算、物联网、大数据等新业态进入成长期，面对我国坐拥的全球规模最大的集成电路产品需求，整体市场规模将在未来继续保持快速增长。这一新形势下，我国集成电路产业迎来了难得的发展机遇。

（三）存储芯片是信息系统的基础核心芯片，是我国集成电路产业重点发展的方向之一

存储芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品类型之一，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺。存储芯片市场规模巨大，广泛应用于国民生活的方方面面，也对国防军工、工业商业有重要意义，是不可或缺的基础元器件之一。《中国制造 2025》中也明确提出，自主化生产先进存储芯片、大容量存储芯片是未来中国大力发展集成电路的关键方向之一。

就我国而言，自 2013 年以来，每年集成电路已经超过石油成为我国金额最大的进口产品，而存储芯片是我国集成电路四大产品类型中自给率最低的部分，是我国进口金额最大的集成电路产品。一方面，我国存储芯片的设计、制造整体上相对世界先进水平存在较大差距。另一方面，我国国产存储芯片市场替代空间巨大，存储芯片设计、制造企业面临良好的市场机遇。在存储芯片制造领域，近年我国相继启动了长江存储等国家重点项目，力求尽快缩小与世界先进水平的差距。但在整体层面，以及 DRAM、SRAM 等细分领域，仍缺乏具有国际影响力的企业。为了填补国内空白，推进资源整合、培育具有国际竞争力的存储芯片设计大型企业是我国集成电路产业跻身世界先进水平梯队的重要标志。

（四）北京矽成在全球 DRAM、SRAM 领域处于行业领先地位

北京矽成系控股型公司，自身尚未开展具体业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 成立于 1993 年 6 月，于

1995年2月在美国纳斯达克上市，于2015年12月被北京矽成私有化收购并退市。ISSI Cayman以及SI EN Cayman原均为ISSI的子公司，在私有化完成后被调整为ISSI的兄弟公司。

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。集成电路存储芯片业务是北京矽成最核心业务，主要产品包括各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片和ANALOG模拟芯片，其产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域。北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位，同时拥有一批优质客户，包括Continental AG、Delphi、Valeo、Panasonic、Siemens、Bosch等，多年来关系稳定。

二、本次交易的目的

（一）顺应国家产业整合思路，做大做强芯片产业

集成电路产业作为国民经济和社会发展的基础性和战略性产业，已经渗透到人民生活、经济生产和国防安全等的方方面面。我国集成电路行业2018年销售规模达到6,532亿元人民币，2016年至2018年行业销售规模增速为20.10%、24.81%和21.50%，显著高于同一时期下全球行业的增速水平。集成电路产业的重心正逐步向亚洲，特别是中国大陆地区转移。中国大陆作为全球集成电路市场的主要增长地区，其产业在全球的地位将迎来快速的提升，在产业链日渐成熟的当下，我国集成电路产业的发展将迎来宝贵的机遇。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的思想，为了推动集成电路产业重点突破和整体提升，集成电路企业需要加强与境外研发机构的合作，加大针对海外优秀企业家和高素质技术、管理团队的引进力度，完善鼓励创新创造的分配激励机制，以此扩大国际合作、整合国际资源、拓展国际市场，实现我国集成电路产业的跨越式发展。

虽然国际市场集成电路产能逐步饱和，我国集成电路产业仍面临国内产能匮乏的现状，参考国际市场的规划和布局，我国集成电路产业拥有巨大的扩展空间。在我国产业扩张需求强烈之际，遵循产业整合思路进行的同行业之间的并购是最为快速有效的解决方式。

首先，集成电路企业通过对外并购重组可以获得先进的研发技术、知识产

权和专利以及经验丰富的技术和管理人员，从而获得研发成本的降低和研发周期的缩短，提高自主创新能力。其次，对于企业的经营规模、行业地位、市场占有率有规模，通过产业的并购可以得到大幅提升，发挥规模化效益，寻求利益最大化。

集成电路产业具有明显的阈值特征。全新的产品从设计到实现收入需要经历较长的研发周期及经验积累，以及繁复的质量认证，而由于行业显著的激烈竞争和规模效应，导致在收入达到一定规模前，较难为企业带来实际的盈利效果。因此，完全通过自主研发填补国内芯片领域的空白是一个漫长而挑战重重的道路。而通过同行业并购和产业整合，可以快速聚集已经具有盈利能力的先进技术和资源，提升企业竞争力，形成行业龙头的集聚效应。通过人才的汇集和产业联盟的形成，将可以加速集成电路产业的发展，做大做强我国整体集成电路存储产业。

（二）优化上市公司业务结构，发挥协同效应

上市公司成立以来一直致力于国产创新 CPU 技术和嵌入式处理器芯片的研制与产业化，具有领先的 CPU 设计技术。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的 XBurst CPU 核心技术，公司推出了一系列具有高性价比的芯片产品，可广泛应用于教育电子、消费电子、生物识别、智能穿戴设备、物联网、智能家居及智能视频等领域。

北京矽成主要经营的集成电路芯片产品中，以 DRAM、SRAM 等易失性存储芯片为主要核心产品。其产品在专用领域市场拥有较好的口碑，被广泛使用于汽车级和工业级应用领域，通过多年在汽车电子、工业制造和消费电子等领域的业务积累，积累了丰富的行业经验。作为拥有国际领先水平的存储芯片设计公司，同专用领域内的国际一流客户保持着良好的合作关系。

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。在质量管控方面，北京矽成已基于产品研发、晶圆采购、封测代工、品质验证及售后服务各环节形成了整套经营模式及管控体系，上市公司在业务性质、内部流程上相类似，

在质量管控方面可以进行有效对接，从而保持长期的稳健发展。在技术研发方面，上市公司可借鉴北京矽成多年的研发经验及团队实力，夯实其在芯片设计领域的综合研发能力，有利于更好地立足本土、着眼全球，开拓新兴的市场机会。在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。在客户及市场规模方面，本次交易完成后公司可充分利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源，增加彼此合作机会，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力。

（三）提高上市公司盈利能力及抗风险能力

本次交易完成后，上市公司的经营状况、研发能力、资产质量将得到进一步的提升，同时上市公司的持续盈利能力以及未来发展空间也会借由本次并购的助力，更上一个台阶。对来自于芯片设计行业的周期、供应链保障、宏观经济周期的风险，上市公司将受益于产品结构优化及更多供应商的产能保障等因素，在抗风险能力上得到进一步加强，从而为上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益带来更有力的保障。

三、本次交易方案

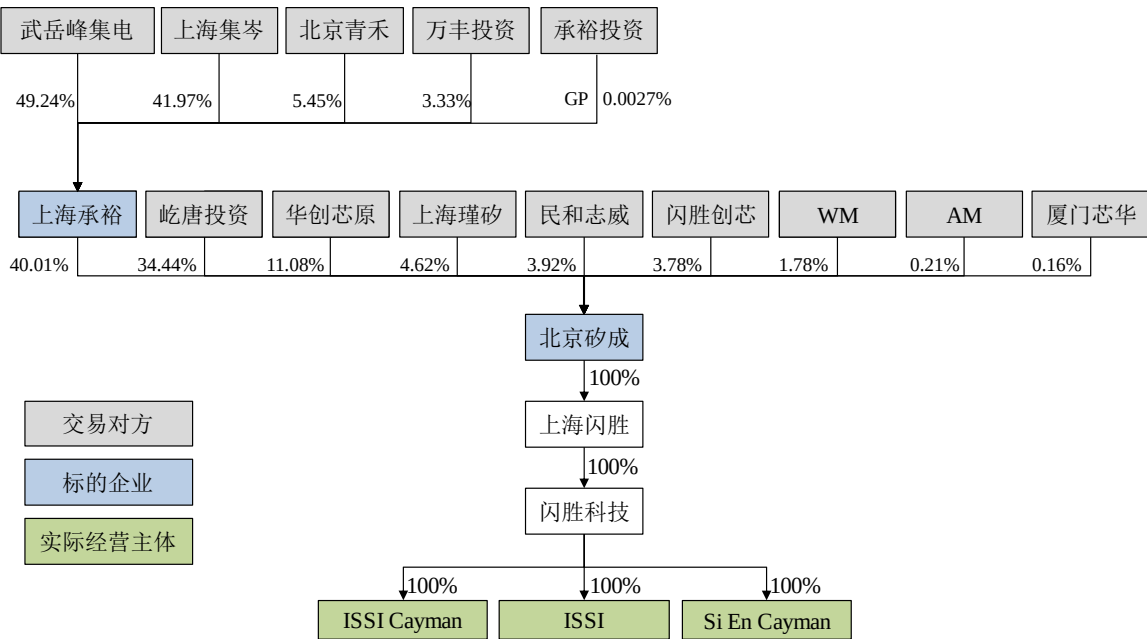
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分。发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。

（一）本次交易方案概述

1、本次收购方案概述

本次收购方案为北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成 59.99%股权，以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕 100%财产份额，合计交易作价 72 亿元。

本次收购的交易架构如下：



本次收购的具体情况如下：

序号	标的企业	权益比例	转让方	受让方	支付方式
1	北京矽成	34.44%	屹唐投资	上市公司	股份+现金
		11.08%	华创芯原	上市公司	股份+现金
		4.62%	上海瑾矽	上市公司	股份
		3.92%	民和志威	上市公司	股份
		3.78%	闪胜创芯	上市公司	股份
		1.78%	WM	上市公司	股份
		0.21%	AM	上市公司	股份
		0.16%	厦门芯华	上市公司	股份
2	上海承裕	49.24%	武岳峰集电	上市公司	股份+现金
		41.97%	上海集岑	上市公司	股份
		5.45%	北京青禾	上市公司	现金
		3.33%	万丰投资	上市公司	股份+现金
		0.0027%	承裕投资	合肥君正	现金

本次收购完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。

北京矽成于 2015 年以 7.8 亿美元（按照 2018 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 6.8632 折算约 53.7 亿元人民币）对美国纳斯达克上市公司 ISSI 实施私有化收购。ISSI 主营各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH 存储芯片及 ANALOG 模拟芯片的研发和销售。本次交易系对集成电路产业同行业公司产业并购，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。

2、配套融资方案概述

公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的部分现金对价、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。

（二）发行股份及支付现金购买资产

根据东洲评估的《北京矽成评估报告》及《上海承裕评估报告》，截至评估基准日（2018 年 12 月 31 日），北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，上海承裕 100%财产份额评估值为 281,217.81 万元。参考上述评估值，经上市公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方协商一致确定北京矽成 59.99%股权的交易作价定为 431,929.02 万元，上海承裕 100%财产份额的交易作价定为 288,102.84 万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，股份发行价格为 22.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量）。上市公司 2018 年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年 4 月 10 日总股本向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2019 年 5 月 27 日，上市公司 2018 年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份购买资产的发行价格由 22.49 元/股调整为 22.46 元/股。

定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的股份发行价格将作相应调整。除此之外，本次发行股份购买资产的股份发行价格不再调整。如果本次发行股份购买资产的股份发行价格发生调整，本次发行股份购买资产的股份发行数量也将做出相应处理。

按照本次交易的交易价格以及本次发行股份购买资产的发行价格，本次交易上市公司将向交易对方支付股份对价金额共计 558,469.55 万元，发行数量共计 248,650,730 股，具体如下：

交易对方	权益比例	交易对价 (万元)	交易对价支付方式				股票发行数量（股）
			股份对价 (万元)	股份对 价占比	现金对价 (万元)	现金对 价占比	
购买北京矽成 59.99%股权							
屹唐投资	34.44%	247,967.83	136,010.36	54.85%	111,957.48	45.15%	60,556,704
华创芯原	11.08%	79,781.46	51,781.46	64.90%	28,000.00	35.10%	23,054,968
上海瑾矽	4.62%	33,230.77	33,230.77	100.00%	-	-	14,795,533
民和志威	3.92%	28,248.33	28,248.33	100.00%	-	-	12,577,174
闪胜创芯	3.78%	27,252.00	27,252.00	100.00%	-	-	12,133,570
Worldwide Memory	1.78%	12,806.75	12,806.75	100.00%	-	-	5,702,027
Asia Memory	0.21%	1,491.80	1,491.80	100.00%	-	-	664,200
厦门芯华	0.16%	1,150.07	1,150.07	100.00%	-	-	512,053
小计	59.99%	431,929.02	291,971.54	67.60%	139,957.48	32.40%	129,996,229
购买上海承裕 100%财产份额							
武岳峰集电	49.24%	141,870.13	135,982.52	95.85%	5,887.61	4.15%	60,544,310
上海集岑	41.97%	120,915.49	120,915.49	100.00%	-	-	53,835,926
北京青禾	5.45%	15,708.30	-	-	15,708.30	100.00%	-
万丰投资	3.33%	9,601.06	9,600.00	99.99%	1.06	0.01%	4,274,265
承裕投资	0.0027%	7.85	-	-	7.85	100.00%	-
小计	100.00%	288,102.84	266,498.01	92.50%	21,604.82	7.50%	118,654,501
合计	-	720,031.86	558,469.55	77.56%	161,562.30	22.44%	248,650,730

本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的股数为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。

（三）发行股份募集配套资金

为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，公司拟采取询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过150,000.00万元的配套资金。其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的50%。

本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）的100%，且根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。刘强控制的企业四海君芯不参与询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量=募集配套资金总金额÷发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易部分现金对价、投入北京矽成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。截至2019年5月31日，公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及相关利息和现金管理收益余额为48,365.53万元。其中，公司除尚需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金2,124.17万元外，剩余募集资金和超募资金无明确使用计划。经公司第四届董事会第七次会议审议，公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息（含现金管理收益）合计45,613.30万元用以支付本次交易的部分现金对价。该事项已经上市公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

四、本次交易构成重大资产重组

本次交易中，标的资产为北京矽成59.99%股权、上海承裕100%财产份额，合计交易价格为720,031.86万元。此外，本次重大资产重组前12个月，公司投资了深圳吉迪思电子科技有限公司。吉迪思主要从事智能设备显示主控芯片的设计、研发及相关电子产品的销售，与本次重组的标的公司北京矽成下属企业属于同一行业。根据《重组管理办法》，公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算，相关财务指标占比情况计算如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	营业收入	资产净额与交易金额孰高
本次交易-购买北京矽成59.99%股权及上海承裕100%财产份额	720,031.86	287,724.41	720,031.86
前次交易-投资吉迪思5.8824%股权	1,000.00	3.11	1,000.00
合计	721,031.86	287,727.52	721,031.86
上市公司财务数据	115,676.00	18,446.70	112,482.76
财务指标占比	623.32%	1,559.78%	641.02%

是否构成重大资产重组	是	是	是

根据《重组管理办法》及上表，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的情形，因此需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

五、本次交易构成关联交易

本次交易/本次收购完成后，发行股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

因此，本次交易构成关联交易。

六、本次交易不构成重组上市

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03%和 12.73%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、四海君芯认购配套融资的 50%测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

因此，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司实际控制人不会发生变化，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

七、业绩承诺与补偿安排

上市公司与业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，主要内容如下：

（一）业绩承诺期

本次交易中，业绩承诺方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度，即 2019 年、2020 年和 2021 年。如监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，双方协商后签署补充协议予以确认。

（二）承诺净利润数及实际净利润数

业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元（以下简称“承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承诺净利润累计数”）。

如监管部门在审核中要求对业绩承诺期及承诺净利润数进行调整，由双方另行协商并签署补充协议。

在业绩承诺期内的每个年度单独披露北京矽成经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“实际净利润数”，业绩承诺期内各年度的实际净利润数合计称“实际净利润累计数”）及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。

为避免争议，双方理解并确认，本协议项下以专项审核的净利润数作为确定业绩承诺方是否需要承担补偿义务的依据。

双方同意，承诺净利润数和实际净利润数应不考虑以下事项的影响：（1）Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；（2）北京矽成因实施股权激励所产生的费用；（3）北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；（4）配套募集资金投资项目损益。

（三）盈利补偿及其方案

业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，即视为未实现业绩承诺，则业绩承诺方承诺将根据本协议约定的条款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分，以股份、

现金或股份与现金相结合的方式补偿。

补偿计算公式：

（1）业绩承诺期届满后，若北京矽成未实现业绩承诺，业绩承诺方中各方应补偿金额及应补偿股份数量的计算方式具体为：

应补偿金额=（承诺净利润累计数－实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×业绩承诺方中各方对应的交易对价

应补偿股份数量=（应补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

其中，“发行价格”为本次发行股份购买资产的发行价格；“业绩承诺方中各方对应的交易对价”为于本次交易项下向业绩承诺方支付的对价金额；依据上述公式计算应补偿股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

（2）业绩承诺方中各方以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，独立、非连带地履行补偿义务。

若业绩承诺方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且已就该等股份于业绩承诺期内自上市公司获得了现金股利，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量；若上市公司在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按前述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。

其中，依据上述公式计算回购股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

（四）减值测试及补偿

业绩承诺期届满时，上市公司应当聘请由双方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产（为本协议之目的，具体指北京矽成 100%股权，下同）进行减值测试，并出具专项审核意见。

经减值测试，如标的资产期末减值额>已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），业绩承诺方应对上市公司另行补偿。另需补偿的金额为：

标的资产期末减值额－已补偿股份总数×发行价格－现金补偿金额。业绩承诺方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体业绩承诺方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。业绩承诺方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式且独立、非连带地履行补偿义务；另需补偿的股份数量为：（另需补偿的金额－另需现金补偿金额）÷发行价格。

其中，依据上述公式计算另需补偿的股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

“标的资产期末减值额”为本次交易项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

为免歧义，双方确认，业绩承诺方中各方在本协议项下的补偿总额以其于本次交易项下取得的交易对价金额有限，业绩承诺方中各方均独立、非连带地履行补偿义务。

（五）业绩承诺合理性及减值测试说明

1、业绩承诺设置的原因及合理性

（1）本次交易系同行业市场化第三方收购

《重组管理办法》第三十五条规定：“上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，不适用本条前二款规定，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排。”

本次交易中交易对方不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，且本次交易完成后上市公司实际控制人不会发生变化，属于同行业市场化的第三方并购。经交易各方商业谈判，根据市场化原则并基于对上市公司及中小股东的利益保护，部分交易对方进行了业绩承诺及补偿安排。

（2）集成电路行业存在周期性波动特点

由于集成电路产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个集成电路行业具有周期性波动的特点。近年来，随着集成电路产品技术革新的不断

加快，新技术、新工艺在集成电路产品中的应用更加迅速，进而导致集成电路产品的生命周期不断缩短，且行业周期性波动的频率要较经济周期更为频繁。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则北京矽成的经营业绩可能受到负面影响。

本次交易中设置承诺净利润的 85%作为业绩补偿触发条件，是交易相关方基于对集成电路行业波动性特点的深入了解与北京矽成所面临行业风险的理解和判断，为合理有效激励业绩补偿方及北京矽成管理团队达成业绩目标、履行业绩补偿承诺所作出的合理安排。

（3）业绩承诺补偿方案符合上市公司本次交易目的

本次交易属于同行业优质企业的整合收购，上市公司较为注重并购北京矽成后的业务整合及协同、未来战略发展和产业布局等。交易完成后，上市公司可以充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位，同时还可充分利用 ISSI 多年积累的优质国际客户资源，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，增强上市公司的行业竞争力。

因此，在进行业绩承诺方案的谈判时，上市公司充分考虑本次交易的商业诉求，同时结合交易对方实际客观情况，各方多次讨论并协商确定包括承诺净利润累计考核、补偿触发比例、承诺净利润数及实际净利润数除外因素等的业绩承诺及补偿方案。

基于上述，依据市场化原则，结合本次交易目的、交易对方实际情况等，上市公司与交易对方经充分协商和谈判并确定本次交易的业绩承诺补偿方案，符合本次交易的目的及交易各方的利益。

（4）业绩承诺补偿方案有利于保护上市公司和中小股东的利益

为保护中小投资者的合法权益，上市公司审议本次交易的股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，同时为尊重中小投资者利益，充分保护其合法权益，与本次股东大会审议事项存在关联关系的股东刘强、李杰和冼永辉对本次股东大会审议的议案回避表决。结果表明，中小股东以同意票占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数 100%的方式通过了《关于公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金方案的议案》。同时，上市公司独立董事已就本次交易发表独立意见，认为本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

综上所述，本次交易不涉及向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人购买资产，且本次交易未导致上市公司控制权发生变更，相关业绩承诺与补偿安排是交易双方充分谈判及自主协商的结果，符合《重组管理办法》的有关规定，符合上市公司本次交易目的且有利于保护上市公司和中小股东的利益，业绩承诺补偿安排具备合理性。

（5）业绩承诺设置情况及合理性

本次交易对应北京矽成整体交易作价为 72 亿元，交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原作为业绩承诺方，承诺北京矽成在 2019 年至 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数不低于 1.92 亿美元（不考虑 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益，股权激励费用，因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销以及配套募集资金投资项目损益）。

选取近期集成电路芯片行业 A 股上市公司收购案例作为可比交易案例，同时考虑市场化交易因素，业绩承诺覆盖情况如下：

序号	上市公司	标的资产	业绩承诺方持股占比	业绩承诺金额覆盖比例	业绩承诺整体覆盖比例
1	上海贝岭 (600171.SH)	锐能微 100%股权	100.00%	16.78%	16.78%
2	亚光科技 (300123.SZ)	亚光电子 97.38%股权	0.00%	0.00%	0.00%
3	皖通科技 (002331.SZ)	赛英科技 100%股权	60.00%	26.05%	15.63%
4	兆易创新 (603986.SH)	思立微 100%股权	100.00%	18.88%	18.88%
5	同有科技 (300302.SZ)	鸿秦科技 100%股权	100.00%	35.34%	35.34%
6	韦尔股份 (603501.SH)	北京豪威 85.53%股权	62.88%	16.53%	10.40%
		思比科 42.27%股权	15.42%	46.11%	7.11%
		视信源 79.93%股权	89.99%	12.05%	10.84%

序号	上市公司	标的资产	业绩承诺方持股占比	业绩承诺金额覆盖比例	业绩承诺整体覆盖比例
7	闻泰科技 (600745.SH)	间接收购安世集团 64.67%股权	0.00%	0.00%	0.00%
平均值			58.70%	19.08%	11.20%
中位值			62.88%	16.78%	10.55%
本次交易			65.22%	18.78%	12.25%

注 1：由于本次交易为第三方并购，不属于《重组管理办法》要求进行业绩承诺的情形，因此上述案例统计中剔除了实际控制人及关联方进行业绩承诺的部分。

注 2：业绩承诺方持股占比=业绩承诺方直接及间接持有标的资产股份比例；业绩承诺金额覆盖比例=业绩承诺金额合计数×收购比例÷交易对价；业绩承诺整体覆盖比例=业绩承诺方持股占比×业绩承诺金额覆盖比例。

本次交易中业绩承诺方合计权益比例为 65.22%，业绩承诺整体覆盖比例为 12.25%，均高于市场平均水平；业绩承诺金额占交易对价的覆盖比例为 18.78%，与市场平均水平相近。

业绩承诺达标考核方面，本次交易经各方商业谈判后设置实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%作为业绩补偿的触发条件，触发后应补偿金额=（承诺净利润累计数—实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×业绩承诺方中各方对应的交易对价。市场案例方面，益丰药房（603939.SH）收购新兴药房 86.31%股权时采用 90%作为业绩补偿触发比例，并于 2018 年 10 月通过中国证监会审核；鼎龙股份（300054.SZ）收购北海绩迅 59%股权亦采用 95%作为业绩补偿触发比例，并于 2019 年 9 月通过中国证监会审核。因此，设置业绩补偿触发比例作为达标考核要求系交易各方综合考虑法规要求、利益均衡、市场案例等因素后进行商业谈判的结果，具备相应的合理性。

2、业绩承诺净利润剔除因素的具体金额、原因及合理性

本次交易中经各方商业谈判设置了北京矽成业绩承诺补偿条款，屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元，且不考虑以下事项的影响：（1）Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；（2）北京矽成因实施股权激励所产生的费用；（3）北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；（4）配套募集资金投资项目损益。不考虑前述事项的具体情况、原因及合理

性如下：

（1）Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务损益情况及不含在本次业绩承诺中的合理性

北京矽成于 2018 年收购 ISSI(Israel) 与 Chiefmax (BVI)，对应获得了 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务。该部分业务技术水平较高，能够对北京矽成现有业务体系形成良好的扩展和补充，但目前相关研发成果处于开发验证测试阶段，尚未实现量产。根据北京矽成管理层预测，该部分业务在业绩承诺期损益情况如下：

单位：万美元

项目	2019 年	2020 年	2021 年
净利润影响额	-1,225.75	-912.75	-177.48

上述 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务系北京矽成 2018 年通过行业并购获取的新业务，对应设计能力及技术水平具有长期的竞争力，但目前仍处于技术开发与成果转化阶段，预计自其被收购完成之日起 3-4 年后实现扭亏为盈，后续形成稳定的利润收入。由于目前相关研发成果未实现量产，虽然预计后续盈利能力较强，但准确进行盈利预测难度较大，且这部分业务独立，因此本次交易中承诺净利润数未考虑 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益。

（2）北京矽成业绩承诺期股权激励情况及不含在本次业绩承诺中的合理性

北京矽成 2017 年 12 月制定了股权激励计划，形成股份支付费用总额 1,814.25 万美元。北京矽成根据员工服务期限分别于 2017、2018、2019 年按照 40%、30%、30% 的比例摊销至股份支付费用中，2017、2018 年和 2019 年计入费用的金额分别为 725.70 万美元、544.28 万美元、544.28 万美元。因此股权激励事项仅影响业绩承诺期中北京矽成 2019 年的利润情况，考虑所得税因素后影响金额约为 462.63 万美元。

上述股权激励事项系北京矽成在 ISSI 私有化退市后对原 ISSI 上市股权激励计划终止的替代性股权激励计划，属于一次性事项，因此本次交易中承诺净利润数未考虑北京矽成因实施股权激励所产生的费用。

(3) 北京矽成收购 ISSI 对应 PPA 情况及不含在本次业绩承诺中的合理性

北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购，私有化完成后北京矽成通过架构调整将 ISSI Cayman、SI EN Cayman 由 ISSI 的子公司调整为兄弟公司。

2015 年 12 月，北京矽成完成对 ISSI 的全资收购后，ISSI 报表中含有因该次收购时可辨认公允价值相对于账面成本的增值部分，即无形资产、固定资产和存货的增值。其中，存货增值在 2016 年随着存货的周转确认为当期营业成本，后续影响北京矽成利润的资产增值摊销主要来自于无形资产、固定资产两个会计科目，业绩承诺期内对应金额如下：

单位：万美元

项目	2019 年	2020 年	2021 年
资产增值年摊销额 (ISSI)	975.13	971.70	966.56

上述资产增值摊销系北京矽成收购 ISSI 所致，与北京矽成业务经营情形的关联关系较小，不影响北京矽成未来的现金流，亦不影响北京矽成的评估值。本次交易系同行业市场化第三方收购，业绩承诺补偿安排系经交易各方商业谈判达成，承诺净利润数未考虑北京矽成因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销，具有合规性。

在核查业绩承诺是否完成时，可直接将报表净利润与因收购 Integrated Silicon Solution, Inc. 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值形成的实际折旧摊销额之和与业绩承诺金额进行对比（即差额=净利润+因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值形成的实际折旧摊销额—业绩承诺金额），具有可操作性。

综上所述，业绩承诺不考虑北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc. 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销具有合规性和可操作性。

(4) 配套募集资金投资项目损益情况及不含在本次业绩承诺中的合理性

本次募集配套资金总额不超过 15.00 亿元，其中 11.59 亿元用于支付本次交易部分现金对价，3.41 亿元投入面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目、

面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目。以上两个募投项目的建设期均为 5 年，预计税后投资回收期分别为 6.78 年、6.90 年，税后内部收益率分别为 17.72%、17.68%。募投项目系上市公司募集资金投入建设，是上市公司为实现重组后的总体战略发展而进行的业务发展规划的一部分，应与北京矽成现有经营主体进行区分，因此本次交易中承诺净利润数未考虑配套募集资金投资项目损益。

3、其他方不参与业绩对赌的合理性以及现有承诺主体履行业绩补偿的能力

本次交易中经各方商业谈判，为充分保护上市公司及中小股东利益，上市公司与业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署了《盈利补偿协议》，屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原作为业绩承诺方参与本次交易。

（1）其他方未作为业绩承诺方的合理性

①本次交易为第三方并购

本次交易属于同行业市场化的第三方并购，法规未要求全部交易对方进行业绩承诺及补偿安排，近期过会的闻泰科技收购安世半导体、北汽蓝谷收购北汽新能源案例中所有交易对方均未进行业绩承诺。因此经各方商业谈判，根据市场化原则并保护上市公司及中小股东利益，本次交易中部分交易对方对北京矽成进行了业绩承诺及补偿安排。

②业绩承诺方为北京矽成的主要投资方

本次交易业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电及华创芯原系北京矽成主要投资方，对北京矽成的经营情况影响力较强。

北京矽成实际经营主体为原纳斯达克上市公司 ISSI。2015 年 3 月，北京京存、武岳峰浦江、北京集成、华清基业与北京闪胜签署《关于北京闪胜投资有限公司之投资协议》，约定各方以其关联方（各方后续确定关联方分别为屹唐投资、上海承裕、华创芯原、华清闪胜）共同投资北京闪胜，并通过北京闪胜私有化收购 ISSI。本次交易中业绩承诺方均为私有化期间的主要投资者（华清闪胜后续将所持股份转让予屹唐投资、上海承裕及民和志威），而武岳峰集电不仅是上海承裕的第一大有限合伙人，同时也是上海承裕的 GP 承裕投资的控股股东。本次交易中，除业绩承诺方外，其他交易对方均未参与私有化收购 ISSI。

北京矽成为中外合资企业，董事会为其最高权力机构，现任七名董事中除两名 ISSI 管理层董事为各方联合委派外，张建勋、王东生系屹唐投资委派，武平、潘建岳系武岳峰控制的上海承裕委派，刘越系华创芯原委派。本次交易中，除业绩承诺方外，其他交易对方均未委派董事。

综合考虑法规要求、市场案例及北京矽成经营情况，并基于本次交易商业谈判结果，本次交易设置业绩承诺方为屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电，其他方不参与业绩承诺与补偿，具备相应的合理性。

（2）现有承诺主体履行业绩补偿的能力

屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原作为本次交易的业绩承诺方，具备较强的履约能力，说明如下：

①本次交易的股份分期解锁安排

作为业绩承诺方，屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原在本次购买资产项下取得的公司新增股份自发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月期满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量－第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

上述股份分期解锁安排与业绩补偿同步，有利于保障业绩承诺方履行业绩补偿义务。

②本次交易盈利补偿协议的违约责任

根据上市公司（甲方）与业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原（乙方）签署的《盈利补偿协议》，违约责任如下：

“1.一方未履行或部分履行本协议项下的义务给对方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。

2.各方明确，乙方各成员相互独立，均独立履行义务并承担责任。就本协议第七条约定的违约责任，除非另有明定，彼此间无任何连带、担保、保证、代理、代表法律关系。乙方任一名或数名成员违约，不代表、亦不视为乙方其他成员违约，相关违约方应独立承担违约责任，与未违约的乙方成员无关，未违约的乙方成员就违约行为不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其合法权益不因此受到损害。

3.乙方保证其于本次交易项下取得的甲方对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

如果乙方持有的在本次交易中认购的甲方股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于乙方对其持有的在本次交易中认购的甲方股份进行处分而导致其所持有的股份不足以完全履行本补偿协议项下补偿义务的，乙方应就股份不足补偿的部分以现金(应补偿未补偿股份数×发行价格)或其他方式进行足额补偿。”

上述违约责任条款经业绩承诺方认可并履行了内部流程审议通过，有利于保障业绩承诺方履行业绩补偿义务。

③业绩承诺方信用情况良好

根据中国人民银行征信中心出具的业绩承诺方企业信用报告，截至信用报告出具日，业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原不存在未按期偿还大额债务等失信行为。

业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原已经出具承诺函，业绩承诺方及高级管理人员最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

④业绩承诺方财务情况良好

业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原财务情况良好，其最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	屹唐投资	武岳峰集电	华创芯原
资产总额	186,635.27	571,952.38	69,399.87
负债总额	60,586.70	5,435.00	33,610.50
所有者权益合计	126,048.56	566,517.38	35,789.37
营业收入	12.97	19,715.50	-
净利润	178.73	11,034.85	3,594.76

综上所述，本次交易进行了股份分期解锁安排与业绩补偿违约责任条款的设置，业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原具备良好的诚信情况与财务情况，履行业绩补偿的能力较高。

4、关于对标的资产减值测试的情况

本次交易盈利补偿协议对应减值测试是对标的资产的专项减值测试，有利于保护上市公司利益；同时，上市公司也将于每年度终了对合并形成的商誉进行减值测试，符合《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及相关会计准则的规定，具体如下：

（1）盈利补偿协议的减值测试是对标的资产的专项减值测试

为保护上市公司的利益，本次交易的盈利补偿协议及补充协议约定业绩承诺期届满后，北京君正应当聘请由北京君正和业绩承诺方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对北京矽成 100%股权进行减值测试，并出具专项审核意见，经减值测试，如北京矽成期末减值额>已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），业绩承诺方应对上市公司另行补偿。

（2）北京君正将于每年末对商誉进行减值测试，符合《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及相关会计准则的规定

《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》规定：“第一，对因企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，都应当至少在每年年度终了进行减值测试。第二，公司应结合可获取的内部与外部信息，合理判断并识别商誉减值迹象。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，公司应及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。第三，公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。”

《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定：“企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。”

本次交易属于非同一控制下的企业合并，北京君正对本次合并成本与评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额，将确认为商誉。北京君正的会计政策约定，对于合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试，符合《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求。

5、关于业绩承诺方采取措施保障所获股份切实用于业绩补偿的相关安排

本次交易的业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原已作出《关于股份质押的声明及承诺函》：“本承诺人承诺，将以股份、现金或股份与现金相结合的方式履行业绩补偿义务；若选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，本承诺人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺。本承诺人保证，不通过质押股份等方式逃废补偿义务，未来在业绩承诺期内质押对价股份时，将书面告知质权

人根据《盈利补偿协议》及其补充协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”

此外，在购买资产协议及其补充协议中已明确载明，非经上市公司书面同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如业绩承诺方非经上市公司方同意质押、转让处于锁定期内的股份，应按购买资产协议规定承担相应的违约责任。

八、本次交易的报批事项

（一）本次交易已经履行的审批程序

1、上市公司及合肥君正决策过程

2018年11月9日，上市公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2018年11月9日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组事宜。

2019年5月16日，上市公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整的相关议案。

2019年5月16日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组方案调整的事宜。

2019年7月31日，上市公司召开第四届董事会第七次会议审议了本次重大资产重组方案的相关议案，相关董事回避表决相关议案后，剩余非关联董事人数不足3人，根据北京君正《公司章程》的规定，相关议案直接提交公司股东大会审议。

2019年7月31日，合肥君正出具股东决定和执行董事决定，同意本次重大资产重组事宜。

2019年9月9日，上市公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2、标的企业决策过程

本次交易的方案已经北京矽成、上海承裕内部权力机构审议通过。

3、交易对方决策过程

本次交易的方案已经全部交易对方的内部权力机构审议通过。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及《购买资产协议》，截至本报告书出具日，本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、中国证监会核准本次交易事项；
- 2、其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。

根据《购买资产协议》《股份认购协议》及本次交易方案，并结合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规，截至本报告书出具日，本次交易的生效除尚需取得中国证监会的核准外，不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。

（三）其他程序

1、CFIUS 及台湾投审会审查进展情况

根据境外律师就 CFIUS 及台湾投审会审查事宜出具的备忘录，本次交易不属于提交强制性 CFIUS 申报的交易、不属于适用法律明确规定应向台湾投审会提出事前申报的交易，即 CFIUS 及台湾投审会审查不属于本次交易的生效条件。为降低本次交易的不确定性，经交易各方协商，北京君正和北京矽成已就本次交易向 CFIUS、台湾投审会提交自愿性申报及审查。

根据 CFIUS 出具的案件审结函（Closing Letter）、台湾投审会出具的收文印章以及境外律师出具的备忘录：

CFIUS 已于 2019 年 10 月 23 日完成对本次交易的安全审查（action with respect to this transaction is concluded），确认不存在尚未解决的国家安全担忧（there are no unresolved national security concerns）；

台湾投审会已于 2019 年 10 月 18 日正式受理 ISSI 及 ISSI Cayman 提交的有关 ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司上层陆资股东架构变动申请，截至本

报告书出具日，台湾投审会审查正在进展过程中；台湾投审会陆资案件审查视个案复杂度通常需时 3 至 6 个月。

本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

2、台湾投审会审查不存在可合理预见的实质性障碍

（1）私有化收购 ISSI 时已取得台湾投审会的批准

2015 年，北京矽成完成私有化收购 ISSI 交易，私有化收购涉及的 ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司上层股东变动事项已取得台湾投审会的批准。根据台湾投审会出具的核准函，ISSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司被准予经营电子材料批发及零售业务。

根据北京矽成出具的书面说明及确认：“自私有化收购完成后，ICSI TW 及 ISSI Cayman 台湾分公司均在台湾投审会核准的业务经营范围开展经营活动，未开展或从事核准函准予业务之外的经营活动，符合陆资投资的有关规定及要求。同时，结合本次交易已通过 CFIUS 安全审查等客观事实，北京矽成合理预计，本次交易通过台湾投审会审查不存在可合理预见的实质性障碍。”

同时，根据境外律师出具的备忘录：“台湾投审会审批的目的与事项主要着重被投资公司（如台湾矽成）是否属于陆资正面表列之项目，亦会对于投资方背景及被投资公司未来营运计划进行相关了解。……由于本件卖方亦为陆资，鉴于前次私有化收购时已通过台湾投审会审查，且假设投资方在本交易案完成后，并无实质性改变台湾矽成业务范围及营业项目之计划，在台湾地区相关政策不发生重大调整的情况下，本交易案通过台湾投审会审查应不存在可合理预见的实质性障碍，除非台湾投审会对于新陆资投资人即投资方北京君正集成电路股份有限公司之身份（如股东结构是否有大陆官方机构、基金及其投资比例）有任何疑虑。”

（2）台湾地区经营主体的业务定位

北京矽成在台湾地区的主要经营主体包括 ISSI Cayman 台湾分公司及 ICSI TW。其中，ISSI Cayman 台湾分公司主要负责组织和实施北京矽成在台湾地区进行的相关采购、整理、暂存和运输等业务，不存在研发业务及对外销售。具体而言，ISSI Cayman 台湾分公司委托相应的供应商提供原材料、加工原材料或者

加工半成品，然后将相应的原材料和半成品暂存，之后将其销售给北京矽成在开曼的子公司。ICSI TW 主要负责为 ISSI Cayman 台湾分公司提供人力资源，以便 ISSI Cayman 台湾分公司实施上述业务，同时 ICSI TW 也负责 ISSI 的芯片在台湾地区的销售及客户服务。北京矽成台湾经营主体的上述业务属于台湾投审会核准函准予经营的业务。

（3）台湾地区经营主体的主要经营情况

报告期内，上述北京矽成在台湾地区经营主体合计的资产规模、采购规模、销售规模、员工人数及所占北京矽成比例情况如下：

单位：万美元、人

项目	2019 年 1-5 月/2019.5.31		2018 年/2018.12.31		2017 年/2017.12.31	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
总资产	25,072.80	26.27%	24,606.02	25.87%	25,995.22	28.31%
净资产	19,165.55	22.46%	18,736.34	22.11%	20,718.68	25.31%
销售金额	1,699.85	9.85%	4,863.25	11.21%	4,080.06	10.95%
采购金额	15,543.10	85.90%	37,499.77	84.01%	28,909.54	79.08%
员工人数	140	27.03%	137	27.08%	141	33.25%

由上表可知，北京矽成下属位于台湾的 ISSI Cayman 台湾分公司及 ICSI TW 主要职能为采购、整理、暂存、运输及部分销售服务，主要系北京矽成考虑晶圆代工等供应商主要分布在台湾、为方便业务沟通协调所致，人员、资产系根据采购及销售服务业务进行配置，涉及的对外销售占比较小。

（4）未通过台湾投审会审查对本次交易的影响

根据境外律师出具的备忘录：“投审会对陆资投资设有正面表列，该正面表列规定了陆资投资的业务范围，包括批发、零售等。倘投审会对案件有疑虑，通常会要求申请人提供更多信息或到会说明，亦有可能要求申请人签署相关承诺书或声明书，或者最终作成附条件之核准。就某些较为复杂之案件，投审会亦有可能与申请人讨论投审会能接受之方案，比如对申请人在台湾地区的投资方式和业务范围进行调整和变更，以继续其在台湾地区的投资和业务活动。若投审会认为相关补充信息、说明或承诺、声明不适当，则其有权暂停或者否决交易；若投审会做出暂停或者否决交易的决定，则可能导致申请人须暂定或终止在台湾地区的投资和业务活动。”

根据北京君正及北京矽成于 2019 年 10 月出具书面说明及承诺：“若台湾投审会在审查本次交易过程中提出相关要求，北京君正及北京矽成将尽最大努力予以配合，包括但不限于补充提供文件资料、回复问题、签署必要文件、作出相关承诺或说明以及采取认可的相关业务调整措施等，尽力促使本次交易通过台湾投审会审查。”

此外，根据北京君正的书面说明，若本次交易未通过台湾投审会审核，上市公司将及时进行相关业务布局调整，鉴于 ISSI 在台湾的业务主要为采购和市场销售，相关调整预计不会对本次交易完成后上市公司及 ISSI 的业务经营造成重大不利影响。

综上所述，本次交易的生效除需取得中国证监会的核准外，不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。截至本报告书出具日，CFIUS 审查已经完成，台湾投审会审查正在进展过程中，结合境外律师出具的备忘录，该等审查应不存在可合理预见的实质性障碍；北京君正及北京矽成已承诺尽最大努力配合，尽力促使本次交易通过台湾投审会审查。但如果发生极端情况，本次交易最终未通过台湾投审会审核，可能会影响北京矽成在台湾地区的业务经营活动，公司和北京矽成已确认将根据相关要求采取适用和可行措施对业务进行调整，前述调整不会对本次交易构成重大不利影响。

九、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析

1、本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应及互补效应。报告期内，上市公司致力于在中国研制自主创新 CPU 技术和产品，基于自主 CPU 技术发展了面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的两条产品线，并且已形成可持续发展的梯队化产品布局。北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。在质量管控方面，北京矽成已基于产品研发、晶圆采购、封测代工、品质验证及售后服务各环节形成了整套经营模式及管控体系，上市公司在业务性质、内部流程上相类似，在质量管控方面可以进行有效对接，从而保持长期的稳健发展。在技术研发方面，上市公司可借鉴北京矽成多年的研发经验及团队实力，夯实其在芯片设计领域的综合研发能力，有利于更好地立足本土、着眼全球，开拓新兴的市场机会。在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。在客户及市场规模方面，本次交易完成后公司可充分利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源，增加彼此合作机会，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力。

2、本次交易对上市公司业务的影响

（1）本次交易对上市公司业务构成的影响

本次交易前，北京君正主营微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发与销售，本次交易标的公司北京矽成主营存储芯片、模拟芯片的研发与销售。

根据信永中和会计师出具的北京君正备考财务报表审阅报告，假设北京君正于 2018 年 1 月 1 日完成对北京矽成及上海承裕的合并，北京君正 2018 年、2019 年 1-5 月的主营业务收入构成及占比情况如下：

单位：万元

交易前				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
微处理器芯片	5,442.94	47.65%	14,482.46	58.16%
智能视频芯片	5,799.22	50.77%	9,948.55	39.95%
技术服务	119.19	1.04%	115.22	0.46%
其他	60.74	0.53%	354.47	1.42%

合计	11,422.08	100.00%	24,900.70	100.00%
交易后				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
存储芯片	105,537.40	82.49%	259,691.21	83.07%
模拟芯片	10,983.52	8.58%	28,033.20	8.97%
微处理器芯片	5,442.94	4.25%	14,482.46	4.63%
智能视频芯片	5,799.22	4.53%	9,948.55	3.18%
技术服务	119.19	0.09%	115.22	0.04%
其他	60.74	0.05%	354.47	0.11%
合计	127,943.00	100.00%	312,625.11	100.00%

本次交易完成后，北京君正将新增存储芯片和模拟芯片的研发和销售。由于北京矽成的芯片主要运用于汽车电子、工业制造、消费电子等领域，因此，本次交易既将丰富上市公司的产品类别，带动公司芯片设计整体技术水平的提升，又将为上市公司带来新领域的优质客户资源。

（2）本次交易对上市公司经营发展战略的影响

上市公司坚持“创新技术、自主研发”的技术战略和“开放平台、纵横扩展”的市场战略。在技术上，公司将不断加强研发力度，持续进行技术创新，密切关注产业发展动向，及时布局产业的关键性核心技术，根据市场变化进行新产品的规划与研发。在市场上，充分发挥自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，积极寻找和拓展适合公司产品的市场领域，及时跟进新市场，抓住未来新兴产业机会，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

未来，公司将统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。上市公司业务具体发展规划如下：

①公司将持续加大研发投入，不断加强技术研发和技术创新能力，根据市场的需求情况持续进行相关核心技术的开发，适时展开新兴领域新技术的跟踪与研究工作，进行相应的产品设计、研发。

②公司将不断加强市场宣传与推广力度，深入挖掘各类市场的发展机会，结合公司产品优势与特点，在各个应用领域积极进行产品推广和客户拓展，及时跟进市场变动和客户产品的需求情况，根据市场需求情况对新产品进行规划和定义。

③公司将不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才培养，努力提高公司研发工作效率、提高公司整体管理水平。

（3）本次交易对上市公司业务管理模式的影响

本次交易完成后，在维持上市公司现有管理模式、决策程序及发展规划不变的前提下，公司将以符合上市公司规范运作的相关要求对标的公司进行管理，完善北京矽成的公司治理。同时，上市公司在企业文化、团队管理、业务和技术以及财务与管理体系等方面进行整合，促使上市公司与标的公司在本次交易完成后快速实现内部整合，尽快实现彼此的协同效应，保证本次重组后上市公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

3、本次交易对上市公司的资产负债及财务安全性影响

（1）本次交易对上市公司的资产负债的影响

本次交易前，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资，其合计分别占报告期各期末总资产的 85.79%、85.34%和 85.78%；主要负债为应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、递延收益，其合计分别占报告期各期末总负债的 100.00%、100.00%、97.34%；报告期各期末，上市公司的资产负债率分别为 2.76%、4.68%、4.84%。

根据信永中和出具的北京君正备考财务报表审阅报告，本次交易完成后，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、无形资产和商誉，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总资产的 81.15%和 88.43%；主要负债为应付账款、其他应付款和递延所得税负债，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总负债的 88.51%和 88.89%；截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日，上市公司的资产负债率分别为 27.18%和 26.97%。

截至 2018 年 12 月 31 日，可比公司紫光国微、全志科技、国科微和兆易创新的平均资产负债率为 29.58%，中位数为 33.65%。由此可见，本次交易完成后，上市公司的资产负债率仍低于行业平均水平，长期偿债能力较强。

（2）本次交易对上市公司的财务安全性影响

根据备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司资产负债率低于行业平均水平，偿债能力较强；上市公司及标的公司不存在大额预计负债或或有负债，无短期借款、长期借款等有息债务，财务安全性较高。

同时，本次交易拟募集配套募集资金不超过 15 亿元，若能足额募集，则上市公司可利用部分募集配套资金优化上市公司的资本结构；若无法足额募集，则可能为支付现金对价及建设标的公司募投项目而新增负债，进而加大财务风险。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响分析

1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面对上市公司未来发展的影响

根据上市公司的发展规划，未来 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 仍将保持其作为独立的境外法人经营实体存续，并由其原核心管理团队继续经营管理，上市公司将在认真客观地分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，力争做到既能保持各自原有的竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。上市公司拟将采取以下措施：

（1）业务整合

本次交易完成后，上市公司将整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术、客户资源和销售渠道的共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与北京矽成相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强整体的盈利能力和持续竞争力。

（2）资产整合

本次交易完成后，标的公司将继续保持资产的独立性，上市公司将通过完善的管理机制和风控体系促进标的公司资产的优化配置，提高资产的使用效率。

（3）财务及管理体系整合

本次交易完成后上市公司取得北京矽成及上海承裕的控制权，上市公司将在保持标的公司独立运营、核心团队稳定的基础上将其纳入整体经营管理体系和财务管理体系，实现优势互补，提高上市公司整体的资金使用效率，实现内部资源的统一管理和优化配置。

（4）人员及机构整合

北京矽成下属经营实体拥有经验丰富的经营管理团队和成熟稳定的业务团队，上市公司将努力维持其原有经营管理团队和业务团队的稳定，为管理层保留较大程度的自主经营权，以使北京矽成经营管理团队的能力得到充分发挥。

2、交易当年和未来两年拟执行的发展计划

本次交易完成后，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力。

（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析

1、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据信永中和会计师出具的北京君正备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务指标比较如下：

项目	2019年5月31日 /2019年1-5月		2018年12月31日 /2018年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考)	本次交易前	本次交易后 (备考)
资产总额（万元）	124,785.26	920,630.99	119,798.02	909,860.44
归属于母公司股东权益 （万元）	118,743.58	671,083.71	114,192.69	661,321.91
营业收入（万元）	11,788.38	128,309.30	25,967.01	313,691.42
利润总额（万元）	3,200.68	10,063.41	1,381.76	10,108.61
归属母公司所有者的净 利润（万元）	3,183.71	8,766.68	1,351.54	8,506.51
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.1950	0.0674	0.1894

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水

平、每股收益均将有所提升，上市公司财务状况、盈利能力得以增强。

2、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，其未来的资本性支出计划将纳入上市公司未来的年度计划、发展规划中统筹考虑。为实现顺利整合或业务的进一步发展，可能需要新增与标的公司相关的资本性支出，上市公司将按照《公司章程》履行必要的决策和信息披露程序。

3、本次交易职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及标的公司的职工安置方案。

4、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易成本主要包括与本次交易相关的税费以及聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构费用。本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，处于合理区间。

5、本次交易预计形成的商誉金额

本次交易系北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金方式购买北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，合计交易作价 720,031.86 万元。本次收购完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成归属于母公司可辨认净资产公允价值为 368,684.95 万元（不含北京矽成账面商誉，含北京矽成可辨认资产及负债公允价值增值部分），考虑递延所得税负债 8,203.23 万元的影响，本次重组交易之合并成本与对应享有北京矽成可辨认净资产公允价值并考虑递延所得税后之间的差额 359,550.13 万元，即为上市公司本次收购预计形成的商誉。

（四）本次交易对上市公司股权结构的影响分析

1、本次交易不会变更上市公司实际控制人

本次交易前，上市公司的总股本为 202,037,984 股（截至 2019 年 9 月 30 日

上市公司总股本），刘强、李杰为公司控股股东和实际控制人。本次交易上市公司拟向交易对方发行 248,650,730 股股份，同时按照北京君正发行前总股本 20% 考虑募集配套资金，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 **491,096,310** 股。本次交易完成前后公司的股权结构如下：

股东名称	交易前		交易后（不考虑募集配套资金）		交易后（考虑募集配套资金）	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘强	4,047.55	20.03	4,047.55	8.98	4,047.55	8.24
四海君芯	-	-	-	-	2,020.38	4.11
刘强及四海君芯持股小计	4,047.55	20.03	4,047.55	8.98	6,067.93	12.36
李杰	2,572.80	12.73	2,572.80	5.71	2,572.80	5.24
实际控制人小计	6,620.36	32.77	6,620.36	14.69	8,640.74	17.59
屹唐投资	-	-	6,055.67	13.44	6,055.67	12.33
武岳峰集电	-	-	6,054.43	13.43	6,054.43	12.33
上海集岑	-	-	5,383.59	11.95	5,383.59	10.96
华创芯原	-	-	2,305.50	5.12	2,305.50	4.69
上海瑾矽	-	-	1,479.55	3.28	1,479.55	3.01
民和志威	-	-	1,257.72	2.79	1,257.72	2.56
闪胜创芯	-	-	1,213.36	2.69	1,213.36	2.47
Worldwide Memory	-	-	570.20	1.27	570.20	1.16
万丰投资	-	-	427.43	0.95	427.43	0.87
Asia Memory	-	-	66.42	0.15	66.42	0.14
厦门芯华	-	-	51.21	0.11	51.21	0.10
其他上市公司股东	13,583.44	67.23	13,583.44	30.14	15,603.82	31.77
合计	20,203.80	100.00	45,068.87	100.00	49,109.63	100.00

注 1：以上测算以截至 2019 年 9 月 30 日上市公司的股权结构为依据。下同。

注 2：以上测算按照配套募集资金发行数量为发行前的 20%（4,040.76 万股）、四海君芯认购配套融资的 50% 进行。

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03% 和 12.73% 股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77% 股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上

市公司股份发行价格、四海君芯认购配套融资的 50%测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

2、交易对方无意谋求上市公司控制权

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方主要为财务性投资者，无意谋求上市公司控制权，其均出具了关于不谋求上市公司控制权的声明及承诺，具体承诺内容详见重大事项提示“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”。交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

3、实际控制人承诺不主动放弃控制权

为维护上市公司的控制权稳定，实际控制人刘强和李杰出具承诺（具体承诺内容详见重大事项提示“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”），将在本次交易完成后 60 个月内，不主动放弃上市公司控制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权；将积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利等，努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力，如有必要将不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维护上市公司控制权稳定。

4、本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，刘强和李杰仍为上市公司实际控制人

（1）本次交易前后，刘强和李杰始终为上市公司持股比例最高的股东

本次交易前，刘强和李杰两人作为一致行动人共同拥有公司的实际控制权，两人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

本次交易完成后，不考虑配套融资情形，刘强和李杰将持有、实际支配上市公司 14.69%股份；考虑配套融资情形（按照北京君正发行前总股本 20%暨发行股份上限测算），刘强和李杰将持有、实际支配上市公司 17.59%股份。

基于上述，且根据《重组监管问答》有关规定，本次交易完成后，无论是否

考虑配套融资情形，上市公司实际控制人刘强和李杰持有、实际支配的股份均高于其他股东。

（2）本次交易前后，刘强和李杰始终对上市公司董事会及高管、重大事项决策及经营管理等有决定性影响

根据北京君正《公司章程》等上市公司内部规章制度、股东大会决议、董事会决议等文件资料，以及北京君正、刘强、李杰及各交易对方出具的书面说明及确认，本次交易前后，刘强和李杰始终对上市公司董事会及高管、重大事项决策及经营管理等有决定性影响，具体说明如下：

①刘强和李杰对上市公司董事会及高级管理人员有重大及实质性影响

A. 交易前刘强、李杰的影响情况

本次交易前，北京君正董事会由 6 名董事组成，非独立董事为刘强、李杰、张紧、冼永辉，独立董事为王艳辉、梁云凤，该等董事均由北京君正上一届董事会提名。非独立董事中，刘强和李杰为北京君正控股股东、实际控制人，张紧、冼永辉为跟随刘强创办北京君正的核心人员，四人均自北京君正创立之初即担任董事或副经理职务，其中，刘强作为北京君正创始人，始终担任北京君正董事长。

本次交易前，北京君正设总经理 1 名、副总经理 7 名（包括董事会秘书 1 名，财务总监 1 名），其中，总经理、董事会秘书由董事会聘任，副总经理、财务总监经总经理提名，由董事会聘任。其中，刘强作为北京君正创始人，始终担任北京君正总经理，是北京君正最核心的管理、技术人员，全面负责北京君正日常的经营管理及技术研发，对北京君正的业务经营发挥着至关重要的作用。刘强作为总经理，可提名北京君正历任副总经理、财务负责人等高级管理人员。截至本报告书出具日，北京君正的高级管理人员为张紧、冼永辉、张敏（兼任董事会秘书）、周生雷、叶飞（兼任财务总监）、黄磊和刘将，其中，张紧、冼永辉自北京君正创立以来一直受聘任公司副总经理。

B. 交易相关方对于交易完成后北京君正治理情况的说明

交易对方、上市公司以及刘强、李杰已就交易完成后北京君正治理相关情况出具书面说明，主要内容如下：

本次交易完成后，1) 董事会构成方面，公司本届董事会成员拟由 6 名调整至 9 名（含 3 名独立董事），其中刘强提名 1 名增补独立董事，交易对方合计提名 2 名增补非独立董事，刘强和李杰担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3；

就公司下一届董事会，刘强和李杰拟提名 7 名董事，其中非独立董事不少于 4 名，全体交易对方合计提名 2 名董事，即刘强和李杰提名的董事人数超过董事会总人数的 2/3、提名的非独立董事人数达到董事会非独立董事总人数的 2/3，且公司董事长仍由刘强担任。

2) 高级管理人员提名及聘任方面，现行《公司章程》中关于高级管理人员提名、聘任、解聘的相关规定保持不变，且北京君正总经理仍由刘强担任，刘强有权根据实际经营需要提名公司副总经理、财务总监等高级管理人员。

C. 交易完成后刘强、李杰的影响情况

基于上述，本次交易完成后，上市公司董事会成员将新增交易对方提名人员，刘强和李杰担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3，其中刘强仍任公司董事长，能够对北京君正董事会一般及重大事项表决、日常经营管理活动形成控制及决定性影响；此外，刘强仍兼任公司总经理，可提名除董事会秘书以外的全部高级管理人员，公司董事会决定高级管理人员的聘任和解聘，因此，刘强和李杰对北京君正高级管理人员的提名及任免也具有重大及实质性影响。

② 刘强和李杰对上市公司重大事项决策有重大及实质性影响

本次交易前，北京君正已根据相关法律法规的要求依法建立股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等内部规章制度，形成了较为规范的公司运作体系，并严格按照上市规则和内部规章及治理制度进行重大事项审议和决策。

本次交易完成后，北京君正仍将保持及沿用现行的公司治理体系及规章制度。如前所述，本次交易完成后，在股东大会层面，刘强和李杰持有、实际支配的公司股份表决权比例最高，仍为北京君正控股股东、实际控制人；在董事会层面，担任、实质影响的董事人数占董事会非独立董事人数的 2/3，且刘强仍担

任董事长；在高级管理人员层面，刘强仍担任公司总经理，有权提名除董事会秘书以外的全部高级管理人员。

因此，本次交易完成后，刘强和李杰将继续保持对上市公司重大事项决策的重大及实质性影响。

③刘强和李杰对上市公司经营和财务管理机制有重大及实质性影响

A. 经营机制

本次交易前，北京君正已根据业务运作的需要设置了相应的内部职能部门，包括董事会办公室、审计部、财务部、商务部、公共关系部、人力资源部、行政部、专利办公室、供应链管理部和IT部等，各职能部门职责明确，相互分工协作，相关职能部门向分管的公司高级管理人员汇报工作，高级管理人员向董事会汇报工作。

本次交易完成后，北京矽成将成为北京君正的全资子公司，北京君正主要通过行使股东权利、参与北京矽成董事会及监事会等方式对其行使管理、协调、监督及考核。北京君正将结合北京矽成的组织架构、境内外业务及经营特点等，在给予现有管理团队一定独立运营权基础上，对原有管理制度进行适当地调整，并纳入北京君正整体经营管理机制。同时，北京君正还将充分利用A股上市平台优势、规范的管理经验及对国内市场环境的深入了解支持北京矽成业务发展，充分发挥现有管理团队的经营管理水平，继续保障各项主营业务持续稳定发展，加大国内市场的拓展，提升经营业绩，实现北京君正股东利益最大化的经营目标。

B. 财务管理机制

本次交易前，北京君正已根据相关法律法规的要求配备了专业的财务人员，并建立了符合有关会计制度要求的财务核算体系和财务管理制度。本次交易完成后，北京君正将对北京矽成的财务制度体系、会计核算体系等实行统一管理和监控，对其日常财务活动等重大事件进行监督控制；通过财务整合，将北京矽成纳入公司财务管理体系，确保符合上市公司要求。

因此，本次交易完成后，北京君正现行重大事项决策机制及经营和财务管理机制保持不变，并将北京矽成纳入公司管理体系；在此基础上，公司治理制度及生产经营活动保持延续及稳定，刘强和李杰继续保持对上市公司日常管理和业务

运营的重大及实质性影响。

（3）本次交易后，屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑不拥有控制权

如前所述，本次交易完成后（考虑配套融资情形），除刘强和李杰外，上市公司持股 5%以上股东为屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑，结合其股东身份和属性、对董事和高管人员任免的影响等客观情况，上述各方不拥有上市公司控制权，具体说明如下：

①作为专业投资机构主观上无控制上市公司的意图或动机

根据屹唐投资的书面说明，屹唐投资为北京亦庄国际投资发展有限公司（北京经济技术开发区国有投资公司）下属集成电路和半导体行业的专业投资机构、且为私有化 ISSI 之目的设立的特殊目的实体，其设立及运营的宗旨及目的为响应国家发展集成电路和半导体行业的号召，开展特定领域与行业的战略投资及海外并购活动，促进产业发展。

根据武岳峰集电、上海集岑的书面说明，武岳峰集电为自然人武平、潘建岳及 Bernard Anthony Xavier 控制的实体担任普通合伙人及管理人、专业投资集成电路和半导体行业的私募基金，已经基金业协会备案；上海集岑为自然人张赛美、何君琦、戴思元控制的实体担任普通合伙人及管理人、与思源电气、双创系基金等共同设立，主要投资汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业的私募基金，已经基金业协会备案。作为私募基金和专业投资机构，武岳峰集电、上海集岑设立及运营的宗旨及目的为管理与运作合伙人资金进行半导体等特定行业的财务投资，以最大化投资收益。

因此，基于股东属性、设立及运营宗旨及目的等，屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑投资北京矽成并参与本次交易，实质属于财务投资行为，以获取投资收益为目的，不存在谋求上市公司控制权的主观意图和动机，同时其亦明确承诺尊重刘强和李杰的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

②客观上对股东大会和董事会决策、高管任免等不具有重大及决定性影响，对上市公司无实际控制力

如前所述，本次交易完成后，在股东大会层面，刘强和李杰持有、实际支配

的上市公司股份比例最高，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑均无法单独对股东大会重大事项决策产生重大及实质性影响；在公司董事会层面，全体交易对方向上市公司提名 2 名董事，无法对董事会一般及重大事项决策产生实质性影响，同时也无法决定上市公司高级管理人员的聘任或解聘。

因此，本次交易完成后，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑对上市公司股东大会和董事会一般及重大事项决策、高管任免等不具有重大及决定性影响，客观上无法对上市公司进行实际控制。

（4）本次交易后，成为上市公司股东的相关交易对方不存在一致行动关系

尽管交易对方之间存在关联方担保及反担保、共同投资、关联方间接参股/出资等经济利益关系，但基于私有化收购整体融资安排、北京矽成业务发展及引进战略投资者、员工持股平台、私募基金/专项投融资平台等客观因素，并结合交易对方出具的相关说明及承诺，相关交易对方²之间不构成一致行动关系。

此外，各交易对方于 2019 年 7 月分别作出承诺：“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。”

因此，相关交易对方之间存在的共同投资、关联方出资、关联方担保及反担保、穿透后部分最终出资人相同、间接持股等关系并不会导致相关交易对方之间构成一致行动关系；各交易对方已分别作出书面说明，确认未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排，亦承诺不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。因此，交易对方彼此之间不存在其他一致行动关系。

² 武岳峰集电与承裕投资存在股权控制关系。本次交易项下，交易对方中承裕投资和北京青禾仅获得现金对价，在本次交易完成后不持有上市公司股份，因此，在论证及认定上市公司股东/投资者是否构成一致行动人情境下，“交易对方”不包括承裕投资和北京青禾。

基于上述，本次交易前后，（1）刘强和李杰始终为上市公司持股比例最高的股东；（2）刘强和李杰始终能对上市公司董事会、经营管理层有重大及决定性影响，始终保持对上市公司重大事项决策、日常经营和财务管理有重大及决定性影响；（3）屹唐投资、武岳峰集电及上海集岑无论在主观意图或客观上均不会对上市公司进行控制，且交易对方之间不存在一致行动关系，不存在共同控制上市公司的主观意愿或客观基础。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，刘强和李杰仍为上市公司实际控制人。

5、相关方保持上市公司控制权稳定性的具体措施

（1）刘强和李杰保持上市公司控制权的具体措施

①刘强和李杰的资信状况

根据刘强和李杰提供的股份登记凭证、不动产登记证明、其他股权投资凭证、相关被投资公司的财务报表、《个人信用报告》等文件资料及书面说明：截至本报告书出具日，刘强和李杰个人资信状况良好，不存在重大逾期负债；刘强和李杰分别持有北京君正 4,047.55 万股和 2,572.80 万股股票，对应市值分别约为 22.37 亿元及 14.22 亿元；除持有北京君正股票外，李杰持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京华如科技股份有限公司 22.84% 股份，该公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的总资产为 44,086.83 万元，净资产为 37,759.52 万元，营业收入为 24,566.69 万元，净利润为 5,646.33 万元。

此外，刘强和李杰还持有部分银行存款、其他对外权益投资、不动产等资产，同时作为上市公司的控股股东、实际控制人，刘强和李杰资信状况良好，可通过借款或其他法律法规允许的方式筹集资金。

②刘强和李杰关于维持上市公司控制权稳定的承诺

刘强和李杰于 2019 年 7 月出具《关于维持上市公司控制权稳定的承诺》：“本承诺人作为上市公司的实际控制人，为本次重组之目的，现就维持上市公司控制权稳定作出声明、确认与承诺如下：1. 本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃上市公司控制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。2. 本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动辞任上市公司董事、高级管理人员的职务（如有）。3. 本次交易完成后 60 个月内，根

据资本市场情况与实际需要，本承诺人不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维护上市公司控制权稳定。4.本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，本承诺人向上市公司提名的董事人数合计不少于四名。5.本承诺人将严格履行股份锁定义务，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定及监管要求，结合已作出的公开承诺，安排及规范股份减持行为，并及时履行信息披露义务。6.本承诺人将根据相关法律法规及公司章程，积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利，不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利，努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力。7.本承诺函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。”

③四海君芯参与本次配套融资的确定性

本次交易中，上市公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。

上市公司与刘强于 2019 年 5 月签署《股份认购协议》，上市公司与四海君芯于 2019 年 7 月签署《股份认购协议之补充协议》，该等协议就四海君芯参与认购本次配套融资相关事宜进行明确约定，包括相关方违反协议应承担的违约责任。

2019 年 8 月，刘强、四海君芯进一步出具《关于参与认购本次配套融资的承诺函》，四海君芯承诺参与本次配套融资，认购配套融资金额不低于本次配套融资总额的 50%，将根据本次配套融资相关安排，按期、足额认购本次配套融资相应股份，于上市公司向认购方发出《缴款通知书》前，通过自有及/或自筹（包括但不限于通过借款或其他法律法规允许的方式筹集）方式，将认购本次配套融资所需的资金准备到位。

一方面，如前所述，刘强作为北京君正的控股股东、实际控制人之一，整体信用资质良好，可通过借款或其他法律法规允许的方式筹集所需资金用于四海君芯认购本次重组配套募集资金。刘强拥有 20 年集成电路和信息技术行业经验，

联合创立北京君正后一直担任公司董事长、总经理职务，带领北京君正进行国产创新 CPU 技术和嵌入式处理器芯片的研制与产业化，较为深厚的行业背景及资源将进一步增强其融资能力。而由于本次重组属于集成电路领域的同行业收购，既顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业的行业背景，又能优化上市公司未来的业务结构、发挥协同效应，因此，资本市场及相关机构对本次重组给予较大期望，有利于刘强在必要时筹措所需资金。

另一方面，四海君芯拟引入第三方投资者，进一步增强认购配套融资的确定性。2019 年 9 月，四海君芯及其股东青岛君品、冼永辉与北京中关村科学城创新发展有限公司、北京汇诚兴海科技中心（有限合伙）签署《股权转让及投资协议》，中关村科学城和汇诚兴海下设科学城基金，并通过科学城基金受让青岛君品、冼永辉分别持有的四海君芯 45.67%、3.33% 的股权。该等股权转让完成后，青岛君品将持有四海君芯 51% 股权，科学城基金将持有四海君芯 49% 股权。北京中关村科学城创新发展有限公司的股东为北京市海淀区国有资本经营管理中心，国资股东的支持增强了四海君芯认购配套融资的确定性。同时，刘强及四海君芯出具了《关于北京四海君芯有限公司引入投资人的声明》，四海君芯拟引入第三方投资者，该等引资完成后，青岛君品投资合伙企业（有限合伙）持有四海君芯的股权比例将不低于 51%，仍为四海君芯的控股股东，刘强仍为四海君芯的实际控制人。

此外，截至本报告书出具日，招商银行北京分行已向四海君芯出具了贷款意向书，同意为四海君芯认购本次重组配套募集资金提供不超过 8 亿元的贷款额度意向，进一步增强了四海君芯认购本次重组配套募集资金的确定性。

基于上述，刘强及四海君芯已就参与本次配套融资相关事宜与上市公司签署书面协议，并出具书面承诺，确认将根据本次配套融资相关安排，按期、足额认购本次配套融资相应股份，并承诺于上市公司向认购方发出《缴款通知书》前将认购本次配套融资所需的资金准备到位；刘强个人资信状况良好，同时四海君芯拟引入第三方投资者，能够保证四海君芯按期、足额认购本次配套融资相关金额。因此，四海君芯参与本次配套融资具有确定性。

（2）交易对方保持上市公司控制权的承诺

根据全体交易对方于 2019 年 7 月出具的《关于不构成一致行动关系及不谋求上市公司控制权的声明及承诺函》：

“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。

2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。

3.本次交易完成后，交易对方将不会联合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事会、监事会成员等改变上市公司董事会、监事会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员组成结构产生实质性影响。交易对方进一步确认，本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总数的四分之一，但不低于两名。

4.交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

5.如违反上述承诺，上市公司有权要求承诺人根据上述承诺予以改正，承诺人拒绝改正的，上市公司有权拒绝承诺人的相应要求。”

基于上述，刘强和李杰及交易对方已就维持上市公司控制权稳定的具体措施做出相关承诺；刘强和李杰资信状况良好，能够保证其维持上市公司控制权稳定相关承诺措施的实施。

（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响分析

本次交易前，上市公司主要经营嵌入式 CPU 芯片业务，本次交易后，随着上市公司取得北京矽成的控制权，上市公司可通过北京矽成将业务拓展至高端存储芯片业务。截至本报告书出具日，刘强、李杰出具了《关于避免同业竞争的承

诺函》，承诺未经营与上市公司和北京矽成主营业务相同或类似的业务，避免与上市公司及北京矽成构成同业竞争。

此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保持上市公司独立性，保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（六）本次交易对上市公司关联交易的影响分析

本次交易/本次收购完成后，发行股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。

上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

因此，本次交易构成关联交易。

为规范和减少上市公司的关联交易，上市公司控股股东和实际控制人刘强、李杰，以及交易对方中的屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

（七）本次交易对上市公司治理结构和独立性的影响分析

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易完成后，上市公司实际控制人的持股比例有所下降，但对公司实际控制人的控制权及现有的公司治理结构不会产生重大不利影响。

本次交易完成后，公司各项经营活动（包括但不限于采购、销售、技术、商标等）对控股股东、实际控制人以及其他第三方不存在重大依赖。

（八）拟支付现金对价对上市公司后续生产经营和财务状况的影响

本次交易的现金对价为 161,562.30 万元，其中以北京君正 IPO 时的结余募集资金（含超募及利息）合计 45,613.30 万元进行支付部分现金对价外，剩余现金对价 115,949 万元拟使用本次交易的募集配套资金支付。

1、上市公司偿债能力

截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，北京君正主要偿债指标情况如下：

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31
资产负债率	4.24%	4.68%	2.76%
流动比率	50.17	39.45	49.63
速动比率	45.76	36.00	43.51

截至 2019 年 6 月末，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务；2017 年末、2018 年末和 2019 年末，北京君正的资产负债率均很低，分别为 2.76%、4.68%和 4.24%，偿债压力较小；流动比率、速动比率维持的较高水平，2019 年 6 月末分别达 50.17 和 45.76，短期偿债能力较强。同时，本次交易现金对价的支付预计不会采用银行借款的方式筹措资金。综合而言，北京君正的偿债能力较强，财务风险较小。

2、上市公司筹资能力

除通过资本市场进行股权融资外，北京君正的其他主要融资渠道为银行借款。截至本报告书出具日，北京君正及其子公司在国内主要合作商业银行获得的银行授信总额为 7,000 万元，且尚未使用该授信额度。同时，招商银行北京分行向北京君正出具了贷款意向书，同意为本次重组项目提供不超过 9.6 亿元的贷款额度意向。此外，如上所述，截至 2019 年 6 月末，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务，偿债能力较强，存在较大的债务融资空间。

综上所述，北京君正具备较强的筹资能力。

3、利息费用支出

截至 2019 年 6 月 30 日，北京君正合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务，无利息费用。本次交易的现金对价除以前次 IPO 结余募集资金（含超募及利息）支付外，剩余现金对价将以募集配套资金筹集，将不会新增借款等情形，亦不会产生利息费用，不会新增财务性支出。

4、营运资本预算计划

2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月，北京君正分别实现营业收入 18,446.70 万元、25,967.01 万元和 14,397.96 万元，经营活动产生的现净流量净额分别为 -3,069.40 万元、3,637.07 万元和 2,189.90 万元，整体收入水平和现金流水平呈现上升趋势。在不考虑本次收购的情况下，伴随着公司智能视频芯片和微处理器芯片的发展，未来公司的收入水平有望持续增长。此外，公司的应收账款回款情况较好，坏账率较低，2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末的坏账准备分别仅为 55.71 元、167.14 元、0.00 元，应收账款周转率分别为 12.72、14.60 和 15.56（2019 年 6 月末的应收账款周转率为年化数值），应收账款周转率较高且保持增长。因此，公司未来的营业收入和持续良好的现金流能为日常营运提供较为充足的资金来源。

5、生产经营计划

根据公司业务发展需求及战略规划，未来公司将继续推进全资子公司合肥君正研发基地二期的建设工作，公司使用前次 IPO 的超募资金 9,500 万元向合肥君正增资的事项已获得第三届董事会第二十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，上述增资款也已向合肥君正完成划款。因此，本次现金对价的支付不会对未来的生产经营计划产生重大不利影响。

6、利润分配政策

本次交易的部分现金对价系公司前次 IPO 的结余募集资金（含超募及利息），其使用需符合募集资金的约定，即使不用以支付现金对价，也不能用以利润分配。

未来随着公司业绩的提升，公司将按照《公司章程》的相关规定，在当年盈利的前提下，每年度至少进行一次利润分配；在满足现金分红条件的情况下，每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 5%，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的母公司年均可分配

利润的 30%。尤其是本次收购完成后，北京矽成将纳入公司的合并范围，随着北京矽成业绩的提升，未来公司可进一步结合北京矽成的利润情况，在满足《公司章程》要求的前提下，实施利润分配。因此，本次现金对价的支付预计不会对未来利润分配产生重大不利影响。

综上所述，本次现金支付对价预计不会对上市公司未来生产经营和财务状况产生重大不利影响。

第二章 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称:	北京君正集成电路股份有限公司
英文名称:	Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
股票简称:	北京君正
股票代码:	300223
注册资本:	20,120.9956 万元 ^注
统一社会信用代码	911100007776681570
成立日期:	2005 年 7 月 15 日
法定代表人:	刘强
注册地址:	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113
办公地址:	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层
邮政编码:	100193
电话号码:	010-56345005
传真号码:	010-56345001
互联网网址:	http://www.ingenic.com/
经营范围:	研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：由于上市公司股票期权激励计划第三个行权期仍处于持续状态，截至 2019 年 9 月 30 日，上市公司总股本为 20,203.80 万股，但尚未完成相应的工商变更事宜，因此工商登记的注册资本仍为 20,120.9956 万元。

二、历史沿革及股本变动情况

（一）上市公司设立情况

公司前身北京君正集成电路有限公司成立于 2005 年 7 月 15 日。2009 年 10 月 30 日，君正有限召开股东会，会议决定将君正有限整体变更、改制设立为股份有限公司。2009 年 12 月 18 日，北京君正召开创立大会暨第一次股东大会，同意以君正有限经审计的截至 2009 年 10 月 31 日的账面净资产折合为 6,000 万

股，每股面值 1 元，其余列入资本公积，将君正有限整体变更为股份有限公司。兴华会计师出具（2009）京会兴验字第 1-23 号《验资报告》，审验确认公司注册资本已由各发起人足额缴纳。2009 年 12 月 24 日，公司取得了北京市工商局核发的注册号为 110108008639445 的营业执照。

（二）首次公开发行股票并上市

经公司 2010 年度股东大会审议通过，中国证监会证监许可[2011]691 号文《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，深圳证券交易所（深证上[2011]161 号）同意，2011 年 5 月 31 日，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“北京君正”，股票代码“300223”。至此，公司注册资本变更为 8,000 万元。上述新增注册资本经兴华会计师出具的（2011）京会兴验字第 1-009 号《验资报告》验证。

公司首次公开发行并上市时股本结构如下：

单位：万股

股份性质	数量	比例
一、有限售条件股份	6,000.00	75.00%
二、无限售条件流通股份	2,000.00	25.00%
三、股份总数	8,000.00	100.00%

（三）上市以后的历次股本变化情况

1、2012 年资本公积转增股本

根据 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年年度股东大会会议决议，公司按每 10 股转增 3 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 2,400 万股，转增基准日期为 2011 年 12 月 31 日，变更后公司股本为人民币 10,400 万股。

2、2015 年资本公积转增股本

根据 2015 年 4 月 20 日召开的公司 2014 年年度股东大会会议决议，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 6,240 万股，转增基准日期为 2014 年 12 月 31 日，变更后股本为人民币 16,640 万股。

3、股票期权激励计划第一个行权期

根据公司第三届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司拟对中高层管理人员、核心业务（技术）人员等公司董事会认为需要进行激励的相关员工实施股权激励。

2017 年 3 月 23 日，上市公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并拟注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次股票期权激励对象在第一个行权期可自主行权股票期权共 74.40 万份，实际行权期限为 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 12 日。

截至 2018 年 3 月 31 日，股票期权激励计划第一个行权期已实质结束，实际行权数量为 667,073 股。股票期权激励计划第一个行权期结束后，公司股本变更为人民币 16,706.7073 万股。

4、股票期权激励计划第二个行权期

2018 年 3 月 29 日，上市公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，本次股票期权激励对象在第二个行权期可自主行权股票期权共 66.00 万份，行权期限为 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日。

5、2018 年资本公积转增股本

根据 2018 年 5 月 4 日召开的公司 2017 年年度股东大会会议决议，公司以 2018 年 2 月 28 日总股本 16,706.7073 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。因公司股权激励计划员工行权，截至 2018 年 6 月 11 日，公司总股本为 16,722.93 万股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司以总股本 16,722.93 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.998059 股，共计转增股份 3,341.34 万股。本次变更后，上市公司股本为人民币 20,064.27 万股。

截至 2019 年 4 月 12 日，股票期权激励计划第二个行权期已实质结束，实际

行权数量为 729,483 股（含 2018 年资本公积转增股本前实际行权数量 162,227 股）。股票期权激励计划第二个行权期结束后，公司股本变更为人民币 20,120.9956 万股。

6、股票期权激励计划第三个行权期

2019 年 4 月 18 日，上市公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，本次股票期权激励对象在第三个行权期可自主行权股票期权共 94.4487 万份，行权期限为 2019 年 4 月 13 日至 2020 年 4 月 12 日。

截至本报告书出具日，本次股票期权激励计划第三个行权期仍处于持续状态。截至 2019 年 7 月 31 日，北京君正总股本为 20,135.2564 万股。

三、最近六十个月控制权变动情况

自 2014 年 1 月 1 日至本报告书出具之日，公司控股股东和实际控制人均为刘强和李杰，未发生变动。

四、重大资产重组情况

2016 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了收购北京豪威科技有限公司 100%股权、北京视信源科技发展有限公司 100%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司 40.4343%股权的方案，初步作价共计 1,262,228.57 万元。后因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化、交易各方认为继续推进重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究，公司于 2017 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了终止该次重大资产重组的相关事项。

最近三年，公司未发生重大资产重组情况。

五、主营业务发展情况

公司为集成电路设计企业，拥有全球领先的 32 位嵌入式 CPU 技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等产品及整体解决方案的研发和销售。

公司拥有较强的自主创新能力，多年来在自主创新 CPU 技术、视频编解码技术、图像和声音信号处理技术、SoC 芯片技术、嵌入式神经网络处理技术、智能视频分析算法技术、软件平台技术等多个领域形成多项核心技术。目前，公司已形成可持续发展的梯队化产品布局，基于自主创新的 XBurst CPU 和视频编解码等核心技术，公司推出了一系列具有高性价比的微处理器芯片产品和智能视频芯片产品，各类别的芯片产品分别面向不同的市场领域，微处理器芯片主要面向智能家居、智能家电、二维码、智能穿戴、智能门锁等物联网市场和生物识别等市场，智能视频芯片主要面向商用和家用消费类智能摄像头及泛视频类市场。

六、主要财务数据及财务指标

上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标（按合并报表口径）如下表所示：

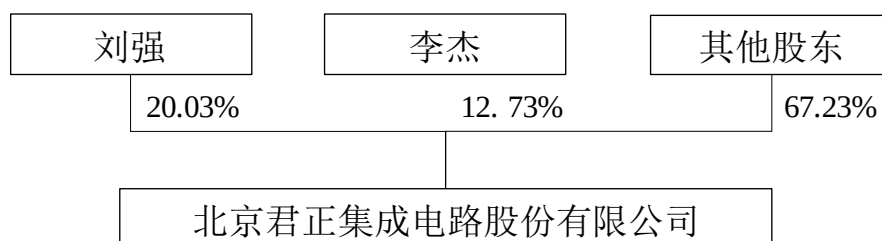
单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	124,785.26	119,798.02	115,676.00	113,482.85
负债总额	6,041.68	5,605.33	3,193.23	3,723.48
归属上市公司股东所有者权益	118,743.58	114,192.69	112,482.76	109,759.37
资产负债率	4.84%	4.68%	2.76%	3.28%
项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	11,788.38	25,967.01	18,446.70	11,168.58
利润总额	3,200.68	1,381.76	683.92	1,118.96
归属母公司所有者的净利润	3,183.71	1,351.54	650.11	705.21
经营活动产生的现金流量净额	2,351.87	3,637.07	-3,069.40	-6,572.33
投资活动产生的现金流量净额	-10,240.64	7,894.35	-14,657.26	23,233.10
筹资活动产生的现金流量净额	555.11	424.95	1,324.29	-499.89
现金及现金等价物净增加额	-7,325.62	11,980.28	-16,429.73	16,169.60
毛利率	39.08%	39.86%	37.01%	46.36%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.07	0.04	0.04

七、上市公司控股股东和实际控制人情况

（一）上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图

截至 2019 年 9 月 30 日，上市公司股权结构图情况如下：



截至 2019 年 9 月 30 日，刘强和李杰作为一致行动人合计持有公司 32.77% 股份，为公司的控股股东、实际控制人。

（二）上市公司控股股东基本情况

刘强，男，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居住权。刘强先生出生于 1969 年，博士学位。刘强先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司董事长，领导研发了嵌入式 Xburst CPU，现任公司董事长、总经理，深圳君正时代集成电路有限公司执行董事，合肥君正科技有限公司执行董事，北京君正集成电路（香港）集团有限公司董事，北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司董事，拉萨君品创业投资有限公司执行董事、经理，北京四海君芯有限公司执行董事、经理，合肥君诺志成集成电路投资有限公司执行董事、经理等职。

李杰，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居住权。李杰先生出生于 1963 年，硕士学位。李杰先生曾在中科院计算所任职，从事大型机的研制工作，曾任北京庚顿数据科技有限公司执行董事，现任公司董事、北京华如科技股份有限公司董事长等职。

刘强和李杰作为一致行动人合计持有公司 32.77% 股份，为公司的控股股东。

（三）上市公司实际控制人情况

刘强和李杰作为一致行动人合计持有公司 32.77% 股份，为公司的实际控制人。

1、认定刘强和李杰为一致行动人的依据

根据刘强和李杰于 2009 年 12 月签署的《一致行动协议书》，“双方确认：自君正有限设立以来，作为君正有限的股东及董事，双方对君正有限所有重大经营决策事项均保持意见一致。”“双方承诺自本协议签署之日起，在处理有关公司经营发展、且需经公司董事会或股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动……”

根据刘强和李杰于 2014 年 7 月签署的《一致行动协议书》，刘强和李杰一致同意自该协议签署之日起，“双方在今后处理有关公司经营发展、且需经公司董事会或股东大会审议批准的重大事项时将采取一致行动，具体为：1、本协议一方拟向公司董事会或股东大会提出议案时，应当事先就议案内容与另一方进行充分的沟通和交流，如果另一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，双方均应当作出适当让步，对议案内容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，再向公司董事会或股东大会提出相关议案，在董事会或股东大会审议时，双方应对议案作出相同的表决意见；2、对于非由本协议的一方或双方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至双方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会会议或股东大会会议上作出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，在议案的内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，一方拟对议案投同意票，而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投同意票；如果一方拟对议案投反对票，而另一方拟对该议案投弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票；如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定，则双方均应对该议案投反对票。”

基于上述，刘强和李杰作为公司的主要创始人，始终为公司的主要股东及在公司担任董事职务，并已签署《一致行动协议书》，约定双方在处理有关公司经营发展、且需经公司董事会或股东大会审议批准的重大事项时采取一致行动。

2、刘强和李杰一致行动关系的期限及稳定性

北京君正自设立以来不存在单一绝对控股股东，股权结构相对分散，刘强和

李杰作为北京君正的主要创办人始终为公司的主要股东，其中刘强始终为第一大股东；刘强和李杰自公司设立以来始终在公司任职，刘强一直担任公司董事长和总经理，李杰一直担任公司董事，两人对公司业务发展和经营规划有决定性影响；刘强和李杰为同乡和清华校友，且研究生期间在中国科学院师从同一导师、关系密切，两人作为主要创办人共同创办公司，在经营理念和管理思路相互认可，有共同的利益基础。鉴于此，早在 2009 年 12 月首次签署《一致行动协议》之前甚至自公司设立起，刘强和李杰即实际形成事实上的一致行动关系和对公司的共同控制，后续签署及续签一致行动协议均是以协议方式予以进一步明确和安排。

根据刘强和李杰于 2014 年 7 月签署的《一致行动协议书》：“二、本协议有效期为自协议签署之日起三十六个月。该有效期届满后，除非出现一方以书面形式明确通知另一方及北京君正不再保持一致行动关系的情况，否则本协议仍将继续有效。三、本协议任何一方违反约定，给他方造成损失的，应当依法进行赔偿。四、本协议经双方签字后生效，在协议有效期内不能撤销、变更。”

根据刘强和李杰于 2016 年 12 月签署的《一致行动协议书之补充协议》，双方同意将原《一致行动协议书》第二条修订为“本协议有效期为自协议签署之日起至 2022 年 12 月 31 日。该有效期届满后，除非出现一方以书面形式明确通知另一方及北京君正不再保持一致行动关系的情况，否则本协议仍将继续有效。”此外，《一致行动协议书之补充协议》约定“本补充协议经双方签字后生效，在协议有效期内不能以任何理由撤销、变更。”

此外，刘强和李杰于 2019 年 11 月签署《关于保持一致行动关系的声明及确认函》：“刘强和李杰承诺，于本次交易完成之日起 60 个月内，任一方均不会向对方或北京君正提出终止双方之间的一致行动关系。本承诺函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。”

基于上述，从个人意愿等主观角度，刘强和李杰自公司创办时起即在相同的管理和运营理念以及共同的经济利益基础上对公司形成共同控制，已实际形成事实上的一致行动关系并始终持续；从协议约定等客观角度，刘强和李杰于 2009 年公司申请首发上市时首次签署一致行动协议且后续多次续签，截至本报告书出具日，一致行动关系有效期至 2022 年 12 月 31 日，除非出现一方书面明确通知

另一方及北京君正不再保持一致行动关系的情况，否则双方一致行动关系将继续有效，且该等协议在协议有效期内不能以任何理由撤销、变更，否则相关方应承担违约责任；此外，刘强和李杰已出具书面文件，进一步承诺于本次交易完成之日起 60 个月内，不会终止双方之间的一致行动关系。因此，刘强和李杰一致行动关系具有稳定性。

3、本次交易前控股股东、实际控制人及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排

本次交易项下发行股份募集配套资金不超过 150,000 万元，其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。

刘强和李杰于 2019 年 10 月出具的《关于股份锁定的承诺函》，“本承诺人于本次交易前持有的上市公司股份，自本次配套融资项下股份发行完成日起 12 个月届满之日前不得转让。”

综上所述，上市公司控股股东、实际控制人刘强和李杰已就本次交易前持有的上市公司股份作出相应锁定安排，符合《证券法》第九十八条、《收购管理办法》第七十四条的规定。

八、最近三年合法合规情况

截至本报告书出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年诚信情况良好，不存在被证券交易所公开谴责的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚。

第三章 交易对方基本情况

本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方为屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华、承裕投资、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资；本次发行股份募集配套资金之交易对方为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及包括刘强控制的企业四海君芯在内的符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 5 名特定投资者。

一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况

（一）屹唐投资

1、屹唐投资的基本情况

中文名称：北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司（委派代表：张文冬）

成立日期：2015 年 5 月 26 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 309 室

统一社会信用代码：911103023482925854

经营范围：投资、投资咨询、投资管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2015 年 5 月设立

2015年5月20日，北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）签署《合伙协议》，出资设立北京兴南科技产业投资中心（有限合伙）（屹唐投资前身）。

2015年5月26日，北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发注册号为110302019208864的营业执照（后经三证合一统一社会信用代码更新为911103023482925854），屹唐投资正式成立。屹唐投资设立时的出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	1.00	0.0014
2	有限合伙人	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	69,999.00	99.9986
合计			70,000.00	100.00

（2）2015年8月变更认缴出资额及合伙人

2015年8月3日，屹唐投资通过变更决定书，同意北京亦庄国际产业投资管理有限公司退伙，屹唐（北京）国际投资管理有限公司入伙；增加出资额至80,000万元，其中屹唐（北京）国际投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资1万元，北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资79,999万元。

同时，屹唐投资的执行事务合伙人由北京亦庄国际产业投资管理有限公司变更为屹唐（北京）国际投资管理有限公司。

2015年8月5日，屹唐投资完成本次变更的工商登记。本次变更后，屹唐投资出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	屹唐（北京）国际投资管理有限公司	1.00	0.0013
2	有限合伙人	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	79,999.00	99.9987
合计			80,000.00	100.00

（3）2016年10月变更合伙人

2016年10月1日，屹唐投资通过变更决定书，同意屹唐（北京）国际投资管理有限公司退伙，北京亦庄国际产业投资管理有限公司入伙；其中北京亦庄国

际产业投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资 79,999 万元。

同时，屹唐投资的执行事务合伙人由屹唐（北京）国际投资管理有限公司变更为北京亦庄国际产业投资管理有限公司。

2016 年 10 月 11 日，屹唐投资完成本次变更的工商登记。本次变更后，屹唐投资出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	1.00	0.0013
2	有限合伙人	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	79,999.00	99.9987
合计			80,000.00	100.00

（4）2017 年 3 月变更认缴出资额

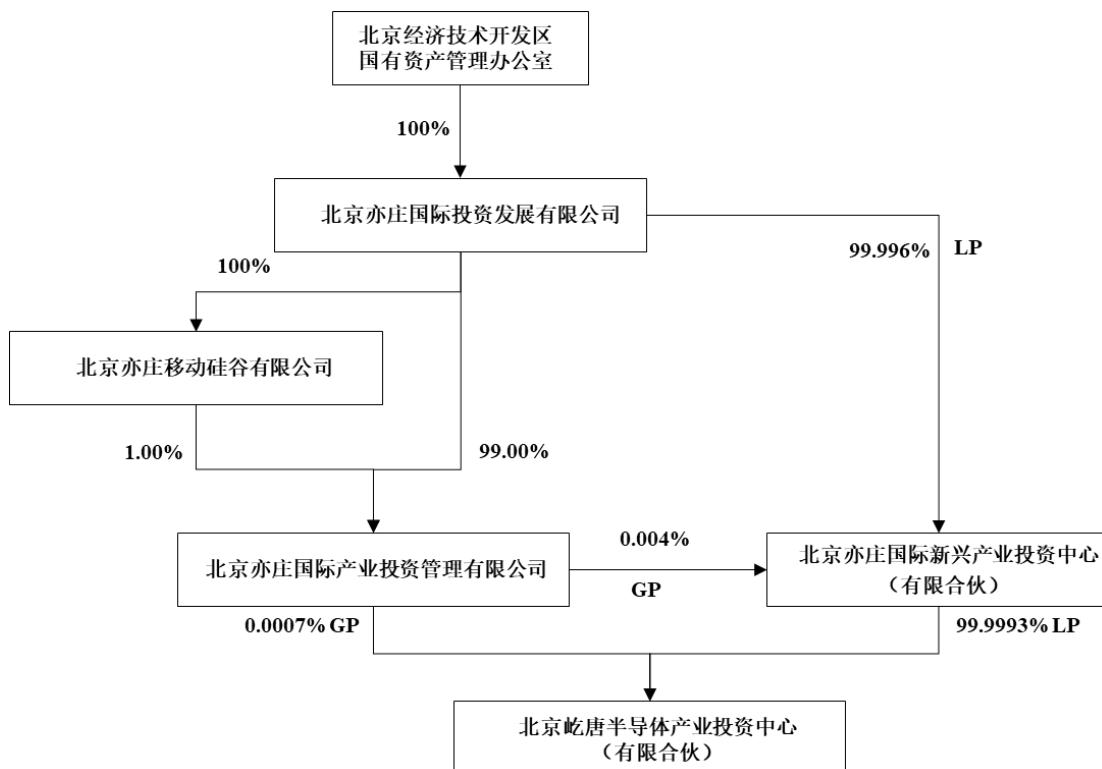
2017 年 3 月 10 日，屹唐投资通过变更决定书，同意增加注册资本至 135,770.3512 万元，由北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）认缴。

2017 年 3 月 10 日，屹唐投资完成本次变更的工商登记。本次变更后，屹唐投资出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	1.00	0.0007
2	有限合伙人	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	135,769.3512	99.9993
合计			135,770.3512	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，屹唐投资的产权结构及控制关系如下：



屹唐投资的最终出资人为北京经济技术开发区国有资产管理办公室。

本次交易完成后，屹唐投资预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据屹唐投资提供的文件和说明，屹唐投资的最终出资人的资金来源均为自有及自筹等。

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，屹唐投资执行事务合伙人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司，基本情况如下：

中文名称：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

法定代表人：张建勋

成立日期：2013 年 2 月 20 日

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

企业地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 6 层 608

统一社会信用代码：91110302062801030J

经营范围：投资管理；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得开展审计、

验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、最近三年主营业务发展情况

屹唐投资系半导体产业投资机构，除对外投资外暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

屹唐投资最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	186,635.27	212,423.12
负债总额	60,586.70	86,553.28
所有者权益合计	126,048.56	125,869.84
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	12.97	23.20
营业利润	178.73	-3,880.23
净利润	178.73	-3,880.23

注：上述财务数据已经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，屹唐投资除持有北京矽成 34.44%股权外，对外投资情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	37.34	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、其他安排

本次交易完成后，屹唐投资预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据《北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）合伙协议》，屹唐投资利润分配、亏损分担及合伙事务执行的有关协议安排如下：

主题	具体条款

主题	具体条款
利益分配及亏损分担	《北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）合伙协议》 第十条 利润分配和亏损分担办法 1、企业的利润和亏损，由合伙人依照以下比例分配和分担：合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的，按合伙人出资比例分配和分担。 2、合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补亏损。 3、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人协商决定。
合伙事务执行	《北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）合伙协议》 第十一条 合伙企业事务执行 1、执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。全体合伙人委托北京亦庄国际产业投资管理有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况，并依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，收益归合伙企业，所产生的亏损或者费用，由合伙企业承担。

根据屹唐投资的工商登记资料及提供的文件和说明，屹唐投资在本次交易停牌前六个月内不存在合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情形。根据屹唐投资出具的书面确认，未来存续期间内暂无合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的相关安排。

（二）华创芯原

1、华创芯原基本情况

中文名称：北京华创芯原科技有限公司

法定代表人：陈智斌

成立日期：2015 年 7 月 1 日

注册资本：10.00 万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院 1 幢 2 层 2076 号

统一社会信用代码：9111010834842279X6

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

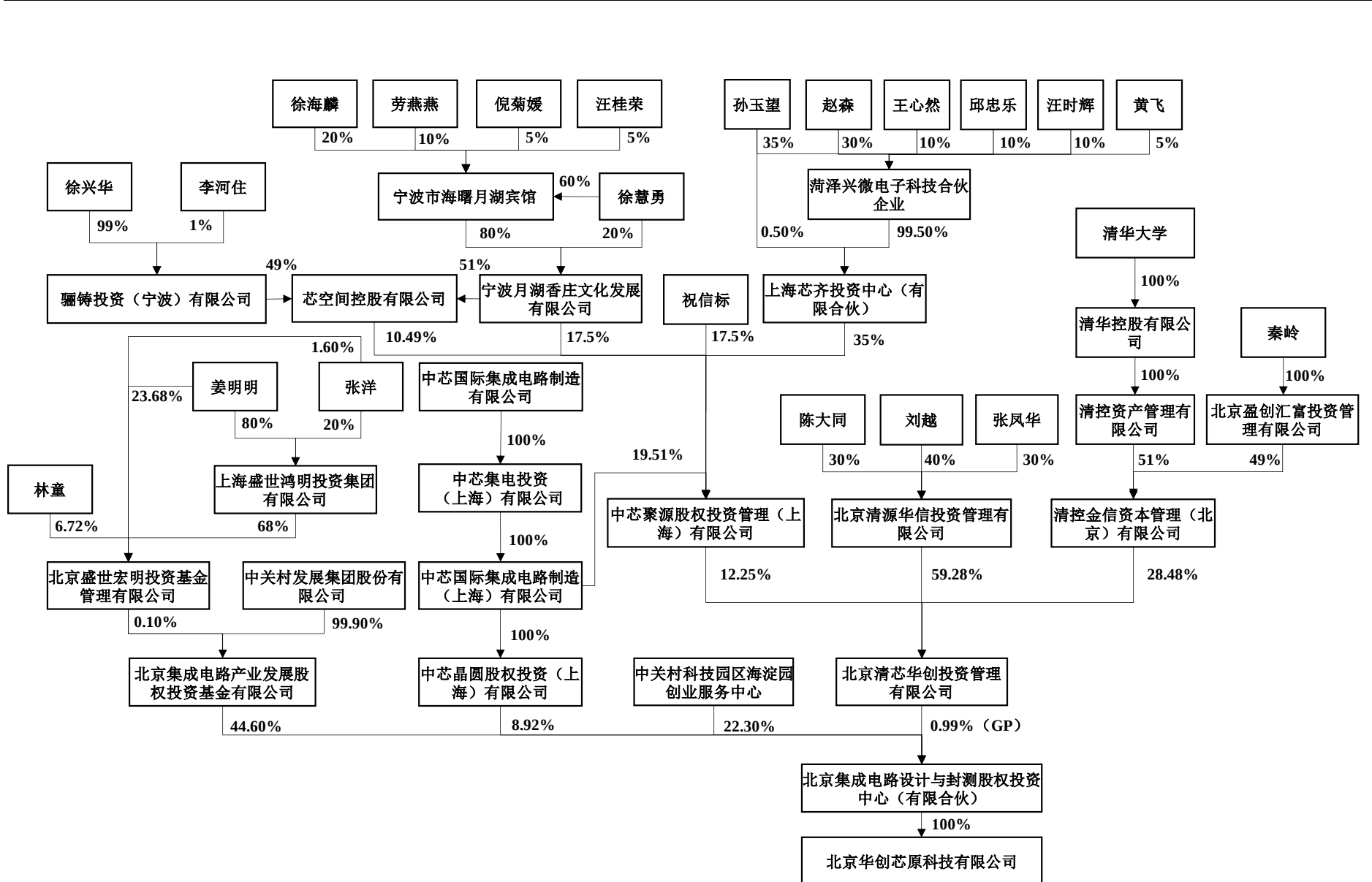
2015 年 6 月，华创芯原由北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）全资设立，注册资本 10 万元，全部以货币形式出资。

2015 年 7 月 1 日，华创芯原取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108019407330 的《营业执照》。

华创芯原设立后至本报告书出具日，华创芯原出资结构未发生变化。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，华创芯原的产权结构及控制关系如下：



华创芯原的最终出资人如下：

交易对方	最终出资人
华创芯原	刘越、陈大同、张凤华、秦岭、清华大学、孙玉望、赵森、王心然、邱忠乐、汪时辉、黄飞、祝信标、徐慧勇、徐海麟、劳燕燕、倪菊媛、汪桂荣、徐兴华、李河住、中关村发展集团股份有限公司、林童、姜明明、张洋、中芯国际集成电路制造有限公司、中关村科技园区海淀创业服务中心、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、赵伟国、李义、李禄媛、浙江中国小商品城集团股份有限公司、悦达资本股份有限公司、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、沈正宁、李国文

4、控股股东基本情况

华创芯原为北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）的全资子公司。截至本报告书出具日，北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）的基本情况如下：

中文名称：北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京清芯华创投资管理有限公司（委派代表：刘越）

成立日期：2014 年 9 月 25 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 1502 室

统一社会信用代码：9111010831792288XB

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，华创芯原暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

华创芯原最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	69,399.87	74,209.61
负债总额	33,610.50	42,015.00
所有者权益合计	35,789.37	32,194.61
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	3,594.76	-1,415.38
净利润	3,594.76	-1,415.38

注：上述财务数据已经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，华创芯原除持有北京矽成 11.08%股权外，其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	15.10	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）上海瑾矽

1、上海瑾矽基本情况

中文名称：上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈冬梅）

成立日期：2017 年 12 月 27 日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 6 幢 401-15 室

统一社会信用代码：91310113MA1GM8CD85

经营范围：集成电路设计；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；研发、设计、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件、网络软硬件产品的设计、研发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的技

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017 年 12 月设立

2017 年 12 月 15 日，上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创管理”）、上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）和宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山嵊犀”）签署《合伙协议》，出资设立上海瑾矽。

2017 年 12 月 27 日，上海市宝山区市场监督管理局核发统一社会信用代码为 91310113MA1GM8CD85 的营业执照，上海瑾矽正式成立。上海瑾矽设立时的出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	10.00	0.0333
2	有限合伙人	上海绿色技术创业投资中心(有限合伙)	25,000.00	83.3056
3	有限合伙人	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	16.6611
合计			30,010.00	100.00

（2）2018 年 2 月变更认缴出资额及合伙人

2018 年 1 月 18 日，上海瑾矽召开合伙人会议，同意上海瑾矽总出资额变更为 5,010 万元，并同意上海绿色技术创业投资中心（有限合伙）退伙。同日，各相关合伙人签订了《退伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018 年 2 月 13 日，上海瑾矽完成本次变更的工商登记。本次变更后，上海瑾矽出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	10.00	0.1996
2	有限合伙人	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	99.8004
合计			5,010.00	100.00

（3）2018 年 6 月变更认缴出资额及合伙人

2018年5月9日，上海瑾矽召开合伙人会议，同意上海瑾矽总出资额变更为30,010万元，并同意上海文棠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海文棠”）、上海梓炯企业管理中心（以下简称“上海梓炯”）入伙；其中上海文棠作为有限合伙人认缴出资20,000万元，上海梓炯作为有限合伙人认缴出资5,000万元。同日，各相关合伙人签订了《入伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018年6月6日，上海瑾矽完成本次变更的工商登记。本次变更后，上海瑾矽出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	10.00	0.0333
2	有限合伙人	上海文棠企业管理中心（有限合伙）	20,000.00	66.6445
3	有限合伙人	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	16.6611
4	有限合伙人	上海梓炯企业管理中心	5,000.00	16.6611
合计			30,010.00	100.00

（4）2018年8月变更合伙人

2018年7月3日，上海瑾矽召开合伙人会议，同意普通合伙人双创管理将其持有的上海瑾矽0.3333%份额转让给上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海若矽”），至此上海瑾矽的普通合伙人由双创管理变更为上海若矽。同日，双创管理和上海若矽签订了《认缴出资额权益转让协议书》，各相关合伙人签订了《入伙协议》并签订了新的《合伙协议》。

2018年8月9日，上海瑾矽完成本次变更的工商登记。本次变更后，上海瑾矽出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）	10.00	0.0333
2	有限合伙人	上海文棠企业管理中心（有限合伙）	20,000.00	66.6445
3	有限合伙人	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	16.6611
4	有限合伙人	上海梓炯企业管理中心（有限合伙）	5,000.00	16.6611
合计			30,010.00	100.00

（5）2018年11月变更合伙人

2018年11月8日，上海瑾矽召开合伙人会议，同意有限合伙人上海梓炯将其持有的上海瑾矽16.6611%份额转让给上海双创集银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“双创集银”）。同日，上海梓炯和双创集银签订了《认缴出资额权益转让协议书》，各相关合伙人签订了《入伙协议》并签订了新的《合伙协议》。

2018年11月13日，上海瑾矽完成本次变更的工商登记。本次变更后，上海瑾矽出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）	10.00	0.0333
2	有限合伙人	上海文棠企业管理中心（有限合伙）	20,000.00	66.6445
3	有限合伙人	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	16.6611
4	有限合伙人	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	5,000.00	16.6611
合计			30,010.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，上海瑾矽的产权结构及控制关系如下：



注 1：上图中注 1：上海双创投资管理有限公司、注 2：上海双创集银创业投资中心（有限合伙）、注 3：上海双创投资中心（有限合伙）、注 4：上海襄银创业投资中心（有限合伙）在本次交易对方上海集岑的多个合伙主体中重复交叉出现，为避免重复，仅在本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（十）上海集岑”的产权结构穿透时体现，其余主体中出现时均未向上层穿透。

注 2：华宝-上海银行-上海襄银单一资金信托虽作为上海襄银创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，但该信托产品为专为指定项目设立，该笔信托资金并未投资于上海瑾矽的出资份额。

注 3：上海瑾矽之有限合伙人上海文棠企业管理中心（有限合伙）之上层股东上海双创科技投资中心（有限合伙）之合伙人份额拟进行变更，上述变更已于 2019 年 7 月 13 日签署相关协议，工商变更尚未办理完毕。

上海瑾矽的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
上海瑾矽	吴一凡、喻丽丽、沈晓波、钱斌、张斌、孙小中、周军梅、李锁银、徐朝军、王学贵、于海菲、史文君、徐冠巨、徐观宝、徐传化、周晓萍、周八斤、周政、周金、张赛美、何君琦、戴思元、上海电力股份有限公司、渤海国际信托股份有限公司（代表其受托管理的单一资金信托计划）、上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）、刘雁、陈冬梅、石梦、曾玉娥、郑君瑶、上海国有资产监督管理委员会、宝山区政府、羊首道、沈安星、李鹤、童明照、李云峰、田步严、苏裕建、杨源、黄剑山、郑鹏峰、周燕、孙丹、冯砚、李月、刘银江、杨剑辉、胡斌、叶春晖、邱维峰、修利平、赵东世、东振中、雷婵、吴超、应科炜、Shueh-Mien Lee、Kong-Yeu Han、Chang-Chaio Han、Ron Kalakuntla、Daniel Wu、Geun-Young Park、Kookhwan Kwon、Jei-Zen Song、Seong-Jun Jang、Kim Hardee、Steve Eaton、Yin-Chao Lai、Chung Chang、Jong-Sang Lee、Kyoung-Chon Jin、Sung-Jin Yoo、Shou-kong Fan、Chin-Fu Huang、Jujiang Li、Pailu Wang、Hsingya Wang、Mingshiang Wang、Ai-Luen Chang、Bruce Schwartz、Lyn Zastrow、Anandarup Bagchi、Charles McLaren、Shan Chen、Ji-Ho Kim、Chung-Ting Yao、Venkatesh Shan、Ted Chang、Amylie Orozco-Guiriba、Paula Zebrowski、Lou Yang、Nadav Katsir、Xiaoqing Yang、Sun-Byeong Yoon、Kwang Kyung Lee、Johny Sjafii、Chia-Kuan Yang、Weiping Wei-Ping Liu、Chin-Chia Kuo、Yi-Chin Huang、Min-Tan Kung、Ying-Hai Cho、Barry Ansell、Glenn Louch、Marco Carlino、Eitan Tene、Eran Schwartz、Omer Shterenberg、Chun-Lung Kuo、Chung-Cheng Wu、Ching-Tang Wu、Kwang-Rae Cho、Ping-Chao Ho、Chi-Wen Kuo、Wei-Li Liu、Chun-Wei Lu、Lien-Sheng Yang、Rong-Tai Kao、Chi-Chieh Sung、Hsiang-Ming Chu、Hua-Chi Lin、Chih-Chun Ho、Cheng-Yi Lu、Chih-Kuang Lin、Kwok-Choi Chun、Yuh-Fong Tang、Tsen-Shau Yang、Chun-Hao Li、Yao-Cheng Lin

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，上海瑾矽执行事务合伙人为上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙），基本情况如下表所示：

中文名称：上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海懿添新能源投资管理有限公司（委派代表：陈冬梅）

成立日期：2018 年 6 月 25 日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：上海市闵行区放鹤路 1088 号第 6 幢 B2022 室

统一社会信用代码：91310000MA1FL5JG2P

经营范围：集成电路设计，机械设备、五金产品及电子产品批发，计算机、软件及辅助设备批发，通讯设备批发，计算机及通讯设备经营租赁，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，上海瑾矽暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

上海瑾矽最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	30,000.04	-
负债总额	15.05	-
所有者权益合计	29,984.99	-
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-15.01	-
净利润	-15.01	-

注：上述财务数据已经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，上海瑾矽除持有北京矽成 4.62%股权外，无其他对外投资。

（四）民和志威

1、民和志威的基本情况

中文名称：青岛民和志威投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：

韩冰）

成立日期：2016 年 3 月 21 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：山东省青岛市即墨区振华街 128 号

统一社会信用代码：91370600MA3C7P7K8Q

经营范围：以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 3 月设立

2016 年 3 月 17 日，烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“民和德元”）、拉萨民和投资管理有限公司（以下简称“拉萨民和”）签署合伙协议，共同出资设立民和志威前身烟台民和志威投资中心（有限合伙）（民和志威前身）。

2016 年 3 月 21 日，烟台市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 91370600MA3C7P7K8Q 的营业执照，民和志威正式成立。民和志威设立时的出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）	1,500.00	5.00
2	有限合伙人	拉萨民和投资管理有限公司	28,500.00	95.00
合计			30,000.00	100.00

（2）2016 年 12 月变更认缴出资额及合伙人

2016 年 12 月 26 日，民和志威召开合伙人会议，同意拉萨民和退伙，同意青岛城投金控股权投资管理有限公司（以下简称“青岛城投”）作为普通合伙人入伙并认缴出资 5.55 万元，同意青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“青岛海丝”）作为有限合伙人入伙并认缴出资 6,004.323 万元，同意民和德元认缴出资额变更为 277.50 万元。同日，各相关合伙人分别签订了《入伙协

议》、《退伙协议》和新的《合伙协议》。

2016年12月29日，民和志威完成本次变更的工商登记。本次变更后，民和志威出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）	277.50	4.41
2	普通合伙人	青岛城投金控股权投资管理有限公司	5.55	0.09
3	有限合伙人	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	6,004.323	95.50
合计			6,287.373	100.00

（3）2017年5月变更认缴出资额

2017年2月16日，民和志威召开合伙人会议，同意合伙企业总认缴出资额变更为28,944.573万元，由全体合伙人同比例认缴。同日，各相关合伙人签订了新的《合伙协议》。

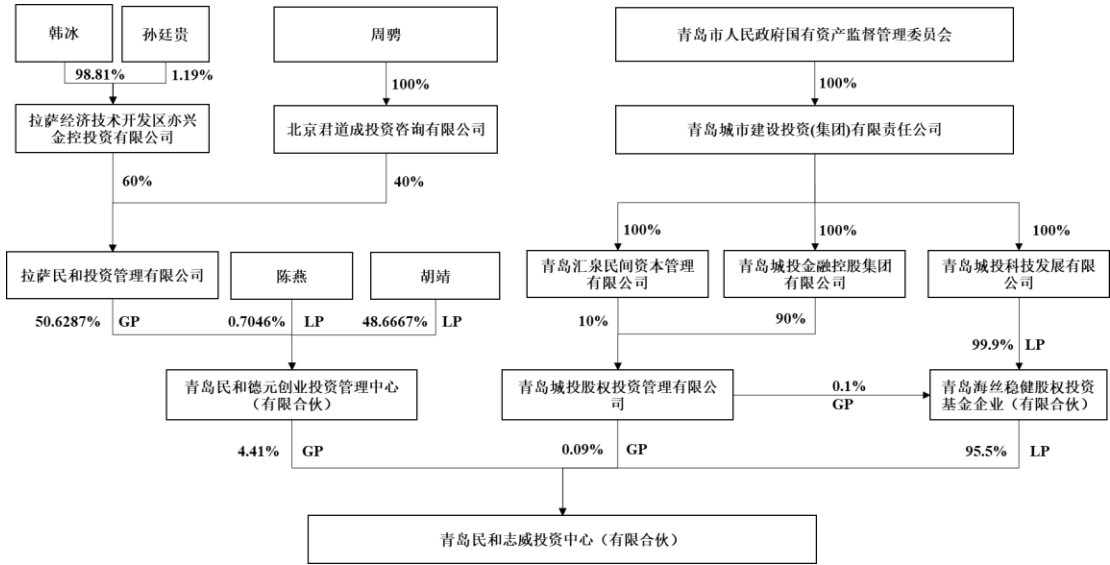
2017年5月3日，民和志威完成本次变更的工商登记。本次变更后，民和志威出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	青岛民和德元股权投资管理中心（有限合伙）	1,277.50	4.41
2	普通合伙人	青岛城投金控股权投资管理有限公司	25.55	0.09
3	有限合伙人	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	27,641.523	95.50
合计			28,944.573	100.00

注：青岛城投金控股权投资管理有限公司已更名为青岛城投股权投资管理有限公司，烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）已更名为烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，民和志威的产权结构及控制关系如下：



民和志威的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
民和志威	韩冰、周骋、胡靖、陈燕、孙廷贵、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，民和志威执行事务合伙人为青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙），基本情况如下：

中文名称：青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：拉萨民和投资管理有限公司（委派代表：韩冰）

成立日期：2016 年 2 月 3 日

企业性质：有限合伙企业

企业地址：山东省青岛市即墨市振华街 128 号

统一社会信用代码：91370600MA3C6BYR3K

经营范围：投资与资产管理；以自有资金进行股权投资；投资管理；投资咨询（未经金融机构批准，不得未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，民和志威暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

民和志威最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	25,760.00	25,779.58
负债总额	0.03	15.93
所有者权益合计	25,759.97	25,763.65
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-593.96	-271.16
净利润	-593.96	-271.16

注：上述财务数据经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，民和志威除持有北京矽成 3.92%股权外，其他主要对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	0.85	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、私募基金备案情况

民和志威于 2017 年 5 月 2 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SR7834，其管理人为民和德元（登记编号 P1031684）。

（五）闪胜创芯

1、闪胜创芯基本情况

中文名称：上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：联发科软件（上海）有限公司（委派代表：Hai Wang）

成立日期：2016 年 2 月 23 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢二层 D298 室

统一社会信用代码：91310000MA1K38785N

经营范围：实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 2 月设立

闪胜创芯由联发科软件（上海）有限公司、联发软件设计（深圳）有限公司、上海承裕、屹唐投资、华创芯原以及北京华清闪胜科技有限公司共同发起设立，认缴出资额为 19,200.00 万元，并于 2016 年 2 月 23 日取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000MA1K38785N 的《营业执照》。闪胜创芯设立时的出资结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	联发科软件（上海）有限公司	320.00	1.67
2	普通合伙人	联发软件设计（深圳）有限公司	320.00	1.67
3	有限合伙人	上海承裕	7,540.00	39.27
4	有限合伙人	屹唐投资	5,220.00	27.19
5	有限合伙人	华创芯原	2,900.00	15.10
6	有限合伙人	北京华清闪胜科技有限公司	2,900.00	15.10
合计			19,200.00	100.00

（2）2017 年 3 月转让份额

2016 年 12 月，经全体合伙人一致同意，北京华清闪胜科技有限公司将其在闪胜创芯中 7,880,460 元（占合伙企业全体合伙人认缴出资总额的 4.1044%）的认缴份额转让给上海承裕；将其在闪胜创芯中 19,486,840 元的认缴份额（占合伙企业全体合伙人认缴出资总额的 10.1494%）的认缴份额转让给屹唐投资；将其在闪胜创芯中 1,632,700 元的认缴份额（占合伙企业全体合伙人认缴出资总额的 0.8504%）的认缴份额转让给民和志威；同时，北京华清闪胜科技有限公司退出闪胜创芯。上述转让完成后，闪胜创芯的股权结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	联发科软件（上海）有限公司	320.00	1.67
2	普通合伙人	联发软件设计（深圳）有限公司	320.00	1.67
3	有限合伙人	上海承裕	8,328.05	43.38
4	有限合伙人	屹唐投资	7,168.68	37.34
5	有限合伙人	华创芯原	2,900.00	15.10
6	有限合伙人	民和志威	163.27	0.85
合计			19,200.00	100.00

2017年3月15日，闪胜创芯完成本次变更的工商登记。

（3）2019年5月变更合伙人

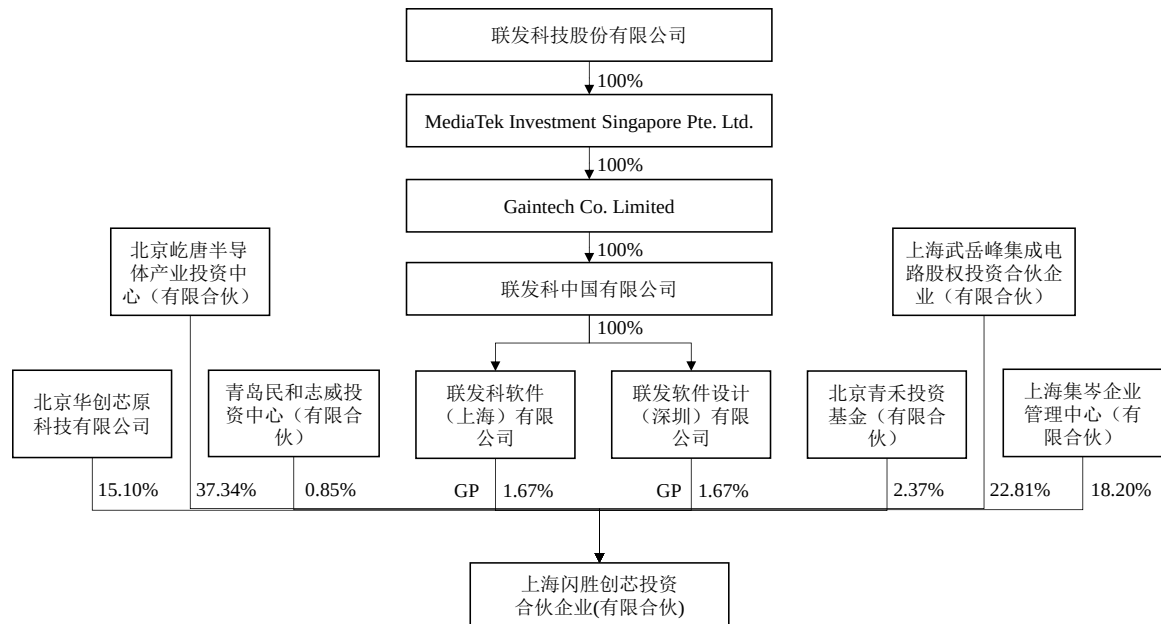
2019年5月，经全体合伙人一致同意，上海承裕退出闪胜创芯；同时，武岳峰集电、上海集岑、北京青禾作为有限合伙人加入闪胜创芯，其中，武岳峰集电认缴闪胜创芯 43,787,283 元份额；上海集岑认缴闪胜创芯 34,952,476 元份额；北京青禾认缴闪胜创芯 4,540,701 元份额。上述变更完成后，闪胜创芯的股权结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	联发科软件（上海）有限公司	320.00	1.67
2	普通合伙人	联发软件设计（深圳）有限公司	320.00	1.67
3	有限合伙人	屹唐投资	7,168.68	37.34
4	有限合伙人	武岳峰集电	4,378.73	22.81
5	有限合伙人	上海集岑	3,495.25	18.20
6	有限合伙人	华创芯原	2,900.00	15.10
7	有限合伙人	北京青禾	454.07	2.37
8	有限合伙人	民和志威	163.27	0.85
合计			19,200.00	100.00

2019年5月27日，闪胜创芯完成本次变更的工商登记。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，闪胜创芯的产权结构及控制关系如下：



注：屹唐投资、华创芯原、民和志威、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾的产权结构详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（一）、（二）、（四）、（九）、（十）、（十一）”相关内容。

闪胜创芯的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
闪胜创芯	北京经济技术开发区国有资产管理办公室、刘越、陈大同、张凤华、秦岭、清华大学、孙玉望、赵森、王心然、邱忠乐、汪时辉、黄飞、祝信标、徐慧勇、徐海麟、劳燕燕、倪菊媛、汪桂荣、徐兴华、李河住、中关村发展集团股份有限公司、林童、姜明明、张洋、中芯国际集成电路制造有限公司、中关村科技园区海淀创业服务中心、赵伟国、李义、李禄媛、浙江中国小商品城集团股份有限公司、悦达资本股份有限公司、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、沈正宁、李国文、韩冰、周骋、胡靖、陈燕、孙廷贵、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会、联发科技股份有限公司、武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier、上海张江高科技园区开发股份有限公司、China Electronic Capital Limited、Qorvo International Pte.Ltd、Farsight Capital International Ltd、上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、陈劲松、中国工商银行股份有限公司、上海市嘉定区集体资产管理委员会、上海市嘉定区国有资产监督管理委员会、嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江省财政厅、清华大学、嘉兴市投资基金管理中心、龙树资本管理股份有限公司、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会、国务院、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会、王盛尧、胡文兵、唐光峰、董骏、李辰海、蒋利明、吴文龙、金燕君、贾杭平、项伟、戚雪飞、沈正宁、李国文、浙江大学、杭州市财政局、神雾环保技术股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江省人民政府、李水荣、许月娟、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙、张志鸿、姜心刚、李文静、榆林市国资委、陕西省国资委、延安市国资委、国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省财政厅、中国长城资产管理股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、陕西金叶科教集团股份有限公司、略阳县财政局、铜川市国资委、延长油田股份有限公司、陕西省人民政府、上海证大投资发展股份有限公司、中

国华融资产管理股份有限公司、西安市人民政府国有资产监督管理委员会、中国烟草总公司陕西省公司、**中铁高新工业股份有限公司、重庆两江新区管理委员会、中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、建银国际（控股）有限公司、优俊投资有限公司、重庆川仪股份有限公司**、孙东伟、北京市人民政府国有资产监督管理委员会、中国中化股份有限公司、长江证券股份有限公司、王水福、陈夏鑫、胡柏藩、张平一、袁益中、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、梁碧源、陈世林、王正江、梁晓东、梁新中、石程、梁志刚、朱汉祥、陈锡能、邓容、黄剑虹、吕月秋、胡煜祥、潘贤炜、张晓东、梁玉琪、张玉英、黄照明、吴正洪、丁仲军、俞伟国、吕锦梅、周贵阳、陈康、孙洁民、梁百安、吕法苗、胡宏灿、求学海、胡柏藩、徐春蕾、陈学军、石欢洪、吕四明、胡英毅、石互英、杨妃姝、章潮宏、吕志芳、许东辉、高玉阳、吕林君、竺志苗、吕士华、汪良明、杨金枢、杨国青、宋槐江、官珊珊、潘德军、梁恩民、张铭锋、张苏芳、陈方武、李和平、胡木莲、石杏康、盛伯钦、吴斌、曹亮炯、张晓波、刘岳军、舒东升、王曦文、刘新友、刘斌、王正鲁、王钟燕、胡正洋、石润民、蔡国平、丁春富、潘浩军、梁保富、吕国英、俞喜春、陈伟东、胡鑫鹦、梁亚东、胡柏素、黄国东、杨新良、王云龙、何继铭、丁月萍、俞孟飞、章雪洋、王子寅、吴轶平、胡志五、黄生富、潘国祥、徐松樟、何中南、盛鸿飞、梁肖、张谦、孙琼华、陈英、王玉如、章丽霞、盛桢、王松浩、郑乐友、胡梅友、胡季强、蔡芍英、胡北、陈德良、叶剑锋、浙江康恩贝制药股份有限公司、余斌、朱啸虎、杨志伟、韩思婷、浙江清华长三角研究院、王国飞、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、林立、林建峰、沈俊毅、张佳慧、蒋治华、陈一芳、陶荣、卫国林、冉隼、刘小鹏、高玉薇、王景斌、王树珍、朱妮、周祁、黄洁贞、时祖仁、夏雪、裘超强、徐健、孙艳霞、张敏、张萍、陈瑾兰、盘旋、王栋、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、悦达资本股份有限公司、中关村科技园区海淀园创业服务中心、杜旭玉、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、门士伟、高瑞昌、郑兴刚、刘峰、周焱、张赛美、何君琦、戴思元、上海瑞金资本管理有限公司-上银瑞金上海银行 2 号专项资产管理计划、启迪控股股份有限公司、**上海市松江区国有资产管理委员会**、丁健、刘雁、宝山区政府、上海电力股份有限公司、赵鑫、黄海英、韩宇泽、冯涛、汤澄、中铄投资股份有限公司、杭州市临安区国有资产监督管理委员会办公室、杭州市临安区财政局、广州市财政局、侯磊、王星、潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊市峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心、博时资本管理有限公司-博时上海永宣新经济专项资产管理计划和博时上海永宣新经济二期专项资产管理计划、思源电气股份有限公司

4、执行事务合伙人的基本情况

中文名称：联发科软件（上海）有限公司

法定代表人：Hai Wang

成立日期：2009 年 12 月 7 日

注册资本：29,700 万元人民币

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

统一社会信用代码：9131000069876516XE

经营范围：计算机软件制作，电子产品、通讯产品的研发，销售自产产品并提供相关配套服务；上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。（涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，闪胜创芯暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

闪胜创芯最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	19,203.62	19,204.83
负债总额	-	-
所有者权益合计	19,203.62	19,204.83
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-1.20	-0.16
净利润	-1.20	-0.16

注：上述财务数据已经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，闪胜创芯除持有北京矽成 3.78%股权外，无其他对外投资。

（六）Worldwide Memory（国际芯盛有限公司）

1、Worldwide Memory 的基本情况

企业名称：Worldwide Memory Co., Limited

成立日期：2017 年 4 月 6 日

股本：1,000 股普通股

注册地址：18/F, Edinburgh Tower, The Landmark15 Queen's Rd Central, Hong

Kong

业务性质：投资

注册登记文件编号：2523548

董事：Shueh-Mien (Jimmy) Lee、Han Kong-Yeu

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017 年 4 月设立

2017 年 4 月 6 日，Worldwide Memory Co., Limited 前身 ISSI Employee Investment Co., Limited 在香港注册成为有限公司，注册资本 60 美元，总股本 600 股，由 US MEMORY, LLC 持有。

（2）2017 年 6 月更名、增资

2017 年 6 月 12 日，ISSI Employee Investment Co., Limited 更名为 Worldwide Memory Co., Limited。

2017 年 6 月 13 日，注册资本增加至 100 美元，股本增加至 1,000 股，新增股份由 Rambo Investment Company Limited 持有。

本次增资完成后，US MEMORY, LLC 和 Rambo Investment Company Limited 分别持有 60%和 40%的股份。

（3）2018 年 2 月股权转让

2018 年 2 月 13 日，US MEMORY, LLC 和 Rambo Investment Company Limited 分别将其持有的 60% 和 40% 股份转让给 US MEMORY, LLC AND EURO-PACIFIC MEMORY LLC (JOINTLY)。

本次转让完成后，US MEMORY, LLC AND EURO-PACIFIC MEMORY LLC (JOINTLY) 持有 100%股份。

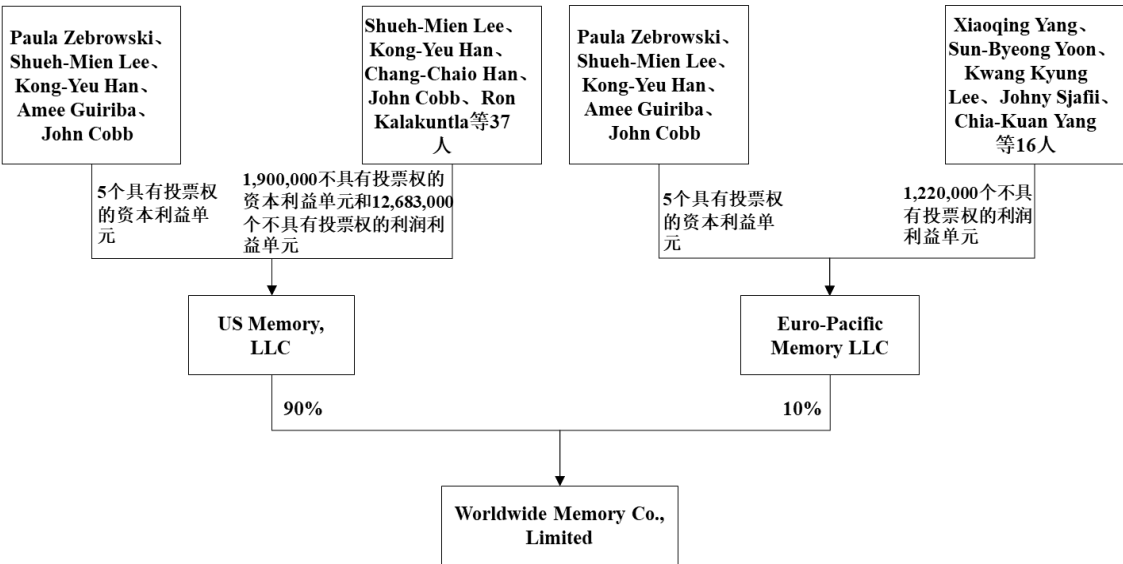
（4）2018 年 11 月股权转让、增资

2018 年 11 月 12 日，US MEMORY, LLC AND EURO-PACIFIC MEMORY LLC (JOINTLY) 将其持有的 900 股转让给 US MEMORY, LLC，将其持有的 100 股转让给 EURO-PACIFIC MEMORY LLC。

同日，US MEMORY, LLC 缴足注册资本至 90 美元，并增资至 15,998,511.18 美元；EURO-PACIFIC MEMORY LLC 缴足注册资本至 10 美元，并增资至 1,636,198.50 美元。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，Worldwide Memory 的产权结构如下：



Worldwide Memory 的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
Worldwide Memory	Shueh-Mien Lee、Kong-Yeu Han、Chang-Chaio Han、John Cobb、Ron Kalakuntla、Daniel Wu、Geun-Young Park、Kookhwan Kwon、Jei-Zen Song、Seong Jun Jang、Kim Hardee、Steve Eaton、Yin-Chao Lai、Chung Chang、Jong Sang Lee、KyoungChon Jin、SungJin Yoo、Shou-kong Fan、Chin Fu Huang、Jujiang Li、Pailu Wang、Hsingya Wang、Mingshiang Wang、Ai-Luen Chang、Bruce Schwartz、Lyn Zastrow、Anandarup Bagchi、Charles McLaren、Shan Chen、Ji-Ho Kim、Chung-Ting Yao、Venkatesh Shan、Ted Chang、Amylie Orozco-Guiriba、Paula Zebrowski、Lou Yang、Nadav Katsir、Xiaoqing Yang、Sun-Byeong Yoon、Kwang Kyung Lee、Johnny Sjaflii、Chia-Kuan Yang、Wei-Ping Liu、Chin-Chia Kuo、Yi-Chin Huang、Min-Tan Kung、Ying-Hai Cho、Barry Ansell、Glenn Louch、Marco Carlino、Eitan Tene、Eran Schwartz、Omer Shterenberg

4、控股股东基本情况

企业名称：US Memory, LLC

成立日期：2017 年 3 月 2 日

注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.

注册号：6333466

经理：Paula Zebrowski

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，Worldwide Memory 暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

Worldwide Memory 最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	11,561.65	10,490.40
负债总额	-	10,493.41
所有者权益合计	11,561.65	-3.01
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-200.92	-3.07
净利润	-200.92	-3.07

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，Worldwide Memory 除持有北京矽成 1.78%股权外，无其他对外投资。

（七）Asia Memory（亚太芯盛有限公司）

1、Asia Memory 的基本情况

企业名称：Asia-Pacific Memory Co., Limited

成立日期：2017 年 11 月 23 日

股本：1,000 股普通股

注册地址：18/F, Edinburgh Tower, The Landmark15 Queen's Rd Central, Hong Kong

业务性质：投资

注册登记文件编号：2612493

董事：Ching-Tang Wu

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017 年 11 月设立

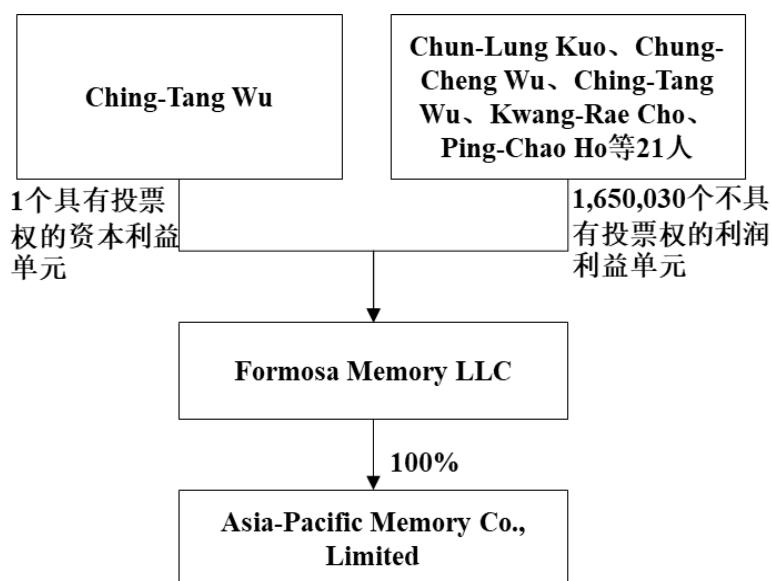
2017 年 11 月 23 日，Asia-Pacific Memory Co., Limited 在香港注册成为有限公司，注册资本 100 美元，总股本 1,000 股，由 Formosa Memory LLC 持有。

（2）2018 年 11 月增资

2018 年 11 月 12 日，Formosa Memory LLC 缴足注册资本至 100 美元，并增资至 2,062,934.61 美元。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，Asia Memory 的产权结构及控制关系如下：



Asia Memory 的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
Asia Memory	Chun-Lung Kuo、Chung-Cheng Wu、Ching-Tang Wu、Kwang-Rae Cho、Ping-Chao Ho、Chi-Wen Kuo、Wei-Li Liu、Chun-Wei Lu、Lien-Sheng Yang、Rong-Tai Kao、Chi-Chieh Sung、Hsiang-Ming Chu、Hua-Chi Lin、Chih-Chun Ho、Cheng-Yi Lu、Chih-Kuang Lin、Kwok-Choi Chun、Yuh-Fong Tang、Tsen-Shau Yang、Chun-Hao Lee、Yao-Cheng Lin

4、控股股东基本情况

企业名称：Formosa Memory LLC

成立日期：2017 年 10 月 20 日

注册地址：Estera Trust (Cayman) Limited, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

注册号：719

经理：Ching-Tang Wu

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，Asia Memory 暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

Asia Memory 最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,346.76	1,364.41
负债总额	0.02	1,364.74
所有者权益合计	1,346.74	-0.33
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-26.17	-0.40
净利润	-26.17	-0.40

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，Asia Memory 除持有北京矽成 0.21% 股权外，无其他对外投资。

（八）厦门芯华

1、厦门芯华的基本情况

中文名称：厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：厦门市矽盛企业管理有限公司（委派代表：羊首道）

成立日期：2018 年 4 月 3 日

企业性质：有限合伙企业

企业地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A124

统一社会信用代码：91350200MA31KYUP0U

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018 年 4 月设立

2018 年 3 月 30 日，羊首道等 19 人签署《合伙协议》，出资设立厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本 918.1796 万元。其中羊首道作为普通合伙人，其余合伙人为有限合伙人。

2018 年 4 月 3 日，厦门市市场监督管理局核发统一社会信用代码为 91350200MA31KYUP0U 的营业执照，厦门芯华正式成立。厦门芯华设立时的出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	普通合伙人	羊首道	0.01	0.00
2	有限合伙人	李云峰	170.01	18.52
3	有限合伙人	沈安星	69.52	7.57
4	有限合伙人	李鹤	63.20	6.88
5	有限合伙人	童明照	60.29	6.57
6	有限合伙人	苏裕建	51.82	5.64
7	有限合伙人	田步严	51.82	5.64
8	有限合伙人	杨源	50.56	5.51
9	有限合伙人	黄剑山	47.40	5.16
10	有限合伙人	周燕	45.50	4.96
11	有限合伙人	郑鹏峰	45.50	4.96
12	有限合伙人	孙丹	42.98	4.68
13	有限合伙人	冯砚	42.98	4.68
14	有限合伙人	李月	40.45	4.41
15	有限合伙人	刘银江	37.92	4.13
16	有限合伙人	杨剑辉	30.72	3.35
17	有限合伙人	汪齐方	25.28	2.75
18	有限合伙人	叶春晖	24.02	2.62

19	有限合伙人	东振中	18.20	1.98
合计			918.18	100.00

（2）2018年4月变更合伙人

2018年4月26日，厦门芯华通过合伙企业变更决定书，同意普通合伙人羊首道将所持有的财产份额转让给厦门市矽盛企业管理有限公司，厦门市矽盛企业管理有限公司作为普通合伙人入伙、羊首道退伙。

2018年4月28日，厦门芯华完成本次变更的工商登记。本次变更后，厦门芯华出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
1	普通合伙人	厦门市矽盛企业管理有限公司	0.01	0.00
2	有限合伙人	李云峰	170.01	18.52
3	有限合伙人	沈安星	69.52	7.57
4	有限合伙人	李鹤	63.20	6.88
5	有限合伙人	童明照	60.29	6.57
6	有限合伙人	苏裕建	51.82	5.64
7	有限合伙人	田步严	51.82	5.64
8	有限合伙人	杨源	50.56	5.51
9	有限合伙人	黄剑山	47.40	5.16
10	有限合伙人	周燕	45.50	4.96
11	有限合伙人	郑鹏峰	45.50	4.96
12	有限合伙人	孙丹	42.98	4.68
13	有限合伙人	冯砚	42.98	4.68
14	有限合伙人	李月	40.45	4.41
15	有限合伙人	刘银江	37.92	4.13
16	有限合伙人	杨剑辉	30.72	3.35
17	有限合伙人	汪齐方	25.28	2.75
18	有限合伙人	叶春晖	24.02	2.62
19	有限合伙人	东振中	18.20	1.98
合计			918.18	100.00

（3）2018年5月变更认缴出资额及合伙人

2018年5月4日，厦门芯华通过合伙企业变更决定书，同意增加羊首道为

有限合伙人并认缴出资 120.08 万元，合伙企业出资额增加至 1,038.2596 万元。

2018 年 5 月 7 日，厦门芯华完成本次变更的工商登记。本次变更后，厦门芯华出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	普通合伙人	厦门市矽盛企业管理有限公司	0.01	0.00
2	有限合伙人	李云峰	170.01	16.37
3	有限合伙人	羊首道	120.08	11.57
4	有限合伙人	沈安星	69.52	6.70
5	有限合伙人	李鹤	63.20	6.09
6	有限合伙人	童明照	60.29	5.81
7	有限合伙人	苏裕建	51.82	4.99
8	有限合伙人	田步严	51.82	4.99
9	有限合伙人	杨源	50.56	4.87
10	有限合伙人	黄剑山	47.40	4.57
11	有限合伙人	周燕	45.50	4.38
12	有限合伙人	郑鹏峰	45.50	4.38
13	有限合伙人	孙丹	42.98	4.14
14	有限合伙人	冯砚	42.98	4.14
15	有限合伙人	李月	40.45	3.90
16	有限合伙人	刘银江	37.92	3.65
17	有限合伙人	杨剑辉	30.72	2.96
18	有限合伙人	汪齐方	25.28	2.43
19	有限合伙人	叶春晖	24.01	2.31
20	有限合伙人	东振中	18.20	1.75
合计			1,038.26	100.00

（4）2019 年 7 月代持解除及变更合伙人

邱维峰、修利平、赵东世、雷婵、肖传莲、吴超、应科炜所持的厦门芯华财产份额原系由李云峰代持。2018 年 11 月，李云峰与上述主体就代持事项签署《厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙财产份额代持解除及转让协议》，肖传莲与邱维峰签署《厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙财产份额转让协议》将所持财产份额转让予邱维峰。胡斌所持的厦门芯华 2.4348%财产

份额系从汪齐方处转入。2018年7月，胡斌与汪齐方签署相关合伙财产份额转让协议，约定汪齐方将其持有的厦门芯华2.4348%财产份额转让给胡斌。2019年6月，厦门芯华通过合伙企业变更决定书，同意上述变更。

2019年7月1日，厦门芯华完成本次变更的工商登记。本次变更后，厦门芯华出资结构如下：

序号	合伙人类型	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴比例(%)
1	普通合伙人	厦门市矽盛企业管理有限公司	0.01	0.00
2	有限合伙人	羊首道	120.08	11.57
3	有限合伙人	沈安星	69.52	6.70
4	有限合伙人	李鹤	63.20	6.09
5	有限合伙人	童明照	60.29	5.81
6	有限合伙人	李云峰	54.35	5.23
7	有限合伙人	苏裕建	51.82	4.99
8	有限合伙人	田步严	51.82	4.99
9	有限合伙人	杨源	50.56	4.87
10	有限合伙人	黄剑山	47.40	4.57
11	有限合伙人	周燕	45.50	4.38
12	有限合伙人	郑鹏峰	45.50	4.38
13	有限合伙人	孙丹	42.98	4.14
14	有限合伙人	冯砚	42.98	4.14
15	有限合伙人	李月	40.45	3.90
16	有限合伙人	刘银江	37.92	3.65
17	有限合伙人	邱维峰	36.02	3.47
18	有限合伙人	杨剑辉	30.72	2.96
19	有限合伙人	胡斌	25.28	2.43
20	有限合伙人	叶春晖	24.02	2.31
21	有限合伙人	修利平	18.33	1.77
22	有限合伙人	赵东世	18.33	1.77
23	有限合伙人	东振中	18.20	1.75
24	有限合伙人	雷婵	16.43	1.58
25	有限合伙人	吴超	15.17	1.46
26	有限合伙人	应科炜	11.38	1.10

合计	1,038.26	100.00

①厦门芯华财产份额代持的基本情况

根据厦门芯华、李云峰、修利平等七人出具的《关于财产份额代持事项的声明与承诺函》及中介机构对李云峰、修利平等七人的访谈，厦门芯华系北京矽成境内员工持股平台，为北京矽成境内资本运作目的，厦门芯华设立时对合伙人数量进行限制，因此由李云峰代修利平等七人持有厦门芯华相关财产份额。2018年，修利平等七人分别与李云峰约定，由李云峰代修利平等七人参与投资厦门芯华，李云峰合计持有厦门芯华1,700,080元合伙份额，其中，代表修利平、邱维峰、赵东世、雷婵、肖传莲、吴超及应科炜分别持有厦门芯华202,240元、183,280元、183,280元、164,320元、158,000元、151,680元、113,760元财产份额。

根据修利平等七人提供的转账凭证、《结婚证》等文件资料，被代持方邱维峰、修利平、赵东世、雷婵、肖传莲、吴超及应科炜于2018年5月（即厦门芯华成立之初）将其对厦门芯华的出资款支付予李云峰（其中，雷婵为李云峰配偶，其向厦门芯华的出资款由其与李云峰的夫妻共同财产支付），上述财产份额代持情况真实存在。

根据厦门芯华、李云峰、修利平等七人出具的《关于财产份额代持事项的进一步声明与承诺函》，修利平等七名被代持人均为中国籍自然人，具备民事权利能力及行为能力，且均为北京矽成境内子公司员工，不存在法律、行政法规或其他规范性法律文件规定的不能担任合伙企业合伙人/出资人的情形，不存在因身份不合法而不能直接持有厦门芯华财产份额的情况。

②厦门芯华财产份额代持的解除

2018年11月5日，邱维峰、修利平、赵东世、雷婵、肖传莲、吴超、应科炜等7名自然人与李云峰签署《厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙财产份额代持解除及转让协议》，约定李云峰将其原代邱维峰、修利平、赵东世、雷婵、肖传莲、吴超及应科炜分别持有的厦门芯华202,240元、183,280元、183,280元、164,320元、158,000元、151,680元、113,760元财产份额转让还原至相应自然人。截至本报告书出具日，上述财产份额代持解除涉及的工商变更登记程序已完成。

基于上述，为北京矽成境内资本运作目的，厦门芯华设立时对合伙人数量进行限制，因此由李云峰代修利平等七人持有相应财产份额，被代持人均真实出资，代持情况真实存在，被代持人不存在因身份不合法而不能直接持有厦门芯华财产份额的情况；截至本报告书出具日，厦门芯华财产份额代持解除涉及的工商变更登记程序已完成，相关代持关系已彻底解除。

③厦门芯华财产份额代持不存在经济纠纷或法律风险，不会对本次交易产生重大不利影响

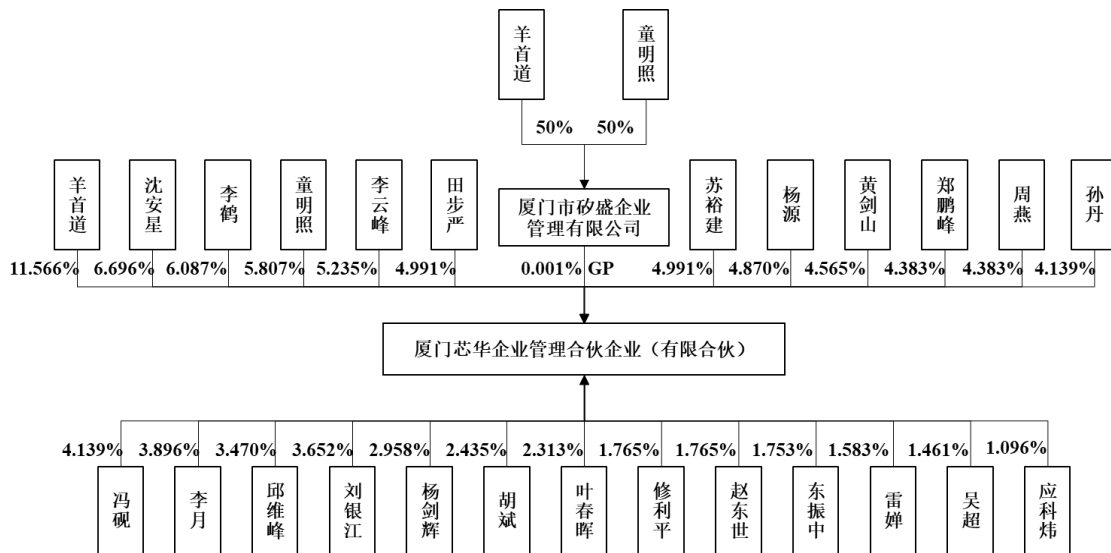
根据厦门芯华、李云峰、修利平等七人出具的《关于财产份额代持事项的声明与承诺函》及中介机构对李云峰、修利平等七人的访谈，上述财产份额转让完成后，厦门芯华合伙财产权属清晰，不存在任何代持、信托持股等不规范行为，也不存在纠纷或潜在纠纷，当事人及第三方均未对此提出任何异议。

此外，经查询中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）等公开渠道，截至本报告书出具日，未发现因厦门芯华财产份额代持而导致的诉讼或仲裁案件。

基于上述，厦门芯华财产份额代持已彻底解除，不存在经济纠纷或法律风险，不会对本次交易产生重大不利影响。

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，厦门芯华的产权结构及控制关系如下：



厦门芯华的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
厦门芯华	羊首道、沈安星、李鹤、童明照、李云峰、田步严、苏裕建、杨源、黄剑山、郑鹏峰、周燕、孙丹、冯砚、李月、刘银江、杨剑辉、胡斌、叶春晖、邱维峰、修利平、赵东世、东振中、雷婵、吴超、应科炜

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，厦门芯华执行事务合伙人为厦门市矽盛企业管理有限公司，基本情况如下表所示：

中文名称：厦门市矽盛企业管理有限公司

法定代表人：羊首道

成立日期：2018年4月3日

注册资本：0.01万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A126

统一社会信用代码：91350200MA31KU4XXK

经营范围：企业管理咨询

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，厦门芯华暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

厦门芯华最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,039.22	-
负债总额	1.08	-
所有者权益合计	1,038.13	-
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-0.12	-
净利润	-0.12	-

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，厦门芯华除持有北京矽成0.16%股权外，无其他对外投资。

（九）武岳峰集电

1、武岳峰集电基本情况

中文名称：上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：Digital Time Investment Limited（委派代表：潘建岳）

成立日期：2015 年 8 月 3 日

企业性质：有限合伙企业

经营场所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2196 室

统一社会信用代码：91310000351127927X

经营范围：股权投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2015 年 8 月设立

武岳峰集电由 Digital Time Investment Limited、上海创业投资有限公司、Gaintech Co. Limited、Shanghai (Z.J.) Holdings Limited、上海张江科技创业投资

有限公司、上海张江火炬创业投资有限公司、上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立，认缴出资总额为 300,000 万元，并于 2015 年 8 月 3 日取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000500574812 的《营业执照》。

武岳峰集电设立时的出资结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	Digital Time Investment Limited	1,575.00	0.53
2	有限合伙人	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	142,735.00	47.58
3	有限合伙人	上海创业投资有限公司	90,000.00	30.00
4	有限合伙人	Gaintech Co. Limited	30,690.00	10.23
5	有限合伙人	Shanghai (Z.J.) Holdings Limited	20,000.00	6.67
6	有限合伙人	上海张江科技创业投资有限公司	10,000.00	3.33
7	有限合伙人	上海张江火炬创业投资有限公司	5,000.00	1.67
合计			300,000.00	100.00

注：Gaintech Co. Limited 和 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 的认缴出资额分别 30,690.00 万元（或等值美元）和 20,000.00 万元（或等值美元）。

（2）2017 年 1 月变更认缴出资额及合伙人

经全体合伙人一致决定，同意国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海张江浩成创业投资有限公司、天津博达恒盛科技有限公司、SummitView Electronic Investment L.P.作为有限合伙人加入武岳峰集电，认缴出资额分别为 150,000 万元、13,000 万元、50,000 万元、30,000 万元；同意 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 的认缴出资额由 20,000 万元减至 7,000 万元；同意上海张江科技创业投资有限公司的认缴出资额由 10,000 万元减至 5,000 万元；同意 Digital Time Investment Limited 的认缴出资额由 1,575 万元增至 2,500 万元；同意 Gaintech Co. Limited 的认缴出资额由 30,690 万元增至 50,000 万元。

2017 年 1 月 9 日，武岳峰集电取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91310000351127927X 的《营业执照》。

本次变更完成后，武岳峰集电的出资结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	Digital Time Investment Limited	2,500.00	0.46

2	有限合伙人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	150,000.00	27.51
3	有限合伙人	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	142,735.00	26.18
4	有限合伙人	上海创业投资有限公司	90,000.00	16.51
5	有限合伙人	Gaintech Co. Limited	50,000.00	9.17
6	有限合伙人	天津博达恒盛科技有限公司	50,000.00	9.17
7	有限合伙人	SummitView Electronic Investment L.P.	30,000.00	5.50
8	有限合伙人	上海张江浩成创业投资有限公司	13,000.00	2.38
9	有限合伙人	Shanghai (Z.J.) Holdings Limited	7,000.00	1.28
10	有限合伙人	上海张江科技创业投资有限公司	5,000.00	0.92
11	有限合伙人	上海张江火炬创业投资有限公司	5,000.00	0.92
合计			545,235.00	100.00

（3）2017年5月变更认缴出资额

2017年5月,经武岳峰集电全体合伙人一致决定,同意 SummitView Electronic Investment L.P.的认缴出资额由 30,000 万元减至 17,300 万元; 同意上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)的认缴出资额由 142,735 万元增至 150,735 万元。

本次变更完成后,武岳峰集电的出资结构如下表所示:

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	Digital Time Investment Limited	2,500.00	0.46
2	有限合伙人	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	150,735.00	27.89
3	有限合伙人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	150,000.00	27.75
4	有限合伙人	上海创业投资有限公司	90,000.00	16.65
5	有限合伙人	Gaintech Co. Limited	50,000.00	9.25
6	有限合伙人	天津博达恒盛科技有限公司	50,000.00	9.25
7	有限合伙人	SummitView Electronic Investment L.P.	17,300.00	3.20
8	有限合伙人	上海张江浩成创业投资有限公司	13,000.00	2.41
9	有限合伙人	Shanghai (Z.J.) Holdings Limited	7,000.00	1.30
10	有限合伙人	上海张江科技创业投资有限公司	5,000.00	0.93
11	有限合伙人	上海张江火炬创业投资有限公司	5,000.00	0.93
合计			540,535.00	100.00

（4）2018 年 7 月变更认缴出资额

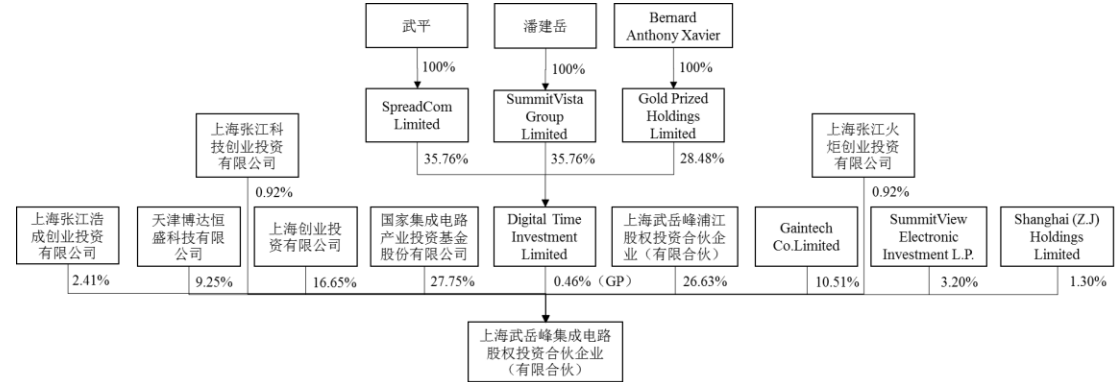
2018 年 4 月，经武岳峰集电全体合伙人一致决定，同意 Gaintech Co. Limited 的认缴出资额由 50,000 万元增至 56,800 万元等值外汇；同意上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由 150,735 万元减至 143,935 万元等值外汇。

2018 年 7 月 27 日，武岳峰集电完成本次变更的工商变更。本次变更完成后，武岳峰集电的出资结构如下表所示：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	Digital Time Investment Limited	2,500.00	0.46
2	有限合伙人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	150,000.00	27.75
3	有限合伙人	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙)	143,935.00	26.63
4	有限合伙人	上海创业投资有限公司	90,000.00	16.65
5	有限合伙人	Gaintech Co. Limited	56,800.00	10.51
6	有限合伙人	天津博达恒盛科技有限公司	50,000.00	9.25
7	有限合伙人	SummitView Electronic Investment L.P.	17,300.00	3.20
8	有限合伙人	上海张江浩成创业投资有限公司	13,000.00	2.41
9	有限合伙人	Shanghai (Z.J.) Holdings Limited	7,000.00	1.30
10	有限合伙人	上海张江科技创业投资有限公司	5,000.00	0.93
11	有限合伙人	上海张江火炬创业投资有限公司	5,000.00	0.93
合计			540,535.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，武岳峰集电的产权结构及控制关系如下：



武岳峰集电的产权结构列表如下：

序号	出资层级	出资人
1	1	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）
2	1.1	Digital Time Investment Limited
3	1.1.1	SpreadCom Limited
4	1.1.1.1	武平
5	1.1.2	Summit Vista Group Limited
6	1.1.2.1	潘建岳
7	1.1.3	Gold Prized Holdings Limited
8	1.1.3.1	Bernard Anthony Xavier
9	1.2	Gaintech Co.Limited
10	1.2.1	MediaTek Investment Singapore Pte Ltd
11	1.2.1.1	联发科技股份有限公司
12	1.3	Shanghai (Z.J) Holdings Limited
13	1.3.1	上海张江浩成创业投资有限公司
14	1.3.1.1	上海张江高科技园区开发股份有限公司
15	1.4	SummitView Electronic Investment L.P.
16	1.4.1	China Electronic Capital Limited
17	1.4.2	Qorvo International Pte.Ltd
18	1.4.3	Farsight Capital International Ltd
19	1.5	上海创业投资有限公司
20	1.5.1	上海科技创业投资（集团）有限公司
21	1.5.1.1	上海市国有资产监督管理委员会
22	1.6	上海张江科技创业投资有限公司
23	1.6.1	上海张江（集团）有限公司
24	1.6.1.1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
25	1.7	上海张江火炬创业投资有限公司
26	1.7.1	上海张江火炬创业园投资开发有限公司
27	1.7.1.1	上海浦东科创集团有限公司
28	1.7.1.1.1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
29	1.8	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）
30	1.8.1	珠海融澄股权投资合伙企业（有限合伙）
31	1.8.1.1	天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）

32	1.8.1.1.1	Profit Score Limited
33	1.8.1.1.1.1	Profit Rainbow Holdings Limited
34	1.8.1.1.1.1.1	Cheer Harvest Holdings Limited
35	1.8.1.1.1.1.1.1	陈劲松
36	1.8.1.1.2	工银国际咨询管理有限公司
37	1.8.1.1.2.1	工银国际投资管理有限公司
38	1.8.1.1.2.1.1	工银国际控股有限公司
39	1.8.1.1.2.1.1.1	中国工商银行股份有限公司
40	1.8.1.2	北京融泽通远投资顾问有限公司
41	1.8.1.2.1	天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）
42	1.8.1.2.1.1	工银国际普通合伙管理有限公司
43	1.8.1.2.1.1.1	工银国际投资管理有限公司（见本表格第 36 项）
44	1.8.1.2.1.2	Benefit Field Limited
45	1.8.1.2.1.2.1	Wise Score Holdings Limited
46	1.8.1.2.1.2.1.1	Acute Profits Holdings Limited
47	1.8.1.2.1.2.1.1.1	陈劲松
48	1.8.1.2.2	天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）（见本表格第 31 项）
49	1.8.2	上海嘉投岳盈投资管理合伙企业（有限合伙）
50	1.8.2.1	上海岳盈投资管理有限公司
51	1.8.2.1.1	潘建岳
52	1.8.2.1.2	武 平
53	1.8.2.2	上海嘉定创业投资管理有限公司
54	1.8.2.2.1	上海市嘉定区集体经济联合社
55	1.8.2.2.1.1	上海市嘉定区集体资产管理委员会
56	1.8.2.2.2	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司
57	1.8.2.2.2.1	上海市嘉定区国有资产管理委员会
58	1.8.2.3	上海水毓企业管理中心
59	1.8.2.3.1	潘建岳
60	1.8.2.4	武 平
61	1.8.3	嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）
62	1.8.3.1	嘉兴市嘉实金融控股有限公司
63	1.8.3.1.1	嘉兴市实业资产投资集团有限公司
64	1.8.3.1.1.1	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

65	1.8.3.1.1.1.1	嘉兴市国有资产监督管理委员会
66	1.8.3.2	义乌中国小商品城金融控股有限公司
67	1.8.3.2.1	浙江中国小商品城集团股份有限公司
68	1.8.3.3	浙江省产业基金有限公司
69	1.8.3.3.1	浙江省金融控股有限公司
70	1.8.3.3.1.1	浙江省财务开发公司
71	1.8.3.3.1.1.1	浙江省财政厅
72	1.8.3.3.2	浙江省创新发展投资有限公司
73	1.8.3.3.2.1	浙江省金融控股有限公司（见本表格第 69 项）
74	1.8.3.4	清控资产管理有限公司
75	1.8.3.4.1	清华控股有限公司
76	1.8.3.4.1.1	清华大学
77	1.8.3.5	嘉兴市投资基金管理中心
78	1.8.3.6	龙树资本管理股份有限公司
79	1.8.3.7	宁波海创投资发展有限公司
80	1.8.3.7.1	宁波杭州湾新区开发建设管理委员会
81	1.8.3.7.2	中国农发重点建设基金有限公司
82	1.8.3.7.2.1	中国农业发展银行
83	1.8.3.7.2.1.1	国务院
84	1.8.3.8	义乌市国有资本运营有限公司
85	1.8.3.8.1	义乌市人民政府国有资产监督管理办公室
86	1.8.3.9	宁波梅山保税港区紫荆也先股权投资管理中心（有限合伙）
87	1.8.3.9.1	王盛尧
88	1.8.3.9.2	胡文兵
89	1.8.3.9.3	唐光峰
90	1.8.3.9.4	董 骏
91	1.8.3.9.5	李辰海
92	1.8.3.9.6	蒋利明
93	1.8.3.9.7	吴文龙
94	1.8.3.9.8	金燕君
95	1.8.3.9.9	贾杭平
96	1.8.3.9.10	项 伟
97	1.8.3.9.11	戚雪飞

98	1.8.3.9.12	北京紫荆华信投资管理中心（有限合伙）
99	1.8.3.9.12.1	北京紫旌资本投资管理中心（有限合伙）
100	1.8.3.9.12.1.1	沈正宁
101	1.8.3.9.12.1.2	北京水木汇金投资管理有限公司
102	1.8.3.9.12.1.2.1	沈正宁
103	1.8.3.9.12.1.2.2	李国文
104	1.8.3.9.12.2	清控紫荆资本管理（北京）有限公司
105	1.8.3.9.12.2.1	清控资产管理有限公司（见本表格第 74 项）
106	1.8.3.9.12.3	北京紫荆华盈投资管理中心（有限合伙）
107	1.8.3.9.12.3.1	沈正宁
108	1.8.3.9.12.3.2	李国文
109	1.8.3.9.12.3.3	北京水木汇金投资管理有限公司（见本表格第 101 项）
110	1.8.3.10	浙江大学创新技术研究院有限公司
111	1.8.3.10.1	浙江大学控股集团有限公司
112	1.8.3.10.1.1	浙江大学
113	1.8.3.10.2	杭州市高科技投资有限公司
114	1.8.3.10.2.1	杭州市财政局
115	1.8.3.10.3	浙江省金融控股有限公司（见本表格第 69 项）
116	1.8.3.10.4	神雾环保技术股份有限公司
117	1.8.3.10.5	浙大网新科技股份有限公司
118	1.8.3.10.6	浙江省交通投资集团有限公司
119	1.8.3.10.6.1.1	浙江省人民政府
120	1.8.3.10.7	浙江荣盛控股集团有限公司
121	1.8.3.10.7.1	李水荣
122	1.8.3.10.7.2	许月娟
123	1.8.3.10.7.3	李永庆
124	1.8.3.10.7.4	李国庆
125	1.8.3.10.7.5	倪信才
126	1.8.3.10.7.6	赵关龙
127	1.8.3.10.7.7	西部信托有限公司
128	1.8.3.10.7.7.1	北京鸿基世业房地产开发有限公司
129	1.8.3.10.7.7.1.1	张志鸿
130	1.8.3.10.7.7.1.2	姜心刚

131	1.8.3.10.7.7.1.3	李文静
132	1.8.3.10.7.7.2	陕西延长石油（集团）有限责任公司
133	1.8.3.10.7.7.2.1	榆林市国资委
134	1.8.3.10.7.7.2.2	陕西省国资委
135	1.8.3.10.7.7.2.3	延安市国资委
136	1.8.3.10.7.7.3	西安飞机工业（集团）有限责任公司
137	1.8.3.10.7.7.3.1	中航飞机有限责任公司
138	1.8.3.10.7.7.3.1.1	中国航空工业集团有限公司
139	1.8.3.10.7.7.3.1.1.1	国务院国有资产监督管理委员会
140	1.8.3.10.7.7.4	陕西汽车实业有限公司
141	1.8.3.10.7.7.4.1	陕西延长石油（集团）有限责任公司（见本表格第 132 项）
142	1.8.3.10.7.7.4.2	重庆机电控股集团信博投资管理有限公司
143	1.8.3.10.7.7.4.2.1	重庆机电控股（集团）公司
144	1.8.3.10.7.7.4.2.1.1	重庆市国有资产监督管理委员会
145	1.8.3.10.7.7.4.3	陕西省产业投资有限公司
146	1.8.3.10.7.7.4.3.1	陕西金融控股集团有限公司
147	1.8.3.10.7.7.4.3.1.1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
148	1.8.3.10.7.7.4.3.1.2	陕西省财政厅
149	1.8.3.10.7.7.4.4	陕西汽车控股集团有限公司
150	1.8.3.10.7.7.4.4.1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
151	1.8.3.10.7.7.4.5	中国长城资产管理股份有限公司
152	1.8.3.10.7.7.5	陕西省产业投资有限公司（见本表格第 145 项）
153	1.8.3.10.7.7.6	陕西金叶科教集团股份有限公司
154	1.8.3.10.7.7.7	略阳钢铁厂
155	1.8.3.10.7.7.7.1	略阳县财政局
156	1.8.3.10.7.7.8	陕西省耀县水泥厂
157	1.8.3.10.7.7.8.1	铜川市国资委
158	1.8.3.10.7.7.9	延长油田股份有限公司
159	1.8.3.10.7.7.10	陕西省电力建设投资开发公司
160	1.8.3.10.7.7.10.1	陕西省人民政府
161	1.8.3.10.7.7.11	上海证大投资发展股份有限公司
162	1.8.3.10.7.7.12	陕西飞机工业（集团）有限公司
163	1.8.3.10.7.7.12.1	中航飞机有限责任公司（见本表格第 137 项）

164	1.8.3.10.7.7.12.2	中国华融资产管理股份有限公司
165	1.8.3.10.7.7.13	西安纺织集团有限责任公司
166	1.8.3.10.7.7.13.1	西安纺织控股有限责任公司
167	1.8.3.10.7.7.13.1.1	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
168	1.8.3.10.7.7.13.1.2	西安工业资产经营有限公司
169	1.8.3.10.7.7.13.1.2.1	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
170	1.8.3.10.7.7.14	宝鸡石油钢管有限责任公司
171	1.8.3.10.7.7.14.1	中国石油天然气集团公司
172	1.8.3.10.7.7.14.1.1	国务院国有资产监督管理委员会
173	1.8.3.10.7.7.15	陕西长岭电气有限责任公司
174	1.8.3.10.7.7.15.1	陕西电子信息集团有限公司
175	1.8.3.10.7.7.15.1.1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
176	1.8.3.10.7.7.16	中国烟草总公司陕西省公司
177	1.8.3.10.7.7.17	中铁宝桥集团有限公司
178	1.8.3.10.7.7.17.1	中铁高新工业股份有限公司
179	1.8.3.10.7.7.18	重庆中侨置业有限公司
180	1.8.3.10.7.7.18.1	中国重庆国际经济技术合作公司中侨贸易公司
181	1.8.3.10.7.7.18.1.1	中国重庆国际经济技术合作公司
182	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1	重庆对外经贸（集团）有限公司
183	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.1	重庆渝富控股集团有限公司
184	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.1.1	重庆市国有资产监督管理委员会
185	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2	重庆保税港区开发管理集团有限公司
186	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.1	重庆两江新区管理委员会
187	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2	建信资本管理有限责任公司
188	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1	建信基金管理有限责任公司
189	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1.1	中国建设银行股份有限公司
190	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1.2	信安金融服务公司
191	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1.3	中国华电集团资本控股有限公司
192	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1.3.1	中国华电集团有限公司
193	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.1.3.1.1	国务院国有资产监督管理委员会
194	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.2	建银国际（中国）有限公司
195	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.2.2.2.1	建银国际（控股）有限公司
196	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.3	重庆轻纺控股（集团）公司
197	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.3.1	重庆市国有资产监督管理委员会

198	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.4	重庆高速公路集团有限公司
199	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.4.1	重庆市国有资产监督管理委员会
200	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.5	重庆钢铁（集团）有限责任公司
201	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.5.1	重庆市国有资产监督管理委员会
202	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.6	重庆化医控股（集团）公司
203	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.6.1	重庆市国有资产监督管理委员会
204	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.7	重庆城市交通开发投资（集团）有限公司
205	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.7.1	重庆市国有资产监督管理委员会
206	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.8	重庆机电控股（集团）有限公司
207	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.8.1	重庆市国有资产监督管理委员会
208	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.9	重庆建工投资控股有限责任公司
209	1.8.3.10.7.7.18.1.1.1.9.1	重庆市国有资产监督管理委员会
210	1.8.3.10.7.7.18.2	重庆中渝物业发展有限公司
211	1.8.3.10.7.7.18.2.1	优俊投资有限公司
212	1.8.3.10.7.7.18.3	重庆康信置业有限公司*
213	1.8.3.10.7.7.18.4	重庆川仪股份有限公司
214	1.8.3.10.7.7.19	金堆城钼业集团有限公司
215	1.8.3.10.7.7.19.1	陕西有色金属控股集团有限责任公司
216	1.8.3.10.7.7.19.1.1	陕西省人民政府
217	1.8.3.10.7.7.20	深圳市圳阳投资发展有限公司
218	1.8.3.10.7.7.20.1	孙东伟
219	1.8.3.10.7.7.21	中国航发西安航空发动机有限公司
220	1.8.3.10.7.7.21.1	中国航空发动机集团有限公司
221	1.8.3.10.7.7.21.1.1	国务院国有资产监督管理委员会
222	1.8.3.10.7.7.21.1.2	北京国有资本经营管理中心
223	1.8.3.10.7.7.21.1.2.1	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
224	1.8.3.10.7.7.21.1.3	中国商用飞机有限责任公司
225	1.8.3.10.7.7.21.1.3.1	国务院国有资产监督管理委员会
226	1.8.3.10.7.7.21.1.3.2	上海国盛（集团）有限公司
227	1.8.3.10.7.7.21.1.3.2.1	上海市国有资产监督管理委员会
228	1.8.3.10.7.7.21.1.3.3	中国中化股份有限公司
229	1.8.3.10.7.7.21.1.3.4	中国宝武钢铁集团有限公司
230	1.8.3.10.7.7.21.1.3.4.1	国务院国有资产监督管理委员会
231	1.8.3.10.7.7.21.1.3.5	中国航空工业集团有限公司（见本表格第 138 项）

232	1.8.3.10.7.7.21.1.3.6	中国铝业集团有限公司
233	1.8.3.10.7.7.21.1.3.6.1	国务院国有资产监督管理委员会
234	1.8.3.10.7.7.21.1.3.7	中国建材集团有限公司
235	1.8.3.10.7.7.21.1.3.7.1	国务院
236	1.8.3.10.7.7.21.1.3.8	中国电子科技集团有限公司
237	1.8.3.10.7.7.21.1.3.8.1	国务院国有资产监督管理委员会
238	1.8.3.10.7.7.21.1.3.9	中国国新控股有限责任公司
239	1.8.3.10.7.7.21.1.3.9.1	国务院
240	1.8.3.10.7.7.21.1.4	中国航空工业集团有限公司（见本表格第 138 项）
241	1.8.3.10.7.7.22	彩虹集团有限公司
242	1.8.3.10.7.7.22.1	中国电子有限公司
243	1.8.3.10.7.7.22.1.1	中国电子信息产业集团有限公司
244	1.8.3.10.7.7.22.1.1.1	国务院
245	1.8.3.10.7.7.23	宝鸡宝钛装备科技有限公司
246	1.8.3.10.7.7.23.1	宝钛集团有限公司
247	1.8.3.10.7.7.23.1.1	陕西有色金属控股集团有限责任公司（见本表格第 215 项）
248	1.8.3.10.7.7.23.1.2	金堆城钼业集团有限公司（见本表格第 214 项）
249	1.8.3.10.8	长江成长资本投资有限公司
250	1.8.3.10.8.1	长江证券股份有限公司
251	1.8.3.10.9	西子联合控股有限公司
252	1.8.3.10.9.1	西子电梯集团有限公司
253	1.8.3.10.9.1.1	王水福
254	1.8.3.10.9.1.2	陈夏鑫
255	1.8.3.10.10	新和成控股集团有限公司
256	1.8.3.10.10.1	胡柏藩
257	1.8.3.10.10.2	张平一
258	1.8.3.10.10.3	袁益中
259	1.8.3.10.10.4	胡柏剡
260	1.8.3.10.10.5	石观群
261	1.8.3.10.10.6	王学闻
262	1.8.3.10.10.7	崔欣荣
263	1.8.3.10.10.8	梁碧源
264	1.8.3.10.10.9	陈世林

265	1.8.3.10.10.10	王正江
266	1.8.3.10.10.11	梁晓东
267	1.8.3.10.10.12	梁新中
268	1.8.3.10.10.13	石 程
269	1.8.3.10.10.14	新昌县汇记投资管理合伙企业（有限合伙）
270	1.8.3.10.10.14.1	梁志刚
271	1.8.3.10.10.14.2	朱汉祥
272	1.8.3.10.10.14.3	陈锡能
273	1.8.3.10.10.14.4	邓 容
274	1.8.3.10.10.14.5	黄剑虹
275	1.8.3.10.10.14.6	吕月秋
276	1.8.3.10.10.14.7	胡煜祥
277	1.8.3.10.10.14.8	潘贤炜
278	1.8.3.10.10.14.9	张晓东
279	1.8.3.10.10.14.10	梁玉琪
280	1.8.3.10.10.14.11	张玉英
281	1.8.3.10.10.14.12	黄照明
282	1.8.3.10.10.14.13	吴正洪
283	1.8.3.10.10.14.14	丁仲军
284	1.8.3.10.10.14.15	俞伟国
285	1.8.3.10.10.14.16	吕锦梅
286	1.8.3.10.10.14.17	周贵阳
287	1.8.3.10.10.14.18	陈 康
288	1.8.3.10.10.14.19	孙洁民
289	1.8.3.10.10.14.20	梁百安
290	1.8.3.10.10.14.21	吕法苗
291	1.8.3.10.10.14.22	胡宏灿
292	1.8.3.10.10.14.23	求学海
293	1.8.3.10.10.14.24	新昌县春禾投资管理合伙企业（有限合伙）
294	1.8.3.10.10.14.24.1	胡柏藩
295	1.8.3.10.10.14.24.2	崔欣荣
296	1.8.3.10.10.15	新昌县诚记投资管理合伙企业（有限合伙）
297	1.8.3.10.10.15.1	徐春蕾
298	1.8.3.10.10.15.2	陈学军

299	1.8.3.10.10.15.3	石欢洪
300	1.8.3.10.10.15.4	吕四明
301	1.8.3.10.10.15.5	胡英毅
302	1.8.3.10.10.15.6	石互英
303	1.8.3.10.10.15.7	杨妃姝
304	1.8.3.10.10.15.8	章潮宏
305	1.8.3.10.10.15.9	吕志芳
306	1.8.3.10.10.15.10	许东辉
307	1.8.3.10.10.15.11	高玉阳
308	1.8.3.10.10.15.12	吕林君
309	1.8.3.10.10.15.13	竺志苗
310	1.8.3.10.10.15.14	吕士华
311	1.8.3.10.10.15.15	汪良明
312	1.8.3.10.10.15.16	杨金枢
313	1.8.3.10.10.15.17	杨国青
314	1.8.3.10.10.15.18	宋槐江
315	1.8.3.10.10.15.19	官珊珊
316	1.8.3.10.10.15.20	潘德军
317	1.8.3.10.10.15.21	梁恩民
318	1.8.3.10.10.15.22	张铭锋
319	1.8.3.10.10.15.23	张苏芳
320	1.8.3.10.10.15.24	陈方武
321	1.8.3.10.10.15.25	李和平
322	1.8.3.10.10.15.26	胡木莲
323	1.8.3.10.10.15.27	石杏康
324	1.8.3.10.10.15.28	盛伯钦
325	1.8.3.10.10.15.29	吴 斌
326	1.8.3.10.10.15.30	曹亮炯
327	1.8.3.10.10.15.31	张晓波
328	1.8.3.10.10.15.32	刘岳军
329	1.8.3.10.10.15.33	舒东升
330	1.8.3.10.10.15.34	王曦文
331	1.8.3.10.10.15.35	刘新友
332	1.8.3.10.10.15.36	刘 斌

333	1.8.3.10.10.15.37	王正鲁
334	1.8.3.10.10.15.38	王钟燕
335	1.8.3.10.10.15.39	新昌县春禾投资管理合伙企业（有限合伙）（见本表格第 293 项）
336	1.8.3.10.10.16	新昌县信记投资管理合伙企业（有限合伙）
337	1.8.3.10.10.16.1	胡正洋
338	1.8.3.10.10.16.2	石润民
339	1.8.3.10.10.16.3	蔡国平
340	1.8.3.10.10.16.4	丁春富
341	1.8.3.10.10.16.5	潘浩军
342	1.8.3.10.10.16.6	梁保富
343	1.8.3.10.10.16.7	吕国英
344	1.8.3.10.10.16.8	俞喜春
345	1.8.3.10.10.16.9	陈伟东
346	1.8.3.10.10.16.10	胡鑫鸚
347	1.8.3.10.10.16.11	梁亚东
348	1.8.3.10.10.16.12	胡柏素
349	1.8.3.10.10.16.13	黄国东
350	1.8.3.10.10.16.14	杨新良
351	1.8.3.10.10.16.15	王云龙
352	1.8.3.10.10.16.16	何继铭
353	1.8.3.10.10.16.17	丁月萍
354	1.8.3.10.10.16.18	俞孟飞
355	1.8.3.10.10.16.19	章雪洋
356	1.8.3.10.10.16.20	王子寅
357	1.8.3.10.10.16.21	吴轶平
358	1.8.3.10.10.16.22	胡志五
359	1.8.3.10.10.16.23	黄生富
360	1.8.3.10.10.16.24	潘国祥
361	1.8.3.10.10.16.25	徐松樟
362	1.8.3.10.10.16.26	何中南
363	1.8.3.10.10.16.27	盛鸿飞
364	1.8.3.10.10.16.28	梁 肖
365	1.8.3.10.10.16.29	张 谦

366	1.8.3.10.10.16.30	孙琼华
367	1.8.3.10.10.16.31	陈 英
368	1.8.3.10.10.16.32	王玉如
369	1.8.3.10.10.16.33	章丽霞
370	1.8.3.10.10.16.34	盛 桢
371	1.8.3.10.10.16.35	王松浩
372	1.8.3.10.10.16.36	郑乐友
373	1.8.3.10.10.16.37	新昌县春禾投资管理合伙企业（有限合伙）（见本表格第 293 项）
374	1.8.3.10.10.17	新昌县和记投资管理合伙企业（有限合伙）
375	1.8.3.10.10.17.1	胡柏藩
376	1.8.3.10.10.17.2	新昌县春禾投资管理合伙企业（有限合伙）（见本表格第 293 项）
377	1.8.3.10.10.18	胡梅友
378	1.8.3.10.11	浙江现代中药与天然药物研究院有限公司
379	1.8.3.10.11.1	康恩贝集团有限公司
380	1.8.3.10.11.1.1	浙江博康医药投资有限公司
381	1.8.3.10.11.1.1.1	胡季强
382	1.8.3.10.11.1.1.2	蔡芍英
383	1.8.3.10.11.1.2	兰溪康恩贝人投资有限公司
384	1.8.3.10.11.1.2.1	胡 北
385	1.8.3.10.11.1.2.2	陈德良
386	1.8.3.10.11.1.2.3	叶剑锋
387	1.8.3.10.11.1.3	东阳市咱老家投资有限公司
388	1.8.3.10.11.1.3.1	胡季强
389	1.8.3.10.11.1.3.2	蔡芍英
390	1.8.3.10.11.2	浙江金华康恩贝生物制药有限公司
391	1.8.3.10.11.2.1	浙江康恩贝制药股份有限公司
392	1.8.3.10.11.2.2	余 斌
393	1.8.3.10.12	杭州同坤金江科技有限公司
394	1.8.3.10.12.1	西藏达孜金沙互联创业投资管理有限公司
395	1.8.3.10.12.1.1	朱啸虎
396	1.8.3.10.12.1.2	杨志伟
397	1.8.3.10.12.1.3	韩思婷
398	1.8.3.11	嘉兴嘉济投资管理合伙企业（有限合伙）

399	1.8.3.11.1	嘉兴浙华嘉融投资管理有限公司
400	1.8.3.11.1.1	浙江浙华投资有限公司
401	1.8.3.11.1.1.1	浙江清华长三角研究院
402	1.8.3.11.2	义乌惠商紫荆资本管理有限公司
403	1.8.3.11.2.1	北京紫荆华盈投资管理中心（有限合伙）（见本表格第 106 项）
404	1.8.3.11.2.2	北京紫荆华融资本管理有限公司
405	1.8.3.11.2.2.1	沈正宁
406	1.8.3.11.2.2.2	清控紫荆资本管理（北京）有限公司（见本表格第 104 项）
407	1.8.3.11.2.2.3	北京紫荆华盈投资管理中心（有限合伙）（见本表格第 106 项）
408	1.8.3.11.2.3	浙江浙华投资有限公司（见本表格第 400 项）
409	1.8.3.11.2.4	义乌中国小商品城金融控股有限公司（见本表格第 66 项）
410	1.8.3.11.2.5	义乌市金融控股有限公司
411	1.8.3.11.2.5.1	义乌市国有资本运营有限公司
412	1.8.3.11.2.5.1.1	义乌市人民政府国有资产监督管理办公室
413	1.8.3.11.2.6	宁波梅山保税港区鸿坤国岳投资管理中心（有限合伙）
414	1.8.3.11.2.6.1	王国飞
415	1.8.3.11.2.6.2	李国文
416	1.8.3.11.3	北京紫荆华信投资管理中心（有限合伙）（见本表格第 98 项）
417	1.8.4	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
418	1.8.4.1	北京亦庄国际产业投资管理有限公司
419	1.8.4.1.1	北京亦庄国际投资发展有限公司
420	1.8.4.1.1.1	北京经济技术开发区国有资产管理办公室
421	1.8.4.1.2	北京亦庄移动硅谷有限公司
422	1.8.4.1.2.1	北京亦庄国际投资发展有限公司（见本表格第 419 项）
423	1.8.4.2	北京亦庄国际投资发展有限公司（见本表格第 419 项）
424	1.8.5	德邦创新资本有限责任公司（作为管理人代表：德邦创新资本-上海集成电路产业专项资产管理计划）
425	1.8.5.1	林立
426	1.8.5.2	林建峰
427	1.8.5.3	沈俊毅
428	1.8.5.4	张佳慧

429	1.8.5.5	蒋治华
430	1.8.5.6	陈一芳
431	1.8.5.7	陶 荣
432	1.8.5.8	卫国林
433	1.8.5.9	冉 隼
434	1.8.5.10	刘小鹏
435	1.8.5.11	高玉薇
436	1.8.5.12	王景斌
437	1.8.5.13	王树珍
438	1.8.5.14	朱 妮
439	1.8.5.15	周 祁
440	1.8.5.16	黄洁贞
441	1.8.5.17	时祖仁
442	1.8.5.18	夏 雪
443	1.8.5.19	裘超强
444	1.8.5.20	徐 健
445	1.8.5.21	孙艳霞
446	1.8.5.22	张 敏
447	1.8.5.23	张 萍
448	1.8.5.24	陈瑾兰
449	1.8.5.25	盘 旋
450	1.8.5.26	王 栋
451	1.8.6	北京紫荆华融股权投资有限公司
452	1.8.6.1	清控资产管理有限公司（见本表格第 74 项）
453	1.8.6.2	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心
454	1.8.6.3	悦达资本股份有限公司
455	1.8.6.4	中关村科技园区海淀园创业服务中心
456	1.8.6.5	义乌中国小商品城金融控股有限公司（见本表格第 66 项）
457	1.8.6.6	北京紫荆华融资本管理有限公司（见本表格第 404 项）
458	1.8.7	清控创业投资有限公司
459	1.8.7.1	清华控股有限公司（见本表格第 75 项）
460	1.8.8	上海嘉定创业投资管理有限公司（见本表格第 53 项）

461	1.8.9	杜旭玉
462	1.9	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
463	1.10	天津博达恒盛科技有限公司
464	1.10.1	杭州润腾投资管理有限公司
465	1.10.1.1	门士伟
466	1.10.1.2	高瑞昌
467	1.11	上海张江浩成创业投资有限公司（见本表格第 13 项）

注：根据国家企业信用信息公示系统显示，重庆康信置业有限公司已于 2014 年 1 月 25 日吊销，故未继续穿透。

武岳峰集电的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
武岳峰集电	武平、潘建岳、Bernard Anthony Xavier、联发科技股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、China Electronic Capital Limited、Qorvo International Pte.Ltd、Farsight Capital International Ltd、上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、陈劲松、中国工商银行股份有限公司、上海市嘉定区集体资产管理委员会、上海市嘉定区国有资产监督管理委员会、嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会、浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江省财政厅、清华大学、嘉兴市投资基金管理中心、龙树资本管理股份有限公司、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会、国务院、义乌市人民政府国有资产监督管理委员会、王盛尧、胡文兵、唐光峰、董骏、李辰海、蒋利明、吴文龙、金燕君、贾杭平、项伟、戚雪飞、沈正宁、李国文、浙江大学、杭州市财政局、神雾环保技术股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江省人民政府、李水荣、许月娟、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙、张志鸿、姜心刚、李文静、榆林市国资委、陕西省国资委、延安市国资委、国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省财政厅、中国长城资产管理股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、陕西金叶科教集团股份有限公司、略阳县财政局、铜川市国资委、延长油田股份有限公司、陕西省人民政府、上海证大投资发展股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、西安市人民政府国有资产监督管理委员会、中国烟草总公司陕西省公司、 中铁高新工业股份有限公司、重庆两江新区管理委员会、中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、建银国际（控股）有限公司、优俊投资有限公司、重庆川仪股份有限公司 、孙东伟、北京市人民政府国有资产监督管理委员会、中国中化股份有限公司、长江证券股份有限公司、王水福、陈夏鑫、胡柏藩、张平一、袁益中、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、梁碧源、陈世林、王正江、梁晓东、梁新中、石程、梁志刚、朱汉祥、陈锡能、邓容、黄剑虹、吕月秋、胡煜祥、潘贤炜、张晓东、梁玉琪、张玉英、黄照明、吴正洪、丁仲军、俞伟国、吕锦梅、周贵阳、陈康、孙洁民、梁百安、吕法苗、胡宏灿、求学海、胡柏藩、徐春蕾、陈学军、石欢洪、吕四明、胡英毅、石互英、杨妃妹、章潮宏、吕志芳、许东辉、高玉阳、吕林君、竺志苗、吕士华、汪良明、杨金枢、杨国青、宋槐江、官珊珊、潘德军、梁恩民、张铭锋、张苏芳、陈方武、李和平、胡木莲、石杏康、盛伯钦、吴斌、曹亮

交易对方	最终出资人
	炯、张晓波、刘岳军、舒东升、王曦文、刘新友、刘斌、王正鲁、王钟燕、胡正洋、石润民、蔡国平、丁春富、潘浩军、梁保富、吕国英、俞喜春、陈伟东、胡鑫鸚、梁亚东、胡柏素、黄国东、杨新良、王云龙、何继铭、丁月萍、俞孟飞、章雪洋、王子寅、吴轶平、胡志五、黄生富、潘国祥、徐松樟、何中南、盛鸿飞、梁肖、张谦、孙琼华、陈英、王玉如、章丽霞、盛桢、王松浩、郑乐友、胡梅友、胡季强、蔡苟英、胡北、陈德良、叶剑锋、浙江康恩贝制药股份有限公司、余斌、朱啸虎、杨志伟、韩思婷、浙江清华长三角研究院、王国飞、北京经济技术开发区国有资产管理办公室、林立、林建峰、沈俊毅、张佳慧、蒋治华、陈一芳、陶荣、卫国林、冉隼、刘小鹏、高玉薇、王景斌、王树珍、朱妮、周祁、黄洁贞、时祖仁、夏雪、裘超强、徐健、孙艳霞、张敏、张萍、陈瑾兰、盘旋、王栋、科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、悦达资本股份有限公司、中关村科技园区海淀园创业服务中心、杜旭玉、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、门士伟、高瑞昌

本次交易完成后，武岳峰集电作为合伙企业预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据武岳峰集电提供的文件和说明，武岳峰集电的最终出资人的资金来源均为自有及自筹等。

4、执行事务合伙人的基本情况

中文名称：Digital Time Investment Limited

成立日期：2013 年 6 月 28 日

注册资本：10,000.00 港币

注册地：中国香港

注册证书号码：No,1929793

5、最近三年主营业务发展情况

武岳峰集电为从事半导体等行业投资的专业投资基金，除对外投资外，武岳峰集电暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

武岳峰集电最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	571,952.38	563,795.41
负债总额	5,435.00	8,104.76

所有者权益合计	566,517.38	555,690.65
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	19,715.50	-6,124.30
营业利润	11,034.85	-13,974.52
净利润	11,034.85	-13,974.52

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，除持有上海承裕 47.27%财产份额外，武岳峰集电主要的其他对外投资如下：

序号	名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	股权比例/ 出资比例	经营范围
1	上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）	150,001.50	99.9990%	企业管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	70,003.00	99.9957%	企业管理，企业管理咨询，从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品设计，企业管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进口业务，集成电路、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、通信设备及相关产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）	25,000.20	99.9992%	企业管理，企业管理咨询，从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品设计，企业管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进口业务，集成电路、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、通信设备及相关产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	上海旭芯仟泰企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	99.99%	企业管理，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	上海承裕投资管理有限公司	1,000.00	99.90%	投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，企业营销策划，创业投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6	东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙）	3,469.5763	30.56%	投资管理、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	山东新恒汇电子科技有限公司	16,666.66	16.93%	IC 卡封装框架、IC 卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务；集成电路软件开发；IC 卡应用工程施工；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	东莞赛微微电子有限公司	1,760.691	17.72%	设立研发机构，从事集成电路芯片的研究和开发，并提供相关配套服务；从事集成电路芯片、电子产品、电路板系统的批发及进出口业务（不含国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	上海陆芯电子科技有限公司	166.078	14.89%	电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品的研发、设计、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）	84,551.00	11.83%	企业管理，企业管理咨询，从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品设计，企业管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进口业务，集成电路、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、通信设备及相关产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	上海硅产业投资有限公司	200,000.00	10.00%	硅材料行业投资，集成电路行业投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	上海晟矽微电子股份有限公司	4,510.562	9.53%	集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	博通集成电路（上海）股份有限公司	10,403.515	2.70%	集成电路的研发、设计；软件的设计、开发、制作，销售自产产品，提供相关技术服务；集成电路芯片和软件产

				品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	深圳英集芯科技有限公司	307.69	35.00%	集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售、技术服务、技术转让、技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物与技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
15	武汉楚恩资产管理合伙企业（有限合伙）	70,002.00	99.9971%	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	常州纵慧芯光半导体科技有限公司	162.23	5.998%	芯片设计；芯片制造；集成电路、电子产品、电子元器件、从事计算机科技、电子科技、信息科技、新材料科技、新能源科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、光电子器件的销售，网络技术服务（增值电信业务除外），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	22.81%	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、其他安排

本次交易完成后，武岳峰集电作为合伙企业预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据《上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，武岳峰集电利润分配、亏损分担及合伙事务执行的有关协议安排如下：

主题	具体条款
利益分配及亏损分担	《上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》 第 9.1 条 利润分配和亏损分担的原则 9.1.1 合伙企业的收入由下列各项组成：(i) 项目投资收入（包括合资基金项目投资收入、直接投资项目收入、可转债收益、境外二级市场股票交易收益）；(ii) 临时性投资收入；及 (iii) 除上述第 (i) 项和第 (ii) 项外的其他杂项收益（包括但不限于违约有限合伙人向合伙企业所支付的逾期出资违约金等）（以下合称“合伙企业收入”，其中第 (ii) 项与第 (iii) 项合称“非

主题	具体条款
	项目投资收入”)。 9.1.2 项目投资收入在各合伙人之间根据本协议第 9.2 条的约定分配。非项目投资收入在合伙人之间且在普通合伙人确定的合理时间内根据实缴出资额比例分配给全体合伙人，但本协议对有关收入的分配另有明确约定的，按照该等约定在合理的时间内进行。原则上非项目投资收入在有可分配收入的基础上每年分配一（1）次，最晚不应晚于该财务年度结束后九十（90）日，但普通合伙人根据本协议的规定将其用于项目投资的情况除外。 9.1.3 各有限合伙人应当在其各自认缴出资额的范围内按照各自认缴出资额的比例承担亏损。
合伙事务执行	《上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》 第 7.1 条 合伙事务的执行 7.1.1 合伙企业由普通合伙人负责执行合伙事务。 7.1.2 普通合伙人可以合伙企业的名义或以其自身的名义，根据本协议约定，代表合伙企业订立合同及达成其他约定、承诺，管理并处分合伙企业的财产，以实现合伙企业的经营宗旨和目的。 7.1.3 普通合伙人为执行合伙企业事务的一切作为和不作为，包括与任何第三方就业务合作或其他相关事项发生交涉，均对合伙企业具有约束力。

上市公司股票于 2019 年 5 月 10 日起停牌，并于 2019 年 5 月 16 日第四届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组事项。

根据武岳峰集电的工商登记资料及提供的文件和说明，武岳峰集电在本次交易停牌前六个月内不存在合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的情形。根据武岳峰集电出具的书面确认，未来存续期间内暂无合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的相关安排。

9、私募基金备案情况

武岳峰集电于 2016 年 11 月 10 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SE3644，其管理人为仟品（上海）股权投资管理有限公司（登记编号 P1029450）。

（十）上海集岑

1、上海集岑基本情况

中文名称：上海集岑企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：上海双创投资管理有限公司（委派代表：张赛美）

成立日期：2018 年 5 月 28 日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢

统一社会信用代码：91310117MA1J2XGX93

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018 年 5 月设立

2018 年 5 月 23 日，上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创管理”）、上海双创集银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“双创集银”）签署《合伙协议》，出资设立上海集岑。

2018 年 5 月 28 日，上海市松江区市场监督管理局核发统一社会信用代码为 91310117MA1J2XGX93 的营业执照，上海集岑正式成立。

上海集岑设立时的出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,000.00	0.66
2	有限合伙人	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	150,000.00	99.34
合计			151,000.00	100.00

（2）2018 年 6 月变更认缴出资额及合伙人

2018 年 6 月 13 日，上海集岑召开合伙人会议，同意上海集岑总出资额变更为 181,000 万元，并同意上海双创科技投资中心（有限合伙）（以下简称“双创科技”）入伙，作为有限合伙人认缴出资 30,000 万元。同日，各相关合伙人签订了《入伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018 年 6 月 21 日，上海集岑完成本次变更的工商登记。

本次变更后，上海集岑出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,000.00	0.55

2	有限合伙人	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	150,000.00	82.87
3	有限合伙人	上海双创科技投资中心（有限合伙）	30,000.00	16.57
合计			181,000.00	100.00

（3）2018年6月第二次变更认缴出资额及合伙人

2018年6月21日，上海集岑召开合伙人会议，同意双创集银退伙，同时上海集岑总出资额减少至31,000万元。同日，各相关合伙人签订了《退伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018年6月28日，上海集岑完成本次变更的工商登记。

本次变更后，上海集岑出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,000.00	3.23
2	有限合伙人	上海双创科技投资中心（有限合伙）	30,000.00	96.77
合计			31,000.00	100.00

（4）2018年7月变更认缴出资额及合伙人

2018年6月28日，上海集岑召开合伙人会议，同意上海集岑总出资额增加至121,200万元，并同意双创管理出资额增加至1,200万元；同意思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）、上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）（以下简称“松江双创”）入伙，其中思源电气作为有限合伙人认缴出资80,000万元，松江双创作作为有限合伙人认缴出资10,000万元。同日，各相关合伙人签订了《入伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018年7月20日，上海集岑完成本次变更的工商登记。

本次变更后，上海集岑出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,200.00	0.99
2	有限合伙人	思源电气股份有限公司	80,000.00	66.01
3	有限合伙人	上海双创科技投资中心（有限合伙）	30,000.00	24.75
4	有限合伙人	上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）	10,000.00	8.25
合计			121,200.00	100.00

（5）2018 年 12 月变更认缴出资额及合伙人

2018 年 11 月 16 日，上海集岑召开合伙人会议，同意上海集岑总出资额增加至 300,000 万元，并同意思源电气出资额增加至 100,000 万元、松江双创出资额增加至 20,000 万元；同意杭州联创永钧科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永钧”）、双创集银入伙，其中联创永钧作为有限合伙人认缴出资 3,000 万元，双创集银作为有限合伙人认缴出资 145,800 万元。同日，各相关合伙人签订了《入伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

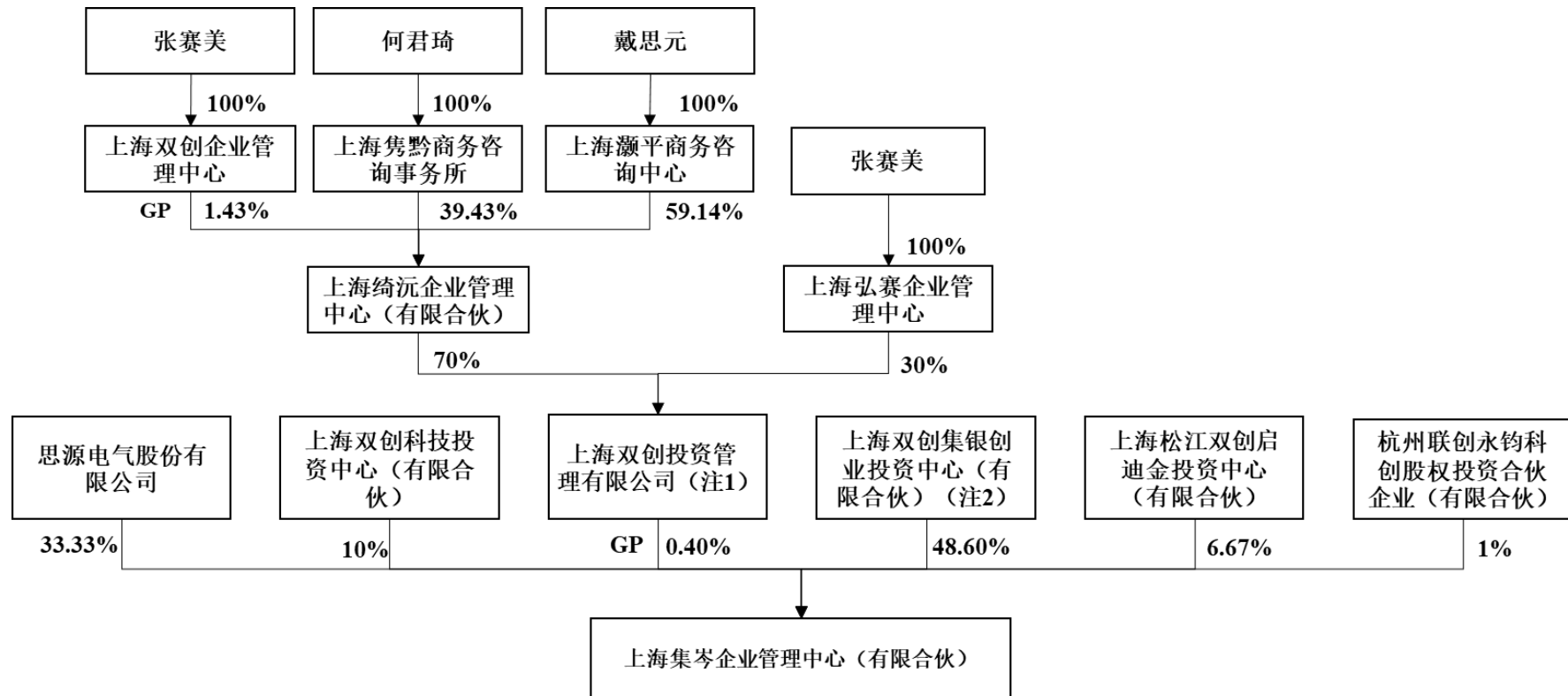
2018 年 12 月 26 日，上海集岑完成本次变更的工商登记。

本次变更后，上海集岑出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,200.00	0.40
2	有限合伙人	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	145,800.00	48.60
3	有限合伙人	思源电气股份有限公司	100,000.00	33.33
4	有限合伙人	上海双创科技投资中心（有限合伙）	30,000.00	10.00
5	有限合伙人	上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）	20,000.00	6.67
6	有限合伙人	杭州联创永钧科创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	1.00
合计			300,000.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，上海集岑的产权结构及控制关系如下



（接下图）



注 1：上图中注 1：上海双创投资管理有限公司、注 2：上海双创集银创业投资中心（有限合伙）、注 3：上海双创投资中心（有限合伙）、注 4：上海襄银创业投资中心（有限合伙）在多个主体中重复交叉出现，为避免重复，仅在一张图中体现，其余主体中出现时未向上层穿透。

注 2：华宝-上海银行-上海襄银单一资金信托虽作为上海襄银创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，但该信托产品为专为指定项目设立，该笔信托资金并未投资于上海集岑的出资份额。

注 3：上海集岑之有限合伙人上海双创科技投资中心（有限合伙）之合伙人份额拟进行变更，上述变更已于 2019 年 7 月 13 日签署相关协议，工商变更尚未办理完毕。

注 4：上海双创孵化投资中心（有限合伙）虽作为上海双创集银创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，但该主体资金并未投资于上海集岑的出资份额。

上海集岑的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
上海集岑	张赛美、何君琦、戴思元、上海瑞金资本管理有限公司-上银瑞金上海银行 2 号专项资产管理计划、启迪控股股份有限公司、上海市松江区国有资产管理委员会、丁健、刘雁、宝山区政府、上海国有资产监督管理委员会、上海电力股份有限公司、国务院国有资产监督管理委员会、赵鑫、黄海英、潘异、韩宇泽、冯涛、汤澄、中钰投资股份有限公司、杭州市临安区国有资产监督管理委员会办公室、浙江省财政厅、杭州市临安区财政局、广州市财政局、侯磊、王星、潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊市峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心、博时资本管理有限公司-博时上海永宣新经济专项资产管理计划和博时上海永宣新经济二期专项资产管理计划、思源电气股份有限公司

本次交易完成后，上海集岑预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据交易对方提供的文件和说明，上海集岑的最终出资人的资金来源均为自有及自筹等。

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，上海集岑的执行事务合伙人为上海双创投资管理有限公司，基本情况如下表所示：

中文名称：上海双创投资管理有限公司

法定代表人：张赛美

成立日期：2015 年 8 月 31 日

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 6 幢 402-1 室

统一社会信用代码：91310000350759025K

经营范围：股权投资管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，上海集岑暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

上海集岑最近两年的的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	131,683.43	-
负债总额	-	-
所有者权益合计	131,683.43	-
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-516.57	-
净利润	-516.57	-

注：上述财务数据已经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，上海集岑除持有上海承裕 41.97%财产份额外，其他对外投资情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	18.20	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、其他安排

本次交易完成后，上海集岑作为合伙企业预计将持有上市公司 5%以上的股份。根据《上海集岑企业管理中心（有限合伙）合伙协议》及《上海集岑企业管理中心（有限合伙）合伙协议》修正案，上海集岑利润分配、亏损分担及合伙事务执行的有关协议安排如下：

主题	具体条款
利润分配及亏损分担	《上海集岑企业管理中心（有限合伙）合伙协议》第六章 利润分配、亏损分担方式

主题	具体条款
	第十四条 利润分配 除全体合伙人一致同意另行约定外，在本合伙企业的合伙期限内，合伙企业收益中的可分配资金将按以下机制和顺序进行分配： （1）首先，扣除合伙企业应支付尚未支付的合伙费用； （2）如有余额，根据各合伙人之间的实缴出资额的比例向全体合伙人分配，直至全体合伙人均收回其对本合伙企业届时的全部实缴出资总额； （3）如再有余额： （i）若该余额达到或超过全体合伙人实缴出资总额按 9%/年（单利）计算所得的回报（计息期间为相应的出资款实缴到位日起到该合伙人收回该部分实缴出资额之日止，以下同），则余额按如下顺序进行分配：a）首先，支付本协议第 21.1.2 条约定的退出管理费；b）其次，余额扣除退出管理费的部分 80%应向全体合伙人依照其各自实缴出资比例分配，其余的 20%应分配给普通合伙人； （ii）若该余额未达到全体合伙人实缴出资总额按 9%/年（单利）计算所得的回报，则余额按如下顺序进行分配：a）首先，按照实缴出资比例分配给全体合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在本合伙企业中对应的实缴出资额按 8%/年（单利）计算所得的回报；b）按照前述 a）项约定分配后仍有剩余，则剩余部分分配给普通合伙人。 第十五条 利润分配方式 （1）现金分配 除需要进行非现金分配外，合伙企业取得项目投资收入后，普通合伙人应尽快制定收入分配方案并在合理时间内向各合伙人完成分配。 （2）非现金分配 在合伙企业清算前，普通合伙人应尽最大努力将合伙企业的投资变现，以避免非现金分配。但如果普通合伙人认为非现金分配更符合各方的利益，则普通合伙人可以决定以非现金形式进行分配。 合伙企业进行非现金分配时，普通合伙人应负责协助全体合伙人办理所分配财产的转让登记手续，并协助全体合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务。接受非现金分配的有限合伙人亦可将其分配到的非现金财产委托普通合伙人按照其指示进行处分。具体委托事宜由普通合伙人和有限合伙人另行协商。 第十六条 亏损分配与债务承担 合伙企业的亏损由所有合伙人以其各自认缴出资额为限承担，超过部分由普通合伙人以其自身资产承担无限连带责任。
合伙事务执行	《上海集岑企业管理中心（有限合伙）合伙协议》及《上海集岑企业管理中心（有限合伙）合伙协议》修正案》第七章 合伙事务的执行 第十八条 合伙事务的执行 18.1 经全体合伙人决定，委托普通合伙人执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业，并代表本合伙企业执行一切合伙事务。 18.2 有限合伙人不得执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。但有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务： （1）参与决定普通合伙人入伙、退伙； （2）对企业的经营管理提出建议； （3）对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料； （4）依法为合伙企业提供担保。 18.3 除本协议另有规定外，在普通合伙人因故不再担任执行事务合伙人

主题	具体条款
	职责时，经全体有限合伙人同意可另行选定执行事务合伙人。 18.5 在遵守本协议约定的条件下，执行事务合伙人的具体职权包括但不限于： 1) 执行投资决策委员会决议、合伙人会议决议、以合伙企业名义开展经营活动； 2) 代表合伙企业对外签署、交付和履行协议、合同及其他文件； 3) 代表合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分资产（包括但不限于投资性资产、投资性资产、不动产和知识产权等其他财产权利）； 4) 采取切必要行动以维持合伙企业合法存续； 5) 开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户，开具支票和其他付款凭证； 6) 聘请和更换合伙企业除合伙人以外的经营管理人员、专业人士、中介及顾问机构（包括但不限于审计机构、律师事务所）为合伙企业提供服务； 7) 根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项； 8) 根据分配方案分配合伙企业的收益、返还投资本金； 9) 根据合伙人会议决议，为合伙企业的利益提起诉讼 / 仲裁或应诉，与争议对方进行协商或和解等，以解决合伙企业与第三方的争议；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险； 10) 变更合伙企业的名称； 11) 变更合伙企业的经营范围； 12) 为执行合伙人会议决议以及根据法律法规规定、本协议约定的其他职权。 18.6 执行事务合伙人应在以下期限内，向所有有限合伙人提交以下文件： 1) 每季度结束后的 20 天内，提交合伙企业及投资标的的未经审计的季度财务报表； 2) 每半年度结束后的 45 天内，提交合伙企业及投资标的的未经审计的半年度财务报表； 3) 每一财务年度结束后 90 天内，提交合伙企业及投资标的的年度审计报告和投资标的的评估报告；如有限合伙人其中一方为上市公司，应在该上市公司年报预披露日之 30 天之前提供上述审计报告和评估报告；该审计报告和评估报告须由具有证券从业资质的专业机构出具； 4) 在有限合伙人内部审计要求时提供相关资料； 5) 如有有限合伙人专项审计（包括且不限于中期审计、特定事项审计需要），提供符合相关要求的审计报告及评估报告。 18.7 在不影响合伙企业投资业务的前提下，执行事务合伙人有权对合伙企业账面闲置现金（包括但不限于尚未予以投资的全体合伙人的实缴出资及尚未分配的投资项目所取得的收益）以临时投资方式投资依法公开发行的国债、央行票据、投资级公司债、货币市场基金等风险较低、流动性较强的集合资产管理计划、专项资产管理计划，信托计划或进行债券逆回购的方式进行管理。 闲置资金投资所得的收入将归于合伙企业的现金收入，在扣除相应的税费及运营成本等费用后，将按照本协议第六章所述的收益分配原则向各合伙人进行分配。

上市公司股票于 2019 年 5 月 10 日起停牌，并于 2019 年 5 月 16 日第四届董事会第五次会议审议通过了重大资产重组事项。

上海集岑成立于 2018 年 5 月 28 日，其历次股权变动情况详见“本节 2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况”。根据上海集岑的工商登记资料及提供的文件，在本次交易停牌前六个月内上海集岑存在新合伙人入伙的情形，具体如下：

2018 年 11 月 16 日，上海集岑召开合伙人会议，同意上海集岑总出资额增加至 300,000 万元，并同意思源电气出资额增加至 100,000 万元、松江双创出资额增加至 20,000 万元；同意杭州联创永钧科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永钧”）、双创集银入伙，其中联创永钧作为有限合伙人认缴出资 3,000 万元，双创集银作为有限合伙人认缴出资 145,800 万元。同日，各相关合伙人签订了《入伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

2018 年 12 月 26 日，上海集岑完成本次变更的工商登记。

本次变更后，上海集岑出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	上海双创投资管理有限公司	1,200.00	0.40
2	有限合伙人	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	145,800.00	48.60
3	有限合伙人	思源电气股份有限公司	100,000.00	33.33
4	有限合伙人	上海双创科技投资中心（有限合伙）	30,000.00	10.00
5	有限合伙人	上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）	20,000.00	6.67
6	有限合伙人	杭州联创永钧科创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	1.00
合计			300,000.00	100.00

根据上海集岑出具的书面确认，未来存续期间内暂无合伙人入伙、退伙、转让财产份额、有限合伙人与普通合伙人转变身份的相关安排。

9、私募基金备案情况

上海集岑于 2019 年 6 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SEV983，其管理人为双创管理（登记编号 P1033535）。

（十一）北京青禾

1、北京青禾基本情况

中文名称：北京青禾投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人：合肥瑾德电子科技有限公司（委派代表：刘峰）

成立日期：2014 年 10 月 13 日

企业性质：有限合伙企业

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇府前街 9 号-8

统一社会信用代码：911100003180329502

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2014 年 10 月设立

2014 年 10 月 11 日，北京风尚欣和投资基金管理有限公司和重庆斯莫尔商贸有限公司签署合伙协议，共同出资设立北京青禾。

2014 年 10 月 13 日，北京市工商行政管理局核发统一社会信用代码为 911100003180329502 的营业执照，北京青禾正式成立。

北京青禾设立时的出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	北京风尚欣和投资基金管理有限公司	500.00	1.00
2	有限合伙人	重庆斯莫尔商贸有限公司	49,500.00	99.00
合计			50,000.00	100.00

（2）2017 年 4 月变更合伙人

2017 年 3 月 31 日，北京青禾召开合伙人会议，同意北京风尚欣和投资基金管理有限公司退伙，合肥瑾德电子科技有限公司（以下简称“合肥瑾德”）作为普通合伙人入伙并认缴出资 500 万元。同时，北京青禾的执行事务合伙人变更为合肥瑾德。同日，各相关合伙人分别签订了《入伙协议》、《退伙协议》，并签订

新的《合伙协议》。

2017年4月7日，北京青禾完成本次变更的工商登记。

本次变更后，北京青禾出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	合肥瑾德电子科技有限公司	500.00	1.00
2	有限合伙人	重庆斯莫尔商贸有限公司	49,500.00	99.00
合计			50,000.00	100.00

（3）2017年8月变更合伙人

2017年7月7日，北京青禾召开合伙人会议，同意重庆斯莫尔商贸有限公司退伙，北京申创银通科技有限公司（以下简称“申创银通”）作为有限合伙人入伙并认缴出资49,500万元。同日，各相关合伙人分别签订了《入伙协议》、《退伙协议》，并签订新的《合伙协议》。

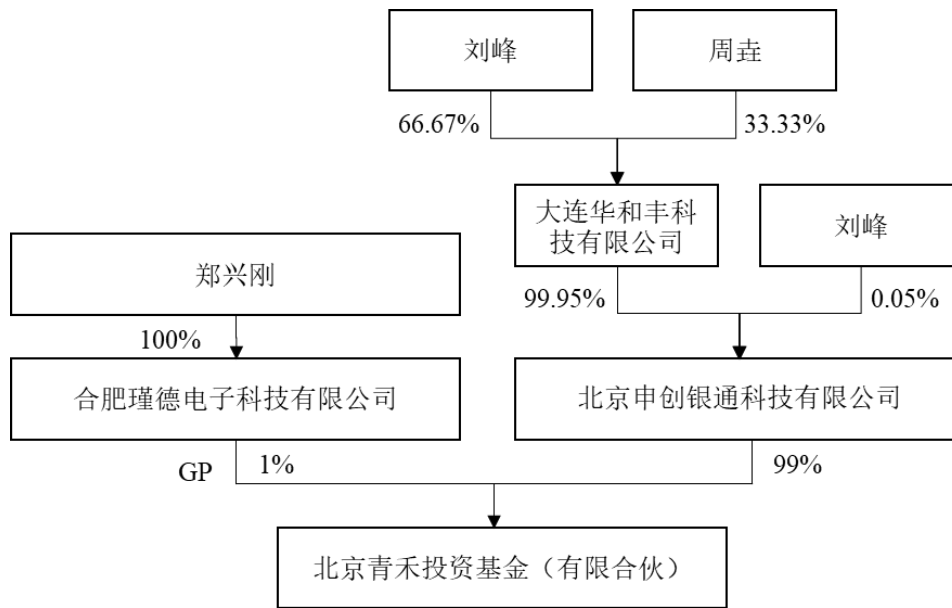
2017年8月24日，北京青禾完成本次变更的工商登记。

本次变更后，北京青禾出资结构如下：

序号	合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	普通合伙人	合肥瑾德电子科技有限公司	500.00	1.00
2	有限合伙人	北京申创银通科技有限公司	49,500.00	99.00
合计			50,000.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，北京青禾的产权结构及控制关系如下：



北京青禾的最终出资人情况如下：

交易对方	最终出资人
北京青禾	郑兴刚、刘峰、周垚

4、执行事务合伙人的基本情况

截至本报告书出具日，北京青禾执行事务合伙人为合肥瑾德电子科技有限公司，基本情况如下表所示：

中文名称：合肥瑾德电子科技有限公司

法定代表人：郑兴刚

成立日期：2013 年 3 月 6 日

注册资本：105 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：合肥市蜀山区金寨路与望江西路交口西北角 4-605

统一社会信用代码：9134010006361195XW

经营范围：计算机及网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；网络工程；计算机及电子产品的销售。

5、最近三年主营业务发展情况

北京青禾主要业务为股权投资和投资管理。

6、最近两年主要财务数据

北京青禾最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	24,476.84	24,443.37
负债总额	57,073.79	57,073.79
所有者权益合计	-32,596.95	-32,630.42
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	33.47	-29,211.70
净利润	33.47	-29,211.70

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，北京青禾除持有上海承裕 5.45%财产份额外，其他对外投资如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,200.00	2.37	实业投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

此外，北京青禾还作为基金管理人管理北京青禾投资基金-天启 1 号私募股权投资基金、北京青禾投资基金-天启 2 号私募股权投资基金、北京青禾投资基金-天启 3 号私募股权投资基金、北京青禾投资基金-天启 4 号私募股权投资基金、北京青禾投资基金-天启 5 号私募股权投资基金。

8、私募基金备案情况

北京青禾于 2015 年 1 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案，备案登记编号为 P1007023。

（十二）万丰投资

1、万丰投资基本情况

中文名称：黑龙江万丰投资担保有限公司

成立日期：2001 年 5 月 25 日

法定代表人：李满起

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：黑龙江省哈尔滨市道里区上游街 58 号

统一社会信用代码：91230102728942084X

经营范围：对房地产、建筑工程安装、教育等领域进行投资。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2001 年 5 月设立

2001 年 4 月，万丰投资（原名：黑龙江万丰投资有限公司）由自然人李满起、冯建成、陈丽平、李满瑞、刘世一共同设立，公司注册资本 1,000 万元，全部以货币形式出资。

2001 年 5 月 25 日，万丰投资取得了黑龙江省工商行政管理局核发的注册号为 2300001102452 的《营业执照》。

万丰投资设立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	600.00	60.00
2	冯建成	100.00	10.00
3	陈丽平	100.00	10.00
4	李满瑞	100.00	10.00
5	刘世一	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

（2）2001 年 11 月增资

2001 年 9 月，经万丰投资股东大会审议通过，万丰投资注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。其中，新增自然人股东王国胜出资额 260 万元；李满起出资额增加至 1,700 万元；冯建成、陈丽平、李满瑞、刘世一出资额均增加至 260 万元。根据黑龙江中龙会计师事务所有限责任公司出具的黑中验 R 字[2001]第 3 号验资报告，截至 2001 年 10 月 26 日上述出资实缴到位。

2001 年 11 月 2 日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

本次增资完成后，万丰投资股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	1,700.00	56.67
2	冯建成	260.00	8.67
3	陈丽平	260.00	8.67
4	李满瑞	260.00	8.67
5	刘世一	260.00	8.67
6	王国胜	260.00	8.67
合计		3,000.00	100.00

（3）2010 年 10 月增资

2010 年 10 月，经万丰投资股东大会审议通过，万丰投资注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元。其中，李满起出资额增加至 2,700 万元；冯建成、陈丽平出资额增加至 760 万元。根据黑龙江中龙会计师事务所有限责任公司出具的中龙验 R 字[2010]003 号验资报告，截至 2010 年 10 月 14 日上述出资实缴到位。

2010 年 10 月 28 日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

本次增资完成后，万丰投资股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	2,700.00	54.00
2	冯建成	760.00	15.20
3	陈丽平	760.00	15.20
4	李满瑞	260.00	5.20
5	刘世一	260.00	5.20
6	王国胜	260.00	5.20
合计		5,000.00	100.00

（4）2010 年 12 月股权转让

2010 年 12 月，经万丰投资股东会审议通过，王国胜将其持有的 5.20%股份转让给陈丽平；同意刘世一将其持有的 5.20%股份转让给冯建成。同时，万丰投资更名为黑龙江万丰投资担保有限公司。

2010 年 12 月 28 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

本次股权转让完成后，万丰投资股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	2,700.00	54.00
2	冯建成	1,020.00	20.40
3	陈丽平	1,020.00	20.40
4	李满瑞	260.00	5.20
合计		5,000.00	100.00

（5）2017年3月股权转让

2017年2月，经万丰投资股东大会审议通过，李满瑞将其持有的5.20%股份转让给李满起。

2017年3月1日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

本次股权转让完成后，万丰投资股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	2,960.00	59.20
2	冯建成	1,020.00	20.40
3	陈丽平	1,020.00	20.40
合计		5,000.00	100.00

（6）2018年7月股权转让

2018年7月，经万丰投资股东大会审议通过，陈丽平将其持有的20.40%股份转让给李满起。

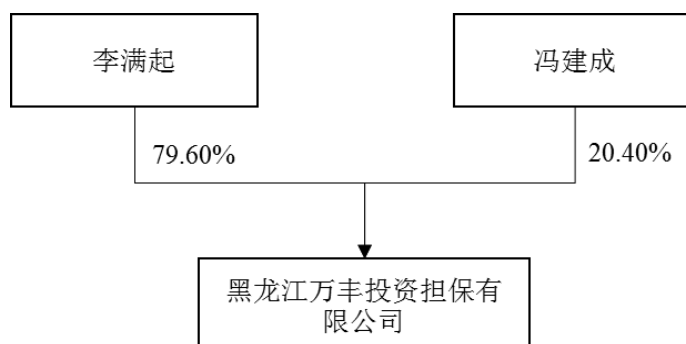
2018年7月27日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

本次股权转让完成后，万丰投资股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李满起	3,980.00	79.60
2	冯建成	1,020.00	20.40
合计		5,000.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，万丰投资的产权结构及控制关系如下：



万丰投资的最终出资人如下：

交易对方	最终出资人
万丰投资	李满起、冯建成

4、控股股东基本情况

截至本报告书出具日，万丰投资的控股股东、实际控制人为李满起，持有万丰投资 79.60%的股权。

姓名	李满起	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	23010219540123****		
住所	哈尔滨市道里区东风街 49 号****		
通讯地址	哈尔滨市道里区东风街 49 号****		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

5、最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，万丰投资的主要业务为股权投资。

6、最近两年主要财务数据

万丰投资最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	13,866.85	12,868.15
负债总额	8,864.34	7,864.34
所有者权益合计	5,002.50	5,003.81
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-1.30	-1.90

净利润	-1.30	-1.90

注：上述财务数据未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，除持有上海承裕 5.31% 财产份额外，万丰投资主要的其他对外投资如下：

序号	名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	股权比例/ 出资比例	经营范围
1	海口京盛房地产开发有限公司	7,000	97.14%	房地产开发、销售、室内外装修、建筑材料、装饰材料、钢材。
2	哈尔滨鹰德房地产开发有限公司	14,000	15.43%	按资质证书从事房地产开发与经营；从事房屋租赁及咨询服务。
3	哈尔滨科技实业开发有限公司	4,000	12.50%	实业投资；房屋租赁；教育咨询服务。
4	黑龙江中实（集团）股份有限公司	10,000	10.44%	无线移动通讯业务，房地产开发，建筑工程及安装，广告业（以上业务由有经营资格的股东单位承担）；国内贸易（国家有专项的规定除外）；通过代理开展易货贸易，销售易货换回的商品；室内装饰；耐火材料，电子产品，仪器仪表；房屋租赁。机械设备制造（分支机构），广告（分支机构），教育教学（分支机构），饮食服务（分支机构）；食品流通（分支机构）；酒类零售。

（十三）承裕投资

1、承裕投资基本情况

中文名称：上海承裕投资管理有限公司

成立日期：2015 年 6 月 19 日

法定代表人：朱慧

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3818 号 2 幢 1218 室

统一社会信用代码：9131011434217692X4

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，企业营销策划，创业投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2015 年 6 月设立

2015 年 6 月 12 日，上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武岳峰浦江”）和朱慧召开股东会并出具《股东会决议》，共同设立承裕投资。

2015 年 6 月 19 日，上海市嘉定区市场监督管理局核发注册号为 310114002925816（后经三证合一统一社会信用代码更新为 9131011434217692X4）的营业执照，承裕投资正式成立。

承裕投资设立时的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	999.00	99.90
2	朱慧	1.00	0.10
合计		1,000.00	100.00

（2）2017 年 4 月股权转让

2017 年 4 月 12 日，承裕投资召开股东会并出具《股东会决议》，同意武岳峰浦江将其持有的承裕投资 99.90%股份转让给武岳峰集电，同意朱慧将其持有的承裕投资 0.10%股权转让给仟品（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“仟品投资”）。同日，各相关股东分别签订了《股权转让协议》，并签订新的《公司章程》。

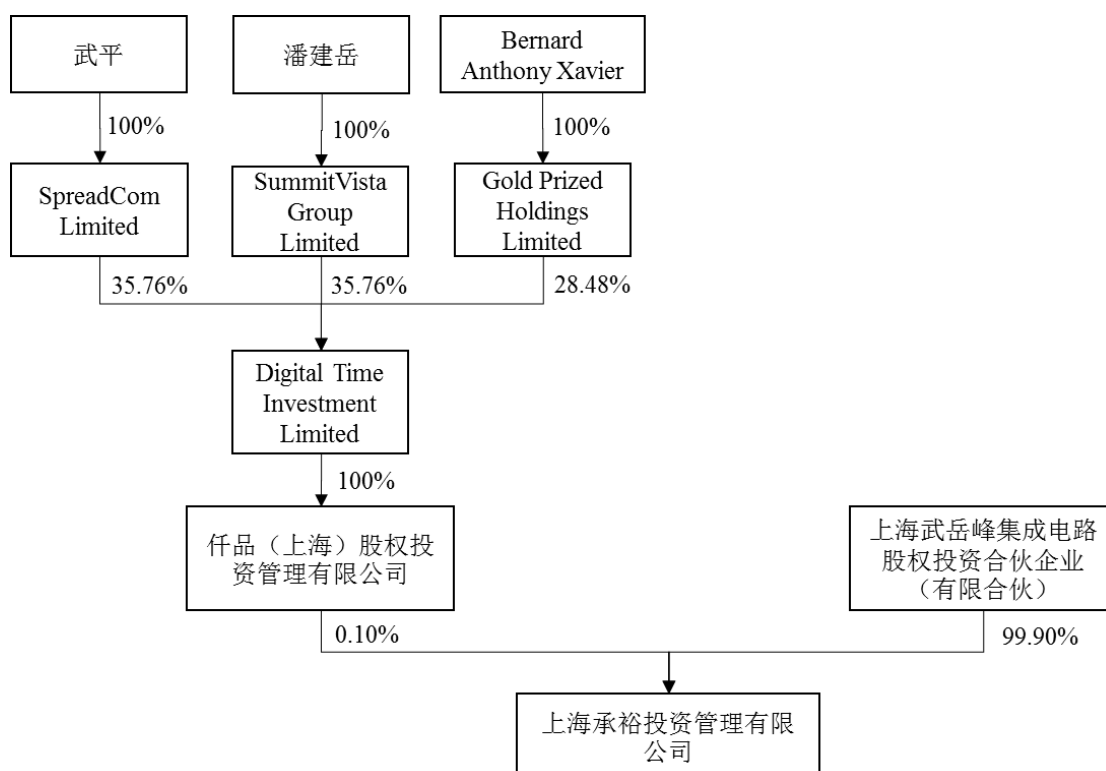
2017 年 4 月 12 日，承裕投资完成本次变更的工商登记。

本次变更后，承裕投资出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	999.00	99.90
2	仟品（上海）股权投资管理有限公司	1.00	0.10
合计		1,000.00	100.00

3、产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，承裕投资的产权结构及控制关系如下：



注 1：武岳峰集电的产权结构详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（九）武岳峰集电”披露的产权结构列表。

注 2：承裕投资的最终出资人情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（九）武岳峰集电”披露的武岳峰集电的最终出资人。

4、控股股东基本情况

承裕投资的控股股东为上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）。截至本报告书出具日，上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况详见本章“一、发行股份及支付现金购买资产之交易对方概况”之“（九）武岳峰集电”之“1、武岳峰集电基本情况”。

5、最近三年主营业务发展情况

除对外投资外，承裕投资暂无其他实际经营业务。

6、最近两年主要财务数据

承裕投资最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	5.00	-

负债总额	4.40	0.20
所有者权益合计	0.60	-0.20
项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	-	-
营业利润	-0.20	-
净利润	-0.20	-

注：上述财务数据均未经审计。

7、对外投资情况

截至本报告书出具日，承裕投资除持有上海承裕 0.0027%财产份额外，无其他对外投资。

二、发行股份募集配套资金之交易对方概况

本次交易募集配套资金的交易对方为包括刘强控制的企业四海君芯在内的不超过 5 名特定投资者。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

（一）四海君芯基本情况

中文名称：北京四海君芯有限公司

成立日期：2019 年 7 月 30 日

法定代表人：刘强

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼二层 A204

统一社会信用代码：91110108MA01LPPMX0

经营范围：技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2019年7月，四海君芯由青岛君品投资合伙企业（有限合伙）及自然人洗永辉共同设立，公司注册资本30,000万元，全部以货币形式出资。

2019年7月30日，四海君芯取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110108MA01LPPMX0的《营业执照》。

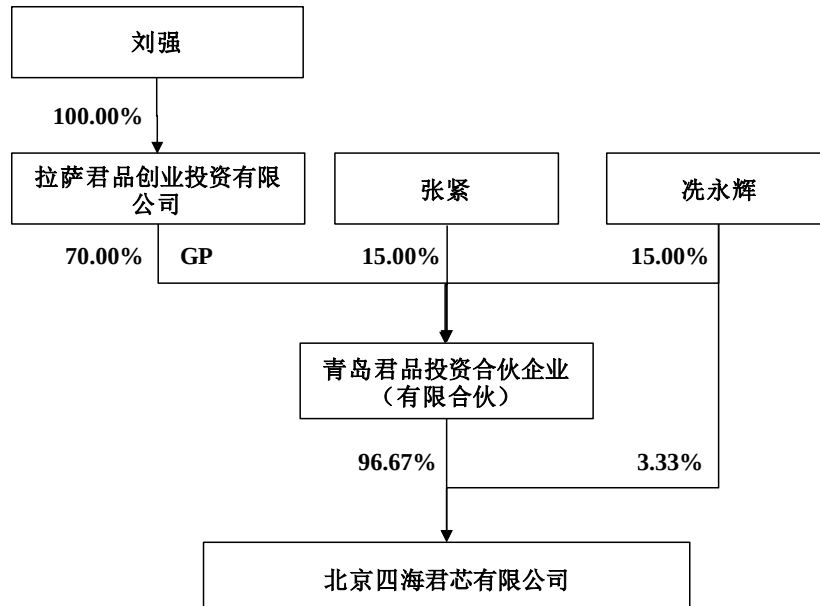
四海君芯股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	青岛君品投资合伙企业（有限合伙）	29,000.00	96.67
2	洗永辉	1,000.00	3.33
合计		30,000.00	100.00

（三）产权结构及控制关系

1、四海君芯目前的产权结构及控制关系

截至本报告书出具日，四海君芯的产权结构及控制关系如下：

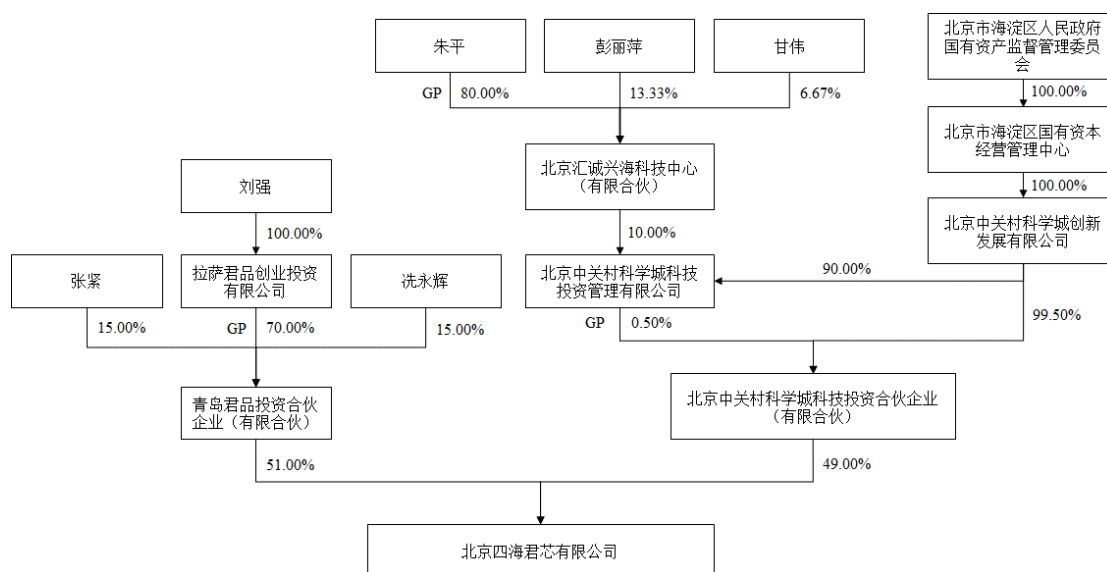


2、2019年9月股权转让后，四海君芯的产权结构及控制关系

2019年9月，四海君芯及其股东青岛君品、洗永辉与北京中关村科学城创新发展有限公司、北京汇诚兴海科技中心（有限合伙）签署《股权转让及投资协议》，中关村科学城和汇诚兴海拟筹建有限合伙企业北京中关村科学城科技创新

基金（有限合伙）（暂定名，以届时工商登记为准，以下简称“科学城基金”），并通过科学城基金受让青岛君品、冼永辉分别持有的四海君芯 45.67%、3.33%的股权。该等股权转让完成后，青岛君品将持有四海君芯 51%股权，科学城基金将持有四海君芯 49%股权。截至本报告书出具日，科学城基金已完成设立，实际工商登记的名称为北京中关村科学城科技投资合伙企业（有限合伙），上述股权转让的工商变更登记手续正在办理中。

上述股权转让完成后，四海君芯的产权结构及控制关系如下：



（四）控股股东、实际控制人的基本情况

1、控股股东

截至本报告书出具日，四海君芯的控股股东为青岛君品，基本情况如下：

中文名称：青岛君品投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：拉萨君品创业投资有限公司（委派代表：刘强）

成立日期：2019 年 4 月 3 日

企业性质： 有限合伙企业

注册地址：青島市即墨區移風店鎮安定街2號

统一社会信用代码：91370282MA3PG10N3U

经营范围：以自有资金对股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收

存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、实际控制人

截至本报告书出具日，四海君芯的实际控制人为自然人刘强，基本情况如下：

姓名	刘强	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号	11010819690305****		
住所	北京市海淀区上地西里风芳园**楼***室		
通讯地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼		
是否取得其他国家或者地区的居留权	否		

（五）最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，四海君芯尚未开展实际经营业务，其控股股东的主要业务为股权投资。

（六）最近两年主要财务数据

四海君芯为 2019 年 7 月新设立公司，且其控股股东于 2019 年 4 月设立，无最近两年财务数据。

（七）对外投资情况

截至本报告书出具日，四海君芯无对外投资情况，其控股股东除四海君芯外其他对外投资情况如下：

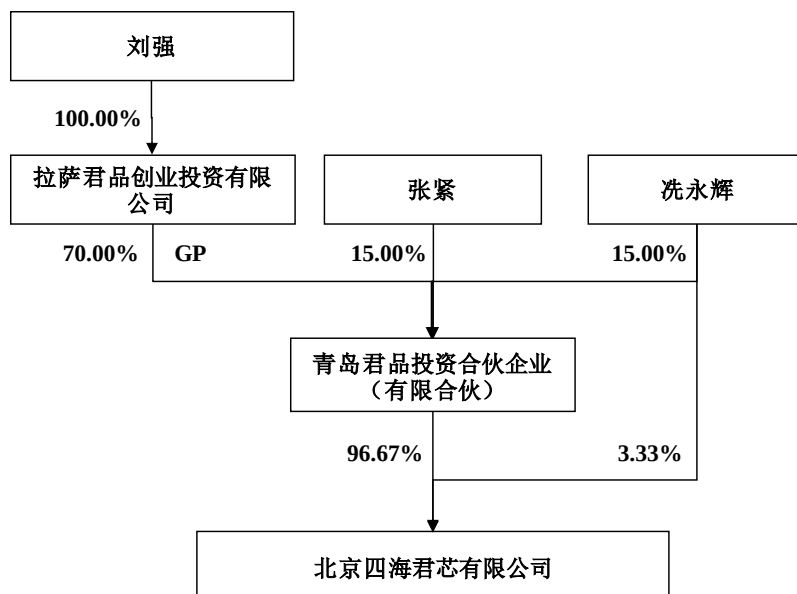
序号	名称	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	经营范围
1	合肥君诺志成集成电路投资有限公司	30,000.00	83.33	集成电路项目投资（未经金融部门批准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）刘强对四海君芯的控制及认购配套募集资金的安排情况

1、刘强能对四海君芯形成实际控制

（1）四海君芯的产权控制关系

根据四海君芯现时有效的《营业执照》及公司章程并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告书出具日，四海君芯的产权控制关系如下图所示：



如上图所示，青岛君品持有四海君芯 96.67%股权，系四海君芯控股股东；刘强全资持有并担任执行董事的拉萨君品持有青岛君品 70%财产份额，同时也是青岛君品的普通合伙人和执行事务合伙人。

根据刘强及四海君芯于 2019 年 8 月出具的《关于北京四海君芯有限公司引入投资人的声明》，四海君芯拟引入第三方投资者，该等引资完成后，青岛君品持有四海君芯的股权比例将不低于 51%，仍为四海君芯的控股股东，刘强仍为四海君芯的实际控制人。

（2）刘强为四海君芯的实际控制人

根据四海君芯的公司章程，公司最高权力机构为股东会，设执行董事一人。除修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式等须经三分之二以上表决权的股东通过外，其他决议须经二分之一以上表决权的股东通过。因此，作为四海君芯的控股股东，青岛君品能够对四海君芯的股东会决议产生决定性影响；同时，刘强还担任四海君芯的执行董事。

根据青岛君品的合伙协议，青岛君品由执行事务合伙人执行合伙事务，并对外代表有限合伙企业，其他合伙人不再执行合伙事务。因此，拉萨君品能够决定

青岛君品的重大事项决策，同时，刘强还担任青岛君品的执行事务合伙人委派代表。

根据拉萨君品的公司章程，其单一股东为刘强，执行董事和经理为刘强。

基于上述，根据拉萨君品、青岛君品及四海君芯的组织机构和决策机制、董事和高管人员等客观事实情况，刘强能够透过拉萨君品和青岛君品对四海君芯的股东会决议产生重大及决定性影响；同时，刘强还担任四海君芯、拉萨君品的执行董事和经理，担任青岛君品执行事务合伙人委派代表，能够单独决定四海君芯的经营管理事务。因此，刘强为四海君芯实际控制人。

（3）2019 年 9 月股权转让后，刘强仍为四海君芯的实际控制人

2019 年 9 月，四海君芯及其股东青岛君品、洗永辉与中关村科学城、汇诚兴海签署《股权转让及投资协议》，中关村科学城和汇诚兴海拟筹建科学城基金，并通过科学城基金受让青岛君品、洗永辉分别持有的四海君芯 45.67%、3.33%的股权，上述股权变更的具体情况详见本节“（三）产权结构及控制关系”。根据上述《股权转让及投资协议》，上述股权转让完成后，青岛君品持有四海君芯 51%股权，有权向四海君芯委派两名董事，占四海君芯董事会人数的三分之二，并有权提名四海君芯经理及财务负责人，青岛君品仍为四海君芯的控股股东。青岛君品的普通合伙人为拉萨君品（认缴出资比例为 70%），后者为刘强的全资子公司。因此，刘强仍为四海君芯实际控制人。

2、本次交易完成后刘强持有上市公司股份比例测算合理性

本次交易前，刘强直接持有北京君正 20.03%股份，为北京君正的控股股东、实际控制人之一。

本次交易中，刘强作为四海君芯的实际控制人，能够决定四海君芯的经营管理事务，能够控制、实际支配四海君芯本次交易项下认购的北京君正股份（详见 1、刘强能对四海君芯形成实际控制）；同时，刘强已就认购股份所需资金和所得股份锁定作出切实、可行的安排（详见 3、关于认购配套募集资金份额所需资金来源以及认购股份后续安排情况）。

本次交易完成后，考虑配套融资情形下，刘强直接持有北京君正 8.24%股份、透过其控制的四海君芯实际支配北京君正 4.11%股份，即持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，仍为北京君正控股股东、实际控制人之一。

3、关于认购配套募集资金份额所需资金来源以及认购股份后续安排情况

本次交易中，上市公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的部分现金对价、投入标的资产的项目建设。其中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。2019 年 5 月，上市公司与刘强就认购配套融资签署《股份认购协议》，2019 年 7 月，上市公司与刘强及其控制的企业四海君芯签署《股份认购协议之补充协议》；同时，刘强、四海君芯亦出具了《关于参与认购本次配套融资的承诺函》。

（1）关于认购资金来源的情况

本次交易上市公司拟配套融资不超过 15 亿元，刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套融资的 50%。

根据刘强及四海君芯出具的《关于参与认购本次配套融资的承诺函》，作为北京君正的实际控制人之一，刘强已明确承诺由其实际控制的四海君芯参与本次配套融资且认购金额不低于本次配套融资总额的 50%，四海君芯将根据本次配套融资相关安排，通过自有及/或自筹方式于上市公司发出《缴款通知书》前将认购本次配套融资所需的资金准备到位。

除自有资金外，截至本报告书出具日，刘强持有北京君正股份市值约 22.37 亿元，可通过质押部分股权筹措资金；同时刘强持有的其他对外权益投资、不动产等资产可用于筹集资金。

刘强作为北京君正的控股股东、实际控制人之一，整体信用资质良好，可通过借款或其他法律法规允许的方式筹集所需资金。同时，刘强拥有 20 年集成电路和信息技术行业经验，联合创立北京君正后一直担任公司董事长、总经理职务，带领北京君正进行国产创新 CPU 技术和嵌入式处理器芯片的研制与产业化，较为深厚的行业背景及资源将进一步增强其融资能力。

由于本次重组属于集成电路领域的同行业收购，既顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业的行业背景，又能优化上市公司未来的业务结构、发挥协同效应，因此，资本市场及相关机构对本次重组给予较大期望，有利于刘强在必要时筹措所需资金。

此外，刘强及四海君芯出具了《关于北京四海君芯有限公司引入投资人的声明》，四海君芯拟引入第三方投资者，该等引资完成后，青岛君品投资合伙企业（有限合伙）持有四海君芯的股权比例将不低于 51%，仍为四海君芯的控股股东，刘强仍为四海君芯的实际控制人。

（2）关于认购股份锁定的情况

本次配套融资中，刘强控制的企业四海君芯获得的上市公司股份锁定期为自股份发行结束之日起 36 个月。同时，刘强、四海君芯承诺不通过转让、赠予或其他变相转让的方式处置尚处于锁定期的股份。本次重组完成后，认购方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增加的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

同时，作为北京君正的实际控制人，刘强承诺本次交易完成后 60 个月内，不会主动放弃上市公司控制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。

根据查询证监会、交易所网站信息及截至 2019 年 8 月 14 日刘强的《个人信用报告》，刘强信用情况良好，未因违反公开承诺而受到相关处分。

综上所述，刘强已对通过四海君芯认购配套融资所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排，能够确保按期、足额认购且取得股份后不会出现变相转让，符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）》相关规定。

（3）募集配套资金取得的相应股份可以在认定控制权时合并计算

根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）》，在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算，但已就认购股份所需

资金和所得股份锁定作出切实、可行安排，能够确保按期、足额认购且取得股份后不会出现变相转让等情形的除外。

综上所述，刘强已对通过四海君芯认购配套融资所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排，能够确保按期、足额认购且取得股份后不会出现变相转让，符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）》相关规定，募集配套资金取得的相应股份可以在认定控制权时合并计算。

三、交易对方之间的关联关系

本次交易的交易对方中，存在如下关联关系：

（一）各相关交易对方之间的关系

截至本报告书出具日，交易对方之间存在若干组关系，具体情况如下：

序号	关系类型/性质	相关事实说明
第一组关系：武岳峰集电（上海承裕）、屹唐投资、华创芯原		
1.1	关联方股权出资	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（以下简称“战新基金”）为屹唐投资的有限合伙人及关联方： 战新基金作为有限合伙人，持有华创芯原单一股东北京集成 17.84% 的财产份额 战新基金作为有限合伙人，持有武岳峰集电有限合伙人武岳峰浦江 18.20% 的财产份额
1.2	关联方担保及反担保	为私有化收购目的，屹唐投资、上海承裕、华创芯原、华清闪胜与中国工商银行股份有限公司作为牵头行牵头组织的银团于 2015 年 11 月签订《美国 ISSI 半导体公司并购项目银团贷款协议》，由银团向屹唐投资、上海承裕、华创芯原及华清闪胜提供私有化收购的并购贷款；由屹唐投资的关联方亦庄国投为上述贷款提供担保。 2015 年 11 月 19 日，华创芯原、华清闪胜、上海承裕与亦庄国投签署《股权质押反担保合同》，华创芯原、华清闪胜、上海承裕分别将其所持北京矽成相应股权质押予亦庄国投以提供反担保。 截至本报告书出具日，华清闪胜、上海承裕均已还清并购贷款，所持北京矽成股权的质押登记已解除；华创芯原的贷款余额为 33,610.50 万元，所持北京矽成全部股权仍质押予亦庄国投。
第二组关系：屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威和闪胜创芯		
2	共同投资/出资	屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威作为闪胜创芯有限合伙人，分别持有闪胜创芯 37.337%、22.806%、18.204%、15.104%、2.365%、0.850% 财产份额
第三组关系：厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory 和上海瑾矽		

序号	关系类型/性质	相关事实说明
3	最终出资人部分或全部重合	厦门芯华、Worldwide Memory 与 Asia Memory 为北京矽成员工持股平台。上海瑾矽的普通合伙人上海若矽的有限合伙人穿透后出资人与上述三个持股平台穿透后的出资人部分或全部重合。 相关架构图如下：
第四组关系：上海集岑和上海瑾矽		
4.1	部分有限合伙人相同	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）（以下简称“双创集银”）作为有限合伙人，分别持有上海集岑 48.60%财产份额（双创集银尚未实缴出资）和上海瑾矽 16.66%财产份额
4.2	部分有限合伙人穿透后的普通合伙人相同	双创集银的普通合伙人为双创投资。 上海集岑有限合伙人上海双创科技投资中心（有限合伙）（以下简称“双创科技”）的普通合伙人为双创投资。 上海瑾矽有限合伙人上海文棠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海文棠”）普通合伙人上海双创文化产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“双创文化”）的普通合伙人为双创投资。

序号	关系类型/性质	相关事实说明
		相关架构图如下： <pre>graph TD A[双创投资 GP] --- B[双创科技 LP] A --- C[双创集银 LP] A --- D[双创文化 GP] B --- E[上海集岑] C --- F[上海瑾矽] D --- G[上海文棠 LP]</pre>
第五组关系：武岳峰集电和上海集岑		
5	间接出资关系	武岳峰集电作为有限合伙人的上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海承芯”，武岳峰集电持有其 99.999% 财产份额）持有思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”）9.08% 股份。 思源电气持有上海集岑 33.33% 财产份额。
第六组关系：武岳峰集电和承裕投资		
6	股权控制关系	武岳峰集电作为股东，持有承裕投资 99.90% 股权

（二）除武岳峰集电和承裕投资外，交易对方之间不构成一致行动关系

根据交易对方提供的工商登记文件、相关企业的公司章程、合伙协议等组织性文件等资料及书面说明，就各交易对方前述关系对照《收购办法》第八十三条第二款的逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	股权控制： 武岳峰集电持有承裕投资 99.90% 股权
2	投资者受同一主体控制	无
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	无
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	无
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	无

序号	推定情形	核查情况
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	共同出资： 屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威作为有限合伙人，分别持有闪胜创芯相应财产份额
7	持有投资者 30%以上股份的自然 人，与投资者持有同一上市公司股 份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级 管理人员，与投资者持有同一上市 公司股份	无
9	持有投资者 30%以上股份的自然 人和在投资者任职的董事、监事及高 级管理人员，其父母、配偶、子女 及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配 偶等亲属，与投资者持有同一上市 公司股份	无
10	在上市公司任职的董事、监事、高 级管理人员及其前项所述亲属同时 持有本公司股份的，或者与其自己 或者其前项所述亲属直接或者间接 控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人 员和员工与其所控制或者委托的法 人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	1.屹唐投资和武岳峰集电、华创芯原之间，存在关联方股权出资、关联方担保及反担保关系 2.厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory 和上海瑾矽之间，存在最终出资人部分或全部重合情形 3.上海集岑和上海瑾矽之间，存在部分有限合伙人相同、部分有限合伙人穿透后的普通合伙人相同情形 4.武岳峰集电和上海集岑之间，存在间接股权出资关系

如上表所述，除武岳峰集电与承裕投资因股权控制而构成一致行动关系外，相关交易对方之间尽管存在共同投资、关联方出资、关联方担保及反担保关系、穿透后部分最终出资人相同、间接持股等关系，但该等关系并不会导致相关交易对方之间构成一致行动关系，现就相关原因及相反证据具体说明如下：

1、屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威的共同投资闪胜创芯

2016年2月，为北京矽成业务发展、资本运作及引入战略投资者等特定安排，由屹唐投资、华创芯原、上海承裕、华清闪胜等作为有限合伙人，与联发科软件（上海）有限公司及联发软件设计（深圳）有限公司合伙设立闪胜创芯并持有北京矽成相应股权。2017年3月，华清闪胜将所持北京矽成的全部股权对外转让，同时将所持闪胜创芯全部财产份额分别转让予上海承裕、屹唐投资及民和志威。2019年5月，为避免本次交易完成后出现交叉持股，上海承裕合伙人武岳峰集电、上海集岑和北京青禾作为有限合伙人入伙闪胜创芯，上海承裕从闪胜创芯退伙。

因此，闪胜创芯设立时的合伙人除联发科软件（上海）有限公司、联发软件设计（深圳）有限公司外，均为北京矽成的股东，设立目的主要是业务发展、资本运作及引入战略投资者；闪胜创芯历史上合伙人调整主要是因北京矽成股东/投资者发生变更。截至本报告书出具日，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威分别持有闪胜创芯 37.337%、22.806%、18.204%、15.104%、2.365%、0.850%财产份额。

屹唐投资、华创芯原、民和志威、武岳峰集电、上海集岑和北京青禾作为不同投资机构或私募基金，具有各自独立的投资策略和决策机制，代表不同投资人利益；该等交易对方出资设立或入股闪胜创芯系为北京矽成引进战略投资者及持有北京矽成股权的整体及特别安排。该等交易对方不因共同投资闪胜创芯而导致其经济利益一致或形成一致行动的主观意图或必要动机。

此外，根据闪胜创芯的《有限合伙协议》，闪胜创芯的合伙事务由执行事务合伙人联发科软件（上海）有限公司执行，有限合伙人不参与管理或控制闪胜创芯的经营和事务。因此，屹唐投资、华创芯原、民和志威、武岳峰集电、上海集岑和北京青禾虽对闪胜创芯存在出资，但均不参与闪胜创芯合伙事务及重大事项决策，即均无法对闪胜创芯的重大决策产生重大影响。

因此，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原、北京青禾、民和志威不因共同投资闪胜创芯而形成一致行动关系。

2、屹唐投资和武岳峰集电、华创芯原之间的关联方股权出资、关联方担保及反担保关系

（1）关联方股权出资：屹唐投资关联方战新基金投资华创芯原股东北京集成、武岳峰集电有限合伙人武岳峰浦江事项，系私募基金的正常投资行为。战新基金作为亦庄国投下属母基金运作平台，根据其《有限合伙协议》，其“以为投资人获取资本回报和创造价值为核心目的”，“主要从事项目股权投资、债权投资及投资于不同阶段、类型或各类所有制形式的股权投资企业”，其经营范围为投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询等，包括投资其他公司或合伙企业。北京集成作为主要投资集成电路设计、封装、测试及相关上下游产业的私募基金；武岳峰浦江为专注于以半导体为核心的信息技术新兴产业投资的私募基金。因此，战新基金作为有限合伙人对北京集成、武岳峰浦江的投资，属于其经营范围内的投资行为。

此外，根据北京集成和武岳峰浦江的《有限合伙协议》，有限合伙人不执行合伙企业事务，不参与管理或控制合伙企业的经营和业务。因此，无论是作为北京集成有限合伙人抑或是武岳峰浦江的有限合伙人，战新基金均不参与执行该等合伙企业的合伙事务及项目投资决策、亦未委派相关管理人员，不会对北京集成或武岳峰浦江的重大事项决策产生重大影响。

（2）关联方担保及反担保关系：前述华创芯原与亦庄国投之间的担保及反担保事宜，系私有化收购中的银团并购贷款的保障措施。该等安排作为私有化收购融资方案组成部分，由亦庄国投为上海承裕、华创芯原、华清闪胜提供担保，上海承裕、华创芯原及华清闪胜向亦庄国投支付担保费并以北京矽成股权质押提供反担保。该等安排具有商业合理性，符合市场操作惯例，具有特定背景及专项性质。华创芯原为亦庄国投的担保提供市场化的对价（即支付担保费，并以其所持北京矽成股权进行质押），屹唐投资及华创芯原并不因前述担保及反担保关系而形成任何一致行动的默契或安排。

3、厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory 和上海瑾矽的最终出资人重合

厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory 和厦门矽茂、Golden State Memory, LLC 均为北京矽成境内外员工持股平台（以下统称员工持股平台）；为员工持股方案实施，厦门矽茂与 Golden State Memory, LLC 引入第三方投资者并通过上海若矽/上海瑾矽持股北京矽成，因此，上海瑾矽穿透后的部分最终出资

人与上述员工持股平台的最终出资人存在重合情形，重合人员为北京矽成境内外员工。

根据上海若矽的《有限合伙协议》，“任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务”。因此，厦门矽茂与 Golden State Memory, LLC 作为上海若矽的有限合伙人，不参与上海若矽合伙事项的管理或决策。

根据上海瑾矽的《合伙协议》，“投资决策委员会由 3 名委员组成，执行事务合伙人有权委派 1 名委员，有限合伙人上海文棠企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区崧犀投资管理合伙企业（有限合伙）各有权委派 1 名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策，审议事项需经三分之二（含）以上投资决策委员会委员同意方可通过”“有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表本合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务”。因此，上海瑾矽的决策机构为投资决策委员会。

因此，厦门芯华、Worldwide Memory、Asia Memory 为员工持股平台，上海瑾矽为北京矽成部分员工与第三方投资人组成的投资入股北京矽成的持股主体，上述各方代表不同的出资人/投资人利益，具有各自独立的决策机制，不因最终出资人重合情形而形成任何一致行动的默契或安排。

4、上海集岑和上海瑾矽的部分有限合伙人相同

上海双创投资中心（有限合伙）（以下简称“双创母基金”）是上海市人民政府发起设立的专注于战略新兴产业的市场化母基金，双创集银、上海文棠和双创科技均为双创母基金发起设立的投融资平台（以下单独或统称“双创基金”），其中双创集银聚焦集成电路产业，双创科技聚焦科技创新领域，上海文棠聚焦文创和信息技术领域。双创集银、上海文棠和双创科技投资上海瑾矽及/或上海集岑属于正常投资业务。

根据上海瑾矽的《合伙协议》，“投资决策委员会由 3 名委员组成，执行事务合伙人有权委派 1 名委员，有限合伙人上海文棠企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区崧犀投资管理合伙企业（有限合伙）各有权委派 1 名委员。投

投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策，审议事项需经三分之二（含）以上投资决策委员会委员同意方可通过”“有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表本合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的投资业务及其他以本合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表本合伙企业签署文件，亦不得从事其他对本合伙企业形成约束的行为”。因此，上海瑾矽投资决策等重大事项由投资决策委员会决定，任一投资决策委员会委员均无法决定或控制投资决策委员会的决定，双创集银与上海文棠作为上海瑾矽的有限合伙人均无权参与管理或控制上海瑾矽的投资事项。

根据上海集岑的《合伙协议》，“投资决策委员会成员人数为 3 人，其中思源电气股份有限公司有权委派 1 名委员，普通合伙人有权委派 2 名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策，投资事项须经全体投资决策委员会成员一致投票通过方可生效”“有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为”。因此，上海集岑投资决策等重大事项由投资决策委员会决定，上海集岑任一合伙人均无法决定或支配上海集岑的行为及重大决策；且双创集银与双创科技作为上海集岑的有限合伙人，均无权参与管理或控制上海集岑的投资事项。

如前所述，上海瑾矽为北京矽成部分员工与第三方投资人组成的投资入股北京矽成的持股主体；上海集岑是思源电气与双创基金等共同投资设立的私募基金。因此，尽管两方穿透后的投资者存在相同情形，但上海瑾矽和上海集岑各有独立的投资目的和决策机制，上述相同的有限合伙人以及部分合伙人穿透后的普通合伙人均无法对上海瑾矽或上海集岑重大事项决策有重大影响，两者也不因存在相同的有限合伙人，以及部分合伙人穿透后的普通合伙人而形成任何一致行动的默契或安排。

5、武岳峰集电和上海集岑的间接出资/参股

（1）上海承芯通过二级市场增持及投资思源电气，并向思源电气提名董事

根据思源电气公告的《关于股东权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》及 2017 年、2018 年年度报告等公开信息，上海承芯自 2017 年 1 月起通过集中竞价交易陆续增持思源电气股票；2017 年 5 月，上海承芯向思源电气提名 2 名董事。截至本报告书出具日，上海承芯持有思源电气 9.08%股份。

（2）上海集岑的设立背景及目的

根据思源电气公告的《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的公告》《关于下属合伙企业签署对外投资意向协议的公告》《关于下属合伙企业签署投资协议的公告》《关于批准下属合伙企业集岑合伙对外投资决议的公告》等公开披露信息，思源电气与双创基金等共同投资上海集岑，并拟通过上海集岑间接收购北京矽成相应股权，具体过程如下：

2018 年 6 月 22 日，思源电气董事会审议通过与双创投资等共同投资上海集岑，后者主要投资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业。

2018 年 9 月 30 日，上海集岑与武岳峰集电、北京青禾等签署《框架协议》《可转换债权投资协议》《有限合伙财产份额转让协议》，上海集岑拟向武岳峰集电、北京青禾购买其持有的上海承裕全部有限合伙份额，并因此间接收购北京矽成 41.65%股权。整体交易方案分为两步，第一步，上海集岑以可转债（不超过 12.55 亿元）方式向上海承裕进行投资，第二步，上海集岑向武岳峰集电及北京青禾支付合伙份额转让款，购买其持有的上海承裕全部有限合伙份额。截至 2019 年 4 月 3 日，上海集岑向上海承裕提供合计 12.4553 亿元借款并已完成债转股的工商变更登记。

2019 年 5 月 8 日，上海集岑投资决策委员会表决通过，终止履行上述交易第二步及《有限合伙财产份额转让协议》，不再受让武岳峰集电和北京青禾所持的上海承裕有限合伙份额，并签署相关《终止协议》。

截至本报告书出具日，思源电气持有上海集岑 33.33%财产份额，上海集岑持有上海承裕 41.9696%财产份额。

因此，上海承芯通过二级市场增持及投资思源电气、思源电气与双创基金等设立上海集岑是相互独立的行为/事项，筹划及实施时间不同，且相关方各有不

同的投资目的和决策机制。同时，武岳峰集电/上海承芯间接出资/参股上海集岑，并不导致武岳峰集电能对上海集岑重大决策产生重大影响，具体说明如下：

（1）上海承芯为财务投资人，无法对思源电气重大事项决策产生决定性影响

上海承芯主要投资于高科技新兴产业，思源电气系一家主营输配电设备的研发、生产、销售和服务的 A 股上市公司。2017 年 1 月，上海承芯因看好思源电气未来发展前景，逐步增持思源电气的股份。截至本报告书出具日，上海承芯持有思源电气 9.08%股份；与此同时，思源电气现任董事 Peter Quan Xiong 系武岳峰集电雇员，现任董事张家荣系武岳峰集电顾问。

根据思源电气 2018 年年度报告、公司章程及相关公开披露信息等，思源电气控股股东与实际控制人为自然人董增平与陈邦栋，截至本报告书出具日，其合计控制思源电气 29.97%的股份；思源电气董事会由七名董事组成，董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。因此，上海承芯作为财务投资人，从主观意图或客观事实上均无法对思源电气董事会会议、股东大会会议的重大事项决策产生决定性影响。

（2）思源电气作为有限合伙人，无法决定或支配上海集岑重大事项决策

2018 年 6 月，思源电气作为有限合伙人出资设立上海集岑，后者投资方向为集成电路及专用芯片设计方向。截至本报告书出具日，思源电气持有上海集岑 33.33%认缴财产份额。

根据上海集岑的《合伙协议》，“投资决策委员会成员人数为 3 人，其中思源电气股份有限公司有权委派 1 名委员，普通合伙人有权委派 2 名委员。投资决策委员会负责审议投资方案并做出投资决策，投资事项须经全体投资决策委员会成员一致投票通过方可生效”。因此，上海集岑投资决策等重大事项由投资决策委员会决定且需经全体委员一致审议通过，思源电气虽委派 1 名投资决策委员会委员，但无法单独决定或支配上海集岑的行为及重大决策。

（3）武岳峰集电与上海集岑不存在一致行动的主观意图和客观基础

武岳峰集电为专注于集成电路设计产业及与集成电路相关的电子信息产业投资的私募基金，上海集岑为思源电气与双创基金等投资者共同设立的专项投资

上海承裕的机构。武岳峰集电与上海集岑在投资目的、经济利益诉求、决策机制、行为导向等方面均有不同，不存在一致行动的主观意图和客观基础。

基于上述，武岳峰集电关联方上海承芯参股上海集岑有限合伙人思源电气是上海承芯的正常投资行为，且上海承芯无法控制或对思源电气重大事项决策产生决定性影响；思源电气作为上海集岑的有限合伙人，虽委派 1 名投资决策委员会委员但无法决定或支配上海集岑的行为及重大决策。因此，武岳峰集电无法透过上海承芯、思源电气对上海集岑的重大事项决策产生重大影响。

（三）各交易对方之间不存在一致行动协议或类似安排

2019 年 7 月，各交易对方分别作出承诺：“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。”

四、交易对方与上市公司之间的关联关系说明及交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

本次交易募集配套资金的交易对方为包括刘强控制的企业四海君芯在内的不超过 5 名特定投资者。其中，刘强先生为上市公司控股股东、实际控制人之一。除上述关联关系外，本次交易其他交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

本次发行股份募集配套资金的交易对方之一四海君芯的实际控制人刘强，为北京君正的董事长、总经理。除此之外，截至本报告书出具日，本次交易的交易对方未向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员。

本次交易交易对方亦出具承诺：“本次交易完成后，交易对方将不会联合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事会、监事会成员等改变上市公

司董事会、监事会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员组成结构产生实质性影响。

交易对方进一步确认，本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总数的四分之一，但不低于两名。”

五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

截至本报告书出具日，本次交易的交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的任何重大民事诉讼或者仲裁。

六、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规及诚信情况

截至本报告书出具日，本次交易的交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

七、各交易对方最终出资人变动情况

（一）上海瑾矽

截至本报告书出具日，上海瑾矽的产权结构及控制关系如下：



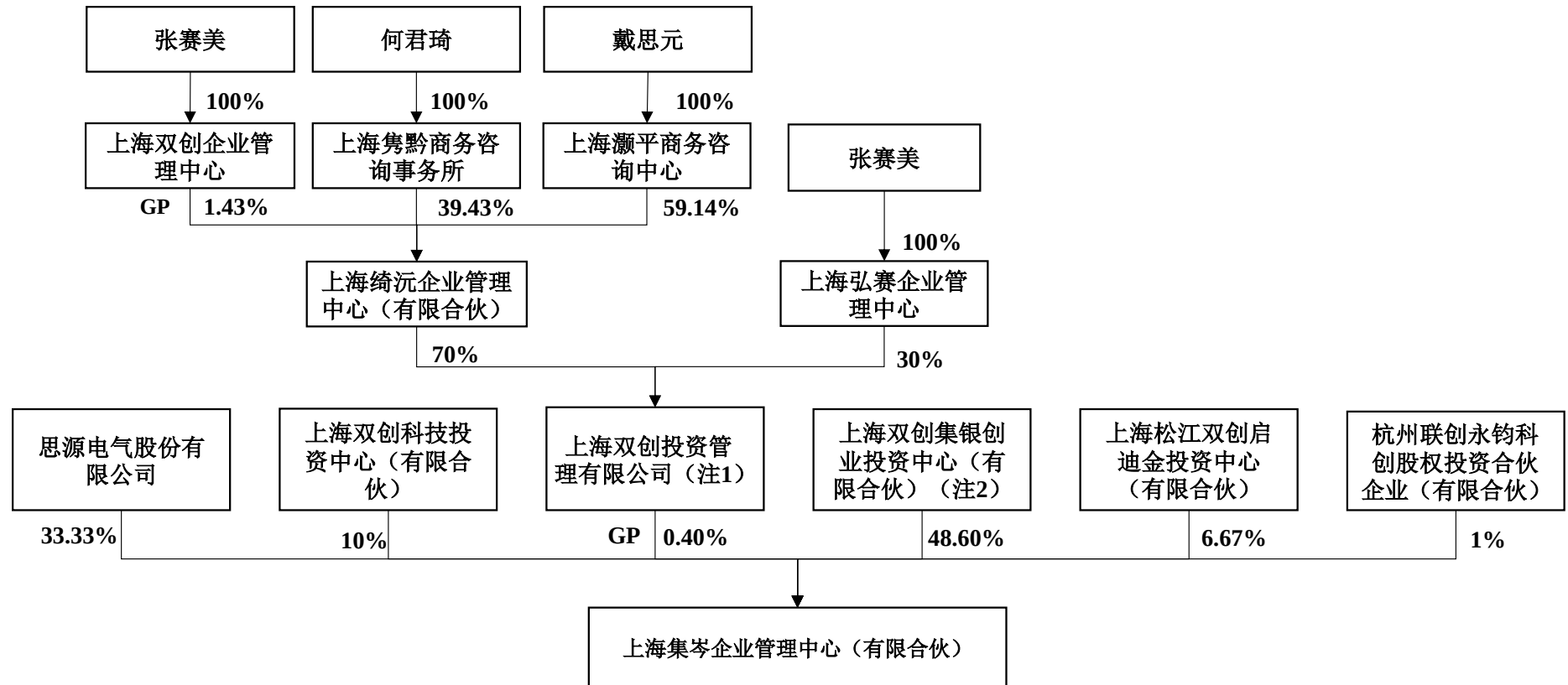
上图中注 1：上海双创投资管理有限公司、注 2：上海双创集银创业投资中心（有限合伙）、注 3：上海双创投资中心（有限合伙）、注 4：上海襄银创业投资中心（有限合伙在本次交易对方上海瑾矽、上海集岑的多个合伙主体中重复交叉出现，未重复披露上层架构，可相互参见。

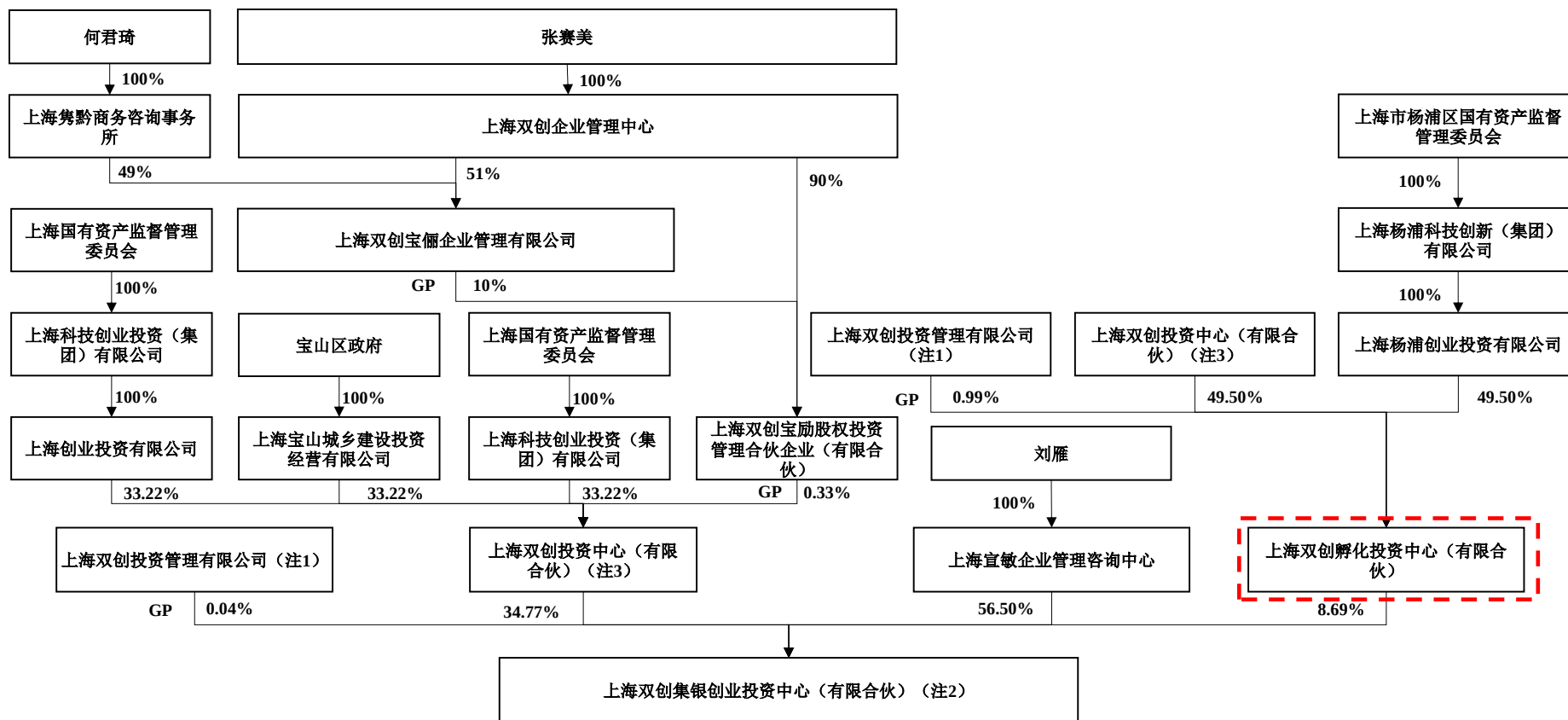
如上图所示，上海瑾矽穿透后的上层出资人较前次重组报告书披露变动情况为：上海瑾矽有限合伙人上海双创集银创业投资中心（有限合伙）（简称“双创集银”）新增有限合伙人上海双创孵化投资中心（有限合伙）（简称“双创孵化”）。因此，上海瑾矽产权结构上穿透后的最终出资人新增上海市杨浦区国有资产监督管理委员会。就上海瑾矽产权结构上最终出资人增加的情形，双创集银全体合伙人作出决议：“双创孵化认缴双创集银 2 亿元有限合伙财产份额。全体合伙人一致同意，双创孵化对合伙企业的所有出资，不用于投资双创集银已投资项目上海集岑和上海瑾矽。双创孵化在此同意并确认未来不享有双创集银投资上海集岑和上海瑾矽产生的所有收益。”

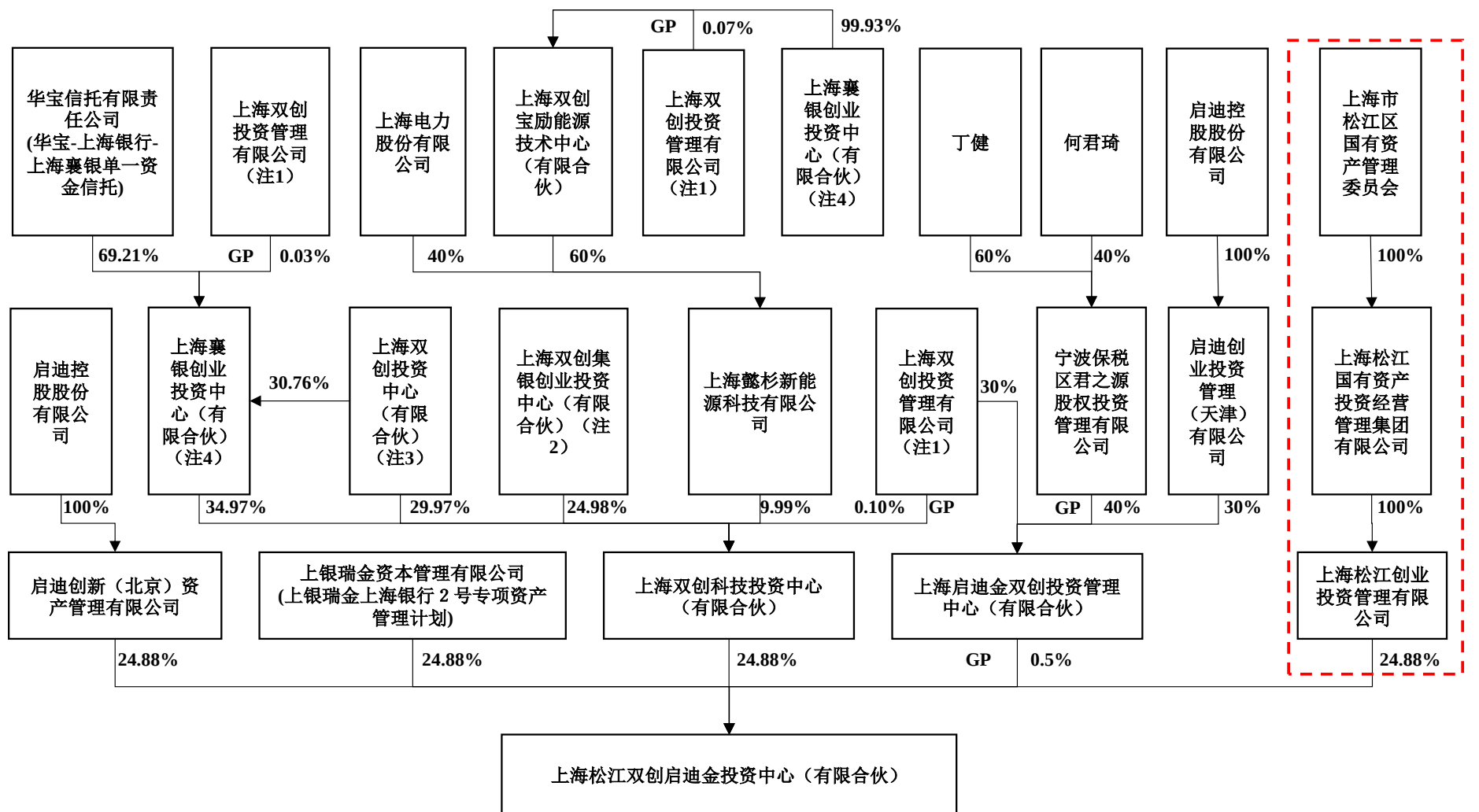
上海瑾矽产权结构上新增的最终出资人现时不享有标的企业任何权益、未来也不享有本次交易完成后上市公司股份权益，即上海瑾矽穿透后实际享有标的企业权益及本次交易完成后上市公司股份权益的最终出资人保持不变。因此，上海瑾矽产权结构上最终出资人新增变更情形不涉及本次交易的交易对象新增或变更，也不涉及标的资产变更，亦不构成本次重组方案重大调整。

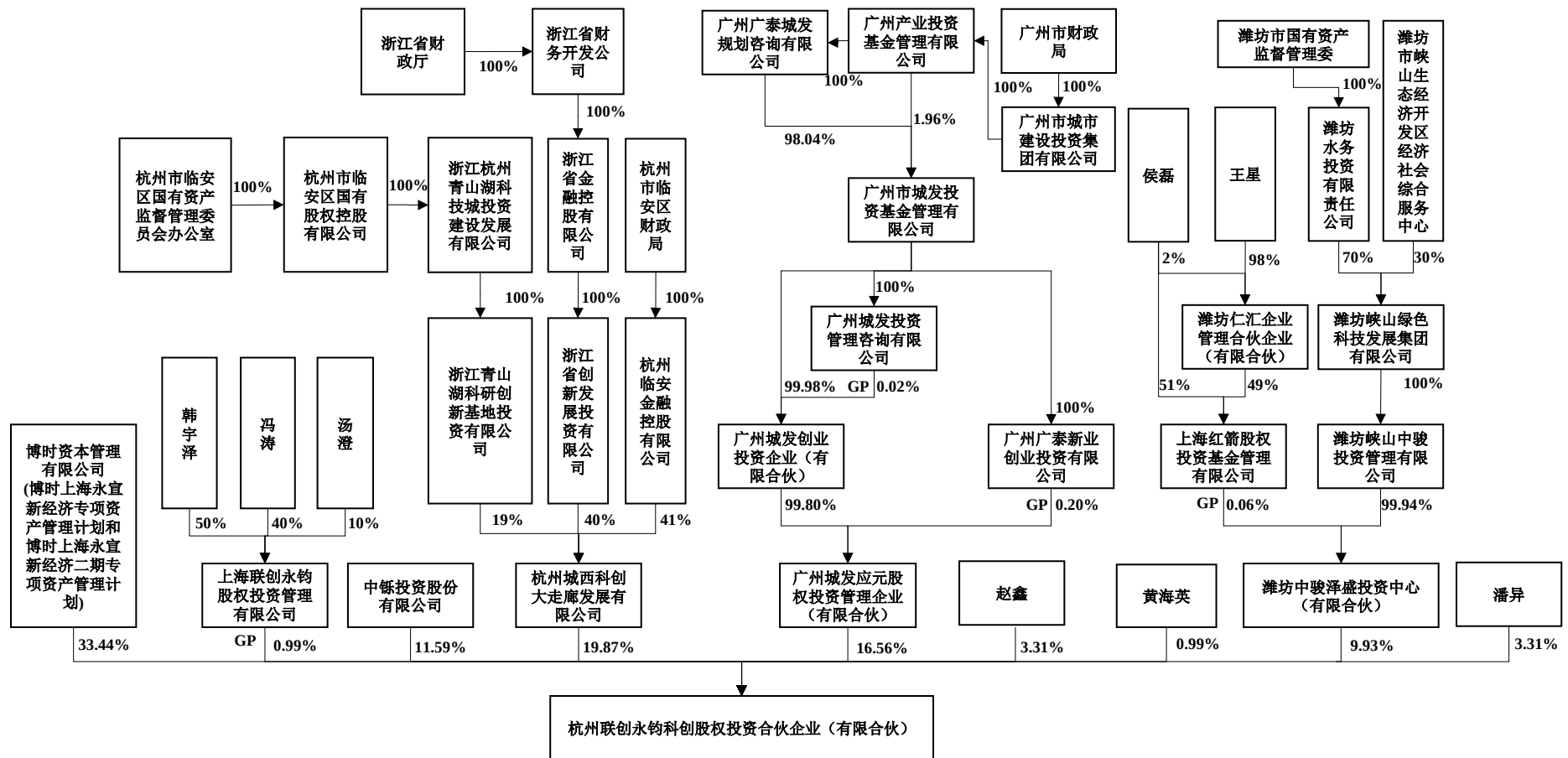
（二）上海集岑

截至本报告书出具日，上海集岑的产权结构及控制关系如下：









如上图所示，上海集岑穿透后的上层出资人较前次重组报告书披露变动情况为：

1、上海集岑有限合伙人上海双创集银创业投资中心（有限合伙）新增有限合伙人上海双创孵化投资中心（有限合伙）。因此，上海集岑产权结构上穿透后的最终出资人新增上海市杨浦区国有资产监督管理委员会。就上海集岑产权结构上最终出资人增加的情形，双创集银全体合伙人作出决议：“双创孵化认缴双创集银 2 亿元有限合伙财产份额。全体合伙人一致同意，双创孵化对合伙企业的所有出资，不用于投资双创集银已投项目上海集岑和上海瑾砂。双创孵化在此同意并确认未来不享有双创集银投资上海集岑和上海瑾砂产生的所有收益。”

上海集岑产权结构上新增的最终出资人现时不享有标的企业任何权益、未来也不享有本次交易完成后上市公司股份权益，即上海集岑穿透后实际享有标的企业权益及本次交易完成后上市公司股份权益的最终出资人保持不变。因此，上海集岑产权结构上最终出资人新增变更情形不涉及本次交易的交易对象新增或变更，也不涉及标的资产变更，亦不构成本次重组方案重大调整。

2、上海集岑有限合伙人上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）之有限合伙人上海松江创业投资管理有限公司的穿透后的最终出资人由上海市松江区中小企业融资担保中心变更为上海市松江区国有资产管理委员会。根据《上海市松江区中小企业融资担保中心根据上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江创业投资管理有限公司股权的通知》（松国资企[2019]13号），该等最终出资人变更系上海市松江区国资内部架构调整所致，不属于最终出资人实质性变动，不构成本次重组方案重大调整。

八、仅持有标的公司股权或财产份额的交易对方最终出资人持有股权或财产份额的锁定安排

本次重组直接/间接仅持有标的公司股权或财产份额的出资人穿透锁定情况如下：

序号	交易对方	穿透层级	投资人名称	是否存在其他对外投资	穿透锁定方式
1	屹唐投资	1	屹唐投资	否	直接锁定

序号	交易对方	穿透层级	投资人名称	是否存在其他对外投资	穿透锁定方式
		1.1	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	是	直接锁定
		1.2	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
2	华创芯原	2	华创芯原	否	直接锁定
		2.1	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
3	上海瑾矽	3	上海瑾矽	否	直接锁定
		3.1	上海若矽集成电路合伙企业（有限合伙）	否	直接锁定
		3.1.1	Golden State Memory, LLC	否	直接锁定
		3.1.1.1	Kong-Yeu Han 等 73 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
		3.1.2	厦门矽茂企业管理合伙企业（有限合伙）	否	直接锁定
		3.1.2.1	厦门市矽盛企业管理有限公司	否	直接锁定
		3.1.2.1.1	童明照、羊首道	最终出资人	直接锁定
		3.1.2.2	羊首道等 25 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
		3.1.3	上海懿添新能源投资管理有限公司	是	直接锁定
		3.2	上海文棠企业管理中心（有限合伙）	是	直接锁定
		3.3	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
		3.4	宁波梅山保税港区嵊犀投资管理合伙企业（有限合伙）	否	直接锁定
		3.4.1	吴一凡	最终出资人	直接锁定
		3.4.2	上海维极投资管理有限公司	是	直接锁定
		3.4.3	上海钧犀实业有限公司	是	直接锁定
4	民和志威	4	民和志威	否	直接锁定
		4.1	青岛城投股权投资管理有限公司	是	直接锁定
		4.2	青岛海丝稳健股权投资基金企业（有限合伙）	是	直接锁定
		4.3	青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）	是	直接锁定
5	闪胜创芯	5	闪胜创芯	否	直接锁定

序号	交易对方	穿透层级	投资人名称	是否存在其他对外投资	穿透锁定方式
		5.1	联发科软件（上海）有限公司	是	直接锁定
		5.2	联发软件设计（深圳）有限公司	是	直接锁定
		5.3	屹唐投资（见 1）	否	直接锁定
		5.4	武岳峰集电	是	直接锁定
		5.5	上海集岑（见 9）	否	直接锁定
		5.6	华创芯原（见 2）	否	直接锁定
		5.7	民和志威（见 4）	否	直接锁定
		5.8	北京青禾	否	直接锁定
		5.8.1	合肥瑾德电子科技有限公司	是	直接锁定
		5.8.2	北京申创银通科技有限公司	否	直接锁定
		5.8.2.1	刘峰	最终出资人	直接锁定
		5.8.2.2	大连华和丰科技有限公司	否	直接锁定
		5.8.2.2.1	刘峰	最终出资人	直接锁定
		5.8.2.2.2	周焱	最终出资人	直接锁定
6	WM	6	WM	否	直接锁定
		6.1	US Memory, LLC	否	直接锁定
		6.1.1	Kong-Yeu Han 等 37 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
		6.2	Euro-Pacific Memory LLC	否	直接锁定
		6.2.1	Shueh-Mien Jimmy Lee 等 16 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
7	AM	7	AM	否	直接锁定
		7.1	Formosa Memory LLC	否	直接锁定
		7.1.1	Ching-Tang Wu 等 21 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
8	厦门芯华	8	厦门芯华	否	直接锁定
		8.1	羊首道等 25 名自然人	最终出资人	通过管理人锁定
		8.2	厦门市矽盛企业管理有限公司	否	直接锁定
		8.2.1	童明照、羊首道	最终出资人	直接锁定
9	上海集岑	9	上海集岑	否	直接锁定
		9.1	上海双创投资管理有限公司	是	直接锁定

序号	交易对方	穿透层级	投资人名称	是否存在其他对外投资	穿透锁定方式
		9.2	思源电气股份有限公司	是	直接锁定
		9.3	上海双创科技投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
		9.4	上海双创集银创业投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
		9.5	上海松江双创启迪金投资中心（有限合伙）	是	直接锁定
		9.6	杭州联创永钧科创股权投资合伙企业（有限合伙）	是	直接锁定

各交易对方上层仅持有标的公司股权/财产份额，不存在其他对外投资情况的股东/合伙人已就其持有交易对方股权/财产份额的锁定安排做出承诺，具体如下：

（一）直接锁定

上述直接锁定承诺方承诺，在其对应的直接交易对方通过本次交易取得的上市公司股份锁定期内，不得以任何方式转让其持有的直接交易对方的股权/财产份额或要求直接交易对方回购股权/其财产份额或从直接交易对方退伙；亦不得以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其通过直接交易对方享有的与上市公司股份有关的权益。

（二）通过管理人锁定

1、厦门矽茂之 25 名自然人（有限合伙人）

厦门矽茂系上海瑾矽之普通合伙人上海若矽的有限合伙人，其上层有限合伙人为 25 名自然人，根据《厦门矽茂企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，“新的有限合伙人入伙须经普通合伙人书面同意”，“除适用法律另有规定（包括但不限于《中华人民共和国合伙企业法》项下规定的有限合伙人当然退伙的情形），在有限合伙企业的合伙期限内，未经普通合伙人的事先书面同意，有限合伙人无权提出退伙或转让其在有限合伙中全部或部分合伙权益或将其合伙权益出质”。

厦门矽茂之普通合伙人厦门矽盛承诺，在上海瑾矽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，将不予接受任何新的有限合伙人入伙，不予接受任何

有限合伙人要求厦门矽茂回购其财产份额或从厦门矽茂退伙，亦不予接受任何有限合伙人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其通过上海瑾矽享有的与上市公司股份有关的权益。

2、Golden State Memory, LLC 之 73 名自然人股东

Golden State Memory, LLC 系上海瑾矽之普通合伙人上海若矽的有限合伙人，其上层股东为 73 名自然人。

根据 Golden State Memory, LLC 组织性文件，Golden State Memory, LLC 份额的转让须取得其管理人（“Manager”）的同意，Golden State Memory, LLC 增加新的份额持有人须由 Shueh-Mien Jimmy Lee 及 Kong-Yeu Han 表决同意。作为 Golden State Memory, LLC 的管理人，Ameé Guiriba 承诺，在上海瑾矽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会同意 Golden State Memory, LLC 现有份额持有人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其拥有的与 Golden State Memory, LLC 份额相关的权益，但因该等持有人从北京矽成半导体有限公司或其下属公司离职而转让给 Golden State Memory, LLC 现有其他份额持有人的除外；Shueh-Mien Jimmy Lee 及 Kong-Yeu Han 承诺，在上海瑾矽通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会同意 Golden State Memory, LLC 增加新的份额持有人。

3、WM 之上层 53 名自然人股东

US Memory, LLC 及 Euro-Pacific Memory LLC 系 WM 之股东，其上层股东合计为 53 名自然人。

根据 US Memory, LLC 组织性文件，US Memory, LLC 份额的转让须取得其管理人（“Manager”）的同意，US Memory, LLC 增加新的股东须由员工持股计划委员会（“Plan Committee”）推荐。作为 US Memory, LLC 的管理人，Paula Zebrowski 承诺，在 WM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会同意 US Memory, LLC 现有份额持有人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其拥有的与 US Memory, LLC 份额相关的权益，但因该等持有人从北京矽成半导体有限公司或其下属公司离职而转让给 US Memory, LLC 现有其他份额持有人的除外；作为员工持股计划委员会委员，

Shueh-Mien Jimmy Lee、Kong-Yeu Han 和许伟承诺，在 WM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会向 US Memory, LLC 推荐新的份额持有人。

根据 Euro-Pacific Memory LLC 组织性文件，Euro-Pacific Memory LLC 份额的转让须取得其管理人（“Manager”）的同意，Euro-Pacific Memory LLC 增加新的份额持有人须由员工持股计划委员会（“Plan Committee”）推荐。作为 Euro-Pacific Memory LLC 的管理人，Ameé Guiriba 承诺，在 WM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会同意 Euro-Pacific Memory LLC 现有份额持有人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其拥有的与 Euro-Pacific Memory LLC 份额相关的权益，但因该等持有人从北京矽成半导体有限公司或其下属公司离职而转让给 Euro-Pacific Memory LLC 其他现有份额持有人的除外；作为员工持股计划委员会委员，Shueh-Mien Jimmy Lee、Kong-Yeu Han 和许伟承诺，在 WM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会向 Euro-Pacific Memory LLC 推荐新的份额持有人。

4、AM 之上层 21 名自然人股东

Formosa Memory LLC 系 AM 股东，其上层股东为 21 名自然人。

根据 Formosa Memory LLC 组织性文件，Formosa Memory LLC 份额的转让须取得其管理人（“Manager”）的同意，Formosa Memory LLC 增加新的份额持有人须由员工持股计划委员会（“Plan Committee”）推荐。作为 Formosa Memory LLC 的管理人，Ching-Tang (Scott) Wu 承诺，在 AM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会同意 Formosa Memory LLC 现有份额持有人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其拥有的与 Formosa Memory LLC 份额相关的权益，但因该等股东从北京矽成半导体有限公司或其下属公司离职而转让给 Formosa Memory LLC 现有其他份额持有人的除外；作为员工持股计划委员会委员，John Zimmerman 和 SJ Paul Chein 承诺，在 AM 通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，不会向 Formosa Memory LLC 推荐新的份额持有人。

5、厦门芯华之 25 名自然人（有限合伙人）

厦门芯华上层有限合伙人为 25 名自然人，根据《厦门芯华企业管理合伙企

业（有限合伙）合伙协议》，“新的有限合伙人入伙须经普通合伙人之书面同意”，“除适用法律另有规定（包括但不限于《中华人民共和国合伙企业法》项下规定的有限合伙人当然退伙的情形），在有限合伙的合伙期限内，未经普通合伙人的事先书面同意，有限合伙人无权提出退伙或转让其在有限合伙中全部或部分合伙权益或将其合伙权益出质”。

厦门芯华之普通合伙人厦门矽盛承诺，在厦门芯华通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期内，将不予接受任何新的有限合伙人入伙，不予接受任何有限合伙人要求厦门芯华回购其财产份额或从厦门芯华退伙，亦不予接受任何有限合伙人以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有其通过厦门芯华享有的与上市公司股份有关的权益。

上述通过管理人锁定方式进行穿透锁定的各主体直接/间接持有北京矽成的股比情况如下：

	锁定主体	直接/间接持有北京矽成股比
1	厦门矽茂	0.0001%
2	Golden State Memory, LLC	0.0013%
3	WM	1.78%
4	AM	0.21%
5	厦门芯华	0.16%
	合计	2.1514%

综上所述，通过管理人锁定方式进行直接/间接对标的公司股权/财产份额的锁定安排符合各锁定主体合伙协议或组织性文件的相关规定；此外，如上表所示，通过管理人锁定方式进行穿透锁定的各主体合计持有北京矽成的股比约为2.15%，占比较低。

九、本次重组交易对方的合伙企业中存在结构化安排的情况

根据交易对方中合伙企业屹唐投资、民和志威、闪胜创芯、上海瑾矽、厦门芯华、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾出具的书面承诺，上述各交易对方及其上层出资人（直至最终实益持有人）的委托人或合伙人之间均不存在分级收益等结构化安排。

十、交易对方股权代持情况

根据全体交易对方及标的企业分别出具的《关于标的资产完整权利的承诺函》和《关于本次重组有关事项的声明及承诺函》，除厦门芯华财产份额代持情形外，全体交易对方均真实持有相应的标的资产，不存在委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。

第四章 标的资产情况

本次交易的标的资产为北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额。北京矽成、上海承裕具体情况如下：

一、交易标的之北京矽成

（一）北京矽成基本情况

截至本报告书出具日，北京矽成基本情况如下：

公司名称	北京矽成半导体有限公司
企业性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地址/办公地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 3 层 301-1
法定代表人	潘建岳
注册资本	51,966.949 万元
成立日期	2014 年 11 月 2 日
统一社会信用代码	91110302318129402G
经营范围	设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）北京矽成出资及合法存续情况

根据北京矽成工商登记资料、北京矽成股东出具的承诺函，北京矽成股东所持有的北京矽成股权不存在代他人持有的情形，也不存在委托他人代其持有的情形，其持有的北京矽成股权均不存在争议或潜在纠纷。

北京矽成股东屹唐投资、上海承裕、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory、厦门芯华对北京矽成股权合法性出具如下承诺：

“1、本承诺人已履行标的企业章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。

2、本承诺人依法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。

3、本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他任何代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。

4、本承诺人进一步确认，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权（无论是现在或将来）根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权。”

（三）北京矽成历史沿革

1、设立（2014年11月）

北京矽成原名北京闪胜。北京闪胜由外滩科技、常州新能聚及中晶投资出资设立，注册资本为1,000万元。北京闪胜设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	外滩科技	400.00	40.00
2	常州新能聚	300.00	30.00
3	中晶投资	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

2014年11月2日，北京闪胜取得了北京市工商行政管理局核发注册号为110302018124675的《营业执照》。截至2015年1月9日，外滩科技、常州新能聚、中晶投资分别实缴出资40万元、30万元、30万元，合计实缴出资100万元。

2、第一次股权转让（2015年3月）

2015年3月6日，北京闪胜召开股东会会议，同意外滩科技分别向中晶投资、常州新能聚各转让200万元认缴出资额，常州新能聚及中晶投资按照1元/实缴出资额分别向外滩科技支付20万元转让款。同日，外滩科技与中晶投资、常州新能聚签署了出资转让协议。

本次股权转让完成后，北京闪胜的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常州新能聚	500.00	50.00
2	中晶投资	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

2015 年 3 月 11 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

3、第二次股权转让（2015 年 9 月）

2015 年 9 月 1 日，北京闪胜召开股东会会议，同意中晶投资分别向上海承裕、屹唐投资转让 406.25 万元、93.75 万元认缴出资额，同意常州新能聚分别向屹唐投资、华清闪胜及华创芯原转让 187.50 万元、156.25 万元及 156.25 万元认缴出资额。同日，中晶投资、常州新能聚与上海承裕、屹唐投资、华清闪胜、华创芯原签署了股权转让协议，约定上海承裕、屹唐投资、华清闪胜及华创芯原按照 1 元/实缴出资额向中晶投资、常州新能聚支付转让款，并履行剩余出资义务。

本次股权转让完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承裕	406.25	40.63
2	屹唐投资	281.25	28.13
3	华清闪胜	156.25	15.63
4	华创芯原	156.25	15.63
合计		1,000.00	100.00

2015 年 9 月 10 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。截至 2015 年 11 月 2 日，北京闪胜认缴出资全部实缴到位。

4、第一次增资（2016 年 7 月）

2015 年 11 月 12 日，北京闪胜召开股东会会议，同意北京闪胜注册资本由 1,000 万元增至 50,000 万元，并由全体股东同比例增资。本次增资价格为 9.94 元/出资额，截至 2015 年 11 月 30 日，增资实缴到位。

本次增资完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海承裕	20,312.50	40.63
2	屹唐投资	14,062.50	28.13
3	华清闪胜	7,812.50	15.63
4	华创芯原	7,812.50	15.63
合计		50,000.00	100.00

2016年7月27日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

5、第二次增资（2016年8月）

2016年1月11日，北京闪胜召开股东会会议，同意北京闪胜注册资本由50,000万元增至51,966.949万元，新增出资额全部由闪胜创芯认缴。本次增资价格为9.76元/出资额，截至2016年8月26日，增资实缴到位。

本次增资完成后，北京闪胜股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海承裕	203,125,000	39.09
2	屹唐投资	140,625,000	27.06
3	华清闪胜	78,125,000	15.03
4	华创芯原	78,125,000	15.03
5	闪胜创芯	19,669,490	3.78
合计		519,669,490	100.00

2016年8月8日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

6、公司名称及营业范围变更（2016年11月）

2016年11月7日，北京闪胜召开股东会会议，同意公司名称变更为“北京矽成半导体有限公司”，经营范围变更为“设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

2016年11月30日，本次公司名称及营业范围变更的工商变更登记手续办

理完毕。

7、第三次股权转让（2017年5月）

2016年12月27日，北京矽成召开股东会会议，同意华清闪胜分别将其持有的北京矽成 52,496,603 元出资额、21,229,620 元出资额及 4,398,777 元出资额转让予屹唐投资、上海承裕及民和志威，其他股东均放弃优先受让权。同日，华清闪胜分别与屹唐投资、上海承裕及民和志威签署股权转让协议，约定屹唐投资、上海承裕及民和志威分别向华清闪胜支付对价 53,821.67 万元、21,765.43 万元及 5,386.73 万元，即转让价格分别为 10.25 元/出资额、10.25 元/出资额及 12.25 元/出资额。

本次股权转让完成后，北京矽成股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海承裕	224,354,620	43.17
2	屹唐投资	193,121,603	37.16
3	华创芯原	78,125,000	15.03
4	闪胜创芯	19,669,490	3.78
5	民和志威	4,398,777	0.85
合计		519,669,490	100.00

2017年5月17日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

8、第四次股权转让（2017年6月）

2017年4月14日，北京矽成召开股东会会议，同意华创芯原将其持有的北京矽成 15,989,830.46 元出资额转让予民和志威，其他股东均放弃优先受让权。同日，华创芯原与民和志威签署股权转让协议，约定转让对价为 20,000 万元，即转让价格为 12.51 元/出资额。

本次股权转让完成后，北京矽成股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海承裕	224,354,620.00	43.17
2	屹唐投资	193,121,603.00	37.16
3	华创芯原	62,135,169.54	11.96
4	民和志威	20,388,607.46	3.92

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
5	闪胜创芯	19,669,490.00	3.78
合计		519,669,490.00	100.00

2017年6月5日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

9、第五次股权转让（2018年4月）

2017年12月31日，北京矽成召开股东会会议，同意上海承裕、屹唐投资、及华创芯原分别将其持有的北京矽成部分出资额转让予 Worldwide Memory、Asia Memory，其他股东均放弃优先受让权。本次股权转让的基本情况如下：

转让出资额（元）		受让方		
		Worldwide Memory	Asia Memory	合计
转让方	上海承裕	3,872,718	503,674	4,376,392
	屹唐投资	3,333,587	433,556	3,767,143
	华创芯原	1,072,552	139,493	1,212,045
	合计	8,278,857	1,076,723	9,355,580

同日，股权转让各方签署了股权转让协议。本次股权转让价格为 12.51 元/出资额。本次股权转让完成后，北京矽成股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海承裕	219,978,228.00	42.33
2	屹唐投资	189,354,460.00	36.44
3	华创芯原	60,923,124.54	11.72
4	民和志威	20,388,607.46	3.92
5	闪胜创芯	19,669,490.00	3.78
6	Worldwide Memory	8,278,857.00	1.60
7	Asia Memory	1,076,723.00	0.21
合计		519,669,490.00	100.00

2018年4月25日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕，北京矽成由其他有限责任公司变更为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

10、第六次股权转让（2018年5月）

2018年5月10日，北京矽成召开董事会会议，同意屹唐投资、华创芯原、上海承裕分别将其持有的北京矽成部分出资额转让予上海瑾矽、厦门芯华、

Worldwide Memory。本次股权转让的基本情况如下：

转让出资额（元）		受让方			
		上海瑾矽	厦门芯华	Worldwide Memory	合计
转 让 方	上海承裕	11,219,684.50	388,293.17	451,218.31	12,059,195.98
	屹唐投资	9,657,761.70	334,242.13	388,402.98	10,380,406.81
	华创芯原	3,107,299.50	107,539.45	124,965.23	3,339,804.18
	合计	23,984,745.70	830,074.75	964,586.52	25,779,406.97

同日，股权转让各方签署了股权转让协议。本次股权转让价格为 12.51 元/出资额。本次股权转让完成后，北京矽成股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	上海承裕	207,919,027.02	40.01
2	屹唐投资	178,974,053.19	34.44
3	华创芯原	57,583,320.36	11.08
4	上海瑾矽	23,984,745.70	4.62
5	民和志威	20,388,607.46	3.92
6	闪胜创芯	19,669,490.00	3.78
7	Worldwide Memory	9,243,443.52	1.78
8	Asia Memory	1,076,723.00	0.21
9	厦门芯华	830,079.75	0.16
合计		519,669,490.00	100.00

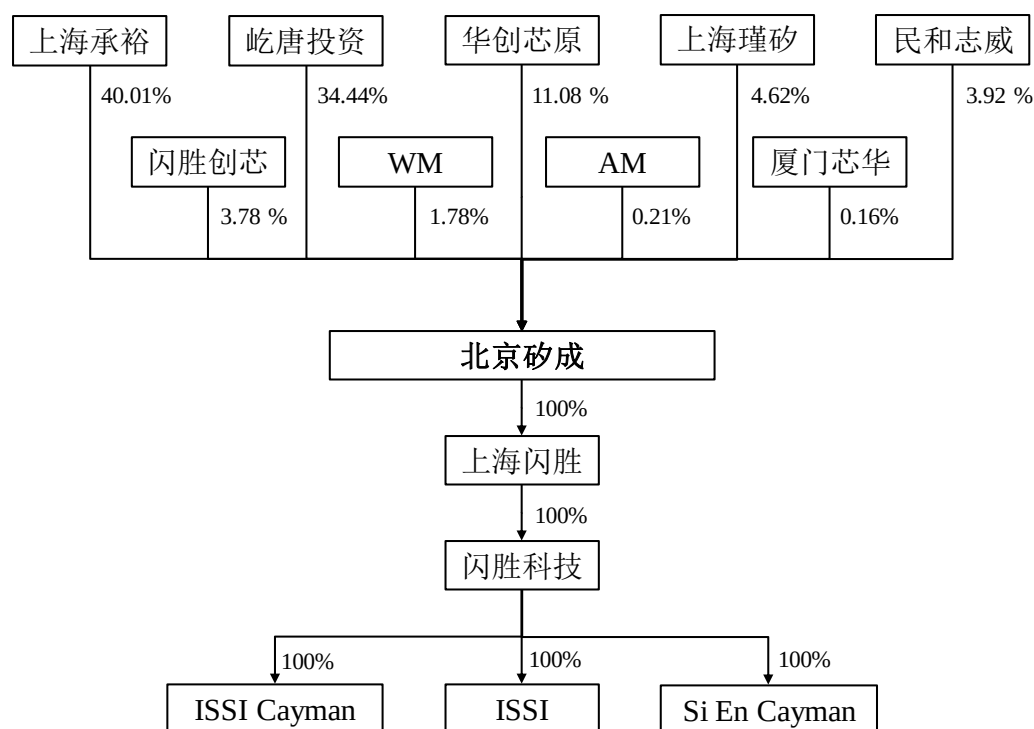
2018 年 5 月 25 日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

截至本报告书出具日，自前次股权转让完成后，北京矽成的股权结构未发生过变更。

（四）北京矽成股权结构及控制关系情况

1、产权关系图

截至本报告书出具日，北京矽成产权结构及控制关系如下图所示：



注：上海承裕的产权关系图请参见“第四章 标的资产情况”之“二、交易标的之上海承裕”，屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM 及厦门芯华的产权关系图请参见“第三章 交易对方基本情况”相应章节。

2、控股股东及实际控制人

截至本报告书出具日，北京矽成之全部股东为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory 和厦门芯华，持股比例分别为 40.01%、34.44%、11.08%、4.62%、3.92%、3.78%、1.78%、0.21%和 0.16%，无单一股东持有北京矽成 50%以上股权。同时，根据北京矽成章程，董事会系北京矽成最高权力机构，共 7 名董事，其中上海承裕委派 2 名董事，屹唐投资委派 2 名董事，华创芯原委派 1 名董事，各方联合委派 2 名董事（目前 2 名董事来自 ISSI 管理层）。根据北京矽成公司章程规定，公司章程的修改、公司注册资本的增加或减少、发行证券等需要全体董事一致同意方可做出决议；公司股东以任何形式将其所持公司的权益进行处置（包括但不限于进行出售、赠与、质押、设定产权负担或以其他方式进行处置）、批准或变更董事会的董事人数或分配、决定聘用或解聘公司总经理、财务总监等高级管理人员等事项需要全体董事 2/3 或以上（且赞成的董事中应当包括屹唐投资、上海承裕及华创芯原提名的至少各自一名出席会议的董事）通过方可做出有效决议。因此，北京矽成任何一方股东均不能通过其委派/提名的董事单独决定上述相关重要事项，无法控

制北京矽成的重大经营决策，无法对北京矽成形成控制。

综上所述，北京矽成无控股股东及实际控制人。

3、北京矽成章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或其他相关投资协议

北京矽成公司章程中存在可能对本次交易产生影响的条款如下：“任何一方其他合资各方或合资各方以外的第三方转让其所持全部或者部分合资公司股权的，须经其他方一致同意，并向工商行政管理部门及商务主管部门办理变更登记及备案手续。尽管有本第十四条第一款的规定，上海承裕、北京屹唐、北京华创向合资公司及其下属子公司（包括但不限于 Integrated Silicon Solution, Inc（芯成半导体有限公司，以下同））的员工组建的员工持股平台转让其所持有的全部或部分合资公司的股权的，其他方股东应当无条件同意该等股权转让且应当配合出具有关同意该等股权转让及放弃相应优先购买权的书面文件（如需）。”

本次交易中，屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华、上海承裕已出具承诺函：“本承诺人享有的与北京矽成相关的股东特殊权利（如有），包括但不限于股权回购请求权、优先认购权、随售权等，自上市公司首次披露本次重组预案/草案之前自动终止。”

北京矽成不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。北京矽成及其子公司不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。

4、北京矽成原高级管理人员和核心人员的安排

截至本报告书出具日，根据本次交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易涉及北京矽成股东变动，不涉及北京矽成聘用人员劳动关系的调整变更。

5、交易完成后上市公司对北京矽成的控制情况

根据北京矽成现时有效的《营业执照》和公司章程，截至本报告书出具日，北京矽成是一家中外合资经营企业，组织形式为有限责任公司。根据本次交易方案，北京君正及合肥君正通过发行股份及支付现金的方式购买北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，本次交易完成后，北京君正将直接持

有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接持有北京矽成 100%股权，后者将变更为内资企业。

（1）本次交易前后北京矽成的公司治理及生产经营安排

根据上市公司的书面说明，本次交易完成后，北京君正作为北京矽成的股东，将依法行使相关股东权利，并按照上市公司法人治理及规范运作要求，通过修改公司章程、改组董事会、新聘高级管理人员及规范公司运作等方式对北京矽成公司治理及生产经营进行安排，确保对北京矽成实现有效控制，具体如下：

	本次交易前	本次交易后
公司章程修改情况	现行公司章程： （1）董事会是北京矽成的最高权力机构，决定北京矽成的一切重大问题； （2）董事会由 7 名董事组成，其中，上海承裕委派 2 名，屹唐投资委派 2 名，华创芯原委派 1 名，各合资方有权联合委派 2 名； （3）经营管理机构负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理 1 名、财务总监 1 名，均由董事会聘请。	拟进行的章程修改： （1）设置股东会，股东会是北京矽成最高权力机构，决定北京矽成一切重大事项； （2）设置董事会，董事由股东会选举产生，对股东会负责，股东会有权解除董事职务； （3）设置经理、副经理、财务负责人及其他高级管理人员等，该等人员由董事会聘任并负责北京矽成日常经营管理工作。
董事会构成及各股东推荐董事及高管情况	（1）董事会构成： 潘建岳、武平（上海承裕委派） 张建勋、王东生（屹唐投资委派） 刘越（华创芯原委派） Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-Yeu Han（各合资方联合委派） （2）高级管理人员构成： 总经理：Kong-Yeu Han 财务总监：John Cobb	北京君正直接及间接持有北京矽成 100%股权，实际控制北京矽成的股东会： （1）北京君正提名新一届董事会：主要由上市公司相关人员组成，同时包括北京矽成现有核心管理人员 Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-Yeu Han。 （2）董事会新聘经理、副经理、财务负责人及其他高级管理人员，主要由上市公司及北京矽成相关人员组成。
重大事项决策机制	董事会是最高权力机构，决定北京矽成的一切重大问题； 北京矽成及其子公司相关重大事项须经出席董事会会议的全体董事一致通过，或须经出席董事会会议的全体董事三分之二或以上（包括上海承裕、屹唐投资、华创芯原提名的至少各自一名出席会议的董事）通过方可做出有效决议。	股东会是北京矽成最高权力机构，决定北京矽成一切重大事项； 董事会负责执行股东会决议及公司章程规定的相关职权，董事会决议的表决，实行一人一票，董事会会议作出决议须经出席会议的董事过半数通过。
经营和财务管理机制	设经营管理机构，负责北京矽成的日常经营管理工作； 经营管理机构设总经理 1 名、财务总	北京矽成新一届董事会在聘任经理、副经理、财务负责人及其他高级管理人员时，将最大限度保持北京矽成现有管理

	监 1 名，总经理负责组建公司职能部门，包括财务与行政、IT、销售与市场、研发等，具体负责北京矽成全球范围内的日常经营；各职能部门对总经理负责，总经理对董事会负责。	团队稳定、给予管理层充分发展空间，以保持其业务持续稳定运营和发展；同时，北京君正将通过有效的控制机制，强化公司在业务经营、财务管理、对外投资、外部融资、资产处置等方面对北京矽成的管理与控制，提高公司整体抗风险能力，并充分利用上市公司规范化管理经验，按照上市公司内部控制和规范管理的要求，并结合北京矽成的经营特点、业务模式及组织架构对原有的内部控制制度、财务制度及管理制度按照上市公司的要求进行适当地调整，以提高运营效率、有效控制风险，使其在各方面均达到上市公司的标准。

（2）本次交易完成后，上市公司对北京矽成能实施有效控制

如前所述，本次交易完成后，作为北京矽成的股东，北京君正将通过公司章程修改、董事会选举、高级管理人员选聘等公司治理和决策机制，在人员、业务经营、财务管理、对外投资、外部融资、资产处置等各方面形成对北京矽成的全面管理与控制；上市公司还将利用现有规范化管理经验，结合北京矽成的经营特点、业务模式及组织架构，对其原有的内部控制制度、财务制度及管理制度按照上市公司内部控制和规范要求进行适当地调整，以提高运营效率、有效控制风险，使其在各方面均达到上市公司的标准。

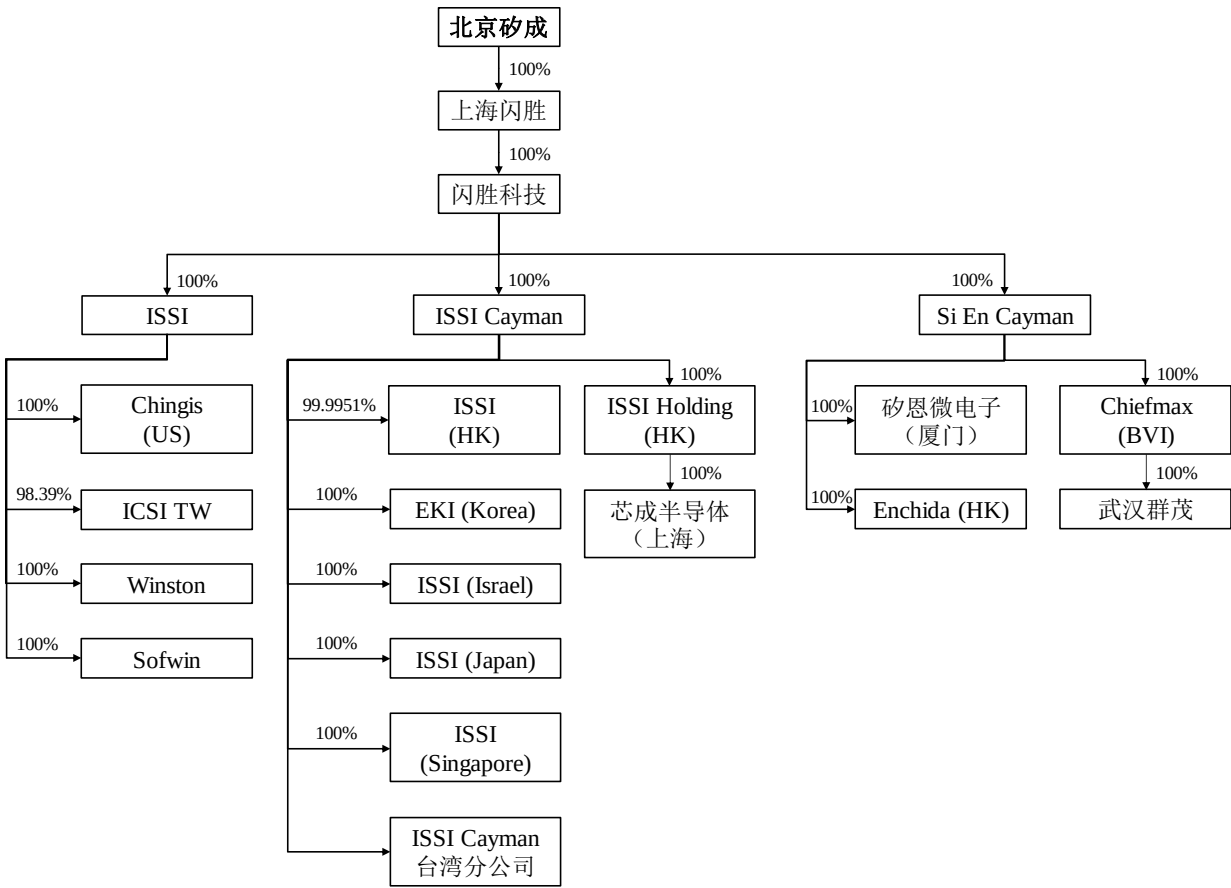
同时，上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应及互补效应。本次交易完成后，上市公司将利用自身对国内集成电路和信息技术行业的理解和经验，充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，实现对北京矽成的有效控制和良好融合。

综上所述，本次交易完成后，北京矽成将成为北京君正全资子公司，将被纳入上市公司管理体系；根据上市公司治理和规范运行的要求，北京君正将对北京矽成的公司治理、生产经营和财务管理进行相应调整 and 安排，并充分发挥与北京矽成的协同效应，通过该等调整 and 安排举措的落实和执行，上市公司能够对北京矽成实现有效控制。

（五）北京矽成主要下属公司情况

北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。私有化收购完成后，考虑提高北京矽成整体运营效率、利润分配体系以及控制税务风险等因素，北京矽成对海外组织架构实施了收购后的调整，ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。

截至本报告书出具日，北京矽成主要下属公司合计 21 家（含 ISSI Cayman 台湾分公司），具体如下：



1、上海闪胜

（1）基本情况

公司名称	上海闪胜集成电路有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址/办公地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 1270 室

法定代表人	Kong- Yeu Han
注册资本	96,000 万元人民币
成立日期	2015 年 7 月 27 日
统一社会信用代码	913100003510082079
经营范围	集成电路及芯片的设计、研发,通讯设备、电子产品、计算机硬件的设计、研发,计算机软件的设计、研发、制作,并提供上述相关领域内的技术咨询、技术服务及技术转让,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,集成电路、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售,从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）历史沿革

①设立（2015 年 7 月）

2015 年 7 月 27 日，上海闪胜设立并领取了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》，设立时注册资本为 5,000 万元，北京闪胜为唯一的出资人。

②增资（2015 年 11 月）

2015 年 11 月 10 日，上海闪胜注册资本增至 96,000 万元，由北京闪胜认缴。

本次变更完成后，上海闪胜的股权结构未发生过变更。

（3）最近三年主营业务发展情况

截至本报告书出具日，上海闪胜主营业务通过 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及其下属子公司开展，除此之外暂无其他实际经营业务。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

上海闪胜主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中合并披露。

（5）上海闪胜对外投资情况

截至本报告书出具日，除闪胜科技及其下属子公司外，上海闪胜不存在其他对外投资情况。

2、闪胜科技

（1）基本情况

公司名称	Uphill Technology Inc.
注册地址	Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands.
公司编号	303532
董事	Xu Wei
股本	50,000 股普通股
成立日期	2015 年 8 月 27 日
经营范围	无明确限制

（2）历史沿革

①设立（2015 年 8 月）

2015 年 8 月 27 日,上海闪胜和 OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 设立闪胜科技,总股本 50,000 股普通股,其中上海闪胜和 OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 分别持有 49,999 股和 1 股。

②第一次股权转让（2015 年 8 月）

2015 年 8 月 27 日,OFFSHORE INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED 将其持有的闪胜科技 1 股普通股转让予上海闪胜。本次股权转让完成后,上海闪胜成为闪胜科技的唯一股东。

本次股权转让完成后,闪胜科技的股权结构未发生过变更。

（3）最近三年内主营业务情况

截至本报告书出具日,闪胜科技主营业务通过 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及其下属子公司开展,除此之外暂无其他实际经营业务。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

闪胜科技主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中合并披露。

（5）闪胜科技对外投资情况

截至本报告书出具日,除 ISSI、ISSI Cayman、Si En Cayman 及上述公司的

下属子公司外，闪胜科技不存在其他对外投资情况。

3、ISSI

（1）基本情况

公司名称	Integrated Silicon Solution, Inc.
注册地址	1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
公司编号	2339695
授权股份数	1,000 股
已发行股份数	100 股
成立日期	1993 年 6 月 10 日
经营范围	特拉华州普通公司法下公司可经营的任何合法业务。

注：根据 ISSI 的说明，ISSI 最初在美国加利福尼亚州注册并随后在美国特拉华州重新注册，本报告书中 ISSI 的成立时间为其重新注册的时间。

（2）历史沿革

ISSI 于 1993 年 6 月 10 日成立，除若干次股份拆细、实施员工股权激励等事项外，ISSI 历史上主要股本变动情况如下：

①首次公开发行股票及上市（1995 年 2 月）

1995 年 2 月 3 日，ISSI 以 13 美元/股的发行价格首次公开发行股票 230 万股后，并于纳斯达克全国市场（NASDAQ National Market，以下简称“纳斯达克”）上市交易，首次公开发行股票及上市后，ISSI 的股份总数为 14,991,096 股。

②公开发行股票（1995 年 5 月）

1995 年 5 月 17 日，ISSI 以 36.50 美元/股的发行价格完成后续公开发行（follow-on public offering）345 万股普通股股票，包括 ISSI 发行的 150 万股新股、部分原股东公开转让的 150 万股股票以及授予承销商配售选择权的 45 万股普通股股票。根据 ISSI 为该次公开发行向美国证监会提交的招股说明书，该次公开发行股票完成后，ISSI 的股份总数为 16,593,187 股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	Wearnes Technology Pte, Ltd. (beneficially owned by Chun Win Wong)	10.7%
2	Joseph Liu	5.0%

序号	股东名称	持股比例
3	International Venture Capital Investment Corporation (beneficially owned by Lip Bu Tan)	4.3%
4	Jimmy Lee	3.1%
5	Chiu-Tzu Yao	2.9%
6	Shuhbin King	2.8%
7	United Microelectronics Corporation	2.4%
8	Hou-Teng Lee	2.0%
9	Kong- Yeu Han	1.8%
10	Hung-Liang Hsieh	1.6%
11	Vision Holdings, Ltd.	1.6%
12	Shin-Sheng Lin	1.3%
13	Ming-Kang Hsu	1.1%
14	其他持股不超过 1%的股东	59.4%
合计		100.0%

③发行股份合并 Nexcom Technology, Inc.（1997 年 12 月）

1997 年 12 月 3 日，ISSI 发行 772,693 股普通股股票并支付 50 万美元现金，吸收合并 Nexcom Technology, Inc.。截至 1998 年 12 月 1 日，ISSI 的股份总数为 19,417,827 股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	Chun Win Wong	2.9%
2	Jimmy Lee	2.5%
3	Kong- Yeu Han	2.2%
4	Lip-Bu Tan	2.0%
5	其他持股不超过 1%的股东	90.4%
合计		100.0%

④公开发行股票（2000 年 1 月至 2000 年 3 月）

2000 年 1 月至 3 月期间，ISSI 以 25.50 美元/股的发行价格完成后续公开发行 3,795,000 股普通股股票。截至 2000 年 12 月 12 日，ISSI 的股份总数为 25,833,848 股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	Pilgrim Baxter & Associates	5.9%
2	Dreyfus Corporation	5.4%
3	Jimmy Lee	1.6%
4	Chun Win Wong	1.4%
5	Lip Bu Tan	1.0%
6	其他持股不超过 1%的股东	84.7%
合计		100.0%

⑤发行股份合并 Purple Ray, Inc.（2002 年 2 月至 2003 年 8 月）

2002 年 2 月 13 日, ISSI 发行 438,281 股普通股股票, 吸收合并 Purple Ray, Inc.。截至 2002 年 12 月 10 日, ISSI 的股份总数为 27,576,761 股, 其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	Berger, LLC	12.4%
2	Dreyfus Corporation	8.7%
3	Fidelity Management & Research	6.2%
4	Jimmy Lee	1.7%
5	其他持股不超过 1%的股东	71.0%
合计		100.0%

2003 年 8 月 7 日, 因 Purple Ray, Inc.达成相关条件, ISSI 额外向 Purple Ray, Inc.原股东发行 8,241 股普通股股票。截至 2003 年 12 月 31 日, ISSI 的股份总数为 28,889,442 股, 其持股 1%及以上的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	Barclays Global Investors	6.6%
2	Jimmy Lee	2.1%
3	Gary Fischer	1.1%
4	其他持股不超过 1%的股东	90.2%
合计		100.0%

⑥公开发行股票（2004 年 1 月至 2004 年 3 月）

2004 年 1 月至 3 月期间, ISSI 以 16.50 美元/股的发行价格完成后续公开发行 6,025,000 股普通股股票。截至 2004 年 12 月 6 日, ISSI 的股份总数为 36,256,285

股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	State Street Research & Management Company	7.6%
2	Jimmy Lee	1.8%
3	其他持股不超过 1%的股东	90.6%
合计		100.0%

⑦发行股份收购 Chingis（TW）股份有限公司剩余股权（2014 年）

2014 年，ISSI 修改公司章程并授权 ISSI 发行 324 股第一级可赎回优先股股票，用于收购 Chingis（TW）（于收购时系 ISSI 的控股子公司）剩余股权。截至 2014 年 9 月 30 日，上述第一级可赎回优先股股票由 ISSI 全部赎回。截至 2015 年 4 月 20 日，ISSI 的股份总数为 31,745,884 股，其持股 1%及以上的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	Starboard Value LP	9.7%
2	Royce and Associates	7.9%
3	Donald Smith & Co, Inc.	6.4%
4	Dimensional Fund Advisors LP	6.2%
5	BlackRock Fund Advisors LP	5.3%
6	Jimmy Lee	1.1%
7	Kong-Yeu Han	1.1%
8	James Han	1.1%
9	其他持股不超过 1%的股东	61.2%
合计		100.0%

⑧私有化收购（2015 年）

2015 年，Uphill Technology 向 ISSI 全体股东收购 ISSI 100%股权，ISSI 从纳斯达克退市。私有化收购完成后，Uphill Technology 持有 ISSI 100%股权，系 ISSI 单一股东。根据北京矽成提供的相关文件资料及境外律师意见，前述私有化收购的具体情况如下：

A.私有化收购的交易背景及目的

2014 年 11 月，ISSI 董事会收到来自潜在敌意收购方/ISSI 股东 Starboard Value

Group, LP 及 Oliver Press Investors LLC 关于拟提名更换 ISSI 董事的函件。2014 年 12 月，为应对该潜在敌意收购，ISSI 多次召开董事会及董事会特别委员会会议，讨论公司长期发展战略、上述潜在敌意收购方意图及应对措施等事项，并聘请顾问团队寻找其他意向收购方。

2015 年 1 月至 3 月期间，武岳峰浦江、北京集成、北京京存及华清基业在私有化收购中最终形成买方团，经过尽职调查及谈判，买方团以北京闪胜名义与 ISSI 于 2015 年 3 月 12 日签署《合并协议与计划》（以下简称《合并协议》），旨在收购 ISSI 100% 股权并使其退市。

B. 私有化收购的具体过程

a. 前期接洽及筹划

2015 年 1 月，ISSI 管理团队在寻找意向收购方过程中，曾与武岳峰浦江代表潘建岳等投资者会面及沟通，并就潜在收购事宜建立并保持联系；2015 年 2 月，武岳峰浦江牵头组建买方团，并以北京闪胜为收购主体，正式启动私有化收购 ISSI 事宜。

b. 达成初步意向，签署保密协议及开展尽职调查工作

2015 年 2 月 4 日，ISSI 与北京闪胜签署保密协议。随后，买方团展开对 ISSI 的财务、法律等各项尽职调查工作；双方就交易框架、尽职调查安排、交易监管规制等问题进行多次沟通及讨论。

2015 年 2 月 20 日，北京闪胜向 ISSI 表示愿意以 19.00 美元/股的价格发出非约束性收购要约，并提供中国工商银行出具的债务融资保函。2015 年 2 月 23 日至 26 日期间，经 ISSI 董事会、董事会战略委员会与北京闪胜多次反复谈判及磋商，北京闪胜最终以 19.25 美元/股的价格发出非约束性收购要约，并于 2015 年 3 月 1 日与 ISSI 就要约价格等关键条款签署函件。

c. 私有化收购的相关协议签署

2015 年 3 月 12 日，武岳峰浦江、北京京存、北京集成、华清基业与北京闪胜签署《关于北京闪胜投资有限公司之投资协议》，约定各方以其关联方（即上海承裕、屹唐投资、华创芯原、华清闪胜）共同投资北京闪胜，并通过北京闪胜

私有化收购 ISSI US.

2015 年 3 月 12 日，ISSI 与北京闪胜签署《合并协议与计划》，并经 ISSI 董事会批准。根据私有化收购方案，北京闪胜于美国特拉华州设立并购子公司，以 19.25 美元/股的价格通过反向三角并购的方式收购 ISSI 并实现其私有化；私有化完成后，ISSI 吸收合并并购子公司，并作为北京闪胜的间接全资子公司继续存续，ISSI 停止上市，其全部流通股股份（根据特拉华州普通公司法而享有且适当行使现金选择权的股东所持有的股份除外）予以撤销，并转化为 19.25 美元/股的现金请求权。

2015 年 4 月 28 日，ISSI 与北京闪胜及其并购子公司签署《合并协议的补充协议一》，就 ISSI 下属部分台湾资产的交割及安排等事宜进行约定。2015 年 5 月 29 日、6 月 11 日、6 月 18 日及 6 月 22 日，ISSI 与北京闪胜及其并购子公司分别签署《合并协议的补充协议二》《合并协议的补充协议三》《合并协议的补充协议四》及《合并协议的补充协议五》，北京闪胜同意将私有化收购的价格依次提高至 20 美元/股、21 美元/股、22 美元/股及 23 美元/股。

2015 年 6 月 29 日，ISSI 召开特别股东大会，审议通过《合并协议》及其全部补充协议。

2015 年 12 月 7 日，私有化收购完成交割相关事宜，ISSI 成为北京闪胜间接全资子公司。

C.私有化收购涉及的境内外审批/监管程序

2015 年 11 月 2 日，北京闪胜就私有化收购相关事宜通过 CFIUS 安全审查。

2015 年 11 月 24 日，ISSI 就私有化收购涉及的台湾业务相关事宜取得台湾投审会的批准。

2015 年 11 月 24 日，国家发展和改革委员会出具《项目备案通知书》（发改办外资备[2015]382 号），同意对上海闪胜收购 ISSI 全部股权项目予以备案。

2015 年 11 月 24 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具沪境外投资[2015]N00918 号文件，同意上海闪胜的境外投资相关事宜；2015 年 11 月 24 日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会向上海闪胜核发《企业境外投资证

书》（境外投资证第 N3100201500919 号）。

2015 年 11 月 27 日，上海浦东发展银行金桥支行出具《业务登记凭证》，经国家外汇管理局上海市分局同意，办理上海闪胜跨境资金汇付相关事宜。

2015 年 12 月 14 日，ISSI 向美国证券交易委员会提交退市证书及通知，正式退市。

D.私有化收购涉及的股东诉讼

2015 年 4 月 1 日、2015 年 4 月 8 日，ISSI 股东 Richard Wilson III、Matthew Sciabacucchi 及 Kathy Guerra 分别提起股东代表诉讼，主张 ISSI 董事在私有化收购过程中违反了董事勤勉义务，请求撤销私有化收购安排。2015 年 5 月，法院裁定就前述三起诉讼进行合并审理。2015 年 9 月 24 日，法院驳回上述诉讼案件的诉讼请求。

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，ISSI 的主营业务为存储芯片和模拟芯片类产品的研发、运营及销售。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

ISSI 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中合并披露。

（5）ISSI 对外投资情况

截至本报告书出具日，除控股 ICSI TW、Chingis(US)、Winston、Sofwin 外，ISSI 不存在其他对外投资情况。

4、ISSI Cayman

（1）基本情况

公司名称	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.
注册地址	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.
公司编号	265305
董事	Kong-Yeu Han、Paula Zebrowski

股本	100 股普通股
成立日期	2012 年 1 月 3 日
经营范围	开曼群岛法律不禁止的任何业务

（2）历史沿革

①设立（2012 年 1 月）

2012 年 1 月 3 日, ISSI 及 Maples Corporate Services Limited 设立 ISSI Cayman, ISSI 及 Maples Corporate Services Limited 分别持有 ISSI Cayman 各 1 股普通股。

ISSI Cayman 设立时, ISSI Cayman 的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	ISSI	1	普通股
2	Maples Corporate	1	普通股

②股权转让（2012 年 1 月）

2012 年 1 月 3 日, Maples Corporate Services Limited 将其持有的 1 股普通股转让予 ISSI。

③重新发行股份（2015 年 7 月）

2015 年 7 月 16 日, ISSI Cayman 重新发行股份, ISSI Cayman 总股本变更为 100 股普通股, ISSI 持有 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

④股权转让（2016 年 10 月）

2016 年 10 月 17 日, ISSI 将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予 Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.。上述股权转让完成后, Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.持有 ISSI Cayman 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

⑤股权转让（2016 年 12 月）

2016 年 12 月 6 日, Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予 Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.。上述股权转让完成后, Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.持有 ISSI Cayman 100 股普通股, 系 ISSI Cayman 单一股东。

2016 年 12 月 6 日，Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.将其持有的 ISSI Cayman 100 股普通股转让予闪胜科技。上述股权转让完成后，闪胜科技持有 ISSI Cayman 100 股普通股，系 ISSI Cayman 单一股东。

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，ISSI Cayman 的主营业务为存储芯片和模拟芯片类产品的销售。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

ISSI Cayman 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中合并披露。

（5）ISSI Cayman 对外投资情况

截至本报告书出具日，除投资芯成积体电路（香港）、EKI (Korea)、ISSI (Israel)、ISSI (Japan)、ISSI (Singapore)、ISSI Holding (HK)、芯成半导体（上海）及上述公司的下属子公司外，ISSI Cayman 不存在其他对外投资情况。

5、Si En Cayman

（1）基本情况

公司名称	Si En Integration Holdings Limited
注册地址	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
公司编号	142978
董事	Kong-Yeu Han、Shueh-Mien Jimmy Lee、Jujiang Li
股本	6,000,000 股不可赎回的有投票权投资人股（“投资人股”）；及 8,050,750 股可赎回的有投票权员工股（“员工股”）
成立日期	2004 年 12 月 14 日
经营范围	开曼群岛法律不禁止的任何业务

（2）历史沿革

①设立（2004 年 12 月）

2004 年 12 月 14 日，Sai Luen Ting、Shan Guan、Offshore Incorporations (Cayman) Limited 及 Apex Achieve International Limited 设立 Si En Cayman，并分别持有 4,111,110 股员工股、3,288,889 股员工股、1 股员工股及 6,000,000 股投资

人股。Si En Cayman 设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	Apex Achieve	6,000,000	投资人股
2	Sai Luen Ting	4,111,110	员工股
3	Shan Guan	3,288,889	员工股
4	Offshore Incorporations	1	员工股

②股权转让（2007 年 8 月）

2007 年 8 月 15 日，Apex Achieve International Limited 将其持有的 150,000 股投资人股转让予 Jianliang Xu、150,000 股投资人股转让予 Qifang Yuan。

上述股权转让完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	Apex Achieve	5,700,000	投资人股
2	Jianliang Xu	150,000	投资人股
3	Qifang Yuan	150,000	投资人股
4	Sai Luen Ting	4,111,110	员工股
5	Shan Guan	3,288,889	员工股
6	Offshore Incorporation	1	员工股

③股权转让、股份发行及股份回购（2011 年 1 月）

2011 年 1 月 13 日，Offshore Incorporations (Cayman) Limited 将其持有的 1 股员工股转让予 Sai Luen Ting。

2011 年 1 月 13 日，Sai Luen Ting 将其持有的 100,000 股员工股转让予 Qifang Yuan、50,000 股员工股转让予 Dandan Wu Daniel、200,000 股员工股转让予 Xi Jia Ding、250,000 股员工股转让予 Andrew Hua Ting、50,000 股员工股转让予 De Xu、266,667 股员工股转让予 Active Minds International Limited。2011 年 1 月 31 日，Sai Luen Ting 将其持有的 3,194,444 股员工股转让予 ISSI。

2011 年 1 月 13 日，Shan Guan 将其持有的 100,000 股员工股转让予 Ming Duenn Ni、将其持有的 50,000 股员工股转让予 Dandan wu Danie、将其持有的 330,000 股员工股转让予 Cindy Guan，将其持有的 50,000 股员工股转让予 De Xu；将其持有的 333,333 股员工股转让予 Active Minds International Limited。2011 年

1月31日，Shan Guan 将其持有的 2,425,556 股员工股转让予 ISSI。

2011年1月15日，Active Minds International Limited 认购 Si En Cayman 发行的 1,200,000 股员工股。

2011年1月26日，Si En Cayman 回购 Active Minds International Limited 持有的 549,250 股员工股。

2011年1月31日，Jianliang Xu 将其持有的 150,000 股投资人股、Qifang Yuan 将其持有的 150,000 股投资人股及 100,000 股员工股、Dandan Wu Daniel 将其持有的 100,000 股员工股、Xi Jia Ding 将其持有的 200,000 股员工股、Andrew Hua Ting 将其持有的 250,000 股员工股、De Xu 将其持有的 100,000 股员工股、Ming Duenn Ni 将其持有的 100,000 股员工股、Cindy Guan 将其持有的 330,000 股员工股、Active Minds International Limited 将其持有的 1,250,750 股员工股转让予 ISSI。

2011年1月31日，Active Minds International Limited 将其持有的 5,700,000 股投资人股转让予 ISSI。

上述股权转让、股份发行及股份回购完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	ISSI	6,000,000	投资人股
2		8,050,750	员工股

④股权转让（2016年10月）

2016年10月17日，ISSI 将其持有的 8,050,750 股员工股及 6,000,000 股投资人股转让予 Integrated ANALOG Solution (Cayman), Inc.。

上述股权转让、股份发行及股份回购完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	Integrated ANALOG Solution (Cayman), Inc.	6,000,000	投资人股
2		8,050,750	员工股

⑤股权转让（2016年12月）

2016年12月6日，Integrated ANALOG Solution (Cayman), Inc. 将其持有的 8,050,750 股员工股及 6,000,000 股投资人股转让予 ANALOG Circuit Solution (Cayman), Inc.。

2016 年 12 月 6 日，ANALOG Circuit Solution (Cayman), Inc.将其持有的 8,050,750 股员工股及 6,000,000 股投资人股转让予闪胜科技。

上述股权转让、股份发行及股份回购完成后，Si En Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	股份种类
1	Uphill Technology Inc.	6,000,000	投资人股
2		8,050,750	员工股

（3）最近三年内主营业务情况

最近三年，Si En Cayman 的主营业务为 ANALOG 产品的研发、销售和运营。

（4）主要资产、负债及对外担保情况

Si En Cayman 主要资产、负债及对外担保情况于本报告书“第四章 标的资产情况”之“一、交易标的之北京矽成”之“（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中合并披露。

（5）Si En Cayman 对外投资情况

截至本报告书出具日，除 Enchida (HK)、矽恩微电子（厦门）、Chiefmax (BVI) 及上述公司的下属子公司外，Si En Cayman 不存在其他对外投资情况。

6、ICSI TW

公司名称	硅成集成电路股份有限公司
注册地址	新竹县竹东镇头重里中兴路 4 段 669 号 5 楼
公司编号	22099630
代表人	韩光宇
资本总额	新台币 3,800,000,000 元
实收资本额	新台币 1,348,615,190 元
成立日期	1990 年 9 月 10 日
经营范围	F119010 电子材料批发业 F219010 电子材料零售业

7、Chingis(US)

公司名称	Chingis Techonology Corporation
注册地址	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
公司编号	C1948880

授权股份数	2,400 万普通股
已发行股份数	60 万普通股
成立日期	1995 年 9 月 20 日
经营范围	加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务，但不包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。

8、Winston

公司名称	Winston Inc.
注册地址	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
公司编号	C2506289
授权股份数	1,000 普通股
已发行股份数	1,000 普通股
成立日期	2013 年 4 月 17 日
经营范围	加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务，但不包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。

9、Sofwin

公司名称	Sofwin Inc.
注册地址	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA 95305
公司编号	C2506290
授权股份数	1,000 普通股
已发行股份数	1,000 普通股
成立日期	2013 年 4 月 17 日
经营范围	加利福尼亚州普通公司法下公司可经营的任何合法业务，但不包括银行、信托公司、或加利福尼亚公司条例许可的专业行业。

10、ISSI (HK)

公司名称	Integrated Silicon Solution Inc. (Hong Kong) Limited
注册地址	Unit 801-5, 8/F., Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
公司编号	353307
董事	Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-Yue Han
股本	20,410 股普通股
成立日期	1992 年 4 月 15 日
主要业务	未营任何业务

11、EKI (Korea)

公司名称	Enable Korea Co., Ltd

注册地址	韩国京畿道城南市盆唐区城南大路 69,710 号
董事	Soon Byung Yoon
资本金总额	50,000,000 万韩元
成立日期	2013 年 5 月 22 日
经营范围	(i) 半导体设计及开发, (ii) 半导体研究及实验, (iii) 半导体技术支持, (iv) 半导体维护及维修, (v) 不动产租赁、转租, 以及 (vi) 与以上各项相关的附属业务

12、ISSI (Israel)

公司名称	Integrated Silicon Solution Israel Ltd.
注册地址	38 HaBarzel Street, Tel Aviv 6971054, Israel
董事	Nadav Katzir、Yao Chung-Ting、Kong-Yeu Han
股本	18,337,360 股普通股
成立日期	1999 年 8 月 19 日
经营范围	标准一般权限

13、ISSI (Japan)

公司名称	日本 ISSI 合同会社
注册地址	东京都新宿区西新宿六丁目 14 番 1 号新宿 GREEN TOWER BUILDING 18 层
职务执行人	三浦直树
注册资本	1,000 万日元
成立日期	1999 年 10 月 1 日
经营范围	半导体、集成电路等电子产品的开发、生产、销售、斡旋及进出口；电脑及其周边产品，以及电脑软件的开发、制作、销售、租赁、中介、保养及进出口；前述各项相关的咨询业务及专有技术（know-how）的销售；前述各项随附的所有业务

14、ISSI (Singapore)

公司名称	Integrated Silicon Solution, Inc (Singapore) Pte. Limited
注册地址	51 Bukit Batok Crescent #08-33 Unity Centre Singapore 658077
公司编号	201308246K
董事	Johny Sjaflie、Kong-Yeu Han
股份数	1 股，每股面值 1 新加坡元
成立日期	2013 年 3 月 28 日
经营范围	其他商业支持服务活动——为控股公司提供销售和市场营销支持；其他特定办公支持活动——为控股公司提供客户支持中心。

15、ISSI Cayman 台湾分公司

公司名称	英属开曼群岛商硅成科技股份有限公司台湾分公司
公司地址	新北市汐止区新台五路 1 段 106 号 7 楼
公司编号	53665841
资本总额	5 万美元
营运资金	300 万新台币
股权状况	有大陆投资人（该投资持股情形应依投审会审定为准）
代表人	刘伟平
核准认许日期	2013 年 2 月 22 日
所营事业资料	F119010 电子材料批发业 F219010 电子材料零售业

16、ISSI Holding (HK)

公司名称	ISSI Hong Kong Holding Limited
注册地址	Unit 5-6, 7/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
公司编号	1173155
董事	Kong-Yeu Han
股本	71,365,753 股
成立日期	2007 年 10 月 5 日
主要业务	未营任何业务

17、芯成半导体（上海）

公司名称	芯成半导体（上海）有限公司
企业性质	有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址/办公地址	中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路 2777 弄 25 号全幢
法定代表人	韩光宇（Kong-Yeu Han）
注册资本	1,791.25 万美元
成立日期	2000 年 9 月 15 日
统一社会信用代码	913100006074199240
经营范围	设计、委托加工超大规模集成电路半导体产品 and 应用系统及制作相关软件，销售自产产品，提供相关技术服务，以及为本公司及其投资者所拥有、控制或关联企业提供经营决策和管理咨询服务、财务管理服务、提供产品采购的质量控制和管理服务、信息服务及员工管理服务以及相关商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

18、Enchida (HK)

公司名称	Enchida International Limited

注册地址	Flat/RM 408, 4/F., Dominion Centre, 43-59 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
公司编号	957358
董事	Jimmy (Shueh-Mien) Lee、Kong-Yeu Han、Yao Chung Ting
股本	10,000 股普通股
成立日期	2005 年 3 月 21 日
主要业务	从事晶圆产品贸易业务（不涉及在香港境内开展零售业务、不涉及在香港境内开展进出口业务等）

19、矽恩微电子（厦门）

公司名称	矽恩微电子（厦门）有限公司
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册地址/办公地址	厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 12F
法定代表人	Kong-Yeu Han
注册资本	70 万美元
成立日期	2005 年 3 月 23 日
统一社会信用代码	91350200769267863D
经营范围	集成电路芯片的设计、开发、测试及其进出口业务经营和相关技术应用、咨询与服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。

20、Chiefmax (BVI)

公司名称	Chiefmax Venture Ltd.
注册地址	Portcullis Chambers, 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110
公司编号	303532
董事	Jujiang Li
股本	50,000 股普通股
成立日期	2001 年 11 月 22 日
经营范围	英属维尔京群岛法律不禁止的任何业务

21、武汉群茂

公司名称	武汉群茂科技有限公司
企业性质	有限责任公司（外国法人独资）
注册地址/办公地址	武汉市东湖开发区关山一路 1 号光谷软件园 C3 栋第 1-2 层
法定代表人	汤宇方
注册资本	4,000 万元
成立日期	2002 年 4 月 22 日

统一社会信用代码	91420100737500966M
经营范围	各类集成电路及其软硬件产品的设计、开发、生产、销售和相关技术服务；相关技术培训；集成电脑系统的应用和销售，集成电路及其相关产品进出口；自有房屋租赁（不含房地产开发）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）北京矽成主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况

1、主要资产的权属情况

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成的固定资产情况如下表所示：

单位：万元

序号	资产名称	原值	账面价值	成新率
1	房屋建筑物	19,091.26	15,706.13	82.27%
2	机器设备	54,159.43	9,790.26	18.08%
3	运输设备	175.94	12.06	6.85%
4	家具设备	3,344.83	270.64	8.09%
合计		76,771.46	25,779.08	33.58%

（1）房屋所有权及使用权

①房屋所有权

截至本报告书出具日，北京矽成对应房屋所有权情况如下：

序号	房屋所有权人	相关证书编号	用途	房屋座落	建筑面积（m²）
1	芯成半导体（上海）	沪房地浦字（2014）第 055674 号	厂房	锦绣东路 2777 弄 25 号全幢	2,871.41
2	芯成半导体（上海）	苏房权证园区字第 00502286 号	非住宅	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 1 幢 1703 室	898.76
3	武汉群茂	武房权证湖字第 200902150 号	办公	东湖新技术开发区关山大道 1 号 12 期光谷企业公馆 C3 栋 1-2 层 1、2 号	1,046.68
4	ISSI ^注	-	-	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA	5,166.52
5	ICSI TW	088 汐建电字第 018441 号	工业用	新北市汐止区昊天段 00639-000 建号	585.38

注：根据北京矽成提供的相关文件资料及说明，ISSI 自有房屋为 ISSI 购买取得的位于美国的自有房屋，其未有记载相关物业信息的权属证书，下同。

②房屋租赁情况

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司的房屋租赁情况如下表所示：

序号	承租人	出租人	座落地址	租赁期限	租赁面积 (平方米)	租赁用途	房屋权属证书/证明文件
1	芯成半导体（上海）	张伟	南京市建邺区奥体大街 128 号奥体名座 B 座 1703 室	2017.11.16-2020.11.15	76.81	办公场所	宁房权证建转字第 517888 号
2	芯成半导体（上海）	上海华虹置业有限公司	上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 25 号地下室分机房	2018.03.01-2021.02.28	18.5	机房	沪房地浦字（2013）第 055639 号
3	矽恩微电子（厦门）	厦门软件产业投资发展有限公司	厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区#602	2019.06.01-2020.05.31	346.79	办公场所	厦国土房证第 00938701 号
4			厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 12F	2019.05.17-2020.05.16	1,512.38	办公场所	
5	芯成半导体（上海）	HUANG YUBIN	深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心 4 号楼 1809-1810	2019.06.18-2022.07.31	427.83	办公场所	粤（2018）深圳市不动产权第 0242442 号、粤（2018）深圳市不动产权第 0242437 号
6	北京矽成	北京亦庄移动硅谷有限公司 注	北京市经济开发区景园北街 2 号 52-1 幢 3 层	2019.07.11-2020.07.10	514	办公场所	X 京房权证开字第 009873 号
7	ISSI	Nor'wood Limited, Inc.,	2060 Briargate Parkway, Suite 315, Colorado Springs, CO	2019.05.01-2022.04.30	约 496.66	办公场所	--
8	ICSI TW	欣兴电子股份有限公司	新竹县竹东镇中兴路四段 669 号 5 楼	2018.07.16-2023.07.15	约 5,289.28	办公场所	建物登记第二类誊本
9	ISSI(Korea)	Sungdo Energy 株式会社	京畿道城南市盆唐区城南大路 69,709 号	2016.12.24-2020.12.24	88	办公场所	--
10	ISSI(Korea)	BigTech 株式会社	京畿道城南市盆唐区城南大路 69,710 号	2016.11.16-2020.11.15	约 714.22	办公场所	--
11	ISSI(Israel)	Diesel Gililot (1975) Assets Ltd	38 HaBarzel Street, Tel Aviv.	2007.07.26-2020.12.31	1,584	办公场所	--

注：根据北京矽成提供的租赁协议，该租赁房屋的所有权人为亦庄国投，北京亦庄移动硅谷有限公司享有使用权及租赁权。

北京矽成并不从事具体生产，上述租赁房屋的主要用途为办公场所，鉴于租赁房屋的租赁成本低、可替代性强、搬迁成本与难度较小等，北京矽成及其下属企业通常在相关租赁期限届满前，结合实际经营情况及需要、租赁成本等客观因素，选择续租或承租其他类似场所。北京矽成及其下属企业就租赁房屋的选择及

续租与否具有一定灵活性，相关租赁房屋到期后续期亦不存在可合理预见的重大法律障碍。

（2）土地所有权及使用权

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司拥有土地共计 5 宗（根据土地所处地域，可指土地使用权或土地所有权），具体情况如下：

序号	使用人	取得方式	相关证书编号	用途	土地座落	终止日期	面积（m ² ）
1	芯成半导体（上海）	出让	沪房地浦字（2014）第 055674 号	工业用地	锦绣东路 2777 弄 25 号全幢	2053.06.05	约 574 ^{注1}
2	芯成半导体（上海）	出让	苏工园国用（2013）第 71033 号	商务金融用地	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 1 幢 1703 室	2049.05.31	128.53
3	武汉群茂	出让	武新国用（商 2009）第 02135 号	工业用地	东湖新技术开发区关山大道 1 号 12 期光谷企业公馆 C3 栋 1-2 层 1、2 号	2052.05.04	264.52
4	ISSI ^{注2}	购买	-	-	1623 Buckeye Drive, Milpitas, CA	-	约 11,533.54
5	ICSI TW	买卖	107 汐电字第 021120 号	建筑用地	新北市汐止区昊天段 1086-0000 地号	无期限	约 49.86 ^{注3}

注 1：该等土地面积为相关公司拥有的自有房产所占土地的对应面积，其《房地产权证》记载面积为 114,382 平方米。

注 2：根据北京矽成提供的相关文件资料及说明，ISSI 自有土地为 ISSI 购买取得的位于美国的自有土地，其未有记载相关物业信息的权属证书。下同。同时，该土地曾作为向 Bank of the West 500 万美元借款的担保（已于 2018 年全部偿还）。

注 3：该等土地面积为相关公司拥有的自有房产所占土地的对应面积。

（3）商标

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司已注册的商标情况如下：

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
1	ISSI	pFusion	5672355	9（中国类号）	2019.08.28-2029.08.27
2	ISSI	ISSI	1625813	9（国际类号）	2010.12.04-2020.12.04
3	ISSI	pFusion	1281848	9（台湾类号）	2007.10.01-2027.09.30
4	ISSI	e Logic	1391763	9（台湾类号）	2010.01.01-2019.12.31
5	ISSI	e FLASH	1391764	9（台湾类号）	2010.01.01-2019.12.31
6	ISSI	e FLASH	1406742	35、42、45	2010.04.16-2020.04.15

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
				(台湾类号)	
7	ISSI	e Logic	1406743	35、42、45 (台湾类号)	2010.04.16-2020.04.15
8	ISSI Cayman	pFLASH	1268489	9 (台湾类号)	2007.07.01-2027.06.30
9	ISSI Cayman	pFusion	935521	9 (台湾类号)	2001.03.16-2021.03.15
10	Chingis(US)		4016287	35、40、42 (国际类号)	2011.08.23-2021.08.23
11	Chingis(US)	pFlash	3545257	9、42 (国际类号)	2008.12.09-2028.12.08
12	ICSI TW		941401	9 (台湾类号)	2001.05.16-2021.05.15
13	ICSI TW		729958	9 (台湾类号)	1996.10.01-2026.09.30
14	ICSI TW	矽成	723534	009 (台湾类号)	2016.08.01-2026.07.31
15	ICSI TW		1610484	9 (中国类号)	2011.07.28-2021.07.27
16	ISSI(Israel)	COPPERGATE	147449	9 (以色列类号)	2001.03.13-2022.03.13
17	芯成半导体 (上海)	芯成	11789281	9 (中国类号)	2014.05.07-2024.05.06
18	芯成半导体 (上海)	ISSI	11789282	9 (中国类号)	2014.05.07-2024.05.06
19	矽恩微电子 (厦门)		5771536	9 (中国类号)	2009.09.28-2029.09.27
20	矽恩微电子 (厦门)	矽恩微電子	5771537	9 (中国类号)	2009.09.28-2029.09.27

(4) 域名

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司取得的域名如下表所示：

序号	所有人	域名	注册/生效日期	到期日期
1	ISSI	issi.com	1998.09.18	2032.09.17

序号	所有人	域名	注册/生效日期	到期日期
2	ISSI	issi-test.com	2001.09.10	2028.09.10
3	ISSI	issiusa.com	1994.10.14	2028.10.13
4	ISSI	imsi-semi.com	2018.04.07	2029.04.07

（5）专利

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司已注册的专利情况如下：

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
1	ISSI	Utility	Ultra low power voltage translation circuitry and its application in a TTL-to-CMOS buffer	US6359470	2002.03.19	美国
2	ISSI	Utility	Memory device having automatic protocol detection	US6851014	2005.02.01	美国
3	ISSI	Utility	Associated content storage system	US6925524	2005.08.02	美国
4	ISSI	Utility	Prefix match search scheme	US6928430	2005.08.09	美国
5	ISSI	Utility	High speed sense amplifier for memory output	US6940315	2005.09.06	美国
6	ISSI	Utility	Non-volatile memory architecture to improve read performance	US7009880	2006.03.07	美国
7	ISSI	Utility	Nonvolatile memory solution using single-poly pFLASH technology	US7078761	2006.07.18	美国
8	ISSI	Utility	High-voltage pump switching circuit including ramp and discharge	US7394305	2008.07.01	美国
9	ISSI	Utility	Optical navigator sensor and optical navigator apparatus using the same	US7755029	2010.07.13	美国
10	ISSI	Utility	Gateway system with automatic dispatch mechanism and method thereof	US8018957	2011.09.13	美国
11	ISSI	Utility	Stacked capacitor for double-poly FLASH memory	US8329533	2012.12.11	美国
12	ISSI	Utility	Signal conversion control circuit for touch screen and method thereof	US8711107	2014.04.29	美国
13	ISSI	Utility	Glitch-free input transition detector	US8890575	2014.11.18	美国
14	ISSI	Utility	Auto-trimming of internally generated voltage level in an integrated circuit	US8929158	2015.01.06	美国
15	ISSI	Utility	Erase algorithm for FLASH memory	US9099192	2015.08.04	美国
16	ISSI	Utility	Auto low current programming method without verify	US9117549	2015.08.25	美国
17	ISSI	Utility	Memory device with multiple cell write for a single input-output in a single write cycle	US9177650	2015.11.03	美国
18	ISSI	Utility	Reference current generation in resistive memory device	US9202561	2015.12.01	美国
19	ISSI	Utility	Memory device implementing reduced ECC overhead	US9280418	2016.03.08	美国
20	ISSI	Utility	Reference current circuit with temperature coefficient correction	US9293215	2016.03.22	美国
21	ISSI	Utility	Glitch free input transition detector	US9319038	2016.04.19	美国
22	ISSI	Utility	Method for improving sensing margin of resistive memory	US9324426	2016.04.26	美国
23	ISSI	Utility	Erase algorithm for FLASH memory	US9336893	2016.05.10	美国
24	ISSI	Utility	FLASH memory device with sense-amplifier-bypassed trim data read	US9349472	2016.05.24	美国

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
25	ISSI	Utility	Resistive memory device implementing selective memory cell refresh	US9373393	2016.06.21	美国
26	ISSI	Utility	Resistive memory device implementing selective memory cell refresh	US9496030	2016.11.15	美国
27	ISSI	Utility	High speed sequential read method for FLASH memory	US9496046	2016.11.15	美国
28	ISSI	Utility	Controller area network node transceiver	US9502889	2016.11.22	美国
29	ISSI	Utility	Auto low current programming method without verify	US9514806	2016.12.06	美国
30	ISSI	Utility	DRAM error correction event notification	US9529667	2016.12.27	美国
31	ISSI	Utility	Touch key control and icon display apparatus	US9534762	2017.01.03	美国
32	ISSI	Utility	Low power high speed program method for multi-time programmable memory device	US9543016	2017.01.10	美国
33	ISSI	Utility	Low power high speed program method for multi-time programmable memory device	US9672923	2017.06.06	美国
34	ISSI	Utility	Audible noise reduction method for multiple LED channel systems	US9717123	2017.07.25	美国
35	ISSI	Utility	Calibration circuit for on-chip drive and on-die	US9780785	2017.10.03	美国
36	ISSI	Utility	Serial bus DRAM error correction event notification	US9880901	2018.01.30	美国
37	ISSI	Utility	Serial bus event notification in a memory device	US9904596	2018.02.27	美国
38	ISSI	Utility	Power supply transient reduction method for multiple LED channel systems	US9967932	2018.05.08	美国
39	ISSI	Utility	Clocked commands timing adjustments in synchronous semiconductor integrated circuits	US10068626	2018.09.04	美国
40	ISSI	Utility	Calibration circuit for on-chip drive and on-die termination	US10103731	2018.10.16	美国
41	ISSI	Utility	Memory device read training method	US10229743	2019.03.12	美国
42	ISSI	Utility	Clocked commands timing adjustments method in Synchronous semiconductor Integrated circuits	US10236042	2019.03.19	美国
43	ISSI	Utility	Single-ended sense amplifier with adjustable noise margin and power down control	US6297670	2001.10.02	美国
44	ISSI	Utility	Interpolating digital to ANALOG converter and TFT-LCD source driver using the same	US6326913	2001.12.04	美国
45	ISSI	Utility	Method and apparatus for interpolating a digital image	US6369787	2002.04.09	美国
46	ISSI	Utility	Image dithering device processing in both time domain and space domain	US6469708	2002.10.22	美国
47	ISSI	Utility	Method for automatically adjusting sampling phase of LCD control system	US6501452	2002.12.31	美国
48	ISSI	Utility	Method and apparatus for interpolating a digital image	US6577778	2003.06.10	美国
49	ISSI	Utility	Method for renewing program code in an embedded micro-controller unit	US6636992	2003.10.21	美国
50	ISSI	Utility	Apparatus and method for rotating on-screen display fonts	US6765577	2004.07.20	美国
51	ISSI	Utility	Clock multiplier	US6977536	2005.10.20	美国
52	ISSI	Utility	Single-ended high-voltage level shifter for a TFT-LCD gate driver	US6670939	2003.12.30	美国
53	ISSI	Utility	Secured chip enable with chip disable	US10331575	2019.06.25	美国

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
54	ISSI	发明	双多晶硅闪存的堆叠式电容器及其制造方法	ZL201110049659.2	2014.01.22	中国
55	ISSI	发明	光学导航传感器及其光学导航装置	ZL200810001070.3	2010.09.29	中国
56	ISSI	实用新型	数字测距装置	ZL200920218192.8	2010.11.03	中国
57	ISSI	实用新型	手持式工具机	ZL201420321585.2	2014.11.26	中国
58	ISSI	实用新型	具有图标显示及照明的触控按键装置	ZL201220413399.2	2013.03.27	中国
59	ISSI	发明	用于多发光二极管信道系统之电源瞬时或可听噪音降低方法	I657717	2019.04.21	台湾
60	ISSI	发明	非挥发性闪存的有效编程方法	I571880	2017.02.21	台湾
61	ISSI	发明	具有写入保护机制之非挥发性闪存运作方法	I436367	2014.05.01	台湾
62	ISSI	发明	双多晶硅闪存之堆栈式电容器	I408802	2013.09.11	台湾
63	ISSI	发明	一种控制电流的装置	I366086	2012.06.11	台湾
64	ISSI	发明	屏幕显示电路及其控制方法	I374666	2012.10.11	台湾
65	ISSI	发明	避免平面显示器之次画面显示失真的方法	I292893	2008.01.21	台湾
66	ISSI	发明	光学导航传感器及其光学导航装置	I426418	2014.02.11	台湾
67	ISSI	发明	单边感测放大器	I43651	2001.10.01	台湾
68	ISSI	发明	插补式数字模拟转换器及应用该转换器的 TFT-LCD 源极驱动器	I46588	2001.11.21	台湾
69	ISSI	发明	用于嵌入式微控制单元之更新程序代码方法	I74321	2003.02.21	台湾
70	ISSI	发明	手持式工具机	M491561	2014.12.11	台湾
71	ISSI	发明	应用于触摸屏之讯号转换控制电路及其方法	I363290	2012.05.01	台湾
72	ISSI	发明	控制器局域网络节点收发器	I578717	2017.04.11	台湾
73	ISSI	发明	数字测距装置	M378868	2010.04.21	台湾
74	ISSI	发明	触控按键及图标显示设备	M452383	2013.05.01	台湾
75	ISSI	发明	自动发送之网关系统及其自动发送讯息框之方法	I393392	2013.04.11	台湾
76	ISSI	发明	用于薄膜晶体管液晶显示设备之闸极驱动器的单端式高电压位移器	I58224	2002.06.21	台湾
77	ISSI	发明	数字影像显示器之影像画质调整装置与方法	I60544	2002.08.01	台湾
78	ISSI	发明	具图表统计功能之 LCD 影像控制系统	I42466	2001.09.21	台湾
79	ISSI	发明	结合时域与空域的影像扰动装置	I20007	2000.09.01	台湾
80	ISSI	发明	自动侦测 USB 及 PS/2 两用计算机键盘之装置及方法	I69654	2002.09.11	台湾
81	ISSI	发明	旋转屏幕显示 (OSD) 字型之装置及方法	I60098	2002.07.21	台湾
82	ISSI	发明	屏幕显示 (OSD) 之装置及方法	I60922	2002.08.01	台湾
83	ISSI	发明	外围内存连接线路之自我测试装置及其方法	I38941	2001.08.21	台湾

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
84	ISSI	发明	屏幕显示字型的旋转装置及方法及解码装置	1246100	2003.11.26	中国
85	ISSI	发明	屏幕显示的装置及方法	1246577	2004.12.29	中国
86	ISSI	发明	屏幕显示字型存取装置	31544436	2006.09.27	中国
87	ISSI	发明	用于嵌入式微控制单元的更新程序码方法	1246267	2004.06.16	中国
88	Chingis(US)	Utility	Redundant memory content substitution apparatus and method	US7193895	2007.03.20	美国
89	Chingis(US)	Utility	Nonvolatile memory solution using single-poly pFLASH technology	US7339229	2008.03.04	美国
90	Chingis(US)	Utility	Low Voltage Low Capacitance FLASH Memory Array	US7505325	2009.03.17	美国
91	Chingis(US)	-	The low voltage, the FLASH memory array of a low capacitance	5280660 ^{注1}	2013.05.31	日本
92	Chingis(US)	发明	微控制器虚拟记忆系统及方法	160095	2002.05.11	台湾
93	Chingis(US)	发明	低电压低电容闪存数组	1467584	2015.01.01	台湾
94	Chingis(US)	发明	使用单-多晶 P 快闪技术之非挥发性内存解决方案	I393256	2013.09.11	台湾
95	ISSI Cayman	发明	PMOS 存储单元及由其构成的 PMOS 存储单元阵列	ZL201010220014.6	2013.05.15	中国
96	ICSI TW	-	Method of booting a computer from any card of a multi-FLASH card reader	1560113 ^{注1}	2006.09.20	欧洲
97	芯成半导体（上海）	发明	地址转变检测电路	ZL201110153158.9	2015.03.11	中国
98	芯成半导体（上海）	发明	一种用于非易失性存储器的平衡对称式读出放大电路	ZL03116628.8	2009.07.29	中国
99	芯成半导体（上海）	发明	进入 ASRAM 芯片内部测试模式的电路	ZL201110158152.0	2015.04.01	中国
100	芯成半导体（上海）	发明	进入 ASRAM 芯片内部测试模式的方法	ZL201110158151.6	2015.03.11	中国
101	芯成半导体（上海）	发明	闪存的擦除方法、读取方法及编程方法	ZL201310473408.6	2016.08.17	中国
102	芯成半导体（上海）	发明	混合结构的存储器阵列及其制备方法	ZL201410284354.3	2016.09.07	中国
103	芯成半导体（上海）	发明	闪存单元的制备方法	ZL201710188414.5	2018.10.23	中国
104	芯成半导体（上海）	发明	闪存的操作方法	ZL201610634627.1	2019.06.28	中国
105	芯成半导体（上海）	发明	闪存及其读取方法	ZL201410398312.2	2017.09.29	中国
106	芯成半导体（上海）	发明	用于测试存储器件的电路和方法	ZL201310108760.X	2017.11.14	中国
107	芯成半导体（上海）	发明	用于芯片上驱动和管芯上端接的校准电路	ZL201611176689.9	2018.09.25	中国
108	芯成半导体（上海）	Utility	Circuit and Method for Testing a Memory Device	US9373417	2016.06.21	美国
109	芯成半导体（上海）	Utility	Circuit and Method for Controlling Internal Test Mode Entry of an Asram Chip	US9287008	2016.03.15	美国
110	芯成半导体（上海）	Utility	Address Transition Detecting Circuit	US9171609	2015.10.27	美国
111	芯成半导体（上海）	Utility	Methods for Erasing, Reading and Programming FLASH Memories	US9263141	2016.02.16	美国
112	芯成半导体（上海）	Utility	Method for operating FLASH memory	US10008267	2018.06.26	美国

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
113	芯成半导体（上海）	Utility	Method for forming FLASH memory unit	US10170597	2019.01.01	美国
114	矽恩微电子（厦门）	发明	一种连续图像播放 LED 显示屏驱动芯片	ZL201210003072.2	2014.07.30	中国
115	矽恩微电子（厦门）	发明	一种 SPRAM 全双工通信控制电路	ZL201210023020.1	2015.11.18	中国
116	矽恩微电子（厦门）	实用新型	一种消除 LED 阵列扫描残影的系统	ZL201120521901.7	2012.09.12	中国
117	矽恩微电子（厦门）	实用新型	一种 IC 参数校正电路	ZL201320688397.9	2014.06.18	中国
118	矽恩微电子（厦门）	发明	一种三维全彩 LED 自动呼吸驱动芯片	ZL201310112681.6	2018.01.26	中国
119	矽恩微电子（厦门）	实用新型	一种无静态功耗的芯片打线选择电路	ZL201320541004.1	2014.03.26	中国
120	矽恩微电子（厦门）	实用新型	无需环路补偿的高 PFC 恒流控制装置及电压变换器	ZL201320226998.8	2013.12.25	中国
121	矽恩微电子（厦门）	发明	一种无静态电流的上电复位信号产生电路	ZL201510335919.0	2018.03.09	中国
122	矽恩微电子（厦门）	发明	亮度线性变化自行调节的 LED 扫描阵列驱动芯片	ZL201510667324.5	2018.01.02	中国
123	矽恩微电子（厦门）	发明	一种汽车阅读灯 LED 驱动芯片	ZL201610019908.6	2017.10.20	中国
124	矽恩微电子（厦门）	发明	应用电荷泵的高压 LDO	ZL201510473212.6	2017.03.29	中国
125	矽恩微电子（厦门）	发明	一种汽车阅读灯的 LED 驱动芯片状态控制方法	ZL201610020904.X	2017.11.03	中国
126	矽恩微电子（厦门）	发明	基于 BCD 工艺的电流感测电路	ZL201510077312.7	2017.06.27	中国
127	矽恩微电子（厦门）	发明	一种实时时钟计时误差补偿方法	ZL201310536937.6	2018.10.23	中国
128	矽恩微电子（厦门）	发明	一种 IC 参数校正电路	ZL201310536913.0	2019.03.15	中国
129	矽恩微电子（厦门）	发明	一种无静态功耗的芯片打线选择电路	ZL201310391755.4	2019.02.15	中国
130	矽恩微电子（厦门）	Utility	Current clamp circuit based on BCD technology	US9755427	2017.09.05	美国
131	矽恩微电子（厦门）	Utility	LED scanning array driver chip and regulation method capable of self-regulating brightness linear change	US9736901	2017.08.15	美国
132	矽恩微电子（厦门）	Utility	Control device for use with switching converters	US9276459	2016.03.01	美国
133	矽恩微电子（厦门）	Utility	Method for compensating timing errors of real-time clocks	US9304498	2016.04.05	美国
134	矽恩微电子（厦门）	Utility	LED driver chip for car reading light and state control method thereof	US9815403	2017.11.14	美国
135	ISSI(Israel)	-	Multipoint digital subscriber lines with home data network ability	136782	2007.02.11	以色列
136	ISSI(Israel)	-	Digital subscriber communication system	136781	2008.11.03	以色列
137	ISSI(Israel)	-	Method and apparatus for transmission of voice and data over subscriber line	135794	2004.07.25	以色列
138	ISSI(Israel)	-	Method and system for communication spectral backward compatibility	153968	2009.06.15	以色列
139	ISSI(Israel)	-	Method and system for communication spectral backward compatibility	193578	2009.06.15	以色列
140	ISSI(Israel)	-	Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks	155098	2009.08.03	以色列

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
141	ISSI(Israel)	-	Collision avoidance media access method for shared networks	177415	2015.05.31	以色列
142	ISSI(Israel)	-	High-frequency homepna	179470	2011.07.31	以色列
143	ISSI(Israel)	-	Shared medium ca/csma robustness	181963	2011.10.31	以色列
144	ISSI(Israel)	-	Method of reducing near-end crosstalk in an mxu networking architecture	167973	2010.10.31	以色列
145	ISSI(Israel)	-	ANALOG hpna hub and network including ANALOG hpna hub	206706	2011.06.30	以色列
146	ISSI(Israel)	-	ANALOG hpna hub and network including ANALOG hpna hub	169189	2011.11.30	以色列
147	ISSI(Israel)	-	ANALOG hpna hub and network including anaolg hpna hub	206705	2012.04.30	以色列
148	ISSI(Israel)	-	Contention slots in a shared robust scheme	205408	2014.03.31	以色列
149	ISSI(Israel)	-	Maximal resource utilization in networks	169580	2012.03.29	以色列
150	ISSI(Israel)	Utility	Communication systems conveying voice and data signals over standard telephone lines	US7031394	2006.04.18	美国
151	ISSI(Israel)	Utility	Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks	US7724764	2010.05.25	美国
152	ISSI(Israel)	Utility	Adaptive synchronous media access protocol for shared media networks	US7944939	2011.05.17	美国
153	ISSI(Israel)	Utility	Multipoint digital subscriber lines with home data network ability	US6985520	2006.01.10	美国
154	ISSI(Israel)	Utility	Digital subscriber line communication system	US7873976	2011.01.18	美国
155	ISSI(Israel)	Utility	HPNA hub	US7693189	2010.04.06	美国
156	ISSI(Israel)	Utility	Method of reducing near-end crosstalk in an MxU networking architecture	US6999433	2006.02.14	美国
157	ISSI(Israel), Sharp Corporation, Qualcomm	Utility	Communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics	US7729372	2010.06.01	美国
158	ISSI(Israel), Sharp Corporation, Qualcomm	Utility	Managing contention-free time allocations in a network	US7822059	2010.10.26	美国
159	ISSI(Israel), Sharp Corporation, Qualcomm	Utility	Time synchronization in a network	US7558294	2009.07.07	美国
160	ISSI(Israel), Sharp Corporation, Qualcomm	Utility	Time synchronization in a network	US7894487	2011.02.22	美国
161	ISSI(Israel), Sharp, Qualcomm Atheros	Utility	Bandwidth management in a powerline network	US8737420	2014.05.27	美国
162	ISSI(Israel), Sharp, Qualcomm Atheros	Utility	Flexible scheduling of resources in a noisy environment	US8553706	2013.10.08	美国
163	ISSI(Israel)	Utility	Collision avoidance media access method for shared networks	US9413550	2016.08.09	美国
164	ISSI(Israel)	Utility	Hybrid telephone, non-telephone network	US7408949	2008.08.05	美国
165	ISSI(Israel)	Utility	Multiple input, multiple output (MIMO) communication system over in-premises wires	US8571124	2013.10.29	美国
166	ISSI(Israel)	Utility	Pairing PLC devices	US8552844	2013.10.08	美国

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
167	ISSI(Israel)	Utility	Pairing PLC devices	US8816831	2014.08.26	美国
168	ISSI(Israel)	Utility	Transmission scheme for multiple-input communication	US9020056	2015.04.28	美国
169	ISSI(Israel)	Utility	Home network domain master	US8676982	2014.03.18	美国
170	ISSI(Israel)	Utility	Network-specific powerline transmissions	US8837268	2014.09.16	美国
171	ISSI(Israel)	Utility	Enhanced power supply unit for powerline networks	US8823499	2014.09.02	美国
172	ISSI(Israel)	Utility	Routing and topology management	US8644135	2014.02.04	美国
173	ISSI(Israel)	Utility	Method and system for communication backward compatibility	US7324586	2008.01.29	美国
174	ISSI(Israel)	Utility	Method and system for communication spectral backward compatibility	US7251287	2007.07.31	美国
175	ISSI(Israel)	Utility	Method and system for communication spectral backward compatibility	US7394868	2008.07.01	美国
176	ISSI(Israel)	Utility	Maximal resource utilization in networks	US7822060	2010.10.26	美国
177	ISSI(Israel)	Utility	High-frequency HomePNA	US7551693	2009.06.23	美国
178	ISSI(Israel)	Utility	High-frequency HomePNA	US7974332	2011.07.05	美国
179	ISSI(Israel)	Utility	Shared medium CA/CSMA robustness	US7545796	2009.06.09	美国
180	ISSI(Israel)	Utility	Frame structure for OFDM signaling including beacons and traffic	US7830907	2010.11.09	美国
181	ISSI(Israel)	Utility	Current position transmission in a shared robust scheme	US8155107	2012.04.10	美国
182	ISSI(Israel)	Utility	Multi-network type coordinator for a single physical layer	US8301760	2012.10.30	美国
183	ISSI(Israel)	Utility	Multi-network type coordinator for a single physical layer	US8934370	2015.01.13	美国
184	ISSI(Israel)	Utility	Dual mode map messages in G.HN	US8335228 ^{注2}	2012.12.18	美国
185	ISSI(Israel)	Utility	Allocation adjustment in network domains	US9094232	2015.07.28	美国
186	ISSI(Israel), Alvarion, Alvarion Technologies	Utility	System for coupling a power line communication device to a power line network	US8816832	2014.08.26	美国
187	ISSI(Israel)	Utility	Relaying of multicast transmissions	US8750300	2014.06.10	美国
188	ISSI(Israel)	Utility	Source adaptive digital subscriber line and method	US6763097	2004.07.13	美国
189	ISSI(Israel)	Utility	MAC structure with packet-quasi-static blocks and ARQ	US8644341	2014.02.04	美国
190	ISSI(Israel)	Utility	After transmission return signal	US8559365	2013.10.15	美国
191	ISSI(Israel)	Utility	Null indication in a shared robust scheme	US8040871	2011.10.18	美国
192	ISSI(Israel)	Utility	Contention slots in a shared robust scheme	US8018965	2011.09.13	美国
193	ISSI(Israel)	Utility	High-performance zero-crossing detector	US8884656	2014.11.11	美国
194	ISSI(Israel)	Utility	Zero crossing indicator device	US9787360	2017.10.10	美国
195	ISSI(Israel)	Utility	Power line communications method and apparatus	US9191067	2015.11.17	美国
196	ISSI(Israel)	Utility	Power line communications method and apparatus	US8952567	2015.02.10	美国

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
197	ISSI(Israel)	Utility	Power line communications method and apparatus	US8879644	2014.11.04	美国
198	ISSI(Israel)	Utility	Power line communication method and apparatus	US9479221	2016.10.25	美国
199	ISSI(Israel)	Utility	Power line communication method and apparatus	US9143198	2015.09.22	美国
200	ISSI(Israel)	-	Bandbreitenverwaltung in einem powerline-netz	602006050860.3 ^{注1}	2016.11.09	欧洲
201	ISSI(Israel)	-	Kommunikationsplan und netzinformationen in einem powerline-netz	602006051167.1 ^{注1}	2016.12.07	欧洲
202	ISSI(Israel)	-	Stromleitungskommunikationsverfahren und -vorrichtungen	602010009934.2 ^{注1}	2013.08.28	欧洲
203	ISSI(Israel)	-	Stromleitungs-Kommunikationsvorrichtung und Stromleitungs-Kommunikationsverfahren	602010035913.1 ^{注1}	2016.08.24	欧洲
204	ISSI(Israel)	-	Netzwerkspezifische stromleitungsübertragungen	602010036813.0 ^{注1}	2016.09.28	欧洲
205	ISSI(Israel)	-	Enhanced power supply unit for powerline networks	2510608 ^{注1}	2016.03.02	欧洲
206	ISSI(Israel)	-	Power line communication method and apparatus	2453583 ^{注1}	2016.08.24	欧洲
207	ISSI(Israel)	-	Network-specific powerline transmissions	2441270 ^{注1}	2016.09.28	欧洲
208	ISSI(Israel)	-	Zero-crossing detection circuit and method for zero-crossing detection	2728751 ^{注1}	2015.07.22	欧洲
209	ISSI(Israel)	-	Power line communication method and apparatus	2453584 ^{注1}	2013.08.28	欧洲
210	ISSI(Israel)	-	Collision avoidance media access method for shared networks	1922843 ^{注1}	2014.12.03	欧洲
211	ISSI(Israel)	-	Bandwidth management in a powerline network	1908189 ^{注1}	2016.11.09	欧洲
212	ISSI(Israel)	-	Communicating schedule and network information in a powerline network	1908223 ^{注1}	2016.12.07	欧洲
213	ISSI(Israel)	-	Flexible scheduling of resources in a noisy environment	1908222 ^{注1}	2016.02.03	欧洲
214	ISSI(Israel)	-	Contention slots in a shared robust scheme	2213055 ^{注1}	2015.02.25	欧洲
215	ISSI(Israel) Alvarion Ltd	-	System for coupling a power line communication device to a power line network	2676376 ^{注1}	2015.04.29	欧洲
216	ISSI(Israel) Qualcomm Atheros, Inc. SHARP Corporation	-	Netzleitungsübertragungssystem	602006053604.6 ^{注1}	2017.09.13	欧洲
217	ISSI(Israel) Qualcomm Atheros, Inc. Sharp KK	-	Managing contention-free time allocations in a network	1913734 ^{注1}	2018.06.27	欧洲
218	ISSI(Israel) Qualcomm Atheros, Inc. Sharp KK	-	Power line communication system	1748574 ^{注1}	2017.09.13	欧洲
219	ISSI(Israel)	-	Transmission of the schedule in a power line network, and network information	5106394 ^{注1}	2012.10.12	日本
220	ISSI(Israel)	-	The competition slot in the access control system of a sharing medium	5346947 ^{注1}	2013.08.23	日本
221	ISSI(Israel) Sharp Corporation Qualcomm Atheros, Inc.	-	Management of the uncompleted time allocation in a network	5068262 ^{注1}	2012.08.24	日本

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号	授予日期	授予国家/地区
222	ISSI(Israel) Sharp Corporation Qualcomm Atheros, Inc.	-	Communication in the network containing the medium which has the variable transmitting characteristic	4920332 ^{注1}	2012.02.10	日本
223	ISSI(Israel) Sharp Kabushiki Kaisha Qualcomm Atheros, Inc.	-	Communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics	10-1247529-0000	2013.03.20	韩国
224	ISSI(Israel)	-	Contention slots in a shared robust scheme	10-1434341-0000	2014.08.20	韩国
225	ISSI(Israel)	-	Communicating schedule and network information in a powerline network	10-1247294-0000	2013.03.19	韩国
226	ISSI(Israel)	-	Bandwidth management in a powerline network	10-1269036-0000	2013.05.23	韩国
227	ISSI(Israel)	-	Collision avoidance media access method for shared networks	10-1236294-0000	2013.02.18	韩国
228	ISSI(Israel)	发明	在电力线网络中对调度表和网络信息进行通信的方法和设备	ZL200680035606.2	2014.05.07	中国
229	ISSI(Israel)	发明	电力线网络中的传输协调方法和设备	ZL201310278303.5	2016.04.27	中国
230	ISSI(Israel)	发明	在共享健壮的方案中争用时段	ZL200880118975.7	2013.08.14	中国
231	ISSI(Israel)	发明	基于户内线缆的多输入多输出(MIMO)通信系统	ZL200880022899.X	2014.05.07	中国
232	ISSI(Israel)	发明	用于共享的网络的碰撞避免介质访问方法	ZL200680032731.8	2013.05.22	中国
233	ISSI(Israel)	发明	用于在电力线网络中协调一个或者多个设备传输的方法及设备	CN200680035555.3	2013.01.02	中国
234	ISSI(Israel) Sharp Corporation, Qualcomm Atheros, Inc.	Utility	Communicating in a network that includes a medium having varying transmission characteristics	US8089901	2012.01.03	美国
235	ISSI(Israel) Sharp Laboratories of America, Inc., Qualcomm Atheros, Inc.	Utility	Synchronizing channel sharing with neighboring networks	US7856008	2010.12.21	美国
236	ISSI(Israel) Sharp	Utility	Systems and methods for network channel allocation	US8050184 ^{注3}	2011.11.01	美国
237	ISSI(Israel) Sharp	Utility	Systems and methods for network channel characteristic measurement and network management	US8213301 ^{注3}	2012.07.03	美国
238	ISSI(Israel) Sharp	Utility	Systems and methods for dynamic network channel modification	US8300540 ^{注3}	2012.10.30	美国
239	夏普株式会社；因特隆公司；科内克森特系统公司[注4]	发明	在网络中管理无争用时间分配的方法和系统	ZL200680035280.3	2012.09.05	中国
240	夏普株式会社；因特隆公司；科内克森特系统公司[注4]	发明	在包括具有变化传输特性的介质的网络中进行通信	ZL200610107587.1	2012.05.23	中国

注1：该等专利信息仅根据北京矽成提供的相关文件资料及欧洲、日本相关专利登记公示机构官方网站公示信息披露。

注2：根据境外律师意见，于该等专利审查期间，Erez Ben Tovim 被加入作为共同发明人，作为共同发明人 Erez Ben Tovim 并未就该等发明成果专利由 ISSI(Israel)享有签署任何协议。根据美国专利相关法律的规定，Erez Ben Tovim 可能被认定为该等专利的共同所有人。

注3：根据境外律师意见，该等专利由科内克森特系统公司（Conexant Systems Inc.）转让予 ISSI(Israel)，截至本报告书出具日，因相关文件缺失，无法确认该等专利发明人是否已就该

等发明成果专利由 Conexant Systems Inc. 公司享有签署相关协议。根据美国专利相关法律的规定，该等专利发明人可能被认定为共同所有人，Conexant Systems Inc. 亦可能无法单方将该等转让予 ISSI (Israel)。

注 4：根据北京矽成提供的相关文件资料及说明，该等专利由科内克森特系统公司转让予 ISSI (Israel)，截至本报告书出具日，该等专利尚未办理权利人变更相关程序。

（6）集成电路布图设计

截至本报告书出具日，北京矽成及其子公司拥有的集成电路布图设计具体情况如下：

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
1	北京矽成	BS.185548571	fmd087	2018.02.11	--	2016.05.25	自登记申请日起 10 年
2	北京矽成	BS.185548601	Fmd127	2018.02.11	--	2015.10.23	自登记申请日起 10 年
3	北京矽成	BS.18554861X	Fmd167	2018.02.11	--	2016.08.10	自登记申请日起 10 年
4	北京矽成	BS.185548628	Fmd647	2018.02.11	--	2016.01.26	自登记申请日起 10 年
5	北京矽成	BS.185548636	fmk087	2018.02.11	--	2015.11.04	自登记申请日起 10 年
6	北京矽成	BS.185548644	fmk127	2018.02.11	--	2016.09.23	自登记申请日起 10 年
7	北京矽成	BS.185548652	fmk167	2018.02.11	--	2016.07.05	自登记申请日起 10 年
8	北京矽成	BS.185548660	fmk257	2018.02.11	--	2015.11.17	自登记申请日起 10 年
9	北京矽成	BS.185548679	fmk327	2018.02.11	--	2016.07.14	自登记申请日起 10 年
10	北京矽成	BS.185548687	fmk647	2018.02.11	--	2017.07.11	自登记申请日起 10 年
11	北京矽成	BS.185547702	SRAM-8137	2018.02.02	--	2015.01.05	自登记申请日起 10 年
12	北京矽成	BS.185547729	SRAM-8142	2018.02.02	--	2015.05.27	自登记申请日起 10 年
13	北京矽成	BS.185547737	SRAM-8143	2018.02.02	--	2015.06.08	自登记申请日起 10 年
14	北京矽成	BS.185547745	SRAM-8149	2018.02.02	--	2015.12.08	自登记申请日起 10 年
15	北京矽成	BS.185547753	SRAM-8152	2018.02.02	--	2015.04.24	自登记申请日起 10 年
16	北京矽成	BS.185547761	SRAM-8153	2018.02.02	--	2015.02.03	自登记申请日起 10 年
17	北京矽成	BS.185547672	SRAM-8156	2018.02.02	--	2016.09.14	自登记申请日起 10 年
18	北京矽成	BS.185547680	SRAM-8157	2018.02.02	--	2016.08.22	自登记申请日起 10 年

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
19	北京矽成	BS.185547699	SRAM-8158	2018.02.02	--	2016.05.13	自登记申请日起 10 年
20	北京矽成	BS.185547710	SRAM-8160	2018.02.02	--	2017.01.27	自登记申请日起 10 年
21	矽恩微电子（厦门）	BS.11500103.4	MS18A	2011.03.11	2009.10.21	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
22	矽恩微电子（厦门）	BS.11500102.6	AU06A	2011.03.11	2009.08.28	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
23	矽恩微电子（厦门）	BS.11500101.8	PM01	2011.02.25	2009.10.30	2008.11.30	自首次投入商业利用日起 10 年
24	矽恩微电子（厦门）	BS.11500100.X	MS13	2011.02.25	2009.10.30	2008.10.31	自首次投入商业利用日起 10 年
25	矽恩微电子（厦门）	BS.11500099.2	AU26	2011.02.25	2009.09.25	2007.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
26	矽恩微电子（厦门）	BS.11500098.4	PM04	2011.02.25	2010.12.14	2010.04.11	自首次投入商业利用日起 10 年
27	矽恩微电子（厦门）	BS.11500097.6	MS19	2011.02.25	2010.10.28	2010.06.11	自首次投入商业利用日起 10 年
28	矽恩微电子（厦门）	BS.11500096.8	MS31	2011.02.25	2010.10.28	2010.07.30	自首次投入商业利用日起 10 年
29	矽恩微电子（厦门）	BS.11500095.X	AU22	2011.02.25	2010.07.28	2010.06.01	自首次投入商业利用日起 10 年
30	矽恩微电子（厦门）	BS.11500094.1	MS11	2011.02.25	2009.12.15	2008.12.01	自首次投入商业利用日起 10 年
31	矽恩微电子（厦门）	BS.11500093.3	TH04	2011.02.25	2009.11.26	2009.10.01	自首次投入商业利用日起 10 年
32	矽恩微电子（厦门）	BS.11500092.5	DX01	2011.02.25	2009.11.26	2008.12.31	自首次投入商业利用日起 10 年
33	矽恩微电子（厦门）	BS.11500091.7	AU11	2011.02.25	2010.09.13	2008.06.01	自首次投入商业利用日起 10 年
34	矽恩微电子（厦门）	BS.11500090.9	AU29	2011.02.25	2010.09.13	2010.01.04	自首次投入商业利用日起 10 年

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
35	矽恩微电子（厦门）	BS.11500089.5	MS23	2011.02.25	2010.07.28	2009.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
36	矽恩微电子（厦门）	BS.11500088.7	MS21	2011.02.25	2010.07.28	2010.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
37	矽恩微电子（厦门）	BS.11500033.X	AU30	2011.02.25	2010.09.13	2010.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
38	矽恩微电子（厦门）	BS.11500701.6	AU28	2011.07.12	--	2010.01.31	自登记申请日起 10 年
39	矽恩微电子（厦门）	BS.11500700.8	DX02	2011.07.12	2011.04.30	2010.08.30	自首次投入商业利用日起 10 年
40	矽恩微电子（厦门）	BS.11500699.0	MS38	2011.07.12	2011.07.15	2010.12.01	自登记申请日起 10 年
41	矽恩微电子（厦门）	BS.11500698.2	MS35	2011.07.12	2011.07.01	2010.07.31	自首次投入商业利用日起 10 年
42	矽恩微电子（厦门）	BS.11500697.4	MS26	2011.07.12	2011.06.26	2010.11.01	自首次投入商业利用日起 10 年
43	矽恩微电子（厦门）	BS.11500696.6	AU31	2011.07.12	2011.05.30	2010.10.31	自首次投入商业利用日起 10 年
44	矽恩微电子（厦门）	BS.11500695.8	AU20	2011.07.12	2011.05.21	2010.07.01	自首次投入商业利用日起 10 年
45	矽恩微电子（厦门）	BS.11500694.X	AU17	2011.07.12	--	2010.06.01	自登记申请日起 10 年
46	矽恩微电子（厦门）	BS.11500934.5	MS16	2011.09.16	2011.08.25	2010.02.01	自首次投入商业利用日起 10 年
47	矽恩微电子（厦门）	BS.11500935.3	Ms21B	2011.09.16	2011.08.01	2010.09.30	自首次投入商业利用日起 10 年
48	矽恩微电子（厦门）	BS.11500933.7	MS12	2011.09.16	2011.08.10	2010.03.01	自首次投入商业利用日起 10 年
49	矽恩微电子（厦门）	BS.12500344.7	AU43A	2012.03.16	2012.02.05	2011.12.01	自首次投入商业利用日起 10 年
50	矽恩微电子（厦门）	BS.12500343.9	AU33	2012.03.16	2012.03.01	2011.09.01	自首次投入商业利用日起 10 年
51	矽恩微电子（厦门）	BS.12500342.0	MS53A	2012.03.16	2012.02.15	2011.12.01	自首次投入商业利用日起 10 年

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
52	矽恩微电子（厦门）	BS.12500341.2	MS41	2012.03.16	2012.02.21	2010.11.01	自首次投入商业利用日起 10 年
53	矽恩微电子（厦门）	BS.12500340.4	AU41A	2012.03.16	2012.02.15	2011.11.01	自首次投入商业利用日起 10 年
54	矽恩微电子（厦门）	BS.12500339.0	AU38A	2012.03.16	2012.02.20	2011.06.01	自首次投入商业利用日起 10 年
55	矽恩微电子（厦门）	BS.12500338.2	MS11B	2012.03.16	2012.03.01	2012.03.01	自首次投入商业利用日起 10 年
56	矽恩微电子（厦门）	BS.12500337.4	MS36	2012.03.16	2012.02.10	2011.12.01	自首次投入商业利用日起 10 年
57	矽恩微电子（厦门）	BS.13500280.X	MS59A	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请日起 10 年
58	矽恩微电子（厦门）	BS.13500277.X	MS45A	2013.04.08	--	2011.07.01	自登记申请日起 10 年
59	矽恩微电子（厦门）	BS.13500278.8	MS49A	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请日起 10 年
60	矽恩微电子（厦门）	BS.13500279.6	PM07	2013.04.08	--	2012.12.01	自登记申请日起 10 年
61	矽恩微电子（厦门）	BS.145501191	MS55A	2014.05.30	--	2013.06.30	自登记申请日起 10 年
62	矽恩微电子（厦门）	BS.145501183	MS51	2014.05.30	--	2013.07.31	自登记申请日起 10 年
63	矽恩微电子（厦门）	BS.145501175	MS47	2014.05.30	--	2013.05.31	自登记申请日起 10 年
64	矽恩微电子（厦门）	BS.145501167	PM09A	2014.05.30	--	2013.06.30	自登记申请日起 10 年
65	矽恩微电子（厦门）	BS.155504592	AU33C	2015.04.16	--	2013.03.31	自登记申请日起 10 年
66	矽恩微电子（厦门）	BS.155504614	MS48B	2015.04.16	--	2014.07.31	自登记申请日起 10 年
67	矽恩微电子（厦门）	BS.155504630	AU53	2015.04.16	--	2013.12.31	自登记申请日起 10 年
68	矽恩微电子（厦门）	BS.155504649	MS70A	2015.04.16	--	2014.03.31	自登记申请日起 10 年
69	矽恩微电子（厦门）	BS.155504606	MS63A	2015.04.16	--	2013.10.31	自登记申请日起 10 年
70	矽恩微电子（厦门）	BS.155504622	MS64	2015.04.16	--	2013.05.31	自登记申请日起 10 年
71	矽恩微电子（厦门）	BS.165511486	AU52	2016.03.22	--	2015.03.15	自登记申请日起 10 年
72	矽恩微电子（厦门）	BS.165511532	PM11	2016.03.22	--	2014.03.31	自登记申请日起 10 年

序号	权利人	登记号	布图设计名称	登记申请日	首次投入商业利用日	创作完成日	专有权保护期
73	矽恩微电子（厦门）	BS.165511540	PM16	2016.03.22	--	2015.01.31	自登记申请日起 10 年
74	矽恩微电子（厦门）	BS.165511494	MS61	2016.03.22	--	2014.12.31	自登记申请日起 10 年
75	矽恩微电子（厦门）	BS.165511524	MS67	2016.03.22	--	2015.01.31	自登记申请日起 10 年
76	矽恩微电子（厦门）	BS.165511516	MS73	2016.03.22	--	2015.06.10	自登记申请日起 10 年
77	矽恩微电子（厦门）	BS.165511508	MS87	2016.03.22	--	2015.12.31	自登记申请日起 10 年
78	矽恩微电子（厦门）	BS.175530165	MS42	2017.08.03	--	2016.12.30	自登记申请日起 10 年
79	矽恩微电子（厦门）	BS.175530157	AU56	2017.08.03	--	2016.12.30	自登记申请日起 10 年
80	矽恩微电子（厦门）	BS.175530173	MS71	2017.08.03	--	2016.12.30	自登记申请日起 10 年
81	矽恩微电子（厦门）	BS.175530181	MS88	2017.08.03	--	2016.12.30	自登记申请日起 10 年
82	矽恩微电子（厦门）	BS.17553019X	MS95	2017.08.03	--	2016.12.30	自登记申请日起 10 年
83	矽恩微电子（厦门）	BS.175535736	AU50	2017.10.30	--	2012.12.31	自登记申请日起 10 年
84	矽恩微电子（厦门）	BS.175535744	PM13	2017.10.30	--	2013.12.31	自登记申请日起 10 年
85	矽恩微电子（厦门）	BS.175535752	PM08	2017.10.30	--	2011.12.30	自登记申请日起 10 年
86	矽恩微电子（厦门）	BS.175535779	MS36B	2017.10.30	--	2011.12.30	自登记申请日起 10 年
87	矽恩微电子（厦门）	BS.175535787	MS57A	2017.10.30	--	2012.12.31	自登记申请日起 10 年
88	矽恩微电子（厦门）	BS.175535795	MS60A	2017.10.30	--	2013.12.31	自登记申请日起 10 年
89	矽恩微电子（厦门）	BS.175535809	MS62A	2017.10.30	--	2012.12.31	自登记申请日起 10 年
90	矽恩微电子（厦门）	BS.175535760	MS18C	2017.10.30	--	2012.12.31	自登记申请日起 10 年

2、主要负债情况

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成合并口径负债总额 75,274.63 万元，其中流动负债 59,491.04 万元，非流动负债 15,783.58 万元，具体如下表：

单位：万元

项目	2019.5.31
应付账款	43,325.17
预收款项	3,091.57

应付职工薪酬	8,997.67
应交税费	1,613.20
其他应付款	2,419.05
其他流动负债	44.37
流动负债合计	59,491.04
长期应付款	2.18
长期应付职工薪酬	3,559.48
预计负债	5,374.34
递延所得税负债	6,847.58
非流动负债合计	15,783.58
负债合计	75,274.63

北京矽成的具体负债情况请参见“第九章 管理层讨论与分析”之“三、北京矽成的财务分析”。

3、权利限制情况

根据《北京矽成企业基础信用报告》与《股权出质设立登记通知书（（京经）股质登记设字[2019]第 00000686 号）》，华创芯原于 2019 年 2 月将所持北京矽成股权（对应股权数额为 5,758.332036 万元）出质给亦庄国投。

（1）华创芯原持有北京矽成股权的质押情况及并购贷款偿还安排

①华创芯原持有北京矽成股权的质押情况

根据华创芯原提供的质押登记凭证等文件资料及书面说明，华创芯原持有的北京矽成 11.08% 股权质押予亦庄国投，系作为私有化收购项下，亦庄国投为华创芯原并购贷款提供连带责任保证而提供的反担保措施。

②华创芯原并购贷款偿还安排

A. 华创芯原并购贷款偿还约定

根据华创芯原与中国工商银行股份有限公司作为牵头行的银团签署的《美国 ISSI 半导体公司并购项目银团贷款协议》，华创芯原共获得银行贷款 4.80 亿元，其贷款偿付安排如下：

期次	还款日	还款额（表示为占首个还款日时的贷款余额的百分比）

期次	还款日	还款额（表示为占首个还款日时的贷款余额的百分比）
1	自提款日（即 2015 年 11 月 30 日，下同）起第 30 个月届满之日	15%
2	自提款日起第 36 个月届满之日	15%
3	自提款日起第 42 个月届满之日	15%
4	自提款日起第 48 个月届满之日	15%
5	自提款日起第 54 个月届满之日	15%
6	自提款日起第 60 个月届满之日	25%

截至本报告书出具日，华创芯原的并购贷款余额 2.64 亿元，未来偿付安排原则如下：

期次	还款日	还款额
1	2019 年 11 月 30 日	0.72 亿元
2	2020 年 5 月 31 日	0.72 亿元
3	2020 年 11 月 30 日	1.20 亿元
合计		2.64 亿元

B. 华创芯原现金对价支付安排

根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，北京君正向华创芯原支付现金对价共计 2.80 亿元，相关支付时点及安排如下：于 2019 年 10 月 31 日前（含）支付第一笔现金对价 0.80 亿元，于 2020 年 4 月 30 日前（含）支付第二笔现金对价 1.00 亿元，于 2020 年 10 月 31 日前（含）支付第三笔现金对价 1.00 亿元。同时，本次配套融资项下募集资金到账之日起 30 个工作日内，北京君正应向华创芯原支付届时尚未支付的全部现金对价。

根据华创芯原的说明，上述现金对价主要用以清偿前述并购贷款，相关支付时点及安排是考虑并匹配并购贷款的还款计划及时点要求。

（2）华创芯原所持北京矽成股权的补充质押安排或其他增信措施

① 华创芯原同意解除质押的相关承诺

根据华创芯原于 2019 年 7 月出具《关于标的股权质押事宜的声明与承诺》：“就华创芯原所持标的公司股权质押事项，华创芯原将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。”

②华创芯原就后续补充质押和其他增信措施的相关安排

根据华创芯原和亦庄国投的书面确认，亦庄国投同意在本次交易交割前配合华创芯原办理完成北京矽成股权解除质押相关手续。本次交易实施完毕至华创芯原清偿并购贷款前，华创芯原拟将本次交易项下取得的北京君正相应股份质押予亦庄国投，继续为并购贷款项下的担保事项提供反担保。除上述安排外，本次交易完成后，华创芯原不存在其他与私有化收购并购贷款相关的补充质押安排和增信措施，不存在对北京矽成股权或资产转让等方面的限制性条款，不会对北京君正生产经营、对外融资、获取商业机会等产生重大不利影响。

③华创芯原将北京君正股份质押予亦庄国投不致其逃废补偿义务

华创芯原作为本次交易的业绩承诺方，于 2019 年 9 月出具《关于股份质押的声明及承诺函》，“将以股份、现金或股份与现金相结合的方式进行履行业绩补偿义务；若选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，本承诺人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺。本承诺人保证，不通过质押股份等方式逃废补偿义务，未来在业绩承诺期内质押对价股份时，将书面告知质权人根据《盈利补偿协议》及其补充协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”

根据亦庄国投的书面确认，“1. 本公司已知悉，华创芯原拟将本次交易项下获得的北京君正股份质押予本公司，且该等股份未来可能被用于《盈利补偿协议》及其补充协议项下的业绩承诺补偿；2. 本公司确认，于华创芯原偿还完毕全部并购贷款之日起 10 个工作日内，本公司将配合华创芯原解除北京君正的股份质押登记；如在华创芯原清偿全部并购贷款前，北京君正董事会审议通过本次交易的业绩补偿方案，且华创芯原质押予本公司的北京君正股份需用于业绩承诺补偿，则本公司将配合华创芯原解除相应股份质押登记，以便该等股份能及时用于业绩补偿。”

根据《盈利补偿协议》及其补充协议，业绩补偿（如有）将发生在业绩承诺期届满后，即相关业绩承诺方履行业绩补偿义务（如有）预计在 2022 年。根据华创芯原的前述还款计划，其预计于 2020 年 11 月 30 日清偿全部并购贷款，

华创芯原向亦庄国投提供的股份质押届时也将解除。因此，华创芯原不会因将北京君正股份质押予亦庄国投而逃废补偿义务。

综上所述，截至本报告书出具日，除华创芯原拟将本次交易项下取得的北京君正股份质押予亦庄国投，继续作为私有化收购并购贷款安排项下的反担保措施外，不存在其他补充质押安排或其他增信措施，不存在对北京矽成股权或资产转让等方面的限制性条款，不会对北京君正生产经营、对外融资、获取商业机会等产生重大不利影响；华创芯原不会因将北京君正股份质押予亦庄国投而逃废补偿义务。

除上述情况外，截至本报告书出具日，北京矽成及相关资产权属清晰，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形。

4、对外担保情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在对外担保的情况。

5、诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况

截至本报告书出具日，北京矽成及其下属企业不存在尚未了结或已知的重大诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。

6、是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚

截至本报告书出具日，北京矽成及其下属企业不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

（七）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、北京矽成所处行业的基本情况

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，根据《上市公司行业分类指引》，北京矽成属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照《国民经济行业分类》，北京矽成所处行业属于“软件和信息技术服务业”之“集成电路设计”，行业代码“6550”。

2、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业主管部门及监管体制

中华人民共和国工业和信息化部是集成电路行业的主管部门，其主要职能为：拟定行业规划、产业发展战略和方针；制定行业技术政策、技术标准，以此推动重大技术发展和自主创新；推动相关科研成果产业化；引导企业结构和产业结构的调整，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是半导体行业的自律性组织，主要进行半导体行业研究、为会员单位提供指导与咨询服务、代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见、维护会员单位的合法权益、推动行业机制的完善等活动。中国半导体行业协会下设集成电路设计分会，该分会在促进我国集成电路设计业的发展方面发挥着重要的作用。

工信部和半导体协会构成了北京矽成所处行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控政策的引导和行业协会的约束下，面向市场独立经营，自主承担市场风险。

（2）行业主要法律法规和产业政策

集成电路行业作为关系国家经济发展和国防安全的支柱行业，国家给予了高度重视和大力支持。2000年以来中国集成电路行业主要政策措施如下表所示：

序号	颁布时间	法律法规	颁布部门	相关内容
1	2017年4月	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	科技部	优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。
2	2016年12月	《信息产业发展指南》	发改委、工信部	着力提升集成电路设计水平；建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；重点发展12英寸集成电路成套生产线设备。
3	2016年12月	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片研发部署。
4	2016年11月	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。

序号	颁布时间	法律法规	颁布部门	相关内容
5	2016年7月	《“十三五”国家科技创新规划》	国务院	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台，推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
6	2016年7月	《国家信息化发展战略纲要》	国务院	购建先进技术体系。打造国际先进、安全可控的核心技术体系、带动集成电路、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
7	2016年5月	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	落实了享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业的税收优惠工作
8	2015年5月	《中国制造2025》	国务院	为大力提升集成电路设计水平，将集成电路纳入“新一代信息技术产业”重点领域
9	2014年6月	《国家集成电路产业发展推进纲要》	国务院	提出着力发展集成电路设计业，以带动制造业的发展，持续推动先进生产线的任务。同时，引导国家产业投资基金资金进入集成电路行业
10	2013年2月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	发改委	将集成电路测试装备列入战略性新兴产业重点产品和服务
11	2012年7月	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	提出要大力提升高性能集成电路产品的自主研发能力，突破先进芯片制造技术，加强相关封装、测试等装备的研发，培育集成电路产业竞争优势
12	2012年4月	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	工信部	提出重点发展集成电路设计，着重提高高端芯片领域设计能力
13	2012年4月	《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	财政部、国家税务总局	颁布了一系列集成电路企业所得税优惠政策。
14	2012年2月	《集成电路产业“十二五”发展规划》	工信部	为“十二五”期间集成电路的发展指明了方向
15	2011年6月	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	将集成电路列为优先发展的高技术产业化重点领域
16	2011年3月	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	十一届全国人大四次会议	提出大力发展包括集成电路产业在内的新一代信息技术产业

序号	颁布时间	法律法规	颁布部门	相关内容
17	2011年1月	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	进一步落实鼓励集成电路产业发展的财税优惠政策、投融资政策、研究发展政策、人才政策等优惠政策
18	2010年10月	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010] 32号）	国务院	提出着力发展集成电路、高端软件、高端服务器等核心基础产业
19	2006年2月	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》	国务院	将高端通用芯片及基础软件、大规模集成电路制造技术及成套工艺作为16个重大专项，并在税收优惠、知识产权保护等方面提出了政策和措施
20	2001年10月	《集成电路布图设计保护条例实施细则》	国家知识产权局	进一步完善了《集成电路布图设计保护条例》实施细则
21	2001年3月	《集成电路布图设计保护条例》	国务院	为了鼓励集成电路技术创新，促进科学技术的发展，同时保护集成电路布图设计专有权
22	2000年6月	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	国务院	该政策对集成电路产业实施全面优惠，包括投资产业政策、出口政策、收入分配政策、融资政策、税收政策等方面，是集成电路产业的核心政策

（八）北京矽成主营业务情况

1、主营业务概况

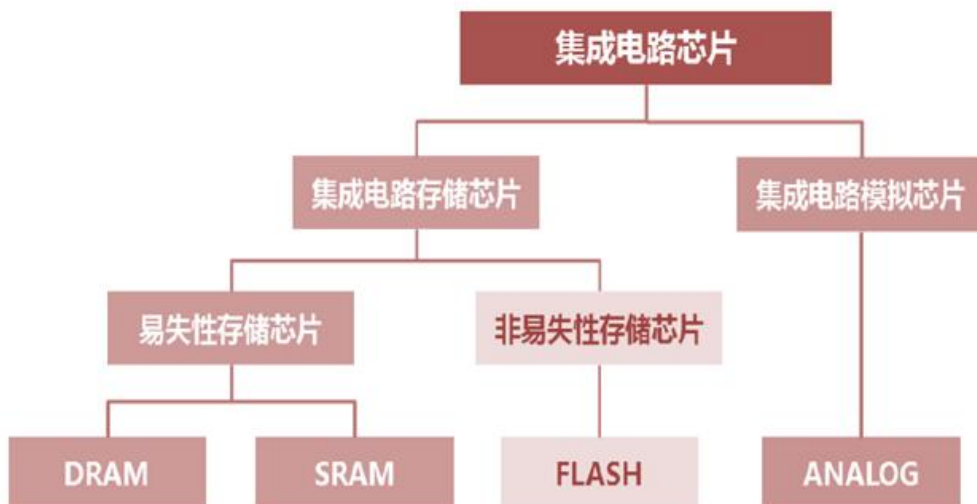
北京矽成成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛用于工业级和汽车级应用，北京矽成通过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验。

DRAM 和 SRAM 的收入占北京矽成的销售收入占比最高，2018 年度分别为 58.41%、19.60%。根据第三方机构 IHS iSuppli 统计，2018 年全年，北京矽成的 DRAM 和 SRAM 产品收入在全球市场中分别位居第七位和第二位，处于市场前列。

2、主要产品及用途

北京矽成的主要产品为集成电路存储芯片和集成电路模拟芯片，按照产品类型分为 DRAM、SRAM、FLASH 及 ANALOG，按照终端市场类型分为汽车市场、工业市场、消费电子市场和信息通讯市场等。产品分类如下图：



（1）DRAM 产品

北京矽成 DRAM 产品主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域开发。涵盖 16M、32M、64M、128M 到 1G、2G、4G、8G、16G 等多种容量规格，能够满足工业、消费、通讯等级和车规等级产品的要求，具备在极端环境下稳定工作以及节能降耗等特点。

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成主要 DRAM 产品及用途情况如下表所示：

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
DDR4 SDRAM	普通型 1.2V_4G	工业、消费、通讯
	车规型 1.2V_4G	汽车
DDR3 SDRAM	普通型 1.5V_1G/2G/4G/8G/16G	工业、消费、通讯
	车规型 1.5V_1G/2G/4G/8G/16G	汽车
DDR3L SDRAM	普通型 1.35V_1G/2G/4G/8G/16G	工业、消费、通讯
	车规型 1.35V_1G/2G/4G/8G/16G	汽车
DDR2 SDRAM	普通型 1.8V_256M/512M/1G/2G	工业、消费、通讯
	车规型 1.8V_256M/512M/1G/2G	汽车
DDR SDRAM	普通型 2.5V_128M/256M/512M	工业、消费、通讯

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
	车规型 2.5V_256M/512M	汽车
SDR SDRAM	普通型 3.3V_16M/64M/128M/256M/512M	工业、消费、通讯
	车规型 3.3V_16M/64M/128M/256M/512M	汽车
EDO/FPM DRAM	普通型 3.3V_16M	工业、消费、通讯
LPDDR4 SDRAM	普通型 1.1V_2G/4G/8G	工业、消费、通讯
	普通型 1.8V_2G/4G/8G	工业、消费、通讯
	车规型 1.1V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.8V_2G/4G/8G	汽车
LPDDR4X SDRAM	普通型 0.6V_2G/4G/8G	工业、消费、通讯
	普通型 1.1V_2G/4G/8G	工业、消费、通讯
	普通型 1.8V_2G/4G/8G	工业、消费、通讯
	车规型 0.6V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.1V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.8V_2G/4G/8G	汽车
LPDDR4 SDRAM with ECC	普通型 1.1V_2G/4G/8G	工业、通讯
	普通型 1.8V_2G/4G/8G	工业、通讯
	车规型 1.1V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.8V_2G/4G/8G	汽车
LPDDR4X SDRAM with ECC	普通型 0.6V_2G/4G/8G	工业、通讯
	普通型 1.1V_2G/4G/8G	工业、通讯
	普通型 1.8V_2G/4G/8G	工业、通讯
	车规型 0.6V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.1V_2G/4G/8G	汽车
	车规型 1.8V_2G/4G/8G	汽车
LPDDR2 SDRAM 节能型	普通型 1.2V_256M/512M/1G/2G/4G	工业、消费、通讯
	普通型 1.8V_256M/512M/1G/2G/4G	工业、消费、通讯
	普通型 1.8V_256M	工业、消费、通讯
	车规型 1.2V_256M/512M/1G/2G/4G	汽车
	车规型 1.8V_256M/512M/1G/2G/4G	汽车
	车规型 1.8V_256M	汽车
Mobile DDR SDRAM 节能型	普通型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G	工业、消费、通讯
	车规型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G	汽车

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
Mobile SDR SDRAM 节能型	普通型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M	工业、消费、通讯
	普通型 2.5V_32M/64M/128M/256M/512M	工业、消费、通讯
	普通型 3.3V_32M/64M/128M/256M/512M	工业、消费、通讯
	车规型 1.8V_32M/64M/128M/256M/512M	汽车
	车规型 2.5V_32M/64M/128M/256M/512M	汽车
	车规型 3.3V_32M/64M/128M/256M/512M	汽车
LPDDR2 DRAM + Serial NOR FLASH	1.2V/1.8V_ 256M DRAM +64M FLASH 1.2V/1.8V_ 256M/512M/1G DRAM +128M FLASH	工业、汽车
RLDRAM2	288M/576M	通讯
RLDRAM3	576M/1G/2G	通讯

（2）SRAM 产品

北京矽成 SRAM 产品品类丰富，从传统的 Synch SRAM、Asynch SRAM 产品到行业前沿的高速 SRAM 产品均拥有自主研发专利。通过多年的积累，SRAM 产品面对客户在高速、低功耗等不同性能需求中，逐渐赢得客户的认可。

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成主要 SRAM 产品及用途情况如下表所示：

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
Asynchronous SRAM 高速型	普通型 5V_64K/256K/512K/1M/4M	工业、消费、通讯
	车规型 5V_1M	汽车
Asynchronous SRAM 低功耗型	普通型 5V_256K/1M/4M/8M	工业、消费、通讯
	车规型 5V_256K/1M	汽车
Asynchronous SRAM 高速低功耗型	普通型 3.3V_256K	工业、消费、通讯
	普通型 1.65V-3.6V_2M/4M/8M/16M	工业、消费、通讯
	普通型 1.65V-2.2V_3M/4M/8M/32M	工业、消费、通讯
	普通型 2.4V-3.6V_512K/1M/2M/4M/8M/32M	工业、消费、通讯
	车规型 1.65V-3.6V_2M/4M/8M/16M	汽车
	车规型 2.4V-3.6V_1M/2M/4M/8M/32M	汽车
Asynchronous SRAM 低功耗节能型	普通型 3.3V_256K	工业、消费、通讯
	普通型 1.65V-2.2V_2M	工业、消费、通讯
	普通型 1.65V-3.6V_1M/2M/4M/8M/16M	工业、消费、通讯
	普通型 1.7V-3.6V_1M	工业、消费、通讯
	车规型 1.65V-3.6V_1M/2M/4M/8M/16M	汽车

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
串行 SRAM 与低引脚数 SRAM	普通型 1.65V-2.2V_512K/1M/2M/4M	工业、消费、通讯
	普通型 2.2V-3.6V_512K/1M/2M/4M	工业、消费、通讯
	普通型 2.7V-3.6V_512K/1M/2M/4M	工业、消费、通讯
	普通型 2.4V-3.6V_4M	工业、消费、通讯
CellularRAM / Pseudo SRAM	普通型 1.7V-1.95V/2.7V-3.6V_8M/16M/32M/64M	工业、消费、通讯
	普通型 1.7V-1.95V_16M/32M/64M	工业、消费、通讯
	普通型 1.7V-1.95V/2.7V-3.6V_8M	工业、消费、通讯
	车规型 1.7V-1.95V/2.7V-3.6V_8M/16M/32M/64M	汽车
	车规型 1.7V-1.95V_16M/32M/64M	汽车
	车规型 1.7V-1.95V/2.7V-3.6V_8M	汽车
HyperRAM	普通型 1.7V-1.95V_64M/128M	工业、消费、通讯
	普通型 2.7V-3.6V_64M/128M	工业、消费、通讯
	车规型 1.7V-1.95V_64M/128M	汽车
	车规型 2.7V-3.6V_64M/128M	汽车
Pipeline Synchronous SRAM	普通型 1.8V_36M/72M	工业、通讯
	普通型 2.5V_4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	普通型 3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	车规型 1.8V_72M	汽车
	车规型 2.5V_4M/36M/72M	汽车
	车规型 3.3V_4M/9M/18M/36M/72M	汽车
Flow-Through Synchronous SRAM	普通型 1.8V_72M	工业、通讯
	普通型 2.5V_4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	普通型 3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	车规型 1.8V_72M	汽车
	车规型 2.5V_4M/9M/36M	汽车
	车规型 3.3V_4M/9M/18M/36M	汽车
No-Wait (ZBT) Synchronous SRAM	普通型 1.8V_36M/72M	工业、通讯
	普通型 2.5V_4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	普通型 3.3V_2M/4M/9M/18M/36M/72M	工业、通讯
	车规型 2.5V_4M/36M	汽车
	车规型 3.3V_4M/18M/36M	汽车
QUAD/QUADP	18M/36M/72M	工业、通讯

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
DDR-II/DDR-IIP	18M/36M/72M	工业、通讯

（3）FLASH 产品

北京矽成 FLASH 类产品包括了目前全球主流的 NOR FLASH 存储芯片和 NAND FLASH 存储芯片，其中 NOR FLASH 存储芯片产品具有串口型和并口型两种设计结构，以及从 256K 至 1G 的多种容量规格，NAND FLASH 存储芯片主攻 1G-4G 大容量规格，公司的 FLASH 产品主要应用于汽车和工业领域。除产品销售收入外，北京矽成还有少量面向消费市场的专利授权费收入。

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成主要 FLASH 产品及用途情况如下表所示：

细分产品名称	细分产品（服务）规格	产品适用领域
Serial NOR FLASH	1.65-1.95V_2M/4M/8M/16M/32M/64M/128M/256M/512M/1G	工业、消费、通讯、汽车
	2.3-3.6V_256K/512K/1M/2M/4M/8M/16M/32M/64M/128M/256M/512M/1G	工业、消费、通讯、汽车
Serial NOR FLASH with ECC	1.65-1.95V_128M/256M/512M	工业、消费、汽车
	2.3-3.6V_128M/256M/512M	工业、消费、汽车
Twin Quad Serial NOR FLASH	1.65-1.95V_256M/512M	工业、消费、汽车
	2.3-3.6V_256M/512M	工业、消费、汽车
HyperFLASH	1.7-1.95V_128M/216M/512M	工业、消费、汽车
	2.7-3.6V_128M/216M/512M	工业、消费、汽车
Parallel NOR FLASH	2.7-3.6V_16M/32M/64M/128M/256M	工业、消费、汽车
SPI NAND FLASH	普通型 3.3V-1G	工业、消费、通讯
	车规型 3.3V-1G	汽车
NAND FLASH	普通型 1.8V-1G/2G/4G	工业、消费、通讯
	普通型 3.3V-1G/2G/4G	工业、消费、通讯
	车规型 1.8V-1G/2G/4G	汽车
	车规型 3.3V-1G/2G/4G	汽车
eMMC	普通型 3.3V-4G/8G/16G/32G/64G	工业、消费、通讯
	车规型 3.3V-4G/8G/16G/32G/64G	汽车
Pfussion Embedded	向晶圆厂商及客户提供的嵌入式闪存专利技术的使用授权	工业、消费、通讯、汽车

（4）ANALOG 产品

北京矽成的 ANALOG 产品主要包括功放驱动芯片、LED 驱动芯片、传感芯

片等。截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成主要 ANALOG 产品或服务及用途情况如下表所示：

细分产品名称	细分产品规格	产品适用领域
Audio Amplifiers	AB 级音频功放	消费
	D 级音频功放	消费、汽车
	耳机驱动	消费
	G 级扬声器功放	消费
	K 级扬声器功放	消费
	数字功放	消费
FxLED Drivers	多频驱动	消费、汽车
	矩阵驱动	消费、汽车
HBLED Drivers	驱动转换器	工业、汽车
	线性驱动	工业、消费、汽车
Backlight Drivers	LCD 背光和闪光灯	消费
Sensors	手势传感器	消费
	接近式传感器	消费
	电容触摸式传感器	工业、消费、汽车
MCU	通用式 MCU	工业、消费、汽车
	CAN 总线式 MCU	汽车
	以太式 MCU	消费
	STN-LCD / LED（矩阵）驱动器	工业、消费
	CAN 控制器/收发器	汽车
Optical Communication	纤维式	通讯
Connectivity	G.hn 型 Connectivity	工业、消费、通讯、汽车
	HomePNA 型 Connectivity	工业、消费、通讯
Automotive ANALOG	汽车功放	汽车
	多通道汽车 FxLED	汽车
	矩阵式汽车 FxLED	汽车
	线性汽车 HBLED	汽车
	转换式汽车 HBLED	汽车
	汽车传感器	汽车
	汽车 MCU	汽车

3、主营业务流程

北京矽成作为专门从事集成电路设计行业的公司，采用无晶圆厂运营模式（Fabless 模式），在晶圆制造和测试、芯片封装和测试生产环节上由大型专业的独立第三方晶圆制造企业、独立第三方封装测试企业完成，后续以成品芯片为单位销售给客户，其业务流程示意图如下：



具体业务流程为：

（1）北京矽成技术人员通过系统设计和电路设计，根据芯片规格和芯片系统、逻辑和性能的设计要求制作成具体的物理图版。之后将设计好的物理图版交付光罩厂制作光罩。

（2）北京矽成委托晶圆厂代工制造晶圆，通过北京矽成提供的由物理图版制成的光罩，晶圆代工厂在晶圆基片上逐层转移设计图形，最终制成成品晶圆。成品晶圆在经过晶圆测试工序后，在满足相应良品率的情况下，进一步成为合格的经测试后晶圆。相应的晶圆测试工序不会对成品晶圆产生物理变化。

（3）经测试后晶圆先由北京矽成委托的封装厂进行封装加工，在经过切割之后挑选出良品晶粒，根据客户对芯片产品的不同规格及工艺要求，晶粒以不同形式进行封装后形成芯片。封装后芯片按照客户对产品性能的不同要求，进行耐用性、抗腐蚀性、耐高温性等得不同测试，通过各测试工序并达标后，产出成品芯片产品。

（4）通常情况下，北京矽成按照客户在产品或方案设计上的不同需求，采用向整机客户直接销售芯片产品，或通过经销商客户的渠道向整机客户销售芯片产品。

4、主要经营模式

北京矽成定位于 Fabless 的经营模式，即无晶圆生产线集成电路设计经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售，无自有生产车间，晶圆生产、芯片封装和测试均通过委托代工方式实现，因此北京矽成需向晶圆代工厂采购晶圆，向封装厂、测试厂采购封装服务和测试服务。

（1）采购/生产模式

在采购/生产环节，北京矽成主要通过客户的订单以及市场对于芯片产品的未来需求预测向晶圆厂及封装测试厂商下订单，主要采购的产品为晶圆、封装服务和测试服务。

北京矽成的采购/生产环节可以分为前端和后端两个环节，其中前端（front end）环节分为晶圆采购及测试环节，后端（back end）环节分为芯片封装、芯片测试环节。在前端环节中，采购产品分成两类：一类为成品晶圆，后续由北京矽成委托第三方完成晶圆测试后，再进入后端的封装、测试加工环节，此类型采购数量占比较高；第二类是直接从晶圆厂采购已经完成测试工序的晶圆，即经测试后晶圆，之后再进入后端的第三方封装、测试加工环节，此类采购数量占比较少。在后端环节中均为服务采购，分为封装服务采购和测试服务采购。由北京矽成将前端采购的经测试后晶圆委托封装厂进行封装服务制成封装后芯片，再将封装后芯片交由测试厂完成最后的测试工序，最终出厂的为封测后芯片。

经过多年的合作，北京矽成与主要的晶圆制造厂商、晶圆测试厂商、芯片封装厂商及芯片测试厂商建立起了长期而稳定的合作关系，能够保障产品及服务的稳定供应。

（2）销售模式

北京矽成的产品主要在欧洲、美洲及亚洲销售，其产品主要应用于汽车电子、工业制造、消费、通讯等领域，销售模式分为直销模式和经销商模式。

①在直销模式下，北京矽成与全球品牌整机厂商直接达成供货合作。通常情况下，直销模式流程如下：

A.整机客户派专人作为销售代表直接和北京矽成的市场部门、研发部门对接，就指定产品或方案提出具体要求。

B.双方针对技术细节深入讨论后交由研发部门做产品开发。

C.待产品开发完毕，样品通过客户的产品性能检测后，由对接整机客户的销售代表向北京矽成的销售人员直接下订单。再由北京矽成委托代工厂生产制造。

②在经销商模式下，北京矽成的客户大多由全球级别的代理商组成，通过代理商对接，有效了解市场需求情况及整机厂商的产品要求。通常情况下，经销商模式流程如下：

A.整机客户通过代理商和北京矽成开始对接，结合代理商对产品未来市场预测，对产品要求及解决方案进行讨论。

B.在北京矽成完成产品开发和通过客户检测后，整机客户向北京矽成发出产品需求预测，同时向代理商下订单。

C.北京矽成结合代理商订单量及整机客户的需求预测，委托代工厂生产制造。

整机客户通常只会选择一种采购方式和北京矽成对接，在直销模式和经销商模式下，客户群体不会发生冲突，同时根据行业惯例，整机厂商亦不会轻易改变采购方式。

（3）盈利模式

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，利润主要来自于芯片产品的销售以及技术专利的授权使用费用。北京矽成通过将前沿技术、行业经验、创新型人才有效结合，组织研究开发，转化为具有高经济价值的芯片产品和专利技术，形成两种盈利模式，分别为成本加成类盈利模式和授权收费类盈利模式。

占主营业务收入绝大部分的集成电路存储芯片研发、销售属于成本加成类盈利模式，北京矽成通过向垂直行业的整机客户提供高性能、高可靠性的集成电路

存储芯片产品，参考市场供需情况、客户订单数量、产品生产成本及合理利润空间确定产品市场价格，最终收获产品销售后利润。北京矽成模拟芯片的盈利模式和存储芯片相同。

占主营业务收入很小部分的技术专利使用授权属于授权收费类盈利模式，北京矽成通过高学历且经验丰富的研发团队进行研究开发，积累技术专利。通过向有技术使用需求的整机客户或者晶圆制造厂商收取技术专利的使用费用获得利润回报。

（4）结算模式

①采购结算模式：北京矽成对于代工厂大多采用月结 45 天或月结 60 天的方式结算采购款。

②销售结算模式：在直销模式下，北京矽成对于整机客户大多采用发货后月结方式结算销售款项。在经销商模式下，北京矽成对于代理商采用月结或待代理商向整机客户发货后月结的方式结算销售款。

（5）北京矽成采用 Fabless 模式的原因及优劣势

①北京矽成与主要竞争对手采取不同经营模式的原因

北京矽成是专注于面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，主营集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。最近三年，北京矽成的 SRAM、DRAM 产品收入分别位居全球前二位、前八位，位居市场前列。与北京矽成主营业务较为接近的集成电路存储芯片的国内外主要上市公司情况如下：

公司名称	所处行业	主营业务模式	主营业务及产品
三星电子 (Samsung Electronics)	半导体行业	IDM 模式	三星电子是韩国最大的电子工业公司，韩国交易所上市公司（股票代码：005930.KS）。三星电子的业务主要涵盖三大部分，即器件解决方案（主要以半导体和显示部件的制造为主，包括 DRAM、FLASH，薄膜晶体管-液晶显示器等）、消费电子（主要包括彩色电视、显示器、打印机、空调、冰箱、洗衣机等）和信息技术与移动通信（主要包括计算机、手持电话、网络系统等）。
SK 海力士 (SK Hynix)	半导体行业	IDM 模式	SK 海力士是全球第二大 DRAM 生产商，韩国交易所上市公司（股票代码：000660.KS）。公司专业从事 DRAM、NAND FLASH 和 CI

			S 系统等产品的研发、生产和销售，主要产品对应的领域为消费电子、工业和汽车市场。
美光科技 (Micron Technology, Inc.)	半导体行业	IDM 模式	美光科技是全球最大的内存存储生产商之一，纳斯达克上市公司（股票代码：MU.O），总部位于美国爱达荷州波夕市。其主要产品包括并行大容量 NOR FLASH、DRAM、NAND FLASH、固态存储、相变内存，以及其它半导体元件和内存模组。
赛普拉斯 (Cypress)	半导体行业	IDM 模式	赛普拉斯是全球领先的集成电路芯片供应商，纳斯达克上市公司（股票代码：CY.O），总部位于美国加利福尼亚州，公司产品主要包括 NAND FLASH、SRAM、F-RAMs 等，其产品主要为消费电子、通讯、工业和汽车。
华邦电子 (Winbond Electronics)	半导体行业	Fabless 模式	华邦电子是全球领先的利基型内存 IC 设计、制造与销售公司，台湾证券交易所上市公司（股票代码：2344.TW）。公司致力提供全球客户全方位的中低密度利基型内存解决方案服务，核心产品包含 Code Storage FLASH Memory、Specialty DRAM 及 Mobile DRAM，在手持装置应用、消费电子及计算机周边市场、良品裸晶圆、车用、工业用电子等应用。
晶豪科技 (Elite Semiconductor Memory Technology)	半导体行业	Fabless 模式	晶豪科技是集成电路存储芯片行业领先的 IC 设计公司，台湾证券交易所上市公司（股票代码：3006.TW）。公司研发的 DRAM 产品以特定型内存为主，可广泛应用于 PC 外围、信息家电、光储存设备及消费性、通讯等系统，SRAM 产品则集中于高速度、低功率应用。
兆易创新 (Giga Device)	半导体行业	Fabless 模式	兆易创新是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，也是国内领先的 MCU 芯片设计企业，上交所上市公司（股票代码：603986）。其主营业务为 FLASH 闪存芯片、微控制器 MCU 芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。产品广泛应用于手持移动终端、消费电子产品、物联网终端、个人电脑及周边、汽车工控等领域。

由上表可见，全球市场中，与北京矽成同属存储芯片领域的行业龙头三星电子、SK 海力士、美光科技等均采用垂直整合制造（IDM）模式，但亦有部分规模较小的存储芯片公司采用无晶圆厂（Fabless）的经营模式；A 股市场中，兆易创新属于存储芯片领域，采用无晶圆厂（Fabless）的经营模式，其他集成电路设计行业公司包括全志科技、紫光国微、国科微等亦采用无晶圆厂（Fabless）的经营模式。

北京矽成实际经营主体 ISSI 自成立初期即采取 Fabless 经营模式，集中自身

技术及资本实力专注于产品研发和芯片设计环节，深耕于存储芯片在汽车行业、工业级医疗行业细分领域中的客户需求。北京矽成与晶圆生产及封测厂商建立了长期稳定的合作关系，下游供应商均具有全球领先技术水平，产品技术保障程度高，对北京矽成的主要研发制程工艺熟悉。此外，北京矽成面临的是少量多样化产品的需求，而且客户需要北京矽成提供长期的高品质的支持，Fabless 模式则具有这样的灵活特性。综上，采取 Fabless 经营模式可使北京矽成充分发挥其轻资产强技术高效率的模式特征。

②Fabless 模式与 IDM 模式的优劣势

根据集成电路设计企业是否具有晶圆生产线，集成电路设计企业经营模式主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式，其各自的优劣势如下：

IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业业务范围涵盖集成电路的设计、制造、封装和测试等所有环节。这种模式对企业的研发力量、资金实力和市场影响力都有较高的要求，企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装和测试厂，部分企业甚至延伸至下游电子设备制造行业。面对晶圆生产、封装和测试的生产线建设，企业均需要投入巨额资金。IDM 模式的优点是企业具有对内部资源整合的优势、以及垂直生产线的技术优势；但是，IDM 模式也有其劣势，由于 IDM 模式所需的资本投入成本较高，在前期需投入巨额的资金购置机器设备，沉没成本较高，一般而言，一条晶圆生产线需要数亿美元的前期投资才可建成投产，而且每年的运行保养、设备更新与新技术开发等成本占总投资的 20%，除此之外，IDM 模式下，企业的制造成本和研发投入均需维持较高水平，如果一条生产线建立后不能进行大量生产则无法收回成本。由于近年来芯片产品加工工艺和设备的成本直线上升，以及在技术迭代中无法迅速反应，导致许多 IDM 厂商无法通过投资生产线实现收益。

Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指集成电路企业只从事集成电路设计业务，晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。Fabless 模式源于集成电路产业的专业化分工，相比 IDM 模式，Fabless 模式的优势是它所需的资金、规模门槛更低，企业能够在资金和规模有限的情况下，集中资源进行集成电路的设计和研发，充分发挥企业的研发能力，因此具有轻资产、强专业的特点，对企业的快速发展起到了至关重

要的作用。但是，采用 Fabless 模式也有其劣势，一般而言，采用 Fabless 模式的芯片设计企业由于自身没有生产能力，较容易受到行业整体生态环境的影响，无法及时灵活调整产能和产量，若整体行业制造环节的产能与需求关系发生波动而导致晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足或上下游供需环境发生重大变化，将对采用 Fabless 模式的企业发展产生一定的影响。

③北京矽成采用 Fabless 模式的优势和劣势

A. 北京矽成采取 Fabless 模式的优势

北京矽成自成立以来，一直专注集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，主要客户均来自于专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯、消费电子等行业。凭借行业领先的研发技术，北京矽成的产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。

在北京矽成成立之初，就基于自身研发实力、资金规模、行业惯例等因素，选择 Fabless 模式作为其经营模式，可以将公司优势资源集中于产品研发及设计环节，能够最大程度地发挥公司自身优势，缩短产品开发周期，提高公司运营效率。集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节，在产业链中具有核心及主导作用。北京矽成核心技术人员一直以来均致力于易失性存储领域或非易失性存储领域的芯片产品研发设计，平均从业年限超过 20 年，具有丰富的工作经验。

与全球存储行业龙头三星电子、美光科技等 IDM 厂商主要定位于通用型领域不同，北京矽成的集成电路芯片产品主要定位于汽车电子、工业及通讯等专用型产品领域，具有较高的毛利率以及较为稳定的市场需求。随着上述龙头 IDM 厂商逐渐增大其在更先进的通用型存储芯片制程工艺的投入，其在传统产品和工业级产品的产能上逐渐削减，并逐步放弃了一些小规模的市场。北京矽成以 Fabless 模式运营，专注于集成电路产品的研发设计，凭借多年的研发积累，其芯片产品性能在极端环境下的可靠性和稳定性均处于行业领先水平，使得其产品在整个客户及汽车客户的产品中更具有市场竞争力，针对车用级客户及工业级客

户的高传输速度、大容量存储芯片可以保持良好的出货量。

B. 北京矽成采取 Fabless 模式的劣势

北京矽成以 Fabless 模式运营，虽然降低了企业的生产成本，使企业能以轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中因供应商的供货所产生的不确定性。

目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆厂和封测厂的产能能否保障北京矽成的采购需求存在不确定性。同时随着行业中晶圆厂和封测厂在不同产品中产能的切换以及产线的升级，可能给北京矽成带来的采购单价的变动，对其毛利造成不利影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆厂和封测厂向北京矽成的正常供货。

虽然北京矽成与业内主要晶圆代工企业和封装测试企业均保持着长期稳定的合作关系，具备丰富的合作经验和充分的信任基础，但上述客观存在的不确定因素仍可能给北京矽成晶圆代工厂的原材料供应和采购封装测试服务的稳定性造成一定影响，可能影响北京矽成的经营业绩。

5、主营业务经营情况

（1）主要产品或服务销售收入情况

①按产品类型分类

报告期内，北京矽成主营业务收入按照产品类型分类，可以分为 DRAM、SRAM、FLASH、ANALOG 产品销售收入，分类情况如下表：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
DRAM	68,994.95	59.21%	168,067.42	58.41%	164,081.94	65.32%
SRAM	20,866.77	17.91%	56,407.63	19.60%	54,642.67	21.75%
FLASH	15,675.67	13.45%	35,216.17	12.24%	19,541.48	7.78%
ANALOG	10,983.52	9.43%	28,033.20	9.74%	12,940.34	5.15%
合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

②按地域分类

报告期内，北京矽成主营业务收入按照地域分类，情况如下表：

单位：万元

地域	2019 年 1-5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
欧洲	34,153.84	29.31%	79,347.15	27.58%	79,336.35	31.58%
中国香港	24,306.09	20.86%	67,417.72	23.43%	58,105.53	23.13%
中国台湾	15,830.23	13.59%	42,049.79	14.61%	28,307.30	11.27%
美国	12,555.08	10.77%	32,507.11	11.30%	30,946.51	12.32%
亚太其他地区	9,117.96	7.83%	20,198.64	7.02%	18,078.61	7.19%
日本	9,113.55	7.82%	19,846.99	6.90%	15,487.07	6.17%
中国大陆	6,969.34	5.98%	17,067.71	5.93%	13,621.68	5.42%
美洲其他地区	3,228.20	2.77%	5,544.83	1.93%	1,547.50	0.62%
韩国	1,246.64	1.07%	3,744.46	1.30%	5,775.89	2.30%
合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

北京矽成下属经营实体 ISSI 成立已逾 20 年，并已形成全球布局，主营业务覆盖了美国、欧洲、日本、中国、亚太等全球主要国家和地区。报告期内，北京矽成主要收入来自于欧洲、中国香港、中国台湾、美国、日本等海外市场，来自中国大陆的收入占比相对较低。受益于近年来汽车市场的发展以及越来越高的电子化程度，凭借自身产品在专用领域的良好性能及高可靠度，北京矽成来自于欧洲、中国香港和美国的主要地区市场收入均较为稳定，来自于中国台湾、日本、中国大陆等地区市场收入占比有所上升。

2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月，北京矽成在中国大陆实现的收入占主营业务收入的比重分别为 5.42%、5.93%及 5.98%，境内销售收入占比相对较低。北京矽成的主要经营实体 ISSI 在私有化完成前，是一家面向全球市场开展业务的美国纳斯达克上市公司，产品海外销售网络发达，但对中国存储芯片市场的开发程度有限。自前次私有化完成后，北京矽成已逐步加强中国大陆客户和渠道的拓展。本次重组完成后，北京矽成可以共享上市公司的国内销售网络、研发技术和符合中国国情的经营理念，进一步加强针对国内市场需求研发投入，加快在国内市场的发展速度。

中国大陆正处于汽车电子的快速发展以及消费电子产品的后普及时期，在产品差异化及消费升级等概念的带动下，新产品的出货仍将保持较高水平；同时，随着我国工业技术的进步、自有工业品牌的发展及新一轮工业自动化的背景下，各类集成电路产品将迎来较大的产品需求。此外在国家安全以及进口替代的国家战略推动下，北京矽成在市场份额的拓展上将更为受益，随着北京矽成在中国大陆业务的拓展，预计中国大陆的收入对主营业务收入的贡献将逐步提升。

③按终端市场分类

报告期内，北京矽成主营业务收入按照终端市场分类，可以分为汽车市场、工业市场、消费电子市场和信息通讯市场等，终端市场分布情况如下：

单位：万元

终端市场	2019 年 1-5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
汽车	61,102.34	52.44%	146,636.47	50.96%	139,815.73	55.66%
工业	25,925.95	22.25%	68,191.14	23.70%	60,247.36	23.98%
消费电子	17,446.31	14.97%	44,804.40	15.57%	27,005.75	10.75%
信息通讯及其他	12,046.32	10.34%	28,092.39	9.76%	24,137.59	9.61%
合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

从终端市场看，北京矽成终端客户主要集中在汽车和工业市场，消费电子、信息通讯及其他市场收入占比较小。

（2）主要产品产销率

报告期内，北京矽成主要产品的产销率情况如下表：

期间	2019 年 1-5 月		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率
DRAM	41,726,967	47,857,360	114.69%
SRAM	17,149,530	18,981,633	110.68%
FLASH	58,845,164	82,714,511	140.56%
ANALOG	40,430,383	40,223,358	99.49%
合计	158,152,044	189,776,862	120.00%
期间	2018 年度		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率

DRAM	136,352,892	129,639,987	95.08%
SRAM	60,281,120	52,451,358	87.01%
FLASH	230,517,690	213,269,053	92.52%
ANALOG	124,007,322	116,215,716	93.72%
合计	551,159,024	511,576,114	92.82%
期间	2017 年度		
产品分类	产品产量（颗）	产品销量（颗）	产销率
DRAM	128,083,731	126,617,929	98.86%
SRAM	56,684,211	51,775,028	91.34%
FLASH	185,200,418	171,777,020	92.75%
ANALOG	92,061,046	86,662,782	94.14%
合计	462,029,406	436,832,759	94.55%

2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月，北京矽成的集成电路芯片产品总体产销率分别为 94.55%、92.82%、120.00%，报告期前两年较为稳定，最近一期产销率上升系受市场整体影响产量下调所致。

（3）报告期内向前五客户的销售情况

报告期内，北京矽成主要通过直销和经销商模式对外进行集成电路存储芯片及集成电路模拟芯片的销售。2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月，北京矽成向前五大客户销售金额占当期营业收入总额的比例分别为 56.87%、52.79%及 52.70%。具体明细如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入总额比例	销售模式
2019 年 1-5 月	1	Avnet	30,937.86	26.55%	经销商
	2	Arrow	18,325.57	15.73%	经销商
	3	Hakuto	4,435.39	3.81%	经销商
	4	Sertek	4,117.37	3.53%	经销商
	5	Delphi	3,587.38	3.08%	直销
	合计		61,403.57	52.70%	-
2018 年度	1	Avnet	65,854.61	22.89%	经销商
	2	Arrow	49,639.22	17.25%	经销商
	3	Delphi	15,399.11	5.35%	直销

	4	Sertek	12,217.41	4.25%	经销商
	5	Hakuto	8,792.66	3.06%	经销商
	合计		151,903.00	52.79%	-
2017 年度	1	Avnet	60,951.47	24.68%	经销商
	2	Arrow	45,473.67	18.41%	经销商
	3	Delphi	16,121.64	6.53%	直销
	4	Sertek	10,562.91	4.28%	经销商
	5	Continental	7,336.98	2.97%	直销
	合计		140,446.67	56.87%	-

注：Delphi 原为 Delphi Automotive PLC，系纽交所上市公司，于 2017 年 4 月分立为 Delphi Technologies PLC（DLPH.N）与 Aptiv PLC（APTIV.N），此处合并计算，下同。

北京矽成前五大客户中，作为经销商的 Avnet（安富利集团）、Arrow（艾睿电子）、Hakuto（日本伯东株式会社）、Sertek（建智股份有限公司）皆为全球知名大型电子元器件经销商，其中 Avnet 为纽交所上市公司，是全球最大的电子元件、计算机产品及嵌入式技术分销商之一；Arrow 是全球领先的元器件分销商之一，总部位于美国科罗拉多州；Hakuto 为东京证券交易所上市公司，是世界知名电子元器件生产商的合作伙伴及高科技设备的专业代理商；Sertek 是大联大控股（WPGHoldings）下属公司，在亚太地区市场份额领先。同时北京矽成的直销客户也都是行业内知名的整机厂商，如纽交所上市公司 Delphi（含 Delphi Technologies PLC（德尔福，DLPH.N）与 Aptiv PLC（安波福，APTIV.N），下同）是全球大型多元化的汽车系统和零部件供应商；Continental（大陆集团）是全球领先的运输行业制造商。北京矽成的主要客户均为全球知名的汽车电子经销商或整机厂商，其中不乏市场认可度颇高的上市公司。

报告期内，北京矽成不存在单个客户的销售比例超过 50%的情况，前五大客户中无北京矽成关联方，北京矽成董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有北京矽成 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有任何权益。

6、主要原材料、能源采购供应及境外生产经营情况

集成电路存储芯片产业经过几十年的发展，已经形成了两种成熟的经营模式，分别为 IDM 模式，即集成整合制造模式，指企业业务范围涵盖集成电路设

计、制造、封装和测试等所有环节的经营模式；以及以垂直分工为主导的经营模式，其中分为集成电路设计、晶圆生产、封装和测试。

北京矽成采用 Fabless 经营模式，即无晶圆生产线集成电路设计经营模式，不从事具体生产，属于垂直分工为主导下的经营模式。该模式下，Fabless 企业通过委托代工方式将晶圆生产、封装和测试工序委托第三方晶圆代工厂、封装厂和测试厂代工，自身专门从事集成电路成存储芯片设计，在取得经测后成品芯片后向直销客户或经销商销售。Fabless 经营模式为企业带来四方面优势：一是轻资产优势，Fabless 企业不需要对昂贵的生产设备、生产技术研发进行资本投入，只需要在研发团队的组建和产品设计技术研发上有针对性的投入；二是聚焦核心竞争力优势，Fabless 企业在经营管理上无须对晶圆制造、封装和测试生产加工环节投入过多精力，使企业能专注于芯片产品的研发设计；三是灵活的销售优势，由于 Fabless 企业更专注于产品的研发环节，与终端客户之间沟通更为频繁，对市场的需求变化具有较高敏感性，能灵活快速的根据市场变化调整销售策略；四是优质供应商合作优势，Fabless 企业在和代工厂商合作过程中，能够根据自身产品的特征挑选具有最佳工艺制程、最高性价比的供应商。

因此，Fabless 经营模式是全球集成电路产业中常见且成熟的经营模式，北京矽成对外采购内容主要为晶圆代工、封装服务及测试服务，符合行业惯例。报告期内，上述三项合计占当期采购总额的比例均超过 60%。

（1）北京矽成委托生产加工情况

北京矽成的委托生产加工为面向晶圆代工厂的晶圆代工、封装厂的封装服务和测试厂对封装后芯片的测试服务。报告期内，北京矽成的上述采购情况如下表：

单位：万元

2019 年 1-5 月		
项目	金额	占当期采购总额比例
晶圆代工采购	51,540.34	42.20%
封装服务采购	11,780.18	9.64%
测试服务采购	13,002.69	10.65%
合计	76,323.21	62.49%
2018 年度		
项目	金额	占当期采购总额比例

晶圆代工采购	130,351.95	44.02%
封装服务采购	33,741.88	11.40%
测试服务采购	35,391.70	11.95%
合计	199,485.53	67.37%
2017 年度		
项目	金额	占当期采购总额比例
晶圆代工采购	93,573.46	37.96%
封装服务采购	32,610.67	13.23%
测试服务采购	32,486.14	13.18%
合计	158,670.27	64.37%

晶圆代工采购、封装服务采购、测试服务采购是北京矽成主要采购项目，报告期内，北京矽成来自于晶圆代工采购、封装服务采购、测试服务采购的合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 64.37%、67.37%、62.49%，占比基本保持稳定。

（2）北京矽成能源供应情况

北京矽成不直接从事生产活动，不采购生产所需要的能源。

（3）报告期内向前五名供应商的采购情况

报告期内，北京矽成主要对外采购为晶圆代工采购、封装服务采购和测试服务采购及其他服务等。报告期内北京矽成向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为 51.66%、52.44%及 50.82%，具体明细如下：

单位：万元

时间	序号	供应商名称	金额	占当期采购总额比例
2019 年 1-5 月	1	南亚科技股份有限公司	23,862.56	19.54%
	2	力晶半导体制造公司（原力晶科技股份有限公司）	22,743.65	18.62%
	3	常忆科技股份有限公司	5,339.18	4.37%
	4	南茂科技股份有限公司	5,229.58	4.28%
	5	紫光宏茂微电子（上海）有限公司	4,903.25	4.01%
	合计		62,078.22	50.82%
2018 年度	1	南亚科技股份有限公司	58,927.45	19.90%
	2	力晶科技股份有限公司	42,014.73	14.19%

时间	序号	供应商名称	金额	占当期采购总额比例
	3	武汉新芯集成电路制造有限公司	23,105.24	7.80%
	4	紫光宏茂微电子（上海）有限公司	16,754.86	5.66%
	5	常忆科技股份有限公司	14,463.79	4.88%
	合计		155,266.07	52.44%
2017 年度	1	南亚科技股份有限公司	56,327.30	22.85%
	2	力晶科技股份有限公司	27,527.36	11.17%
	3	紫光宏茂微电子（上海）有限公司	17,696.30	7.18%
	4	常忆科技股份有限公司	13,302.91	5.40%
	5	矽格股份有限公司	12,489.05	5.07%
	合计		127,342.91	51.66%

注 1：对应供应商采购金额为当期采购金额。

注 2：2012 年北京矽成下属公司 ICSITW 分别与南亚科技（2408.TW）及其大股东南亚塑胶签订股份认购协议和股权转让协议，认购及受让南亚科技部分股份。北京矽成已于 2014 年及 2016 年处置了持有的全部南亚科技股份，截至 2016 年末，北京矽成不再持有南亚科技股份。

报告期内，北京矽成向前五大供应商采购金额分别为 127,342.91 万元、155,266.07 万元及 62,078.22 万元，占当期采购总额的比例分别为 51.66%、52.44% 及 50.82%，基本保持稳定。

报告期内，北京矽成不存在单个供应商的采购比例超过 50%的情况，前五大供应商中无北京矽成关联方。北京矽成董事、监事、高级管理人员和核心人员，主要关联方或持有北京矽成 5%以上股份的股东并未在报告期内持有前五名供应商的任何权益。

（4）北京矽成报告期主要采购项目的相关情况

①主要供应商的主营业务

晶圆代工采购、封装服务采购、测试服务采购是北京矽成主要采购项目，报告期内，与上述主要采购业务相关的前五大供应商共涉及 6 家，其主营业务情况列示如下：

序号	供应商名称	主营业务	主要采购内容

1	南亚科技股份有限公司	专注于利基型存储芯片，主要产品包括各类 DRAM 晶片、晶圆制造服务	晶圆代工
2	力晶科技股份有限公司	从事以晶圆代工业务为主的各式集成电路的研发和制造	晶圆代工
3	武汉新芯集成电路制造有限公司	从事以 NOR FLASH 为主的晶圆代工业务，以及产品设计、晶圆制造和销售业务	晶圆代工
4	南茂科技股份有限公司	各类集成电路的封装和测试服务	封装服务和测试服务
5	紫光宏茂微电子（上海）有限公司	半导体的封装和测试服务	封装服务和测试服务
6	矽格股份有限公司	半导体的封装和测试服务	封装服务和测试服务

报告期内，北京矽成向上述供应商采购的晶圆代工和封装测试服务金额分别占晶圆代工采购总额和封装测试服务采购总额的比重如下：

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
晶圆代工			
南亚科技股份有限公司	38.65%	35.57%	38.91%
力晶科技股份有限公司	42.85%	30.40%	28.21%
武汉新芯集成电路制造有限公司	6.80%	17.20%	11.52%
小计	88.30%	83.17%	78.65%
封装和测试服务			
南茂科技股份有限公司	19.38%	17.42%	16.77%
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	19.49%	24.02%	27.18%
矽格股份有限公司	18.40%	18.20%	18.93%
小计	57.27%	59.64%	62.89%

②双方交易的具体内容、采购模式和结算模式，交易条款、价格及付款条件与其他供应商不存在重大差异

北京矽成根据芯片产品的实际需求，综合考虑各项合同条件选择合适的供应商采购晶圆代工、封装、测试服务，以获得持续稳定的产能供应，并与上述主要供应商保持了长期稳定的合作关系。

北京矽成通常与供应商签订框架协议进行合作约束。北京矽成的采购框架协议大多都会约定下单方式、加工责任、品质保证要求、加工验收标准等，在框架协议的整体约束下，日常以订单形式向供应商下达具体采购需求；在实际的订单中，通常均会明确每批产品的品名、型号、数量、加工项目、加工条件

等具体事项；采购单价则基于供应商与北京矽成之间定期确定的价格，在具体订单中体现；付款与结算则通常在采购订单产品验收入库并取得发票后，在信用期限内完成。

报告期内，北京矽成主要供应商与其他供应商之间的主要采购结算模式、交易条款、价格及付款条件不存在重大差异，不同的供应商就产品的产能供应保障、付款方式和产品定价上存在一些差异化安排，主要系合作双方基于业务发展需求自主协商确定。

（5）供应商集中度高的原因、应对措施及对北京矽成的影响

①与同行业主要上市公司的供应商集中度对比

2017 年和 2018 年，北京矽成与同行业主要上市公司向前五大供应商进行采购的金额占比情况如下：

证券代码	公司简称	2018 年占比	2017 年占比
002049.SZ	紫光国微	60.34%	60.29%
300458.SZ	全志科技	75.65%	81.43%
300672.SZ	国科微	53.98%	77.19%
603986.SH	兆易创新	84.37%	76.01%
平均值		68.59%	73.73%
北京矽成		52.44%	51.66%

数据来源：Wind 资讯、各上市公司年报

由上表可知，北京矽成同行业主要上市公司 2017 年和 2018 年前五大供应商采购金额占比平均为 73.73%和 68.59%，供应商集中度较高。而北京矽成 2017 年和 2018 年前五大供应商采购金额占比为 51.66%和 52.44%，占比亦较高，但低于同行业上市公司的平均值，其供应商集中度水平较为合理。

②供应商集中度高的原因

晶圆制造及封装测试对企业自身技术和资金规模的要求较高，产业集聚效应明显。拓璞产业研究院的数据统计显示，2019 年第一季度，全球前十大晶圆厂的市场占有率达 95%，全球前十大封装测试厂的市场占有率达 83.3%。因此，芯片设计企业的供应商集中度较高主要系受行业整体格局所致。

此外，由于北京矽成的存储芯片和模拟芯片多运用于汽车、工业等专用领域，具有特定的技术要求，并需要持续性的基础设施服务，在行业本身集中度较高的背景下，也会进一步导致北京矽成的供应商集中度较高。

③对供应商集中度较高的应对措施

北京矽成将进一步巩固与现有供应商之间的合作关系，同时努力寻求与新供应商的合作机会，以尽可能地减少供应商集中度过高的问题。

巩固与原有供应商合作关系：由于集成电路设计行业属于技术密集型行业，对产业化运作有着较高的要求，晶圆代工厂和封装测试厂与芯片设计厂商的合作存在较高的壁垒，包括技术、产业整合、人才、资金规模、客户等方面，双方需要长时间的合作才能达成稳定的合作状态。北京矽成的实际经营实体的前身为美国纳斯达克上市公司，在行业地位、采购规模、技术能力等方面均有较大的优势，在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优秀的产品质量逐步积累起了相应的品牌和声誉，并且已经与供应商形成了长期、互信的合作。报告期内北京矽成的主要供应商未发生重大变化，在合同发生期间双方未发生纠纷。未来几年，北京矽成与主要供应商将继续遵循市场化定价原则，保持互利合作的态度，进一步发展更高水平的合作。

根据业务发展需要进一步寻求与新供应商的合作机会：根据业务发展的需要，北京矽成努力寻求与更多供应商的合作机会，以更好地应对晶圆价格等波动带来的影响。本次重组完成后，北京矽成将结合自身业务与技术的优势，充分发挥与上市公司之间相关资源的整合优势，努力扩大北京矽成在中国市场的品牌影响力，在保证产品质量的前提下，寻求与更多其他供应商之间的合作机会。

④对北京矽成议价能力的影响

北京矽成作为车规及工业领域具有较高竞争力的芯片设计企业，与主要供应商之间拥有长期稳定的合作，相关产品的价格按照市场价格进行定价，双方已建立起互利合作的态度与默契，并将继续保持这样的合作关系。因此，北京矽成的议价能力并未因供应商集中度较高而受到不利影响。同时，随着上述应对措施的实施，将有助于提升北京矽成的议价能力。

此外，北京矽成未来发展规模将进一步增长，且本次重组完成后，北京矽成与上市公司之间将产生协同效应，其产品的销售规模将获得提升，从而亦将扩大采购规模，北京矽成的议价能力或将得以进一步增强。

⑤对北京矽成生产经营的影响

北京矽成的主要供应商为业内较为知名的晶圆制造和封装测试厂商，其财务状况良好，规模较大，在市场上具有较高的影响力。报告期内，北京矽成与主要供应商保持了良好的合作关系，互相合作时间基本为十年以上，稳定性较高。北京矽成供应商集中度较高主要系受行业特性的影响，且报告期内北京矽成不存在向单个供应商的采购比例超过 50%的情况，不存在对主要供应商的重大依赖。

晶圆制造、封测服务是对技术壁垒、资金壁垒有很高要求的产业，若短期内主要晶圆厂及封测厂的技术要求及规模无法更新升级以满足北京矽成的产品需要，更换供应商仍需付出一定的时间成本，现有采购模式或出现无法及时保证晶圆的产能供给及封测服务的产品良率。同时若未来晶圆、封测服务等采购的市场价格上升，北京矽成的成本将增加，对产品毛利可能造成不利影响。此外，如果出现突发的自然灾害等破坏性事件，晶圆厂和封测厂能否保障公司的采购需求亦存在不确定性，将会对北京矽成产品的未来规划、布局以及产品的正常运营产生一定的影响。

综上所述，北京矽成与供应商合作稳定性高，供应商集中度符合行业发展的背景，且与同行业上市公司相比处于较为合理水平；由于北京矽成与主要供应商实现了长期稳定的合作，议价能力受供应商集中度高的影响相对较小，未来随着北京矽成巩固合作关系、寻求新合作机会等措施的实施，其议价能力将得到增强；北京矽成与主要供应商之间的互利合作不存在重大依赖。

（6）本次收购对供应商供货意向、未来经营能力的影响以及应对措施

①兆易创新前次收购北京矽成的终止原因

根据兆易创新披露的相关公告，其前次收购北京矽成的终止原因为：ISSI 某主要供应商认为兆易创新与 ISSI 重组后将成为其潜在的有力竞争对手，要求 ISSI 与其签署补充协议，约定在交易完成时其有权终止相关供应合同。经兆易

创新、北京矽成及当时的交易对方评估，认为该事项将在重组完成后对北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响，为切实保护兆易创新全体股东及交易各方的利益，兆易创新收购北京矽成事项宣告终止。

②本次收购不影响相应供应商的供货意向，预计不会对未来经营能力产生不利影响

北京矽成与主要供应商保持了长期、稳定的良好合作关系。本次北京君正收购北京矽成的交易中，主要供应商在访谈时均表示将与北京矽成开展长期的业务合作安排。截至本报告书出具日，北京矽成亦未收到供应商关于因本次收购而调整或取消双方之间业务合作的要求。本次收购预计不会影响相应供应商的未来供货意向、不会对未来经营能力产生不利影响。

然而，若后续发生部分供应商影响供货的情形，则可能影响北京矽成的晶圆供给、封测需求，从而使得北京矽成无法满足下游客户的产品需求，进而导致无法正常履约交付产品、市场竞争力下降、经营业绩下降等不利影响。

为了有效应对该等因供应商供货因素而导致的不利影响，北京矽成将本着互利合作的态度，进一步加强与供应商的沟通协调，并发展更高水平的合作；同时，北京矽成亦将努力开拓与新供应商的合作机会。

（7）境外生产经营情况

①北京矽成境外经营情况

北京矽成具有覆盖全球主要成熟市场的集成电路芯片销售网络，报告期内，境外地区销售占比前五大地区分别为欧洲、中国香港、中国台湾、美国和亚太其他地区。报告期内，北京矽成主营业务收入按不同地区分类情况如下：

单位：万元

地域	2019年 1-5月		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
欧洲	34,153.84	29.31%	79,347.15	27.58%	79,336.35	31.58%
中国香港	24,306.09	20.86%	67,417.72	23.43%	58,105.53	23.13%
中国台湾	15,830.23	13.59%	42,049.79	14.61%	28,307.30	11.27%
美国	12,555.08	10.77%	32,507.11	11.30%	30,946.51	12.32%
亚太其他	9,117.96	7.83%	20,198.64	7.02%	18,078.61	7.19%

地区						
日本	9,113.55	7.82%	19,846.99	6.90%	15,487.07	6.17%
中国大陆	6,969.34	5.98%	17,067.71	5.93%	13,621.68	5.42%
美洲其他地区	3,228.20	2.77%	5,544.83	1.93%	1,547.50	0.62%
韩国	1,246.64	1.07%	3,744.46	1.30%	5,775.89	2.30%
合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

②北京矽成境外资产情况

北京矽成在境外拥有的资产情况详见“第四章标的资产情况”之“一、北京矽成基本情况”之“（三）北京矽成股权及其主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产的权属情况”。

③北京矽成与主要客户、供应商的关联关系

A. 北京矽成主要客户

a. 核查范围

报告期内，北京矽成主要通过直销和经销商模式对外进行集成电路存储芯片及模拟芯片的销售。独立财务顾问和会计师对报告期内北京矽成的主要客户进行了核查，包括 Avnet、Arrow、Sertek、Delphi、ZLG Electronics (Hong Kong)、Ho Young Electronics、德赛西威等。

b. 核查手段

独立财务顾问及会计师通过公开渠道查询北京矽成主要客户的官方网站、境外交易所公告等公开资料信息，关注是否存在注册地与北京矽成及其子公司相同或相似的情形、关注是否存在主要股东、董事、高级管理人员等与北京矽成相同的情形；对主要客户进行了现场、邮件、电话等形式的访谈；对北京矽成的董事、监事、高级管理人员发放了调查表，由其进行填写并签字确认；通过公开渠道查询了北京矽成的股权结构变化情况，其董事、监事、高级管理人员的构成，并获得了北京矽成的工商底档资料。

c. 核查结论

经核查，北京矽成与其主要客户不存在关联关系。

B. 北京矽成主要供应商

a. 核查范围

报告期内，北京矽成主要对外采购为晶圆代工采购、封装服务采购和测试服务采购及其他服务等。独立财务顾问和会计师对报告期内北京矽成的主要供应商进行了核查，包括南亚科技股份有限公司、力晶科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司、紫光宏茂微电子（上海）有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司、矽格股份有限公司等。

b. 核查手段

独立财务顾问及会计师通过公开渠道查询北京矽成主要供应商的官方网站、境外交易所公告等公开资料信息，关注是否存在注册地与北京矽成及其子公司相同或相似的情形、关注是否存在主要股东、董事、高级管理人员等与北京矽成相同的情形；对主要供应商进行了现场、邮件等形式的访谈；对北京矽成的董事、监事、高级管理人员发放了调查表，由其进行填写并签字确认；通过公开渠道查询了北京矽成的股权结构变化情况，其董事、监事、高级管理人员的构成，并获得了北京矽成的工商底档资料。

c. 核查结论

经核查，北京矽成与其主要供应商不存在关联关系。

④北京矽成收入确认政策符合会计准则的规定

A. 核查范围

本次核查的范围为北京矽成的收入确认政策及执行情况。

a. 企业会计准则关于收入确认的规定

企业会计准则关于收入确认的规定如下：

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。企业应当在履行了合同中的履约义务并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（a）销售商品收入

对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

客户已接受该商品；

其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(b) 使用费收入

对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据企业为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，企业应当采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

b. 北京矽成的收入确认政策

(a) 销售商品收入

北京矽成在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(b) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(c) 利息收入

按照他人使用北京矽成货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 核查手段

独立财务顾问及会计师通过与北京矽成财务人员访谈，了解北京矽成具体业务的收入确认会计政策及收入确认时点；针对报告期的销售流程和内控情况执行了穿行测试；此外，独立财务顾问及会计师通过检查销售合同上的主要结算条款并对照《企业会计准则》中收入确认的相关判断标准来判断北京矽成的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

C. 核查结论

经核查，北京矽成收入确认政策符合企业会计准则的规定。

⑤北京矽成境外销售的真实性

A. 核查范围

本次核查范围为北京矽成报告期内境外收入的真实性。

B. 核查手段

独立财务顾问和会计师针对北京矽成境外营业收入的真实性进行的核查程序如下：

a. 确认销售与收款相关的内部控制的有效性

了解和评价北京矽成管理层与销售收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性，并与企业内部控制基本规范及其配套指引对照；结合北京矽成的销售业务流程，判断北京矽成的销售与收款相关的制度是否合理及完善；通过访谈北京矽成的管理层，对北京矽成的销售模式、信用政策进行了解，执行销售与收款循环内控流程穿行测试及关键控制点测试，将取得的销售明细样本对应的销售订单、发货单、物流信息、客户签收资料、发票、收款凭证等单据进行核对。

b. 选取主要客户进行背景调查

对比报告期内北京矽成主要客户名单，分析报告期客户数量变动及总体分布情况；对于交易额较大的新增客户以及各年度销售额前五大客户，通过官方网站、境外交易所公告等公开资料信息，关注是否存在注册地与北京矽成及其子公司相同或相似的情形、关注是否存在董事、高级管理人员等与北京矽成相同的情形。

c.获得主要客户的销售合同

获得并查阅了报告期内主要客户的销售（框架）合同，了解销售交易的主要条款，包括交付及运输的条款、适用的销售返利安排等，以评价北京矽成主要客户的销售收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

d.选取样本进行实质性测试程序

选取样本执行实质性测试程序，包括并不限于查阅销售合同、相关订单、发票、发货单及运输单等，检查会计记录与物流信息是否一致，检查原始凭证是否齐全、真实、并与合同约定相一致，核对实际交易的产品品名、规格、数量等与订单规定是否相符。

e.向主要客户进行了发函确认

以客户为单位进行抽样，对主要客户的营业收入发生额实施函证程序，核实其真实及准确性，检查有无取得对方认可的大额销售是否取得对方确认，通过函证与替代程序对北京矽成营业收入的核实情况如下：

2019 年 1-5 月营业收入的发函比例为 77.41%，回函比例为 90.18%，回函准确相符率（包含可解释差异的回函，下同）为 100%；2018 年营业收入发函比例为 51.45%，回函比例为 26.50%，回函相符准确率为 100%；2017 年营业收入发函比例为 55.54%，回函比例为 26.79%，回函相符准确率为 100%。

(a) 2017 年和 2018 年的发函比例相对较低的原因

2017 年和 2018 年营业收入的发函比例相对较低，主要原因如下：

a) 境外审计理念差异

北京矽成境外主要经营实体 ISSI 原为纳斯达克上市公司，自身整体运作较为规范，在境外的监管环境下，其过往接受的审计更加侧重风险导向，通过控

制测试结果实现审计目标，包括函证事项在内的外部实质性验证程序的应用相对较少。而 ISSI 主要客户多为境外上市公司，其所处的资本市场和监管环境与 ISSI 相似，对函证事项等外部实质性验证程序的应用亦相对较少。

b) 本次审计工作情况

本次并购重组事项中，北京矽成财务报表的审计工作共分为两阶段进行。第一阶段审计期间为 2017 年和 2018 年，第二阶段（加期）审计期间为 2019 年 1-5 月。

在第一阶段审计阶段，会计师和独立财务顾问通过对北京矽成管理层的访谈及对北京矽成主要业务模式、历史沿革、主要客户背景及信用情况、客户回款周期等的了解，获知北京矽成的直接客户主要为国际知名的大型半导体经销商及汽车工业等直销客户，多为境外上市公司。在执行审计工作中，中介机构按照风险导向审计理念，充分进行风险评估，并按照国内的监管要求，结合 ISSI 的实际情况，增加了实质性审计程序的执行范围。

在第二阶段（加期）审计阶段，随着审计过程和本次交易整体方案的推进，ISSI 管理层对境内审计理念及监管要求有了进一步的理解，并多次向其客户提出配合完成相关审计程序的请求，因此在 2019 年 1-5 月的审计中发函比例较 2017 年、2018 年有所提高。

c) 发函率整体相对较高

本次审计对 2017 年和 2018 年的发函比例与其他跨境收购相比，属于较高水平。与近期境外收购案例对比情况如下：

上市公司	报告期第一年 发函比例	报告期第二年 发函比例	报告期最近一期 发函比例
闻泰科技（600745.SH）	6.20%	62.30%	-
中国天楹（000035.SZ）	35.75%	36.84%	31.51%
北京君正（300223.SZ）	55.54%	51.45%	77.41%

综上所述，2017 年、2018 年和 2019 年 1-5 月，北京矽成营业收入的发函比例分别为 55.54%、51.45%和 77.41%，随着审计过程和本次交易整体方案的推进，第二阶段加期审计的发函比例较第一阶段进一步提高，在跨境收购案例中整体处于较高水平。

(b) 2019 年 1-5 月回函率较高的原因

2019 年 1-5 月，营业收入的回函率为 90.18%，高于 2017 年和 2018 年的回函率，主要原因如下：

在 2019 年 1-5 月的审计中，针对发出的询证函，中介机构定期将下游客户的未回函情况进行统计并及时通知未回函客户尽快回函，同时 ISSI 管理层亦多次向其客户提出配合完成相关审计程序的请求。通过中介机构和北京矽成管理层的努力沟通与协调，2019 年 1-5 月的回函比例有了较大提升。

(c) 对未回函的替代程序

针对未回函收入的情况，主要基于以下程序对其真实性进行验证：

对主要客户的框架合同进行了核查，并对销售流程执行了控制测试，对抽取样本的订单、信用审批、发货单、物流跟踪信息及发票等主要节点执行了控制测试。检查了凭证流与物流的一致性，检查了原始凭证（包括销售订单、出库单、运单等）是否齐全、真实、与原始订单一致，核对实际交易的品名、规格、数量等与原始订单规定是否相符，经核查，未发现异常。

对未回函客户进行了银行回款核查。报告期内，北京矽成的主要销售主体为 ISSI、ISSI (Cayman) 和 ICSI，其合计销售收入占营业收入总额的比例均超过 90%。通过获取主要销售主体的银行回款流水并对未回函客户的回款情况进行核查，核查银行流水单据的时间、金额以及回款名称等信息与销售订单及信用期限是否相符，以及抽取的订单是否存在异常。经检查，未发现异常。

在上述基础上，结合客户访谈、北京矽成管理层访谈等程序，综合判断北京矽成的销售收入具有真实性。

f. 检查资产负债表日后事项

检查资产负债表日后发货明细和营业收入序时账，以识别重要的会计跨期，并检查相关支持性文件，以评价相关收入是否记录于恰当的会计期间。

g. 银行账户核查

取得了标的企业银行账户截至报告期各期末的对账单，并对重要银行账户进行发函询证。

h.对主要客户进行访谈

独立财务顾问和会计师通过现场走访/电话/邮件等形式对北京矽成主要客户进行访谈，接受访谈的客户包括 Avnet、Arrow、Sertek、Delphi、ZLG Electronics (Hong Kong)、Ho Young Electronics、德赛西威。上述主要客户的合计销售金额分别占报告期内北京矽成销售收入的 60.00%、57.49%和 55.90%。访谈重点询问下列事项：

- （a）客户的基本情况、业务发展情况；
- （b）客户与北京矽成开始合作的时间及选择北京矽成合作的原因；
- （c）客户向北京矽成采购的主要产品类型和用途，以及客户与北京矽成之间的各项交易定价原则；
- （d）是否从其他供应商购买同类产品，以及是否存在采购价格差异；
- （e）客户从北京矽成购买的相关产品的风险转移时点；
- （f）客户向北京矽成采购的依据原则；
- （g）客户与北京矽成的结算周期及方式，是否存在委托第三方向北京矽成付款的情况或收款账户为非北京矽成的情形，以及客户与北京矽成的对账周期；
- （h）客户与北京矽成之间的退货情形；
- （i）客户是否向北京矽成销售相关产品；
- （j）客户对北京矽成的评价情况，及未来与北京矽成继续保持合作关系的稳定性和前景；
- （k）客户与北京矽成之间是否存在纠纷、诉讼；
- （l）客户与北京矽成之间是否存在正常业务往来之外的其他利益安排，及客户（包括其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员）与北京矽成（包括其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员）之间是否存在关联关系。

C. 核查结论

- a. 北京矽成主要客户为境外知名企业，资质良好

报告期内，北京矽成向前五大客户的销售收入合计占当期销售收入的比例分别为 56.87%、52.79%和 52.70%，具体列示如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额	占当期营业收入总额比例	销售模式
2019 年 1-5 月	1	Avnet	30,937.86	26.55%	经销商
	2	Arrow	18,325.57	15.73%	经销商
	3	Hakuto	4,435.39	3.81%	经销商
	4	Sertek	4,117.37	3.53%	经销商
	5	Delphi	3,587.38	3.08%	直销
	合计		61,403.57	52.70%	-
2018 年度	1	Avnet	65,854.61	22.89%	经销商
	2	Arrow	49,639.22	17.25%	经销商
	3	Delphi	15,399.11	5.35%	直销
	4	Sertek	12,217.41	4.25%	经销商
	5	Hakuto	8,792.66	3.06%	经销商
	合计		151,903.00	52.79%	-
2017 年度	1	Avnet	60,951.47	24.68%	经销商
	2	Arrow	45,473.67	18.41%	经销商
	3	Delphi	16,121.64	6.53%	直销
	4	Sertek	10,562.91	4.28%	经销商
	5	Continental	7,336.98	2.97%	直销
	合计		140,446.67	56.87%	-

注：Delphi 原为 Delphi Automotive PLC，系纽交所上市公司，于 2017 年 4 月分立为 Delphi Technologies PLC（DLPH.N）与 Aptiv PLC（APTIV.N），此处合并计算。

报告期内，北京矽成主要客户较为稳定。北京矽成经销客户多为全球知名大型电子元器件经销商，主要包括 Avnet（安富利集团）、Arrow（艾睿电子）、Hakuto（日本伯东株式会社）、Sertek（建智股份有限公司）等。报告期内，北京矽成对上述四家经销商的销售收入占比分别为 49.94%、47.45%、49.62%，整体较为稳定。对上述经销商简要介绍如下：

（a）Avnet（安富利集团）

Avnet 是全球最大的电子元件、计算机产品和嵌入技术分销商之一，主要分销计算机产品和半导体，以及互连、无源和机电元件，连接世界领先的技术提

供应商和客户，提供相关的设计链和供应链支持。该公司成立于 1955 年，目前为纳斯达克上市公司，股票代码为 AVT.O，总市值约为 40 亿美元，是财富五百强企业之一。根据 2019 财年年报（2018 年 7 月至 2019 年 6 月），Avnet 营业收入约为 195.19 亿美元、净利润约为 1.76 亿美元。

(b) Arrow（艾睿电子）

Arrow 是全球领先的电子元件产品及服务的提供商和服务商之一，为企业提供材料规划、产品设计、编程和组装服务、库存管理、反向物流、电子资产处置等产品、服务和解决方案。该公司成立于 1935 年，目前为纽交所上市公司，股票代码为 ARW.N，总市值约为 67 亿美元，是财富五百强企业之一。根据 2018 财年年报（2018 年 1 月至 2018 年 12 月），Arrow 营业收入约为 296.77 亿美元、净利润约为 7.16 亿美元。

(c) Hakuto（日本伯东株式会社）

Hakuto 主要从事电子元件、电气电子设备和工业化学品的制造和销售，公司经营四个业务部门，其中电子部件部门提供半导体器件和一般电子部件。电子电气设备部门主要提供印刷电路板相关设备和半导体制造相关设备，工业化工部门主要提供工业化学品，其他部门从事合同物流管理和保险代理服务。该公司成立于 1953 年，目前为东京证券交易所上市公司，股票代码为 7433.T，总市值约为 316 亿日元。根据 2019 财年年报（2018 年 4 月至 2019 年 3 月），Hakuto 营业收入约为 1,401.23 亿日元、净利润约为 24.73 亿日元。

(d) Sertek（建智股份有限公司）

Sertek 是大联大控股（WPG Holdings）下属公司，在亚太地区市场份额领先。大联大控股是全球领先、亚太区第一的半导体零部件供应商，总部位于台北，旗下拥有世平、品佳、詮鼎及友尚，2018 年营业额达 180 亿美金。Sertek 于 1983 年成立，之前是宏碁的全资子公司，2007 年被友尚集团收购。Sertek 目前注册资本为 10 亿台币，2018 年营业收入约为 5 亿美元。根据访谈显示，该公司与 ISSI 合作近 20 年，从 ISSI 采购的商品占车用半导体总采购量的 70%，涉及业务规模占营业收入比例约为 4%。

直销客户 Delphi 为全球大型的多元化的汽车系统和零部件供应商，为纽交所上市公司，Continental（大陆集团）为全球领先的运输行业制造商。

北京矽成客户作为大型经销商及汽车工业企业，其主要系基于自身经济利益考虑，不存在大额囤货的主观动机。

b. 北京矽成现金流回款良好

报告期内，北京矽成销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
销售商品、提供劳务收到的现金	115,015.87	282,286.27	251,113.73
营业收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	98.71%	98.11%	99.96%

由上表可知，报告期内，北京矽成销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入的比例为 99.96%、98.11%、98.71%，经营活动回款状况较好，营业收入增长转化为现金的能力较强。

c. 北京矽成坏账准备较低

报告期各期末，北京矽成应收账款坏账计提情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
应收账款余额	45,174.95	43,241.23	38,330.43
坏账准备	55.52	34.09	24.35
坏账准备计提比例	0.12%	0.08%	0.06%

北京矽成的客户主要为境外大中型经销商及厂商，客户质量较高，且与公司合作时间较长、信用情况良好，北京矽成历史上较少发生坏账损失。由上表可知，报告期内，北京矽成应收账款坏账准备计提比例较低，符合其一贯的经营情况。

d. 对主要经销客户的销售稳定增长

报告期内，北京矽成向主要经销客户的销售收入具体列示如下：

单位：万元

客户名称	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年

Avnet	30,937.86	65,854.61	60,951.47
Arrow	18,325.57	49,639.22	45,473.67
Hakuto	4,435.39	8,792.66	6,353.66
Sertek	4,117.37	12,217.41	10,562.91

2018 年，北京矽成向主要经销客户的销售均较 2017 年增长，未发生当年较上年销售额大幅下降的情形，表明主要经销客户对产品拥有持续稳定的需求，未因大量囤货而大幅减小采购金额。

e. 主要经销客户未发生大量退货及盲目采购情形

通过对北京矽成主要客户进行了访谈确认，主要客户均表示其向北京矽成退货的比例很小。同时，主要经销客户向北京矽成的采购系基于下游客户需求及合理预测进行。

经核查，北京矽成境外销售具有真实性，主要客户未发生大量囤货的情形。

（8）本次收购不会对北京矽成在主要资产及业务所在国家和地区持续开展业务产生不利影响

①北京矽成主要资产、业务所在国家和地区及业务资质情况

北京矽成的主要资产及业务分布在美国、中国（含大陆、香港、台湾）、欧洲、日本等国家或地区。

在日常经营活动中，北京矽成需要遵守其主要资产和业务所在国家或地区相关的安全生产、环保、劳动人事等法律法规。根据北京矽成提供的相关文件资料、说明及境外律师出具的法律意见，除依据相关适用法律的规定办理相关国家/地区的工商/公司、税务、外商投资等登记手续，及 ICSI TW 与 ISSI Cayman 台湾分公司从事进出口业务分别持有台湾地区经济部国际贸易局颁发的《进出口厂商登记证明书》外，北京矽成及其境内外子公司从事相关业务无需取得事前许可或相关资质，北京矽成及其下属公司在其核准的经营范围内开展业务，其经营范围和经营方式符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

②ISSI 私有化后业务持续发展

2015 年，武岳峰浦江、北京集成、北京京存及华清基业形成的买方团对 ISSI 进行了私有化收购，ISSI 从纳斯达克退市。私有化收购完成后，北京矽成通过

上海闪胜及闪胜科技持有原 ISSI 资产及业务。

前次私有化完成后，北京矽成的各项业务持续发展，收入与利润规模均有所增长。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和出具的审计报告，北京矽成 2015 年至 2018 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015.12.31 /2015 年	2016.12.31 /2016 年	2017.12.31 /2017 年	2018.12.31 /2018 年
资产总计	554,552.60	602,784.78	601,828.44	655,984.69
所有者权益合计	480,983.17	550,037.84	534,859.81	581,711.84
营业收入	193,575.52	213,639.22	251,206.43	287,724.41
净利润	6,142.05	14,287.25	6,005.03	24,502.14
息税折旧摊销前利润	31,293.13	32,229.40	30,759.44	41,117.33

③本次收购后北京矽成经营管理保持稳定

本次交易完成后，北京君正将北京矽成纳入上市公司合并报表范围内，按照上市公司相关法人治理及规范运作要求对北京矽成进行管理，通过修改公司章程、改组董事会成员等方式，确保实现对北京矽成的完全控制。

根据上市公司的发展规划，未来北京矽成仍将保持其作为独立的法人经营实体存续，并由其原核心管理团队继续经营管理，上市公司将在认真客观地分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，力争做到既能保持各自原有的竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。

④本次收购尚需履行的程序情况

在本次收购前，北京矽成私有化收购 ISSI 相关事项已于 2015 年通过 CFIUS 及台湾投审会的安全审查及批准，北京矽成及其下属境内外主体已为中资控股的企业。

考虑本次收购，上市公司尚需获得中国证监会的核准；同时，上市公司及北京矽成已就本次交易向 CFIUS 与台湾投审会提交自愿性申报，且 CFIUS 已于 2019 年 10 月完成对本次交易的安全审查。除上述审批事项、程序外，本次交易不涉及其他境内外有权机构的审批、许可或同意。上市公司将在上述审查过程中通过当地法律顾问与主管部门积极沟通，本次收购预期不会对北京矽成

在主要资产及业务所在国家和地区持续开展业务产生不利影响。

综上所述，综合考虑北京矽成在主要资产及业务所在国家和地区及业务资质情况、ISSI 私有化后业务持续发展、本次收购后北京矽成经营管理保持稳定以及本次收购尚需履行程序情况，本次收购预期不会对北京矽成在主要资产及业务所在国家和地区持续开展业务产生不利影响。

7、安全生产及环境保护情况

（1）安全生产情况

北京矽成主要从事集成电路的设计，不涉及生产环节，相关生产环节通过委托加工的方式进行。

（2）环保情况

北京矽成经营不会产生废水、废气、废渣和噪声等，对环境不会产生污染。

8、质量控制情况

（1）质量控制体系

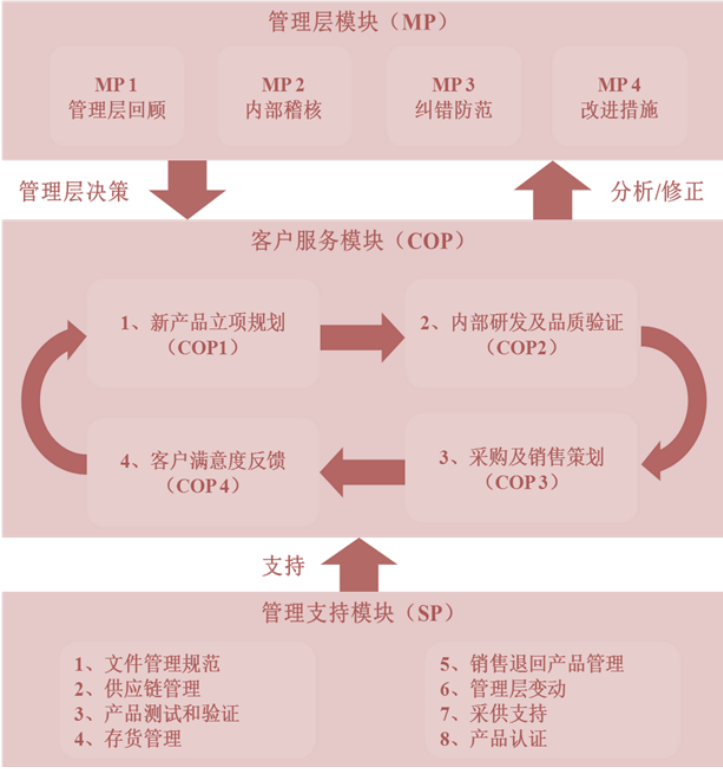
为保障产品质量达到各垂直行业的专业技术标准，满足各个客户要求，北京矽成设立了品质保障部门（QRA），负责北京矽成内部产品质量和可靠性的管理。品质保障部门同时结合北京矽成的质量管理体系（QMS），对基于产品研发、晶圆代工、封装代工、测试代工、品质验证及售后服务各环节形成的整套经营模式进行全程监控。

（2）质量管理体系及构成

在内部质量监管系统方面，北京矽成根据 ISO9001 和 TS16949 的标准开发了符合其经营特点的质量管理系统。品质保障部门在对北京矽成内部各部门工作监管时，以质量管理体系作为工作活动的规范，确保各部门的工作符合要求。质量管理体系不局限于对北京矽成内部工作活动的规范，还为晶圆厂和其他代工厂提供了产品质量的标准和依据。

北京矽成的质量管理体系主要由三部分组成，分别为客户服务模块（COP）、管理层模块（MP）和管理支持模块（SP）。其中核心模块为客户服务模块，本着以客户满意度为首的管理理念，在该模块中品质保障部门围绕从新产品立项规

划、内部研发及品质验证、采购及销售策划到客户满意度反馈四个环节对产品的品质做到全范围的跟踪和监控。管理层模块和管理支持模块则是为了进一步加强客户服务环节中对产品质量的管理。北京矽成的质量管理体系如下图所示：



（3）质量控制措施

为确保产品的质量、部门的规范性和质量管理体系的有效性，北京矽成制定了管理层模块和管理支持模块，作为加强质量管理体系的控制措施。

在管理层模块中，起着重要作用的有定期进行的内部稽核制度和管理层回顾会议。内部稽核制度是由经验丰富的资深稽核员牵头，每年会排定内部稽核计划，并严格按照计划进行稽核。对于不符合标准或者可以改善的情况，被稽核部门需要提出方案进行相应的改善。北京矽成也会对产品定期安排质量与可靠度的定期抽检，以确保产品的品质。同时，北京矽成管理层每季度也会联合各部门主管每季度召开管理层回顾讨论会议，旨在对报告中各个部门出现的问题进行分析及探讨改进的方案。

在管理支持模块中，品质保障部门不仅对内部的工作制定了相关规定，也对外部的供应链管理做到全程的管理。对于内部规定中最重要的文件管理规范，是通过结合北京矽成自身特点，由市场、研发、销售、运营、行政等各部门联合制

定的全套规范文件，该规范为各部门活动开展提供了流程依据，同时也记录和保存了各部门的报告，便于各部门间的查阅。对于外部提供代工服务的供应链，各部门每个月会联合对应供应商定期进行供应商审核会议，同时每年至少会对供应商排定一次年度稽核程序，根据每个供应商的产品品质、技术、产能、运输和成本进行评分，得分较低的供应商会被要求进行改善。

（4）产品质量纠纷情况

北京矽成非常重视客户的满意程度，在产品品质的质量控制上建立了覆盖到各经营环节的监管规范及管理措施，多年来一直遵守严格的质量管理标准。报告期内，北京矽成未发生过重大产品质量纠纷。

9、产品技术水平、核心技术人员及研发情况

（1）主要产品所采用的技术情况

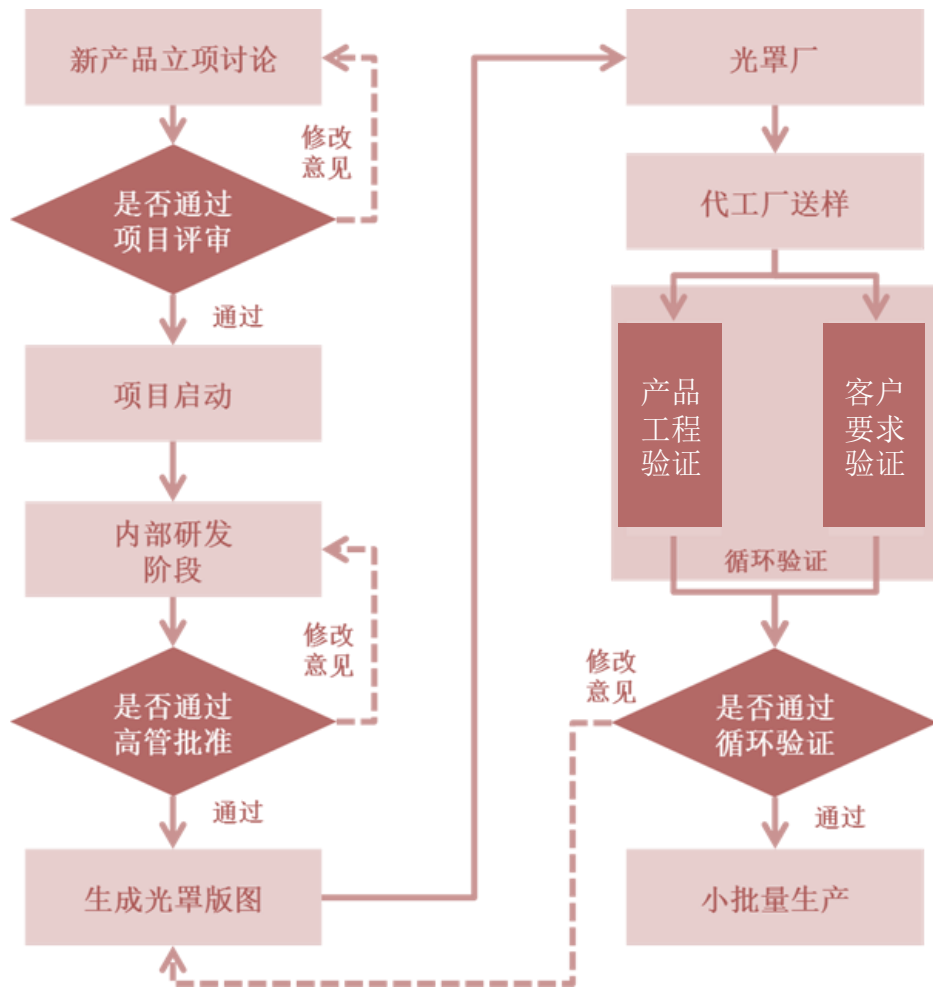
序号	核心技术	技术特点及先进性	所处阶段
1	带有 ECC 功能 DRAM	传统的系统级 ECC 解决方案是通过单独的 ECC 通道及 DRAM 颗粒，用于存储及恢复 ECC 编码，需要增加 8bit 的数据线来实现，占用一定引脚资源及 PCB 空间，北京矽成具有创新的带有片内 ECC 功能 DDR3，可以侦测及纠正位出错，客户在不需要做硬件或者软件更改即可采用，可提升系统的数据完整性、可靠性，帮助系统实现 ISO26262 所定义的功能安全。	产品处于送样状态，客户涵盖世界知名汽车高级驾驶辅助一级供应商
2	带有 ECC 功能 SRAM	北京矽成在业内前列推出具有 ECC 纠错功能的异步 SRAM 芯片，性能卓越、可靠性高，市场反响较好。芯片内置独立 ECC 单元，可进行比特位错误检测及错误纠正，能够避免软失效。该类产品广泛适应于汽车，医疗，工控及通讯领域。	产品处于量产状态，客户涵盖世界知名汽车，工控医疗客户等
3	带有 ECC 功能 FLASH	为了满足汽车电子客户对可靠性要求提升，公司开发了支持 ECC 功能的 SPI FLASH 产品。该产品内置 ECC 存储及逻辑单元，大幅提升存储可靠性，10 万次擦写后，数据保留超过 100 年，是普通 FLASH 的 10 倍。该产品支持双倍传输速率可达 66MHz，吞吐量 532Mb/s，在 DTR 操作模式下具有数据学习功能，适应于智能座舱，ADAS，自动驾驶等安全相关产品，帮助客户实现 ISO26262 功能安全目标。	产品处于量产状态，客户涵盖世界知名一级供应商

序号	核心技术	技术特点及先进性	所处阶段
4	灯效驱动技术	产品系列采用的相关灯效控制架构和技术性能均居业界领先地位，可提供 40 多款产品组合，满足客户应用需求。	产品处于量产状态，并广泛地用于国内外众多知名客户产品中。例如智能音箱，游戏设备，家电产品，IOT 物联网产品等
5	汽车照明驱动技术	IS32LT 产品系列技术采用世界领先高品质高压晶圆厂工艺，采用严苛的汽车等级产品设计和生产品质管理流程，有多款能够通过严苛 AEC-Q 汽车等级测试的专业汽车照明驱动芯片厂家。同时公司也在积极导入满足最新汽车安全功能安全等级管理 ISO26262 设计流程开发更多更高安全等级的汽车照明驱动设计。	产品处于量产状态，并广泛地用于国内外众多知名汽车厂电子商的车内外照明模组产品中，其终端汽车客户厂商包括通用，大众，吉利，尼桑等知名汽车企业
6	网络通信技术	ISSI 是 HPNA 的成员，拥有基于 G.hn 技术的系列芯片，支持家庭网络通信，视频监控，电网通讯等多种应用。	产品处于量产状态，用于世界各地的服务于家庭网络通讯、电网、视频监控产品的供应商

（2）研发模式

北京矽成的主要产品集成电路存储芯片以及模拟芯片在产品质量和性能上有着较高的市场认可度，这受益于北京矽成一整套科学、规范的研发流程。从最初的新产品立项讨论、设计标准检验，经过客户以及工程部对产品规格和性能的循环检验，直至最后产品开始小规模生产，北京矽成缜密而严格的研发管理体系，确保了产品从设计到量产的过程中，每一个重要环节都得到有效的控制和管理，最终通过客户的不断验证，获得市场的认可。

北京矽成的研发流程如下：



①立项讨论阶段

在新产品立项阶段，首先会由市场部搜集主要客户的产品要求，在规格、性能、成本和需求量方面进行了解，同时综合技术发展趋势、竞争对手产品研究、未来市场供需预测等因素制作初步报告。之后在每月例行的产品规划会议中，市场部联合设计工程师根据讨论新产品的规划方向，制定新产品的产品规格和性能特征，再交由设计部门进行新产品的的项目可行性分析，最终由设计团队负责人决定是否通过项目评审，启动项目。

②内部研发阶段

每个新产品项目将会被分配至不同产品线的设计工程团队中的不同设计小组，由设计小组组长、产品设计团队负责人、设计部门负责人分别对产品研发的日程进度以及阶段性成果做逐层向上的管控。同时对于研发进程中可能会遇到的技术障碍和难点问题，设计部有着灵活的协调研讨会议制度，通过协调研发部内部资源，组织具有丰富经验的设计工程师互动讨论，促进项目研发工作的实施。

在设计工程师根据项目启动时指定的产品规格及性能特征基本完成新产品的开发设计后，会由技术工程师进行分析，评估在未来生产阶段最合适的代工晶圆厂。在通过技术工程师的评估环节后，市场部会对整个新厂品项目做完整的ROI分析，评估整个项目的投资回报情况。最后在得到项目决策委员会的高管批准后，生成产品的物理图版，交由光罩厂制作光罩。

③循环验证阶段

经过指定的晶圆代工厂生产以及封装厂、测试厂的加工，测试部及产品部将对代工厂送来的产品样品进行循环验证，循环验证主要分为两部分，分别为产品工程验证和客户要求验证：

A.产品工程验证是由封装工程师和测试工程师在品质保障部门的可靠性工程师的协助下，对产品进行品质测试、特征测试、可靠性测试、压力测试、失效分析、阿尔法测试和贝塔测试等一系列严格而高标准的检测。

B.客户要求验证是由产品工程师从产品的工作特征可靠性以及工艺稳定性性能的角度出发，检测新产品是否满足客户对于芯片产品在整机组装后的工作表现，如果检测结果未达标，需要同客户一起分析可能的原因，并反馈给设计工程部。

若经过产品工程验证及客户要求验证后，有任何一项未达到产品的性能和特征要求或是未能满足客户的要求，设计工程师需要对产品设计或是工艺材料做重新调整，并对物理图版做修改，对收到的新样品再次进行产品工程验证及客户要求验证直至完全满足要求。

④小批量产、大批量产阶段

研究部门负责人和北京矽成高管最终参考产品循环验证报告，同时结合市场部及质量控制部的意见，对产品是否投入生产阶段做决定性意见。在产品投入小批量生产一段时间，且良品率达到北京矽成的标准后，产品会转入大批量生产。

（3）主要产品研发项目进展情况

①截至2019年5月31日，DRAM及SRAM存储芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示：

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	终端市场
1	K101	25nm 制程, 8Gb DDR3 (x8/x16)	大批量产	汽车、工业、通讯
2	K095	25nm 制程, 2Gb DDR3 (x8/x16)	大批量产	汽车、工业、通讯
3	K096	25nm 制程, 4Gb DDR3 (x8/x16)	大批量产	汽车、工业、通讯
4	K093	25nm 制程, 1Gb DDR3 (x8/x16)	工程样片	汽车、工业、通讯
5	K103	25nm 制程, 8Gb DDR4 (x8/x16)	设计规划	汽车、工业、通讯
6	N312	25nm 制程, 2Gb LPDDR4 + ECC	设计规划	汽车、工业、通讯
7	N313	25nm 制程, 2Gb LPDDR2/1	设计规划	汽车、工业、通讯
8	N509	38nm 制程, 256M Hyper/OctaRAM	工程样片	汽车、工业、通讯
9	N510	38nm 制程, 32Mb/16Mb Serial SRAM	设计规划	汽车、工业、通讯、消费

②截至 2019 年 5 月 31 日, FLASH 存储芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示:

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	终端市场
1	FKK257A0	65nm 制程, 256Mb SPI/QPI FLASH 3.3V/1.8V	设计规划	汽车、工业、通讯、消费
2	FKK047A0	65nm 制程, 4Mb SPI/QPI FLASH 3.3V/1.8V	设计规划	汽车、工业、通讯、消费
3	FMW527A	50nm 制程, 512Mb SPI/QPI FLASH 3.3V/1.8V	设计规划	汽车、工业、通讯、消费
4	FMK646A0	65nm 制程, 64Mb Parallel FLASH 并行	设计规划	汽车、工业、通讯、消费
5	FMD254A0	65nm 制程, 256Mb Octal FLASH	设计规划	汽车、工业、通讯、消费
6	FMW524A	50nm 制程, 512Mb Octal FLASH	设计规划	汽车、工业、通讯、消费

③截至 2019 年 5 月 31 日, ANALOG 芯片业务主要产品研发进展情况如下表所示:

序号	在研产品名称	拟达到规格	目前进度	终端市场
1	212x series	Mono/Stereo Class D, 0.15 BCD, 单声道、立体声 class D, 0.15 微米 BCD 工艺	小批量产	汽车、工业
2	3361/395x	Switching LED driver 交换式	小批量产	汽车、工业
3	374x	Linear matrix LED driver 线性矩阵	大批量产	汽车、消费

4	316x	Hall sensor + LED	开发阶段	汽车、工业
5	511x	Touch and proximity sensor 触控	风险量产	汽车、工业
6	672x	10G fiber communication 光纤通信控制器 controller	工程样片	通讯

（4）核心技术人员情况

①核心技术人员基本情况

北京矽成作为半导体集成电路的设计公司，具有专用领域领先的研发实力，在全球主要科技发达地区都有研发团队驻扎，主要分布在美国圣荷西、科罗拉多、韩国首尔、中国大陆等地区。同时，北京矽成在研发人员的培养与激励方面具有较为完善的制度支撑，经验丰富的研发团队是北京矽成保持持续竞争力的主要来源。截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成共有研发人员 223 人，占员工总数比例为 44.07%。

北京矽成高度重视研发技术人员的培养以及核心技术团队的稳定性，各产品研发团队核心成员的流动性较低。

②核心技术人员简历

Pailu Wang，技术发展副总裁，明尼苏达大学博士，曾就职于 Micron Technology、Integrated Device Technology、G-LINK Technology 等，在半导体领域拥有超过 30 年的行业专业经验，1998 年至今任 ISSI 技术发展副总裁。

Seong JunJang，设计副总裁，庆北国立大学学士，曾就职于 Hynix 等，在半导体领域拥有超过 30 年的行业专业经验，1996 年起任 ISSI 设计工程师、设计总监、设计副总裁。

Kyoung ChonJin，设计副总裁，韩国崇实大学学士，曾就职于 Hynix、PMC、Spansion 等，在半导体领域拥有超过 20 年的行业专业经验，2015 年至今任 ISSI 设计副总裁。

Paul J Song，总工程师，斯坦福大学博士，曾就职于 AMD、EXEL 等，在半导体领域拥有超过 30 年的行业专业经验，1981 年起任 ISSI 设计总监、总工程师。

Chung K.Chang，总工程师，康奈尔大学硕士，曾就职于 Hewlett Packard、

AMD、Eon Silicon Devices、Hyundai Electronics America 等，在半导体领域拥有超过 20 年的行业专业经验，2001 年起任 ISSI 工程副总裁、总工程师。

Kookhwan Kwon，存储设计总监，庆北国立大学学士、三星工程硕士，曾就职于 Mosel Vitelic Corporation、三星、索尼等，在半导体领域拥有超过 20 年的行业专业经验，2008 年起任 ISSI 存储设计总监。

③公司拟保障核心技术人员稳定性以及勤勉尽责的措施

北京矽成作为集成电路设计企业，产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用，其核心员工来自于全球，同时中国也有 DRAM、SRAM、Embedded FLASH 和 ANALOG 的核心技术人员和研发团队。目前，北京矽成及其重要子公司拥有一批研发能力突出的核心人员，同时相关人员拥有多年的行业经验，对产品研发及客户需求有着深刻的理解，具有较强的竞争优势。为保证北京矽成核心技术人员稳定及勤勉尽责，上市公司与交易对方协商达成相关措施如下：

A. 本次交易在不改变北京矽成现有员工结构的前提下进行整合

根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》，本次交易涉及北京矽成股东变动，并不涉及北京矽成聘用人员劳动关系的调整变更。本次交易完成后，北京矽成将作为上市公司的全资子公司继续存续并独立运营，上市公司将保留北京矽成的管理团队并在日常管理中给予其一定独立运营权，以激发其主观能动性，努力完成既定目标。同时，上市公司将通过董事会和股东会的周期性监督、决策机制，对北京矽成战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对员工的行为和绩效给予校正和评价。

上市公司将通过实施有效的企业文化整合计划，提倡相互尊重并理解各自的文化背景，促进团队成员在交流、组织、决策时具备全球化思维和视角，进而形成相互包容、相互信任的企业文化基础。另外，上市公司将谨慎地制定公司层面的沟通机制和有针对性的培训计划，确保降低误解风险，提高各级员工相互理解的能力，并保证在组织中各类信息的顺畅沟通和传达。

B. 北京矽成具备规范成熟的人力资源管理机制，历史期核心技术人员保持稳定且勤勉尽责

北京矽成下属经营实体 ISSI 于 1995 年在美国纳斯达克上市，具有规范成熟的人力资源管理机制，在员工的激励、沟通、培养等方面具有较为完善的制度支撑，具体如下：

在员工的激励方面，北京矽成对其核心人员实行具有市场竞争力的薪酬制度和奖励制度。其中，ISSI 于 2007 年开始实施股权激励计划，包括股票期权、股票增值权、限制性股票和红股等多种方式。ISSI 私有化收购完成后，由于其股票不具有二级市场交易价格，北京矽成将前期 ISSI 未实施的股权激励计划金额转化为持有北京矽成股票的股权激励以及现金激励计划。

在员工的沟通方面，北京矽成一贯保持决策和执行层面顺畅的沟通交流、高效的工作效率、强烈的团队精神为理念的管理风格，保障了其核心技术团队在历史以及未来维持持续稳定的结构。

在员工的培养方面，北京矽成为不同职级、不同类型的员工提供了完善的职业发展道路以及培训发展计划，保证员工在工作的同时获得工作能力的不断提升。北京矽成在集成电路存储芯片行业位居市场前列，并积极进行技术革新、业务拓展与产品更新，为核心技术人员的职业发展提供完善的平台。在北京矽成的发展过程中，每年北京矽成都会根据市场需求研制未来汽车和工业市场需要的芯片产品，研发新的技术。公司的财务状况一直能够支撑技术的演进，对保留核心技术人员起到了重要的作用。本次交易完成后，上市公司将在保持北京矽成内部管理制度的前提下继续为员工提供上升渠道和提升空间。

同时，北京矽成高度重视研发技术人员的培养以及核心技术团队的稳定性，在前期 ISSI 纳斯达克退市及后续重组过程中，核心技术人员均保持稳定且勤勉尽责，业务发展良好。

C. 本次交易后上市公司将继续加大优秀人才引进及培养力度，充实北京矽成核心技术人员储备

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》提出的思想，集成电路企业需要加强与境外研发机构的合作，加大针对海外优秀企业家和高素质技术、管理团队的引进力度，完善鼓励创新创造的分配激励机制，以此扩大国际合作、整合国际资源、拓展国际市场，实现我国集成电路产业的跨越式发展。本次交易完成后，北

京矽成将成为上市公司全资子公司，平台及资源将更加丰富，上市公司也将在人才选聘、激励机制、考核机制等方面继续对北京矽成进行指导，并通过市场化手段，借助外部招聘、内部选拔等方式，积极帮助北京矽成培养和引进存储芯片研发设计领域的高端研发人才，降低北京矽成人员流失风险。

综上所述，本次交易在不改变北京矽成现有员工结构的前提下进行整合，北京矽成自身具备规范成熟的人力资源管理机制且历史期核心技术人员保持稳定且勤勉尽责，核心技术人员稳定性较强。本次交易后上市公司也将继续加大优秀人才引进及培养力度，充实北京矽成核心技术人员储备，降低人员流失风险。

（5）北京矽成与核心技术人员、研发人员劳动合同签署情况

①关于劳动合同的签订情况

根据北京矽成提供的书面说明及确认，截至 2019 年 9 月 30 日，北京矽成及其子公司共拥有核心技术人员 6 人，该等人员在 ISSI 任职，均与 ISSI 签署了统一的《保密信息、发明转让和仲裁协议》（《CONFIDENTIAL INFORMATION, INVENTION ASSIGNMENT AND ARBITRATION AGREEMENT》，下同）及关于确认收到《ISSI 商业行为守则》（《ISSI Standards of Business Conduct》，下同）、《ISSI 员工手册》（《ISSI US EMPLOYEE HANDBOOK》，下同）的确认函。

根据北京矽成提供的书面说明及确认，截至 2019 年 9 月 30 日，北京矽成及其子公司共拥有研发人员 233 人，其中，103 人为中国大陆地区员工，均依据中国大陆地区法律法规与任职公司签署了统一的《劳动合同》，其余研发人员任职于北京矽成位于美国、以色列、韩国等国家和地区的子公司，均与所任职公司签署了统一的《保密信息、发明转让和仲裁协议》及关于确认收到《ISSI 商业行为守则》《ISSI 员工手册》的确认函。

②关于保障核心技术人员、研发人员稳定性的条款设置

根据北京矽成及其子公司与中国大陆地区研发人员签署的《劳动合同》及其附件，约定“合同期限”“不得招揽”“劳动合同的续订”“利益冲突准则”等条款，并以《保密信息与发明转让协议》作为附属协议。

根据该等《劳动合同》关于“劳动合同的修改、解除、期满和续订”的约

定，“员工若需解除聘用关系，应提前三十(30)天以书面形式通知公司”“本合同到期前，双方均可以口头或书面提出续签或终止的通知”“本合同期满后，若双方均未就续签或终止提出通知，则视作本合同到期后自然续签”。

根据北京矽成核心技术人员及非中国大陆地区研发人员签署的《保密信息、发明转让和仲裁协议》及收到《ISSI 商业行为守则》《ISSI 员工手册》的书面确认函，约定聘用关系无固定期限，并约定/规定“保密（CONFIDENTIALITY）”“发明转让（Assignment of Inventions）”“冲突义务（CONFLICTING OBLIGATIONS）”“公司资料归还（RETURN OF COMPANY MATERIALS）”等条款。

根据该等《保密信息、发明转让和仲裁协议》及《ISSI 员工手册》，合同双方均有权在任何时候、基于任何理由终止劳动关系，而无需提前通知对方；对于主动离职的员工，北京矽成鼓励该等员工至少提前两周（最好以书面形式）通知公司，以给公司合理的时间安排后续工作。对于善意地从公司离职的员工，将符合公司未来重新录用的条件。

（6）报告期内北京矽成核心技术人员、研发人员变化情况

报告期内，北京矽成核心技术人员 Pailu Wang、Seong JunJang、Kyoung ChonJin、Paul J Song、Chung K.Chang 及 Kookhwan Kwon 均持续在北京矽成任职，未发生变化。

报告期内，北京矽成的研发人员变化情况如下：

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
期初研发人员数量	223	163	164
期间入职数量	11	82 ^注	12
期间离职数量	3	22	13
期末研发人员数量	231	223	163

注：包含因收购 ISSI(Israel)和 Chiefmax(BVI)分别新增的研发人员 33 人、16 人。

综上所述，报告期内北京矽成核心技术人员均持续在公司任职，未发生变化；研发人员除因收购 ISSI(Israel)及 Chiefmax(BVI)而导致研发人员新增外，整体变动较小，相对保持稳定。

（7）本次交易对北京矽成核心技术人员、研发人员稳定性的影响

本次交易完成后，北京君正直接及间接持有北京矽成 100% 股权，北京矽成将被纳入上市公司管理体系。北京君正作为其股东，将根据《公司法》等适用法律法规修改北京矽成公司章程，并有权决定北京矽成一切重大事项，包括董事会成员任免、高级管理人员选聘等。为北京矽成现时业务和长远发展之目的，北京君正将最大限度保持北京矽成现有核心管理团队稳定。具体请参见“本次交易后上市公司能够对标资产实现有效控制”。

根据公司的书面说明与确认，本次交易不涉及北京矽成及其子公司的员工劳动关系调整或变更，同时本次交易完成后，上市公司将采取如下措施确保核心技术人员和研发人员的稳定性：

“（1）支持北京矽成独立自主经营并继续实施原有保持核心技术人员和研发人员的相关稳定措施

“本次交易完成后，虽然上市公司将通过修改章程、改组董事会及规范公司管控机制等方式确保对北京矽成形成有效控制，但上市公司将继续尊重北京矽成的独立法人地位，不会以股东名义直接干预北京矽成的日常生产经营活动，确保北京矽成管理团队保持相对独立的自主经营权。同时，上市公司会延续实施北京矽成原有保持核心技术人员和研发人员稳定的相关措施，并借助上市公司平台和成熟的管理体系，完善北京矽成原有技术研发人员培养与培训机制，形成更加有效的福利制度与体系，保持现有核心技术人员和研发人员的稳定。

“（2）北京矽成员工持股平台将在本次交易项下取得上市公司股份并作出了股份锁定安排

“本次交易项下，上市公司与北京矽成员工持股平台等交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，北京矽成员工持股平台因本次交易取得上市公司股份并同时应遵循相应股份锁定安排。本次交易方案及股份锁定安排体现了北京矽成核心技术人员、研发人员与上市公司利益的一致性，有利于保障北京矽成核心技术人员与研发人员的稳定性。

“（3）上市公司将对北京矽成核心技术人员与研发人员适时实施奖励和激励

“本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，上市公司在

制定员工激励方案和计划时，将把北京矽成的核心技术人员与研发人员纳入考核和激励范围。一方面上市公司支持北京矽成制定和执行其自身的考核激励办法，使北京矽成业绩增长惠及核心技术人员与研发人员；另一方面上市公司也将利用上市平台的多样化激励手段和措施，在业绩考核基础上，对北京矽成的核心技术人员与研发人员予以奖励和激励。

“(4) 上市公司将与北京矽成开展和实施企业文化整合

“本次交易完成后，上市公司拟开展和实施企业文化整合，提倡相互尊重并理解各自文化背景，促进团队成员在交流、组织、决策时具备全球化思维和视角，形成相互包容、相互信任的企业文化基础。另外，上市公司将谨慎地制定公司层面的沟通机制和有针对性的培训计划，降低和消除误解风险，提高各级员工相互理解的能力，确认在组织中各类信息的顺畅沟通和传达。”

综上所述，本次交易不涉及北京矽成及其子公司员工劳动关系的调整变更。本次交易完成后，北京君正直接及间接持有北京矽成 100% 股权，在将北京矽成纳入上市公司管理体系的基础上，仍将确保其现有公司治理及生产经营安排的延续性和稳定性，并采取系列措施确保其核心技术人员和研发人员的稳定。因此，本次交易不会对北京矽成核心技术人员、研发人员的稳定性造成重大不利影响。

（九）北京矽成报告期内主要财务数据及非经常性损益的构成情况

1、主要财务数据

根据信永中和会计师出具的北京矽成审计报告，北京矽成报告期内经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产合计	288,526.86	292,291.55	215,328.74
非流动资产合计	375,493.12	363,693.14	386,499.70
资产总计	664,019.98	655,984.69	601,828.44
流动负债合计	59,491.04	59,760.07	52,824.79
非流动负债合计	15,783.58	14,512.77	14,143.85
负债合计	75,274.63	74,272.84	66,968.63

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
所有者权益合计	588,745.35	581,711.84	534,859.81
项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
营业收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
营业成本	77,823.76	185,902.30	158,147.56
利润总额	9,114.72	28,383.39	17,077.09
净利润	7,405.58	24,502.14	6,005.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7,284.05	24,101.47	5,770.34

2、主要财务指标

北京矽成报告期内主要财务指标如下：

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	4.85	4.89	4.08
速动比率	3.01	3.14	2.82
资产负债率	11.34%	11.32%	11.13%
项目	2019年1-5月	2018年	2017 年
总资产周转率（次/年）	0.42	0.46	0.41
应收账款周转率（次/年）	6.33	7.05	6.31
存货周转率（次/年）	1.61	1.95	2.31
息税折旧摊销前利润（万元）	14,719.93	41,117.33	30,759.44
利息保障倍数	-	631.78	169.59

注：以上指标计算公式如下：

- 1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 2、速动比率=（期末流动资产-期末存货净额）/期末流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、总资产周转率=2*营业收入/（期初总资产+期末总资产）
- 5、应收账款周转率=2*营业收入/（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）
- 6、存货周转率=2*营业成本/（期初存货账面余额+期末存货账面余额）
- 7、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出-利息收入
- 8、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
- 9、2019 年 1-5 月的上述指标计算中，营业收入、营业成本以年化测算

3、非经常性损益情况

根据经信永中和会计师事务所审计的北京矽成财务报告，北京矽成报告期内经审计的非经常损益明细如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
非流动资产处置损益	-3.64	5.30	52.20
计入当期损益的政府补助	60.14	186.70	94.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63.06	263.84	148.26
小计	119.56	455.83	295.07
所得税影响额	22.17	67.28	48.86
少数股东权益影响额（税后）	-0.02	1.08	0.79
归母非经常性损益净额	97.37	387.47	245.43

北京矽成非经常性损益具体分析请参见“第九章 管理层讨论分析”之“三、北京矽成的财务分析”之“（三）盈利能力分析”之“6、非经常性损益分析”。

（十）主要会计政策及会计处理

1、收入的确认原则和计量方法

（1）销售商品收入

北京矽成在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、主要会计政策和会计估计与同行业或同类资产及上市公司之间差异情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，北京矽成所属行业为“C 制造业”下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据经信永中和审计(《审计报告(XYZH/2019BJA90485)》)的北京矽成 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-5 月期间的财务报告，北京矽成的会计政策和会计

估计与同行业或同类型资产及上市公司不存在重大差异。

北京矽成与上市公司在应收款项坏账准备计提政策方面存在一定差异。

（1）上市公司坏账准备计提政策具体如下：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额大于等于 100 万元、其他应收账款单项金额大于等于 100 万元的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，在有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	计提方法
单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项	账龄分析法
其他的应收款项以账龄特征划分若干应收款项组合	账龄分析法

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0	1 年以内 5%
7 至 12 个月	5%	
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	80%	80%
4 年以上	100%	100%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

（2）北京矽成应收款项的坏账计提政策为：

北京矽成将期末余额达到 300.00 万元（含 300.00 万元）以上的应收款项作为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项按照以下坏账政策计提：

单项计提坏账准备的理由	将单项金额不重大的债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项以及单项金额不重大的其他应收款进行单项测试计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据历史经验个别认定法。

北京矽成历史客户信用情况良好且应收账款的实际损失情况很低，未按照风险特征组合计提坏账准备。

该差异对净利润及净资产无重大影响。

3、财务报表编制基础及合并财务报表范围、变化情况变化原因

北京矽成的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定以及财务报告所附会计政策和会计估计编制。

根据经信永中和审计(《审计报告(XYZH/2019BJA90485)》)的北京矽成 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-5 月期间的财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成将以下公司纳入合并财务报表合并范围：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）	
				直接	间接
1	上海闪胜集成电路有限公司	中国上海	中国上海	100	-
2	Uphill Technology Inc.	开曼群岛	开曼群岛	100	-
3	Integrated Silicon Solution, Inc.	美国	美国	100	-
4	Si En Integrated Holdings Limited	开曼群岛	开曼群岛	100	-
5	Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc.	开曼群岛	开曼群岛	100	-
6	Chingis Technology Corporation	美国	美国	-	100
7	Chiefmax Venture LTD.	英属维京群岛	英属维京群岛	-	100
8	武汉群茂科技有限公司	中国武汉	中国武汉	-	100
9	矽恩微电子（厦门）有限公司	中国厦门	中国厦门	-	100
10	Enchida International Limited	中国香港	中国香港	-	100
11	Enable Korea Co., Ltd	韩国京畿道城南市	韩国京畿道城南市	-	100
12	Integrated Silicon Solution, Inc. (Singapore) Pte. Limited	新加坡	新加坡	-	100

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）	
				直接	间接
13	ISSI Hong Kong Holding Limited.	中国香港	中国香港	-	100
14	ISSI Japan Good Kaisha	日本东京	日本东京	-	100
15	矽成积体电路股份有限公司	中国台湾	中国台湾	-	98.39
16	芯成积体电路（香港）有限公司	中国香港	中国香港	-	99.9951
17	芯成半导体（上海）有限公司	中国上海	中国上海	-	100
18	Integrated Silicon Solution Israel Ltd	以色列	以色列	-	100
19	Winston Inc.	-	美国	-	100
20	Sofwin Inc.	-	美国	-	100

报告期合并报表范围变化情况及原因如下：

（1）非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本（万美元）	股权比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
ISSI (Israel)	2018/2/15	2,524.91	100	现金	2018/2/15	完成股权交割
Chiefmax Venture LTD. ^注	2018/3/11	347.42	100	现金	2018/3/11	完成股权交割

注：主要经营主体为武汉群茂科技有限公司。

（2）注销子公司

序号	公司名称	注销时间
1	Integrated ANALOG Solution (Cayman), Inc.	2018 年
2	Integrated Memory Solution (Cayman), Inc.	2018 年
3	ANALOGy Circuit Solution (Cayman), Inc.	2018 年
4	Memory Circuit Solution (Cayman), Inc.	2018 年

（十一）资质证照情况

截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成及其下属企业拥有的资质证书如下：

序号	单位名称	证书名称	证书编号	发证日	有效期
1	矽恩微电子（厦门）	高新技术企业证书	GR201835100565	2018/12/03	三年
2	矽恩微电子（厦门）	技术先进性服务企业证书	JF20183502000004	2018/11/27	三年
3	芯成半导体（上海）	技术先进性服务企业证书	JF20143101150155	2015/01/14	2018/12/31

注：芯成半导体（上海）的技术先进型服务企业证书已于 2018 年 12 月 31 日到期，需要进行重新认定。

（十二）涉及立项、环保等有关报批事项

本次交易标的资产为北京矽成 59.99%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。

（十三）拟购买资产为股权的说明

1、购买资产股权出资及合法存续情况

截至本报告书出具日，北京矽成不存在出资瑕疵或影响合法存续的情况。

2、关于交易标的是否为控股权的说明

本次交易的标的资产为北京矽成 59.99%的股权及上海承裕 100%财产份额（持有北京矽成 40.01%股权），本次收购北京矽成股权系控股股权。

3、关于交易标的是否取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件的说明

截至本报告书出具日，北京矽成现行有效的公司章程存在股权转让设置前置条件。北京矽成公司章程的股权转让前置条件详见本节“一、交易标的之北京矽成”之“（四）北京矽成股权结构及控制关系情况”之“3、北京矽成章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或其他相关投资协议”。

（十四）北京矽成最近三年股权转让、增资及评估情况说明

1、最近三年的股权转让、增资情况

（1）最近三年北京矽成增资和股权转让时的作价情况

最近三年，北京矽成共发生两次增资和四次股权转让，所涉及的北京矽成作价情况列示如下：

工商变更 时间	增资方	增资认缴出资额 (万元)	增资金额 (万元)	每 1 元增 资额价格 (元)	北京矽成 100%股 权的作价 (亿元)
2016 年 7 月	上海承裕	19,906.25	197,813.61	9.94	49.69
	屹唐投资	13,781.25	136,974.45	9.94	49.69

	华清闪胜		7,656.25		76,096.92	9.94	49.69
	华创芯原		7,656.25		76,096.92	9.94	49.69
小计			49,000.00		486,981.90	-	-
2016 年 8 月	闪胜创芯		1,966.95		19,200.00	9.76	50.73
小计			1,966.95		19,200.00	-	-
工商变更时间	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让出资占注册资本的比例	转让对价（万元）	每 1 元出资转让价格（元）	北京矽成 100%股权的作价（亿元）
2017 年 5 月	华清闪胜	屹唐投资	5,249.66	10.10%	53,821.67	10.25	53.28
		上海承裕	2,122.96	4.09%	21,765.43	10.25	53.28
		民和志威	439.88	0.85%	5,386.73	12.25	63.64
小计			7,812.50	15.03%	80,973.83	-	-
2017 年 6 月	华创芯原	民和志威	1,598.98	3.08%	20,000.00	12.51	65
小计			1,598.98	3.08%	20,000.00	-	-
2018 年 4 月	上海承裕	WM	387.27	0.75%	4,843.98	12.51	65
		AM	50.37	0.10%	629.99	12.51	65
	屹唐投资	WM	333.36	0.64%	4,169.63	12.51	65
		AM	43.36	0.08%	542.29	12.51	65
	华创芯原	WM	107.26	0.21%	1,341.54	12.51	65
		AM	13.95	0.03%	174.48	12.51	65
小计			935.56	1.80%	11,701.91	-	-
2018 年 5 月	上海承裕	上海瑾矽	1121.97	2.16%	14,033.53	12.51	65
		厦门芯华	38.83	0.07%	485.68	12.51	65
		WM	45.12	0.09%	564.38	12.51	65
	屹唐投资	上海瑾矽	965.78	1.86%	12,079.88	12.51	65
		厦门芯华	33.42	0.06%	418.07	12.51	65
		WM	38.84	0.07%	485.81	12.51	65
	华创芯原	上海瑾矽	310.73	0.60%	3,886.59	12.51	65
		厦门芯华	10.75	0.02%	134.51	12.51	65
		WM	12.5	0.02%	156.31	12.51	65
小计			2,577.94	4.96%	32,244.76	-	-

(2) 上述增资和股权转让时北京矽成作价情况是否构成股份支付

①股份支付的相关规定

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。

根据规定，股份支付具有以下特征：（1）股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；（2）股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易；（3）股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

②增资和股权转让时北京矽成作价情况不构成股份支付

北京矽成最近三年发生的上述四次股权转让和两次增资中，北京矽成的作价情况不构成股份支付，具体情况如下：

2016 年 7 月对北京矽成的增资系扩充北京矽成资本金安排、各股东同比增资所致。本次增资时各股东均为私有化时的财团，非北京矽成相关的员工或为北京矽成提供服务的其他相关方，本次增资不是以获取职工或其他方服务为目的，因此，本次增资不构成股份支付。

2016 年 8 月对北京矽成的增资系为北京矽成资本运作及引入战略投资者进行的相应安排。增资方闪胜创芯非北京矽成相关的员工，亦非为北京矽成提供服务的其他相关方，本次增资不是以获取职工或其他方服务为目的，其增资对价系双方协商确定，因此，本次增资不构成股份支付。

2017 年 5 月华清闪胜将北京矽成合计 15.03%股权转让予屹唐投资、上海承裕和民和志威，系私有化财团之一华清闪胜出于退出目的做出的安排。受让方屹唐投资、上海承裕为私有化时的财团成员，民和志威为其他第三方投资者，受让方均非北京矽成相关的员工，亦非为北京矽成提供服务的其他相关方，本次股权转让不是以获取职工或其他方服务为目的，且转让价格系交易各方协商确定。因此，本次股权转让不构成股份支付。

2017 年 6 月华创芯原将北京矽成 3.08%股权转让予民和志威，系私有化财团之一华创芯原出于提前获得部分退出收益所做出的安排，受让方民和志威为第三方投资者，非北京矽成相关的员工，亦非为北京矽成提供服务的其他相关

方，本次股权转让不是以获取职工或其他方服务为目的，且转让价格系交易双方协商确定。因此，本次股权转让不构成股份支付。

2018年4月上海承裕、屹唐投资、华创芯原合计将北京矽成1.80%股权转让予WM和AM，系北京矽成出于激励境外人员的安排，本次股权转让对应北京矽成100%股权作价为65亿元。ISSI于私有化后开始筹划激励事项，2017年8月北京矽成董事会决议进行员工激励计划。根据2017年6月华创芯原转让予民和志威3.08%股权时对应北京矽成100%股权作价（65亿元），以及2017年4月兆易创新收购北京矽成100%股权作价（65亿元），本次转让作价充分参考了上述同时期北京矽成的估值作价情况，对价公允，不构成股份支付。（本次股权转让中，WM和AM的资金系北京矽成以奖励计划的形式向其提供，北京矽成根据激励人员的服务条件满足情况分别于2017、2018、2019年按照40%、30%、30%的比例计提了股份支付费用，该股份支付非因北京矽成股权转让时的估值作价差异产生。）

2018年5月上海承裕、屹唐投资、华创芯原合计将北京矽成4.96%股权转让予上海瑾矽、厦门芯华、WM系出于引入新投资者、激励境内外人员的安排，对应北京矽成100%股权的作价为65亿元。本次转让事宜已于2018年1月经北京矽成董事会决议通过，且充分参考了前次激励安排、兆易创新收购北京矽成股权以及2017年6月华创芯原转让股权时的作价情况，对价公允，不构成股份支付。（本次股权转让中，厦门芯华和WM作为境内外平台以其出资人自有/自筹资金支付股权转让款，非通过北京矽成实际支付，不产生股份支付费用。）

（3）上述增资和股权转让的交易作价与本次交易作价的差异及合理性

①本次交易作价情况

本次交易中北京矽成的作价系参考东洲评估出具的评估报告，经上市公司与交易对方协商一致后确定，北京矽成100%股权的作价确定为72亿元。东洲评估的评估结论系基于北京矽成历史经营情况及管理层制定的盈利预测，以收益法作为最终评估结果。

②历次增资和股权转让的交易作价与本次交易作价的差异及合理性

上述各次增资和股权转让中，北京矽成的交易作价与本次交易作价存在差异，主要原因如下：

2016年7月北京矽成各股东方同比例增资及2016年8月引入闪胜创芯时的作价，系参考私有化成本进行。2017年5月华清闪胜向屹唐投资、上海承裕的转让系私有化股东之间的转让，其定价估值参考私有化成本加一定的资金成本。私有化时与本次交易在行业发展背景、北京矽成运营情况均出现了变化，具体请参见“本次作价整体估值相比私有化时期增长的合理性”。因此，上述交易作价与本次交易作价差异具有合理性。

2017年5月华清闪胜向民和志威转让北京矽成股权时北京矽成作价为63.64亿元，2017年6月华创芯原向民和志威转让北京矽成股权，2018年4月上海承裕、屹唐投资、华创芯原向WM和AM转让股权，以及2018年5月上海承裕、屹唐投资、华创芯原向上海瑾矽、厦门芯华、WM转让股权时，北京矽成作价为65亿元，主要系结合行业前景、市场背景及北京矽成的未来发展综合考虑，且充分参考了彼时兆易创新收购北京矽成时的评估作价。兆易创新收购北京矽成时的作价与本次交易作价存在差异，主要系集成电路行业发展迅速，且北京矽成的财务状况较兆易创新拟收购时有明显提高。因此，上述交易作价与本次交易作价差异具有合理性。

2、最近三年资产评估、改制情况

北京矽成最近三年不存在改制的情形，经具有证券业务资格的评估机构进行评估的具体情况如下：

2017年4月17日，中联资产评估有限公司对北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）拟购买北京矽成100%股权所涉及的北京矽成半导体有限公司股东全部权益在2016年9月30日的投资价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中联评报字[2017]第483号）。经收益法及市场法评估，北京矽成在评估基准日2016年9月30日公司所有者权益账面值527,046.21万，评估值分别为580,858.47万元、527,046.21万元，最终采取收益法580,858.47万元作为评估结论，增值53,812.26万元。同时，根据《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，中联资产评估有限公司同

期出具了《北京兆易创新科技股份有限公司拟购买北京矽成半导体有限公司股权所涉及的协同效应估值报告》（中联评咨字[2017]第 494 号），兆易创新与北京矽成于 2016 年 9 月 30 日估值基准日时点可辨认的协同效应投资价值的估值区间为 24,037.35 万元至 54,425.49 万元。参考上述评估值，经交易各方协商并综合考虑本次交易相关协同效应及评估基准日后汇率变动影响，确定北京矽成的交易价格为 650,000.00 万元。2017 年 8 月 9 日，兆易创新披露《关于终止重大资产重组的公告》，该次交易终止。

本次作价整体估值相比兆易创新拟收购时增长的合理性如下：

（1）兆易创新拟收购北京矽成的背景

①我国集成电路产业发展迅速，高端领域面临挑战

集成电路产业作为信息技术产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。

在市场推动和政策支持下，近年来我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2015 年销售规模达到 3,609.81 亿元，2013 年至 2015 年行业销售规模增速为 19.72%、20.20%、16.21%，行业市场增速明显高于全球水平。

虽然我国集成电路产业从发展初期至今已经取得了较大进步，但是产业中仍然存在持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求脱节等突出问题，产业发展水平与先进国家和地区相比依然存在较大差距。同时在高端集成电路产品领域，对进口依赖程度仍旧较高，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑。我国集成电路产业在高端领域正面临巨大的挑战。

②存储芯片重点发展，北京矽成行业领先

存储芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品类型之一，最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺。《中国制造 2025》中也明确提出，自主化生产先进存储芯片、大容量存储芯片是未来中国大力发展集成电路的关键方向之一。就我国而言，自 2013 年以来，每年集成电路已经

超过石油成为我国进口金额最大进口产品，而存储芯片是我国集成电路四大产品类型中自给率最低的部分，是我国进口金额最大的集成电路产品。一方面，我国存储芯片的设计、制造整体上相对世界先进水平存在较大差距。另一方面，我国国产存储芯片市场替代空间巨大，存储芯片设计、制造企业面临良好的市场机遇。在 NOR FLASH 等存储芯片的细分领域涌现出以兆易创新为首的具有优秀设计能力的企业，但在整体层面以及 DRAM、SRAM 等细分领域，仍缺乏具有国际影响力的企业。为了填补国内空白，推进资源整合、培育具有国际竞争力的存储芯片设计大型企业是我国集成电路产业跻身世界先进水平梯队的重要标志。

北京矽成及其下属公司的主营业务为集成电路存储芯片（及其衍生产品）的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售。集成电路存储芯片业务是标的公司最核心业务，2014-2016 年均占收入的比重超过 95%，主要产品包括各类型高性能 DRAM、SRAM、FLASH 存储芯片产品，其产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域。北京矽成存储芯片产品在 DRAM、SRAM 领域保持全球领先地位，根据 IHS 统计，2016 年上半年，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第八位，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际一流厂商一同处于行业领先地位。

（2）兆易创新拟收购北京矽成时与目前北京矽成的财务状况对比

2017 年 4 月，兆易创新公告拟收购北京矽成的草案，参考当时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京矽成 2016 年备考财务报表，北京矽成当时与目前的财务状况的对比如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2018.12.31	变动率	2019.5.31	变动率
总资产	602,784.78	655,984.69	8.83%	664,019.98	10.16%
总负债	52,746.94	74,272.84	40.81%	75,274.63	42.71%
净资产	550,037.84	581,711.84	5.76%	588,745.35	7.04%
归母净资产	548,146.57	580,494.44	5.90%	587,503.80	7.18%
项目	2016 年	2018 年	变动率	2019 年 1-5 月	变动率
营业收入	213,639.22	287,724.41	34.68%	116,520.92	-

净利润	14,287.25	24,502.14	71.50%	7,405.58	-
归母净利润	14,055.40	24,488.94	74.23%	7,381.42	-

截至 2018 年末,北京矽成总资产和归母净资产分别较 2016 年末增长 8.83% 和 5.90%; 2018 年北京矽成营业收入和归母净利润分别较 2016 年增长 34.68% 和 74.23%。北京矽成目前的财务状况较兆易创新拟收购北京矽成时有显著提高。

(3) 兆易创新拟收购北京矽成时及本次交易的市盈率

根据 2017 年 4 月兆易创新公告拟收购北京矽成的草案,兆易创新拟以 65.00 亿元的交易对价收购北京矽成。根据当时中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京矽成 2016 年备考财务报表计算,市盈率为 46.25 倍。本次交易对价为 72.00 亿元,根据信永中和出具的北京矽成 2018 年财务报表计算,市盈率为 29.40 倍,具体情况如下:

单位:万元

项目	2016 年	2018 年
交易对价	650,000.00	720,000.00
归母净利润	14,055.40	24,488.94
市盈率	46.25	29.40

综上所述,北京矽成本次交易的市盈率低于兆易创新拟收购时的市盈率。

(4) 北京矽成实际业绩与兆易创新拟收购北京矽成时的预测差异

根据 2017 年 4 月兆易创新公告拟收购北京矽成的草案,2017、2018 年净利润预测分别为 3,378.11 万美元、4,629.18 万美元。由于 2018 年北京矽成分别收购了 ISSI(Israel)、Chiefmax (BVI) 从而获得 Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务,为保证前后对比口径统一,下述对比采用剔除上述业务以及调整部分特殊事项后的净利润:

单位:万美元

项目	2017 年			2018 年		
	前次预测值	实际值	差异率	前次预测值	实际值	差异率
净利润	3,378.11	890.65	-	4,629.18	4,191.42	-
现金奖励	570.00	983.70	-	440.00	90.22	-
股份支付	-	725.70	-	-	544.28	-
并购中介费	-	171.37	-	-	237.20	-

汇兑损失	-	228.58	-	-	8.27	-
税改影响	-	1,178.50	-	-	-	-
所得税影响额	159.60	408.47	-	125.70	144.81	-
调整后的净利润	3,788.51	3,770.03	-0.49%	4,943.48	4,926.58	-0.34%

注 1：现金奖励是指 2017 现金奖励计划（因 ISSI 私有化收购完成后，其股票不具有二级市场交易价格，ISSI 将剩余未实施的股权激励计划金额全部转化为现金激励计划）及 2018 年新实施的现金奖励计划。

注 2：股份支付指 2017 年北京矽成成立员工持股平台、实施股权激励形成的股份支付费用。

注 3：并购中介费是指 2018 年北京矽成收购 ISSI(Israel)、Chiefmax (BVI) 分别在 2017 年及 2018 年发生的法律、财务尽调中介费用以及成立 WM、AM 涉及的律师费等费用。

在上述特殊事项调整后，北京矽成 2017 年及 2018 年实际业绩与兆易创新拟收购北京矽成时的盈利预测差异较小。

（5）两次评估主要参数差异

①收益法参数差异

从收益法评估参数上看，两次评估参数的主要差异为汇率、折现率及永续期的永续增长率。

汇率方面，前次评估基准日为 2016 年 9 月 30 日，根据中国人民银行公布的评估基准日下美元兑人民币中间价为 1: 6.6778。本次评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，根据中国人民银行公布的评估基准日下美元兑人民币中间价为 1: 6.8632，两个基准日下汇率累计上涨 2.78%。由于北京矽成记账本位币和大部分结算货币为美元，评估模型是在以美元数据为基础的情况下测算，最终将美元评估值换算为人民币评估值，故人民币评估值会随汇率的波动而有同比例的差异。

折现率方面，前次评估折现率（WACC）为 9.93%-9.96%，本次评估折现率（WACC）为 10.50%。主要由于基准日时点不同，两次评估所选择的无风险报酬率、市场风险溢价、企业所得税率等市场参考指标有所差异，导致两次评估折现率有所不同。

永续增长率方面，前次评估永续期的永续增长率为 0%，本次评估的永续增长率选择 2%。主要考虑宏观经济与北京矽成发展两个因素：

宏观经济方面，根据美国商务部发布最新季度 GDP 数据显示，美国 2018 年全年 GDP 增速为 2.9%。根据世界经济预测报告，2019 年世界经济 GDP 增速

最新预测值为 2.5%。在 2020 年，世界经济 GDP 增速同样为 2.5%，至 2021 年世界经济 GDP 增速趋稳并达到 2.6%。根据 IMF 数据，世界通货膨胀率为 3.8%，其中中国的通货膨胀率为 2.4%，美国的通货膨胀率为 2.1%。

北京矽成方面，由于 ISSI 原为纳斯达克上市公司，根据公开数据查询，北京矽成近 10 年收入复合增长率约为 6.49%。根据管理层访谈以及管理层提供的资料，北京矽成管理层对企业未来的增长一直保持着乐观的态度和充足的信心，在内部经营测算时永续增长率选择 5%。

结合 GDP 增速、通货膨胀率以及管理层预期，最终与管理层确认北京矽成盈利预测五年后的永续增长率为 2%。

此外，根据统计近期 A 股上市公司选择永续增长参数的并购案例，目前市场上对于一些未来预期普遍看好的行业和企业也会选择一定数值的永续增长率参数。具体情况如下：

序号	并购案例	永续增长率
1	共达电声收购万魔声学	2.40%
2	华铭智能收购聚利科技	2.50%
3	光环新网收购科信盛彩	2.50%
4	中源协和收购傲源医疗	2.25%
5	科锐国际收购 Investigo	1.60%
6	益丰药房收购新兴药房	2.00%
平均值		2.21%
北京君正拟收购北京矽成		2.00%

②市场法参数差异

从市场法评估参数上看，两次评估参数的主要差异为价值比率。前次评估的价值比率选择 PB 值。本次评估的价值比率选择 EV/EBITDA 和 EV/S，并选择两个价值比率下得出的估值平均值作为市场法评估值。本次评估根据北京矽成的经营特征选取四家纳斯达克上市公司作为可比公司，为了更全面、更综合的评价北京矽成经营情况，本次选取盈利类指标 EV/EBITDA、收入类指标 EV/S 作为比较的价值比率。

综上所述，北京矽成目前的财务状况较兆易创新拟收购时有大幅提升，本

次交易的市盈率远低于兆易创新拟收购时市盈率，同时两次评估根据评估时点、市场环境等差异在汇率、折现率、永续增长率、价值比率等方面存在差异，本次作价整体估值相比兆易创新拟收购时增长具备合理性。

（十五）本次交易涉及的债权债务转移情况

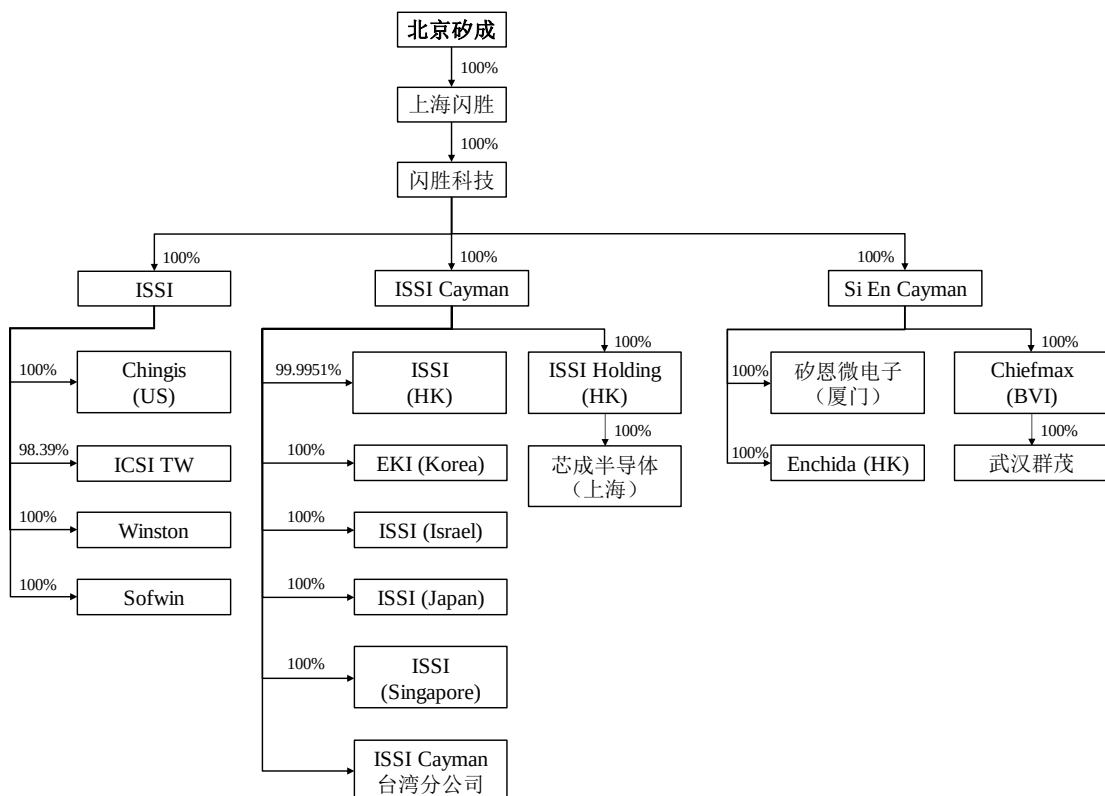
本次交易拟收购资产之一为北京矽成 59.99%股权，不涉及债权债务转移的事项。

（十六）北京矽成因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形符合相关税收、外汇监管要求，有利于维护上市公司及中小股东利益

1、北京矽成因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形是否符合相关税收、外汇监管要求

（1）北京矽成主要经营实体为境外企业，主要经营收益留存境外符合业务发展的客观需要

北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，主要经营实体为全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 及 Si En Cayman，其中，ISSI 原为纳斯达克上市公司；ISSI Cayman 和 Si En Cayman 原均为 ISSI 子公司，后因税务规划和运营效率等原因调整股权架构而成为 ISSI 的兄弟公司，相关股权结构图如下：



如上图所示，北京矽成通过 ISSI、ISSI Cayman 和 Si En Cayman 及其下属境外子公司具体开展及实施生产经营活动。ISSI 已形成全球布局，主要业务覆盖美国、欧洲、日本、中国等全球主要国家和地区。报告期内，北京矽成的主要收入来自于欧洲、中国香港、中国台湾、美国、日本等海外市场，且其 90% 以上的营业收入均来自于中国大陆以外的国家和地区；北京矽成前五大客户 Avnet、Arrow、Hakuto、Sertek 和 Delphi 均为全球知名大型电子元器件经销商或整机厂商，其中包括市场认可度较高的上市公司。此外，北京矽成包括前五大在内的主要供应商也多为中国大陆外的厂商。因此，北京矽成的主要经营活动在境外开展及实施，其将主要经营收益留存于境外，是其生产经营和业务发展的客观需要，符合北京矽成的经营利益和长期规划。

此外，作为 ISSI Cayman 和 Si En Cayman 的境内子公司，芯成半导体（上海）、矽恩厦门和武汉群茂主要从事集成电路半导体产品的设计研发及相关技术咨询服 务，其运营资金来源于 ISSI Cayman 和 Si En 的投资款，即间接源于境外留存的经营收益。

本次交易完成后，北京矽成的经营收益仍将主要用于其自身业务发展及项目投资；北京矽成将根据未来境内外生产经营和业务发展的客观需求，合理调

配留存于境外及汇回境内的经营收益，确保公司实现长期可持续发展。

（2）未来主要经营收益汇回境内时的税收规划考虑

ISSI 在私有化完成后成为国内企业北京矽成的全资子公司，但其主要子公司及经营实体仍直接归属于 ISSI。为提升对主要子公司的直接控制权和有效实施税务规划，北京矽成下属包括 ISSI 在内的各境外子公司进行了股权架构调整，调整后整体所得税费用达到相对较低的水平。

北京矽成主营业务为集成电路设计行业，属于国家鼓励发展的高新技术行业，受产业政策和税收优惠政策支持。首先，根据国家税务总局《中华人民共和国增值税暂行条例》中有关技术及服务出口的增值税优惠政策，可以根据向境外出口技术或提供技术服务享受零增值税或免征优惠。其次，国家规划布局的重点集成电路设计企业可享受 10% 的所得税优惠税率以及所得税“两免三减半”的税收优惠政策。再次，根据国家税务总局相关规定，高新技术企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间可按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

此外，北京矽成将持续不断的评估业务所在地区和相关税收的影响，并作出有利经营发展的相应调整，同时维护股东利益。

（3）北京矽成主要经营收益留存境外情形符合相关税收、外汇监管要求

① 税收相关规定

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）第三条，“居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税”；第四条，“企业所得税的税率为 25%”；第四十五条，“由居民企业，或者由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负明显低于本法第四条第一款规定税率水平的国家（地区）的企业，并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配的，上述利润中应归属于该居民企业的部分，应当计入该居民企业的当期收入。”

如前所述，北京矽成主要经营收益留存境外用于其经营活动和业务开展，属于合理的经营需要，不违反《企业所得税法》第四十五条的规定。

②外汇相关规定

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《外汇管理条例》）（国务院令 第 532 号）第九条，“境内机构、境内个人的外汇收入可以调回境内或者存放境外；调回境内或者存放境外的条件、期限等，由国务院外汇管理部门根据国际收支状况和外汇管理的需要作出规定。”；第十三条，“经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构”；第五十二条，“（三）经常项目，是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目等。”

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发[2009]30 号）第四条，“境内机构可以使用自有外汇资金、符合规定的国内外汇贷款、人民币购汇或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产来源等进行境外直接投资。境内机构境外直接投资所得利润也可留存境外用于其境外直接投资。”

根据《国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目外汇收入的通知》（汇发[2007]49 号），“一、境内机构可根据经营需要自行保留其经常项目外汇收入。”

结合上述外汇监管相关规定，境内机构控制的境外企业的主要经营收益属于该境内机构经常项目下的外汇收入，可以根据经营需要自行保留。因此，北京矽成主要经营收益留存境外用于经营活动和业务开展，不违反《外汇管理条例》等相关规定。

2、北京矽成主要经营收益留存境外有利于维护上市公司及中小股东利益

（1）北京矽成主要经营收益留存境外有利于北京矽成业务发展

如前所述，本次交易完成后，北京矽成的经营收益仍将主要用于其自身业务发展及项目投资；北京矽成将根据未来境内外生产经营和业务发展的客观需求，合理调配留存于境外及汇回境内的经营收益，确保公司实现长期可持续发展。作为全球半导体设计领域的领先者，北京矽成在持续稳定经营基础上扩大规模、提升盈利水平也将有利于上市公司提高资产质量和增强持续盈利能力，使上市公司及中小股东受益。

如前所述，北京矽成主要经营收益留存境外用于其经营活动和业务开展，有利于其长期及可持续发展。作为全球纯半导体设计领域的领先者，北京矽成在持续稳定经营基础上扩大规模、提升盈利水平也将有利于上市公司提高资产质量和增强持续盈利能力，使上市公司及中小股东受益。

（2）主要经营收益留存境外不会对上市公司利润分配政策及其执行造成不利影响

根据北京君正《公司章程》及股东分红回报规划的规定，本次交易完成后，在满足现金分红的前提下，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 5%，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。此外，北京君正《公司章程》及股东分红回报规划还详细规定了利润分配条件和比例、利润分配预案审议程序、利润分配方案制定和决策机制、利润分配政策调整等内容，符合中国证监会和深交所关于上市公司分红的相关规定。

北京君正 2017 年度和 2018 年度派发现金股利 3,341,341.46（含税，下同）和 6,036,298.68 元，现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东的净利润比率分别为 51.40%和 44.66%；截至 2018 年 12 月 31 日，北京君正归属于母公司累计可供分配利润为 218,837,715.68 元。本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司全资子公司，并与上市公司形成良好的协同效应，上市公司境内营业收入和净利润将有所增长，利润分配金额将有所增加，北京君正自身实现的收益可以满足《公司章程》规定的利润分配资金需求。

（3）税收规划有利于维护上市公司中小股东利益

截至本报告书出具日，北京矽成合并报表范围内的子公司共 20 家，分别位于美国、日本、新加坡、韩国、中国香港和中国台湾等地区，北京矽成已根据各国或地区的税收政策做出了合理的税收规划。本次交易完成后，若未来需要将境外实体经营收益汇回，上市公司将充分运用境内外税收优惠政策、合法转移支付等合理措施促使经营收益汇回时产生的税负处于较低水平，以维护上市公司及中小股东利益。

综上所述，北京矽成因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形符合相关税收、外汇监管规定及要求，有利于维护上市公司及中小股东利益。

二、交易标的之上海承裕

（一）上海承裕基本情况

截至本报告书出具日，上海承裕基本情况如下：

公司名称	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	上海市嘉定区工业区兴顺路 558 号 7 幢 545 室
办公地址	上海市浦东新区松涛路 506 号 1 号楼
执行事务合伙人	上海承裕投资管理有限公司（委派代表：朱慧）
成立日期	2015 年 7 月 21 日
统一社会信用代码	91310114350937792Y
经营范围	资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）上海承裕出资及合法存续情况

根据上海承裕工商登记资料、上海承裕股东出具的承诺函，上海承裕合伙人所持有的上海承裕份额目前不存在代他人持有的情形，也不存在委托他人代其持有的情形，其持有的上海承裕份额均不存在争议或潜在纠纷。

上海承裕合伙人上海集岑、武岳峰集电、万丰投资、北京青禾、承裕投资对上海承裕份额合法性出具如下承诺：

“1、本承诺人已履行标的企业合伙协议规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为合伙人应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的企业合法存续的情况。

2、本承诺人依法拥有所持标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分等完整权利；本承诺人所持标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任

何妨碍权属转移的其他情形。

3、本承诺人真实持有相应的标的资产，不存在通过委托持股、信托持股、收益权安排、期权安排、权益代持或其他方式代表其他方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的资产行使表决权的协议或类似安排。

4、本承诺人进一步确认，截至本函出具之日，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方根据任何选择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、转换、分配、出售或转让标的资产，从而获取标的资产或对应的利润分配权的情形。

5、本承诺人向上市公司转让标的资产符合相关法律法规及标的企业合伙协议规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在实质障碍。”

（三）上海承裕历史沿革

1、设立（2015 年 7 月）

上海承裕由承裕投资和武岳峰浦江共同设立，设立时合伙人认缴出资额为 1,001.00 万元。上海承裕设立时各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	武岳峰浦江	有限合伙人	1,000.00	99.90
2	承裕投资	普通合伙人	1.00	0.10
合计		-	1,001.00	100.00

2015 年 7 月 21 日，上海承裕取得了上海市嘉定区市场监督管理局核发注册号为 310114002941849 的《营业执照》。

2、第一次份额转让及增资（2015 年 8 月）

2015 年 8 月 27 日，经合伙企业变更决定，武岳峰浦江将所持上海承裕份额转让予武岳峰集电，；同时武岳峰集电、承裕投资对上海承裕进行增资，增资完成后上海承裕总认缴出资额变更为 96,432.50 万元。本次份额转让及增资完成后，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	武岳峰集电	有限合伙人	96,427.50	99.99
2	承裕投资	普通合伙人	5.00	0.01
合计		-	96,432.50	100.00

2015年8月31日，本次份额转让及增资的工商变更登记手续办理完毕。

3、第二次增资（2016年2月）

2016年1月5日，经合伙企业变更决定，北京青禾对上海承裕进行增资，增资完成后上海承裕总认缴出资额变更为106,432.50万元。本次增资完成后，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	武岳峰集电	有限合伙人	96,427.50	90.60
2	北京青禾	有限合伙人	10,000.00	9.40
3	承裕投资	普通合伙人	5.00	0.0047
合计			106,432.50	100.00

2016年2月1日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

4、第三次增资（2019年4月）

2019年3月，上海集岑将其对上海承裕的可转换债权转换为认缴出资额76,975.55万元。本次增资完成后，上海承裕总认缴出资额变更为183,408.05万元，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	武岳峰集电	有限合伙人	96,427.50	52.58
2	上海集岑	有限合伙人	76,975.55	41.97
3	北京青禾	有限合伙人	10,000.00	5.45
4	承裕投资	普通合伙人	5.00	0.0027
合计			183,408.05	100.00

2019年4月3日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

5、第二次份额转让（2019年5月）

2019年5月，武岳峰集电将所持上海承裕6,112.10万元份额转让予万丰投资。本次变更完成后，各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	武岳峰集电	有限合伙人	90,315.40	49.24
2	上海集岑	有限合伙人	76,975.55	41.97
3	北京青禾	有限合伙人	10,000.00	5.45

4	万丰投资	有限合伙人	6,112.10	3.33
5	承裕投资	普通合伙人	5.00	0.0027
合计		-	183,408.05	100.00

2019年6月3日，本次份额转让的工商变更登记手续办理完毕。

截至本报告书出具日，上述变更完成后，上海承裕的合伙人结构未发生过变更。

6、上海集岑及万丰投资入股上海承裕的原因

（1）上海集岑、万丰投资受让上海承裕份额情况及原因

①上海集岑受让上海承裕份额情况及原因

2018年9月，上海集岑与上海承裕签署《可转换债权投资协议》约定，上海集岑向上海承裕提供可转换成上海承裕新增有限合伙财产份额的可转债的方式向上海承裕投资，且上海集岑向上海承裕提供的借款总额不超过人民币12.55亿元，用于偿还上海承裕参与收购ISSI时产生的贷款本息等相关费用。2019年3月，上海集岑与上海承裕签署《可转换债权投资协议补充协议》约定，上海集岑向上海承裕提供的实际借款金额为人民币124,553.00万元，双方同意于上海集岑书面通知上海承裕之日将上述借款转换为上海承裕的有限合伙财产份额。转换完成后，上海集岑持有上海承裕41.9696%（对应财产份额为人民币76,875.55万元）的有限合伙财产份额。

上海集岑受让上海承裕份额主要考虑如下因素：

上海集岑的普通合伙人为上海双创投资管理有限公司，有限合伙人涵盖具有区域政府背景的投资机构及相关领域产业资本，上海集岑响应国家“大力发展核心技术”的国家战略和落实“做大做强新兴产业集群，推动集成电路产业发展”产业政策，投资领域聚焦于集成电路及专用芯片设计方向，主要投资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业。本次重组的最终标的公司北京矽成作为集成电路芯片设计细分领域的龙头企业符合基金的投资策略，并能够在未来可预期的期间内给投资人带来稳定可观的收益回报。

②万丰投资受让上海承裕份额情况及原因

2019年5月，武岳峰集电与万丰投资签署《有限合伙财产份额转让协议》，协议约定武岳峰集电向万丰投资转让其上海承裕持有的3.3325%（对应财产份额为人民币6,112.10万元）有限合伙财产份额，转让作价为人民币1亿元。

万丰投资受让上海承裕份额主要考虑如下因素：

万丰投资控股及参股的公司涉及行业领域较为广泛，包括房地产开发与经营、实业投资及无线移动通讯业务等。此次受让上海承裕财产份额主要看中本次重组最终标的公司北京矽成在集成电路芯片设计细分领域龙头企业地位、看好未来中国集成电路行业的快速发展带来的行业机遇以及上市公司通过此次并购整合合同行业优质企业带来的产业协同及在研发设计、市场营销等方面的协同效应，以寻求未来的上市公司股权增值及股权投资退出收益。

（2）交易作价差异情况及原因

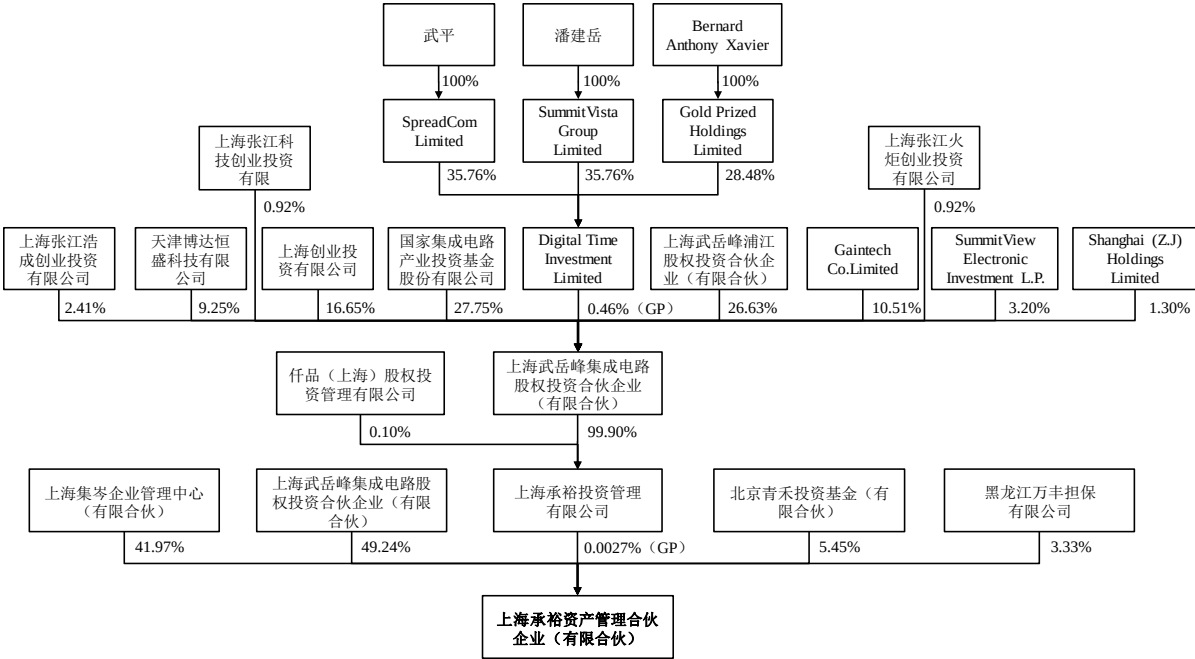
上海集岑在前述可转债转换完成后持有上海承裕41.9696%（对应财产份额为人民币76,875.55万元）的有限合伙财产份额，穿透至北京矽成100%股权价值为人民币72.00亿元。此次上海集岑债转股对应的标的公司作价为交易双方根据上海承裕管理层出具的估值报告以及对标的公司未来业绩的评估基础上协商确定的，与本次重组交易作价不存在差异。

万丰投资通过与武岳峰集电签署的《有限合伙财产份额转让协议》受让上海承裕3.3325%（对应财产份额为人民币6,112.10万元）有限合伙财产份额，转让作价为人民币1亿元，穿透至北京矽成100%股权价值为人民币75.00亿元。此次转让价格略高于本次重组北京矽成交易作价，主要由于受让方看好北京矽成未来业绩发展趋势以及对上市公司今后的股权增值预期，同时出让方亦为提前获取部分投资退出收益，交易双方基于上述考虑经协商一致后确定。

（四）上海承裕产权结构及控制关系情况

1、产权关系图

截至本报告书出具日，上海承裕产权结构及控制关系如下图所示：



2、执行事务合伙人

截至本报告书出具日，上海承裕的执行事务合伙人为承裕投资，基本情况如下：

公司名称	上海承裕投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路 3818 号 2 幢 1218 室
办公地址	上海市浦东新区松涛路 506 号 1 号楼
法定代表人	朱慧
注册资本	1,000 万元
成立日期	2015 年 6 月 19 日
统一社会信用代码	9131011434217692X4
经营范围	投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，企业营销策划，创业投资，实业投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、上海承裕合伙协议中可能对本次交易产生影响的主要内容或其他相关投资协议

根据上海承裕出具的说明，上海承裕合伙协议中不存在可能对本次交易产生影响的内容。上海承裕不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议，亦不存在让渡经营管理权、收益权等影响资产独立性的协议或其他安排。

4、上海承裕主要人员的安排

截至本报告书出具日，根据本次交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易涉及上海承裕合伙人变动，不涉及上海承裕聘用人员劳动关系的调整变更。

（五）上海承裕主要下属公司情况

截至本报告书出具日，上海承裕除持有北京矽成 40.01%股权外，不存在其他下属公司。

（六）上海承裕主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况

根据上海承裕出具的说明，上海承裕的主要资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（对应北京矽成 40.01%股权）等。

截至本报告书出具日，上海承裕不存在自有土地及建筑物的情况，亦未拥有任何知识产权；不存在大额负债及或有负债；相关资产权属清晰，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形；不存在正在履行的对外担保；不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

（七）上海承裕主营业务情况

根据上海承裕出具的说明，上海承裕系对 ISSI 进行私有化及后续经营管理的投资机构，除持有北京矽成 40.01%股权外，不存在其他实际经营业务。

（八）上海承裕报告期内主要财务数据及非经常性损益的构成情况

1、主要财务数据

根据信永中和会计师出具的上海承裕审计报告，上海承裕报告期内经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	281,217.54	281,217.81	308,848.76
负债合计	-	124,553.00	140,246.48

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
合伙人权益合计	281,217.54	156,664.81	168,602.28
项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
营业收入	-	-	-
利润总额	-0.27	-12,751.47	20,733.62
净利润	-0.27	-12,751.47	20,733.62

2、主要财务指标

上海承裕报告期内主要财务指标如下：

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	-	2.26	5.84
速动比率	-	2.26	5.84
资产负债率	0.00%	44.29%	45.41%
项目	2019年1-5月	2018年	2017 年
息税折旧摊销前利润（万元）	-0.30	-6,817.52	27,915.29
利息保障倍数	-	-1.14	3.86

注：以上指标计算公式如下：

- 1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 2、速动比率=（期末流动资产-期末存货净额）/期末流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出-利息收入
- 5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

3、非经常性损益情况

根据信永中和会计师事务所出具的上海承裕审计报告，上海承裕报告期内不存在非经常损益情形。

（九）涉及立项、环保等有关报批事项

本次交易标的资产之一为上海承裕 100%份额，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项。

（十）上海承裕最近三年份额转让、增资及评估情况说明

1、最近三年的股权转让情况

最近三年上海承裕共进行过一次份额转让，系双方协商决定，具体情况如下：

单位：万元

工商变更时间	转让方	受让方	转让出资额	转让价格
2019 年 5 月	武岳峰集电	万丰投资	6,112.10	10,000.00

2、最近三年增资情况

最近三年上海承裕共进行过 2 次增资，系上海承裕引进合伙人北京青禾以及对上海集岑实施债转股形成，具体情况如下：

序号	工商变更时间	增资方	认缴出资额（万元）
1	2016 年 2 月	北京青禾	10,000.00
2	2019 年 4 月	上海集岑	76,975.55

3、最近三年资产评估、改制情况

上海承裕最近三年不存在评估及改制的情形。

（十一）本次交易涉及的债权债务转移情况

本次交易拟收购资产之一为上海承裕 100%财产份额，不涉及债权债务转移的事项。

第五章 标的资产评估情况

本次交易标的资产经具有证券期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司进行评估。东洲评估以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对标的企业北京矽成的股东全部权益、上海承裕的全部财产份额进行评估，并分别出具了《北京矽成评估报告》《上海承裕评估报告》。

一、标的资产评估的基本情况

本次交易标的资产为北京矽成 59.99%股权、上海承裕 100%财产份额。

（一）评估方法概述

依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法（成本法）三种方法：

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用收益法，强调的是企业的整体预期盈利能力。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用市场法，具有评估数据直接选取于市场，评估结果说服力强的特点。

资产基础法（成本法）是指以评估对象评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用资产基础法，可能存在并非每项资产和负债都可以被充分识别并单独评估价值的情形。

1、北京矽成评估方法的选择

北京矽成本次评估选用的评估方法为收益法和市场法，理由如下：

根据《资产评估执业准则——企业价值》规定“执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法”，“对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估”。

本次评估目的是为股权收购提供价值参考依据。北京矽成成为半导体行业，采用无晶圆厂运营模式，从账面资产构成情况看属于轻资产企业，拥有的经营模式、服务平台、营销团队、研发团队等众多无形资源难以逐一识别和量化反映价值的特征，故采用资产基础法（成本法）不能全面合理地反映企业的内在价值。

收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结果具有较好的可靠性和说服力。同时，北京矽成具备了应用收益法评估的前提条件：未来可持续经营、未来收益期限可以预计、股东权益与企业经营收益之间存在稳定的关系、未来经营收益可以预测量化、与企业预期收益相关的风险报酬能被估算计量。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法，适用市场法的前提条件是存在一个发育成熟、公平活跃的公开市场，且市场数据比较充分，在公开市场上有可比的交易案例。目前与北京矽成同一行业，产品类型、业务结构、经营模式相类似的上市公司数量较多。而且，本次评估目的即为股权收购提供市场价值参考，本次适合采用市场法评估。

综上所述，北京矽成本次评估采用收益法和市场法进行评估。

2、上海承裕评估方法的选择

上海承裕本次评估选用的评估方法为资产基础法，理由如下：

根据《资产评估执业准则-企业价值》规定“执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法”，“对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估”。

本次评估目的是为财产份额收购提供价值参考依据。资产基础法（成本法）的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产，潜在的投资者在决定投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本评估项目能满足资产基础法（成本法）评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法（成本法）可以满足本次评估的价值类型的要求。

上海承裕主要从事创业投资、投资管理、投资咨询活动，其主营业务为对外投资，收入主要来源于被投资项目的价值变化。本次评估对于对外投资项目北京矽成半导体有限公司的市场价值参考上海东洲资产评估有限公司出具的《北京矽成评估报告》结论，该报告对京矽成半导体有限公司采用收益法及市场法两种方法评估，最终选择收益法作为评估结论。

综上分析，上海承裕本次评估采用资产基础法一种方法进行评估。

（二）评估结论

1、北京矽成的评估结论

根据东洲评估出具的《北京矽成评估报告》，东洲评估分别采用收益法和市场法两种方法对北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法的评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日，北京矽成评估值为 702,791.68 万元。

（1）收益法的评估结论

采用收益法，得出北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值评估值如下：评估基准日，北京矽成股东权益账面值为 580,494.44 万元，评估值 702,791.68 万元，评估增值 122,297.24 万元，增值率 21.07%。

（2）市场法的评估结论

采用市场法，得出北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值评估值如下：评估基准日，北京矽成股东权益账面值为 580,494.44 万元，评估值 828,388.24 万元，评估增值 247,893.80 万元，增值率 42.70%。

（3）评估结果分析及最终评估结论

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为 702,791.68 万元，采用市场法得出的股东全部权益价值为 828,388.24 万元，市场法评估结论较收益法评估结论高 125,596.56 万元，高 17.87%。两种评估方法差异的原因主要是：收益法是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响；市场法是通过以类似上市公司作为对比公司，分析北京矽成与参考企业的异

同并对差异进行量化调整从而得到委估对象的市场价值的方法，受宏观环境和资本市场交易价格波动影响。

北京矽成业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。北京矽成主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。虽然半导体行业具有一定的周期性，但北京矽成大部分客户集中于汽车电子领域、通信设备领域以及工业制造领域，近年收入一直保持着稳定增长，也保持着较强的盈利能力。

北京矽成所属的半导体行业虽然拥有较多的上市公司，但是各公司间的研究领域或经营模式差异较大。北京矽成的主营产品为存储芯片，采用无晶圆厂的经营模式。然而存储芯片领域的竞争对手大都采用 IDM 模式，账面上固定资产占比相对较高，从财务数据上不具备充分可比性。本次评估选择的可比案例均为以设计为主的芯片公司，但是主营产品、细分技术领域与标的公司有一定的差异。此外，市场法的结论会受到投资环境、投机程度以及投资者信心等因素的影响而造成波动，而收益法则是管理层根据企业实际经营情况对未来做出的合理预期，同时评估人员结合企业历史经营情况进行分析核实，能更好的体现企业的内在价值。

综上所述，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。

通过以上分析，选用收益法评估结果作为本次北京矽成股东全部权益价值评估结论，北京矽成股东全部权益价值为人民币 702,791.68 万元。

2、上海承裕的评估结论

根据东洲评估出具的《上海承裕评估报告》，东洲评估采用资产基础法对上海承裕在评估基准日的全部财产份额价值进行评估，评估值如下：评估基准日，上海承裕全部财产份额账面值 2,812,178,119.19 元，评估值 2,812,178,119.19 元，评估增值 0 元，评估增值率 0%。

二、北京矽成评估情况

（一）收益法评估具体情况

1、收益法简介

企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。根据国家有关规定以及《资产评估准则-企业价值》，本次评估按照收益途径，采用现金流折现方法（DCF）估算企业的股东全部权益价值。

（1）应用前提

- ①被评估资产的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量。
- ②资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量。
- ③被评估资产预期获利年限可以预测。

（2）评估假设

①基本假设

A.交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

B.公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

C.企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设北京矽成在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

②一般假设

A.本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

B.本次评估没有考虑北京矽成及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响。

C.假设北京矽成所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

D.本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

E.北京矽成现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、注册证明、公司章程的相关约定。

③收益法评估特别假设

A.北京矽成目前及未来的管理层合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。

B.北京矽成各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

C.北京矽成于评估基准日后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要性方面保持一致。

D.北京矽成部分子公司拥有《高新技术企业证书》《先进型服务企业证书》。假设现行的相关法规政策未来无重大变化，评估师对企业目前的主营业务构成类型、研发人员构成、未来研发投入占主营收入比例等指标分析后，基于对未来的

合理推断，假设北京矽成未来具备持续获得相关认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。

E.北京矽成目前租赁取得的生产经营场所，本次评估假设租赁合同到期后，北京矽成能按租赁合同的约定条件获得续签继续使用，或届时能以市场租金价格水平获取类似条件和规模的经营场所。

（3）评估思路

根据本次评估尽职调查情况以及评估对象资产构成和主营业务的特点，本次评估的基本思路是以评估对象经审计的会计报表口径为基础估算其权益资本价值。即首先按收益途径采用现金流折现方法（DCF），估算评估对象的经营性资产的价值，再加上基准日的其他非经营性或溢余性资产的价值，来得到评估对象的企业价值。企业价值再扣减付息债务价值后，得出评估对象的股东全部权益价值。具体如下：

①对纳入合并报表范围的资产和主营业务，按照最近几年不包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益的历史经营状况变化趋势和业务类型估算预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价值。

②将纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）估算中未予考虑的诸如基准日存在的溢余资产，以及定义为基准日存在的非经营性资产（负债），单独估算其价值。

③由上述二项资产价值的加和，得出评估对象的企业价值，再扣减付息债务价值以后，得到评估对象的权益资本（股东全部权益）价值。

本次评估在计算企业经营性资产的价值的时候未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益，主要原因如下：

①根据企业申报材料及访谈获悉，2018年2月，企业收购 Sigma Designs Israel S.D.I. LTD100%股权（现已更名为 Integrated Silicon Solution Israel Ltd），收购金额 2,524.91 万美元，截至评估基准日收购款已全额支付。ISSI(Israel)主营业务为开发、销售 Connectivity（连接类）芯片。

ISSI (Israel)原本系纳斯达克上市公司 Sigma Designs, Inc.的下属公司，主要产品为类似于“电力猫”这样的家庭电力连接类产品芯片。由于家庭网络连接这样的消费类市场更新较快，波动相对较大，企业近年业绩下滑。但是企业连接类芯片技术拥有高技术门槛，属于世界前沿，并且近年开始往车用连接、智能电网的方向发展。北京矽成管理层认为 ISSI (Israel)连接类芯片技术在车用领域、工业领域的应用将会填补北京矽成这部分技术的空白，并且认为 ISSI (Israel)的先进技术结合北京矽成在汽车电子领域、工业领域深耕的销售渠道、客户关系以及对车规芯片的理解，未来将会扩大北京矽成在车规芯片、工业芯片领域的业务范围，使得北京矽成在存储芯片领域外得到更好的发展。

ISSI (Israel)近年已完成汽车电子领域相关产品的研发并与两家美国大型汽车厂商开始合作，目前已提供第一版样品测试。由于汽车电子领域的连接芯片一般从测试到量产需要三年左右，故短期内不会实现量产，但产品一旦满足大型汽车厂商的要求，将会是一个长期合作的过程。

企业管理层对上述连接类芯片技术方向带来的业务有较高的期望，由于企业这部分产品尚未量产，盈利预测的准确度相对难以把握，且这部分业务独立，北京矽成在此次收购前没有 Connectivity 业务，故本次评估采用的管理层盈利预测不包含 Connectivity 业务的相关损益，将 ISSI (Israel)的收购款作为非经营性资产。

（注：此处非经营性资产非实质上的不经营，而是指在未来的现金流中预测中未考虑这部分资产贡献，下同。）

②根据北京矽成提供的材料及访谈获悉，2018 年 3 月，北京矽成收购 Chiefmax (BVI)100%股权（含其全资子公司武汉群茂 100%股权），收购金额 347.42 万美元，截至评估基准日已支付 80%收购款 277.94 万美元。Chiefmax (BVI)无实质经营业务，武汉群茂的主营业务为开发、销售光纤通信类数模混合的芯片。

Chiefmax (BVI)原本系台湾上市公司世纪民生科技股份有限公司（简称“Myson”）子公司。Myson 汽车电子领域的产品专注于数模混合的芯片的设计，主要是 MCU、LIN 总线、CAN 总线的技术方向，使用 Myson 芯片所设计的触控模组导入了裕隆纳智捷量产，由于该车型销售不理想，导致 Myson 这部分业务经营情况不佳。但是其用于汽车电子的集成电路芯片设计能力及技术水平具有长

期的竞争力。北京矽成希望借此新增 LIN, CAN, MCU 及光纤通信芯片业务，填补北京矽成在这方面业务的空白。

企业管理层对上述 MCU 等技术方向带来的业务有较高的期望，但由于目前相关研发成果未实现量产，盈利预测的准确度相对难以把握，且这部分业务独立，北京矽成在此次交易前没有 LIN, CAN, MCU 及光纤通讯芯片业务，故本次评估采用的管理层盈利预测不包含 LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益，将 Chiefmax (BVI) 的收购款作为非经营性资产。

综上所述，本次评估参考的企业历史业绩系由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审计报告，备考审计报告的备考合并报表范围不包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关资产、负债及相关损益。采用的管理层提供的盈利预测同样不包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益。

（4）评估模型及各项参数

根据北京矽成的实际情况，本次现金流量折现法（DCF）具体选用企业自由现金流量折现模型，基本模型为：

$$E = B - D$$

式中：

E：评估对象的股东全部权益价值；

D：评估对象的付息债务价值；

B：评估对象的企业价值；

$$B = P + \sum C_i$$

式中：

P：评估对象的经营性资产价值；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n * (1+g)}{(r-g) * (1+r)^n}$$

式中：r：所选取的折现率；

资产评估专业人员，在综合考虑评估基准日的利率水平、市场投资收益率等资本市场相关信息和所在行业、被评估单位的特定风险等相关因素确定折现率。

F_i : 评估对象未来第 i 年的预期收益（现金流）；

n : 明确的预测期期间是指从评估基准日至企业达到相对稳定经营状况的时间。

评估人员在对企业收入结构、成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素，确定预测期。本次明确的预测期期间 n 选择为 5 年。

根据被评估单位所在行业现状与发展前景、协议与章程约定、经营状况、资产特点和资源条件等，确定预测期后收益期确定为无限期

g : 未来收益每年增长率，根据企业进入稳定期的因素分析预测期后的收益趋势，本次评估假定 n 年后 F_i 每年增长 2%， g 取 2%。

ΣC_i : 评估对象基准日存在的溢余资产、非经营性资产或负债的价值。

本次评估，使用企业的自由现金流量作为评估对象的收益指标，其基本定义为：

$R = \text{净利润} + \text{税后的付息债务利息} + \text{折旧和摊销} - \text{资本性支出} - \text{营运资本增加}$

根据评估对象的经营历史以及未来盈利预测，估算其未来预期的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和，测算得到企业经营性资产价值。

本次评估采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率 R ：

$$R = R_d \times (1 - T) \times W_d + R_e \times W_e$$

式中：

W_d : 评估对象的付息债务比率；

$$W_d = \frac{D}{(E + D)}$$

W_e ：评估对象的权益资本比率；

$$W_e = \frac{E}{(E + D)}$$

T ：所得税率；

R_d ：付息债务利率；

R_e ：权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ；

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ε ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为可比公司的付息债务与权益资本。

被评企业按公历年度作为会计期间，因而本项评估中所有参数的选取均以年度会计数据为准，以保证所有参数的计算口径一致。

2、收益法评估过程

（1）营业收入、营业成本及净利润相关预测

北京矽成近年调整后的模拟利润表如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
一、营业收入	37,258.27	41,745.94

项目\年份	2017	2018
其中：主营业务收入	37,258.27	41,745.94
其他业务收入	0.00	0.00
减：营业成本	22,294.60	26,223.99
其中：主营业务成本	22,294.60	26,223.99
其他业务成本	0.00	0.00
税金及附加	24.65	18.88
销售费用	3,411.45	3,374.45
管理费用	2,211.59	1,764.29
研发费用	4,712.79	4,082.78
财务费用	82.10	-205.23
资产减值损失	861.20	633.30
加：其他收益	14.03	28.14
投资收益（损失“-”号）	0.00	0.00
公允价值变动损益（损失“-”号）	0.00	0.00
资产处置收益（损失“-”号）	7.74	1.73
二、营业利润	3,681.68	5,883.35
加：营业外收入	27.29	40.71
减：营业外支出	5.30	7.56
三、利润总额	3,703.67	5,916.50
减：所得税费用	1,642.18	708.24
四、净利润	2,061.49	5,208.27
减：少数股东损益	-1.59	1.99
五、归属于母公司损益	2,063.09	5,206.28

注：上述数据中未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关资产、负债及相关损益，亦未包含因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销，下同。

结合上述历史经营情况，管理层根据北京矽成制定的发展规划，签发了管理层盈利预测。评估师对北京矽成盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，经过与北京矽成管理层及其主要股东多次讨论，北京矽成进一步修正、完善后，评估机构采信了北京矽成盈利预测的相关数据。预测数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023
一、营业收入	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023
其中：主营业务收入	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业成本	26,520.00	28,715.00	32,680.00	36,028.79	38,573.66
其中：主营业务成本	26,520.00	28,715.00	32,680.00	36,028.79	38,573.66
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88
销售费用	3,375.59	3,546.17	3,837.45	4,065.35	4,254.08
管理费用	1,600.27	1,402.45	1,468.78	1,520.89	1,569.86
研发费用	3,899.66	4,041.80	4,271.81	4,698.67	4,837.64
财务费用	-89.14	-178.28	-178.28	-167.14	-111.42
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	5,174.74	7,553.97	9,301.36	10,334.56	11,157.30
加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	5,174.74	7,553.97	9,301.36	10,334.56	11,157.30
四、所得税	776.21	1,133.10	1,395.20	1,550.18	1,673.59
五、净利润	4,398.53	6,420.87	7,906.16	8,784.38	9,483.71
减：少数股东损益	1.68	2.45	3.02	3.36	3.62
六、归属于母公司损益	4,396.85	6,418.42	7,903.14	8,781.02	9,480.09

注：上述数据中未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关资产、负债及相关损益，亦未包含因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销，下同。

①主营业务收入预测

北京矽成历年主营业务收入情况如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017A	2018A
营业收入合计	37,258.27	41,745.94
其中：主营业务收入	37,258.27	41,745.94
其他业务收入	0.00	0.00

项目\年份	2017A	2018A
主营收入分析		
DRAM	24,336.20	25,335.01
SRAM	8,104.46	8,503.06
FLASH	2,898.34	5,308.60
ANALOG	1,919.28	2,599.27

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。集成电路存储芯片产品中，包括了动态随机存储器芯片（DRAM）和静态随机存储器芯片（SRAM），非易失性存储芯片产品有闪存芯片（FLASH）。北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用，北京矽成通过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验。

①从行业上看，半导体存储器作为电子计算机系统的基础构成器件，其发展历程贯穿着这个集成电路发展的历程，目前已经形成了成熟的产业市场和产业格局，在整个半导体市场中占据着举足轻重的地位。根据 SIA 数据，2018 年 5 月，全球半导体营收结构中，存储芯片仍以 32% 的占比位居第一。全球半导体存储市场发展的驱动力主要来自三大领域，即云计算、IDC 与边缘计算。此外，随着智能驾驶时代来临，车载存储市场也有望迎来爆发。汽车是新技术应用的重要载体，随着信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术在汽车领域广泛应用，汽车正由人工操控的机械产品加速向智能化系统控制的智能产品转变，存储作为基础芯片有望先行受益。

②从全球行业地位上看，标的公司 DRAM 和 SRAM 的销售收入占比最高，根据第三方机构 IHS 最新统计，2018 年四季度，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第七位。

纵观近年行业排名情况，随着标的公司业务发展，2014 年 SRAM 产品收入跃居至行业第二位，并一直稳定保持着行业第二的地位。2014 年 DRAM 产品收入为行业第九位，2018 年已攀升至行业第七位。

③从波动性上看，集成电路存储产业具有明显的周期性特征。通用领域存储市场周期性波动明显，专用领域存储市场的周期性特征较弱，受益于历来稳定的汽车、工业等行业客户需求，以及规模相对较小的产能变动，专用领域存储市场周期性波动较小。而标的公司主要客户均为汽车、工业等行业客户，这里客户一定与标的公司完成产品测试进入量产阶段，一般不会轻易更换。

④从北京矽成自身角度看，2017年北京矽成收入增长率为16.03%（2016年收入参考北京矽成以前年度审计报告），2018年北京矽成收入增长率为12.04%，北京矽成近年收入保持着较高的增长速度。

2019年，企业高速增长的势头受行业波动以及贸易战的影响，预计营业收入将有所下降。根据Capital IQ预测，Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology等同行业公司2019年销售收入均有较大幅度的下滑，2020年以后将逐渐回升。在行业整体波动下，企业2019年预计收入有所下滑，2020年起继续增长。

结合上述的分析计算过程，营业收入的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024年及以后
营业收入合计	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00	61,506.00
增长率	-2.98%	11.36%	13.97%	9.92%	6.73%	2.00%
其中：主营业务收入	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00	61,506.00
增长率	-2.98%	11.36%	13.97%	9.92%	6.73%	2.00%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主营收入分析						
DRAM	24,720.00	26,800.00	30,500.00	34,100.00	36,800.00	-
增长率	-2.43%	8.41%	13.81%	11.80%	7.92%	-
SRAM	7,100.00	7,000.00	6,800.00	6,800.00	6,500.00	-
增长率	-16.50%	-1.41%	-2.86%	0.00%	-4.41%	-
FLASH	6,280.00	8,400.00	10,600.00	11,600.00	12,600.00	-
增长率	18.30%	33.76%	26.19%	9.43%	8.62%	-
ANALOG	2,400.00	2,900.00	3,500.00	4,000.00	4,400.00	-
增长率	-7.67%	20.83%	20.69%	14.29%	10.00%	-

②主营业务成本预测

北京矽成历年主营业务成本情况如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
营业成本合计	22,294.60	26,223.99
毛利率	40.16%	37.18%
其中：主营业务成本	22,294.60	26,223.99
毛利率	40.16%	37.18%
其他业务成本	0.00	0.00
主营成本分析		
DRAM	15,514.20	17,551.60
毛利率	36.25%	30.72%
SRAM	4,230.30	4,249.30
毛利率	47.80%	50.03%
FLASH	1,703.40	3,253.20
毛利率	41.23%	38.72%
ANALOG	846.70	1,169.89
毛利率	55.88%	54.99%

集成电路存储芯片产业经过几十年的发展，已经形成了以下几种成熟的经营模式，分别为 IDM 模式（集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身）、Fabless 模式（无晶圆生产线集成电路设计模式）和 Foundry 模式（代工厂，只负责制造、封装或测试的其中一个环节）

北京矽成属于无晶圆厂半导体设计公司，不从事具体生产工作。北京矽成通过委托代工方式将晶圆生产、封装和测试工序委托第三方晶圆代工厂、封装厂和测试厂代工，自身专门从事集成电路存储芯片设计，在取得经测后成品芯片后向直销客户或经销商销售。北京矽成主营业务成本主要为晶圆代工、封装服务、测试服务以及技术无形资产的摊销和提供给供应商使用的设备的折旧。

北京矽成历史毛利率会受到产品更新以及宏观环境的影响有所波动，整体波动率较小。2018 年四季度开始，存储芯片价格开始下滑。此外，由于贸易战等一些非经营性因素导致 2018 年以及 2019 年预测毛利率均有所下滑。

企业管理层基于对未来市场的判断以及对非经营性因素的应对措施，预计2020年起毛利率将有所回升。

此外，受半导体行业特点，一般都会存在金额较大的资产减值损失。由于未来年度不考虑计提资产减值准备（计提不影响现金流），管理层在未来营业成本的预测中考虑一定的存货减值损失，原因及合理性如下：

A. 存货跌价准备计提政策的依据

报告期内，北京矽成存货跌价准备计提政策均为：资产负债表日，北京矽成按照单个存货项目计提存货跌价准备，对存货成本高于其可变现净值的存货计提跌价准备。北京矽成在报告期及预测期内均依据上述计提政策进行存货跌价准备的计提或估计，政策依据具有一致性。

B. 未来营业成本预测中考虑一定存货减值损失的原因及合理性

报告期内，北京矽成建立了良好的质量控制体系，每季度末对库存商品的可变现净值进行检测，其中对于库龄大于1年的库存商品将进行筛选并重点关注。市场部会根据存货品质及预期销售情况，对所有库存商品进行判断，按照可变现净值与成本孰低法对单个品种计提跌价准备。公司产品主要系以销定产的生产模式，库存商品的管理和运营能力较强，减值风险相对较小。

预测期内，北京矽成管理层根据历史经营经验、行业发展趋势及对未来市场变化预测，基于谨慎性判断，合理预测未来期间存货减值损失，降低了未来期间现金流预测高估的风险，符合北京矽成的实际经营情况及对未来期间的合理估计，具有合理性。

结合上述的分析过程，营业成本的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024年 及以后
营业成本合计	26,520.00	28,715.00	32,680.00	36,028.79	38,573.66	39,345.13
毛利率	34.52%	36.33%	36.42%	36.23%	36.03%	36.03%
其中：主营业务成本	26,520.00	28,715.00	32,680.00	36,028.79	38,573.66	39,345.13
毛利率	34.52%	36.33%	36.42%	36.23%	36.03%	-
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
主营成本分析						
DRAM	17,450.00	17,990.00	20,350.00	22,799.26	24,648.64	-
毛利率	29.41%	32.87%	33.28%	33.14%	33.02%	-
SRAM	3,690.00	3,710.00	3,605.00	3,605.00	3,445.96	-
毛利率	48.03%	47.00%	46.99%	46.99%	46.99%	-
FLASH	4,300.00	5,710.00	7,150.00	7,824.53	8,499.06	-
毛利率	31.53%	32.02%	32.55%	32.55%	32.55%	-
ANALOG	1,080.00	1,305.00	1,575.00	1,800.00	1,980.00	-
毛利率	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	-

③其他业务收入和成本预测

北京矽成历史年度无其他业务收入和成本，未来不予分析预测。

④税金附加预测

北京矽成历年税金及附加情况如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
税金及附加	24.65	18.88
税金及附加率	0.07%	0.05%

北京矽成税金及附加为房产土地税，2017 年房产土地税较高是由于 ISSI 上海于 2017 年同时补缴了前一年度税费所致。未来税金及附加参考历史水平进行预测。

通过对相关税率和相应的计算过程的核查，税金附加的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
税金及附加	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88

⑤期间费用预测

A. 销售费用预测

对销售费用中的各项费用进行分类分析，根据不同费用的发生特点、变动规律进行分析，按照和营业收入的关系、自身的增长规律，采用不同的模型计算。

北京矽成以前年度的销售费用情况如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
销售费用	3,411.45	3,374.45
占营业收入比例	9.16%	8.08%
折旧摊销	61.04	63.68
职工薪酬	1,787.67	1,541.14
佣金费	656.55	752.44
占主营收入比例	1.76%	1.80%
差旅费	127.57	146.14
占主营收入比例	0.34%	0.35%
运费	101.89	121.36
占主营收入比例	0.27%	0.29%
广告费	23.08	34.16
占主营收入比例	0.06%	0.08%
租金	74.37	78.85
以权益结算的股份支付	82.98	62.24
外包服务费	39.16	52.62
占主营收入比例	0.11%	0.13%
销售产品样本费	43.51	80.21
占主营收入比例	0.12%	0.19%
其他费用	413.62	441.61

折旧摊销：北京矽成销售团队及办公场所相对稳定，该类费用占收入的比例变动不大，除更新维护外，基本没有大额的新增需求，未来按照历史水平进行预测。

职工薪酬：2017 年职工薪酬较高主要由于 2017 年计入了北京矽成给员工的一次性现金奖励。公司近年来销售团队及销售渠道一直比较稳定，以后年度职工薪酬保持一定比例增长。

佣金费、差旅费、运费、广告费、外包服务费、销售产品样本费：该类费用和北京矽成的营业收入显著相关，未来参考 2018 年佣金费占收入的比例进行测算；

租金：北京矽成近几年随着业务的增长，租赁的场地也有增加，目前租赁面积已经满足预计未来经营增长的需要，未来考虑适度的租金增长率。

以权益结算的股份支付：2017 年北京矽成授予管理层及核心员工信托份额成立员工持股平台，并受让部分北京矽成股权。上述费用将按照 40%、30%、30% 的比例于 2017 年、2018 年、2019 年进行分摊。2019 年以后不再预测。

其他费用：其他费用类别较多、单项发生额较小，包括办公费、通讯费等，未来按照一定比例的增长。

结合上述的分析计算过程，销售费用的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
销售费用	3,375.59	3,546.17	3,837.45	4,065.35	4,254.08	4,339.16
占营业收入比例	8.33%	7.86%	7.47%	7.20%	7.05%	7.05%
折旧摊销	64.05	66.94	70.25	73.14	73.14	-
职工薪酬	1,550.00	1,620.00	1,700.00	1,760.00	1,820.00	1,856.40
增长率	0.58%	4.52%	4.94%	3.53%	3.41%	-
佣金费	729.98	812.89	926.44	1,018.37	1,086.86	-
占主营收入比例	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	-
差旅费	141.78	157.88	179.94	197.79	211.09	-
占主营收入比例	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	-
运费	117.74	131.11	149.42	164.25	175.30	-
占主营收入比例	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	0.29%	-
广告费	33.14	36.90	42.06	46.23	49.34	-
占主营收入比例	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	-
租金	82.80	86.94	91.28	95.85	100.64	-
增长率	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	-
以权益结算的股份支付	62.24	-	-	-	-	-
外包服务费	51.05	56.85	64.79	71.22	76.01	-
占主营收入比例	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	-

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
销售产品样本费	77.82	86.66	98.76	108.56	115.86	-
占主营收入比例	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	-
其他费用	465.00	490.00	514.50	529.94	545.83	-
增长率	5.30%	5.38%	5.00%	3.00%	3.00%	-

B. 管理费用预测

对管理费用中的各项费用进行分类分析，根据不同费用的发生特点、变动规律进行分析，按照和营业收入的关系、自身的增长规律，采用不同的模型计算。

近年的管理费用如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
管理费用	2,211.59	1,764.29
占营业收入比例	5.94%	4.23%
折旧摊销	98.33	92.70
职工薪酬	1,173.04	819.57
专业服务费	391.16	355.88
以权益结算的股份支付	339.57	254.68
维修费	80.46	85.51
差旅费	37.21	42.48
租金	27.89	30.46
办公费	23.49	32.76
保险费	31.73	32.69
其他	8.70	17.57

折旧摊销：北京矽成管理团队及办公场所相对稳定，该类费用占收入的比例变动不大，除更新维护外，基本没有大额的新增需求，未来按照历史水平进行预测。

工资薪酬：2017 年职工薪酬较高主要由于 2017 年的现金奖励中包含了一次性计入的因私有化而给予员工的现金奖励。企业的核心管理团队一直稳定，未来考虑一定的工资水平的增长进行预测。

专业服务费：北京矽成 2017 年及 2018 年专业服务费较高主要由于这两年北京矽成因收购 Chiefmax (BVI)、ISSI (Israel)、美国税改等特殊事件发生了相关财务尽调、法律尽调、税务尽调、审计、税务、PPA 报告等费用。2019 年预计不会发生上述费用，以后年度在 2019 年费用预测的基础上考虑一定的增加额。

以权益结算的股份支付：2017 年北京矽成授予管理层及核心员工信托份额成立员工持股平台，并受让部分北京矽成股权。上述费用将按照 40%、30%、30% 的比例于 2017 年、2018 年、2019 年进行分摊。2019 年以后不再预测。

差旅费：北京矽成 2017 年及 2018 年由于收购武汉群茂、ISSI (Israel) 差旅费较高，未来在 2019 年预测数据的基础上考虑一定的增长率。

租金：北京矽成近几年随着业务的增长，租赁的场地也有增加，目前租赁面积已经满足预计未来经营增长的需要，未来考虑适度的租金增长率。

维修费、办公费、保险费等其他费用：按照 2017 年及 2018 年发生额的水平，未来考虑一定的增长率。

结合上述的分析计算过程，管理费用的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
管理费用	1,600.27	1,402.45	1,468.78	1,520.89	1,569.86	1,601.26
占营业收入比例	3.95%	3.11%	2.86%	2.69%	2.60%	2.60%
折旧摊销	95.12	98.56	103.15	106.59	106.59	-
职工薪酬	830.00	860.00	900.00	930.00	960.00	979.20
增长率	1.27%	3.61%	4.65%	3.33%	3.23%	-
专业服务费	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	-
增加额	-175.88	10.00	10.00	10.00	10.00	-
以权益结算的股份支付	254.68	-	-	-	-	-
增加额	-	-	-	-	-	-
维修费	88.07	90.72	93.44	96.24	99.13	-
增长率	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
差旅费	43.00	45.15	47.41	48.83	50.29	-
增长率	1.22%	5.00%	5.00%	3.00%	3.00%	-

租金	31.98	33.58	35.26	37.02	38.87	-
增长率	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	-
办公费	33.75	34.76	35.80	36.88	37.98	-
增长率	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
保险费	33.67	34.69	35.73	36.80	37.90	-
增长率	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
其他	10.00	15.00	18.00	18.54	19.10	-
增长率	-43.08%	50.00%	20.00%	3.00%	3.00%	-

C. 研发费用预测

对研发费用中的各项费用进行分类分析，根据北京矽成的研发投入计划、不同费用的发生特点进行分析，采用不同的模型计算。

近年的研发费用如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2017	2018
研发费用	4,712.79	4,082.78
占营业收入比例	12.65%	9.78%
折旧摊销	194.01	221.35
工资福利费	1,963.10	1,298.39
外包服务费	1,636.41	1,897.74
以权益结算的股份支付	303.15	227.36
年增加额	-	-75.79
模具费	190.58	123.75
原料/测试费	111.39	82.20
办公费	67.40	46.49
租金	31.98	33.67
维修费	23.40	27.09
其他费用	191.37	124.75

北京矽成自 2016 年起资本化符合要求的研发费用，由于未来符合资本化条件的研发费用金额较难预测，本次评估采用的盈利预测维持历史资本化的金额水平进行预测。资本化的支出体现在无形资产的资本性支出以及无形资产维护性资本性支中。

折旧摊销：北京矽成未来将继续加大对研发的投入，根据北京矽成未来的研发规划，需要加大研发设备的投入，折旧摊销按投入规划增长。

工资薪酬：2017 年职工薪酬较高主要由于 2017 年的现金奖励中包含了一次性计入的因私有化而给予员工的现金奖励。未来工资薪酬的预测在 2018 年预测数的水平上考虑一定增长率。

以权益结算的股份支付：2017 年北京矽成授予管理层及核心员工信托份额成立员工持股平台，并受让部分北京矽成股权。上述费用将按照 40%、30%、30% 的比例于 2017 年、2018 年、2019 年进行分摊。2019 年以后不再预测。

原料/测试费：2017 年及 2018 年有部分薪酬已资本化，未来原料/测试费的预测在 2019 年预测数的水平上考虑一定增长率。

外包服务费、模具费、办公费等其他费用：结合企业未来研发规划，2019 年受市场环境的影响，测试项目有所减少，外包服务费也相应缩减。未来参考历史水平考虑一定增长率。

结合上述的分析计算过程，研发费用的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
研发费用	3,899.66	4,041.80	4,271.81	4,698.67	4,837.64	4,934.40
占营业收入比例	9.63%	8.96%	8.31%	8.32%	8.02%	8.02%
折旧摊销	225.04	236.97	247.20	257.43	257.43	-
增长率	1.67%	5.30%	4.32%	4.14%	0.00%	-
工资福利费	1,320.00	1,390.00	1,450.00	1,622.00	1,673.00	1,706.46
增长率	1.66%	5.30%	4.32%	11.86%	3.14%	-
外包服务费	1,710.00	1,900.00	2,010.00	2,100.45	2,163.46	-
增长率	-9.89%	11.11%	5.79%	4.50%	3.00%	-
以权益结算的股份支付	227.36	-	-	-	-	-
年增加额	-	-	-	-	-	-
模具费	124.00	150.00	165.00	287.00	296.00	-
增长率	0.21%	20.97%	10.00%	73.94%	3.14%	-
原料/测试费	83.00	100.00	110.00	127.00	133.00	-
增长率	0.98%	20.48%	10.00%	15.45%	4.72%	-

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年及以后
办公费	47.00	48.41	49.86	51.36	52.90	-
增长率	1.11%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	-
租金	35.36	37.12	38.98	40.93	42.97	-
增长率	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	-
维修费	27.90	29.30	30.76	32.30	33.27	-
增长率	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3.00%	-
其他费用	100.00	150.00	170.00	180.20	185.61	-
增长率	-19.84%	50.00%	13.33%	6.00%	3.00%	-

D. 财务费用预测

截至评估基准日，北京矽成无付息债务。

根据北京矽成提供的业务合同，北京矽成 2019 年将以融资租赁的方式租借给 Powerchip Technology Corporation（简称“Powerchip”）价值 6,000 万美元和 120,000 万新台币的设备，利率为 1.8%。Powerchip 还本付息期间为 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日。未来的利息收入预测如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
利息收入	89.14	178.28	178.28	167.14	111.42	52.00	3.71

此外，财务费用中，存款利息收入同银行手续费之间基本抵消；其它财务费用较少，故以后年度也不予预测。

结合上述的分析计算过程，财务费用的预测具备合理性，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年以后
财务费用合计	-89.14	-178.28	-178.28	-167.14	-111.42	0.00
占营业收入比例	-0.22%	-0.40%	-0.35%	-0.30%	-0.18%	-
其中：利息收入	89.14	178.28	178.28	167.14	111.42	-

E. 预测期期间费用占营业收入比逐年下降，且低于报告期水平的原因及合理性

2017 年至 2023 年北京矽成的期间费用占同期营业收入情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
销售收入	37,258.27	41,745.94	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00
销售费用	3,411.45	3,374.45	3,375.59	3,546.17	3,837.45	4,065.35	4,254.08
占比	9.16%	8.08%	8.33%	7.86%	7.47%	7.20%	7.05%
管理费用	2,211.59	1,764.29	1,600.27	1,402.45	1,468.78	1,520.89	1,569.86
占比	5.94%	4.23%	3.95%	3.11%	2.86%	2.69%	2.60%
研发费用	4,712.79	4,082.78	3,899.66	4,041.80	4,271.81	4,698.67	4,837.64
占比	12.65%	9.78%	9.63%	8.96%	8.31%	8.32%	8.02%
财务费用	82.10	-205.23	-89.14	-178.28	-178.28	-167.14	-111.42
占比	0.22%	-0.49%	-0.22%	-0.40%	-0.35%	-0.30%	-0.18%
合计	10,417.92	9,016.29	8,786.38	8,812.15	9,399.76	10,117.77	10,550.16
占比	27.96%	21.60%	21.69%	19.54%	18.29%	17.91%	17.50%

注：上述预测不包含北京矽成于 2018 年通过收购获得 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务以及私有化形成的可辨认无形资产和固定资产增值的折旧摊销。

预测期期间费用占营业收入比逐年下降，且低于报告期水平主要由于：

a. 北京矽成 2017-2019 年期间费用包含一次性费用

北京矽成 2017-2019 年期间费用占营业收入比例较高，主要原因为报告期期间费用包含了现金奖励计划所涉及的职工薪酬、股份支付费用、并购产生的专业服务费用等，此类费用具有偶发性特点，因此预测期期间费用中不包含此类一次性费用，相关一次性费用具体情况如下。

(a) “2017 现金奖励计划”

ISSI 私有化收购完成后，其股票不具有二级市场交易价格，ISSI 将剩余未实施的股权激励计划金额全部转化为现金激励计划，并制定了“2017 现金奖励计划”，其中 983.70 万美元作为职工薪酬计入 2017 年当期费用，31.81 万美元作为职工薪酬计入 2018 年当期费用。

(b) 股份支付费用

2017 年北京矽成设立员工持股平台，因股权激励事项形成的股份支付费用总金额为 1,814.26 万美元，其中 2017 年计入当期费用 725.70 万美元，2018 年计入当期费用 544.28 万美元，2019 年计入当期费用 544.28 万美元。

(c) 专业服务费

2017-2018 年，北京矽成收购 ISSI(Israel)和 Chiefmax(BVI)产生相关律师费用、财务尽调费用以及成立 WM、AM 产生相关律师费等，上述专业服务费用计入 2017 年和 2018 年当期费用分别为 171 万美元和 237 万美元。

(d) 汇兑损益

在盈利预测中，由于无法判断未来外汇市场变化，未对汇兑收益/损失进行预测。2017 年，北京矽成发生汇兑损失 228.58 万美元，2018 年，北京矽成发生汇兑损失 8.27 万美元。

因此，在剔除上述影响后，北京矽成 2017-2019 年期间费用占同期营业收入比例分别为 22.30%、19.62%和 20.35%，2017-2019 年期间费用占营业收入比例较高主要系一次性费用影响所致。

b. 预测期期间费用持续增长

根据北京矽成管理层提供的盈利预测，北京矽成 2019-2023 年期间费用总额持续增长，从 8,242.11 万美元（不包括 2019 年股份支付费用 544.28 万美元）增长至 10,550.16 万美元，复合增长率达到 6.37%。

c. 预测期营业收入增幅快于期间费用增幅

(a) 行业复苏带动营业收入快速增长

2018-2019 年半导体行业进入下行期，但市场机构普遍认为半导体行业在 2019 年相对疲软后有望在 2020 年实现复苏并保持繁荣。IHS 预计，2020 年全球半导体市场收入将出现反弹，增幅会达到 5.9%；WSTS 认为 2020 年全球半导体的市场规模将同比上升 5.4%，其中存储芯片上涨幅度高于其他品类；普华永道研究认为内存产品销售额仍是半导体收入的最大份额，预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%。

与此同时，作为近年来行业增速逐年增长的半导体专用领域行业之一，半导体在汽车产业中的应用逐渐扩大，市场整体呈稳步上升趋势。根据 IHS 预测，全球汽车半导体市场将从 2018 年的 340 亿美元增长到 2022 年的 553 亿美元，年均复合增长率达到 12.93%。根据普华永道研究，在半导体的应用市场中汽车和工业增长速度较快。其中，预计汽车市场增长最快，年均复合增长率将达到

11.9%；工业是仅次于汽车的增长市场，预计到 2022 年复合年均增长率将达到 10.8%。

同时，北京矽成作为存储芯片市场前列的设计公司，在产品研发方面保持稳定投入，具有较强的技术优势，持续推出行业领先的相关芯片产品。目前带有 ECC 功能的 SRAM 和 FLASH 均进入量产阶段，带有 ECC 功能的 DRAM 已进入产品送样阶段，后续也将不断推出专用领域存储芯片行业技术水平领先的研发成果和创新产品。新技术及新产品的持续开发将有助于北京矽成未来业务规模的持续提高。

因此，随着半导体行业逐渐复苏，尤其是北京矽成专注的汽车电子等领域的持续发展以及北京矽成新技术新产品的持续推出，将会带动北京矽成营业收入的快速增长。

(b) 期间费用中固定成本占比较高，不完全与营业收入线性相关

报告期内，北京矽成 2017 年和 2018 年期间费用中固定成本占比较高，具体情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比
销售费用	3,411.45	-	3,374.45	-
折旧摊销	61.04	1.79%	63.68	1.89%
职工薪酬	1,787.67	52.40%	1,541.14	45.67%
其他费用	1,562.74	45.81%	1,769.63	52.44%
管理费用	2,211.59	-	1,764.29	-
折旧摊销	98.33	4.45%	92.70	5.25%
职工薪酬	1,173.04	53.04%	819.57	46.45%
其他费用	940.22	42.51%	852.02	48.29%
研发费用	4,712.79	-	4,082.78	-
折旧摊销	194.01	4.12%	221.35	5.42%
职工薪酬	1,963.10	41.65%	1,298.39	31.80%
其他费用	2,555.68	54.23%	2,563.04	62.78%
销售费用、管理费用、研发费用合计	10,335.83	-	9,221.52	-
职工薪酬及折旧摊销	5,277.19	51.06%	4,036.83	43.78%

项目	2017 年		2018 年	
其他费用	5,058.64	48.94%	5,184.69	56.22%

2017 年和 2018 年，北京矽成销售费用、管理费用和研发费用中职工薪酬及折旧摊销金额，合计占三项费用总金额的比例分别为 51.06%和 43.78%，占比相对较高；且职工薪酬和折旧摊销费用相对较为固定，不完全与营业收入线性相关，不会随营业收入增长而大幅增加。

(c) 北京矽成管理体系成熟，持续优化改进

北京矽成发展成为汽车、工业等集成电路存储芯片专用领域的行业领先公司，除了其技术优势突出、研发实力领先、设计线条丰富等原因，与其高效率的服务、供应链、研发等管理体系也息息相关。

在服务链条方面，北京矽成已建立完善的质量管理系统，分别为客户服务模块（COP）、管理层模块（MP）和管理支持模块（SP）。其中核心模块为客户服务模块，本着以客户满意度为首的管理理念，在该模块中品质保障部门围绕从新产品立项规划、内部研发及品质验证、采购及销售策划到客户满意度反馈四个环节对产品的品质做到全范围的跟踪和监控。管理层模块和管理支持模块则是为了进一步加强客户服务环节中对产品质量的管理。

供应链网络方面，北京矽成多年来专注于设计领域的经营历史构筑了其在行业内同供应商之间可靠而稳定的合作关系。目前其长期合作的供应商伙伴包括了力晶科技、南亚科技、中芯国际等，均为在集成电路存储领域具有高品质、高良率、产能充足的晶圆代工厂。在封装和测试环节，北京矽成和南茂科技、矽格等厂商有着深厚的合作关系，在产能安排、测试品质、物流安排方面得到封装、测试厂的大力支持，满足专用领域客户及时高效、保质保量的需求。

研发管理方面，从最初的新产品立项讨论、设计标准检验，经过客户以及工程部对产品规格和性能的循环检验，直至最后产品开始小规模生产，北京矽成缜密而严格的研发管理体系，确保了产品从设计到量产的过程中，每一个重要环节都得到有效的控制和管理。

北京矽成通过其长期积累形成的成熟高效的经营管理体系，其期间费用不会随销售收入同比例增长。此外，北京矽成还在持续对其经营管理体系改进。

具体来说，北京矽成最近完成了新的 CRM 系统的优化，CRM 系由 Salesforce 开发的一种高度有效的客户关系管理系统，结合原有 ERP 系统，这将进一步提高公司经营管理、生产管理、和客户管理的效率，实现进一步降低运营成本和提高经营效率。

综上所述，北京矽成报告期内期间费用占营业收入比例较高主要系一次性费用影响所致；预测期内，期间费用复合增长率达到 6.37%，期间费用随业务发展持续增长；在行业复苏带动营业收入快速增长的同时，由于固定成本的存在，期间费用的增幅将低于营业收入的增幅，预测期期间费用占营业收入比逐渐下降符合市场发展趋势及北京矽成自身费用结构情况，具有合理性。

⑥其他收益和非经常性损益项目预测

由于行业特点，北京矽成未来会发生一定的存货减值损失，本次评估北京矽成管理层已在主营业务成本中考虑。故不再预测未来资产减值损失。

公允价值变动损益、资产处置收益、其他收益等非经常性损益因其具有偶然性，本次不作预测。

结合上述的分析计算过程，其他收益和非经常性损益项目的预测具备合理性。

⑦投资收益预测合理性分析

北京矽成长期股权投资金额较小，已作为非经营性资产处理，未来不预测相关投资收益。

⑧所得税的计算

北京矽成主要地区的所得税率如下表：

金额单位：万美元

税种	计税依据	税率
企业所得税（中国）	应纳税所得额	15%/25%
企业所得税（美国）	应纳税所得额	21%/35%
企业所得税（台湾）	应纳税所得额	17%
企业所得税（香港）	应纳税所得额	16.5%
企业所得税（开曼群岛）	应纳税所得额	0%

税种	计税依据	税率
企业所得税（日本）	应纳税所得额	15%-24%
企业所得税（新加坡）	应纳税所得额	17%
企业所得税（韩国）	应纳税所得额	24.2%

根据北京矽成管理层的访谈，北京矽成作为全球化的跨国企业，通过聘请第三方独立机构协助测算所得税额并协助制定相应的税务规划，在此基础上，北京矽成管理层预测未来的综合所得税率将保持在 15%左右。

（2）现金流相关预测

企业自由现金流 = 净利润 + 税后的付息债务利息 + 折旧和摊销 - 资本性支出 - 营运资本增加 + 以权益结算的股份支付 + 对外融资租赁现金流入，具体数据如下：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
一、营业收入	40,500.00	45,100.00	51,400.00	56,500.00	60,300.00	61,506.00
减：营业成本	26,520.00	28,715.00	32,680.00	36,028.79	38,573.66	39,345.13
税金及附加	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88	18.88
销售费用	3,375.59	3,546.17	3,837.45	4,065.35	4,254.08	4,339.16
管理费用	1,600.27	1,402.45	1,468.78	1,520.89	1,569.86	1,601.26
研发费用	3,899.66	4,041.80	4,271.81	4,698.67	4,837.64	4,934.40
财务费用	-89.14	-178.28	-178.28	-167.14	-111.42	0.00
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业利润	5,174.74	7,553.97	9,301.36	10,334.56	11,157.30	11,267.17
三、利润总额	5,174.74	7,553.97	9,301.36	10,334.56	11,157.30	11,267.17
四、所得税	776.21	1,133.10	1,395.20	1,550.18	1,673.59	1,690.08
五、净利润	4,398.53	6,420.87	7,906.16	8,784.38	9,483.71	9,577.09
六、归属于母公司损益	4,396.85	6,418.42	7,903.14	8,781.02	9,480.09	9,573.43
加：折旧和摊销	1,087.19	1,303.63	1,402.38	1,466.13	1,508.63	1,508.63
加：对外融资租赁现金流入	-9,993.44	-178.28	-178.28	2,921.77	3,301.44	-
减：资本性支出	1,666.48	1,922.92	1,971.67	1,535.42	1,477.92	1,508.63
减：营运资本增加	-453.05	134.19	2,826.38	2,332.19	1,774.48	552.80

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
七、股权自由 现金流	-5,722.84	5,486.67	4,329.19	9,301.31	11,037.75	9,020.63
加：税后的付 息债务利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、企业自由 现金流	-5,722.84	5,486.67	4,329.19	9,301.31	11,037.75	9,020.63

①折旧和摊销

折旧和摊销的预测，除根据北京矽成原有的各类固定资产和其它长期资产，并且考虑了改良和未来更新的固定资产和其它长期资产。折旧和摊销详见下表：

金额单位：万美元

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
企业资本性支出总计	1,666.48	1,922.92	1,971.67	1,535.42	1,477.92	1,508.63
其中：房屋建筑类资 本性支出小计	30.71	30.71	30.71	30.71	30.71	61.42
设备类的资本性支出 小计	565.06	826.11	856.11	676.11	581.11	581.11
其他长期资产的资本 支出小计	1,070.71	1,066.10	1,084.85	828.60	866.10	866.10
固定资产的资本性支出计算表						
在建工程-土建类期 末账面值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑物类原值	2,272.48	2,272.48	2,272.48	2,272.48	2,272.48	2,272.48
当期建筑物类折旧	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42
折旧资金用于维护的 比例	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%
因保持永续经营而维 护资金投入	30.71	30.71	30.71	30.71	30.71	61.42
期末建筑物类净值	1,914.10	1,883.39	1,852.68	1,821.97	1,791.26	1,791.26
账面净值率	84.2%	82.9%	81.5%	80.2%	78.8%	78.8%
在建工程-设备类期 末账面值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当期产能扩张需新增 设备类的资本投入	60.00	300.00	300.00	100.00	-	-
当期结转固定资产而 减少额（假设期末结 转）	121.03	300.00	300.00	100.00	0.00	-
设备类账面原值	7,667.09	7,967.09	8,267.09	8,367.09	8,367.09	8,367.09
当期设备类折旧	505.06	526.11	556.11	576.11	581.11	581.11

项目\年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 及以后
折旧资金用于维护的比例	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
因保持永续经营而维护资金投入	505.06	526.11	556.11	576.11	581.11	581.11
期末设备类净值	1,960.96	2,260.96	2,560.96	2,660.96	2,660.96	2,660.96
账面净值率	25.6%	28.4%	31.0%	31.8%	31.8%	31.8%
其他长期资产的资本性支出计算表						
其他长期资产的原值	5,728.77	6,278.77	6,628.77	6,928.77	6,928.77	6,928.77
其中：房产装修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术其他	5,728.77	6,278.77	6,628.77	6,928.77	6,928.77	6,928.77
因产能扩张需新增的长期资产投入	550.00	350.00	300.00	0.00	0.00	0.00
当期摊销总额	520.71	716.10	784.85	828.60	866.10	866.10
其中：房屋装修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摊销资金用于维护的比例	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
土地部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摊销资金用于维护的比例	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
技术其他	520.71	716.10	784.85	828.60	866.10	866.10
摊销资金用于维护的比例	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
因保持永续经营而维护资金投入	520.71	716.10	784.85	828.60	866.10	866.10
折旧摊销总额	1,087.19	1,303.63	1,402.38	1,466.13	1,508.63	1,508.63
其中：营业成本列支	702.98	901.16	981.78	1,028.97	1,071.47	1,071.47
销售费用列支	64.05	66.94	70.25	73.14	73.14	73.14
管理费用列支	95.12	98.56	103.15	106.59	106.59	106.59
研发费用列支	225.04	236.97	247.20	257.43	257.43	257.43

②资本性支出

本处定义的资本性支出是指企业为满足未来经营计划而需要更新现有固定资产设备和未来可能增加的资本支出及超过一年的长期资产投入的资本性支出。

基于本次收益法的假设前提之一为未来收益期限为无限期，所以目前使用的固定资产将在经济使用年限届满后，为了维持持续经营而必须投入的更新支出。

分析企业现有主要设备的成新率，大规模更新的时间在详细预测期之后，这样就存在在预测期内的现金流量与以后设备更新时的现金流量口径上不一致，为使两者能够匹配，本次按设备的账面原值/会计折旧年限的金额，假设该金额的累计数能够满足将来一次性资本性支出，故将其在预测期作为更新资本性支出。

随着业务收入的逐年增长，正常情况下固定资产的新增是必需的。企业自身虽然不进行生产，但是有部分供供应商使用的设备，同时，企业随着业务发展，也需要新增部分研发设备。根据企业管理层提供的设备资本性支出计划，评估人员在预测中考虑了每年度追加的设备资本性支出。

企业房地产可以满足未来的经营需求，未来除维护性支出外不考虑新增房地产。

无形资产的摊销，其可使用年限和企业的摊销年限相近，在维持现有生产规模的资本支出摊销与现有水平一致的基础上，额外考虑一定的研发费用资本化。具体数据请参见前述“①折旧与摊销”表格。

③营运资本增加额

营运资本增加额系指北京矽成在不改变当前主营业务条件下，为保持北京矽成持续经营能力所需的新增营运资金。营运资金的追加是指随着北京矽成经营活动的变化，获取他人的商业信用而占用的现金，正常经营所需保持的现金、存货等；同时，在经济活动中，提供商业信用，相应可以减少现金的即时支付。

北京矽成营运资本主要包括：正常经营所需保持的安全现金保有量、产品存货购置、代客户垫付购货款（应收、预付账款）等所需的基本资金以及应付、预收账款等。通常上述科目的金额与收入、成本呈相对稳定的比例关系，其他应收账款和其他应付账款以及其他经营性资产、负债需具体甄别视其与所估算经营业务的相关性确定（其中与主营业务无关或暂时性的往来作为非经营性）。本报告所定义的营运资本增加额为：

营运资本增加额=当期营运资本-上期营运资本

其中，营运资本=安全现金保有量+应收账款+预付账款+存货-应付账款-预收账款-应付职工薪酬-应交税费

安全现金保有量：企业要维持正常运营，需要一定数量的现金保有量。结合分析北京矽成以前年度营运资金的现金持有量与付现成本情况，确定安全现金保有量的月数，根据该月数计算完全付现成本费用。

月完全付现成本=（销售成本+应交税金+三项费用-折旧与摊销）/12

应收账款=营业收入总额/应收款项周转率

预付账款=营业成本总额/预付账款周转率

存货=营业成本总额/存货周转率

应付账款=营业成本总额/应付账款周转率

预收账款=营业收入总额/预收账款周转率。

应付职工薪酬=营业成本总额/应付职工薪酬率

应交税费=营业收入总额/应交税费周转率。

④对外融资租赁现金流入

根据企业提供的合同，企业计划 2019 年将以融资租赁的方式租借给 Powerchip Technology Corporation(简称“Powerchip”)价值 6,000 万美元和 120,000 万新台币的设备。故在 2019 年预测 9,904.31 万美元购买设备的现金流出。

根据合同约定，Powerchip 还本付息期间为 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日。由于本次评估收益法预测企业至 2023 年将达到稳定期，故在在 2024 年以前考虑 Powerchip 还本付息的现金流入，将 2024 年及 2025 年 Powerchip 还本付息（税后利息）的现金流折现后确认为非经营性资产。

⑤税后付息债务利息

税后付息债务利息根据财务费用中列支的利息支出，扣除所得税后确定。

北京矽成没有付息债务，故未来不考虑税后付息债务利息。

（3）折现率的确定

折现率，又称期望投资回报率，是收益法确定评估企业市场价值的重要参数。由于北京矽成不是上市公司，其折现率不能直接计算获得。因此本次评估采用选取对比公司进行分析计算的方法估算被评估企业期望投资回报率。为此，第一步，

首先在上市公司中选取对比公司，然后估算对比公司的系统性风险系数 β ；第二步，根据对比公司平均资本结构、对比公司 β 以及被评估公司资本结构估算被评估企业的期望投资回报率，并以此作为折现率。

本次采用资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率。WACC 模型它是期望的股权回报率和所得税调整后的债权回报率的加权平均值。

在计算总投资回报率时，第一步需要计算，截至评估基准日，股权资金回报率和利用公开的市场数据计算债权资金回报率。第二步，计算加权平均股权回报率和债权回报率。

总资本加权平均回报率利用以下公式计算：

$$R = R_d \times (1 - T) \times W_d + R_e \times W_e$$

式中：

W_d ：评估对象的付息债务比率；

$$W_d = \frac{D}{(E + D)}$$

W_e ：评估对象的权益资本比率；

$$W_e = \frac{E}{(E + D)}$$

T ：所得税率；

R_d ：付息债务利率；

R_e ：权益资本成本；

①权益资本成本

权益资本成本，按资本资产定价模型（CAPM）确定权益资本成本 R_e ：

$$R_e = R_f + \beta_e \times MRP + \varepsilon$$

式中：

R_f ：无风险报酬率；

MRP ：市场风险溢价；

ϵ ：评估对象的特定风险调整系数；

β_e ：评估对象权益资本的预期市场风险系数；

$$\beta_e = \beta_t \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

式中： β_t 为可比公司的预期无杠杆市场风险系数；

D、E：分别为付息债务与权益资本。

分析 CAPM 采用以下几步：

A. 无风险报酬率

根据 Aswath Damodaran 的研究，一般会把作为无风险资产的零违约证券的久期，设为现金流的久期。国际上，企业价值评估中最常选用的年限为 10 年期债券利率作为无风险利率。本次评估无风险报酬率选择基准日美国十年期国债到期收益率 2.69%。

B. 市场风险溢价 MRP 的确定

市场风险溢价（Equity Risk Premiums，ERP）是预期市场证券组合收益率与无风险利率之间的差额。

本次评估中采用美国纽约大学斯特恩商学院著名金融学教授、估值专家 Aswath Damodaran 根据美国股票市场的统计计算。根据 Damodaran 2019 年 1 月发布的数据，成熟市场的风险溢价为 5.96%。

C. 贝塔值

该系数是衡量委估企业相对于资本市场整体回报的风险溢价程度，也用来衡量个别股票受包括股市价格变动在内的整个经济环境影响程度的指标。由于北京矽成目前为非上市公司，一般情况下难以直接对其测算出该系数指标值，故本次通过选定与北京矽成处于同行业的上市公司于基准日的 β 系数（即 β_t ）指标平

均值作为参照。CapitalIQ 是一家提供金融数据并提供 β 值的计算的公司。经查半导体行业的可比公司剔除财务杠杆调整平均 $\beta_t = 1.144$ 。D 根据基准日的有息负债确定，E 根据股权价值评估值确定。经过计算，北京矽成自身的 $D/E = 0.0\%$ 。最后得到评估对象权益资本预期风险系数的估计值 $\beta_e = 1.144$ 。

D. 企业特定风险 ε 的确定

经分析，企业特定风险调整系数为待估企业与所选择的可比上市公司在企业规模、经营风险、管理能力、财务风险等方面所形成的优劣势方面的差异，各风险说明如下：

北京矽成的经营实体原本为美国上市公司，后被北京矽成收购。由于北京矽成采用无晶圆厂的运营模式，资产规模和营业收入与大部分可比上市公司相比较小。但是，经营业务上净利润率等收益指标已经达到甚至超过可比上市公司水平；北京矽成主要产品为存储芯片，经营业务涉及全球，在细分行业内有一定的排名。北京矽成内部管理及控制机制尚好，管理人员的从业经验和资历较高。北京矽成目前经营情况良好，现金流较为稳定，没有大额的资金需求。

综合以上因素，北京矽成特定风险 ε 的确定为 1%。

E. 权益资本成本的确定

最终得到评估对象的权益资本成本 $R_e = 10.50\%$

② 债务资本成本

债务资本成本 R_d 取 5 年期以上贷款利率 4.90%。

③ 资本结构的确定

结合企业未来盈利情况、管理层未来的筹资策略，确定上市公司资本结构为企业目标资本结构比率。

$$W_d = \frac{D}{(E + D)} = 0.0\%$$

$$W_e = \frac{E}{(E + D)} = 100.0\%$$

④折现率计算

$$R = R_d \times (1 - T) \times W_d + R_e \times W_e = 10.50\%。$$

(4) 股东全部权益价值计算

本次评估的基本模型为：

$$E = B - D$$

式中：

E：评估对象的股东全部权益价值；

B：评估对象的企业价值；

D：评估对象付息债务价值。

$$B = P + \sum C_i$$

P：评估对象的经营性资产价值；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n * (1+g)}{(r-g) * (1+r)^n}$$

式中：

r：所选取的折现率系资产评估专业人员，在综合考虑评估基准日的利率水平、市场投资收益率等资本市场相关信息和所在行业、被评估单位的特定风险等相关因素确定折现率；

Fi：评估对象未来第 i 年的预期收益（现金流）；

n：明确的预测期期间是指从评估基准日至企业达到相对稳定经营状况的时间。

评估人员在对企业收入结构、成本结构、资本结构、资本性支出、投资收益和风险水平等综合分析的基础上，结合宏观政策、行业周期及其他影响企业进入稳定期的因素，确定预测期。本次明确的预测期期间 n 选择为 5 年。

根据被评估单位所在行业现状与发展前景、协议与章程约定、经营状况、资产特点和资源条件等，确定预测期后收益期确定为无限期

g —未来收益每年增长率，根据企业进入稳定期的因素分析预测期后的收益趋势，本次评估假定 n 年后 F_i 不变， g 取 2%。

ΣC_i : 评估对象基准日存在的溢余资产、非经营性资产或负债的价值。

①经营性资产价值

对纳入报表范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型估算预期收益（净现金流量），并折现得到评估对象经营性资产的价值。

②溢余资产价值

经清查，账面货币资金账户存款余额 16,895.10 万美元。经评估人员根据历史数据分析，企业正常资金周转需要的完全现金保有量为 2 个月的付现成本费用，除此之外约有 11,050.66 万美元货币资金为溢余性资产。

根据北京矽成管理层了解，一般情况下 2 个月的付现成本费用可以满足企业的正常资金周转。同时，评估师根据企业报告期内应收账款周转率 6.63 进行复核分析，在正常情况企业不足 2 个月即可收到客户的货款，故认为 2 个月的付现成本费用可以满足企业的正常资金周转。根据计算，2018 年月付现成本约 2,922.22 万美元，2 个月的月付现成本约 5,844.44 万美元。

北京矽成 2018 年 12 月 31 日货币资金余额为 16,895.10 万美元，扣减上述最低现金保有量即得到溢余资金 11,050.66 万美元。上述资金主要用于 2019 年以融资租赁的方式租借给力晶科技设备的购买费用。

根据 ISSI、ICSI 与力晶科技共同签署的融资租赁协议，租赁标的物均为生产设备，主要用于力晶科技的晶圆制造，目前设备购买已陆续进行。由于融资租赁并非北京矽成的主营业务，本次评估未将上述融资租赁所需要支付的资金列入营运资金周转中考虑。在企业自由现金流计算的过程中，2019 年单独扣除了需要购买融资租赁设备的 9,904.31 万美元现金支出。

综上所述，北京矽成于 2018 年 12 月 31 日存在溢余资金余额具备合理性。

③非经营性资产价值

经过资产清查，北京矽成的非经营性资产和负债评估值如下：

金额单位：万美元

科目名称	内容	账面价值	评估价值
非经营性资产小计		6,043.86	8,408.61
其他流动资产	待抵扣进项税、预缴所得税、股份支付款	1,188.19	1,188.19
长期股权投资	Saint Tai Group Limited	134.09	134.09
递延所得税资产	会税差异产生的递延所得税资产	959.95	959.95
其他非流动资产	Chiefmax (BVI)、ISSI (Israel)已支付收购款	2,802.85	2,802.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	在 UBS 购买的货币基金	958.78	958.78
长期应收款	预测期末确认的融资租赁现金流入	-	2,364.75

其中部分非经营性资产评估值说明如下：

长期股权投资：由于本次评估采用合并利润表为基础进行盈利预测，对非控股权益法核算的长期投资无法获得盈利预测，且企业投资 Saint Tai Group Limited 金额较少，近年盈利变化不大，且故作为非经营性资产按账面值评估。

其他非流动资产- Chiefmax (BVI)、ISSI (Israel)已支付收购款：按照本次评估思路，将 Chiefmax (BVI)、ISSI (Israel)作为非经营性资产处理，由于上述两家公司均于 2018 年完成收购，收购时间较近，故按照已支付的收购款确认评估值。

长期应收款-预测期末确认的融资租赁现金流入：根据北京矽成提供的合同，北京矽成计划 2019 年将以融资租赁的方式租借给 Powerchip 价值 6,000 万美元和 120,000 万新台币的设备。Powerchip 还本付息期间为 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日。由于本次评估收益法预测北京矽成至 2023 年将达到稳定期，故将 2024 年及 2025 年 Powerchip 还本付息的现金流折现后确认为非经营性资产。

金额单位：万美元

科目名称	内容	账面价值	评估价值
非经营性负债小计		1,003.33	1,003.33
递延所得税负债	会税差异产生的递延所得税负债	783.43	783.43
长期应付职工薪酬	设定受益计划净负债	17.12	17.12
其他应付款	应付利息	9.46	9.46
其他负债	税项	193.32	193.32

④企业价值

将所得到的经营性资产的价值、基准日的溢余资产价值、非经营性资产价值

代入公式，即得到评估对象企业价值。

⑤股东全部权益价值

将评估对象的付息债务的价值代入式，得到评估对象的全部权益价值为：

$$E = B - D = 102,400.00 \text{ 万美元}$$

（5）收益法评估结论

经收益法评估，北京矽成半导体有限公司于评估基准日，在假设条件成立的前提下，股东全部权益价值为美元102,400.00万元。按中国人民银行公布的基准日外汇中间价1：6.8632计算，折合人民币702,791.68万元。

（二）市场法评估具体情况

1、市场法简介

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估方法。市场法实质是利用活跃交易市场上已成交的类似案例的交易信息或合理的报价数据，通过对比分析的途径确定委估企业或股权价值的一种评估技术。

市场法中常用的两种方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，评估结论应当考虑流动性对评估对象价值的影响。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。运用交易案例比较法时，应当考虑评估对象与交易案例的差异因素对价值的影响。

（1）应用前提

①必须有一个充分发展、活跃的资本市场；

②存在三个及三个以上相同或类似的可比企业，可比企业应当与被评估企业属于同一行业，或者受相同经济因素的影响；

③可比企业与被评估企业的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

（2）评估假设

①市场法所选取的可比上市公司的案例，其股票的市场交易是正常有序的，交易价格并未受到非市场化的操控；

②上市公司公开披露的财务报表数据是真实的，信息披露是充分的、及时的。

（3）评估思路

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。采用上市公司比较法，一般是根据评估对象所处市场的情况，选取某些指标如市净率(P/B)、市盈率(P/E)等与可比上市公司进行比较，通过对评估对象与可比上市公司各指标相关因素的比较，调整影响指标因素的差异，来得到评估对象的市净率(P/B)、市盈率(P/E)，据此计算被评估单位股权价值。对于上市公司比较法，使用市场法估值的基本条件是：需要有一个较为活跃的资本、证券市场；可比公司及其与估值目标可比较的指标、参数等资料是可以充分获取。证券公司监管严格，信息披露充分，目前存在较多的可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。采用交易案例比较法和上市公司比较法类似，一般是根据评估对象所处市场的情况，选取某些公共指标如市净率(P/B)、市盈率(P/E)等与可比公司进行比较，通过对评估对象与可比公司各指标相关因素的比较，调整影响指标因素的差异，来得到评估对象的市净率(P/B)、市盈率(P/E)，据此计算目标公司股权价值。

鉴于近年资本市场与标的公司行业相同，规模相近并公开披露标的完整财务数据的可比交易案例较少，本次选择上市公司比较法。

本次上市公司比较法的基本评估思路如下：

①分析被评估单位的基本状况。主要包括企业类型、成立时间、业务结构及市场分布、经营模式、规模、所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等。

②确定可比上市公司。主要结合业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等进行比较筛选。

③分析、比较被评估单位和可比公司的主要财务指标，包括盈利能力、资产规模、经营能力、风险管理能力等。

④对可比公司选择适当的价值比率，并采用适当的方法对其进行修正、调整，进而估算出被评估单位的价值比率。

⑤根据被评估单位的价值比率，最终确定被评估单位的股权价值。

考虑到被评估单位盈利尚可，且根据评估对象所处半导体设计行业的特点，有效的高研发投入会体现在收入规模上，因此收入类指标和收益率指标均适用。此外，被评估对象一般与可比公司之间资本结构有所差异，为了更全方位、更综合的评价被评估单位的经营情况，本次选取盈利类指标 EV/EBITDA、收入类指标 EV/S 作为比较的价值比率。

（4）评估模型及各项参数

股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值

经营性资产价值=被评估企业相关指标×参考企业相应的价值比率×修正系数

其中，价值比率是企业整体价值或股权价值与自身一个与整体价值或股权价值密切相关的体现企业经营特点参数的比值。价值比率的实质就是“单位价值”的概念。价值比率是市场法评估将被评估单位与可比公司进行“对比分析”的基础。

按照价值比率分子的性质，价值比率可以分为权益价值比率与企业整体价值比率。权益价值比率主要指以权益价值作为分子的价值比率，主要包括 P/E、P/B

等。企业整体价值比率主要指以企业整体价值作为分子的价值比率，主要包括 EV/EBIT、EV/EBITDA、EV/销售收入等。

按照价值比率分母的性质，价值比率可以分为盈利价值比率、收入价值比率、资产价值比率和其他特殊价值比率：

$$\text{盈利价值比率} = \frac{\text{企业整体价值} / \text{股权价值}}{\text{盈利类参数}}$$

$$\text{收入价值比率} = \frac{\text{企业整体价值}}{\text{销售收入}}$$

$$\text{资产价值比率} = \frac{\text{企业整体价值} / \text{股权价值}}{\text{资产类参数}}$$

$$\text{其他特殊价值比率} = \frac{\text{企业整体价值} / \text{股权价值}}{\text{特殊类参数}}$$

考虑到所能获取到的上市公司资料的局限性，本次评估在计算可比公司有关价值比率时，未对可比公司相关非经常性损益及非经营性资产（负债）予以调整。而被评估单位采用模拟审计报告披露的相关财务数据，故被评估单位的除其他非流动资产中武汉群茂及 ISSI (Israel)已支付的收购款外，其他相关非经营性因素也不做调整。

2、市场法评估过程

（1）对比公司的选择

由于被评估企业是一家非上市公司，其股权不具备公开交易流通市场，因此不能直接确定其市场价值，也不适宜采用直接法计算其风险回报率。我们采用在美国上市公司中选用对比企业，对比企业的选取过程如下：

在本次评估中对对比公司的选择标准如下：

- ①对比公司属于半导体行业，以设计为主，账面固定资产占比相对较低。
- ②对比公司近年 EBITDA 为正数；
- ③对比公司的收入规模为标的公司的±4 倍。

委估标的注册在中国，但主要经营实体注册在美国、台湾等地。本次对比公司选择美国市场上市公司，原因如下：

台湾资本市场：台湾半导体行业上市公司多为 IDM 模式（集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身）和 Foundry 模式（代工厂，只负责制造、封装或测试的其中一个环节），账面固定资产占比相对较高，与标的公司的无晶圆厂模式结构差异较大。

美国资本市场：美国资本市场规模大，且历史悠久，被公认为相对成熟的资本市场，且有可以类似的上市公司可供选择；

根据上述原则，我们选取了以下四家公司作为对比企业：

①对比公司一：Silicon Laboratories Inc.（简称：SLAB）

股票代码：NasdaqGS:SLAB

公司注册地：美国

Silicon Laboratories Inc.成立于 1996 年，总部位于德克萨斯州奥斯汀市，是一家无晶圆厂半导体公司，在美国，中国和国际上其他国家设计、开发和销售混合信号集成电路。该公司提供物联网相关产品，包括 8 位混合信号，32 位无线和超低功耗 32 位微控制器；无线连接设备相关产品，如多协议无线 Gecko 片上系统设备；实时操作系统；传感器产品。它还提供基础设施相关产品，如计时设备、多通道隔离器、广播产品等。该公司主要通过直接销售人员以及独立销售代表和分销商网络将其产品销售给物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费和汽车市场。

②对比公司二：Mellanox Technologies, Ltd.（简称：MLNX）

股票代码：NasdaqGS:MLNX

公司注册地：美国

Mellanox Technologies, Ltd.成立于 1999 年，总部位于加利福尼亚州桑尼维尔市，是一家无晶圆厂半导体公司。其产品有助于服务器，存储系统，通信基础设施设备和其他嵌入式系统之间的数据传输。该公司提供 InfiniBand 解决方案，包括交换机、网关集成电路（IC）、适配卡、电缆、模块和软件；和以太网解决方案，如以太网交换机产品和以太网适配器，用于企业数据中心、高性能计算、云数据中心等。它还还为服务器，存储，通信基础设施和嵌入式系统原始设备制造

商提供适配器。该公司通过其直销团队，销售代表网络和独立分销商销售其产品。该公司在美国，中国，欧洲，美洲其他地区以及亚洲其他地区开展业务。

③对比公司三：Semtech Corporation（简称：SMTC）

股票代码：NasdaqGS:SMTC

公司注册地：美国

Semtech Corporation 成立于 1960 年，总部位于加利福尼亚州卡马里奥，是一家主营模拟和混合信号半导体公司。包括用于各种企业计算、工业和通信应用的光学数据传输、视频传输产品组合；用于数据中心、企业网络、无源光网络、无线基站光收发器和高速接口应用的集成电路产品组合；用于广播应用的视频产品，以及用于专业音频视频应用的 IP 视频技术。它还提供无线和传感产品，包括各种用于工业、医疗和通信应用的专用射频产品组合，以及用于工业和消费者应用的专用传感产品。它为企业计算，通信，消费和工业终端市场中的原始设备制造商及其供应商提供服务。该公司直接销售其产品，并通过美国，欧洲和亚洲的独立销售代表公司和独立分销商销售产品。

④可比案例四：Lattice Semiconductor Corporation（简称：LSCC）

股票代码：NasdaqGS:LSCC

公司注册地：美国

Lattice Semiconductor Corporation 成立于 1983 年，总部位于俄勒冈州希尔斯伯勒。该公司在亚洲，欧洲和美洲开发和销售半导体产品。该公司提供现场可编程门阵列，包括五个产品系列：ECP，MachXO，iCE40，CrossLink 和可编程混合信号器件。它还提供视频连接应用特定的标准产品，如端口处理器，端口控制器，视频处理器，发射器，接收器，桥接器和转换器，用于移动电话，超高清电视，家庭影院系统的 HDMI 电缆延长器等。该公司并不自行制造硅晶片，亚洲几个大型半导体生产商与公司保持战略伙伴关系。该公司直接向终端客户销售产品，并间接通过独立制造商代表和独立分销商的网络销售产品。该公司主要服务于通信和计算，移动和消费，工业和汽车终端市场的原始设备制造商。

（2）对比公司财务指标的分析

公司财务指标的好坏直接影响企业的价值，一般公司的财务指标分为盈利能力指标、成长能力指标、营运能力指标及偿债能力指标四类。

盈利能力指标：盈利能力指标是指衡量一个企业经营盈利能力的指标，经常被采用的盈利能力指标包括销售毛利率、总资产利润率和净资产收益率等，本次评估综合分析后采用上述三个指标作为衡量企业经营盈利能力的指标。

成长能力指标：成长能力指标是指衡量被评估企业经营发展的成长能力的指标，经综合分析，本次评估我们选取主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率、总资产同比增长率作为我们衡量被评估企业经营发展的成长能力的指标。

营运能力指标：营运能力指标实际上是衡量被评估企业经营管理能力的一项指标，本次评估我们采用营业周期、净资产周转率和总资产周转率作为营运能力的衡量指标。

偿债能力指标：偿债能力指标是衡量企业偿还到期债务能力的指标，本次评估选取流动比率、速动比率、资产负债率及已获利息倍数作为衡量企业偿债能力的指标。

四家对比公司及被评估企业近年的主要财务数据及各项指标数据详见下表：

金额单位：万美元

项目	具体指标	待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTC	LSCC
资产负债表	应收账款	6,083.96	7,319.40	15,062.50	7,922.30	7,003.30
	存货	15,135.16	7,497.20	10,438.10	6,367.90	6,709.60
	资产总额	95,107.54	162,435.40	158,719.80	106,288.10	62,368.70
	付息债务	-	35,477.10	-	21,111.40	25,964.70
	净资产总额	85,262.65	106,729.00	130,164.80	68,268.10	25,845.70
	归母净资产	85,085.27	106,729.00	130,164.80	68,268.10	25,845.70
利润表	营业收入	41,745.94	86,826.70	108,874.30	62,719.60	39,879.90
	营业成本	27,231.42	34,076.80	38,857.30	25,017.40	17,153.10
	销售税金及附加	18.88	-	-	-	-
	期间费用	9,230.94	43,129.10	56,151.80	29,526.90	18,979.30
	财务费用	-205.23	1,130.00	180.00	920.00	2,060.00

项目	具体指标	待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTIC	LSCC
	利润总额	4,899.66	7,216.10	11,221.10	6,297.20	-2,400.00
	净利润	4,191.42	8,359.10	13,425.80	6,305.60	-2,630.00
	归母净利润	4,189.43	8,359.10	13,425.80	6,305.60	-2,630.00
偿债能力	流动资产	41,970.30	82,663.80	71,043.80	48,530.40	28,442.30
	存货	15,135.16	7,497.20	10,438.10	6,367.90	6,709.60
	资产总额	95,107.54	162,435.40	158,719.80	106,288.10	62,368.70
	流动负债	8,378.54	14,484.50	21,277.20	12,991.40	6,941.80
	负债总额	9,844.89	55,706.40	28,555.00	38,020.00	36,523.00
	流动比率	5.0	5.7	3.3	3.7	4.1
	速动比率	3.2	5.2	2.8	3.2	3.1
	资产负债率	10.4%	34.3%	18.0%	35.8%	58.6%
经营能力	存货周转率	1.8	4.5	3.7	3.9	2.6
	应收账款周转率	6.9	11.9	7.2	7.9	5.7
	总资产周转率	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6
盈利能力	成本费用利润率	13.5%	9.2%	11.8%	11.4%	-6.3%
	净利率	10.0%	9.6%	12.3%	10.1%	-6.6%
	净资产收益率	4.9%	7.8%	10.3%	9.2%	-10.2%
成长性	2020 年预测收入	45,100.00	93,526.00	140,087.00	65,539.00	43,015.00
	收入复合增长率	3.9%	4.5%	13.4%	2.2%	3.9%

（3）价值比率计算及修正

根据获得的对比公司近年的财务数据计算对比公司近年的价值比率，计算公式如下：

$EV/EBITDA = \text{经营性企业价值} / \text{基准日当年归母息税折旧前利润}$

$EV/S = \text{经营性企业价值} / \text{基准日当年营业收入}$

$\text{经营性企业价值} = \text{对比公司市值} \times (1 - \text{非流通性折扣率}) + \text{付息债务} - \text{货币资金}$

由于对比公司和被评估企业在经营风险和未来预期收益的增长率等方面的影响因此需要对比公司上述价值比率进行必要的修正，分别采用了不同的修正系数对对比公司的修正系数进行修正，具体如下：

EV/EBITDA 因素条件比较和打分表

金额单位：万美元

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTC	LSCC
价值比例 EV/EBITDA		-	15.55	13.88	14.44	11.22
交易日期修正	评估基准日	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
交易情况修正	交易情况	-	均为正常市场交易	均为正常市场交易	均为正常市场交易	均为正常市场交易
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
成长性修正	收入复合增长率	3.9%	3.8%	13.4%	2.2%	3.9%
	打分系数	100.0	100.0	105.0	98.0	100.0
控制权修正	控制权影响	控制权转让	小股权转让	小股权转让	小股权转让	小股权转让
	打分系数	100.0	91.0	91.0	91.0	91.0
经营规模修正	营业收入	41,745.94	86,826.70	108,874.30	62,719.60	39,879.90
	打分系数	100.0	105.0	105.0	103.0	100.0
	资产总额	95,107.54	162,435.40	158,719.80	106,288.10	62,368.70
	打分系数	100.0	104.0	103.0	101.0	98.0
	小计	100.0	104.5	104.0	102.0	99.0
营运能力修正	总资产周转率	0.40	0.50	0.70	0.60	0.60
	打分系数	100.0	101.0	104.0	103.0	103.0
	应收账款周转率	6.90	11.90	7.20	7.90	5.70

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTc	LSCC
	打分系数	100.0	104.0	100.0	101.0	99.0
	小计	100.0	102.5	102.0	102.0	101.0
偿债能力修正	速动比率	3.20	5.20	2.80	3.20	3.10
	打分系数	100.0	103.0	99.0	100.0	100.0
	资产负债率	0.10	0.34	0.18	0.36	0.59
	打分系数	100.0	95.0	96.0	95.0	95.0
	小计	100.0	99.0	97.5	97.5	97.5

EV/S 因素条件比较和打分表

金额单位：万美元

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTc	LSCC
价值比例 EV/S		-	2.72	2.75	2.81	0.99
交易日期修正	评估基准日	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31	2018/12/31
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
交易情况修正	交易情况	-	均为正常市场交易	均为正常市场交易	均为正常市场交易	均为正常市场交易
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
成长性修正	收入复合增长率	3.90%	3.80%	13.40%	2.20%	3.90%
	打分系数	100.0	100.0	105.0	98.0	100.0

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三	案例四
		北京矽成	SLAB	MLNX	SMTc	LSCC
控制权修正	控制权影响	控制权转让	小股权转让	小股权转让	小股权转让	小股权转让
	打分系数	100.0	91.0	91.0	91.0	91.0
经营规模修正	资产总额	95,107.54	162,435.40	158,719.80	106,288.10	62,368.70
	打分系数	100.0	104.0	103.0	101.0	98.0
营运能力修正	总资产周转率	0.40	0.50	0.70	0.60	0.60
	打分系数	100.0	101.0	104.0	103.0	103.0
	应收账款周转率	6.90	11.90	7.20	7.90	5.70
	打分系数	100.0	104.0	100.0	101.0	99.0
	小计	100.0	102.5	102.0	102.0	101.0
偿债能力修正	速动比率	3.20	5.20	2.80	3.20	3.10
	打分系数	100.0	103.0	99.0	100.0	100.0
	资产负债率	0.10	0.34	0.18	0.36	0.59
	打分系数	100.0	95.0	96.0	95.0	95.0
	小计	100.0	99.0	97.5	97.5	97.5
盈利能力修正	成本费用利润率	13.5%	9.2%	11.8%	11.4%	-6.3%
	打分系数	100.0	98.0	99.0	99.0	95.0
	净资产收益率	4.9%	7.8%	10.3%	9.2%	-10.2%
	打分系数	100.0	103.0	105.0	104.0	95.0
	小计	100.0	100.5	102.0	101.5	95.0

修正体系解释如下：

①流通性的修正

由于选取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的，而北京矽成非上市公司，因此对比案例的流通市场的市值需要修正。

一般认为不可流通股与流通股之间的价格差异主要由下列因素造成：

承担的风险：流通股的流通性很强，一旦发生风险后，流通股持有者可以迅速出售所持有股票，减少或避免风险。非流通股持有者在遇到同样情况后，则不能迅速做出上述反映而遭受损失。

交易的活跃程度：流通股交易活跃，价格上升。非流通股缺乏必要的交易人数，另外非流通股一般数额较大，很多投资者缺乏经济实力参与非流通股的交易，因而，与流通股相比，交易缺乏活跃，价格较低。

从历史上看，缺乏流通性折扣的定量研究主要有以下两个途径：限制性股票交易价格研究途径（Restricted Stock Studies）；IPO 前交易价格研究途径（Pre-IPO Studies）。

按照限制性股票交易价格研究途径。下面给出一些比较著名的美国研究：

国外不可流通研究一览表

序号	研究报告	研究时期	平均折扣率(%)
1	SEC Overall Average	1966-1969	25.8
2	SEC Non-reporting OTC Companies	1966-1969	32.6
3	Gelman	1968-1970	33
4	Trout	1968-1972	33.5
5	Moroney	1973	35.6
6	Maher	1969-1973	35.4
7	Standard Research Consultants	1978-1982	45
8	Willamette Management Associates	1981-1984	31.2
9	Silber Study	1981-1988	33.8
10	FMV Study	1979-1992.4	23
11	FMV Restricted Stock Study	1980-2001	22.1
12	Management Planning, Inc.	1980-1995	27.7

序号	研究报告	研究时期	平均折扣率(%)
13	Bruce Johnson	1991-1995	20
14	Columbia Financial Advisors	1996-1997.2	21
15	Columbia Financial Advisors	1997.5-1998	13

上述研究的平均缺乏流通性折扣率为 29%。

按照 IPO 前交易价格研究途径。美国评估界也有一系列研究：

研究涵盖日期	IPO 项目数量	复核条件的交易 案例数量	折扣率平均值	折扣率中位值
1997-2000	1,847	266	50%	52%
1995-1997	732	84	43%	41%
1994-1995	318	45	45%	47%
1991-1993	433	49	45%	43%
1990-1992	266	30	34%	33%
1989-1990	157	17	46%	40%
1987-1989	98	21	43%	43%
1985-1986	130	19	43%	43%
1980-1981	97	12	68%	68%
1980-2000	4,008	543	47%	47%

上述研究的平均缺乏流通性折扣率为 46%。

以上研究可以有力证明如下一个观点，缺少变现能力或说缺少流通性，对股票的价格有很大的减值影响。这种影响如果与可流通股相比较存在减值折扣率。

参考上述统计，本次评估结合两种研究途径的结论选择 38%作为非流通性折扣率。

由于非流通性折扣率相关统计是基于股权价值上的考虑，故本次评估通过扣除流通性溢价的股权价值加上债权价值减去货币资金得出企业价值用于计算相关价值比率。详见下表：

金额单位：万美元

具体指标	案例一	案例二	案例三	案例四
	SLAB	MLNX	SMTc	LSCC
市值	355,523.40	492,869.83	300,055.67	41,143.24
非流通性折扣率	38%	38%	38%	38%

具体指标	案例一	案例二	案例三	案例四
	SLAB	MLNX	SMTC	LSCC
经营性股权价值	220,424.51	305,579.29	186,034.52	25,508.81
付息债务	35,477.10	-	21,111.40	25,964.70
货币资金	19,704.30	5,676.60	31,212.00	11,905.10
经营性企业价值	236,197.31	299,902.69	175,933.92	39,568.41
对应归母息税折旧前利润	15,187.50	21,600.10	12,181.10	3,526.10
对应营业收入	86,826.70	108,874.30	62,719.60	39,879.90
EV/EBITDA 值	15.55	13.88	14.44	11.22
EV/S 值	2.72	2.75	2.81	0.99

②交易日期修正

资产的价格会因为不同的时间而发生变化，而可比案例的成交日期与评估时点通常不同。因此需要将可比案例在其成交日期时的价格调整到在评估时点的价格。这种对可比案例成交价格进行的调整，称为“市场状况调整”，或称“交易日期修正”。经过这一调整或修正之后，就将可比案例在其成交日期的价格变成了在评估时点的价格。

本次采用上市公司比较法，且计算口径均为 2018 年 12 月 31 日的股票交易价格，因此不需要进行交易日期修正。

③交易情况修正

可比案例的成交价格是实际发生的，它可能是正常的、公允的市场价值，也可能是某些特定条件、交易条款下的价格。由于要求评估对象价值是客观、公允的，所以可比案例的成交价格如果是不正常的，则应把它修正为正常的。这种对可比案例成交价格进行的修正，称为交易情况修正。

进行交易情况修正，应排除交易行为中的特殊因素所造成的可比案例成交价格偏差，将可比案例的成交价格调整为正常价格。需要核查的交易情况如下：

A.有利害关系人之间的交易-来自于配偶、父母、子女等，或者同一实际控制下的某些交易，管理团队之间的交易等；

B.急于出售或急于购买的交易；

C.交易双方或某一方对市场行情缺乏了解的交易；

D.交易双方或某一方有特别动机或偏好的交易；

E.非正常的特殊方式的交易，如哄抬或抛售；

F.交易税费非正常负担，如应由买方缴纳的税费，买卖双方协议由卖方来缴纳或应由卖方缴纳的税费买卖双方协议由买方来缴纳；

G.受债权债务关系影响的交易。

经过核查，评估人员认为，上市公司的交易价格均为均为市场充分活跃交易情况下、公开的正常的市场交易价格。因此不需要进行交易情况修正。

④成长性修正

案例的企业可能处于不同的发展阶段拥有不同的成长潜力。本次评估根据企业 2018 年至 2020 年营业收入的复合增长率修正其成长性。其中标的公司 2020 年营业收入参照收益法预测结果，对比公司 2020 年营业收入根据 CapitalIQ 统计预测结果。

收入复合增长率修正是正向的，即收入复合增长率越高，则向上修正；反之则向下修。

⑤控制权修正

控制权是公司治理理论的核心问题之一。一般而言，控制权是指对企业决策间接或直接的影响力，包括企业的长期战略决定、联盟、并购、解雇及日常管理，资金管理，资本运作等。企业的控制权可以通过投票权、董事会席位、合约条款及清算权等不同方式实现对企业的管理。

案例为上市公司，而上市公司的交易均为市场散户的交易价格，因此可以理解为小股权交易价格。而本次收购对象为控股权，因此需要进行控制权溢价修正。

控股权溢价和少数股权折价，国外通常有两种方法来间接衡量：第一种是基于大宗股权转让的控制权溢价模型，由 Barclay 和 Holderness（1989）推出。他们认为如果公司股东都按照持股比例获取公司利益，那控制权就没有私人利益。但是，如果大股东能够通过控制权获得小股东无法获得的利益，那么大宗股权的交易就存在溢价。他们通过对美国 1978—1982 年间 63 宗超过 5%比例的股权交

易进行研究，发现成交价格高于股权交易宣布后的价格，平均溢价率为 20%。但是，如果大股东预期到要承担净的私人成本，那么大宗股权应该是以折价成交。他们还发现，如果其他条件不变，溢价通常随着大宗股权比例的上升而上升。后来的研究证实了大宗股权通常是以溢价成交的。这些研究同样认为大宗股权溢价反映了预期的控制权私人收益。Mikkelsen 和 Regassa（1991）证明了 1978 年到 1987 年之间 37 项大宗股权交易的平均溢价为 9.2%（中值为 5.5%）。Chang 和 Mayers（1995）报告了平均为 13.6%（中值为 10.1%）的溢价。

另一种方法是通过投票权溢价（votingrightspremium）来度量控制权。因为控制权往往通过投票权来实现的。McConnell 和 Mikkelsen（1983）、Zingales（1995）通过对股票市场上的两种股票交易价格的差别来度量控制权利益。这两种股票具有同等的分红权利，但是唯一区别是投票权。他们特别考察了 1940—78 年间普通股公开发售的 30 家公司的股价，并且这些公司中的两级股票只存在投票权的差异。这些公司的双重股票若是同一天交易的，其月末交易价格常常表明了差异性投票权的价值或掌控公司运作的权力。从这 26—30 家公司所观测到的一组月末交易价格与支付给具有优先投票权等级股票的溢价一致。平均来看，优先投票权等级的股票比次级投票权股票的价格高 5.4%。因此，在这 26—30 家公司的例子中，两种股票的相对价格差别说明了控制权是具有价值的。DeAngelo（1985）和 Zingales（1995）所做的研究同样显示，在美国，尽管平均溢价较低，但优先股都是以溢价进行交易的。Zingales（1995）的研究成果表明，即使该溢价总体上来看是非常小的，若一旦出现竞相争夺控制权的情况，其溢价将会大幅上升。这也再次证实控制权获取的利润不是小股东所能得到的。在其他国家中甚至有更极端的例子，Levy（1982）发现爱尔兰公司的平均投票权溢价为 45.4%，Rydqvist（1987）证实瑞典公司投票控制权的溢价为 6.5%，Hornor（1988）瑞士公司的控制权溢价为 20%，Zingales（1994）发现在米兰股票交易市场中更高达 82%。Nenova（2000）采用 18 个国家的 661 个双重类别公司为样本，发现公司控制权的价值在不同国家差别很大，在墨西哥这一价值为公司市场价值 50%，而在意大利为 10%。Dyck 和 Zingales（2002）通过对 1999-2000 年间 39 个国家的 412 笔控制权交易进行研究，证明了控制权价值的变动范围为公司市场价值的-4%到+65%，平均为 14%。

考虑到本次为 100%的控制权转让，在结合上述研究材料的情况下，本次评估赋予的控股权溢价比例为 10%，即四个案例的分值均为 91。

⑥经营规模修正

不同案例的企业，其经营规模是有差异的。而在衡量市场地位，市场份额方面，营业收入是一个非常重要的指标。在衡量企业规模方面，总资产是一个非常重要的指标。因此经营规模的修正因素，在 EV/EBITDA 价值比率中选择“营业收入”和“总资产”指标，在 EV/S 价值比率中选择“营业收入”指标。

营业收入和总资产的修正是正向的，即营业收入或总资产大，则向上修正，反之则向下修正。

⑦运营能力修正

运营能力是指企业基于外部市场环境的约束，通过内部人力资源和生产资料的配置组合而对财务目标实现所产生作用的大小，通俗来讲，就是企业运用各项资产以赚取利润的能力。

企业营运能力的财务分析比率有：存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率和总资产周转率等。这些比率揭示了企业资金运营周转的情况，反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。企业资产周转越快，流动性越高，资产获取利润的速度就越快。本次评估选择应收账款周转率和总资产周转率修正营运能力。

应收账款周转率和总资产周转率的修正是正向的，即应收账款周转率或总资产周转率越高，则向上修正；反之则向下修。

⑧偿债能力修正

企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力，是企业能否健康生存和发展的关键，反映企业财务状况和经营风险的重要标志。静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。

偿债能力的衡量指标主要有流动比率、速动比率、资产负债率等。本次评估偿债能力指标我们选择反映长期偿债能力的指标资产负债率和短期偿债能力的指标速冻比率。

资产负债率修正的方向是反向的，即资产负债率越高，代表企业经营风险越大，则向下修正；反之则向上修。速动比率的修正方向是正向的，即速动比率越高，则向上修正，反之则向下修。

⑨盈利能力修正

盈利能力通常是判断一家企业价值高低的最关键因素，在采用非收益价值比例指标的时候，需要进行盈利能力修正。

因此，本次评估对 EV/S 价值比率选择成本费用利润率和净资产收益率对盈利能力进行修正。对 EV/EBITDA 价值比率不予修正。

成本费用利润率和净资产收益率的修正是正向的，即成本费用利润率和净资产收益率越高，则向上修正，反之则向下修。

3、市场法评估结论

（1）委估对象评估值测算

①EV/EBITDA 比率指标评估值测算

金额单位：万美元

项目	案例一			案例二			案例三			案例四		
	SLAB			MLNX			SMTC			LSCC		
价值比例 EV/EBITDA	15.55			13.88			14.44			11.22		
交易日期修正	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0
交易情况修正	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0
成长性修正	100.0	/	100.0	100.0	/	105.0	100.0	/	98.0	100.0	/	100.0
控制权修正	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0
经营规模修正	100.0	/	105.0	100.0	/	105.0	100.0	/	103.0	100.0	/	100.0
营运能力修正	100.0	/	102.5	100.0	/	102.0	100.0	/	102.0	100.0	/	101.0
偿债能力修正	100.0	/	99.0	100.0	/	97.5	100.0	/	97.5	100.0	/	97.5
修正后价值比例 EV/EBITDA	16.04			13.91			15.81			12.52		
权重	25%			25%			25%			25%		

项目	案例一	案例二	案例三	案例四
	SLAB	MLNX	SMTc	LSCC
加 权 修 正 后 EV/EBITDA	14.57			
对 应 归 母 EBITDA	6,814.95			
经营性企业价值	99,293.79			
减：付息债务	0.00			
加：非经营性资产、负债	2,802.85			
加：溢余资产、负债	0.00			
加：货币资金	16,895.10			
评估值	118,991.70			

如上表：

经营性企业价值=2018年度委估对象归母 EBITDA×对比公司 EV/EBITDA 比率平均值=6,814.95×14.57=99,293.79 万美元

考虑到所能获取到的上市公司资料的局限性，本次评估在计算对比公司有关价值比率时，未对可比公司相关非经常性损益及非经营性资产（负债）予以调整。而被评估单位采用模拟审计报告披露的相关财务数据，故被评估单位的除其他非流动资产中武汉群茂及 ISSI (Israel)已支付的收购款外，其他相关非经营性因素也不做调整。（下同）

股东全部权益价值=经营性企业价值-付息债务+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值+货币资金价值=99,293.79-0+0+2,802.85+16,895.10=118,991.70 万美元

②EV/S 比率指标评估值测算

金额单位：万美元

项目	案例一			案例二			案例三			案例四		
	SLAB			MLNX			SMTc			LSCC		
价值比例 EV/S	2.72			2.75			2.81			0.99		
交易日期修正	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0
交易情况修正	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0	100.0	/	100.0
成长性修正	100.0	/	100.0	100.0	/	105.0	100.0	/	98.0	100.0	/	100.0

项目	案例一			案例二			案例三			案例四		
	SLAB			MLNX			SMTC			LSCC		
控制权修正	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0	100.0	/	91.0
经营规模修正	100.0	/	104.0	100.0	/	103.0	100.0	/	101.0	100.0	/	98.0
营运能力修正	100.0	/	102.5	100.0	/	102.0	100.0	/	102.0	100.0	/	101.0
偿债能力修正	100.0	/	99.0	100.0	/	97.5	100.0	/	97.5	100.0	/	97.5
盈利能力修正	100.0	/	100.5	100.0	/	102.0	100.0	/	101.5	100.0	/	95.0
修正后价值比例 EV/S	2.82			2.75			3.09			1.19		
权重	25%			25%			25%			25%		
加权修正后 EV/S	2.46											
对应营业收入	41,745.94											
经营性企业价值	102,695.02											
减：付息债务	0.00											
加：非经营性资产、负债	2,802.85											
加：溢余资产、负债	0.00											
加：货币资金	16,895.10											
评估值	122,393.00											

如上表：

经营性企业价值=2018 年度委估对象营业收入×对比公司 EV/S 比率平均值
 $=41,745.94 \times 2.46 = 102,695.02$ 万美元

股东全部权益价值=经营性企业价值-付息债务+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值+货币资金价值
 $=102,695.02 - 0 + 0 + 2,802.85 + 16,895.10 = 122,393.00$ 万美元

（2）企业股东全部权益价值的确定

由于上述指标 EV/EBITDA、EV/S 代表了从不同角度对企业的财务状况、经营成果进行考察。因此，为了完整、全面的考虑企业的具体情况，综合各种价值比率的优点，选择上述指标得出股东全部权益价值的平均值，以此来测算企业股权的评估值。

经市场法评估，北京矽成于评估基准日，在假设条件成立的前提下，股东全部权益价值为美元 120,700.00 万元。按中国人民银行公布的基准日外汇中间价 1:6.8632 计算，折合人民币 828,388.24 万元，详见下表：

市场法评估计算表

金额单位：万美元

项目/指标	EV/EBITDA	EV/S
不同方法评估值	118,991.70	122,393.00
权重	50.00%	50.00%
加权平均后评估值	120,700.00	

（三）评估结论的分析及采用

1、收益法的评估结论

采用收益法，得出北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值评估值如下：评估基准日，被评估单位归属于母公司的股东权益账面值为 580,494.44 万元，评估值 702,791.68 万元，评估增值 122,297.24 万元，增值率 21.07%。

2、市场法的评估结论

采用市场法，得出北京矽成在评估基准日的股东全部权益价值评估值如下：评估基准日，被评估单位归属于母公司的股东权益账面值为 580,494.44 万元，评估值 828,388.24 万元，评估增值 247,893.80 万元，增值率 42.70%。

3、评估结果分析及最终评估结论

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为 702,791.68 万元，采用市场法得出的股东全部权益价值为 828,388.24 万元，市场法评估结论较收益法评估结论高 125,596.56 万元，高 17.87%。两种评估方法差异的原因主要是：收益法是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响；市场法是通过与类似上市公司作为对比公司，分析北京矽成与参考企业的异同并对差异进行量化调整从而得到委估对象的市场价值的方法。这种方法受宏观环境和资本市场交易价格波动影响。

北京矽成业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。北京矽成主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。虽然半导体行业具有一定的周期性，但北京矽成大部分客户集中于汽车电子领域、通信设备领域以及工业制造领域，近年收入一直保持着稳定增长，也保持着较强的盈利能力。

北京矽成所属的半导体行业虽然拥有较多的上市公司，但是各公司间的研究领域或经营模式差异较大。北京矽成的主营产品为存储芯片，采用无晶圆厂的经营模式。然而存储芯片领域的竞争对手大都采用 IDM 模式，账面上固定资产占比相对较高，从财务数据上不具备充分可比性。本次评估选择的可比案例均为以设计为主的芯片公司，但是主营产品、细分技术领域与标的公司有一定的差异。此外，市场法的结论会受到投资环境、投机程度以及投资者信心等因素的影响而造成波动。而收益法则是管理层根据企业实际经营情况对未来做出的合理预期，同时评估人员结合企业历史经营情况进行分析核实，能更好的体现企业的内在价值。

综上所述，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。

通过以上分析，选用收益法评估结果作为本次北京矽成股东全部权益价值评估结论，北京矽成股东全部权益价值为人民币 702,791.68 万元。

（四）其他需说明的情况

1、引用其他机构报告的相关情况

本次评估报告未引用其他机构报告内容。

2、评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

本次评估不存在评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项。

三、上海承裕评估情况

（一）资产基础法评估具体情况

1、资产基础法简介

资产基础法具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业全部财产份额价值的方法。

（1）评估假设

①基本假设

A.交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

B.公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

C.企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

②一般假设

A.本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

B.本次评估没有考虑被评估单位及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响。

C.假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

D.本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日评估对象所在地有效价格为依据。

E.被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

③特别假设

本次评估假设以下期后事项于评估基准日已完成：

A.2018 年 9 月，上海集岑与上海承裕及上海承裕合伙人上海武岳峰、北京青禾、承裕投资签订框架协议，协议明确上海集岑拟向上海承裕提供不超过 12.55 亿元的可转债借款。同月，各方签订了正式的《可转换债权投资协议》，并规定借款用途仅可用于归还上海承裕银行贷款及经上海集岑书面确认的合伙企业的其他债务和费用。《可转换债权投资协议》同时规定，在上海承裕已经根据规定的借款用途向相关方支付完毕的情况下，上海集岑对上海承裕的实际借款额应自动全部转换为上海承裕的有限合伙人财产份额。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海集岑已累计向上海承裕提供 1,245,530,000.00 元借款，上海承裕均已经按照《可转换债权投资协议》中规定的用途使用。2019 年，上海集岑与上海承裕签订了《可转换债权投资协议补充协议》，规定上述 1,245,530,000.00 元借款应于上海集岑书面通知上海承裕之日转换为占上海承裕财产份额 41.9696%的合伙人权益份额，上海承裕于 2019 年 3 月 15 日收到上海集岑的转换书面通知，并于 2019 年 4 月完成相应的工商变更。

B.2016 年 2 月，上海承裕认缴闪胜创芯有限合伙份额 75,400,000.00 元。2016 年 12 月，上海承裕与北京华清闪胜科技有限公司签署财产份额转让协议，取得闪胜创芯有限合伙份额 7,880,460.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，上海承裕认缴闪胜创芯有限合伙份额总计为 83,280,460.00 元，并已全部实缴出资。

2019年5月，上海承裕与闪胜创芯所有合伙人签订了合伙人变更协议，上海承裕退出闪胜创芯，闪胜创芯向上海承裕退还资金人民币8,666.00万元。

2019年5月，上海承裕根据合伙协议约定“上海承裕应按照全体合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）的财产份额比例进行收益分配，并由合伙企业执行事务合伙人在收到收益后的三个月内实施完毕”，对闪胜创芯退还资金8,666.00万元按照合伙人财产份额对上海承裕合伙人进行收益分配。上海承裕于2019年5月完成了收益分配及工商变更登记。

（2）评估思路

各类资产及负债的评估思路如下：

①货币资金

货币资金为银行存款。对银行存款以核实后账面值为评估值。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，通过查阅相关协议、被投资企业章程和有关会计记录等，核实以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成过程、账面值构成和现阶段实际状况，以确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的真实性和完整性。

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的评估参考上海东洲资产评估有限公司出具的《北京矽成评估报告》结论，并结合持股比例确定价值。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产评估值=被投资企业股东全部权益价值×持股比例

通过上述途径确定评估值时，没有考虑对外投资因控股权或少数股权等因素产生的溢价和折价，也未考虑股权流动性对对外投资评估价值的影响。

③其他流动资产

其他流动资产系可抵减增值税。通过相关决议、会计记录等对其他资产核实无误的基础上，以核实后账面值确定评估值。

④负债

上海承裕无负债。

2、资产基础法评估过程

（1）资产的评估

①货币资金

A.银行存款

评估人员核查资产占有方银行存款账户，收集各开户银行各账户的银行对账单、银行余额调节表，验证未达账项的真实性。同时评估人员向银行进行了询证，函证结果与对账单记录相符。

银行存款评估采取同银行对账单余额核对的方法，如有未达账项则编制银行存款余额调节表，平衡相符后，对人民币账户以核实后的账面值确认为评估值。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

企业以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系持有北京矽成40.01%股权。

评估人员通过查阅相关协议、被投资企业章程和有关会计记录等，核实以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产形成过程、账面值构成和现阶段实际状况，以确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的真实性和完整性。

截至2018年12月31日，各股东方投资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	投资比例（%）
1	上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）	207,919,027.02	货币	40.01
2	北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	178,974,053.19	货币	34.44
3	北京华创芯原科技有限公司	57,583,320.36	货币	11.08
4	上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）	23,984,745.70	货币	4.62
5	烟台民和志威投资中心(有限合伙)	20,388,607.46	货币	3.92
6	上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	19,669,490.00	货币	3.78
7	Worldwide Memory Co., Limited	9,243,443.52	货币	1.78

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	投资比例（%）
8	Asia-Pacific Memory Co., Limited	1,076,723.00	货币	0.21
9	厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）	830,079.75	货币	0.16
合计		519,669,490.00	货币	100.00

北京矽成主要业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，于 2015 年末被北京矽成私有化收购。ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 原均为 ISSI 的子公司，在私有化完成后被调整为 ISSI 的兄弟公司。北京矽成的全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片与模拟芯片的研发和销售。其存储芯片产品中，包括了动态随机存储器芯片（DRAM）和静态随机存储器芯片（SRAM），非易失性存储芯片产品有闪存芯片（FLASH）。北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用，北京矽成通过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验。

本次评估引用上海东洲资产评估有限公司出具的《北京矽成评估报告》并结合持股比例确定价值。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产评估值=被投资企业股东全部权益价值×持股比例

根据上述报告评估结论，北京矽成于 2018 年 12 月 31 日股东全部权益价值评估值为人民币 702,791.68 万元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产评估值

=基准日北京矽成的股东全部权益价值×持股比例

=基准日北京矽成的股东全部权益价值×（上海承裕对北京矽成出资额÷北京矽成股东出资额合计）

=7,027,916,800.00×（207,919,027.02÷519,669,490.00）

=2,811,859,559.11 元

通过上述途径确定评估值时，没有考虑对外投资因控股权或少数股权等因素产生的溢价和折价，也未考虑股权流动性对对外投资评估价值的影响。

③其他流动资产

其他流动资产系可抵减增值税。评估人员核对明细账、总账与评估申报表的一致性的基础上，通过相关决议、会计记录等对其他资产核实无误的基础上，以核实后账面值确定评估值。

④资产评估结论

单位：元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	货币资金	318,000.08	318,000.08	0.00	0.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,811,859,559.11	2,811,859,559.11	0.00	0.00
3	其他流动资产	560.00	560.00	0.00	0.00
资产合计		2,812,178,119.19	2,812,178,119.19	0.00	0.00

（2）负债的评估

本次评估范围内无负债。

（3）资产基础法评估结论

经过上述资产基础法评估，上海承裕于评估基准日 2018 年 12 月 31 日市场状况下，全部财产份额价值为人民币 2,812,178,119.19 元。

其中：总资产的账面价值 2,812,178,119.19 元，评估价值 2,812,178,119.19 元。同账面价值相比，无增减值变化。

负债的账面价值 0.00 元，评估值 0.00 元。同账面价值相比，无增减值变化。

合伙权益的账面价值 2,812,178,119.19 元，评估价值 2,812,178,119.19 元。同账面价值相比，无增减值变化。

（二）评估结论的分析及采用

1、评估结论

根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照以上的评估程序对上海承裕在评估基准日的市场价值进行评估。评估结论根据以上评估工作得出，具体情况如下：

采用资产基础法，得出评估基准日，上海承裕全部财产份额账面值 2,812,178,119.19 元，评估值 2,812,178,119.19 元。同账面价值相比，无增减值变化。

上海承裕主要从事创业投资、投资管理、投资咨询活动，其主营业务为对外投资，收入主要来源于被投资项目的价值变化。由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目中的被投资项目在会计上按照公允价值计量，与本次评估结果的市场价值相同，故无增减值变动。

通过上述分析，经评估，上海承裕于评估基准日 2018 年 12 月 31 日在上述各项假设条件成立的前提下，全部财产份额价值评估值为人民币 2,812,178,119.19 元。

2、关于流动性和控股权或少数股权折价或溢价

本次评估结论仅对全部财产份额价值发表意见。鉴于市场资料的局限性，本次评估未考虑由于是否具有控制权等因素产生的溢价或折价。全部财产份额价值并不必然等于全部财产份额价值与财产份额比例的乘积。

本次评估过程中，由于无法获取行业及相关资产产权交易情况资料，缺乏对资产流动性的分析依据，故没有考虑资产的流动性对评估对象价值的影响。

（三）其他需说明的情况

1、引用其他机构报告的相关情况

本次评估引用了《北京矽成评估报告》。

2、评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

本次评估不存在评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项。

四、董事会对资产评估的合理性及定价的公允性分析

（一）董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性、评估定价的公允性发表的意见

北京君正董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：

1、评估机构的独立性

担任本次交易评估机构的东洲评估具有证券期货业务资格，东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员为本次交易出具的相关资产评估报告所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估对北京矽成采用收益法和市场法进行了评估，并采用收益法评估结果作为最终评估结论；对上海承裕采用资产基础法进行了评估并作为最终评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。

4、评估定价的公允性

本次交易以东洲评估出具的资产评估报告载明的评估值为基础并经交易各方协商确定交易价格，标的资产评估定价公允，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。

综上，北京君正董事会认为：本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。

（二）财务预测的合理性分析

本次交易标的资产为北京矽成 59.99%股权及上海承裕 100%财产份额（主要资产为持有北京矽成 40.01%股权），下述主要对北京矽成相关情况进行分析。

1、北京矽成所处行业地位

北京矽成是专注于面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，提供集成电路存储芯片及集成电路模拟芯片的研发和设计，目前主要客户来自于专业领域行业，包括汽车行业、工业以及通讯、消费电子等行业。凭借专用领域领先的研发技术，北京矽成的产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。

凭借丰富的利基型芯片研发实力和国际客户中良好的合作关系，北京矽成在存储芯片半导体设计领域位于市场前列。最近三年，北京矽成的 SRAM 产品收入均全球位居第二位，DRAM 产品收入分别位居全球第八位、第八位及第七位，仅次于三星电子、SK 海力士、美光科技、赛普拉斯等国际一流厂商，位于市场前列。

2、行业发展趋势

根据 Wind 资讯的数据统计显示，全球及中国集成电路市场规模从 2012 年到 2018 年的年化复合增长率分别为 14.60%、20.71%，行业整体蓬勃发展，中国市场行业市场增速高于全球水平。同时，集成电路存储芯片作为逻辑电路、模拟电路、存储芯片、微器件全球四大集成电路产品之一，有着重要的产业地位，而

伴随着未来移动互联网、大数据等新兴产业的进一步发展，集成电路存储器芯片对于现代化信息通讯以及信息安全等领域有着至关重要的作用。根据 Wind 资讯的数据统计显示，全球及中国集成电路设计产业销售规模从 2012 年到 2018 年的年化复合增长率分别为 7.87%、26.27%。未来随着汽车电子的推动以及物联网市场的推动，集成电路及设计行业目前发展行情放缓，后续有望实现复苏并保持繁荣。具体行业发展趋势请参见“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）行业整体发展情况”。

3、行业竞争及经营情况

集成电路设计行业兼具资金密集型和技术密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。集成电路存储芯片的种类繁多，不同技术原理下催生出不同的产品，具有各自的优缺点和适用领域。集成电路设计行业整体集中度较高，行业内企业主要包括赛普拉斯（Cypress）、三星电子（Samsung Electronics）、SK 海力士（SK Hynix）、美光科技（Micron Technology, Inc.）等。根据第三方机构 IHS iSuppli 统计，2018 年全年，北京矽成的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第七位，位于市场前列。具体行业竞争及经营情况请参见“第九章管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（七）行业主要企业及竞争格局”。

4、报告期及未来财务预测相关情况

（1）报告期内的财务情况

报告期内，北京矽成主营业务收入、成本、净利润及情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年	2018 年
营业收入	37,258.27	41,745.94
营业成本	22,294.60	26,223.99
毛利润	14,963.67	15,521.95
综合毛利率	40.16%	37.18%
净利润	2,061.49	5,208.27
净利率	5.53%	12.48%

注：上述数据中未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关资产、负债及相

关损益，亦未包含因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销。

报告期内，北京矽成的营业收入源于主营业务收入，即集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。2017 年、2018 年，北京矽成主营业务收入分别为 251,206.43 万元、287,724.41 万元。伴随着集成电路市场景气度的提升，北京矽成 2018 年主营业务收入稳步增长，较 2017 年增长 14.54%。盈利方面，报告期内，北京矽成合并财务报表归属于母公司股东的净利润分别为 6,015.76 万元、24,488.94 万元，销售净利率分别为 2.39%、8.52%，均呈现增长态势。受员工现金奖励、股份支付及美国税收改革影响，北京矽成 2018 年利润水平较 2017 年增长幅度较大。

（2）未来财务预测情况

根据评估报告，北京矽成的收益预测综合考虑了收入、成本、费用等各项因素，具体情况如下：

单位：万美元

项目/年份	2019	2020	2021	2022	2023
营业收入	43,300.01	48,200.00	53,380.01	58,400.00	62,400.00
营业成本	27,894.21	30,693.11	33,898.57	37,159.38	39,745.62
毛利润	15,405.80	17,506.89	19,481.44	21,240.62	22,654.38
综合毛利率	35.58%	36.32%	36.50%	36.37%	36.31%
净利润	4,739.11	6,609.57	7,896.44	8,988.06	9,766.11
净利率	10.94%	13.71%	14.79%	15.39%	15.65%

注：上述数据中未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关资产、负债及相关损益，亦未包含因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销。

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，北京矽成的产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于汽车级、工业级应用，通过多年在汽车电子领域、通信设备领域、工业制造领域及消费电子领域的业务积累，拥有丰富的行业经验与稳定的客户市场，收入与利润稳定发展，未来预测与实际财务状况较为一致。

综上所述，北京君正董事会认为：北京矽成未来各项财务数据的预测均以历史财务数据为基础，结合北京矽成所处行业地位、所处行业的现状与发展趋势、行业竞争情况、业务发展情况等因素进行综合分析得出的测算结果。北京矽成未来财务预测具有合理性，未来预测与实际财务状况较为一致。

5、北京矽成预测期 DRAM 毛利率持续上升的合理性

根据信永中和出具的北京矽成审计报告及东洲评估出具的北京矽成评估报告，报告期及预测期内北京矽成 DRAM 业务相关收入、成本及毛利率情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-5 月	2019 年（E）
DRAM-营业收入	24,336.20	25,335.01	10,220.26	24,720.00
DRAM-营业成本	16,087.63	18,086.79	7,563.37	17,450.00
DRAM-毛利率	33.89%	28.61%	26.00%	29.41%
项目	2020 年（E）	2021 年（E）	2022 年（E）	2023 年（E）
DRAM-营业收入	26,800.00	30,500.00	34,100.00	36,800.00
DRAM-营业成本	17,990.00	20,350.00	22,799.26	24,648.64
DRAM-毛利率	32.87%	33.28%	33.14%	33.02%

考虑行业因素影响，报告期内 DRAM 毛利率整体下滑的主要原因为：①自 2018 年三季度起，在行业低迷、存储芯片价格下滑的市场背景下，北京矽成部分 DRAM 产品的销售价格受到了一定的影响；②2017 年及 2018 年上半年，全球存储器市场供不应求，晶圆产能紧张，导致该期间生产备货的部分产品晶圆代工成本提高，毛利率有所下降。

预测期内，一方面，随着半导体及汽车电子等领域的市场行情逐渐复苏，DRAM 产品整体价格将逐渐企稳回升。由于北京矽成面向专用领域的产品价格受行业周期的影响相对较小，且目前 DRAM 现货价格已趋于稳定并略微上涨，而北京矽成也会根据综合成本调整供应商区域以应对市场政策风险，预计后续毛利率将稳定提高；另一方面，面对前期供不应求的市场形势，各大存储器制造企业已相应扩大产能，而全球经济因素导致 DRAM 市场规模下滑，因此后续将出现存储器芯片产能大于市场需求的状况，导致存储器晶圆代工的成本下跌。同时，随着市场需求的不断变化，北京矽成也在积极开发满足不同需求及更高附加值的 DRAM 产品，有助于进一步提高 DRAM 毛利率。

综上所述，随着半导体及汽车电子等领域的市场行情复苏、未来晶圆代工成本预期下降以及北京矽成新产品的开发进程，北京矽成预测期内 DRAM 毛利率有所增长，符合行业及北京矽成自身业务的发展趋势。

6、报告期及预测期内北京矽成研发费用占营业收入比例逐年下降的合理性

（1）北京矽成所在行业研发、技术及产品更新情况

北京矽成的主要产品集成电路存储芯片以及模拟芯片在产品质量和性能上有着较高的市场认可度，被广泛使用于汽车及工业级应用。

在技术及产品更新方面，北京矽成的主要产品被广泛使用于汽车及工业级应用。与消费类产品具有产品生命周期短、更新迭代快的特点不同，汽车及工业市场中单一品种（如 1Gb 的 DDR3 芯片）的供货生命周期一般长达 7-10 年。当消费级 DRAM 芯片逐步从 19nm 向 18nm、17nm 工艺演进时，汽车和工业所使用宽温区、高品质 DRAM 芯片还在二十几纳米工艺上演进，每一次更新换代（如从 1Gb、2Gb 的 DDR3 更换至 4Gb、8Gb 的 LPDDR4 芯片）均需要 3 到 5 年才能传导至终端的汽车和工业用户。

北京矽成主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域开发，产品种类较为全面，服务周期较长，如 DRAM 产品涵盖了 16M、32M、64M、128M 到 1G、2G、4G、8G、16G 等多种容量规格，产品具备在极端环境下稳定工作以及节能降耗等特点，更新换代周期能够满足客户的多种类型需求。

（2）报告期内北京矽成研发费用占营业收入比例的情况及合理性

北京矽成研发费用主要由职工薪酬、股份支付费用、外包服务费、原材料及测试费、模具费等构成，报告期内研发费用分别为 31,775.06 万元、35,041.51 万元、14,322.51 万元，占营业收入的比例分别为 12.65%、12.18%、12.29%，尽管略有下滑，但总体保持稳定。具体情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-5 月
研发费用	31,775.06	35,041.51	14,322.51
研发费用占营业收入比例	12.65%	12.18%	12.29%

2017-2018 年，境外同行业可比公司研发费用占营业收入的比例情况如下：

证券代码	公司名称	研发费用占营业收入比例（%）		比例变动（%）
		2017年	2018年	
2344.TW	华邦电子	14.13	15.04	0.91
3006.TW	晶豪科技	8.13	7.17	-0.96
CY.O	赛普拉斯	15.34	14.65	-0.69

证券代码	公司名称	研发费用占营业收入比例（%）		比例变动（%）
		2017年	2018年	
MU.O	美光科技	8.98	7.04	-1.94
	中位数	11.55	10.91	-0.64
	平均数	11.71	10.98	-0.73
	北京矽成	12.65	12.18	-0.47

注：美光科技以距每年8月31日最近的星期四结束的52或53个星期为一财年

上述公司中，美光科技、华邦电子、晶豪科技系 DRAM 领域市场前列公司，赛普拉斯系 SRAM 领域龙头公司，均为北京矽成的同行业竞争对手；晶豪科技与北京矽成同属于无晶圆厂经营模式，美光科技、赛普拉斯及华邦科技属于垂直整合制造经营模式。其中，与 2017 年研发费用占营业收入比例相比，华邦电子 2018 年研发费用占营业收入比例略有上升，晶豪科技、赛普拉斯与美光科技 2018 年研发费用占营业收入比例均有所下降，主要系行业发展导致的营业收入规模增长较快导致。

2017 年与 2018 年，北京矽成研发费用占营业收入的比例高于境外同行业可比公司平均水平，研发费用投入情况较为合理。

（3）预测期内北京矽成研发费用占营业收入比例的情况及合理性

由于北京矽成预测期财务数据未包含股权激励所产生的费用（一次性事项）、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益等，保持相同口径后北京矽成研发费用及研发投入情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
研发费用	4,373.22	3,828.11	3,644.99	4,041.80
占营业收入比例	11.74%	9.17%	9.00%	8.96%
项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
研发费用	4,271.81	4,698.67	4,837.64	4,934.40
占营业收入比例	8.31%	8.32%	8.02%	8.02%

北京矽成预测期内研发费用占营业收入比例有所下降，主要原因包括：

①预测期内北京矽成业务快速发展，营业收入大幅增长

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存

储芯片、模拟芯片的研发和销售，产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于汽车及工业级应用。综合考虑未来半导体行业发展趋势（普华永道研究预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%）、汽车电子行业发展趋势（IHS 预测，全球汽车半导体市场将从 2018 年的 340 亿美元增长到 2022 年的 553 亿美元，年均复合增长率达到 12.93%）以及北京矽成在行业内的前列地位，受益于行业市场规模的增长，北京矽成营业收入仍将保持快速增长。

关于北京矽成所在半导体及车用市场快速发展情况请参见《重组报告书》“第五章 标的资产评估情况”之“四、董事会对资产评估的合理性及定价的公允性分析”之“（二）财务预测的合理性分析”。

根据东洲评估出具的北京矽成评估报告，北京矽成 2019-2023 年营业收入复合增长率为 10.46%，与权威机构预测的行业发展情况相符。

②北京矽成研发费用中固定成本占比较高

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-5 月
外包服务费	11,033.14	15,127.55	5,548.26
职工薪酬	13,235.82	11,987.19	4,937.12
原材料及测试费	751.05	649.63	643.71
股份支付	2,043.94	1,508.29	639.54
授权使用费	659.23	1,081.67	461.31
折旧与摊销	648.82	796.65	446.26
专家咨询费	607.21	1,106.63	437.48
模具费	1,284.95	977.35	322.44
租金	215.64	440.03	199.21
办公费	454.43	334.22	176.11
其他	840.84	1,032.31	511.08
合计	31,775.06	35,041.51	14,322.51

由上表可知，北京矽成的研发费用主要由外包服务费、职工薪酬、折旧与摊销等组成，其中职工薪酬、折旧与摊销开支较为稳定，并不随营业收入的增长而同比大幅增加。

③北京矽成预测期研发费用持续增长

根据东洲评估出具的北京矽成评估报告，北京矽成 2019-2023 年研发费用从 3,899.66 万美元增长至 4,837.64 万美元，复合增长率为 5.54%，符合北京矽成业务增长需要。

综上所述，北京矽成 2017-2018 年研发费用占营业收入的比例高于境外同行业可比公司平均水平，研发费用投入情况较为合理；预测期内研发费用持续增长，研发费用复合增长率低于营业收入复合增长率导致研发费用占营业收入比例有所下降；结合行业及公司的经营模式、研发模式、技术及产品更新情况，北京矽成研发投入能够满足技术更新换代需求，技术优势具备可持续性。

7、北京矽成后续业绩增长可持续性 & 业绩承诺的可实现性

（1）北京矽成后续业绩增长的可持续性

①北京矽成报告期内营业收入、净利润及毛利率情况及下滑原因

根据信永中和出具的北京矽成审计报告及北京矽成管理层提供的数据，北京矽成 2017 年至 2019 年 1-5 月的收入、利润及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	2018 年较 2017 年增长率	2019 年 1-5 月	2019 年 1-5 月占 2018 年比例
营业收入	251,206.43	287,724.41	14.54%	116,520.92	40.50%
其中：DRAM	164,081.94	168,067.42	2.43%	68,994.95	41.05%
SRAM	54,642.67	56,407.63	3.23%	20,866.77	36.99%
FLASH	19,541.48	35,216.17	80.21%	15,675.67	44.51%
ANALOG	12,940.34	28,033.20	116.63%	10,983.52	39.18%
净利润	6,005.03	24,502.14	308.03%	7,405.58	30.22%
综合毛利率	37.04%	35.39%	-	33.21%	-

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，产品中 DRAM、SRAM 排名近年来均处于市场前列；FLASH、ANALOG 经近年来连续开拓，整体增幅较大。2019 年 1-5 月，北京矽成营业收入占 2018 年全年的 40.50%，净利润占 2018 年全年 30.22%，主要原因为行业下行因素影响所致。

报告期内，北京矽成的综合毛利率分别为 37.04%、35.39%、33.21%，其中

占收入比例最大的 DRAM 受采购成本上升影响毛利水平下降较为明显；FLASH 由于更高集成性产品（毛利率相对较低）销售提升导致单位成本上升，毛利率亦有所下滑；SRAM 与 ANALOG 的毛利率保持在较高水平。考虑行业因素影响，综合毛利率整体下滑的主要原因为：①自 2018 年三季度起，在行业低迷、存储芯片价格下滑的市场背景下，北京矽成部分产品的销售价格受到了一定的影响；②受贸易战影响，北京矽成部分晶圆代工、封装业务关税成本有所提高；③2017 年及 2018 年，全球存储器市场供不应求，晶圆产能紧张，导致该期间生产备货的部分产品晶圆代工成本提高，毛利率有所下降。

②北京矽成后续业绩保持增长的原因

北京矽成作为半导体存储芯片市场前列的设计公司，产品涵盖 DRAM、SRAM、FLASH 与 ANALOG 系列，且 DRAM、SRAM 产品市场稳定发展，近年来均位居全球市场前列；FLASH 及 ANALOG 业务领域迅速扩大，2018 年较 2017 年营业收入增长率分别达到 80.21%、116.63%。同时，北京矽成在产品研发方面保持稳定投入，具有较强的技术优势，目前带有 ECC 功能的 SRAM 和 FLASH 均进入量产阶段，带有 ECC 功能的 DRAM 已进入产品送样阶段，后续也将不断推出专用领域存储芯片行业技术水平领先的研发成果。考虑半导体及汽车电子等领域的市场行情复苏的背景下，预计北京矽成整体业务规模后续将稳定提高。

主营业务毛利率方面，一方面，北京矽成专用领域的产品价格受行业周期的影响相对较小，且目前存储芯片现货价格已趋于稳定并略微上涨，而北京矽成也会根据综合成本调整供应商区域以应对市场政策风险，预计后续毛利率将稳定提高；另一方面，面对前期供不应求的市场形势，各大存储器制造企业已相应扩大产能，而全球经济因素导致存储芯片市场规模下滑，因此后续将出现存储器芯片产能大于市场需求的状况，导致存储器晶圆代工的成本下跌，北京矽成毛利率随之进一步增长。

综上所述，随着半导体及汽车电子等领域的市场行情复苏，北京矽成将立足自身的技术与市场优势实现收入及利润水平的稳定提高，后续业绩保持增长。

（2）北京矽成业绩承诺的可实现性

①北京矽成 2019 年 1-5 月业绩承诺实现情况

本次交易中，业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元，且不考虑 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益、股权激励费用、因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销以及配套募集资金投资项目损益。

根据北京矽成提供的数据，在前述业绩承诺口径下，北京矽成 2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月的营业收入、毛利率与净利润与 2019 年全年预算的对比情况如下：

单位：万美元

项目	2017 年	2018 年	2019 年 1-5 月	2019 年 预测数	完成比例
营业收入	37,258.27	41,745.94	16,489.15	40,500.00	40.71%
其中：DRAM	24,336.20	25,335.01	10,220.26	24,720.00	41.34%
SRAM	8,104.46	8,503.06	3,091.01	7,100.00	43.54%
FLASH	2,898.34	5,308.60	2,322.05	6,280.00	36.98%
ANALOG	1,919.28	2,599.27	855.83	2,400.00	35.66%
毛利率	40.16%	37.18%	34.40%	34.52%	-
净利润	2,658.68	5,653.55	1,842.02	4,861.16	37.89%

上述口径下，北京矽成 2018 年营业收入较 2017 年增长 12.04%，其中 DRAM 和 SRAM 分别增长 4.10%和 4.92%，2019 年受行业因素影响，营业收入的预测低于 2018 年。2019 年 1-5 月北京矽成的营业收入为 16,489.15 万美元，完成全年预测的 40.71%，与全年预算进度（全年金额的 5/12）差异较小；2019 年 1-5 月北京矽成的净利润为 1,842.02 万美元，完成全年预测的 37.89%。

②北京矽成 2019 年 1-9 月业绩承诺实现情况

根据北京矽成 2019 年 1-9 月未经审计的财务报表并调整至业绩承诺口径，北京矽成 2019 年 1-9 月实现营业收入约 29,279 万美元，已完成预测收入 40,500 万美元的 72.29%；净利润约 3,534 万美元，已完成承诺业绩 4,900 万美元的 72.12%。同时在业绩承诺口径下，北京矽成 2018 年 1-9 月营业收入占全年比例为 74.36%，净利润占全年比例为 76.64%，综合考虑 2018 年三季度起存储芯片行业下行北京矽成业绩有所下降、2019 年三季度起行业逐渐回暖北京矽成业绩有所回升且未来预计保持繁荣等情况，本次业绩承诺具有可实现性。

③北京矽成业绩承诺实现的原因及影响因素

行业方面，全球半导体销售额自 2018 年三季度起大幅下滑，根据当前市场机构对半导体行业的判断，2019 年半导体行业已进入下行期。全球半导体贸易统计组织 WSTS 于 2019 年 5 月发布预测认为 2019 年全球半导体的市场规模将同比下降 12%，信息技术研究分析公司 Gartner 预测 2019 年全球半导体销售额将同比下降 9.6%，主要原因系中美贸易摩擦等导致经济不确定性加强、半导体下游行业（主要包括智能手机、服务器和 PC 等）等需求下滑所致。与此同时，市场机构普遍认为半导体行业在 2019 年相对疲软后有望在 2020 年实现复苏并保持繁荣。WSTS 认为 2020 年全球半导体的市场规模将同比上升 5.4%，其中存储芯片上涨幅度高于其他品类；普华永道研究预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%。

具体到北京矽成主要专注的汽车电子行业领域，作为近年来行业增速逐年增长的半导体专用领域行业之一，电子电器在汽车产业中的应用逐渐扩大，汽车电子市场整体呈稳步上升趋势。根据市场研究公司 IHS Markit 预测，全球汽车半导体市场将从 2018 年的 340 亿美元增长到 2022 年的 553 亿美元，年均复合增长率达到 12.93%。同时普华永道研究认为，伴随着电动汽车和混合动力汽车的普及率的不断提高，其半导体需求量可为传统汽车的两倍；随着汽车更加自动化，每辆汽车对半导体的需求量增加，先进驾驶辅助系统（ADAS）、光探测和测距（LiDAR）、信息娱乐系统以及安全和便利功能将促进半导体在汽车中的应用；2019 至 2022 年汽车半导体年均增长率预计可达 11.9%。

同行业公司方面，根据 2019 年 8 月 Capital IQ 公布的收入预测数据，境外主要半导体行业上市公司 2019 年至 2021 年收入同比增幅的平均值分别为 -7.90%、12.08%、14.29%。同行业中三星电子、SK 海力士及美光科技等公司 2019 年受到行业周期以及宏观形势的影响，收入预测普遍呈下滑态势；2020 年业务规模预计将逐步回升，并在 2021 年保持较高增长。

2018 年第三季度以来，北京矽成业绩受到了行业下行因素的影响，但自身具备较强的技术研发实力与市场地位。预计后续随着市场复苏，北京矽成 DRAM、SRAM 产品将保持行业前列，收入利润规模稳定增长；FLASH 及 ANALOG 业务规模将继续扩大，保持拓展趋势。北京矽成在技术与产品的研发方面保持稳定

投入，公司不断推出专用领域存储芯片行业技术水平领先的研发成果，产品具有较强的技术优势。在半导体及汽车电子等领域的市场行情复苏的背景下，预计北京矽成整体业务规模后续将稳定提高。

同时，北京矽成也会继续优化管理以进一步提高盈利能力。首先，由于受贸易战影响，北京矽成部分晶圆代工、封装业务关税成本有所提高。北京矽成将根据综合成本调整供应商区域以应对市场政策风险，预计后续毛利率将稳定提高。其次，2017年及2018年三星等大存储器制造企业发生了大量资本性支出来扩大产能，因此后续将出现存储器芯片产能大于市场需求的状况，导致存储器晶圆代工的成本下跌，北京矽成毛利率将随之进一步增长。此外，北京矽成最近完成了新的CRM系统的优化，结合原有ERP系统，将进一步提高公司经营管理、生产管理、和客户管理的效率，实现降低成本和提高经营效率的目标。

结合北京矽成自身的技术与市场优势，综合考虑前述半导体及汽车电子等行业回暖以及北京矽成业绩增长等因素，本次交易的业绩承诺具有可实现性。

（3）北京矽成承诺期净利润较报告期净利润有大幅增长的依据、合理性及可实现性

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于汽车及工业级应用。在不考虑Connectivity、LIN、CAN、MCU及光纤通讯业务相关损益的口径下，北京矽成报告期净利润处于增长态势，预测期2019年净利润下滑，2020年起净利润恢复增长。承诺期利润大幅增长，主要考虑下列因素：

①北京矽成所处行业长期看处于增长趋势

综合考虑半导体行业将复苏并保持繁荣、汽车及工业半导体行业快速发展等情况，北京矽成所处行业长期看处于增长趋势。作为近年来备受关注的半导体专用领域行业，根据普华永道研究，汽车和工业在半导体的应用市场中增长速度较快。其中，预计汽车市场增长最快，年均复合增长率将达到11.9%；工业是仅次于汽车的增长第二快的市场，预计到2022年复合年均增长率将达到10.8%。

②行业技术的更新速度

技术更新周期：北京矽成的主要产品被广泛使用于汽车及工业级应用。在技

术更新方面，与消费类产品具有产品生命周期短、更新迭代快的特点不同，汽车及工业市场中单一品种（如 1Gb 的 DDR3 芯片）的供货生命周期一般长达 7-10 年。当消费级 DRAM 芯片逐步从 19nm 向 18nm、17nm 工艺演进时，汽车和工业所使用宽温区、高品质 DRAM 芯片还在二十几纳米工艺上演进，每一次更新换代（如从 1Gb、2Gb 的 DDR3 更换至 4Gb、8Gb 的 LPDDR4 芯片）均需要 3 到 5 年才能传导至终端的汽车和工业用户。

技术更新方向：目前存储器的需求结构正快速向着多样化转变，人工智能、物联网、大数据、5G 等将成为后续的核心增长动力及技术更新方向。人工智能方面，根据普华永道研究认为，未来人工智能（AI）应用的快速增长带来的芯片需求将极大促进该行业的整体增长，且人工智能的应用大部分需求将来自于汽车和工业市场。由于电动汽车和混合动力汽车普及率的不断提高，再加上自动驾驶汽车的市场潜力巨大，汽车市场将是增长最快的市场，预计到 2022 年汽车市场复合年均增长率将达到 11.9%。与此同时，传统汽车芯片的需求依然强劲。工业市场继续受到安全和医疗领域对人工智能芯片需求的推动，预计到 2022 年工业市场复合年均增长率将达到 10.8%。物联网方面，近年来 IoT 市场规模逐渐扩大，智能家居和智慧城市等物联网相关行业进入了高速发展期。IC Insights 认为，在物联网市场中，车联网市场、工业物联网及智能家庭产品成长最为迅速。车联网之所以会被视为增长最迅速的市场，原因在于汽车正不断提升安全性，包括定位系统、道路状况提示、辅助驾驶功能及车用通讯等功能都与车联网领域相关，同时车内通讯娱乐系统也同样需要使用联网接收讯息，未来车联网市场将迎来更加快速的增长。

③行业竞争格局及主要竞争对手

北京矽成的主要产品为 DRAM、SRAM，该类产品所处市场均具有高垄断性与高集中性。

DRAM 市场方面，北京矽成的市场份额位列全球第七位，但前三大芯片厂商占据了超过 90% 的市场份额，已呈现出相对寡头的竞争局面。根据 IHS 统计结果，2019 年上半年 DRAM 销售额及市场份额情况如下：

单位：百万美元

排名	公司名称	2019 年 1-6 月销售额	占比

1	三星电子	13,072	41.5%
2	SK 海力士	9,132	29.0%
3	美光科技	7,799	24.8%
4	南亚科技	760	2.4%
5	华邦电子	299	0.9%
6	晶豪科技	171	0.5%
7	ISSI	120	0.4%
8	其他	124	0.4%
合计		31,477	100.0%

注：表格中 ISSI 为北京矽成的经营实体。（下同）

SRAM 市场方面，北京矽成的市场份额位列全球第二位，与赛普拉斯共享全球一半以上的市场份额。根据 IHS 统计结果，2019 年上半年 SRAM 销售额及市场份额情况如下：

单位：百万美元

排名	公司名称	2019 年 1-6 月销售额	占比
1	赛普拉斯	59	33.9%
2	ISSI	38	21.8%
3	其他	77	44.3%
合计		174	100.0%

具体到车用易失性存储芯片等专用领域，美光科技近年来均位居行业第一名，市场份额超过 40%，北京矽成位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚科技、三星电子、SK 海力士、赛普拉斯等位居其后。

④北京矽成未来市场开拓规划

应用市场：北京矽成的主要目标市场是汽车和工业市场，公司在该领域已取得较大成果，具备市场前景广阔、技术优势突出、产品丰富优质、服务完善高效等优势，且具备多样的销售渠道与优质的供应链，形成靠前的市场排名和良好的市场口碑。随着人工智能、物联网、5G 的发展，北京矽成认为这些应用在汽车和工业市场的前景广阔，北京矽成会重点开拓上述应用市场。

地域市场：集成电路行业具有明显的区域性特征，全球主要集成电路厂商分布于欧洲、美洲、日韩、台湾地区等。国外的集成电路产业已经形成较为成熟的体系并且稳定运行了多年，技术上存在明显的竞争优势，而国内处于发展初期，

以长三角、珠三角、京津环渤海等部分地区为主并形成了一定的产业集群。

销售区域方面，目前欧洲、美洲及日韩等发达国家仍然是集成电路的主要销售区域，但产业链已开始向以亚洲为代表的新兴市场，特别是中国市场进行转移，其未来将成为重要的主流市场之一。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业 2018 年销售规模达到 6,532 亿元，受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动，以及智能手机等消费电子产品的普及，2016 年至 2018 年行业销售规模增速为 20.10%、24.81%和 21.50%，行业市场增速明显高于全球水平。

在当前大陆半导体市场发展环境下，电动汽车、混合动力汽车以及工业自动化等都是中国大陆的重点发展方向。北京矽成自私有化 ISSI 以来积极推进产业落地，未来也会加大对中国市场的拓展以及加速相关产业落地的进度，分享中国半导体市场的快速发展。

⑤北京矽成未来研发计划

在产品研发方面，在 DRAM 产品上，北京矽成未来的主要方向是提供完整的、车规级温度要求的 LPDDR4 的芯片产品，以及带有 ECC 功能的 DRAM 产品，用以支持汽车上的各种电子产品发展的需要，比如中央处理、信息娱乐系统、域控制器以及 360 度环视系统等，以便进一步响应未来多屏显示与各项 ADAS 功能及相关应用发展的趋势。在 SRAM 产品上，北京矽成将在继续为现有高质量的产品提供长期支持的同时，利用其低功耗芯片设计技术以及和代工厂商的长期合作关系，开发 OctalRAM 芯片用于汽车和工业市场，开发串行 SRAM 产品以满足未来 IoT 和可穿戴产品市场的需求。在 FLASH 产品上，北京矽成将提供更高质量的、完整系列的串行 NOR FLASH 芯片，开发 OctalFLASH 芯片、具有显著成本优势的 SLC NAND FLASH 芯片和低容量的 eMMC 芯片产品。在 ANALOG 产品方面，北京矽成将继续推动创新性较强的产品的研发，包括车用 HBLEED 驱动芯片，用于各种 IoT 产品、家电等的智能 FxLED 驱动解决方案，以及用于各种汽车、工业应用的 DC/DC 芯片产品等。此外，北京矽成将对新型存储器 MRAM 进行布局，长期来看 MRAM 具有应对车用电子系统对存储芯片更高要求的潜力，是新型存储的发展方向之一。

在研发投入方面，北京矽成所专注的领域目前处于稳步发展阶段，北京矽成会参考历史研发投入水平，一如既往的保持其稳定的研发投入，并根据市场变动趋势以及主要竞争对手的经营策略适时调整。

（三）后续经营过程中经营方面的变化趋势分析

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应及互补效应。北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

在可预见的未来发展时期，北京矽成后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面不存在重大不利变化，其变动趋势对标的资产的估值水平没有明显不利影响。同时，董事会未来将会根据行业宏观环境、产业政策、税收政策等方面的变化采取合适的应对措施，保证北京矽成经营与发展的稳定。

（四）评估结果对关键指标的敏感性分析

根据对北京矽成评估所参考的收益法评估模型，永续增长率、美元兑人民币汇率和折现率对北京矽成评估结果影响较大，敏感性分析如下所示：

1、预测期内永续增长率变动的敏感性分析

永续增长率变化值	北京矽成全部股东权益的评估值（万元）	评估值变动率
-0.30%	689,751.60	-1.86%
-0.20%	693,869.52	-1.27%
-0.10%	698,673.76	-0.59%
0.00%	702,791.68	0.00%
0.10%	707,595.92	0.68%
0.20%	712,400.16	1.37%
0.30%	717,204.40	2.05%

2、预测期内美元兑人民币汇率变动的敏感性分析

美元兑人民币汇率变化值	北京矽成全部股东权益的评估值（万元）	评估值变动率
-0.30	672,071.68	-4.37%
-0.20	682,311.68	-2.91%
-0.10	692,551.68	-1.46%
0.00	702,791.68	0.00%
0.10	713,031.68	1.46%
0.20	723,271.68	2.91%
0.30	733,511.68	4.37%

3、预测期内折现率变动的敏感性分析

折现率变化值	北京矽成全部股东权益的评估值（万元）	评估值变动率
-1.50%	846,232.56	20.41%
-1.00%	792,013.28	12.70%
-0.50%	744,657.20	5.96%
0.00%	702,791.68	0.00%
0.50%	665,730.40	-5.27%
1.00%	632,787.04	-9.96%
1.50%	602,588.96	-14.26%

根据上述数据，在其他因素保持不变的情况下：若永续增长变化值从-0.30%至 0.30%，则北京矽成评估值变化率为-1.86%至 2.05%；若美元兑人民币汇率变化值从-0.30 至 0.30，则北京矽成评估值变化率为-4.37%至 4.37%；若折现率变化值从-1.50%至 1.50%，则北京矽成评估值变化率为 20.41%至-14.26%。

（五）北京矽成与上市公司业务的协同性分析

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的协同效应。报告期内，上市公司致力于在中国研制自主创新 CPU 技术和产品，基于自主 CPU 技术发展了面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的两条产品线，并且已形成可持续发展的梯队化产品布局。北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。在质量管控方面，北京矽成已基于产品研发、晶圆采购、封测代工、品质验证及售后服务各环节形成了整套经营模式及管控体系，上市公司在业务性质、内部流程上相类似，在质量管控方面可以进行有效对接，从而保持长期的稳健发展。在技术研发方面，上市公司可借鉴北京矽成多年的研发经验及团队实力，夯实其在芯片设计领域的综合研发能力，有利于更好地立足本土、着眼全球，开拓新兴的市场机会。在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。在客户及市场规模方面，本次交易完成后公司可充分利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源，增加彼此合作机会，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力。

综上所述，本次重组中上市公司和北京矽成之间产生的协同效应将助力上市公司优化质量管控、夯实技术研发、丰富产品格局、拓展客户结构及市场规模，北京矽成将强化上市公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等各方面实力。

（六）评估值及交易定价的公允性分析

1、与可比行业上市公司的对比分析

北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。北京矽成 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 24,488.94 万元。本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，对应的评估基准日市盈率倍数为 29.40 倍。截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成归属于母公司所有者权益为 580,494.44 万元，对应的评估基准日市净率为 1.24 倍。

根据万得行业分类统计及北京矽成主营业务情况，北京矽成属于半导体行业中集成电路设计企业。本报告书从万得数据库国内 A 股市场从事半导体芯片设计行业的上市公司中，选取与北京矽成业务相同或相近的半导体行业上市公司作

为可比公司。2018 年 12 月 31 日同行业可比公司市盈率、市净率情况如下表所示：

序号	证券代码	证券简称	市盈率	市净率
1	002049.SZ	紫光国微	75.79	4.67
2	300458.SZ	全志科技	59.25	3.07
3	300672.SZ	国科微	105.35	4.47
4	603986.SH	兆易创新	59.02	9.28
平均值			74.85	5.37
中位值			67.52	4.57
北京矽成			29.40	1.24

上述半导体行业上市公司截至 2018 年 12 月 31 日平均市盈率为 74.85 倍，中位数为 67.52 倍，而北京矽成对应的市盈率 29.40 倍。上述半导体行业上市公司截至 2018 年 12 月 31 日平均市净率为 5.37 倍，中位数为 4.57 倍，而本次交易对应的市净率 1.24 倍。本次交易的市盈率与市净率均低于同行业上市公司水平，从同行业上市公司角度而言本次交易的定价具备公允性。

2、与可比交易案例的对比分析

本次评估北京矽成股东全部权益价值为人民币 702,791.68 万元，评估增值 122,297.24 万元，增值率 21.07%。

本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，2019 年承诺净利润数为 4,900 万美元（未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益及股权激励费用，亦未包含因北京矽成收购 ISSI 后可辨认资产增值部分的折旧摊销），采用 2018 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 1 美元兑人民币 6.8632 元折算，2019 年全年预测归属于母公司所有者的净利润为 33,629.68 万元，对应市盈率为 21.41 倍。

选取近期集成电路芯片行业 A 股上市公司收购案例作为可比交易案例，其具体估值情况如下：

序号	上市公司	标的资产	交易价格 (亿元)	评估增值率 (%)	承诺期第一年 净利润对应市 盈率(倍)
1	上海贝岭 (600171.SH)	锐能微 100%股权	5.9	347.67	24.71

序号	上市公司	标的资产	交易价格 (亿元)	评估增值率 (%)	承诺期第一年 净利润对应市 盈率(倍)
2	亚光科技 (300123.SZ)	亚光电子 97.38%股权	33.42	425.10	21.43
3	皖通科技 (002331.SZ)	赛英科技 100%股权	4.3	399.41	13.65
4	兆易创新 (603986.SH)	思立微 100%股权	17	1,941.04	17.88
5	同有科技 (300302.SZ)	鸿秦科技 100%股权	5.8	751.42	20.00
6	韦尔股份 (603501.SH)	北京豪威 85.53%股权	130.23	47.63	27.92
		思比科 42.27%股权	2.34	13,178.74	23.70
		视信源 79.93%股权	2.55	646.76	22.14
7	闻泰科技 (600745.SH)	间接收购安世集团 64.67%股权	199.25	118.50	22.99
平均值			-	1,984.03	21.60
中位值			-	425.10	22.14
本次交易			72.00	21.07	21.41

注：上述可比交易选取 2017 年以来同行业可比交易案例；承诺期第一年净利润对应市盈率（倍）=标的资产交易价格/标的公司承诺期第一年净利润/收购比例，其中承诺期第一年净利润指业绩承诺期第一个完整会计年度承诺实现的净利润（由于兆易创新系承诺三年合并利润数、闻泰科技未进行利润承诺，对应案例中净利润数系标的资产 2018 年度实际利润数）。

本次交易中，北京矽成评估增值率为 21.07%，远低于同行业水平水平；北京矽成预测期第一年净利润对应市盈率为 21.41 倍，对比上市公司收购同类型资产案例，低于同行业可比交易案例对应市盈率平均值 21.60 倍、中位值 22.14 倍。整体而言，本次评估及交易定价较为合理、公允。

（七）评估基准日至重组报告书披露日标的公司发生的重要变化及其影响分析

评估基准日至本报告书出具日，北京矽成、上海承裕不存在评估报告未列明的重要变化的事项。

（八）交易作价与评估结果的差异分析

本次交易，北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，较评估值增加 2.45%；上海承裕 100%

财产份额评估值为 281,217.81 万元，交易作价为 288,102.84 万元，较评估值增加 2.45%。本次交易作价与评估结果略有差异，系经交易各方参考评估值协商确定。

（九）本次作价整体估值相比私有化时期增长的合理性

1、ISSI 私有化的背景

（1）全球集成电路行业快速发展，国家产业政策持续加持

全球集成电路行业在过去三十年的时间中，在以美国和欧洲为首的西方发达国家带领下经历了从无到有的进步。随着以日本、韩国、中国台湾为代表的新势力的崛起，晶圆代工厂以及 Fabless 的设计厂商的出现在生产产能、生产工艺以及技术路径等方面为全球集成电路产业带来了前所未有的快速提升。如今在面对全球消费电子，包括计算机、便携式电脑、智能手机、智能手表等应用产品的发展和普及浪潮下，集成电路产业逐渐成为全球经济发展的支柱型产业之一。

我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，经过十年“创芯”发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头、封装测试业为主体、制造业为重点的产业格局。但由于我国集成电路行业起步晚，制约我国集成电路产业做大做强的核心技术缺乏，产品难以满足市场需求等问题依然十分突出。自 2000 年以来，我国政府相关部门相继出台了《集成电路产业“十二五”发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策文件，一方面鼓励国内企业自主创新、掌握核心技术、实现弯道超车；另一方面积极推动国内优秀集成电路企业通过“走出去”等产业整合方式收购境外优质资产，打破技术、人才、客户壁垒，获得全球领先技术，提升我国集成电路行业在世界市场的竞争地位。

（2）ISSI 保持行业领先，中国财团看好未来发展

ISSI 的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片及模拟芯片，产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于汽车及工业级应用。ISSI 存储芯片产品在 DRAM、SRAM 领域保持全球领先地位，根据第三方机构 IHS 统计，2014 年，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第九位，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际一流厂商一同处于行业领先地位。

自 2013 年以来，集成电路已经超过石油成为我国每年第一大宗进口产品，

而存储芯片在集成电路四大产品类型中自给率最低,是我国进口金额最大的集成电路产品。在 ISSI 专注的车规存储芯片领域,由于对品质和长期支持能力的要求较高,鲜有中国半导体企业能够进入。随着半导体在汽车产业中的应用逐渐扩大,市场稳步上升,汽车及工业等领域存储芯片的广阔发展空间将会对 ISSI 的发展提供良好的契机。私有化后 ISSI 有望成为中国汽车电子半导体的重要品牌,为中国整车产业链的自主化作出重要贡献。基于上述考虑,中国财团积极参与 ISSI 私有化进程,并于 2015 年 12 月完成了私有化交割相关事宜。

2、私有化时及目前的财务状况对比

ISSI 于 2015 年 12 月从纳斯达克退市,中国资本正式完成对 ISSI 的私有化收购。由于退市前 ISSI 执行美国会计准则,为了便于比较,私有化时的财务状况引用前次兆易创新拟收购北京矽成时中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京矽成 2015 年备考财务报表。具体情况如下:

单位:万元

项目	2015.12.31	2018.12.31	变动率	2019.5.31	变动率
总资产	554,552.60	655,984.69	18.29%	664,019.98	19.74%
总负债	73,569.43	74,272.84	0.96%	75,274.63	2.32%
净资产	480,983.17	581,711.84	20.94%	588,745.35	22.40%
归母净资产	479,408.09	580,494.44	21.09%	587,503.80	22.55%
项目	2015 年	2018 年	变动率	2019 年 1-5 月	变动率
营业收入	193,575.52	287,724.41	48.64%	116,520.92	-
净利润	6,142.05	24,502.14	298.92%	7,405.58	-
归母净利润	5,905.54	24,488.94	314.68%	7,381.42	-

截至 2018 年末,北京矽成总资产和归母净资产分别较 2015 年末增长 18.29% 和 21.09%;2018 年北京矽成营业收入和归母净利润分别较 2015 年增长 48.64% 和 314.68%。北京矽成目前的财务状况较私有化时有显著提高。

3、私有化时及本次交易的市盈率

北京矽成于 2015 年末完成对 ISSI 的私有化交易,交易对价为 7.83 亿美元,按 2015 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 1 美元兑人民币 6.4936 元折算,交易对价为 50.82 亿元。根据前次兆易创新重组时中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京矽成 2015 年备考财务报表计算,市盈率为 86.05 倍。本次交易对价

为 72.00 亿元，根据本次重组信永中和出具的北京矽成 2018 年财务报表计算，市盈率为 29.40 倍，具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年	2018 年
交易对价	508,183.29	720,000.00
归母净利润	5,905.54	24,488.94
市盈率	86.05	29.40

综上所述，北京矽成本次交易的市盈率远低于私有化时的市盈率。

4、私有化后的运营情况

ISSI 被北京矽成私有化后，基本维持原模式正常运营，在行业排名、产品领域、业绩水平方面均有所提升。

（1）行业排名稳中有升

ISSI 存储芯片产品在 DRAM、SRAM 领域保持全球领先地位，根据第三方机构 IHS 统计，2014 年，标的公司的 SRAM 产品收入在全球 SRAM 市场中位居第二位，仅次于赛普拉斯；DRAM 产品收入在全球 DRAM 市场中位居第九位，与三星、海力士、美光、华邦电子等国际一流厂商一同处于行业领先地位。根据 IHS 统计，2019 年上半年，北京矽成的 DRAM 产品收入在全球市场中升至第七位，SRAM 产品收入保持在全球 SRAM 市场中位居第二位。

（2）新产品份额持续增加

ISSI 的主要产品为 DRAM、SRAM，为了提升公司整体竞争力与综合实力水平，ISSI 同时也在加强 FLASH 和 ANALOG 产品的研发和推广。

2015 年 ISSI 的 FLASH 产品收入占总收入比例为 5.11%，ANALOG 产品收入占总收入比例为 2.90%。在收入规模较 2015 年大幅增长的情况下，2019 年 1-5 月，北京矽成的 FLASH 产品收入占总收入比例提高至 13.45%，ANALOG 收入占总收入比例提高至 9.43%。除存储领域外，北京矽成也在加强 LED、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务领域的拓展。

（3）业绩水平大幅提高

ISSI 被私有化后，中国资本股东基本维持原 ISSI 的核心经营管理团队，在

三年的时间里，截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成收入增长 48.64%，净利润增长 314.68%，较私有化收购时大幅提高。

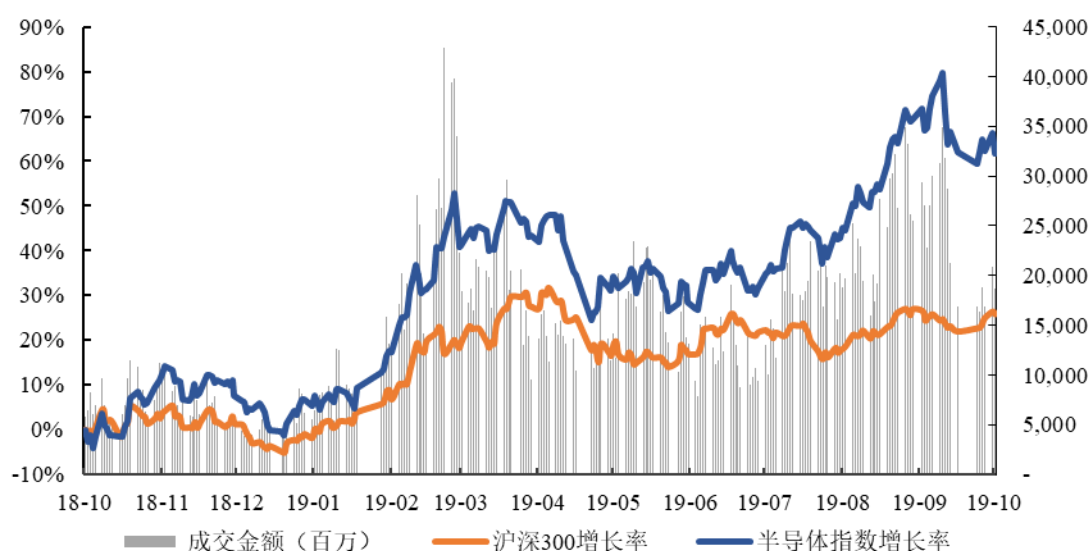
综上所述，北京矽成目前的财务状况较 ISSI 私有化时有大幅提升，本次交易的市盈率远低于 ISSI 私有化时市盈率，ISSI 私有化后运营稳定，业绩持续提升，本次作价整体估值相比私有化时期增长具备合理性。

（十）本次交易调整前后估值差异的原因及合理性

1、交易前后市场环境差异

2018 年以来中美贸易摩擦不断且逐渐升级，我国集成电路产业发展正面临巨大的挑战。在此背景下，国家进一步加大对半导体产业的支持力度，与北京矽成类似的全球知名存储芯片企业在国内随着产业支持以及国产替代将会迎来更多的市场机会，北京矽成管理层对未来在国内的产业落地、市场拓展和发展前景更有信心。

从国内市场看，自 2018 年 10 月至 2019 年 10 月 Wind 半导体行业指数与沪深 300 指数的对比，可以看出半导体行业指数增幅明显高于同期沪深 300 指数增幅。从股票成交金额看，2019 年 2 月起半导体行业成交金额大幅上升。



在国内半导体企业短期基本面没有发生根本变化的情况下，二级市场上投资人对整体行业投资观点的改变，可以说明由于中美贸易摩擦、国家对半导体行业的进一步支持、半导体行业国产替代的推进等，市场对半导体行业的长远预期同

样较以往更加看好。在此背景下，2018年10月，思源电气（002028.SZ）亦披露拟通过下属合伙企业间接入股北京矽成，对应北京矽成整体估值约为72亿元。

2、评估预估值参数差异

（1）数据基础差异

2018年10月下旬，上市公司正式委托评估机构对北京矽成进行预估，预估基准日为2018年6月30日，最近一期的历史财务数据采用的是管理层提供的财务报表，盈利预测采用的是北京矽成半年度董事会上制定的盈利预测指标，没有对北京矽成展开正式尽调以及管理层访谈等工作。

本次评估所采用的历史数据系经审计的北京矽成2017及2018年财务数据。同时，自2018年12月起，评估人员陆续赴美国、中国台湾、北京等北京矽成的主要经营场所，对北京矽成展开深入尽调，了解企业当前的经营状况、所在行业的市场变化、未来几年的经营计划以及经营策略，包括市场需求、研发投入、价格策略、销售计划、成本费用控制、资金筹措和预计新增投资计划等，以及主要的市场竞争者情况和所面临的经营风险。在尽调期间评估人员与其他中介机构对北京矽成主要供应商、客户进行了访谈，了解其与北京矽成的业务合作情况、主要的合作基础条件、未来的合作意向等情况。通过初步的尽调结果并结合宏观经济因素、所在行业现状与发展前景，评估人员与北京矽成管理层深入探讨了前次盈利预测的合理性及可实现性，管理层对前次盈利预测进行了更新。

（2）汇率差异

本次重组预估基准日为2018年6月30日，根据中国人民银行公布的预估基准日下美元兑人民币中间价为1: 6.6166。本次评估基准日为2018年12月31日，根据中国人民银行公布的评估基准日下美元兑人民币中间价为1: 6.8632，两个基准日下汇率累计上涨3.73%。由于北京矽成记账本位币和大部分结算货币为美元，评估模型是在以美元数据为基础的情况下测算，最终将美元评估值换算为人民币评估值，故人民币评估值会随汇率的波动而有同比例的差异。

（3）折现率及永续增长率差异

本次重组预估基准日为2018年6月30日，评估基准日为2018年12月31日，由于估值时点不同，参考的公开市场参数数据有所变化，导致两次折现率有

所差异。同时，在对北京矽成进行充分尽调以及对管理层的访谈以后，并结合尽调期间前述的市场环境差异，本次评估永续期盈利预测较预估数据相应发生了变化，本次评估根据当前的市场环境以及管理层访谈结果将稳定期的增长率调整为2%。

综上所述，本次交易调整前后估值存在差异，主要系市场环境变化以及评估对应的数据基础、汇率、折现率及永续增长率等有所调整所致，具备合理性。

五、独立董事对本次交易评估事项的意见

为本次交易之目的，公司聘请具有证券业评估资格的上海东洲资产评估有限公司以2018年12月31日为基准日，对本次交易涉及的标的资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《重组管理办法》，作为公司的独立董事，现对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性发表如下独立意见：

（一）评估机构的独立性

公司聘请的专项评估机构具有证券期货业务资格，公司的选聘程序合法合规；评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方、标的公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

（二）评估假设前提的合理性

本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次交易项下资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

（四）评估定价的公允性

本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。

作为公司独立董事，我们认为公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果与标的资产定价公允。

第六章 发行股份情况

一、发行股份购买资产并募集配套资金具体情况

（一）发行股份购买资产方案

1、发行价格、定价基准日和定价依据

根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的董事会决议公告日，即 2019 年 5 月 17 日。

公司拟定本次购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 22.49 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商，最终确定本次购买资产的股份发行价格为 22.49 元/股。

根据上市公司 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年 4 月 10 日总股本 201,209,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共分配现金股利 6,036,298.68 元（含税）。2019 年 5 月 27 日，上市公司 2018 年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为 22.46 元/股。

2、发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外，上述发行价格不再调整。

3、发行股份的类型和面值

本次购买资产项下发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

4、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

根据交易价格以及上述公式，公司本次购买资产项下发行股份（即对价股份）数量为 248,650,730 股。在不考虑配套募集资金情况下，上述发行股份占发行完成后上市公司总股本的 55.26%；在考虑配套募集资金情况下（配套募集资金发行数量按北京君正发行前总股本 20%测算），上述发行股份占发行完成后上市公司总股本的 50.72%。各交易对方获得的对价股份数量如下：

交易对方	权益比例	股份对价（万元）	股份数量（股）
购买北京矽成 59.99%股权			
屹唐投资	34.44%	136,010.36	60,556,704
华创芯原	11.08%	51,781.46	23,054,968
上海瑾矽	4.62%	33,230.77	14,795,533
民和志威	3.92%	28,248.33	12,577,174
闪胜创芯	3.78%	27,252.00	12,133,570
WM	1.78%	12,806.75	5,702,027
AM	0.21%	1,491.80	664,200
厦门芯华	0.16%	1,150.07	512,053
小计	59.99%	291,971.54	129,996,229
购买上海承裕 100%财产份额			
武岳峰集电	49.24%	135,982.52	60,544,310
上海集岑	41.97%	120,915.49	53,835,926
万丰投资	3.33%	9,600.00	4,274,265
小计	94.55%	266,498.01	118,654,501
合计	-	558,469.55	248,650,730

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

5、锁定期安排

（1）屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电

作为业绩承诺方，屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电在本次购买资产项下取得的公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量 - 第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

《专项审核报告》应于公司 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经甲乙双方同意并确认延期的，则视为该等业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自公司相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。

（2）上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory、厦门芯华、上海集岑、万丰投资

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的公司新

增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

本次交易完成后，交易对方因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

（二）发行股份募集配套资金

1、募集配套资金的金额及占交易总金额的比例

为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，本次发行股份募集配套资金总额不超过 150,000.00 万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）的 100%。上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。

2、发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行对象和认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括刘强控制的企业四海君芯在内的不超过 5 名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

4、募集配套资金的发行价格及定价原则

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

5、募集配套资金的董事会决议明确的发行价格调整方案

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

6、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量 = 募集配套资金总金额 ÷ 发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

公司本次发行股份募集配套资金项下新发行股份的总数量不超过公司本次交易前总股本的 20%。最终发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

若发行价格根据有关规定发生调整，则公司本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量将进行相应调整。

7、锁定期安排

刘强控制的企业四海君芯认购的本次交易募集配套资金发行的股份自发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次交易募集配套资金发行的股份自本次发行完成之日起 12 个月内不转让。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

二、本次发行股份募集配套资金情况说明

（一）募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 150,000.00 万元，拟用于支付本次交易部分现金对价、支付面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目、面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	拟投入募集配套资金
1	现金对价	115,949.00
2	面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目	16,151.00
3	面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目	17,900.00
合计		150,000.00

募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规及股东大会的授权对上述拟投入募集资金额进行适当调整。

（二）募集配套资金投资项目介绍

1、面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目

（1）项目概况

针对智能汽车对于存储器在容量、读写速率和安全性方面的需求，北京矽成拟在已有技术基础上进行新一代高速存储器芯片技术及整体解决方案的研发，为全球汽车制造商和系统供应商提供更高的存储容量、更快的存储速度、更长的数据存留时间，以支持智能汽车的高质量运行。

本项目计划总投资 17,793.00 万元，拟投入募集资金 16,151.00 万元。其中，拟投资 1,271.00 万元用于设备购置和软件购置等工程费用，拟投资 16,522.00 万元用于工程建设其他费用。

（2）项目实施的可行性分析

伴随着汽车市场规模的增长，以及汽车行业朝着智能化、互联网化和新能源化的发展，包括存储芯片、模拟芯片在内的汽车电子需求将持续提升，同时对于容量、速度、安全性等存储芯片的功能要求也逐步提高。

经过长期技术积累，北京矽成掌握了包括 DRAM、SRAM、FLASH 在内的各类存储器芯片的设计技术并形成了多项自主知识产权专利，在车用存储芯片的研发领域具有全球领先水平。在生产工艺方面，北京矽成具有多年同各类晶圆厂商深度合作的经验，凭借其在车用存储芯片设计中的扎实基础，可在成本、功耗、性能上取得更适合特定应用的有效优化和平衡，在降低成本的同时提高产品的竞争力。在人才建设方面，北京矽成的管理层均为集成电路行业资深的技术专家或市场专家，其中相当一部分曾服务于国内外领先的 IC 设计及制造企业，具有国际化视野与战略眼光，拥有集成电路设计的实践与经验，在业界有着广泛的影响与资源积累。在知识构建方面，北京矽成始终把核心技术的自主创新作为长期发展战略，在芯片设计中将积累的丰富经验规模化、体系化、平台化，建立了良好的知识管理、知识分享体系，便于技术经验在研发过程中的延续。

此外，北京矽成通过对实施该项目的相关数据进行谨慎测算，其内部收益率预期将高于社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。同时，该项目所述领域属于国家鼓励发展的集成电路领域，项目建成达产后，社会效益明显。

本项目的实施，可以充分发挥北京矽成已经掌握的具有自主知识产权的各项存储器芯片设计技术和专利，应对智能汽车对存储器提出的更高速度、更大容量、更可靠安全性的要求，对北京矽成在汽车存储器市场占领先机有重要意义。

（3）项目投资概算

本项目计划总投资 17,793.00 万元，拟投入募集资金 16,151.00 万元。其中，总投资中拟投资 1,271.00 万元用于设备购置和软件购置等工程费用，拟投资 16,522.00 万元用于工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。项目总投资构成见下表：

单位：万元

项目类别	项目名称	投资总额	投入募集资金总额
工程费用	设备购置费	1,134	1,134
	软件购置费	137	137
工程建设其他费用	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3,425	3,425
	流片试制费用	4,550	4,550
	产品开发人员工资福利费	6,905	6,905
预备费	基本预备费	340	-
铺底流动资金	-	1,302	-
投资总额		17,793	16,151

（4）项目实施计划

结合面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目的建设目标，本项目建设期为 5 年。具体进展计划如下：

- ①T+15 月：存储芯片的前后端设计与验证
- ②T+20 月：存储芯片的初次流片与试生产
- ③T+26 月：存储芯片的产品工程验证与芯片修正（第二次流片）
- ④T+29 月：存储芯片的客户导入设计
- ⑤T+35 月：存储芯片的客户要求验证与芯片修正
- ⑥T+38 月：存储芯片进入量产阶段

（5）项目投资的相关收益

根据测算，该项目的税后投资回收期约为 6.78 年，税后内部收益率约为 17.72%。

（6）项目的前置审批/备案情况

2019年8月29日，芯成半导体（上海）在浦东新区发展和改革委员会对本项目进行备案，并取得《上海市外商投资项目备案证明》。

2019年8月29日，本项目的《建设项目环境影响登记表》完成备案。

2、面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目

（1）项目概况

本项目将面向智能汽车和智慧城市领域研发百兆以上带宽的网络芯片，以满足智能汽车、智能电网、智能监控、通讯网络等领域的通讯带宽需求。该项目对于公司在相关芯片市场上占领先机具有重要意义。

本项目计划总投资19,450.00万元，拟投入募集资金17,900.00万元。其中，拟投资1,300.00万元用于设备购置和软件购置等工程费用；拟投资18,150.00万元用于工程建设其他费用。

（2）项目实施的可行性分析

随着汽车行业朝着智能化、互联网化和新能源化的发展，需要处理的信息量逐步提高，因此对网络芯片的需求将持续提高。而智慧城市已成为全球城市发展关注的热点，我国先后发布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，奠定智慧城市的国家战略地位，包括智能电网、固定智能视频监控和智慧公交系统等在内的应用市场将持续增长，因此对于网络芯片的需求也将持续提高。

北京矽成拥有网络芯片产品研发技术，于2002年开始网络芯片设计。目前网络芯片产品已经供应于欧美的电网输配电管理、视频监控、家庭网络、通讯网络等领域。在生产工艺方面，北京矽成具有多年同各类晶圆厂商深度合作的经验，凭借其在车用存储芯片设计中的扎实基础，可在成本、功耗、性能上取得更适合特定应用的有效优化和平衡，在降低成本的同时提高产品的竞争力。在人才建设方面，北京矽成的管理层均为集成电路行业资深的技术专家或市场专家，其中相当一部分曾服务于国内外领先的IC设计及制造企业，具有国际化视野与战略眼光，拥有集成电路设计的实践与经验，在业界有着广泛的影响与资源积累。在知识构建方面，北京矽成始终把核心技术的自主创新作为长期发展战

略，在芯片设计中将积累的丰富经验规模化、体系化、平台化，建立了良好的知识管理、知识分享体系，便于技术经验在研发过程中的延续。

此外，北京矽成通过对实施该项目的相关数据进行谨慎测算，其内部收益率预期将高于社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。同时，该项目所述领域属于国家鼓励发展的集成电路领域，项目建成达产后，社会效益明显。

本项目的实施，北京矽成可以充分发挥已掌握的具有自主知识产权的各项网络芯片设计技术和专利，应对智能汽车和智慧城市对网络芯片提出的更高要求，在网络芯片市场占领先机。

（3）项目投资概算

本项目计划总投资 19,450.00 万元，拟投入募集资金 17,900.00 万元。其中，总投资中拟投资 1,300.00 万元用于设备购置和软件购置等工程费用，拟投资 18,150.00 万元用于工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。项目总投资构成见下表：

单位：万元

项目类别	项目名称	投资总额	投入募集资金总额
工程费用	设备购置费	300	300
	软件购置费	1,000	1,000
工程建设其他费用	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	7,000	7,000
	流片试制费用	3,100	3,100
	产品开发人员工资福利费	6,500	6,500
预备费	基本预备费	350	-
铺底流动资金	-	1,200	-
投资总额		19,450	17,900

（4）项目实施计划

结合面向智慧城市和智能汽车的网络芯片研发项目的建设目标，本项目建设期为 5 年。具体进展计划如下：

①T 项目启动

②T+24 月：网络芯片的多项目晶圆流片

- ③T+27 月：网络芯片的产品工程验证、标定与修正
- ④T+30 月：网络芯片的导入客户设计
- ⑤T+30 月：网络芯片的第二次流片
- ⑥T+33 月：网络芯片在客户端的验证和标定
- ⑦T+44 月：网络芯片的量产流片
- ⑧T+47 月：网络芯片量产样片返回
- ⑨T+54 月：网络芯片的产品工程验证、标定与修正
- ⑩T+60 月：网络芯片进入量产阶段（完成 AEC-Q100 测试）

（5）项目投资的相关收益

根据测算，该项目的税后投资回收期约为 6.9 年，税后内部收益率约为 17.68%。

（6）项目的前置审批/备案情况

截至本报告书出具日，本项目尚未完成立项备案。

2019 年 9 月 19 日，本项目的《建设项目环境影响登记表》完成备案。

2019 年 9 月 25 日，北京矽成在北京经济技术开发区管理委员会对本项目进行备案，并取得《关于北京矽成半导体有限公司面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目备案的通知》及《项目备案表》。

（三）上市公司前次募集资金情况

1、首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]691 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，北京君正由主承销商齐鲁证券有限公司（后更名为“中泰证券股份有限公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 43.80 元。截至 2011 年 5 月 26 日，公司募集资金总额为 87,600.00 万元，

实际收到募集资金 83,490.40 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用 924.30 万元，募集资金净额为 82,566.10 万元。

上述募集资金到位情况经兴华会计师验证，并出具（2011）京会兴验字第 1—009 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

2、上市公司首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 51,259.56 万元，累计募集资金银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 17,711.59 万元，募集资金账户余额（含超募资金）合计为 49,018.13 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				82,566.10	本报告期投入募集资金总额					1,146.29	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额				15,653.14	已累计投入募集资金总额					51,259.56	
累计变更用途的募集资金总额比例				18.96%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019年1-6月投入金额	截至2019年6月末累计投入金额(2)	截至2019年6月末累计投入金额与总投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2019年6月末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019年1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	是	8,165.00	2,138.74	0.00	2,138.74	0.00	100.00	不适用	0.00	否	是
便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	是	8,721.00	324.30	0.00	324.30	0.00	100.00	不适用	0.00	否	是
移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	否	12,387.00	12,387.00	0.00	11,402.82	-984.18	92.05	2013/5/31	0.00	否	否
研发中心建设项目	是	3,388.00	3,142.00	0.00	1,810.31	-1,331.69	57.62	2014/12/31	0.00	是	否

物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目	否	0.00	13,991.00	1,146.29	12,083.39	-1,907.61	86.37	2020/04/24	601.00	不适用	否
承诺投资项目小计		32,661.00	31,983.04	1,146.29	27,759.56	-4,223.48			601.00		
超募资金投向											
投资成立合肥君正科技有限公司	否	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	2014/2/14	532.95	不适用	否
向合肥君正增资以投资建设合肥君正二期研发楼	否	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00	2018/12/20	0.00	不适用	否
超募资金投向小计		23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	-		532.95		
合计		56,161.00	55,483.04	1,146.29	51,259.56	-4,223.48			1,133.95		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。 2、截至 2013 年 5 月 31 日，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结。由于移动互联网终端产品市场的销售受软件生态等因素影响，市场拓展一直严重受阻，致使该项目未能达到预计收益，项目累计亏损 4,605.02 万元。 3、2013 年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。 4、“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处于探索阶段，公司根据市场发展态势不断调整技术										

	研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联网类产品逐渐从概念走向具体产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场推广的重要阶段，同时，针对物联网市场的产品特点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。因此，经公司 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行了延期，将原计划完成时间由 2017 年 4 月 24 日调整为 2019 年 4 月 24 日。2018 年度，国内物联网及智能可穿戴设备市场均处于蓬勃发展的时期，公司在这些领域中积累了深厚的市场基础和技术基础，为及时抓住市场发展机会，不断扩大公司的市场份额，为公司带来更多的经济效益，公司需要根据目前的市场发展趋势和产品需求情况继续推出更高性能和性价比的芯片产品。因此，经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由 2019 年 4 月 24 日调整为 2020 年 4 月 24 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。 2、2013 年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	1、2011 年 5 月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10 万元，募投项目承诺投资额 32,661.00 万元，超募资金金额为 49,905.10 万元。2012 年 4 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，变更投资额后结余的 246.00 万元转入超募资金管理。 2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，经公司 2013 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 14,000.00 万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014 年 2 月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。 3、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 9,500 万元对公司全资子公司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正二期研发楼的建设。2018 年 12 月，公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公司的增资工作。 4、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议审议，公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息（含现金

	管理收益) 45,613.30 万元支付公司重大资产重组部分现金对价, 该事项尚需公司股东大会审议通过方可生效。 5、截至 2019 年 6 月末, 公司超募资金余额为 26,651.10 万元, 其中部分存放于募集资金专户, 部分用于购买银行保本型理财产品。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》, 对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更, 原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内, 变更后的实施地点位于中关村软件园二期(西扩)起步区 J-2 地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 9 月 15 日, 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过, 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2011)京会兴核字第 1-041 号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司以募集资金 1,843.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额, “移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期为 2013 年 5 月 31 日, 募集资金承诺投资总额为 12,387.00 万元。截至 2013 年 5 月 31 日, 该投资项目已经完结, 实际投资总额为 11,402.82 万元, 结余募集资金 984.18 万元。结余的主要原因为, 公司从项目的实际情况出发, 本着节约、合理及有效的原则使用募集资金, 并且公司结合自身的技术优势和经验, 充分利用现有的设备资源, 减少了新设备的购置, 节省了设备购置费用, 致使募集资金出现结余。 2、根据招股说明书及公司董事会决议, “研发中心建设项目”预计完成时间为 2014 年 12 月 31 日, 募集资金承诺投资总额为 3,142.00 万元。截至 2014 年 12 月 31 日, 该投资项目已经完结, 实际投资金额为 1,810.31 万元, 结余募集资金 1,331.69 万元。结余的主要原因为, 公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金, 严格控制各项支出, 并对各项资源进行合理调度和优化配置, 充分考虑资源的共通性, 节省了项目费用, 致使募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月末, 公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户, 部分用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、关于上市公司使用募集资金的合规性

(1) IPO 募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，北京君正 IPO 时募集资金使用情况如下：

单位：万元

(1) IPO 募集资金拟投资项目投资情况					
IPO 时募集资金投资项目	是否变更项目(含部分变更)	IPO 披露投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	是否完结
便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	是	8,165.00	2,138.74	2,138.74	是
便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	是	8,721.00	324.30	324.30	是
移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	否	12,387.00	12,387.00	11,402.82	是
研发中心建设项目	是	3,388.00	3,142.00	1,810.31	是
小计		32,661.00	17,992.04	15,676.17	-
(2) IPO 募集资金用途变更情况					
变更后募集资金投资项目	募集资金用途变更情况		投资金额	累计投入金额	是否完结
物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目	使用“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”剩余结余资金余额 6,026.26 万元、“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”终止后的部分结余资金 6,980.56 万元、“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结后的结余资金 984.18 万元。		13,991.00	12,083.39	否
小计			13,991.00	12,083.39	-
(3) 超募资金使用情况					
超募资金投资项目			投资金额	累计投入金额	是否完结
投资成立合肥君正			14,000.00	14,000.00	是
向合肥君正增资以投资建设合肥君正二期研发楼			9,500.00	9,500.00	是
小计			23,500.00	23,500.00	-
合计			55,483.04	51,259.56	-
(4) 募集资金账户余额					
募集资金净额			82,566.10		

银行存款账户利息收入和 现金管理收益扣除手续费净额	17,711.59
募集资金累计使用金额	51,259.56
募集资金余额	49,018.13

如上表所示：北京君正 IPO 募集资金净额 82,566.10 万元，其中，募投项目投资额 32,661.00 万元，超募资金金额 49,905.10 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，上市公司累计使用 IPO 募集资金 51,259.56 万元，具体情况如下：

1、北京君正 IPO 拟投资的“研发中心建设项目”，因项目实施地点变更，经公司 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，公司将该项目投资额由 3,388.00 万元变更为 3,142.00 万元，减少支出 246.00 万元转入超募资金专户管理。截至 2014 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”实施完毕，项目累计投入金额为 1,810.31 万元，结余 1,331.69 万元。

2、北京君正 IPO 拟投资的“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”，因无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。该项目计划投资总额 8,721.00 万元，截至项目终止时累计投入金额为 324.30 万元，结余 8,396.70 万元，其中 6,980.56 万元转入“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”后，结余 1,416.14 万元。

3、北京君正 IPO 拟投资的“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”，于 2013 年 5 月 31 日实施完毕，项目累计投入金额为 11,402.82，结余 984.18 万元转入“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。

4、北京君正 IPO 拟投资的“便携式教育电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”，因教育电子市场发生较大变化，为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司将该项目变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”，变更后的项目投资额为 13,991.00 万元。

“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”使用“便携式教育电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”截至项目变更时的结余资金 6,026.26 万元、已终止的“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”终止后的部分结余资金 6,980.56 万元以及“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结后的结余资金 984.18 万元。

5、经公司 2013 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 14,000.00 万元在合肥高新技术产业开发区投资设立全资子公司合肥君正；独立董事发表同意的独立意见。2014 年 2 月，合肥君正完成设立的工商登记。

6、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 9,500 万元对合肥君正进行增资，以投资建设合肥君正二期研发楼；公司独立董事发表同意的独立意见。2018 年 12 月，合肥君正完成增资的工商变更登记。

基于上述，北京君正 IPO 后，（1）除现金管理外，北京君正未使用募集资金进行持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，未用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用的情形；（2）北京君正因投资回报、项目实施需求等客观情况变更或终止部分募集资金投资项目，该等变更或终止均已经公司董事会及/或股东大会审议通过，且变更后的募集资金均投资于公司主营业务；（3）北京君正使用超募资金投资设立并增资合肥君正，符合公司发展规划及实际生产经营需求，已经公司董事会和股东大会审议通过，且独立董事已发表同意的独立意见；（4）北京君正在募投项目完成或终止后将部分结余资金用作其他项目，已经公司董事会和股东大会等审议通过。因此，北京君正 IPO 募集资金的具体使用均履行了必要决策程序，符合《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）的相关规定。

（2）北京君正使用募集资金用于本次支付现金对价的合规性

北京君正拟将截至 2019 年 5 月 31 日结余募集资金、超募资金以及部分募集资金利息（含现金管理收益，下同）合计 45,613.30 万元用于支付本次交易部分现金对价。

根据北京君正董事会决议和股东大会决议、独立董事意见以及《中天国富证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的核查意见》等文件资料，北京君正使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付本次交易部分现金对价，已经公司董事会和股东大会审议通过，独立董事已发表同意的独立意见。同时，公司保荐机构中天国富证券有限公司也就上述募集资金使用事项予以核查，认为（1）上述募集资金使用已履行必要的审批程序；（2）上述募集资金使用没有与 IPO 募投项目的实施计划相抵触，不会影响原募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；（3）上述募集资金使用有利于提高募集资金使用效率，推动公司重大资产重组工作顺利完成，符合全体股东利益。

基于上述，公司使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付本次交易部分现金对价，属于投资公司主营业务，不存在使用募集资金进行持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不存在用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用的情形；公司使用募集资金支付本次交易部分现金对价已经公司董事会和股东大会审议通过，并经独立董事发表独立意见、以及保荐机构发表核查意见，履行了必要的决策程序，符合《上市规则》《规范运作指引》的相关规定。

（四）募集配套资金的必要性

1、上市公司、标的资产的资金用途

（1）上市公司的资金用途

截至 2019 年 5 月 31 日，公司合并报表上未经审计的货币资金余额为 8,734.56 万元，交易性金融资产中现金管理产品本金余额为 74,500.00 万元，上述货币资

金及交易性金融资产中现金管理产品本金余额包含首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及相关利息和现金管理收益，以及支付给合肥君正的增资款 9,500.00 万元。

根据公司的募集资金使用计划，截至 2019 年 5 月 31 日，“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”尚需投入募集资金 2,124.17 万元。

因此，扣除“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”尚需投入的资金以及支付给合肥君正的增资款，上市公司实际可用上述货币资金及现金管理产品本金余额共计 7.16 亿元，若 7.16 亿元全部用以支付现金对价，则现金对价部分尚存在 8.95 亿元的资金缺口。

（2）标的公司的资金用途

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成合并财务报表中的货币资金余额为 111,995.17 万元，未来货币资金将主要用于存储芯片、模拟芯片及其衍生产品的研发、设计、委外加工和销售等日常营运，以及购买需租赁给力晶半导体公司（Powerchip Technology Corporation）的设备。

本次交易完成后，上市公司将直接和间接合计拥有北京矽成 100%股权，为了提高本次交易的整合绩效，充分发挥交易完成后带来的协同效应，本次交易拟募集配套资金除用于支付本次交易的标的资产的现金对价外，还将投入北京矽成的项目建设。鉴于此，上市公司的营运资金需求将进一步增加。

根据本次重大资产重组交易方案，上市公司需以现金方式向交易对方支付 16.16 亿元，同时拟投入 3.41 亿元用于面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目、面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目，仅依靠上市公司和北京矽成的货币资金无法满足支付本次交易现金对价、上述拟筹建的研发项目，以及上市公司交易完成后日常运营的全部资金需求，需借助外部融资的有效支撑。

2、债务融资方式不利于公司的持续稳健经营

（1）债务融资方式的限制

若全部通过债务融资的方式进行募集配套资金的筹集，一方面公司的利息支出将增加，降低公司的盈利水平；另一方面，债务融资较股权融资有较多的限制，

银行通常以短期借款形式为企业 提供融资需求，难以满足公司业务规模扩大之后对营运资金长期、稳定的需求。此外，通过债务方式筹集资金支付本次交易的现金对价及投入标的公司项目建设，亦将增加公司的资产负债率。

（2）Fabless 模式一定程度限制了债务筹资

公司采用 Fabless 生产模式，使得公司具有“资产轻、专业强”的特点。该种生产模式下，公司能在资金和规模有限的情况下，充分发挥公司的研发能力，集中资源进行芯片的设计和研发，对公司的快速发展起到了至关重要的作用。然而与此同时，上市公司拥有的可用作抵押物进行债务融资的资产相对较少，一定程度上限制了通过债务融资方式筹集所需资金。

3、本次募集配套资金数额与上市公司及标的资产现有生产经营规模和财务状况相匹配

本次交易中，公司拟募集配套资金不超过 150,000.00 万元，上述金额无法通过上市公司的自有资金进行全额支付。根据信永中和出具的备考审阅报告（第 XYZH/2019BJA90477 号），截至 2019 年 5 月 31 日，公司流动资产总额为 384,613.90 万元，资产总额为 920,630.99 万元，配套募集资金总额上限占交易完成后上市公司截至 2019 年 5 月 31 日流动资产总额的 39.00%，资产总额的 16.29%，占比相对合理。

此外，配套募集资金用以支付本次交易的现金对价及投入标的公司的项目建设，有利于改善重组完成后上市公司的整体财务状况，降低财务风险；有利于更好地提高公司自有资金的使用效率，降低因新增借款支付现金对价带来的债务成本压力，可确保本次交易顺利进行，提高并购重组的整合绩效，通过资本市场实现公司更好更快地发展。

综上所述，本次募集配套资金具有必要性。

（五）募集资金管理和使用的内部控制制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集

资金使用（2014 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》。

《募集资金管理办法》是对募集资金进行管理的最主要和最直接的内部控制制度。该制度对募集资金存放、使用、变更、管理、监督和责任追究等进行了明确的规定。

（六）募集资金失败的补救措施

本次交易中，若募集配套资金数额少于 150,000.00 万元，或最终募集配套资金失败，上市公司将根据实际募集配套资金数额，按照实际需要自行调整募集配套资金的具体使用安排，募集配套资金不足部分通过银行借款、资本市场融资等方式解决。

1、上市公司通过债权融资

截至 2019 年 6 月 30 日，上市公司合并资产负债表无短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券等有息债务，资产负债率仅 4.24%，资产负债率较低，存在较大的债务融资空间。若无法足额募集配套融资，上市公司可通过银行借款、资本市场融资等方式筹措资金。截至本报告书出具日，招商银行北京分行向上市公司出具了贷款意向书，同意为本次重组项目提供不超过 9.6 亿元的贷款额度意向。

2、调整募集配套资金的具体使用安排

本次交易的现金对价为 161,562.30 万元，除以前次 IPO 结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息（含现金管理收益）合计 45,613.30 万元进行支付部分现金对价外，剩余现金对价 115,949 万元拟使用本次募集的配套资金支付。若募集配套资金不足，上市公司将调整募集配套资金的具体使用安排，以优先满足支付本次交易的现金对价。

3、四海君芯将参与认购不低于 50%的配套募集资金

本次配套募集资金中，上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套资金的 50%。刘强就通过四海君芯参与配套募集资金

认购所需的资金已作出了切实、可行的安排。四海君芯的认购将减小本次配套募集资金的募集压力。

4、同行业优质产业并购有利于投资者积极参与配套募集资金

本次重组属于集成电路领域的同行业收购，既顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业的行业背景，又能优化上市公司未来的业务结构、发挥协同效应。通过本次重组，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。因此，基于集成电路行业发展的前景及未来上市公司与北京矽成整合与协同，资本市场及相关机构对本次重组给予较大期望，有利于届时投资者积极参与配套募集资金的询价，将减小配套募集资金不足的风险。

综上所述，若募集配套资金不足，上市公司将通过债权融资方式筹措资金，调整募集配套资金的具体使用安排，以优先满足支付本次交易的现金对价。上市公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的四海君芯的参与将减小整体募集配套资金的募集压力。同时，鉴于本次重组属于集成电路领域的同行业优质产业并购，受到市场的较大关注和期望，有利于届时投资者积极参与询价，降低配套募集资金不足风险。

第七章 本次交易相关合同主要内容

一、发行股份购买资产协议及其补充协议

（一）购买北京矽成 59.99%股权的《发行股份及支付现金购买资产协议》

1、合同主体、签订时间

2019 年 5 月 16 日，上市公司（甲方）与屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华（乙方）及北京矽成（丙方）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2、本次交易整体方案

（1）北京君正及/或其全资子公司合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.990%的股权和上海承裕 100%的财产份额；北京君正同时向包括刘强或其控制的关联方在内的特定投资者定向发行股份募集配套资金。

本协议项下，甲方通过发行股份及支付现金的方式购买乙方合计持有的丙方 59.990%股权，其中甲方以发行股份方式购买丙方 40.581%股权、以支付现金方式购买丙方 19.409%股权。

本次交易完成后，甲方将直接持有北京矽成 59.990%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.010%股权，即甲方直接及间接合计持有北京矽成 100%股权权益。

（2）各方同意，上述各项购买资产事项构成本次交易的整体方案，同步实施，不可分割。本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提；本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

3、标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对北京矽成 100%股权截至基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估报

告所确定的评估值为依据。

截至本协议签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。经初步评估及各方确认，北京矽成 100%股权截至基准日的预估值为 719,727.52 万元。经甲方与乙方协商，参考上述预估值，北京矽成 59.990%股权的交易价格暂定为 431,929.02 万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由甲方和乙方协商确定并另行签订补充协议。

4、交易方式及对价支付

甲方以发行股份及支付现金相结合的方式支付本次购买资产交易对价，参考标的资产预估值，标的资产的交易对价暂定 431,929.02 万元，具体情况如下：

交易对方	出资比例（%）	本次购买资产交易对价	
		股份对价金额（万元）	现金对价金额（万元）
屹唐投资	34.440	136,221.13	111,746.70
华创芯原	11.081	51,781.46	28,000.00
上海瑾矽	4.615	33,230.77	-
民和志威	3.923	28,248.33	-
闪胜创芯	3.785	27,252.00	-
WorldwideMemory	1.779	12,806.75	-
AsiaMemory	0.207	1,491.80	-
厦门芯华	0.160	1,150.07	-
合计	59.990	292,182.31	139,746.70

5、发行股份购买资产

作为本次购买资产的一部分，上市公司以发行股份的方式向乙方购买丙方 40.58%的股权，其主要内容如下：

作为本次购买资产的一部分，甲方以发行股份的方式向乙方购买丙方 40.581%的股权，其主要内容如下：

（1）发行方式

本次发行的方式为向特定对象（即交易对方）非公开发行股份。

（2）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行对象及认购方式

发行股份购买资产项下的发行对象为屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory、AsiaMemory 和厦门芯华。前述各方以其所持丙方相应股权为对价认购甲方新增股份。

（4）定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为甲方审议本次交易的首次董事会决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。

各方拟定本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 22.49 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量，下同。

经甲方与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 22.49 元/股。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外，上述发行价格不再调整。

（5）发行数量

发行股份购买资产项下甲方作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量 = 以股份支付的交易对价 ÷ 发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

根据上述公式，参考标的资产预估值，发行股份购买资产项下向乙方发行股份情况暂定如下：

交易对方	以股份支付的交易对价（万元）	发行股份（股）
屹唐投资	136,221.13	60,569,644
华创芯原	51,781.46	23,024,215
上海瑾矽	33,230.77	14,775,797
民和志威	28,248.33	12,560,397
闪胜创芯	27,252.00	12,117,385
WorldwideMemory	12,806.75	5,694,421
AsiaMemory	1,491.80	663,314
厦门芯华	1,150.07	511,370
合计	292,182.31	129,916,543

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（6）滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

（7）锁定期安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认，交易对方对本次购买资产项下取得甲方新增股份作出如下承诺：

①屹唐投资和华创芯原

作为业绩承诺方，屹唐投资、华创芯原在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月期满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数与承诺净利润数的比例未达到补偿触发比例，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数与承诺净利润数的比例达到补偿触发比例或以上，各业绩承诺方可解锁的

股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例未达到补偿触发比例，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例达到补偿触发比例或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量 - 第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

为本条之目的，《专项审核报告》应于甲方 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经甲乙双方同意并确认延期的，则视为该等业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，可自甲方相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。

②上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory、AsiaMemory 和厦门芯华

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的甲方新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

③本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对乙方本次购买资产项下取得甲方新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交甲方董事会、股东大会审议。

④各方确认，非经甲方书面同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如业绩承诺方非经甲方同意质押、转让处于锁定期内的股份，应按本协议规定承担相应的违约责任。

（8）上市地点

上市公司发行股份购买资产项下的新增股份将在深交所上市交易。

6、现金购买资产

（1）作为本次购买资产的一部分，甲方以支付现金方式向屹唐投资、华创芯原购买丙方 19.409%股权，参考标的资产预估值，支付的现金暂定 139,746.70 万元（以下简称“现金对价”）。

（2）各方同意，本次配套融资项下募集资金到账之日起 30 个工作日内，甲方应向屹唐投资、华创芯原指定的账户一次性支付现金购买资产部分的全部交易对价。

7、本次配套融资方案

各方同意，甲方将以询价方式向包括刘强或其控制的关联方在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 150,000 万元的资金，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 100%，且拟发行的股份数量不超过甲方本次发行前总股本的 20%。

8、本协议生效的先决条件

（1）本协议及本协议所述之交易行为在以下条件均获得满足之日起生效：

①甲方董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；

②乙方均按各自章程/合伙协议等内部管理制度规定，经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜；

③丙方按其内部管理制度规定，经内部有权机构审议批准或同意本次交易相

关事宜；

④中国证监会核准本次交易；

⑤其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。

（2）本协议各方需尽力促使、并尽快完成由其负责满足或完成的上述先决条件。

9、交割及相关事项

（1）各方同意，本协议所述之交易在以下条件均已成就后方可交割：

①于本次交易交割前，没有发生已对或将对丙方以及本次交易产生重大不利影响的事件、或者任何对丙方的经营、财务状况或资产有现时或基于其合理的预测将产生重大不利影响的事件；

②各方均未实质违反各自于本协议项下应在本次交易交割日前履行的义务和责任；

③除丙方本次交易所涉工商行政管理部门等有权部门的备案/变更登记手续外，为完成本次交易所必需的由第三方或境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案均已适当取得且有效。

（2）各方同意，本协议第四条第1款所述交割先决条件全部成就（或被豁免）之日起30个工作日内，乙方及丙方应尽快负责到有关工商行政管理部门办理标的资产过户至甲方的工商变更登记手续，具体工作包括但不限于：促使北京矽成召开董事会，变更公司股东，同时修改公司章程；促使北京矽成办理股东、公司章程及董事、监事、高级管理人员（如涉及）的工商变更登记手续。

办理上述程序或手续期间，涉及需要甲方配合的，甲方应予以及时响应和协助。各方进一步确认，标的资产过户至甲方名下的工商变更登记完成且丙方换领新的营业执照之日，即为本协议项下标的资产的交割日。

（3）各方同意，为履行标的资产的相关交割手续，各方将密切合作并采取一切必要的行动和措施（包括按照本协议规定的原则根据需要签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件），以尽快完成标的资产的交割。

（4）自交割日起，上市公司将直接持有丙方59.990%股权，并依法行使股

东权利、履行股东义务、承担股东责任。

（5）各方同意，交割日起 30 个工作日内（但上市公司依据深交所规则无法办理股份登记事项的期间除外），上市公司应尽快将向乙方发行的股份相应办理至乙方名下。上市公司具体工作包括但不限于：

①聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告（如需）；

②于深交所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次交易项下新增股份的发行及登记等手续；

③向中国证监会及其派出机构履行报告和备案等有关手续。

办理上述手续期间，涉及需要乙方配合的，乙方应予以及时响应和协助。

10、过渡期

（1）转让方保证在过渡期内，其持续拥有丙方股权的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保其持有的丙方股权不存在司法查封、冻结、为任何第三方设定质押或设置任何形式的权利负担的情形。

（2）转让方保证在过渡期内，将积极、合理、谨慎地运营及管理丙方；尽力确保丙方管理团队的稳定和业务的正常经营；尽力确保丙方在正常经营之外不进行非正常的导致丙方股权价值减损的行为，亦不从事任何导致丙方无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为；保证丙方的经营状况将不会发生重大不利变化。

（3）转让方同意，过渡期间内，丙方如作出日常生产经营外可能引发重大不利变化（包括但不限于主营业务变更、股本结构变化、重大资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等涉及金额在 1 亿人民币以上的事项/行为）的决策，乙方及丙方应在作出或参与上述决策前，征得甲方的书面同意。

（4）转让方同意，在标的资产交割前，丙方不进行利润分配；丙方滚存未分配利润自交割后归上市公司所有。

（5）各方同意自交割日起 5 个工作日内，各方将共同聘请具有证券从业资格的会计师事务所对丙方在过渡期内的损益进行审计，该审计的基准日为交割日所在月的最后一日。若丙方在过渡期内净资产增加（包括但不限于因经营实现盈

利导致净资产增加等情形）的，则增加部分由上市公司享有；若丙方在过渡期内净资产减少（限于因正常经营造成亏损导致净资产减少，但经甲乙双方认可的事项/情形除外）的，则在净资产减少数额经审计确定后的 30 个工作日内，由乙方中各方按照本协议签署日持有丙方股权的比例以现金方式向上市公司补足。

11、本次交易涉及的人员安排及债务处理

（1）本次交易涉及丙方股东变动，不涉及丙方聘用人员劳动关系的调整变更。

（2）本次交易不涉及丙方债权债务转移，丙方对其现有的债权债务在本次交易完成后依然以其自身的名义享有或承担。

（3）如因法律法规要求或因丙方签署的任何合同、协议的约定，使其负有向政府机构、债权人、债务人等第三方通知本次购买资产事项的义务，乙方和丙方应及时向第三方履行通知义务，并尽最大努力确保该等第三方遵守与乙方和丙方同等的保密义务。根据丙方签署的任何合同、协议的约定，本次购买资产如需获得债权人或其他第三方同意的，乙方及丙方应确保本次购买资产获得了债权人或其他第三方的同意。

（4）交割日后，甲方将持有丙方 59.990%股权，甲方将根据《中华人民共和国公司法》，在符合上市公司规范治理和信息披露制度的前提下，结合丙方业务管理需要，行使股东权利，并相应制定、修改和完善丙方章程及相关内部制度。

12、盈利补偿

本次交易项下，甲方收购上海承裕 100%财产份额系为间接收购并持有北京矽成相应股权权益。鉴于此，为本次交易业绩承诺及补偿之目的，参考中国证监会的相关规定，甲方与屹唐投资、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及华创芯原另行签署《盈利补偿协议》，就本次交易涉及的北京矽成业绩承诺及补偿相关事宜进行约定。

13、不竞争承诺

为保障上市公司及标的企业的利益，乙方承诺：业绩承诺期内，其不以任何方式直接或间接地控制任何从事与丙方（含其下属企业，下同）的主营业务相同

的业务活动的任何实体，亦不会在丙方以外雇佣丙方的雇员（含在本协议签署日前 12 个月内曾与丙方签订劳动合同的人员）、不会唆使任何丙方的高级管理人员和核心技术人员离开公司。若发生此种行为，则乙方应在因此种行为所获利金额的限额内按照甲方实际损失向甲方支付赔偿。

各方确认并同意，乙方于本次交易生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述条款限制。

本条约定之不竞争承诺，于以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）乙方中一方对北京君正持股比例首次低于 5%，该方不竞争承诺终止；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。

14、甲方的声明、保证与承诺

（1）甲方为根据中国法律法规成立并有效存续的企业法人，具有权利、权力及能力订立及履行本协议及其项下的所有义务和责任。

（2）甲方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）甲方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准；对尚未取得但对本协议的履行必不可少的授权、许可及批准，将采取一切可行的方式予以取得。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）甲方将严格依据本协议的约定，在本协议第三条所述之所有先决条件满足后按本协议有关约定向乙方发行股份和支付现金对价。

（5）本协议一经签署即对甲方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（6）于签署日和交割日，甲方在本协议内的所有陈述均真实、准确和完整。

15、乙方的声明、保证与承诺

（1）乙方为依据中国/香港法律法规设立并有效存续的企业，各方均具有独

立的权利、权力及能力订立本协议并履行本协议项下的所有义务和责任，其根据本协议项下相应条款所承担的义务和责任均是合法、有效且相互独立、非连带的。

（2）乙方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）乙方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准（如适用）。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）乙方向甲方为制订及/或执行本协议的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致对方做出错误判断的情形。

（5）乙方对丙方的出资均已及时、足额缴纳，依法对标的资产拥有合法所有权，并有权将该等股权根据本协议的约定转让给甲方；除华创芯原将其持有的丙方 11.081%股权质押予北京亦庄国际投资发展有限公司外，乙方中其他各方持有的标的资产不存在质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形。

华创芯原承诺，就其所持标的资产质押事项，其将于本次交易交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。乙方确认，标的资产过户将不存在实质性法律障碍，亦不会导致甲方取得标的资产后使用、转让、出售或以其他方式处置标的资产的能力受限并造成重大不良后果。

（6）乙方确认，除已披露的情形外，截至本协议签署日，乙方及其关联方与丙方及其下属企业之间不存在其他关联交易、资金往来。

（7）乙方确认，截至本协议签署日，丙方不存在未向甲方披露的债务（包括已有债务及由于丙方提供保证、抵押、质押或其他形式的担保所产生的或有债务）。

（8）乙方承诺，自本协议签署日起，除本协议约定的各项义务外不会对所持丙方股权主动进行再次出售、质押、托管或设置任何第三方权利（包括优先购买权或购股权等），亦不就所持丙方股权的转让、质押、托管或设置任何第三方权利等事宜与其它任何第三方主动进行交易性接触，签订备忘录、合同书、谅解备忘录、或与本次购买资产相冲突或包含禁止或限制标的资产转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

（9）乙方最近五年未曾受到任何刑事/行政处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。

（10）因交割日前乙方自身原因导致丙方遭受处罚、罚款等实际损失的，乙方应向甲方予以相应补偿。为免异议，乙方中任一方有前述情形的（出现该等情形的乙方称为“过错方”），应由该等过错方独立向甲方承担补偿责任，与乙方其他方无关，乙方其他成员不承担因此导致的后果及责任。

（11）本协议一经签署即对乙方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（12）于签署日和交割日，乙方在本协议内的所有陈述均真实、准确和完整。

16、丙方的声明、保证与承诺

（1）丙方为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有权利、权力及能力订立本协议并履行本协议项下的所有义务和责任。

（2）丙方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）丙方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）丙方保证，为本次交易目的，其已按照诚信标准向甲方真实、完整披

露了标的资产的全部重要情况；丙方向甲方及/或为制订及/或执行本协议的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致其他方做出错误判断的情形。丙方保证除上述已披露信息外，没有任何其他人对其自身及标的资产主张任何权利。如果存在其他权利主张，丙方保证有能力将该等权利主张及时予以消除，以维护甲方的合同利益。

（5）本协议一经签署生效即对丙方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（6）于签署日和交割日，丙方在本协议项下的所有陈述均真实、准确和完整。

17、本协议的生效、变更和终止

（1）本协议经各方法定代表人或执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章后成立，其中第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条第1款及第5至7款、第十七条、第十八条及第十九条自本协议签署之日起生效，其他条款自本协议第三条第1款所述之先决条件全部满足之日起生效。

（2）本协议有效期为本协议签署之日起10个月；除非任何一方于本协议有效期届满至少30日前向其他各方提出书面异议，则本协议有效期届满后自动延长2个月；若本次交易最终于本协议有效期（含自动延长期限）内获得中国证监会的核准，则本协议有效期延长至本次交易完成日。

（3）本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经各方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（4）下列情况发生，本协议终止：

①协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；

②经本协议各方协商一致同意终止本协议；

③受不可抗力影响，一方可依据本协议第十四条第3款规定终止本协议；

④本次交易被相关审批机关否决。

（5）本协议终止后将不再对各方具有法律效力，但本协议的第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条除外。

18、违约责任

（1）本协议签署后，各方均应严格遵照执行，并积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，非因本协议各方的故意或重大过失导致的过错直接致使本协议不能生效的，各方均不需要承担责任。

（2）根据本协议第二条第4款第（7）项，非经甲方同意，业绩承诺方转让相关未解锁股份的，该业绩承诺方需向甲方支付违约金，违约金标准为已转让股份在股份过户日市值的10%。非经甲方同意，业绩承诺方质押相关未解锁股份的，该业绩承诺方应根据甲方要求与通知及时解除质押，并自质押日（以证券登记结算公司办理质押登记手续之日为准）起向甲方支付违约金，违约金标准为已质押股份在质押日市值的0.03%/天，直至该业绩承诺方解除股份质押，但由于甲方的原因导致逾期办理解除股份质押手续的除外。

业绩承诺方不可撤销地确认及同意，业绩承诺方承担上述违约责任后，并不当然免除其对甲方的业绩补偿责任。

（3）各方同意，本次交易交割条件满足后，甲方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向乙方支付现金对价或股份对价的，每逾期一日，应以应付未付金额为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金，但由于非甲方的原因导致逾期付款的除外。

（4）各方同意，本次交易交割条件满足后，乙方中任何一方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限办理完毕标的资产交割，每逾期一日，该违约方应以其所对应的标的资产相应对价为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给甲方，但由于非乙方的原因导致逾期交割的除外。

（5）除本协议另有约定外，本协议签署后，任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，或除不可抗力外，任何一方不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金（包括守约方为避

免损失而支出的合理费用）。

（6）前款赔偿金包括但不限于违约方为本次购买资产而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用、合理差旅费用等，但不得超过违约方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失，其中，违约方为本次购买资产而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用等中介机构费用，原则上合计不超过 8,000 万元。

（7）各方明确，乙方各成员之间相互独立，均独立履行义务并承担责任。就本协议第十六条约定的违约责任，除非另有明确约定，乙方各成员之间无任何连带、担保、保证、代理等法律关系。乙方任一名或数名成员违约，不代表、亦不视为乙方其他成员违约，相关违约方应独立承担违约责任，与未违约的乙方成员无关，未违约的乙方成员就违约行为不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其合法权益不因此受到损害。

（二）购买北京矽成 59.99%股权的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

1、合同主体、签订时间

2019 年 7 月 31 日，上市公司（甲方）与屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华（乙方）及北京矽成（丙方）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

2、本次交易整体方案

（1）北京君正及/或其全资子公司合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.990%的股权和上海承裕 100%的财产份额；北京君正同时向包括刘强或其控制的关联方在内的特定投资者定向发行股份募集配套资金。

本协议项下，甲方通过发行股份及支付现金的方式购买乙方合计持有的丙方 59.990%股权，其中甲方以发行股份方式购买丙方 40.552%股权、以支付现金方式购买丙方 19.438%股权。

本次交易完成后，甲方将直接持有北京矽成 59.990%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.010%股权，即甲方直接及间接合计持有北京矽成 100%股

权权益。

（2）各方同意，上述各项购买资产事项构成本次交易的整体方案，同步实施，不可分割。本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提；本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

3、标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对北京矽成 100%股权截至基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

标的资产的交易价格：根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司 59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号），北京矽成 100%股权截至基准日的评估值为 702,791.68 万元。经甲方与乙方协商，参考上述评估值，北京矽成 59.990%股权的交易价格确定为 4,319,290,192 元。

4、交易方式及对价支付

甲方以发行股份及支付现金相结合的方式支付本次购买资产交易对价，标的资产的交易对价为 4,319,290,192 元，具体情况如下：

交易对方	出资比例(%)	本次购买资产交易对价	
		股份对价金额(元)	现金对价金额(元)
屹唐投资	34.440	1,360,103,574	1,119,574,774
华创芯原	11.081	517,814,600	280,000,000
上海瑾矽	4.615	332,307,692	-
民和志威	3.923	282,483,340	-
闪胜创芯	3.785	272,519,997	-
Worldwide Memory	1.779	128,067,540	-
Asia Memory	0.207	14,917,954	-
厦门芯华	0.160	11,500,721	-
合计	59.990	2,919,715,418	1,399,574,774

5、发行股份购买资产

作为本次购买资产的一部分，甲方以发行股份的方式向乙方购买丙方40.552%的股权。

（1）发行价格

鉴于上市公司2018年年度权益分派方案已获2018年年度股东大会审议通过并于2019年5月27日实施完毕，发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为22.46元/股。

（2）发行数量

发行股份购买资产项下甲方作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=以股份支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

根据上述公式及北京矽成59.990%股权的交易价格，发行股份购买资产项下甲方向乙方发行股份的具体情况如下：

交易对方	以股份支付的交易对价（元）	发行股份（股）
屹唐投资	1,360,103,574	60,556,704
华创芯原	517,814,600	23,054,968
上海瑾矽	332,307,692	14,795,533
民和志威	282,483,340	12,577,174
闪胜创芯	272,519,997	12,133,570
Worldwide Memory	128,067,540	5,702,027
Asia Memory	14,917,954	664,200
厦门芯华	11,500,721	512,053
合计	2,919,715,418	129,996,229

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（3）锁定期安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认，交易对方对本次购买资产项下取得甲方新增股份作出如下承诺：

1) 屹唐投资和华创芯原

作为业绩承诺方，屹唐投资、华创芯原在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月期满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况³，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量 - 第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

为本条之目的，《专项审核报告》应于甲方 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经甲乙双方同意并确认延期的，则视为该等业绩承诺方已满足上述相应阶段的解锁条件，

³ 根据《盈利补偿协议》，业绩承诺方应对北京矽成于业绩承诺期内的盈利情况作出承诺并承担相应补偿义务(如需)。

可自甲方相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。

2) 上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WorldwideMemory、AsiaMemory 和厦门芯华

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的甲方新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对乙方本次购买资产项下取得甲方新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交甲方董事会、股东大会审议。

各方确认，非经甲方书面同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如业绩承诺方非经甲方同意质押、转让处于锁定期内的股份，应按本协议规定承担相应的违约责任。

6、现金购买资产

（1）作为本次购买资产的一部分，甲方以支付现金方式向屹唐投资购买其持有的丙方 15.549%股权、向华创芯原购买其持有的丙方 3.889%股权。根据北京矽成 59.990%股权的交易价格，支付的现金确定为 1,399,574,774 元（以下简称“现金对价”），其中，甲方向屹唐投资支付现金对价 1,119,574,774 元，向华创芯原支付现金对价 280,000,000 元。

（2）各方同意，现金购买资产项下现金对价支付安排如下：

1) 屹唐投资

甲方和屹唐投资确认及同意，于本次配套融资项下募集资金到账之日起 30

个工作日内（含），甲方应向屹唐投资指定的账户一次性支付现金购买资产部分的全部交易对价；但该等现金对价支付期限至迟应不晚于中国证监会核准本次交易之日起 210 日（含）或本次购买资产项下屹唐投资取得的甲方新增股份于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份登记之日起 90 日（含）（以孰晚者为准）。

2) 华创芯原

a) 第一期：于 2019 年 10 月 31 日前（含），甲方应向华创芯原指定的账户支付第一笔现金对价 80,000,000 元；

b) 第二期：于 2020 年 4 月 30 日前（含），甲方应向华创芯原指定的账户支付第二笔现金对价 100,000,000 元；

c) 第三期：于 2020 年 10 月 31 日前（含），甲方应向华创芯原指定的账户支付第三笔现金对价 100,000,000 元。

为免歧义，甲方及华创芯原确认及同意，于本次配套融资项下募集资金到账之日起 30 个工作日内，甲方应向华创芯原指定的账户支付届时尚未支付的全部现金对价。若本次交易因任何原因终止，华创芯原应自终止之日起 10 个工作日内将其截至本次交易终止时已经收到的现金对价，及该等现金对价按照自华创芯原收到相应现金对价之日（含）至华创芯原将现金对价转入甲方指定的账户之日（含）期间的同期银行贷款基准利率计算的利息，转入甲方指定的账户。

各方同意，经甲方与相关方协商一致，本次购买资产项下现金对价支付安排可根据本次配套融资实施进展与本次交易实际情况进行相应调整。

7、不竞争承诺

各方同意，《发行股份及支付现金购买资产协议》第八条调整如下：

为保障上市公司及标的企业利益，乙方承诺：业绩承诺期内，其不以任何方式直接或间接地控制任何从事与丙方（含其下属企业，下同）的主营业务相同的业务活动的任何实体，亦不会在丙方以外雇佣丙方的雇员（含在本协议签署日前 12 个月内曾与丙方签订劳动合同的人员）、不会唆使任何丙方的高级管理人员和核心技术人员离开公司。若发生此种行为，则乙方应在因此种行为所获利金额的

限额内按照甲方实际损失向甲方支付赔偿。

各方确认并同意，乙方于本次交易生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述条款限制。

仅为本条之目的，“控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。

本条约定之不竞争承诺，于以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）乙方中一方对北京君正持股比例首次低于 5%，该方不竞争承诺终止；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。

8、其他事项

（1）本协议自各方法定代表人或执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，经各方各自履行内部决策程序后，除本协议第一条第 5 款第

（2）项自本协议签署之日起生效外，其余条款随《购买资产协议》同时生效；若《购买资产协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。

（2）各方理解并同意，本协议是对《购买资产协议》的调整和补充，与《购买资产协议》具有同等法律效力。本协议对《购买资产协议》项下相关事项重新约定或与《购买资产协议》就同一事项的约定相冲突或矛盾时，以本协议的约定为准；本协议未约定的或与履行本协议有关的其他事项以《购买资产协议》的约定为准，按照《购买资产协议》中的相关条款执行。

（3）除非本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议的有关措辞、用语、简（统）称与《购买资产协议》中的相应、用语、简（统）称的含义相同。

（三）购买上海承裕 100%财产份额的《发行股份及支付现金购买资产协议》

1、合同主体、签订时间

2019 年 5 月 16 日，上市公司及其全资子公司合肥君正（甲方）与承裕投资、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资（乙方）及上海承裕（丙方）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2、本次交易整体方案

（1）北京君正及/或其全资子公司合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.990%的股权和上海承裕 100%的财产份额；北京君正同时向包括刘强或其控制的关联方在内的特定投资者定向发行股份募集配套资金。

本协议项下，甲方通过发行股份及支付现金方式购买乙方合计持有的丙方 100%财产份额，其中，甲方以发行股份方式购买丙方 92.5788%财产份额，以支付现金方式购买丙方 7.4212%财产份额。

本次交易完成后，甲方将直接持有北京矽成 59.990%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.010%股权，即甲方直接及间接合计持有北京矽成 100%股权权益。

（2）各方同意，上述各项购买资产事项构成本次交易的整体方案，同步实施，不可分割。本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提；本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

3、标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

截至本协议签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成。经初步评估及各方确认，标的资产截至 2018 年 12 月 31 日的预估值为 287,961.96 万元。经甲方与乙方协商，参考上述预估值，标的资产的交易价格暂定为 288,070.98 万元。标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由甲方和乙方协商确定并另行签订补充协议。

4、交易方式及对价支付

甲方以发行股份及支付现金相结合的方式支付本次购买资产交易对价，参考标的资产预估值，标的资产的交易对价暂定 288,070.98 万元，具体情况如下：

交易对方	出资比例（%）	本次购买资产交易对价	
		股份对价金额（万元）	现金对价金额（万元）
承裕投资	0.0027	-	7.85
武岳峰集电	49.2429	136,190.45	5,664.00
上海集岑	41.9696	120,902.12	-
北京青禾	5.4523	-	15,706.56
万丰投资	3.3325	9,600.00	-
合计	100.0000	266,692.57	21,378.41

5、发行股份购买资产

（1）发行方式

本次发行的方式为向特定对象（即交易对方）非公开发行股份。

（2）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行对象及认购方式

发行股份购买资产项下的发行对象为武岳峰集电、上海集岑和万丰投资。前述各方以其所持丙方相应财产份额为对价认购甲方新增股份。

（4）定价基准日及发行价格

本次发行的定价基准日为甲方审议本次交易的首次董事会决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。

各方拟定本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 22.49 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量，下同。

经甲方与交易对方协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为 22.49 元/股。

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外，上述发行价格不再调整。

（5）发行数量

发行股份购买资产项下甲方作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=以股份支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

根据上述公式，参考标的资产预估值，发行股份购买资产项下向乙方发行股份情况暂定如下：

交易对方	以股份支付的交易对价（万元）	发行股份（股）
武岳峰集电	136,190.45	60,556,000
上海集岑	120,902.12	53,758,168
万丰投资	9,600.00	4,268,563
合计	266,692.57	118,582,731

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（6）滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照其持股比例共同享有。

（7）锁定期安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认，交易对方对本次购买资产项下取得甲方新增股份作出如下承诺：

①武岳峰集电

作为业绩承诺方，武岳峰集电在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，

武岳峰集电根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数与承诺净利润数的比例未达到补偿触发比例，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数与承诺净利润数的比例达到补偿触发比例或以上，武岳峰集电可解锁的股份数按如下公式计算：

武岳峰集电可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×武岳峰集电获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例未达到补偿触发比例，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例达到补偿触发比例或以上，武岳峰集电可解锁的股份数按如下公式计算：

武岳峰集电可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×武岳峰集电获得的对价股份数量 - 第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，武岳峰集电于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

为本条之目的，《专项审核报告》应于甲方 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经甲乙双方同意并确认延期的，则视为武岳峰集电已满足上述相应阶段的解锁条件，可自甲方相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。

②上海集岑和万丰投资

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如

对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的甲方新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

③本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对前述各方本次购买资产项下取得甲方新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交甲方董事会、股东大会审议。

④各方确认，非经甲方书面同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如业绩承诺方非经甲方同意质押、转让处于锁定期内的股份，应按本协议规定承担相应的违约责任。

（8）上市地点

上市公司发行股份购买资产项下的新增股份将在深交所上市交易。

6、现金购买资产

（1）作为本次购买资产的一部分，甲方中合肥君正以支付现金方式向承裕投资购买其持有的丙方 0.0027%财产份额，甲方中北京君正以支付现金方式向武岳峰集电购买其持有的丙方 1.9662%财产份额、向北京青禾购买其持有的丙方 5.4523%财产份额，参考标的资产预估值，支付的现金暂定 21,378.41 万元（以下简称“现金对价”）。

（2）各方同意，本次配套融资项下募集资金到账之日起 30 个工作日内，甲方应向承裕投资、武岳峰集电、北京青禾指定的账户一次性支付现金购买资产部分的全部交易对价。

7、本次配套融资方案

各方同意，甲方将以询价方式向包括刘强或其控制的关联方在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 150,000 万元的资金，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 100%，且拟发行的股份数量不超过甲方本次发行前总股本的 20%。

8、本协议生效的先决条件

（1）本协议及本协议所述之交易行为在以下条件均获得满足之日起生效：

①甲方董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；

②乙方均按各自章程/合伙协议等内部管理制度规定，经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜；

③丙方按其内部管理制度规定，经内部有权机构审议批准或同意本次交易相关事宜；

④中国证监会核准本次交易；

⑤其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。

（2）本协议各方需尽力促使、并尽快完成由其负责满足或完成的上述先决条件。

9、交割及相关事项

（1）各方同意，本协议所述之交易在以下条件均已成就后方可交割：

①于本次交易交割前，没有发生已对或将对丙方及其下属企业以及本次交易产生重大不利影响的事件、或者任何对丙方及其下属企业的经营、财务状况或资产有现时或基于其合理的预测将产生重大不利影响的事件；

②各方均未实质违反各自于本协议项下应在本次交易交割日前履行的义务和责任；

③除丙方本次交易所涉工商行政管理部门等有权部门的备案/变更登记手续外，为完成本次交易所必需的由第三方或境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案均已适当取得且有效。

（2）各方同意，本协议第四条第1款所述交割条件全部成就（或被豁免）之日起30个工作日内，乙方及丙方应尽快负责到有关工商行政管理部门办理标的资产过户至甲方的工商变更登记手续，具体工作包括但不限于：促使丙方全体合伙人修改合伙协议，变更丙方合伙人；促使丙方办理合伙人变更等的工商登记、备案手续。

办理上述程序或手续期间，涉及需要甲方配合的，甲方应予以及时回应和协助。各方进一步确认，标的资产过户至甲方名下的工商变更登记完成且丙方换领新的营业执照之日，即为本协议项下标的资产的交割日。

（3）各方同意，为履行标的资产的相关交割手续，各方将密切合作并采取一切必要的行动和措施（包括按照本协议规定的原则根据需要签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件），以尽快完成标的资产的交割。

（4）自交割日起，甲方将持有丙方 100%财产份额，并依法行使合伙人权利、履行合伙人义务、承担合伙人责任。

（5）各方同意，交割日起 30 个工作日内（但甲方依据深交所规则无法办理股份登记事项的期间除外），甲方应尽快办理向乙方发行股份的相关事宜。甲方具体工作包括但不限于：

①聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告（如需）；

②于深交所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次交易项下新增股份的发行及登记等手续；

③向中国证监会及其派出机构履行报告和备案等有关手续。

办理上述手续期间，涉及需要乙方配合的，乙方应予以及时响应和协助。

10、过渡期

（1）转让方保证在过渡期内，其拥有的丙方财产份额的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保其持有的丙方财产份额不存在司法查封、冻结、为任何第三方设定质押或其他形式权利负担的情形。

（2）转让方保证在过渡期内，促使丙方积极、合理、谨慎行使其作为北京矽成股东的权利，履行股东义务，参与北京矽成（含其境内外子公司，下同）的运营及管理，尽力确保北京矽成管理团队的稳定和业务的正常经营；尽力确保北京矽成在正常经营之外不进行非正常的导致其价值发生重大减损的行为，亦不从事任何在重大方面导致北京矽成无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为；尽力确保北京矽成的经营状况将不会发生重大不利变化。

（3）转让方同意，过渡期间内，北京矽成作出日常生产经营外可能引发重

大不利变化（包括但不限于主营业务变更、股本结构变化、重大资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等涉及金额在 1 亿人民币以上的事项/行为）的决策时，如丙方向北京矽成委派的董事参与上述决策，则丙方应在其向北京矽成委派的董事作出或参与上述决策前，就决策内容征得甲方的书面同意。

（4）转让方同意，在标的资产交割前，除（1）丙方将其截至 2018 年 12 月 31 日的账面货币资金进行分配、（2）丙方将其因从闪胜创芯退伙而获得的货币资金进行分配外，丙方不进行其他利润分配；丙方向北京矽成委派的董事亦不会作出同意北京矽成进行利润分配的决策；丙方的滚存未分配利润自交割后归上市公司所有。

（5）本次交易完成后，甲方将透过丙方持有北京矽成 40.010%股权。各方同意自交割日起 5 个工作日内，各方将共同聘请具有证券从业资格的会计师事务所对北京矽成在过渡期内的损益进行审计，该审计的基准日为交割日所在月的最后一日。若北京矽成在过渡期内净资产增加（包括但不限于因经营实现盈利导致净资产增加等情形）的，则增加部分由上市公司享有；若北京矽成在过渡期内净资产减少（限于因正常经营造成亏损导致净资产减少，但经甲乙双方认可的事项/情形除外）的，则在净资产减少数额经审计确定后的 30 个工作日内，由乙方中各方按照本协议签署日持有北京矽成实际权益的比例以现金方式向上市公司补足。

11、本次交易涉及的人员安排及债务处理

（1）本次交易涉及丙方合伙人变动，不涉及丙方聘用人员劳动关系的调整变更。

（2）本次交易不涉及丙方债权债务转移，丙方对其现有的债权债务在本次交易完成后依然以其自身的名义享有或承担。

（3）如因法律法规要求或因丙方签署的任何合同、协议的约定，使其负有向政府机构、债权人、债务人等第三方通知本次购买资产事项的义务，乙方和丙方应及时向第三方履行通知义务，并尽最大努力确保该等第三方遵守与乙方和丙方同等的保密义务。根据丙方签署的任何合同、协议的约定，本次购买资产如需获得债权人或其他第三方同意的，乙方及丙方应确保本次购买资产获得了债权人

或其他第三方的同意。

（4）交割日后，甲方将持有丙方 100%财产份额，甲方将根据《中华人民共和国合伙企业法》，在符合上市公司规范治理和信息披露制度的前提下，结合丙方和北京矽成业务管理需要，行使合伙人权利，并相应制定、修改和完善丙方合伙协议及相关内部制度。

12、盈利补偿

本次交易项下，甲方收购上海承裕 100%财产份额系为间接收购并持有北京矽成相应股权权益。鉴于此，为本次交易业绩承诺及补偿之目的，参考中国证监会的相关规定，甲方与北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、武岳峰集电及北京华创芯原科技有限公司另行签署《盈利补偿协议》，就本次交易涉及的北京矽成业绩承诺及补偿相关事宜进行约定。

13、不竞争承诺

为保障上市公司及标的企业利益，乙方承诺：业绩承诺期内，其不以任何方式直接或间接地控制任何从事与北京矽成（含其下属企业，下同）的主营业务相同的业务活动的任何实体，亦不会在北京矽成以外雇佣北京矽成的雇员（含在本协议签署日前 12 个月内曾与北京矽成签订劳动合同的人员）、不会唆使任何北京矽成的高级管理人员和核心技术人员离开公司。若发生此种行为，则乙方应在因此种行为所获利金额的限额内按照甲方实际损失向甲方支付赔偿。

各方确认并同意，乙方于本次交易生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述条款限制。

本条约定之不竞争承诺，于以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）乙方中一方对北京君正持股比例首次低于 5%，该方不竞争承诺终止；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。

14、甲方的声明、保证与承诺

（1）甲方均为根据中国法律法规成立并有效存续的企业法人，具有权利、权力及能力订立及履行本协议及其项下的所有义务和责任。

（2）甲方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规

定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）甲方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准；对尚未取得但对本协议的履行必不可少的授权、许可及批准，将采取一切可行的方式予以取得。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）甲方将严格依据本协议的约定，在本协议第三条所述之所有先决条件满足后按本协议有关约定向乙方发行股份和支付现金对价。

（5）本协议一经签署即对甲方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（6）于签署日和交割日，甲方在本协议内的所有陈述均真实、准确和完整。

15、乙方的声明、保证与承诺

（1）乙方为依据中国法律法规设立并有效存续的企业，各方均具有独立的权利、权力及能力订立本协议并履行本协议项下的所有义务和责任，其根据本协议项下相应条款所承担的义务和责任均是合法、有效且相互独立、非连带的。

（2）乙方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）乙方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准(如适用)。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）乙方向甲方为制订及/或执行本协议的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准

确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致对方做出错误判断的情形。

（5）乙方对丙方的出资均已及时、足额缴纳，依法拥有标的资产所有权，并有权将标的资产根据本协议的约定转让给甲方；乙方持有的标的资产不存在质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形。

乙方确认，标的资产过户将不存在实质性法律障碍，亦不会导致甲方取得标的资产后使用、转让、出售或以其他方式处置标的资产的能力受限并造成重大不良后果。

（6）乙方确认，除已经披露的情形外，截至本协议签署日，乙方及其关联方与丙方及其下属企业之间不存在未向甲方披露的关联交易、资金往来。

（7）乙方确认，截至本协议签署日，丙方及其下属企业不存在未向甲方披露的债务(包括已有债务及由于丙方及其下属企业提供保证、抵押、质押或其他形式的担保所产生的或有债务)。

（8）乙方承诺，自本协议签署日起，除本协议约定的各项义务外不会对所持丙方财产份额主动进行再次出售、质押、托管或设置任何第三方权利(包括优先购买权或购股权等)，亦不就所持丙方财产份额的转让、质押、托管或设置任何第三方权利等事宜与其他任何第三方主动进行交易性接触，签订备忘录、合同书、谅解备忘录、或与本次购买资产相冲突或包含禁止或限制标的资产转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

（9）乙方最近五年未曾受到任何刑事/行政处罚(与证券市场明显无关的除外)，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可合理预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。

（10）因交割日前乙方自身原因导致丙方及其下属企业遭受处罚、罚款等实际损失的，乙方应向甲方予以相应补偿。为免歧义，乙方中任一方有前述情形的(出现该等情形的乙方称为“过错方”)，应由该等过错方独立向甲方承担补偿责任，与乙方其他方无关，乙方其他方不承担因此导致的后果及责任。

（11）本协议一经签署即对乙方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（12）于签署日和交割日，乙方在本协议内的所有陈述均真实、准确和完整。

16、丙方的声明、保证与承诺

（1）丙方为依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，具有权利、权力及能力订立本协议并履行本协议项下的所有义务和责任。

（2）丙方签署及履行本协议不会抵触或导致违反现行有效之法律法规的规定、其作为一方或对其有约束力的任何章程性文件、已经签署的协议及获得的许可，也不会导致其违反或需要获得法院、政府主管部门、监管机构发出的判决、裁定、命令或同意。

（3）丙方已根据中国现行法律法规的规定取得了签署及履行本协议而必要的授权、许可及批准。为确保本协议的执行，所有为签署及履行本协议而获得的授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。

（4）丙方保证，为本次交易目的，其已按照诚信标准向甲方真实、完整披露了标的资产的全部重要情况；丙方向甲方及/或为制订及/或执行本协议的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致其他方做出错误判断的情形。丙方保证除上述已披露信息外，没有任何其他人对其自身及标的资产主张任何权利。如果存在其他权利主张，丙方保证有能力将该等权利主张及时予以消除，以维护甲方的合同利益。

（5）本协议一经签署生效即对丙方构成有效、具有约束力及可予执行的文件。

（6）于签署日和交割日，丙方在本协议项下的所有陈述均真实、准确和完整。

17、本协议的生效、变更和终止

（1）本协议经各方法定代表人或执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章后成立，其中第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条第1款及第5至7款、第十七条、第十八条及第十九条

自本协议签署日起生效，其他条款自本协议第三条第 1 款所述之先决条件全部满足或被有权机构豁免之日起生效。

（2）本协议有效期为本协议签署之日起 10 个月；除非任何一方于本协议有效期届满至少 30 日前向其他各方提出书面异议，则本协议有效期届满后自动延长 2 个月；若本次交易最终于本协议有效期（含自动延长期限）内获得中国证监会的核准，则本协议有效期延长至本次交易完成日。

（3）本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经各方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（4）下列情况发生，本协议终止：

①协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议时；

②经本协议各方协商一致同意终止本协议；

③受不可抗力影响，一方可依据本协议第十四条第 3 款规定终止本协议；

④本次交易被相关审批机关否决。

（5）本协议终止后将不再对各方具有法律效力，但本协议的第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条除外。

18、违约责任

（1）本协议签署后，各方均应严格遵照执行，并积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，非因本协议各方的故意或重大过失导致的过错直接致使本协议不能生效的，各方均不需要承担责任。

（2）根据本协议第二条第 4 款第（7）项，非经甲方同意，业绩承诺方转让相关未解锁股份的，该业绩承诺方需向甲方支付违约金，违约金标准为已转让股份在股份过户日市值的 10%。非经甲方同意，业绩承诺方质押相关未解锁股份的，该业绩承诺方应根据甲方要求与通知及时解除质押，并自质押日（以证券登记结算公司办理质押登记手续之日为准）起向甲方支付违约金，违约金标准为已质押股份在质押日市值的 0.03%/天，直至该业绩承诺方解除股份质押，但由于甲方的原因导致逾期办理解除股份质押手续的除外。

业绩承诺方不可撤销地确认及同意，业绩承诺方承担上述违约责任后，并不当然免除其对甲方的业绩补偿责任。

（3）各方同意，本次交易交割条件满足后，甲方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向乙方支付现金对价或股份对价的，每逾期一日，应以应付未付金额为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金，但由于非甲方的原因导致逾期付款的除外。

（4）各方同意，本次交易交割条件满足后，乙方中任何一方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限办理完毕标的资产交割，每逾期一日，该违约方应以其所对应的标的资产相应对价为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算违约金支付给甲方，但由于非乙方的原因导致逾期交割的除外。

（5）除本协议另有约定外，本协议签署后，任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，或除不可抗力外，任何一方不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金（包括守约方为避免损失而支出的合理费用）。

（6）前款赔偿金包括但不限于守约方为本次购买资产而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用、合理差旅费用等，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失，其中，守约方为本次购买资产而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、律师费用等中介机构费用，原则上合计不超过 8,000 万元。

（7）各方明确，乙方各成员之间相互独立，均独立履行义务并承担责任。就本协议第十六条约定的违约责任，除非另有明确约定，乙方各成员之间无任何连带、担保、保证、代理等法律关系。乙方任一名或数名成员违约，不代表、亦不视为乙方其他成员违约，相关违约方应独立承担违约责任，与未违约的乙方成员无关，未违约的乙方成员就违约行为不承担任何连带、担保、保证或补偿义务，其合法权益不因此受到损害。

（四）购买上海承裕 100%财产份额的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

1、合同主体、签订时间

2019年7月31日，上市公司及其全资子公司合肥君正（甲方）与承裕投资、武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资（乙方）及上海承裕（丙方）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

2、本次交易整体方案

（1）北京君正及/或其全资子公司合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成 59.990%的股权和上海承裕 100%的财产份额；北京君正同时向包括刘强或其控制的关联方在内的特定投资者定向发行股份募集配套资金。

本协议项下，甲方通过发行股份及支付现金方式购买乙方合计持有的丙方 100%财产份额，其中，甲方以发行股份方式购买丙方 92.5010%财产份额，以支付现金方式购买丙方 7.4990%财产份额。

本次交易完成后，甲方将直接持有北京矽成 59.990%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.010%股权，即甲方直接及间接合计持有北京矽成 100%股权权益。

（2）各方同意，上述各项购买资产事项构成本次交易的整体方案，同步实施，不可分割。本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，但本次配套融资以本次购买资产的实施为前提；本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。

3、标的资产的定价依据及交易价格

标的资产的定价参考依据：以具有证券从业资格的评估机构对上海承裕 100%财产份额截至基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。

标的资产的交易价格：根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额所涉及的全部财产份额价值评估报告》（东洲评报字[2019]

第 0741 号），上海承裕 100%财产份额截至基准日的评估值为 2,812,178,119.19 元。经甲方与乙方协商，参考上述评估值，上海承裕 100%财产份额的交易价格确定为 2,881,028,361 元。

4、交易方式及对价支付

甲方以发行股份及支付现金相结合的方式支付本次购买资产交易对价，标的资产的交易对价为 2,881,028,361 元，具体情况如下：

交易对方	出资比例（%）	本次购买资产交易对价	
		股份对价金额（元）	现金对价金额（元）
武岳峰集电	49.2429	1,359,825,217	58,876,104
上海集岑	41.9696	1,209,154,900	-
北京青禾	5.4523	-	157,082,983
万丰投资	3.3325	96,000,000	10,616
承裕投资	0.0027	-	78,541
合计	100.0000	2,664,980,117	216,048,244

5、发行股份购买资产

作为本次购买资产的一部分，甲方中北京君正以发行股份的方式向武岳峰集电、上海集岑和万丰投资购买丙方合计 92.5010%财产份额。

（1）发行价格

鉴于上市公司 2018 年年度权益分派方案已获 2018 年年度股东大会审议通过并于 2019 年 5 月 27 日实施完毕，发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 22.46 元/股。

（2）发行数量

发行股份购买资产项下甲方作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份数量=以股份支付的交易对价÷发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

根据上述公式及上海承裕 100%财产份额的交易价格，发行股份购买资产项下甲方向乙方发行股份的具体情况如下：

交易对方	以股份支付的交易对价（元）	发行股份（股）
武岳峰集电	1,359,825,217	60,544,310
上海集岑	1,209,154,900	53,835,926
万丰投资	96,000,000	4,274,265
合计	2,664,980,117	118,654,501

自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

（3）锁定期安排

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定并经各方同意及确认，交易对方对本次购买资产项下取得甲方新增股份作出如下承诺：

1) 武岳峰集电

作为业绩承诺方，武岳峰集电在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，武岳峰集电根据其业绩承诺的完成情况（注：根据《盈利补偿协议》，业绩承诺方应对北京矽成于业绩承诺期内的盈利情况作出承诺并承担相应补偿义务（如需）），可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，武岳峰集电可解锁的股份数按如下公式计算：

武岳峰集电可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×武岳峰集电获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数 85%或以上，武岳峰集电可解锁的股份数按如下公式计算：

武岳峰集电可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×武岳峰集电获得的对价股份数量-第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，武岳峰集电于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

为本条之目的，《专项审核报告》应于甲方 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告披露之日起 30 日内出具。如《专项审核报告》届时未能出具且未经甲乙双方同意并确认延期的，则视为武岳峰集电已满足上述相应阶段的解锁条件，可自甲方相应年度报告披露届满 30 日后按上述安排解锁相应数量的股份。

2) 上海集岑和万丰投资

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的甲方新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的甲方新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

3) 本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对前述各方本次购买资产项下取得甲方新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交甲方董事会、股东大会审议。

4) 各方确认，非经甲方书面同意，业绩承诺方处于锁定期内的股份不得质押、转让；如业绩承诺方非经甲方同意质押、转让处于锁定期内的股份，应按本协议规定承担相应的违约责任。

6、现金购买资产

（1）作为本次购买资产的一部分，甲方中北京君正以支付现金方式向武岳峰集电购买其持有的丙方 2.0436%财产份额、向北京青禾购买其持有的丙方

5.4523%财产份额、向万丰投资购买其持有的丙方 0.0004%财产份额；甲方中合肥君正以支付现金方式向承裕投资购买其持有的丙方 0.0027%财产份额。根据上海承裕 100%财产份额的交易价格，支付的现金确定为 216,048,244 元（以下简称“现金对价”）；其中，北京君正向武岳峰集电支付现金对价 58,876,104 元，向北京青禾支付现金对价 157,082,983 元，向万丰投资支付现金对价 10,616 元；合肥君正向承裕投资支付现金对价 78,541 元。

（2）各方确认及同意，于本次配套融资项下募集资金到账之日起 30 个工作日内（含），甲方应向武岳峰集电、北京青禾、万丰投资、承裕投资指定的账户一次性支付现金购买资产部分的全部交易对价；但该等现金对价支付期限至迟应不晚于中国证监会核准本次交易之日起 210 日（含）或本次购买资产项下乙方取得的甲方新增股份于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份登记之日起 90 日（含）（以孰晚者为准）。

各方同意，经甲方与相关方协商一致，本次购买资产项下现金对价支付安排可根据本次配套融资实施进展与本次交易实际情况进行相应调整。

7、不竞争承诺

各方同意，《发行股份及支付现金购买资产协议》第八条调整如下：

为保障上市公司及标的企业利益，乙方承诺：业绩承诺期内，其不以任何方式直接或间接地控制任何从事与北京矽成（含其下属企业，下同）的主营业务相同的业务活动的任何实体，亦不会在北京矽成以外雇佣北京矽成的雇员（含在本协议签署日前 12 个月内曾与北京矽成签订劳动合同的人员）、不会唆使任何北京矽成的高级管理人员和核心技术人员离开公司。若发生此种行为，则乙方应在因此种行为所获利金额的限额内按照甲方实际损失向甲方支付赔偿。

各方确认并同意，乙方于本次交易生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述条款限制。

仅为本条之目的，“控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。

本条约定之不竞争承诺，于以下情形发生时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）乙方中一方对北京君正持股比例首次低于 5%，该方不竞争承

诺终止；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。

8、其他事项

（1）本协议自各方法定代表人或执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，经各方各自履行内部决策程序后，随《购买资产协议》同时生效；若《购买资产协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。

（2）各方理解并同意，本协议是对《购买资产协议》的调整和补充，与《购买资产协议》具有同等法律效力。本协议对《购买资产协议》项下相关事项重新约定或与《购买资产协议》就同一事项的约定相冲突或矛盾时，以本协议的约定为准；本协议未约定的或与履行本协议有关的其他事项以《购买资产协议》的约定为准，按照《购买资产协议》中的相关条款执行。

（3）除非本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议的有关措辞、用语、简（统）称与《购买资产协议》中的相应、用语、简（统）称的含义相同。

二、盈利补偿协议

（一）北京君正与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》

1、合同主体、签订时间

2019年5月16日，北京君正（甲方）与本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原（乙方）签署了《盈利补偿协议》。

2、业绩承诺期限

双方确认，本协议项下乙方的业绩承诺期为本次交易实施完毕当年起的连续三个会计年度（以下简称“业绩承诺期”），即2019年、2020年和2021年。如监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，双方协商后签署补充协议予以确认。

3、承诺净利润数及实际净利润数

（1）双方同意，乙方承诺北京矽成在2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于特定数值（以下简

称“承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承诺净利润累计数”）。上述承诺净利润数将由双方另行协商确定并签署补充协议。

如监管部门在审核中要求对业绩承诺期及承诺净利润数进行调整，由双方另行协商并签署补充协议。

（2）双方同意，北京矽成业绩承诺期内每个年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为“实际净利润数”；业绩承诺期内各年度的实际净利润数合计称“实际净利润累计数”。此外，在计算实际净利润数时应不考虑：①北京矽成因实施股权激励所产生的费用及相关所得税费用的影响；②北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销及相关所得税费用的影响。

（3）甲方在业绩承诺期内的每个年度单独披露北京矽成实现的实际净利润数及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。

为避免争议，双方理解并确认，本协议项下以专项审核的净利润数作为确定乙方是否需要承担补偿义务的依据。

4、盈利补偿及其方案

（1）业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例未达到一定比例（以下简称“补偿触发比例”），即视为未实现业绩承诺，则乙方承诺将根据本协议约定的条款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分，以股份、现金或股份与现金相结合的方式补偿。上述补偿触发比例将由双方另行协商，并在承诺净利润数确定后一并签署补充协议予以明确。

（2）补偿计算公式：

①业绩承诺期届满后，若北京矽成未实现业绩承诺，乙方中各方应补偿金额及应补偿股份数量的计算方式具体为：

应补偿金额=（承诺净利润累计数-实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×乙方中各方对应的交易对价

应补偿股份数量=（应补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

其中，“发行价格”为甲方本次交易项下发行股份购买资产的发行价格；“乙方中各方对应的交易对价”为甲方于本次交易项下向乙方支付的对价金额。

②乙方中各方以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，独立、非连带地履行补偿义务。

③若乙方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且乙方已就该等股份于业绩承诺期内自甲方获得了现金股利，乙方应在股份补偿实施前向甲方返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准）×应补偿股份数量；若甲方在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按本协议第四条第2款公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。

5、减值测试及补偿

（1）业绩承诺期届满时，甲方应当聘请由双方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产（为本协议之目的，具体指北京矽成100%股权，下同）进行减值测试，并出具专项审核意见。

经减值测试，如标的资产期末减值额>已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），乙方应对甲方另行补偿。另需补偿的金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-现金补偿金额。乙方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体乙方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。乙方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式且独立、非连带地履行补偿义务；另需补偿的股份数量为：（另需补偿的金额-另需现金补偿金额）÷发行价格。

“标的资产期末减值额”为本次交易项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（2）为免歧义，双方确认，乙方中各方在本协议项下的补偿总额（包括本协议第四条及第五条）以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，乙方中各方均独立、非连带地履行补偿义务。

6、盈利补偿的实施

（1）若根据本协议第四条及/或第五条约定发生应进行盈利补偿及/或减持补偿的情形，乙方应在审计机构专项审核报告及/或减值测试结果正式出具日起 10 个工作日内，将其选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式进行补偿的决定以及具体补偿方案（包括股份和现金补偿分别占应补偿金额的比例以及预计补偿现金金额及股份数量等）以书面方式通知甲方；甲方应在收到乙方通知日起 20 个工作日内召开董事会，审议确定具体盈利补偿方案。

（2）双方同意，就乙方选择采用股份方式补偿的部分，乙方应在甲方董事会决议日后 10 个工作日内将其持有的相应数量股份划转至甲方董事会设立的专门账户进行锁定，该部分应补偿的股份自甲方董事会审议通过盈利补偿方案之日起即不再拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分股份应分配的利润归甲方所有。

甲方应在前述董事会决议后就盈利补偿方案及应补偿股份回购等事宜召开股东大会，并在股东大会审议通过之日起 30 个工作日内将应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。

若甲方股东大会未审议通过盈利补偿方案及相关股份回购议案，则甲方应在股东大会决议公告日后 10 个工作日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后的 30 个工作日内将相应数量的股份赠与甲方董事会确定的股权登记日登记在册的除乙方以外的甲方其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有的股份数后的甲方股份数量的比例享有相应的获赠股份。

（3）双方同意，就乙方选择采用现金方式补偿的部分，乙方应在甲方董事会审议通过补偿方案之日起 30 个工作日内，将用于补偿的相应现金金额支付至甲方指定账户。

（二）北京君正与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议之补充协议》

1、合同主体、签订时间

2019 年 7 月 31 日，北京君正（甲方）与本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺方屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原（乙方）签署了《盈利补偿协议之补充协议》。

2、关于业绩承诺方

各方同意，《盈利补偿协议》第一条调整如下：

本次交易项下，甲方及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及支付现金方式收购北京矽成 59.99%股权及上海承裕 100%财产份额，其中上海承裕持有北京矽成 40.01%股权。

本次交易作价以具有证券从业资格的评估机构对北京矽成 100%股权及上海承裕 100%财产份额截至基准日（即 2018 年 12 月 31 日）的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的评估值为依据。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司 59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号，以下简称“《北京矽成评估报告》”），北京矽成 100%股权截至基准日的评估值为 702,791.68 万元；根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额所涉及的全部财产份额价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0741 号），上海承裕 100%财产份额截至基准日的评估值为 2,812,178,119.19 元。

双方同意并确认，本次交易项下，甲方收购上海承裕 100%财产份额系为间接收购并持有北京矽成相应权益。鉴于此，为本次交易业绩承诺及补偿之目的，北京矽成的股东屹唐投资和华创芯原、上海承裕的合伙人武岳峰集电（即本协议项下乙方）同意作为本次交易的业绩承诺方，就北京矽成在业绩承诺期内的盈利情况作出承诺并承担相应补偿责任。

3、关于承诺净利润数及实际净利润数

各方同意，《盈利补偿协议》第三条调整如下：

（1）双方同意，乙方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元（以下简称“承诺净利润数”，业绩承诺期内各年度的承诺净利润数合计称“承诺净利润累计数”）。

如监管部门在审核中要求对业绩承诺期及承诺净利润数进行调整，由双方另行协商并签署补充协议。

（2）甲方在业绩承诺期内的每个年度单独披露北京矽成经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“实际净利润数”，业绩承诺期内各年度的实际净利润数合计称“实际净利润累计数”）及其与承诺净利润数的差异情况，并由具有证券业务资格的会计师事务所对该等差异情况进行专项审核并出具报告/意见。

为避免争议，双方理解并确认，本协议项下以专项审核的净利润数作为确定乙方是否需要承担补偿义务的依据。

（3）双方同意，承诺净利润数和实际净利润数应不考虑以下事项的影响：1）Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京矽成评估报告》中关于盈利预测的口径一致）；2）北京矽成因实施股权激励所产生的费用；3）北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；4）配套募集资金投资项目损益。

4、关于盈利补偿及其方案

各方同意，《盈利补偿协议》第四条调整如下：

（1）业绩承诺期届满后，若北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的比例未达到承诺净利润累计数的 85%，即视为未实现业绩承诺，则乙方承诺将根据本协议约定的条款和条件，就北京矽成实际净利润累计数与承诺净利润累计数的差额部分，以股份、现金或股份与现金相结合的方式补偿。

（2）补偿计算公式：

①业绩承诺期届满后，若北京矽成未实现业绩承诺，乙方中各方应补偿金额及应补偿股份数量的计算方式具体为：

应补偿金额=（承诺净利润累计数-实际净利润累计数）÷承诺净利润累计数×乙方中各方对应的交易对价

应补偿股份数量=（应补偿金额－现金补偿金额）÷发行价格

其中，“发行价格”为甲方本次交易项下发行股份购买资产的发行价格；“乙

方中各方对应的交易对价”为甲方于本次交易项下向乙方支付的对价金额；依据上述公式计算应补偿股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

②乙方中各方以其于本次交易项下取得的交易对价金额为限，独立、非连带地履行补偿义务。

（3）若乙方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且乙方已就该等股份于业绩承诺期内自甲方获得了现金股利，乙方应在股份补偿实施前向甲方返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利（以税后金额为准×应补偿股份数量；若甲方在业绩承诺期内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：按本协议第四条第2款公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例））。

其中，依据上述公式计算回购股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

5、减值测试及补偿

各方同意，《盈利补偿协议》第五条第1款调整如下：

业绩承诺期届满时，甲方应当聘请由双方一致同意的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产（为本协议之目的，具体指北京矽成100%股权，下同）进行减值测试，并出具专项审核意见。

经减值测试，如标的资产期末减值额>已补偿金额（已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额），乙方应对甲方另行补偿。另需补偿的金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份总数×发行价格-现金补偿金额。乙方中各方应补偿金额按其各自于本次交易项下取得的交易对价占全体乙方于本次交易项下合计取得的交易对价的比例分别计算。乙方可以选择以股份、现金或股份与现金相结合的方式且独立、非连带地履行补偿义务；另需补偿的股份数量为：（另需补偿的金额-另需现金补偿金额）÷发行价格。

其中，依据上述公式计算另需补偿的股份数量时，如果计算结果存在小数，应当按照舍去小数并增加一股的方式进行处理。

“标的资产期末减值额”为本次交易项下标的资产评估值减去业绩承诺期届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期内标的企业增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

6、其他事项

（1）本协议自双方法定代表人或执行事务合伙人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，经双方各自履行内部决策程序后，随《盈利补偿协议》同时生效；若《盈利补偿协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。

（2）双方理解并同意，本协议是对《盈利补偿协议》的调整和补充，与《盈利补偿协议》具有同等法律效力。本协议对《盈利补偿协议》项下相关事项重新约定或与《盈利补偿协议》就同一事项的约定相冲突或矛盾时，以本协议的约定为准；本协议未约定的或与履行本协议有关的其他事项以《盈利补偿协议》的约定为准，按照《盈利补偿协议》中的相关条款执行。

（3）除非本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议的有关措辞、用语、简（统）称与《盈利补偿协议》中的相应、用语、简（统）称的含义相同。

三、股份认购协议

（一）北京君正与刘强签署的《股份认购协议》

1、本次发行股份募集配套资金方案

（1）发行方式

本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行股份的方式。

（2）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（3）发行对象和认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为包括刘强（乙方）或其控制的关联方在内的不超过5名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投

资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象等。该等特定投资者均以现金认购本次非公开发行的股份。

（4）定价基准日及发行价格

本次配套融资项下发行股份的定价基准日为上市公司本次发行的发行期首日，发行股份的价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。具体发行价格在取得发行核准批文后，根据有关规定及其他发行对象申购报价等市场询价情况，最终由上市公司董事会根据股东大会授权，与独立财务顾问（主承销商）协商确定。

认购方不参与本次发行询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。

（5）本次配套融资总金额、认购方认购的配套融资金额

本次配套融资总金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。根据标的资产的交易价格，确定本次配套融资总金额不超过 150,000.00 万元，其中，认购方拟认购的配套融资金额不低于本次配套融资总金额的 50%。最终认购金额将由上市公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

（6）发行数量、认购方认购股份数量

本次配套融资项下发行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的 20%，其计算公式为：本次配套融资发行数量 = 本次配套融资总金额 / 发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。

认购方认购股份数量的计算公式为：认购方认购股份数量 = 认购方认购的配套融资金额 / 发行价格，认购方认购股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。

最终发行数量及认购方认购股份数量将在中国证监会核准的配套融资方案

基础上，由上市公司董事会根据股东大会授权，与独立财务顾问（主承销商）根据发行价格协商确定。

若发行价格根据有关规定发生调整，则公司本次发行股份募集配套资金项下发行股份数量将进行相应调整。

（7）股票锁定期

认购方认购股份自本次发行完成之日起三十六（36）个月内不得转让。本次配套融资完成后，上市公司实行分配股票股利、转增股本等情形的，则认购方基于持有的上述认购股份而增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。认购方同意按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。

认购方认购股份在前款规定的锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

（8）滚存利润

本次发行完成后，认购方按其对上市公司的持股比例，与上市公司其他股东共同享有上市公司本次发行前滚存的未分配利润。

2、获取批准

（1）任何一方应及时将有权机关审批本协议的情况通知其他方。任何一方应当立即通知对方并向对方提供其所知的有权机关不时就相关文件出具的任何意见或文件。如果有权机关对相关文件有异议并要求做出修订，双方应该协商修订相关文件，并及时将修订后的相关文件提交有权机关审批。

（2）对于本次发行所需批准、授权、同意和备案中涉及的需由上市公司申请的事宜，上市公司应在签署日后根据中国法律向有权机关提交所有必要的文件以使相关文件获得批准，并将有权机关不时就相关文件出具的任何意见和文件立即通知对方。乙方应尽其最大努力协助上市公司完成本协议规定应由上市公司申报的各项审批事项。

3、股份认购价款支付及验资

（1）支付方式

自本次交易生效后，在上市公司与独立财务顾问（主承销商）确定的具体缴款日期（以下简称“缴款日”），认购方在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。上市公司应在缴款日前至少 3 个工作日前书面通知认购方有关上市公司非公开发行收款账户的详细信息。

（2）验资

在收到认购方支付的认购价款后，上市公司应当及时委托有从事证券业务资格的会计师事务所对本次发行所募集的全部资金进行验资并出具验资报告。

4、交割和交割后续事项

（1）交割

双方均理解并同意，在认购方依本协议约定向上市公司支付全部认购价款并经验资后，上市公司应及时向认购方发行新增股份，即上市公司应于前述验资完成之日起 3 个工作日内按照深交所、证券登记结算机构的相关业务规则及要求提交股份发行及登记的相关申请文件。认购方将认购价款交付上市公司指定账户后 10 个工作日内，上市公司应为认购方在中国证券登记结算有限责任公司办理本次现金认购股份的股票登记手续。

新增股份经证券登记结算机构登记在认购方合法开立的 A 股股票账户名下即视为交割的完成，完成该等登记当日即为新增股份交割日。

（2）交割完成后，认购方将成为新增股份的所有人，享有或承担作为上市公司股东的权利或义务。

（3）双方同意，为履行新增股份的相关交割及落实后续各项手续，双方将密切合作并采取一切必要的行动和措施（包括按照本协议规定的原则根据需要签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件），以尽快完成各项工作。

5、募集资金用途

本次发行所募集资金用途将依法严格根据上市公司股东大会审议通过的相应决议执行（上市公司董事会有权在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整）。

6、协议的生效

本协议在下列生效条件全部成就之日起生效：

- （1）甲方董事会和股东大会审议批准本次交易相关事宜；
- （2）中国证监会核准本次交易；
- （3）法律、法规所要求的其他有权机关的审批、许可或同意(如适用)。

本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（二）北京君正与刘强、四海君芯签署的《股份认购协议》之补充协议

1、合同主体、签订时间及前提

2019年7月31日，上市公司（甲方）、刘强（乙方）及四海君芯（丙方）签署了《股份认购协议之补充协议》。

截至本协议签署日，乙方确认将由其实际控制的丙方作为认购方参与本次配套融资认购。为此，甲方、乙方及丙方同意签署本协议，就《股份认购协议》项下有关条款及未尽事宜进行调整及补充。

2、关于认购方

各方同意，《股份认购协议》中认购方确定为丙方，《股份认购协议》项下关于认购方的各项权利和义务均由丙方承继。

3、丙方的陈述与保证

- （1）丙方系依据中国法律成立并有效存续的有限公司。
- （2）丙方已取得签署本协议所必要的批准、授权，对本协议的签署、提交与履行符合相关法律法规。
- （3）丙方保证其用于认购新增股份的全部资金来源符合中国适用法律的要求，不存在任何争议及潜在纠纷。
- （4）就本次发行项下认购新增股份，丙方未与任何第三方签订对本协议产生不利影响的其他合同或协议。

（5）丙方提供的与本协议有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（6）丙方保证在本次发行完成后，在法律、法规和中国证监会所规定的限售期内，其不转让其于本协议项下的认购股份。

（7）丙方将积极签署并准备与本次发行有关的一切必要文件。

4、其他事项

（1）本协议自甲方和丙方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立，经甲方和丙方各自履行内部决策程序后，随《股份认购协议》同时生效；若《股份认购协议》解除或终止的，则本协议同时解除或终止。

（2）各方理解并同意，本协议是对《股份认购协议》的调整和补充，与《股份认购协议》具有同等法律效力。本协议对《股份认购协议》项下相关事项重新约定或与《股份认购协议》就同一事项的约定相冲突或矛盾时，以本协议的约定为准；本协议未约定的或与履行本协议有关的其他事项以《股份认购协议》的约定为准，按照《股份认购协议》中的相关条款执行。

（3）除非本协议另有规定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议的有关措辞、用语、简（统）称与《股份认购协议》中的相应、用语、简（统）称的含义相同。

（4）本协议正本一式九份，各方各执一份，其余报有关单位或部门。每份正本均具有同等法律效力。

第八章 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

本次交易符合《重组管理办法》关于重大资产重组和发行股份购买资产的相关规定，并符合《创业板发行管理办法》关于非公开发行股票的规定，具体如下：

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

（1）本次交易符合国家产业政策

本次交易北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成 59.99%股权，武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕 100%财产份额。本次交易完成后，上市公司将直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。

根据证监会《上市公司行业分类指引》分类，标的公司所从事的集成电路存储芯片（及其衍生产品）的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售属于“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，按照国家统计局《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）标准，属于“C 制造业”门类下的“C396 电子器件制造”项下的“C3963 集成电路制造”行业。

集成电路产业作为信息技术产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。

国家高度重视集成电路产业的发展，自 2000 年以来相继出台了多项政策支持集成电路产业发展。2014 年 6 月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，设立国家产业投资基金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。2016 年 5 月，国务院发布《国家创新驱动发展战略纲要》，要求加大集成电路等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度；攻克集成电路装备等方

面的关键核心技术。2016年7月，国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台，推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，要求启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。2016年12月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，要求大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片研发部署。2017年4月，科技部发布《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》，提出优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。

本次重组的标的公司北京矽成在 DRAM、SRAM 等存储芯片领域保持全球领先地位，同时拥有一批优质客户。本次交易完成后，北京矽成作为一家拥有专用技术市场领先水平的存储芯片设计公司将注入上市公司，上市公司可以充分发挥和北京矽成在产品类型、产品市场、客户结构、技术研发等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。综上，本次重组将实现产业整合，较大幅度的提升上市公司研发能力及综合实力，符合国家产业政策。

（2）本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

本次交易标的公司及其下属子公司的主营业务为集成电路存储芯片（及其衍生产品）的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售，其业务模式采取 Fabless 模式，即主要进行产品的设计工作，将晶圆生产、芯片封装业务委托给其他厂家完成。标的公司主营业务不存在违反其所在地国家或地区环境保护相关法律法规的情形。本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

（3）本次交易符合国家土地管理相关的法律和行政法规的规定

本次交易标的资产为北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，不直接涉及土地交易。标的公司均通过自有房产和租赁房产满足经营活动。

报告期内，标的公司不存在因严重违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规而受到任何其他行政处罚的情形，符合国家关于土地管理的法律及行政法规的规定。

（4）本次交易不存在违反反垄断法律法规规定的情形

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定：“经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币”。

根据上述规定，本次交易相关指标未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条所规定的标准，本次交易未存在违反反垄断法律法规规定的情形。

综上所述，本次交易符合国家相关产业政策和国家关于环境保护、土地管理、反垄断等有关法律、行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据目前上市公司股东所持股份的情况，以及交易标的作价、本次拟发行普通股的定价进行计算，本次资产重组完成后，北京君正公众股东所持比例高于 10% 的最低比例要求，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和全体股东合法权益的情形

根据《购买资产协议》及其补充协议，本次资产重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，标的资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基础经交易各方协商后确定。北京君正董事会审议通过了本次交易的相关议案，关联董事均回避了相关议案的表决，独立董事发表的独立意见认为，本次交易评估机构具有独立性，评估假设前提合理，标的资产评估定价公允，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

因此，本次交易相关标的资产的定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

根据本次交易标的资产和交易对方提供的资料、出具的承诺声明等文件，截至本报告书出具日，标的资产的权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，除华创芯原持有的北京矽成 11.08%股权质押给亦庄国投外，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或已知的重大诉讼、仲裁。就华创芯原以其所持北京矽成股权向亦庄国投质押事宜，华创芯原已承诺，将于本次重组交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。

本次交易标的资产为北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，本次重组不涉及债权债务的转移。

综上，本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，本次交易的债权债务处理合法。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易完成后，北京君正将持有北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，直接及间接持有北京矽成 100%股权。本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易完成前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，信息披露及时，运行规范。未因违反独立性原则而受到监管机构的处罚。

本次交易完成后，上市公司资产质量和独立经营能力得到提高，将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，继续规范运作，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上，本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构

等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

7、本次交易有利于上市公司完善健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已建立健全法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能充分独立运行的组织职能机构，并保障了上市公司的日常运营。

本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，根据实际情况对上市公司章程进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构。

综上，本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

（二）本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

1、本次交易未导致上市公司控制权变更

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03%和 12.73%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。

在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、四海君芯认购配套融资的 50%测算，刘强将直接持有北京君正 8.24%股份并通过其控制的企业四海君芯间接持有北京君正 4.11%股份，即刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%；李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

2、相关方已出具维持上市公司现有控制权稳定的承诺

为保证上市公司控制权的稳定，上市公司控股股东、实际控制人刘强和李杰出具了《关于维持上市公司控制权稳定的承诺》，主要内容如下：

“1.本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃上市公司控制权，也不会以任何方式直接或间接协助或促使任何第三方谋求上市公司控制权。2.本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动辞任上市公司董事、高级管理人员

的职务（如有）。3.本次交易完成后 60 个月内，根据资本市场情况与实际需要，本承诺人不排除通过协议转让、二级市场增持等方式增加上市公司股份，以维护上市公司控制权稳定。4.本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，本承诺人向上市公司提名的董事人数合计不少于四名。5.本承诺人将严格履行股份锁定义务，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定及监管要求，结合已作出的公开承诺，安排及规范股份减持行为，并及时履行信息披露义务。6.本承诺人将根据相关法律法规及公司章程，积极行使包括提名权、表决权在内的股东权利和董事权利，不会主动放弃或促使本承诺人的一致行动人放弃所享有的任何股东权利和董事权利，努力保持对上市公司股东大会、董事会及管理层团队的实质影响力。7.本承诺函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构成对承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。”

为保证交易完成后上市公司控制权的稳定，本次交易的全体交易对方出具了《关于不谋求上市公司控制权的声明及承诺函》，主要内容如下：

“1.截至本函出具日，交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。2.本次交易完成后，在上市公司的日常运作中，交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互间委托股东表决权，不会就上市公司审议事项相互商议一致后再进行表决，即交易对方之间不会形成一致行动的默契或安排，但为维护上市公司现有控制权之目的除外。3.本次交易完成后，交易对方将不会联合向上市公司提出以下议案：提名董事、监事候选人；罢免上市公司在任董事、监事；改组上市公司董事会、监事会；新增上市公司董事会、监事会成员等改变上市公司董事会、监事会现有人员组成结构或对董事会、监事会人员组成结构产生实质性影响。交易对方进一步确认，本次交易完成后，上市公司董事会成员由六名调整至九名，全体交易对方向上市公司提名的董事人数合计不超过上市公司届时董事总数的四分之一，但不低于两名。4.交易对方均尊重刘强先生和李杰先生于上市公司的实际控制人地位，在本次交易完成后 60 个月内，不以任何方式单独或联合第三方谋求上市公司控制权。

5.如违反上述承诺，上市公司有权要求承诺人根据上述承诺予以改正，承诺人拒绝改正的，上市公司有权拒绝承诺人的相应要求。”

综上所述，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

3、对照核查《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条

第十三条的触发条件		是否符合
1	上市公司自控制权发生变更之日起 60 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：	否，控制权未变更
	（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上；	是
	（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 100%以上；	是
	（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到 100%以上；	是
	（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 100%以上；	是
	（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到 100%以上；	是
	（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；	不适用，主营业务亦未发生根本变化
	（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。	-
	上市公司实施前款规定的重大资产重组，应当符合下列规定：上市公司实施前款规定的重大资产重组，应当符合下列规定：（一）……（五）	不适用，本次重组不属于前款规定的重大资产重组
2	创业板上市公司自控制权发生变更之日起，向收购人及其关联人购买资产，不得导致本条第一款规定的任一情形。	否，控制权未变更
3	上市公司自控制权发生变更之日起，向收购人及其关联人购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定。	不适用，北京君正不属于特定行业

综上所述，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司实际控制人不会发生变化，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

（1）本次交易对于上市公司资产质量、财务状况和持续盈利能力的影响

本次交易前，北京君正 2018 年和 2019 年 1-5 月归属于母公司股东的净利润分别为 1,351.54 万元和 3,237.15 万元。根据经信永中和会计师事务所审阅的上市公司备考财务报告，北京君正 2018 年和 2019 年 1-5 月备考口径下归属于母公司股东的净利润分别为 8,506.51 万元和 8,766.68 万元。

本次交易业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元。若本次交易业绩承诺足额如期实现，将有助于改善公司的财务状况，提高盈利能力，增强综合竞争实力和持续经营能力。

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，可以形成良好的规模效应及互补效应。本次交易完成后，随着上市公司对北京矽成的控制和融合，北京君正将整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术、客户资源和销售渠道的共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与北京矽成相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强上市公司的整体盈利能力和持续竞争力。

（2）关于减少关联交易

本次交易前，上市公司未发生与日常经营相关的重大关联交易，上市公司已制定了《关联交易决策制度》，上市公司的关联交易均需遵循公开、公平、公正的原则，均需以双方平等协商为基础，均需履行必要的决策程序，定价合理、公允。上市公司监事会、独立董事需要依据法律、法规及公司章程等的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表意见。上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险，加强上市公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易前，上市公司与标的公司不存在关联交易。本次交易完成后，发行

股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。另外，上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。因此，本次交易构成关联交易。

本次交易完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，从而直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。未来上市公司将继续严格按照《上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求，审议、披露关联交易事项，确保关联交易的价格公允、合理，维护上市公司及股东的合法权益。

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人和上市公司的关联交易，刘强、李杰就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》；此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。

（3）关于避免同业竞争

本次交易前，上市公司实际控制人刘强、李杰未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及北京矽成经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及北京矽成生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后上市公司将不存在同业竞争情形。同时，为充分保护上市公司利益，避免同业竞争，上市公司实际控制人刘强、李杰已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将

超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有利于保持上市公司独立性、保障全体股东，尤其是中小股东的利益。

（4）关于增强独立性

本次交易完成后，上市公司资产质量和独立经营能力得到提高，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。为充分保护上市公司利益，保持上市公司独立性，上市公司实际控制人刘强、李杰已出具《关于保证上市公司独立性的承诺》。

综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，将不会因本次交易新增日常性关联交易、交易后上市公司与持股 5%以上股东及其控制的企业仍不存在同业竞争、有利于增强独立性。

2、上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见的情形

北京君正 2018 年会计报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见的情形。

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次上市公司发行股份拟购买的资产为北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额。

根据本次交易标的资产和交易对方提供的资料、出具的承诺声明等文件，截至本报告书出具日，标的资产的权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或

争议，除华创芯原持有的北京矽成 11.08%股权质押给亦庄国投外，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或已知的重大诉讼、仲裁。就华创芯原以其所持北京矽成股权向亦庄国投质押事宜，华创芯原已承诺，将于本次重组交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。

综上，上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，资产过户或者转移不存在法律障碍，能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

（四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定

《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外。

本次交易上市公司募集配套资金不超过 15 亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，符合上述《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定，将一并提交并购重组审核委员会审核。

（五）本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定

根据《重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量

本次购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的董事会决议公告日，即 2019 年 5 月 17 日。公司拟定本次购买资产的发行价格不低于定价基准日前 120

个交易日公司股票交易均价的 90%，即 22.49 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量。经公司与交易对方协商，最终确定本次购买资产的股份发行价格为 22.49 元/股。

根据上市公司 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年 4 月 10 日总股本 201,209,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共分配现金股利 6,036,298.68 元（含税）。2019 年 5 月 27 日，上市公司 2018 年度利润分配实施完毕。根据前述利润分配情况，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格相应调整为 22.46 元/股。

自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。除此之外，上述发行价格不再调整。

综上，本次发行股份及支付现金购买资产的定价原则符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

（六）本次交易符合《重组管理办法》第四十六条和《创业板发行管理办法》第十六条的规定

根据《重大重组管理办法》第四十六条规定，特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让；属于下列情形之一的，36 个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（二）特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；（三）特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月。

《创业板发行管理办法》第十六条规定，上市公司非公开发行股票确定发行价格和持股期限，应当符合下列规定：……（三）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票

均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的锁定期

（1）业绩承诺方的锁定期安排

作为业绩承诺方，屹唐投资、华创芯原、武岳峰集电在本次购买资产项下取得的公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让。12 个月届满后，该等业绩承诺方根据其业绩承诺的完成情况，可以分期及按比例解锁，具体方式及安排如下：

第一期，本次发行完成之日起 12 个月届满且 2019 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年实际净利润数未达到承诺净利润数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年实际净利润数达到承诺净利润数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年承诺净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量

第二期，于 2020 年《专项审核报告》出具后，如根据《盈利补偿协议》，北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数未达到承诺净利润累计数的 85%，则可解锁的股份数为零；如北京矽成 2019 年和 2020 年实际净利润累计数达到承诺净利润累计数的 85%或以上，各业绩承诺方可解锁的股份数按如下公式计算：

各业绩承诺方可解锁的股份数=2019 年和 2020 年承诺净利润累计数÷业绩承诺期内承诺净利润累计数×各业绩承诺方获得的对价股份数量－第一期解锁股份数

第三期，于 2021 年《专项审核报告》出具后，业绩承诺方于《盈利补偿协议》项下业绩补偿及减值补偿义务（如有）履行完毕后所持剩余股份可全部解锁。

（2）非业绩承诺方的锁定期安排

该等交易对方取得新增股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准，下同），如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则其在本次购买资产项下取得的上市

公司新增股份（即对价股份）自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；如对于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则其取得的上市公司新增股份自本次发行完成之日起 36 个月届满之日前不得转让。

本次交易完成后，前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

若中国证监会等监管机构对交易对方本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。

2、募集配套资金所涉发行股份的锁定期

刘强控制的企业四海君芯认购的募集配套资金发行的新增股份自发行完成之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的募集配套资金发行的新增股份自发行完成之日起 12 个月内不得转让。

本次交易完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份，亦应遵守上述限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

二、本次交易不存在《创业板发行管理办法》第十条规定的不得发行证券的情形

上市公司不存在《创业板发行管理办法》第十条规定的以下情形：

- 1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 2、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
- 3、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

4、上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

5、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，上市公司不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得发行证券的情形。

第九章 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析

根据兴华会计师审计的北京君正 2017 年、2018 年财务报告以及 2019 年 1-5 月未经审计的财务报表，北京君正最近两年及一期财务数据、经营指标如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	124,785.26	119,798.02	115,676.00
负债总额	6,041.68	5,605.33	3,193.23
归属上市公司股东所有者权益	118,743.58	114,192.69	112,482.76
资产负债率	4.84%	4.68%	2.76%
项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
营业收入	11,788.38	25,967.01	18,446.70
营业利润	3,202.94	1,561.67	672.07
利润总额	3,200.68	1,381.76	683.92
归属母公司所有者的净利润	3,183.71	1,351.54	650.11
经营活动产生的现金流量净额	2,351.87	3,637.07	-3,069.40
毛利率	39.08%	39.86%	37.01%
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.0674	0.0325

（一）本次交易前上市公司财务状况分析

1、资产结构分析

最近两年及一期，上市公司合并报表口径的资产构成主要如下：

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产						
货币资金	8,734.56	7.00%	16,060.18	13.41%	4,079.91	3.53%
交易性金融资产	75,439.34	60.46%	-	-	-	-
应收票据及应收账款	1,529.15	1.23%	2,232.07	1.86%	1,324.14	1.14%
预付款项	893.01	0.72%	389.74	0.33%	624.43	0.54%
其他应收款	553.08	0.44%	231.25	0.19%	444.65	0.38%

存货	8,117.00	6.50%	8,024.80	6.70%	10,530.35	9.10%
其他流动资产	795.18	0.64%	64,662.70	53.98%	68,384.36	59.12%
流动资产合计	96,061.33	76.98%	91,600.74	76.46%	85,387.83	73.82%
非流动资产						
可供出售金融资产	-	-	13,484.12	11.26%	16,240.74	14.04%
长期股权投资	184.05	0.15%	183.61	0.15%	198.46	0.17%
其他权益工具投资	13,958.08	11.19%	-	-	-	-
投资性房地产	3,120.24	2.50%	3,149.42	2.63%	3,220.61	2.78%
固定资产	3,608.98	2.89%	3,629.85	3.03%	3,618.82	3.13%
在建工程	3,663.38	2.94%	3,513.92	2.93%	2,496.11	2.16%
无形资产	3,236.80	2.59%	3,270.20	2.73%	3,365.71	2.91%
长期待摊费用	85.23	0.07%	117.59	0.10%	150.46	0.13%
递延所得税资产	707.47	0.57%	547.53	0.46%	268.35	0.23%
其他非流动资产	159.71	0.13%	301.04	0.25%	728.89	0.63%
非流动资产合计	28,723.93	23.02%	28,197.28	23.54%	30,288.16	26.18%
资产总计	124,785.26	100.00%	119,798.02	100.00%	115,676.00	100.00%

（1）资产结构总体分析

报告期各期末，上市公司资产总额分别为 115,676.00 万元、119,798.02 万元和 124,785.26 万元。上市公司资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资构成，报告期各期末上述资产合计占资产总额的比重分别为 85.79%、85.34%和 85.78%。

从资产结构方面看，上市公司资产主要以流动资产为主，主要原因在于上市公司经营采用 Fabless 模式，无需大型生产设备及厂房的大额投入。报告期各期末，上市公司流动资产金额分别为 85,387.83 万元、91,600.74 万元和 96,061.33 万元，占资产总额的比例分别为 73.82%、76.46%和 76.98%。

（2）流动资产结构分析

报告期各期末，上市公司流动资产金额分别为 85,387.83 万元、91,600.74 万元和 96,061.33 万元，主要由货币资金、交易性金融资产、存货和其他流动资产组成，报告期各期末，上述资产账面价值合计占流动资产总额的比重分别为 97.20%、96.89%和 96.90%。

报告期各期末，上市公司货币资金余额分别为 4,079.91 万元、16,060.18 万元和 8,734.56 万元。截至 2019 年 5 月末，货币资金余额较 2018 年末下降 45.61%，主要系购买短期理财产品支出；截至 2018 年末，货币资金余额较 2017 年末增长 293.64%，主要系购买的短期理财产品到期收回所致所致。

报告期各期末，上市公司存货余额分别为 10,530.35 万元、8,024.80 万元和 8,117.00 万元。截至 2019 年 5 月末，存货余额较 2018 年末增长 1.15%，整体变动较小；截至 2018 年末，存货余额较 2017 年末减少 23.79%，主要原因为对部分未生产完毕且不打算继续生产的在产品全额计提跌价准备及对部分丧失市场价值的芯片产品计提较大金额跌价准备。

报告期各期末，上市公司其他流动资产的余额分别为 68,384.36 万元、64,662.70 万元和 795.18 万元。截至 2019 年 5 月末，其他流动资产余额较 2018 年末下降 98.77%，主要系上市公司自 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则将原计入其他流动资产的金融机构理财产品转入交易性金融资产核算所致。上市公司交易性金融资产、其他流动资产主要为金融机构理财产品，截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 5 月末，理财产品余额分别为 67,198.90 万元、63,500.00 万元和 75,439.34 万元。

（3）非流动资产结构分析

报告期各期末，上市公司非流动资产分别为 30,288.16 万元、28,197.28 万元和 28,723.93 万元。上市公司非流动资产主要为可供出售金融资产、其他权益工具投资。截至 2019 年 5 月末，上市公司新增其他权益工具投资系 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产转入其他权益工具投资核算所致。报告期各期末，可供出售金融资产分别为 16,240.74 万元、13,484.12 万元和 0.00 万元，其他权益工具投资分别为 0.00 万元、0.00 万元和 13,958.08 万元。

2、负债结构分析

最近两年及一期，上市公司合并报表口径的负债结构主要如下：

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债						
应付票据及应付账款	619.48	10.25%	584.98	10.44%	340.10	10.65%
预收款项	164.80	2.73%	209.03	3.73%	304.60	9.54%
应付职工薪酬	58.59	0.97%	667.79	11.91%	532.53	16.68%
应交税费	105.01	1.74%	444.14	7.92%	36.56	1.14%
其他应付款	358.42	5.93%	415.86	7.42%	506.68	15.87%
流动负债合计	1,306.31	21.62%	2,321.80	41.42%	1,720.46	53.88%
非流动负债						
递延所得税负债	160.74	2.66%	-	-	-	-
递延收益	4,574.63	75.72%	3,283.53	58.58%	1,472.77	46.12%
非流动负债合计	4,735.37	78.38%	3,283.53	58.58%	1,472.77	46.12%
负债合计	6,041.68	100.00%	5,605.33	100.00%	3,193.23	100.00%

（1）负债总体结构分析

报告期各期末，上市公司负债总额分别为 3,193.23 万元、5,605.33 万元和 6,041.68 万元，截至 2019 年 5 月末，负债总额较 2018 年末增长 7.78%，主要系收到政府补助致递延收益增加所致；截至 2018 年末，负债总额较 2017 年末增长 75.54%，主要系账期内应付款增加、应交税费增加及政府补助产生的递延收益增加所致。

从负债总体结构来看，上市公司负债结构中流动负债、非流动负债占比较为均衡。2018 年，因政府补助产生较大递延收益，非流动负债余额较 2017 年末增长 122.95%，非流动负债占负债总额的比重也因此增加至 58.58%。

（2）流动负债结构分析

上市公司的流动负债包括应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款。

报告期各期末，上市公司应付票据及应付账款余额分别为 340.10 万元、584.98 万元和 619.48 万元。2019 年 5 月末，应付票据及应付账款较 2018 年末增长 5.90%，整体变动较小；2018 年末，应付账款较 2017 年末增长 72.00%，主要

系随着营业收入的增长，采购增加，处于账期内的应付款项相应增加所致。

报告期各期末，上市公司预收账款余额分别为 304.60 万元、209.03 万元和 164.80 万元。2019 年 5 月末，预收账款较 2018 年末减少 21.16%，主要系相应预收账款结转销售收入所致；2018 年末，预收账款较 2017 年末减少 31.38%，主要系相应预收账款结转销售收入所致。

报告期各期末，上市公司应付职工薪酬余额分别为 532.53 万元、667.79 万元和 58.59 万元。2019 年 5 月末，应付职工薪酬较 2018 年末减少 91.23%，主要系当年发放 2018 年计提的工资、奖金、津贴和补贴等；2018 年末，应付职工薪酬较 2017 年末增加 25.40%，主要系 2018 年计提的工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬较 2017 年增加，且 2018 年末尚有部分薪酬未发放所致。

报告期各期末，上市公司应交税费余额分别为 36.56 万元、444.14 万元和 105.01 万元。2019 年 5 月末，应交税费较 2018 年 12 月 31 日减少 76.36%，主要系当年缴纳 2018 年计提的应交增值税等税费；2018 年末，应交税费较 2017 年末增加 1,114.97%，主要系 2018 年 12 月份增值税应税收入较高且可抵扣进项税较少所致。

报告期各期末，上市公司其他应付款余额分别为 506.68 万元、415.86 万元和 358.42 万元。2019 年 5 月末，其他应付款余额较 2018 年末减少 13.81%，主要系退还客户销售的押金；2018 年末，其他应付款余额较 2017 年末减少 17.92%，主要系退还客户销售押金所致。

（3）非流动负债结构分析

上市公司非流动负债主要由递延收益组成，递延收益主要系上市公司所取得的政府补助。报告期各期末，递延收益分别为 1,472.77 万元、3,283.53 万元和 4,574.63 万元。2019 年 5 月末，上市公司递延收益较 2018 年末增加 39.32%，主要系上市公司收到政府补助增加所致；2018 年末，上市公司递延收益较 2017 年末增加 122.95%，主要系上市公司“高性能区块链共识算法芯片关键技术研究”及全资子公司合肥君正“高清视频 SoC 芯片研发项目”、“基于 28 纳米工艺的视频监控芯片研发项目”等新增政府补助所致。

3、现金流量分析

报告期各期，上市公司经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	2,351.87	3,637.07	-3,069.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,240.64	7,894.35	-14,657.26
筹资活动产生的现金流量净额	555.11	424.95	1,324.29
现金及现金等价物净增加额	-7,325.62	11,980.28	-16,429.73

报告期各期，上市公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,069.40 万元、3,637.07 万元和 2,351.87 万元。2018 年度，上市公司经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 6,706.48 万元，主要系随着对各应用领域的市场推广的不断加强，上市公司产品在物联网和智能视频等领域的销售收入持续增长，销售商品、提供劳务收到的现金收入增加所致。

报告期各期，上市公司投资活动产生的现金流量净额分别为-14,657.26 万元、7,894.35 万元和-10,240.64 万元。2018 年度上市公司投资活动产生的现金流量净额为正，较 2017 年度增加 22,551.61 万元，主要系 2018 年理财产品收回投资及投资收益的金额大于当年购买理财产品的支出，而 2017 年度购买理财产品的现金流出高于收回的投资，导致 2017 年度投资活动产生的现金流量为负。

报告期各期，上市公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,324.29 万元、424.95 万元和 555.11 万元。2018 年度，上市公司筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度减少 899.34 万元，主要系公司对主要员工进行了股票期权激励计划，2018 年行权数量较 2017 年减少，收到的股权激励行权款相应减少，同时进行派息分红所致。

4、偿债能力分析

报告期各期末，上市公司合并报表口径的主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率	73.54	39.45	49.63
速动比率	67.32	36.00	43.51
资产负债率	4.84%	4.68%	2.76%

报告期各期末，上市公司流动比率分别为 49.63、39.45 和 73.54，速动比率分别为 43.51、36.00 和 67.32，流动比率和速动比率均较高。2019 年 5 月末流动比率和速动比率均较 2018 年末上升，主要系随着应付职工薪酬、应交税费的结算使得流动负债减少所致；2018 年末流动比率和速动比率均较 2017 年末下降，主要系随着销售规模的增长，期末应交税费、采购应付账款等流动负债余额增幅较大所致。

报告期各期末，上市公司资产负债率分别为 2.76%、4.68%和 4.84%，负债水平较低。

总体而言，上市公司资产流动性较高、整体偿债能力较好。

（二）本次交易前经营成果分析

1、利润构成分析

报告期各期，上市公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	11,788.38	25,967.01	18,446.70
其中：营业收入	11,788.38	25,967.01	18,446.70
营业总成本	11,137.91	28,876.58	21,516.71
其中：营业成本	7,181.65	15,615.75	11,620.03
税金及附加	130.75	429.71	470.93
销售费用	318.24	1,067.77	733.98
管理费用	1,332.29	3,072.87	2,705.50
研发费用	2,260.92	7,396.44	5,674.01
财务费用	-116.07	-84.53	-24.74
资产减值损失	-	1,378.56	337.00
加：其他收益	1,168.44	1,570.55	1,327.76
投资收益	444.69	2,900.69	2,414.31
公允价值变动收益	939.34	-	-
营业利润	3,202.94	1,561.67	672.07
加：营业外收入	1.84	9.40	39.16
减：营业外支出	4.10	189.30	27.31

利润总额	3,200.68	1,381.76	683.92
减：所得税费用	16.97	30.22	33.81
净利润	3,183.71	1,351.54	650.11
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	3,183.71	1,351.54	650.11

报告期各期，上市公司实现营业收入分别为 18,446.70 万元、25,967.01 万元和 11,788.38 万元。上市公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等产品及整体解决方案的研发和销售，报告期内，上市公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 94.42%、95.89%和 96.89%，为营业收入主要来源。按产品大类分类，上市公司主营业务收入主要为微处理芯片和智能视频芯片销售收入，报告期各期，微处理芯片和智能视频芯片销售收入合计占营业收入的 92.97%、94.08%和 95.36%。

上市公司最近两年及一期营业收入按产品分类列示如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
微处理器芯片	5,442.94	46.17%	14,482.46	55.77%	9,026.84	48.93%
智能视频芯片	5,799.22	49.19%	9,948.55	38.31%	8,122.33	44.03%
技术服务	119.19	1.01%	115.22	0.44%	104.80	0.57%
其他	60.74	0.52%	354.47	1.37%	163.75	0.89%
主营业务收入	11,422.08	96.89%	24,900.69	95.89%	17,417.72	94.42%
房租收入	366.31	3.11%	1,066.32	4.11%	1,028.98	5.58%
其他业务收入	366.31	3.11%	1,066.32	4.11%	1,028.98	5.58%
营业收入	11,788.38	100.00%	25,967.01	100.00%	18,446.70	100.00%

报告期各期，上市公司分别实现营业利润 672.07 万元、1,561.67 万元和 3,202.94 万元，分别实现净利润 650.11 万元、1,351.54 万元和 3,183.71 万元。

随着公司不断加强各应用领域的市场推广，加强芯片与方案的研发，2018 年公司产品在物联网和智能视频等领域的销售收入较 2017 年增长。此外，2018 年度公司理财产品产生的投资收益较 2017 年度有所增加，进一步提高了其利润水平。

2、盈利指标分析

上市公司最近两年及一期的盈利指标如下：

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
销售毛利率	39.08%	39.86%	37.01%
销售净利率	27.01%	5.20%	3.52%
期间费用率	32.20%	44.10%	49.27%
加权平均净资产收益率	2.74%	1.19%	0.59%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.92%	-1.83%	-1.67%
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.0674	0.0325
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.0533	-0.1035	-0.1107

上市公司的盈利水平较为稳定。2018 年，随着公司在物联网和智能视频等领域的销售收入增长，其销售毛利率、净利率、加权平均净资产收益率、每股收益指标较 2017 年有所提升。2019 年 1-5 月，因期间费用率的降低，当期产生较大的政府补助，且 2018 年计提了较大金额的存货跌价损失及可供出售金融资产减值损失，上市公司的净利率、加权平均净资产收益率、每股收益指标较 2018 年进一步提升。

二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析

（一）行业整体发展情况

1、集成电路行业

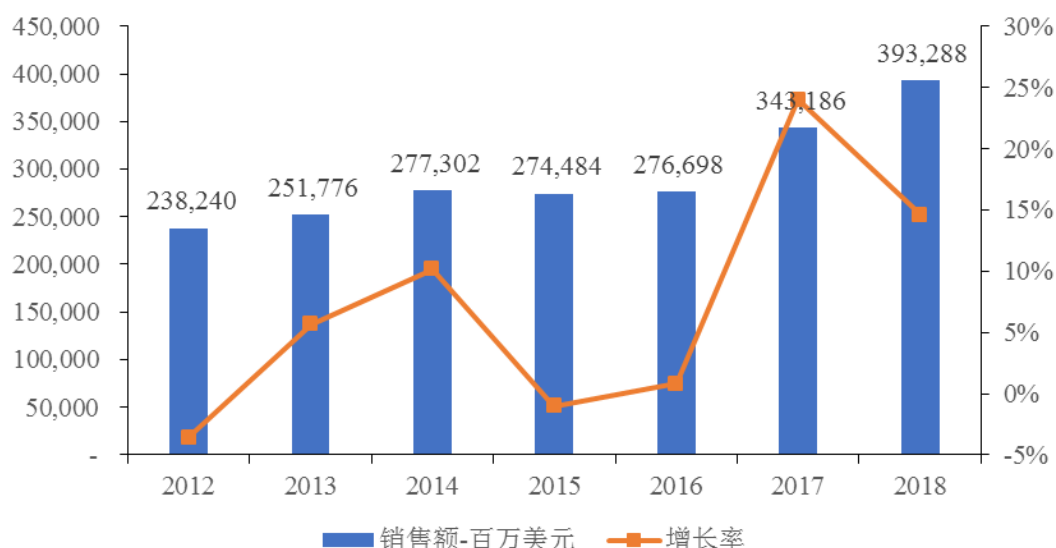
集成电路是一种微型的电子器件，是经过一定的工艺，把构成一定功能的电路所需的电子元器件及连接导线制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路具有高度集成化、低功耗和高可靠性等优点，同时其成本较低，便于大规模生产，在电子设备领域得到广泛应用。集成电路产业是促进经济发展的关键基础产业，是世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的产业之一。

（1）全球集成电路行业发展情况

全球集成电路行业在过去三十年的时间中，在以美国和欧洲为首的西方发达国家带领下经历了从无到有的进步。其后以日本、韩国、中国台湾为代表的新势

力的崛起，为全球集成电路经营模式带来的革新，晶圆代工厂以及 Fabless 的设计厂商的出现在全球集成电路的生产产能、生产工艺以及技术路径上都带来了前所未有的快速提升。之后在面对全球消费电子，包括计算机、便携式电脑、智能手机、智能手表等应用产品的发展和普及浪潮下，集成电路产业逐渐成为全球经济发展的支柱型产业之一。根据 WSTS 统计显示，全球集成电路市场规模从 2012 年的 2,382 亿美元增长至 2018 年的 3,933 亿美元，年均复合增长率为 8.71%。在经历了 2015、2016 年震荡调整后，2017 年全球集成电路市场复苏，销售额较 2016 年增长 24.03%；而 2018 年全球集成电路市场供给趋于充裕，全年销售额较 2017 年增长 14.60%，增速趋于放缓。

2012 年-2018 年全球集成电路销售额

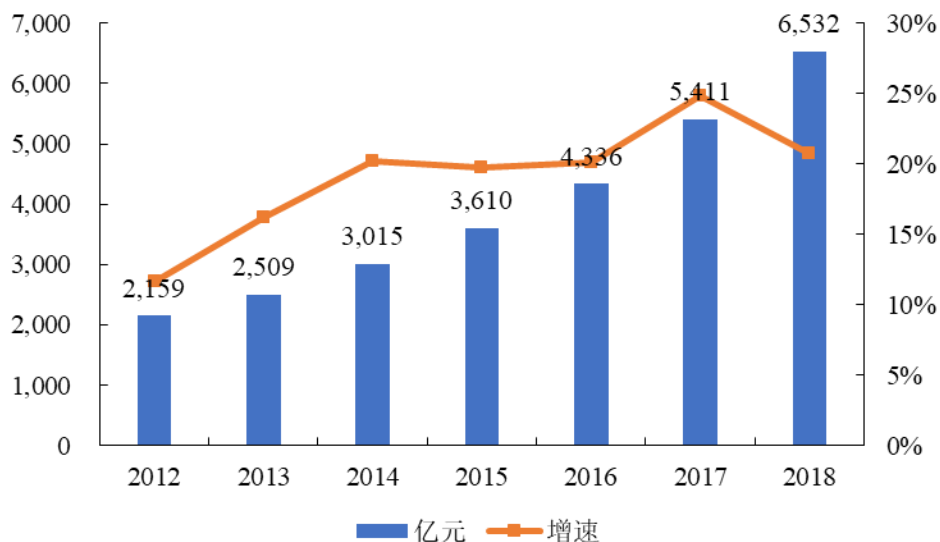


数据来源：Wind 资讯、WSTS

（2）我国集成电路行业发展情况

集成电路产业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

2012-2018 年中国集成电路销售规模



数据来源：Wind 资讯、中国半导体行业协会

近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源，以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国集成电路行业在 2017 年、2018 年销售规模分别达到 5,411 亿元、6,532 亿元。受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等带动，以及外资企业加大在华投资影响，过去三年行业销售规模增速分别为 20.10%、24.81%、20.71%，整体增速高于全球水平且较为稳定。

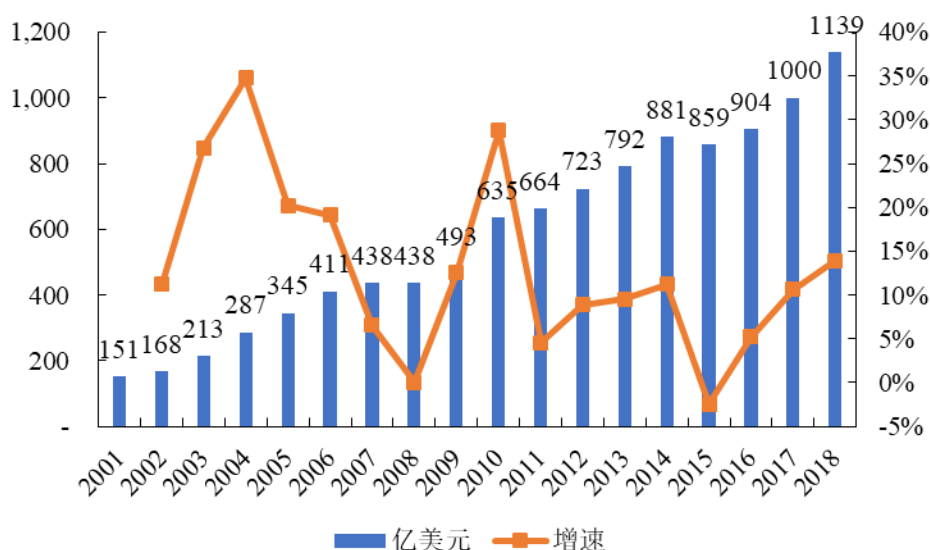
2、集成电路设计行业

（1）全球集成电路设计行业发展情况

集成电路行业包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装业、集成电路测试业、集成电路加工设备制造业等子行业。集成电路设计（IC 设计）行业作为集成电路行业的子行业，处于产业链的上游，主要根据终端市场的客户需求，设计开发各类芯片产品，对于下游应用市场有着密切的依赖关系，近年来来自于汽车电子、工业控制、医疗电子、移动通讯、消费电子、移动互联网、显示照明等市场发展有力促进了集成电路设计行业的快速发展。

集成电路设计行业兼具资金密集型和技术密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求，因此在集成电路子行业中毛利率水平相对较高，也是行业持续发展的重要基础。

2001-2018 年全球 IC 设计产业市场规模



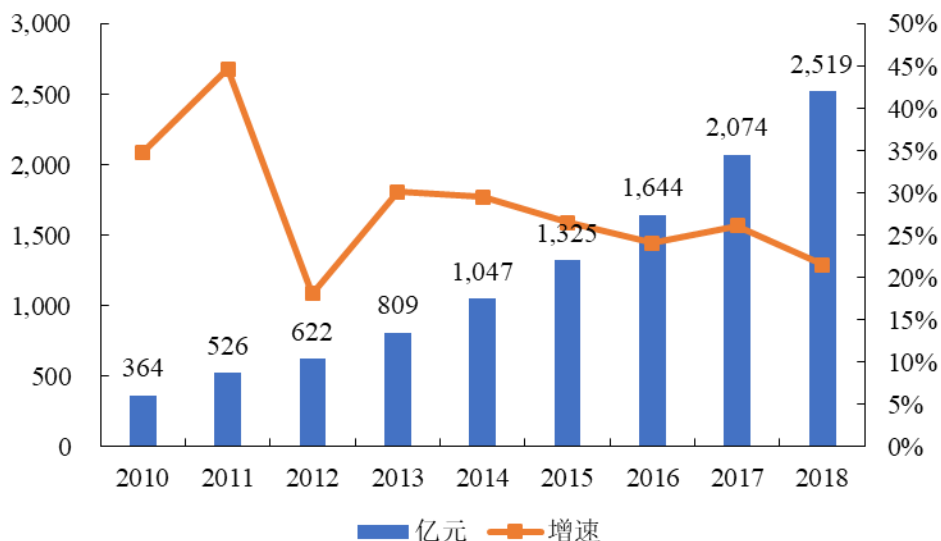
数据来源：IC Insights

随着全球电子信息产业的快速发展，全球集成电路设计行业一直呈现持续增长的势头。然而，由于智能手机、笔记本电脑等终端产品进入成熟期，增量放缓，而物联网、人工智能等新兴领域仍处于技术积累阶段，对行业的贡献度较低，2015年全球 IC 设计行业市场规模出现小幅滞涨，于 2016 年再次实现正向增长。2018 年全球 IC 设计行业销售额达 1,139 亿美元，较 2017 年增长 13.90%。

（2）我国集成电路设计行业发展情况

经过十年“创芯”发展，国内集成电路产业呈现集聚态势，逐步形成以设计业为龙头，封装测试业为主体，制造业为重点的产业格局。虽然我国集成电路设计行业起步较晚，但发展速度较快，根据中国半导体行业协会的数据，我国集成电路设计企业销售规模在 2016 至 2018 年分别为 1,644 亿元、2,074 亿元、2,519 亿元，同比增速分别达到 24.10%、26.10%、21.50%，高于全球集成电路设计行业平均水平。

2010 年-2018 年中国集成电路设计企业销售额



数据来源：Wind 资讯、中国半导体行业协会

我国集成电路设计行业实现高速增长主要来自于以下三大因素：

①中国市场作为近年来提供全球集成电路行业需求的主要市场之一，在个人电脑、智能手机、平板电脑等领域为行业提供了爆发式的需求增长。未来在可穿戴设备、智能家居等消费电子领域，将更加显现我国集成电路市场的内生增长动力。

②我国作为劳动力市场的输出国，在基本劳动力上具有相对其他地区的天然优势。集成电路设计行业作为人力和技术的密集型行业，伴随着我国设计行业市场规模的逐渐扩大，对研发人员的需求也逐年提升，而我国拥有大量且具备专业素质的基层设计人员，为企业带来劳动力成本的优势，提供了强而有力的行业竞争力。

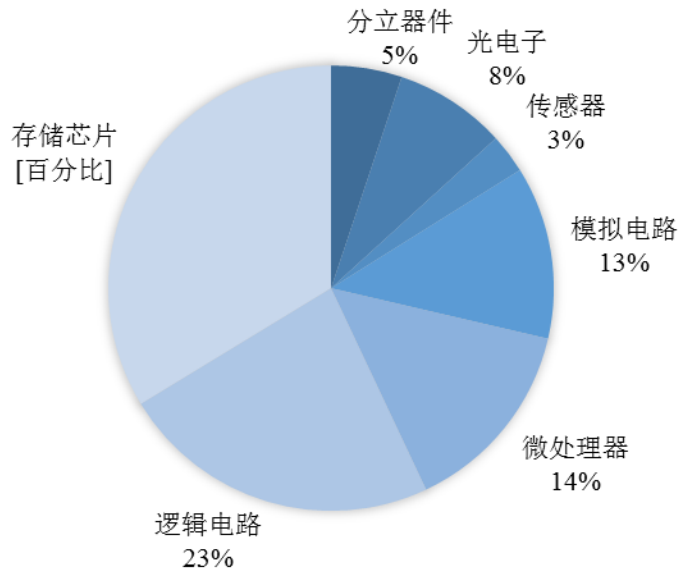
③考虑到我国相对突出的集成电路消费市场空间，以及制造及劳动力成本优势，越来越多的全球集成电路厂商在国内投资设厂。同时，基于我国政府对于集成电路产业的大力支持，优质的本土半导体企业已逐步具备一定规模及实力，深度参与全球市场竞争，进一步促成全球集成电路产业中心逐渐向我国转移的趋势。

3、集成电路存储芯片行业

通俗而言，在计算设备的运算过程中，原始数据的输入、计算设备运算过程中的中间结果以及最终运行结果都会经过计算设备中的存储器并在一定期限内

保留其中，所以集成电路存储芯片作为保存信息的记忆设备是现代信息技术发展的核心部件之一。

2018 年半导体产业产品结构图



数据来源：WSTS

根据 WSTS 统计，2018 年全球半导体市场销售规模为 4,688 亿美元，其中集成电路存储芯片的销售规模最大，为 1,580 亿美元，占半导体市场 34% 的份额。可见集成电路存储芯片作为存储芯片、逻辑电路、模拟电路、微处理器四大集成电路产品之一，有着重要的产业地位。伴随着未来移动互联网、大数据等新兴产业的进一步发展，集成电路存储器芯片对于现代化信息通讯以及信息安全等领域有着至关重要的作用。

（1）全球存储芯片发展情况

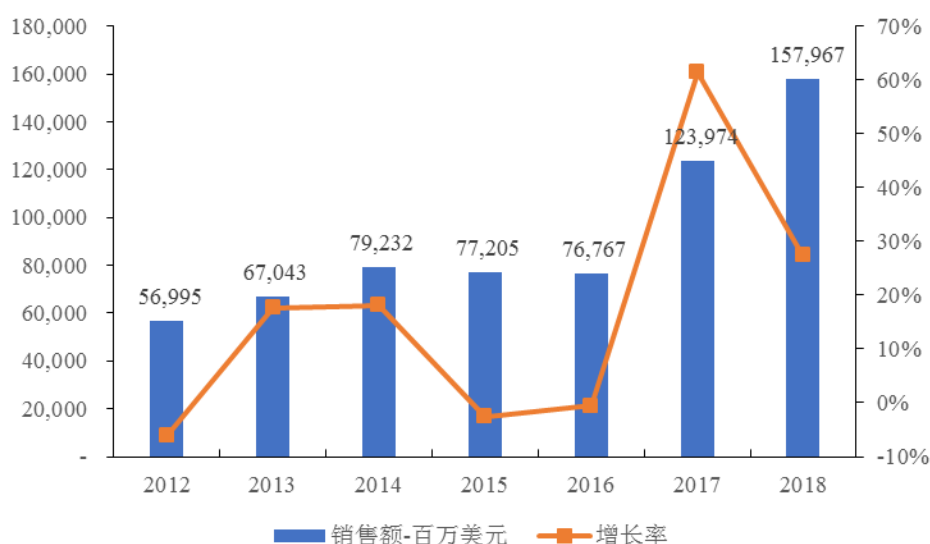
集成电路存储芯片的种类繁多，不同技术原理下催生不同的产品，具有各自的优缺点和适用领域。若按照信息保存的角度来分类，可以分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片在所在电路断电后，将无法保存数据，代表性产品有 DRAM 和 SRAM；非易失性存储芯片在所在电路断电后，仍保有数据，代表性产品为 NAND FLASH 和 NOR FLASH。

DRAM 作为具有高容量、大带宽、低功耗、短延时、低成本等特征，是主要用于个人电脑、服务器、手机等设备的最为常见的系统内存，也是半导体行业最大的单一产品类别。由于采用不同的设计结构，SRAM 比 DRAM 的读写速度

更快、功耗水平更低，但电路结构的差异也造成了相同容量的 SRAM 的成本高于 DRAM，通常情况下只会使用在 CPU 的一、二级缓存等对存储速度要求严格的领域。FLASH 具有寿命长、体积小、功耗低、非易失性等特点和优势，广泛应用于消费电子、移动通信、网络通信、个人电脑、服务器等领域，主要用于代码存储和数据存储等，是近年来发展较快的存储器芯片产品。

根据 WSTS 的数据，全球存储芯片市场销售额于 2015 年出现下滑，2016 年下半年在中国智能手机出货顺畅以及全球个人电脑出货回暖的带动下，存储芯片价格开始回升，并于 2017 年呈现爆发式回暖，全年实现销售额 1,240 亿美元，同比增长 61.69%。2018 年，存储芯片整体维持较好发展，全年实现销售额 1,580 亿美元，同比增长 27.42%。

2012-2018 年全球存储芯片行业市场规模



数据来源：Wind 资讯、WSTS

（2）我国存储芯片发展情况

我国作为全球最大的集成电路市场和消费国，在高端微芯片、大容量存储芯片、通信芯片、模拟电路等方面基本依靠进口，根据海关总署数据显示，我国进口集成电路金额在 2016-2018 年分别为 2,270.26 亿美元、2,601.16 亿美元、3,120.58 亿美元，常年保持较高的进口金额水平，存在巨大的进口替代空间。

我国在存储芯片领域的基础并非一穷二白。以 DRAM 为例，在二十世纪八十年代我国便自主研发了中国人第一块 64K DRAM，采用 2.5 微米工艺；1990

年代至 2010 年代，中国 DRAM 产业处于自主技术量产和技术引进的市场化探索阶段；2015 年，紫光收购西安华芯半导体有限公司（后更名为“西安紫光国芯半导体有限公司”）填补了国内 DRAM 设计空白；2016 年，合肥产投牵头成立合肥长鑫，主攻 DRAM 方向，在两年多的时间内，合肥长鑫在元件、光罩、设计、制造和测试领域都积累了许多技术和经验。

目前，国内主要存储芯片方队正努力推进扩张步伐。紫光集团正组建 DRAM 事业部，且其旗下的西安紫光国芯自主创新出全球首系列内嵌自检测修复 DRAM 存储器产品，开发的存储器芯片产品中有二十余款产品实现全球量产和销售。在 3D NAND 闪存领域，紫光旗下的长江存储成功研发并已小批量生产了 32 层 3D NAND 闪存芯片，其创新的 Xtacking TM 技术，实现了 3D NAND 闪存芯片结构的历史性突破。经过两年多的研发并通过和奇梦达的合作，合肥长鑫改进了工艺技术，预计于今年底可量产 8GB 的 DRAM 产品。

4、行业发展趋势

（1）行业发展趋势概况

IC Insights 预计，2016-2021 年，汽车电子及物联网将成为全球半导体下游市场增速最快的两个领域，其市场份额也仅次于手机和标准电脑。与此同时，与物联网、汽车电子等应用相关的产品，如存储芯片、微处理器（MCU）、分立器件、通信芯片、网络芯片等，都成为各大半导体设计厂商（包括 IDM 和 Fabless）重点布局的领域。

在经历了需求强劲以及 DRAM 和 NAND 平均销售价格的多年增长周期之后，2018 年底半导体行业发展行情放缓，全球芯片销售额从 2018 年第一季度的 1,162 亿美元下降至 2019 年第一季度的 1,012 亿美元。根据普华永道的预测，尽管存在 2019 年相对疲软的整体发展态势，2020 年半导体行业将实现复苏并保持繁荣，到 2022 年达到 5,750 亿美元，复合增长率有望达到 4.6%。

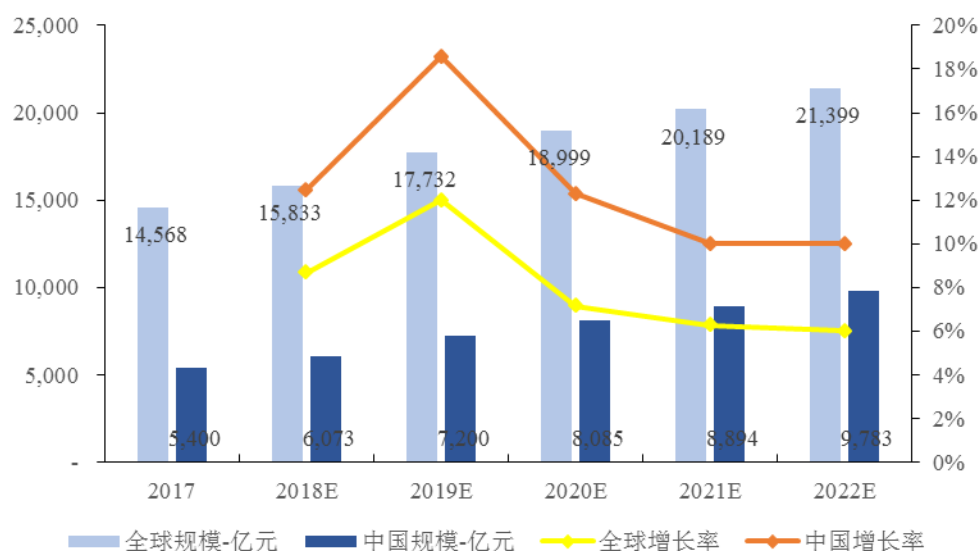
（2）行业发展的驱动力

①汽车电子的推动

作为近年来行业增速逐年增长的半导体专用领域行业之一，电子电器在汽车产业中的应用逐渐扩大，市场整体呈稳步上升趋势。根据盖世汽车的研究，受智

能驾驶升级和新能源车普及推动，至 2022 年，全球汽车电子市场规模有望达到 21,399 亿元，较 2017 年增长近 50%，而中国汽车电子市场规模将达到 9,783 亿元，较 2017 年增长 80%以上。相较于全球，中国将在汽车电子领域实现更高的复合增长水平。

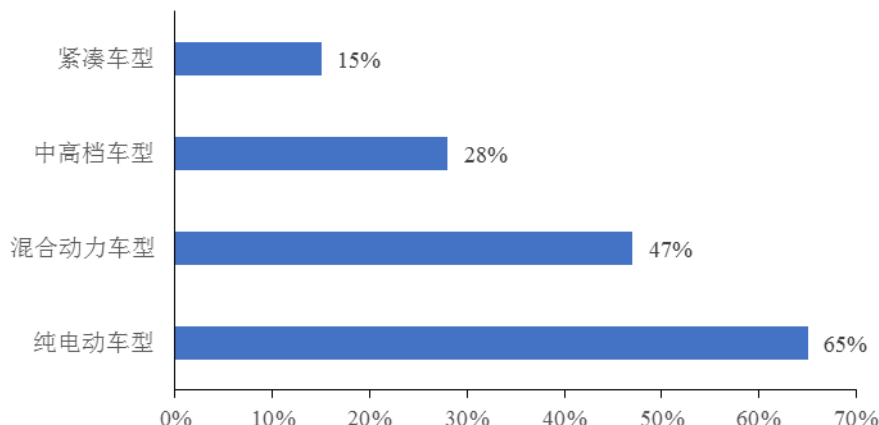
2017-2022 年全球及中国汽车电子市场规模



数据来源：盖世汽车

全球汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。随着消费者对安全性、舒适性、经济性、稳定性、娱乐性等要求的提高，汽车不断朝着互联网化、智能化和新能源化发展，汽车电子在汽车整车成本中占比越来越高。根据盖世汽车统计，2018 年纯电动汽车中汽车电子成本已占到总成本的 65%，远高于传统紧凑车型的 15%和中高端车型的 28%。

汽车电子占整车成本的比重



数据来源：盖世汽车

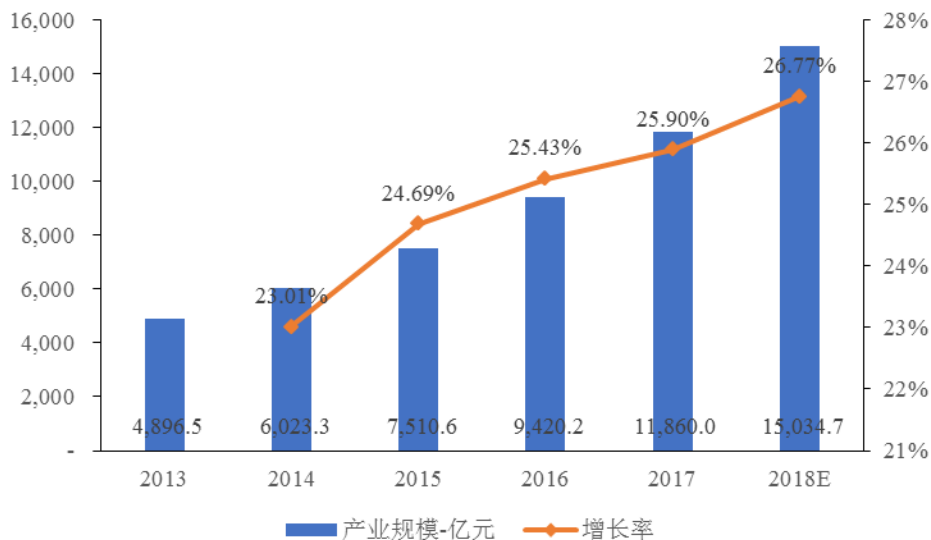
新能源汽车市场的快速发展以及传统燃油车的自动化、智能化升级都将成为全球汽车电子产业发展的重要驱动力。普华永道研究认为，伴随着电动汽车和混合动力汽车的普及率的不断提高，其半导体需求量可为传统汽车的两倍；随着汽车更加自动化，每辆汽车对半导体的需求量增加，先进驾驶辅助系统（ADAS）、光探测和测距（LiDAR）、信息娱乐系统以及安全和便利功能将促进半导体在汽车中的应用；半导体在汽车中的应用可达年均 11.9% 的增长率。

②物联网市场的推动

根据中国经济信息社发布的《2017-2018年中国物联网发展年度报告》，2017年，全球物联网市场规模为0.9万亿美元；智能家居等终端交互应用的快速兴起促进了全球消费性物联网产业的发展，但企业数字化转型及变革转型的驱动有望推动产业物联网实现更为快速的发展，预计2022年，全球物联网整体市场规模可达2.3万亿美元，年均增幅可达20%。

得益于外部动力和内生动力的不断丰富，物联网应用场景迎来更大范围的拓展，智慧政务、智慧产业、智慧家庭、个人信息化等方面产生了大量创新性应用方案。2013年我国物联网产业规模不足5,000亿元，2017年已增长至11,860亿元，预计2018年全年达15,034.7亿元，年均复合增长率超25%，高于全球水平。

2013-2018年我国物联网产业规模



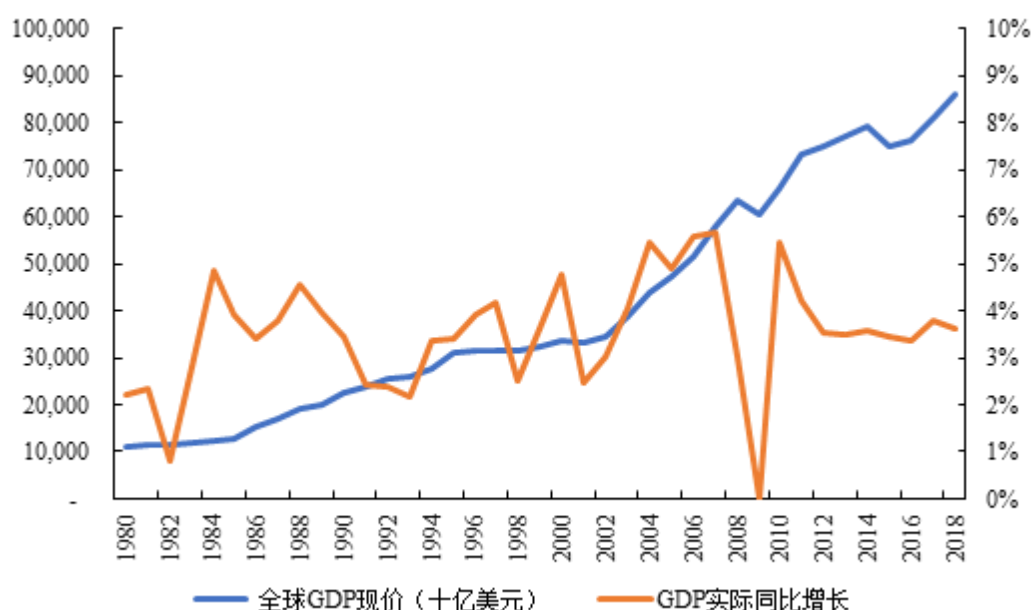
数据来源：中国经济信息社

自2008年以来，物联网被广泛关注和研究，全球物联网生态逐步形成，并深入影响了其上游芯片行业的发展。市场研究公司Gartner预测，2020年物联网技术将会被嵌入到95%的电子设备中，以支持新的产品设计。而美国的芯科实验室（Silicon Labs）预测，物联网将在2018年继续成为半导体行业增长的一个重要推动力，在2025年全球将有700亿部物联网设备被部署到各类物联网网络中。

5、国际经济环境、行业竞争格局、行业供需情况对产品价格及成本的影响

（1）国际经济温和增长，发展中国家增速较快

自2008年经济危机以来，世界经济实现相对复苏。2018年以来世界经济延续温和增长，同时动能有所放缓。一方面，在新一轮科技革命和产业变革尚未实现重大突破的情形下，主要发达经济体经济增速已经达到甚至超过其潜在增长率，当前的相对强劲增长伴随通胀率的明显上升，持续性较弱；另一方面，受保护主义抬头等因素影响，国际贸易和跨境投资作为世界经济增长的重要动能，近期表现欠佳。



数据来源：Wind 资讯、世界银行、国际货币基金组织

同时，综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至2035年，全球经济增长平均速度为2.6%左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在1.7%左右，要低于过去50多年的平均增长速度；发展中国家增速较快，年均增长速度将达到4.9%左右。以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。

（2）行业发展进入复苏，竞争格局保持稳定

全球半导体行业在过去数十年中随着科技创新的进程整体保持快速增长趋势，亦保持一定的周期性。根据美国半导体协会统计的2000年至2019年6月全球半导体月度销售额数据，2018年10月全球半导体销售额较2009年2月上涨194.23%，随之出现较大幅度的下滑，2019年4月全球半导体销售额较2018年10月下跌23.15%，2019年5月至8月有略微复苏。

2000年1月-2019年8月全球集成电路月度销售额

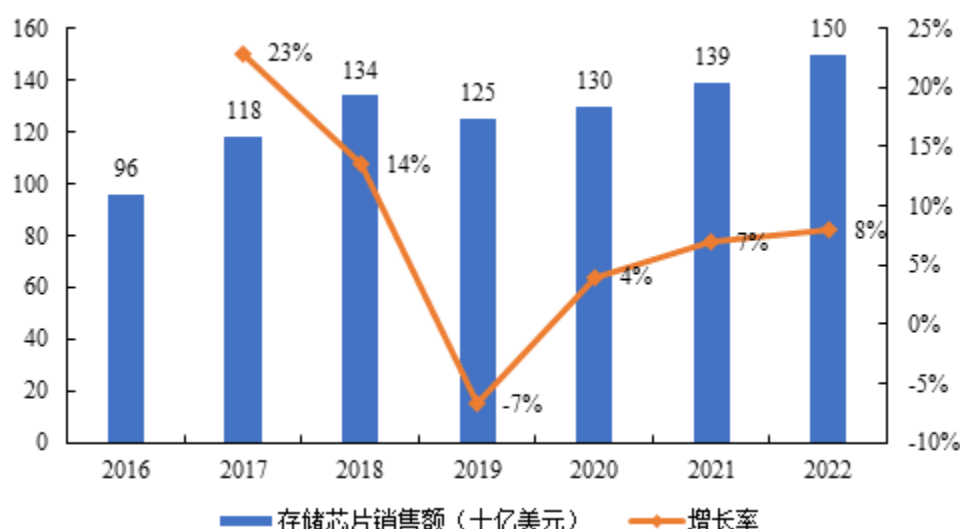


数据来源：Wind 资讯、美国半导体协会

根据当前市场机构对半导体行业的判断，2018-2019 年半导体行业已进入下行期，主要系中美贸易争端以及半导体下游行业（主要包括智能手机、服务器和 PC 等）需求增速放缓等多方面因素导致。与此同时，市场机构普遍认为半导体行业在 2019 年相对疲软后有望在 2020 年实现复苏并保持繁荣，普华永道研究预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%。

存储芯片方面，2019 年存储芯片市场有所下滑，预计 2020 年开始进入复苏阶段。该领域的增长将由持续的技术进步推动，同时 DRAM 和 NAND 闪存芯片的平均销售价格提高也将推动收入增长。在半导体的应用市场中，预计汽车市场增长最快，年均复合增长率将达到 11.9%；工业是仅次于汽车的增长市场，预计到 2022 年复合年均增长率将达到 10.8%。

2016-2022 年存储芯片销售额及增长率



数据来源：普华永道研究

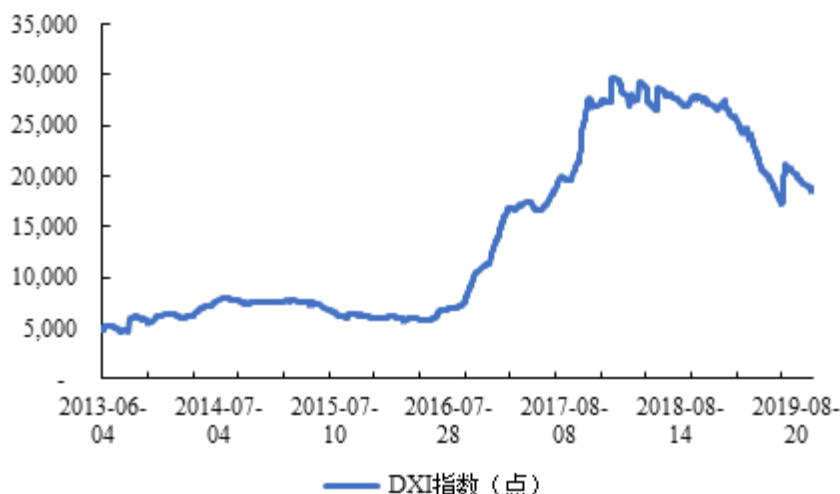
竞争格局方面，存储芯片行业在过去五十多年的发展中经过了严峻的商业竞争和淘汰，已经形成了寡头垄断的局面，国外巨头三星电子、SK 海力士和美光科技在 DRAM 市场占比超过 90%，在 NAND 闪存市场占比超过 60%。

具体到车用易失性芯片等专用领域，由于对产品有着高品质、稳定性、小批量、多样性的要求，产品技术革新速度较为缓和，同时行业集中度较低。车用易失性芯片领域美光科技近年来均位居行业第一名，市场份额超过 40%，北京矽成位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚科技、三星电子、SK 海力士、赛普拉斯等位居其后。

（3）行业供需周期变化，未来增长因素可期

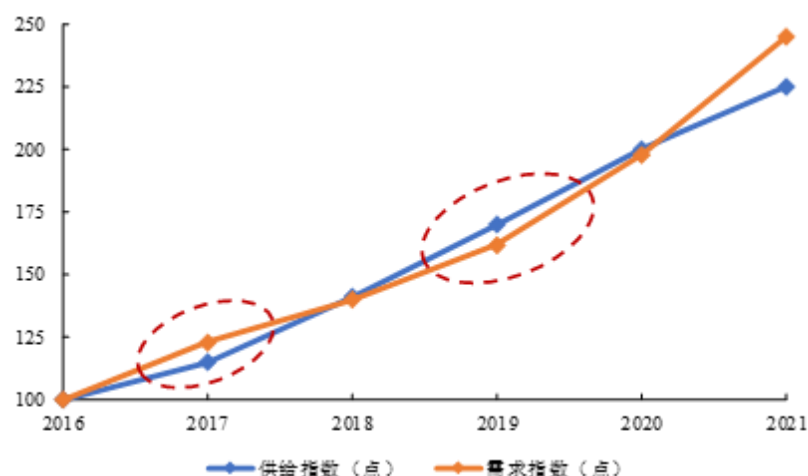
北京矽成所在集成电路设计行业上游为晶圆代工及封测行业，下游为通讯、消费、车用等集成电路应用行业，供需情况呈现周期性变化趋势。根据集邦咨询半导体研究中心（DRAM exchange）的调研报告，DRAM 内存芯片价格在 2018 年第三季度以来持续下跌，并在 2019 年第一季度跌幅从原先预估的 25% 调整至接近 30%，近期在 2019 年第三季度以来出现复苏趋势。

2013 年-2019 年 9 月全球 DXI 价格指数（DRAM 价格指数）



数据来源：Wind 资讯、DRAM exchange

从供给端考虑，以DRAM为主的存储芯片供给增速处于整体放缓的趋势。DRAM位元供给的增长来源以工艺进步带来的密度提升为主，以产能扩张带来的投片量提升为辅。但是近年来DRAM制程提升开始遇到瓶颈，主流厂商出于成本和研发难度的考虑，开发应用比较谨慎，制程推进放缓和存储密度增速降低直接导致DRAM综合位元供给增速下降。2013-2018年上半年供给端处于产能的平台期，DRAM价格先抑后扬，主要是在消化前期制程提升带来的丰富供给。2018年下半年开始，由于三星电子、SK海力士等资本性支出增加，快速填补需求缺口，景气行情终结，预计2019-2020年即将成为投片量、制程水平的双重平台期，后续2019年将消化库存、2020年前后DRAM位元供求会重新达到平衡。



数据来源：智研咨询

从需求端考虑，在经历前期以智能手机为主带动的快速发展后，存储芯片的

需求结构正快速向着多样化转变，人工智能、物联网、大数据、5G等将成为后续的核心增长动力。过去二十年中，前十年PC端带动了行业的大幅增长，后十年进入智能手机时代，消费电子市场规模迅速扩大，成为半导体行业增长的主要动力。自2018年下半年以来，受智能手机增长放缓、数字货币下行及汽车销量下降等影响，需求处于疲软状态，存储芯片的价格及销量持续下跌。其中，消费电子市场受影响最大，汽车市场由于单车半导体需求量不断增加、工业市场由于安全、自动化的需求上升而受市场影响程度较小。2020年后5G、AI以及云服务、大数据、物联网的普及和应用将成为拉动半导体需求的重要力量，同时下一代DRAM制程也将开始普及，下行周期总体可控，规模总体向上。

受上述经济环境、行业及供需影响，成本方面，北京矽成报告期内晶圆代工采购等成本有所上升，后续北京矽成将根据综合成本调整供应商区域以应对市场政策风险；产品价格方面，由于汽车、工业等专用领域受市场影响程度较小，北京矽成报告期内部分产品价格随市场行情有所调减，后续公司将把握物联网、5G等机遇积极开发更高附加值的产品，预计产品整体价格将逐渐企稳回升。

（二）行业进入壁垒

1、技术壁垒

集成电路行业属于技术密集型行业，集成电路的制程进步遵循摩尔定律，即每一至两年伴随集成电路的工艺进步，集成电路产品在计算能力上将得到一倍的提升，在制造生产上将获得减半的成本。对于集成电路设计企业而言，需要紧跟工艺的进步以及生产技术的发展，以保持自身在行业进步中在市场上的竞争优势。随着集成电技术的迭代发展，电路结构越来越复杂，加工步骤也越来越繁多，集成电路设计行业中的部分企业逐渐创新出自身的差异化产品，形成自主核心技术，构筑起同行难以仿效的技术壁垒。

2、资金和规模壁垒

集成电路行业一直以来都是资金密集型行业，无论是在产品的设计研发或是制造生产环节，大量的研发投入或是制造生产线的投入对于资金的规模都有很高的要求。在集成电路设计行业，设计厂商在制程的研发、规格的升级上需紧跟快速变化的市场要求，从而实现芯片产品的更新换代，因此需持续进行研发投入，

若研发投入不足而放缓研发进展，则很可能使设计厂商失去技术和成本的优势。集成电路制造厂商持续采购先进设备以及对生产线的技术升级所需要的巨额资金往往比设计厂商的研发投入规模要求更高，以此才能保持制造厂商在生产规模及成本上的优势。因此，若无足够的资金实力以维持高额的研发支出，且若未经过长时间的发展实现规模效应，新进入者将无法持续生存。

3、人才壁垒

集成电路行业属于知识密集型行业，领先的技术创新人才和经验丰富的管理人才对于企业未来的发展和市场竞争力的提高具有重要的推动作用。集成电路设计行业在所有集成电路子行业中，对于人才的要求和依赖程度最高，作为以 Fabless 模式经营的轻资产行业，人员稳定、高效而富有经验的团队是企业的核心竞争力之一。我国大陆集成电路领域的高端技术人才相较于美国、韩国和台湾地区而言相对稀缺，优秀的管理人才和技术人才多集中于行业龙头企业。因此，对于市场的新进入者，人才的引进和激励管理是非常重要的战略工作。

4、客户壁垒

芯片作为整个电子器件的核心，其可靠性和稳定性对电子产品而言意义重大。因此，下游客户在选择上游芯片供应商时极为谨慎，对新产品的导入控制非常严格，通常会对市场上符合要求、口碑较好的多款芯片产品进行可靠性、稳定性、兼容性等验证，从中挑选出最合适的芯片方案。因导入周期较长，下游客户一旦选定芯片方案，通常不会轻易再进行更换。一旦某一款芯片或者某几款芯片获得了客户认可，形成了良好的市场口碑，将对市场新进入者形成壁垒。

（三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策大力扶持

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一，我国政府也已通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，国家已陆续颁布了一系列法律法规及政策，从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业的发展。2015 年国务院颁布的《中国制造 2025》

中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点扶持的领域，而存储芯片产品作为目前进口消费比重最高的领域无疑将获得更大的产业政策支持。

（2）我国集成电路产业链日趋成熟

近年来，全球集成电路产业的制造重心、消费市场及人才在中国快速积聚，产业重心转移趋势明显，产业链日趋成熟。

在制造环节，台积电、通富微电、日月光等全球主要晶圆制造企业、封装测试企业纷纷在中国大陆建立和扩充生产线，国内原有的晶圆代工制造企业的工艺水平也得到显著提升，为采用 Fabless 模式的国内集成电路设计企业提供了产能上的保障。

在消费市场方面，中国人口基数大、电子产品接受程度高、消费需求旺盛。随着国民经济和收入水平的快速增长，中国已成为全球最重要的电子产品消费市场。国内芯片设计企业凭借相似的文化背景，可以与下游厂商乃至终端客户保持顺畅沟通，提供更稳定的供应和更好的服务，充分发挥贴近本土市场的地缘优势。在此背景下，国内集成电路设计、制造、封测等方面的技术取得了明显的进步，原来由国外企业垄断的核心芯片设计技术也逐步被部分国内优秀企业攻克、掌握并成功产业化。

（3）市场需求的有利推动

集成电路行业的下游应用领域十分广泛，包括汽车电子、工业控制、消费电子、网络设备、移动通信等，下游广阔的应用领域稳定支撑着集成电路行业的持续发展。随着终端市场的便携化、智能化、网络化的发展趋势日趋明显，智能手机、平板电脑等下游市场需求旺盛，产品更新换代速度快，相关应用领域的繁荣使得上游的集成电路行业稳步上升。此外，随着物联网、人工智能、云计算、智能汽车、智能家居、可穿戴设备等为代表的新兴产业快速发展，催生大量芯片产品需求，成为继计算机、网络通信、消费电子之后推动集成电路产业发展的新动力，为集成电路设计企业带来新的发展机遇。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业竞争激烈，国内集成电路存储设计领域基础薄弱

集成电路行业在我国竞争非常激烈，其市场主要由技术领先、资本雄厚、经营灵活的国际企业占据。尽管国内企业在集成电路设计领域取得了一定进步，但技术水平与产业规模都与国际企业有一定差距，基础仍较为薄弱。

（2）设计人才匮乏，研发投入巨大

集成电路的发展遵循摩尔定律，因此持续的研发投入是保证企业竞争性的前提和基础。同时，高性能、高可靠性的集成电路产品设计也需要大量高端人才，目前国内从事集成电路设计的人才无论是从数量或者经验的角度与国际高端技术人才对比，都还有一定的差距。

（四）区域性、周期性和季节性特征

1、区域性

集成电路行业具有明显的区域性特征，全球主要集成电路厂商分布于欧洲、美洲、日韩、台湾等地区。国外的集成电路产业已经形成较为成熟的体系并且稳定运行了多年，技术上存在明显的竞争优势，而国内处于发展初期，以长三角、珠三角、京津环渤海等部分地区为主并形成了一定的产业集群。

销售区域方面，目前欧洲、美洲及日韩等发达国家仍然是集成电路的主要销售区域，但产业链已开始向以亚洲为代表的新兴市场，特别是中国市场进行转移，其未来将成为重要的主流市场之一。

2、周期性

受国际芯片发展准则摩尔定律的制约，集成电路产业的发展会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整，因此集成电路产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期性波动的特点。集成电路产业的发展趋势和宏观经济运行周期存在一定相似性，即宏观经济发展较好时，终端客户对产品的需求增加，而宏观经济放缓时，终端客户需求的减弱也会减少对集成电路产品的需求。

3、季节性

集成电路产业没有明显的季节性特征。但是，对于消费类电子产品芯片而言，

由于节假日产品销量较多，因此在节前的芯片出货量一般较高。

（五）行业经营模式

根据集成电路设计企业是否具有晶圆生产线，集成电路设计企业经营模式主要可分为 IDM 模式和 Fabless 模式。

1、IDM

IDM 模式即垂直整合制造模式，是指企业业务范围涵盖集成电路的设计、制造、封装和测试等所有环节。这种模式对企业的研发力量、资金实力和市场影响力都有较高的要求，企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装和测试厂，部分企业甚至延伸至下游电子设备制造行业。面对晶圆生产、封装和测试的生产线建设，企业均需要投入巨额资金。IDM 模式的优点是企业具有对内部资源整合的优势、以及垂直生产线的技术优势。采用 IDM 模式的代表性企业包括英特尔、三星、美光、海力士、东芝半导体、意法半导体等大型跨国企业。

2、Fabless

Fabless 模式即无晶圆生产线集成电路设计模式，是指集成电路企业只从事集成电路设计业务，晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装企业和测试企业代工完成。Fabless 模式源于集成电路产业的专业化分工，相比 IDM 模式，Fabless 模式的资金、规模门槛更低，企业能够在资金和规模有限的情况下，集中资源进行集成电路的设计和研发，充分发挥企业的研发能力，因此具有轻资产、强专业的特点，对企业的快速发展起到了至关重要的作用。目前，全球大多数集成电路企业均采用 Fabless 模式，代表性企业包括高通、博通、英伟达、迈威科技、展讯、海思等。

（六）所处行业与上、下游行业之间的关系

北京矽成作为集成电路设计企业，处于集成电路产业链中的核心环节。在 Fabless 模式下，集成电路设计企业的产品方案通过代工方式委托给晶圆制造企业、封装和测试企业进行产品的制造和生产，上游企业包括了晶圆制造企业、封装企业以及测试企业。下游企业主要包括各种电子产品制造企业、集成电路产品

经销商等。

1、上游行业对本行业的影响

晶圆制造、封装和测试作为集成电路设计行业的上游行业，对本行业的影响体现在三个方面：一是产品良率，受到代工企业的晶圆制造和芯片封装的工艺水平、存储芯片测试技术能力的影响，芯片的最终产品良率高低会直接影响到芯片的单位成本；二是产品成本，集成电路存储芯片主要原材料晶圆价格的变化，以及封装和测试费用的高低，直接影响集成电路存储芯片设计企业产品的成本高低和结构；三是交货周期，代工企业的整体产能以及产能利用率将直接决定集成电路存储芯片设计企业产品的出货数量，进而导致代工企业在交货周期上产生差异。

因此，建立和代工企业之间紧密而良好的合作关系对于集成电路存储芯片设计企业而言尤为重要，谨慎选择代工企业、对产品制造工艺和技术问题等保持和代工厂有效的沟通、完善企业采购管理制度等措施，能有效降低上游行业对集成电路存储芯片设计企业的负面影响，同时强化企业自身竞争实力。

2、下游行业对本行业的影响

集成电路设计行业的下游主要是涵盖了汽车、工业制造、通讯设备、消费电子等应用领域。下游行业企业面临的产品性能提升、成本优化、技术升级等需求通过市场传递到集成电路设计行业。由于专用领域市场存在的高壁垒特征，使行业新进入设计公司很难在短期内提高市场份额，而具有多年行业经验的设计厂商则能更快速的对接下游企业的设计需求。以汽车电子市场为例，受驾驶自动化和汽车电子化趋势的影响，近年来汽车存储芯片逐步转型升级为拥有具有更高集成度、更低功耗表现、并能更深入地与其他产品兼容的特性，这也为具有多年芯片设计经验的企业提供了更好的前景。集成电路设计企业需依靠对市场变化的敏锐洞察能力以及下游企业持续对产品进行升级和设计要求提高的需求，保持在行业中的竞争力，以减小下游行业变化带来的负面影响。

（七）行业主要企业及竞争格局

1、行业主要企业

（1）赛普拉斯（Cypress）

赛普拉斯是全球领先的集成电路芯片供应商，纳斯达克上市公司（股票代码：CY.O），总部位于美国加利福尼亚州。该公司的产品主要包括 NAND FLASH、SRAM、F-RAMs 等，其产品主要对应的市场为消费电子、通讯、工业和汽车。

（2）三星电子（Samsung Electronics）

三星电子是韩国最大的电子工业公司，韩国交易所上市公司（股票代码：005930.KS）。三星电子的业务主要涵盖三大部分，即器件解决方案（主要以半导体和显示部件的制造为主，包括 DRAM、FLASH，薄膜晶体管-液晶显示器等）、消费电子（主要包括彩色电视、显示器、打印机、空调、冰箱、洗衣机等）和信息技术与移动通信（主要包括计算机、手持电话、网络系统等）。

（3）SK 海力士（SK Hynix）

SK 海力士是全球第二大 DRAM 生产商，韩国交易所上市公司（股票代码：000660.KS）。公司专业从事 DRAM、NAND FLASH 和 CIS 系统等产品的研发、生产和销售，主要产品对应的领域为消费电子、工业和汽车市场。

（4）美光科技（Micron Technology, Inc.）

美光科技是全球最大的内存存储生产商之一，纳斯达克上市公司（股票代码：MU.O），总部位于美国爱达荷州波夕市。其主要产品包括并行大容量 NOR FLASH、DRAM、NAND FLASH、固态存储、相变内存，以及其它半导体元件和内存模组。

2、北京矽成易失性存储芯片产品的市场份额

（1）根据第三方机构 IHS 的统计，最近三年 ISSI 的 DRAM 产品在全球易失性存储芯片 DRAM 市场中的份额占比情况如下表所示：

时间	排名	公司名称	市场份额
2018 年度	1	三星电子	42.75%
	2	SK 海力士	29.58%
	3	美光科技	23.15%
	4	南亚科技	2.82%
	5	华邦电子	0.72%
	6	晶豪科技	0.36%

时间	排名	公司名称	市场份额
	7	ISSI	0.26%
	8	其他	0.37%
	合计		100.00%
2017 年度	1	三星电子	44.55%
	2	SK 海力士	27.70%
	3	美光科技	22.58%
	4	南亚科技	2.43%
	5	华邦电子	0.89%
	6	力晶科技	0.62%
	7	晶豪科技	0.42%
	8	ISSI	0.33%
	9	其他	0.48%
	合计		100.00%
2016 年度	1	三星电子	47.09%
	2	SK 海力士	25.81%
	3	美光科技	19.65%
	4	南亚科技	3.08%
	5	华邦电子	1.58%
	6	力晶科技	0.86%
	7	晶豪科技	0.61%
	8	ISSI	0.52%
	9	其他	0.80%
	合计		100.00%

全球 DRAM 市场中，三星电子、SK 海力士、美光科技等行业前三名占据了超过 90% 市场份额，最近三年市场占有率逐年上升。2016 年、2017 年，北京矽成下属经营实体 ISSI 的 DRAM 产品在全球市场均排名第八，2018 年排名第七，市场份额占比分别为 0.52%、0.33%、0.26%。

（2）根据第三方机构 IHS 的统计，最近三年 ISSI 的 SRAM 产品在全球易失性存储芯片 SRAM 市场中的份额占比情况如下表所示：

时间	排名	公司名称	市场份额
2018 年度	1	赛普拉斯	30.36%

	2	ISSI	19.42%
	3	其他	50.22%
	合计		100.00%
2017 年度	1	赛普拉斯	31.88%
	2	ISSI	19.95%
	3	其他	48.17%
	合计		100.00%
2016 年度	1	赛普拉斯	37.44%
	2	ISSI	18.04%
	3	其他	44.52%
	合计		100.00%

全球 SRAM 产品市场中，ISSI 拥有的市场份额仅次于赛普拉斯。2016 年、2017 年和 2018 年，北京矽成下属经营实体 ISSI 的 SRAM 产品在全球市场均排名第二，市场份额占比分别为 18.04%、19.95%和 19.42%，整体较为稳定。

3、易失性存储芯片市场竞争格局

（1）DRAM 市场竞争对手分析

DRAM 市场具有典型的集成电路存储芯片的行业特征，高垄断性和高集中度导致全球 DRAM 市场 90%以上的份额常年由行业排名前三的三星电子、SK 海力士、美光科技包揽。作为 DRAM 行业龙头公司的三家公司均采用 IDM 经营模式，涵盖了存储芯片设计、晶圆制造、测试等重要生产工艺环节。IDM 经营模式尽可能降低了存储芯片产品的单位生产成本，而标准型 DRAM 存储芯片作为适用范围广阔、标准化程度高的产品，在 IDM 经营模式下能高效的向集成电路存储芯片企业提供可观的利润，同时也成为了 IDM 类型企业赖以生存的重要产品。

相比行业中的龙头企业，北京矽成不具备晶圆制造、测试、封装的生产工序，相关环节需外包给其他厂商。但作为轻资产的纯芯片设计企业，北京矽成更能发挥自身研发特长，优化芯片设计服务体验，并专注于深耕工业、汽车等专用领域，但无需对生产设备、制造流水线、先进制程生产工艺研发等进行巨额资本投入并承担相关风险。由于专用领域 DRAM 存储芯片产品不具生产标准化特点，且具有较低的生产成本敏感性，三大行业龙头企业对专用领域市场介入不多，这恰好

为具备丰富行业经验的北京矽成提供了合适的发展空间。

（2）SRAM 市场竞争对手分析

由于 SRAM 在设计逻辑和工作原理方面与 DRAM 产品存在的本质不同，在同等规格和容量下，SRAM 产品在制程工艺、性能表现、产品成本等方面较 DRAM 产品有着更严格的标准、更高效的表现和更高的生产成本，这也导致 SRAM 产品在目前易失性存储芯片领域的使用范围较 DRAM 产品小，通常被作为处理器的二级高速缓存使用。

赛普拉斯作为行业老牌厂商，提供包括 NAND FLASH、SRAM 等存储芯片以及芯片解决方案服务，在 SRAM 领域具有多年丰富的经营历史和行业经验，在高端产品设计领域具有领先优势，产品覆盖了包括消费电子、通讯、工业和汽车等领域，业务规模相对较大。北京矽成则凭借多年在专用领域的深耕，同客户之间形成了紧密的合作模式，从早期介入客户的初步方案设计直至后期根据客户要求对试生产产品性能进行循环测试，标的公司向专用领域客户提供的更专注的芯片设计服务近年来正逐步获得更多客户信任。凭借优质的芯片设计服务，近年来北京矽成在全球 SRAM 市场的占有率获得逐年提升，在行业内的竞争实力也随之得到有效增强。

（八）标的公司核心竞争力及行业地位

1、行业地位

北京矽成是专注于面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，主营集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，目前主要客户来自于专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯、消费电子等行业。凭借行业领先的研发技术，北京矽成的产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。

凭借丰富的利基型芯片研发实力和国际客户中良好的合作关系，北京矽成在全球纯半导体设计领域具有领先的行业地位。最近三年，北京矽成的 SRAM、DRAM 产品收入分别位居全球前二位、前八位，位居市场前列。

2、核心竞争力

（1）研发优势

北京矽成作为存储行业领先的设计公司，在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念，在产品的工艺上一直保持行业前沿。截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成共有研发人员 223 人，其中核心技术人员在易失性存储领域或非易失性存储领域均有多年丰富的工作经验，经历了数次行业研发技术的革新以及多轮产品的迭代，其平均从业年限超过 20 年。在经验丰富的核心技术团队带领下，目前带有 ECC 功能的 SRAM 和带有 ECC 功能的 FLASH 均进入量产阶段，带有 ECC 功能的 DRAM 已进入产品送样阶段。经过长期的技术积累，北京矽成代表行业领先技术水平的专用领域存储芯片的研发成果将逐渐在未来显现，同时基于先进制程的研发能力会进一步稳固公司在芯片设计领域的行业地位。

（2）产品优势

北京矽成的集成电路芯片产品主要定位于汽车电子、工业及通讯等专用型产品领域，相较于大部分半导体存储芯片所在的通用型领域，具有较高的毛利率以及较为稳定的市场需求。标的公司拥有丰富的行业经验，紧跟市场的动向，针对车用级客户及工业级客户的高传输速度、高容量存储芯片保持良好的出货量。北京矽成产品性能的稳定表现和在极端环境下的可靠性优势越来越多地应用于整机客户及汽车客户的产品中。

同时，伴随近两年存储行业龙头三星电子、美光科技等逐渐在传统产品产能上的削减，北京矽成凭借多年研发的积累和客户资源在传统产品中更具有市场竞争力，成功扩展 SDR、DDR、mDDR 等产品的市场销量，逐步提高利基型产品的销售规模，进一步增强产品竞争力。

（3）供应链优势

北京矽成多年来专注于设计领域的经营历史构筑了其在行业内同供应商之间可靠而稳定的合作关系。目前其长期合作的供应商伙伴包括了力晶科技、南亚科技、中芯国际等，均为在集成电路存储领域具有高品质、高良率、产能充足的晶圆代工厂。在封装和测试环节，北京矽成和南茂科技、矽格等厂商有着深厚的合作关系，在产能安排、测试品质、物流安排方面得到封装、测试厂的有力支持，

满足专用领域客户及时高效、保质保量的需求。此外，北京矽成与中国大陆的供应链厂商正逐渐加强合作关系，进一步构建高效、稳定和低成本的区域供应链网络。

（4）客户优势

北京矽成在专用领域市场拥有多元化的客户结构，直销模式和经销商模式下带来的终端客户和代理商客户使其规避了对单一大客户的依赖风险。报告期内，北京矽成具有合作关系的终端客户覆盖了大陆集团、奥托立夫、西门子、松下、博世等全球知名企业，客户结构具有较高稳定性。同时受益于来自各专用领域的全球知名客户均具有较好的现金流，使北京矽成的坏账率处于较低水平。

由于北京矽成的终端客户主要源自汽车、工业、通讯等专用领域，在向其提供芯片产品时，经常需要和客户直接或联合经销商一起根据客户要求对芯片产品做细节上的个性化设计。凭借该种合作模式，北京矽成不仅和客户之间形成了极强的粘性和信任，同时来自于全球知名的专用领域客户对芯片产品的要求，一定程度上也成为专用领域存储芯片未来发展趋势，为其产品在行业内树立了标杆的形象。

（5）团队优势

北京矽成下属经营实体的管理层及核心技术人员在集成电路的研发设计领域拥有多年的行业经验，对于存储芯片和模拟芯片的技术应用和技术发展的探索有着较为敏锐的判断。核心管理团队结构稳定，能够确保决策和执行层面的沟通交流较为顺畅、工作效率较为高效，使得北京矽成多年来能够持续发展。

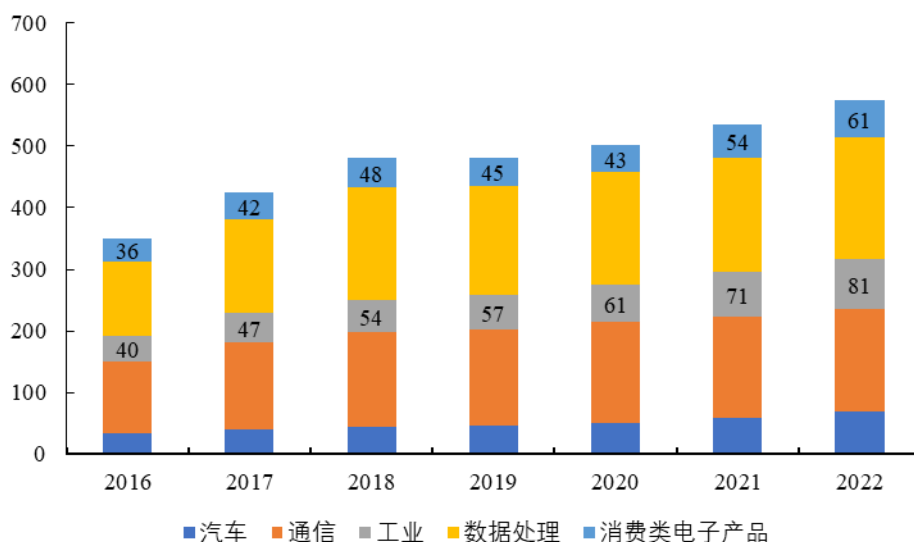
3、基于所处行业以及工业用及车用 DRAM 行业竞争状况、产品市场容量、同行业公司的发展水平等，北京矽成具有核心竞争力和持续盈利能力

（1）工业用半导体、车用半导体及 DRAM 行业发展状况

根据普华永道研究，在半导体的应用市场中汽车和工业增长速度较快。其中，预计汽车市场增长最快，年均复合增长率将达到 11.9%，主要原因为：伴随着电动汽车和混合动力汽车的普及率的不断提高，其半导体需求量可为传统汽车的两倍；随着汽车更加自动化，每辆汽车对半导体的需求量增加，先进驾驶辅助系统（ADAS）、光探测和测距（LiDAR）、信息娱乐系统以及安全和便利功能将促进

半导体在汽车中的应用。工业是仅次于汽车的增长市场，预计到 2022 年复合年均增长率将达到 10.8%，其中最大份额将来自于对安全、自动化、固态照明和运输的需求。

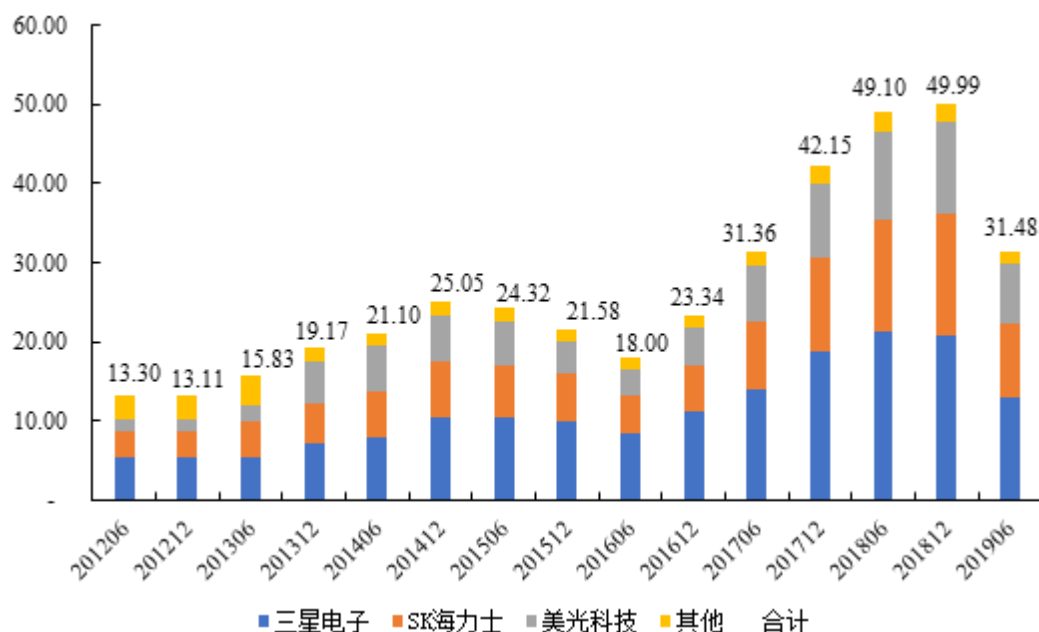
2016-2022 年半导体应用市场销售额（单位：十亿美元）



数据来源：普华永道研究

半导体产业按照元件划分，内存芯片元件的市场份额近年来保持首位。其中，根据 IHS 统计，DRAM 市场在 2012-2018 年呈波动增长趋势，2019 年上半年跌势较为明显，较 2018 年下半年下降 37%。同时，DRAM 市场前三大巨头公司三星电子、SK 海力士及美光科技近年来市场份额跃居 90%，集中度较高。具体到车用存储芯片等专用领域，由于对产品有着高品质、稳定性、小批量、多样性的要求，产品技术革新速度较为缓和，同时行业集中度相对较低。车用易失性存储芯片领域美光科技近年来均位居行业第一名，市场份额超过 40%，北京矽成位居行业第二名，市场份额约为 15%，南亚科技、三星电子、SK 海力士、赛普拉斯等位居其后。

2012-2019 年上半年 DRAM 市场销售额（单位：十亿美元）



数据来源：IHS

（2）北京矽成的核心竞争力与持续盈利能力

DRAM 市场具有典型集成电路存储芯片行业的高垄断性和高集中度特征，全球 DRAM 市场 90%以上的份额常年由行业排名前三的三星电子、SK 海力士、美光科技包揽。作为 DRAM 行业龙头公司的三家公司均采用 IDM 经营模式，涵盖了存储芯片设计、晶圆制造、测试等重要生产工艺环节。

相比行业中的龙头企业，北京矽成不具备晶圆制造、测试、封装的生产工序，相关环节需外包给其他厂商。作为轻资产的纯芯片设计企业，北京矽成集中自身技术及资本实力专注于产品研发和芯片设计环节，更能发挥自身研发特长、优化客户技术支持服务体验，并深耕于存储芯片在汽车行业、工业级医疗行业细分领域中的客户需求，无需对生产设备、制造流水线、先进制程生产工艺研发等进行巨额资本投入并承担相关风险。由于专用领域 DRAM 存储芯片产品的品种较多、稳定性要求较高，需要长期供货，三大行业龙头企业对专用领域市场投入有限。随着龙头 IDM 厂商逐渐增大其在更先进的通用型存储芯片制程工艺的投入，其在传统产品和工业级产品的产能上逐渐削减，并逐步放弃了一些小规模的市场。以上均为具备丰富行业经验的北京矽成提供了较大的发展空间。北京矽成凭借多年的研发积累，其芯片产品性能在极端环境下的可靠性和稳定性均处于行业领先水平，其产品在整机客户及汽车客户的产品中具有较强的市场竞争力，针对车用

级客户及工业级客户的高传输速度、高容量存储芯片可以保持良好的出货量，持续满足专用领域市场少量多样化的产品需求，并保持高品质、全周期的服务跟进。

北京矽成自成立以来，一直专注集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，主要客户均来自于专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯、消费电子等行业。凭借行业领先的研发技术，北京矽成的产品在汽车动力和控制系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。后续北京矽成将保持上述优势，持续开发新产品并保持高品质、全周期的服务跟进，从而稳定发展、持续盈利。

4、北京矽成与同行业可比公司相比在市场前景、研发能力、生产工艺、销售渠道、客户关系等方面的核心竞争力及可持续性

凭借强大的研发实力、丰富的产品线条、稳定的产品品质、完善的客户服务以及全球客户、供应商良好的合作关系，北京矽成在全球半导体设计领域具有领先的行业地位。最近三年，北京矽成的 SRAM、DRAM 产品收入分别位居全球前二位、前八位，同行业可比公司包括美光科技、赛普拉斯、华邦电子等。相比与同行业竞争对手，北京矽成的核心竞争力及可持续性主要表现在：

（1）专注专用市场，发展前景广阔

全球半导体行业在过去数十年中随着科技创新的进程整体保持快速增长趋势，亦保持一定的周期性。根据当前市场机构对半导体行业的判断，2018-2019 年半导体行业已进入下行期，后续有望在 2020 年实现复苏并保持繁荣，普华永道研究预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%。在半导体的应用市场中，普华永道研究预计汽车市场增长最快，年均复合增长率将达到 11.9%；工业是仅次于汽车的增长市场，预计年均复合增长率将达到 10.8%。

北京矽成的集成电路芯片产品主要定位于汽车电子、工业及通讯等专用型产品领域，相较于大部分半导体存储芯片所在的通用型领域，具有较高的毛利率以及较为稳定的市场需求，发展前景较为广阔。北京矽成拥有丰富的行业经验，紧跟市场的动向，针对车用级客户及工业级客户的高传输速度、高容量存储芯片保

持良好的出货量,其产品性能的稳定表现和在极端环境下的可靠性优势越来越多地应用于整机客户及汽车客户的产品中。

同时,伴随近两年存储行业龙头三星电子、SK 海力士等逐渐在传统产品产能上的削减,北京矽成凭借多年研发积累和客户资源在传统产品中更具有市场竞争力,成功扩展 SDR、DDR、Mobile DDR 等产品的市场销量,逐步提高利基型产品的销售规模,进一步扩大市场份额、增强整体竞争力。

（2）技术优势突出，研发实力领先

在集成电路设计领域,车规级及工业级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费电子更为严格。在温度适应能力方面,消费级一般为 0~70 摄氏度、工业级一般为 -40~85 摄氏度、车规级一般为 -40~125 摄氏度);使用寿命方面,消费级一般为 1-3 年,工业级及车规级则可能达到 7-15 年或以上;车规级及工业级芯片对振动、冲击、EMC 电磁兼容性能等也有着更高要求。鉴于上述原因,汽车、工业等专用领域对相关行业的芯片设计能力提出较高要求,技术门槛与效仿难度较高。

自成立以来,北京矽成下属经营实体的管理层及核心技术人员深耕集成电路的研发设计领域,对于存储芯片和模拟芯片的技术发展及应用的探索有着较为敏锐的判断。截至 2019 年 5 月 31 日,北京矽成已在美国、欧洲、日本、台湾及中国大陆等地区注册 240 项专利技术,并拥有 90 项集成电路布图设计。凭借行业领先的技术水平,北京矽成的产品在汽车动力和控制系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力,同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额,受到专业领域客户的广泛认可。

北京矽成作为存储行业领先的设计公司,在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念,在产品的工艺上一直保持行业前沿。截至 2018 年 12 月 31 日,北京矽成共有研发人员 223 人,其中核心技术人员在易失性存储领域或非易失性存储领域均有多年丰富的工作经验,经历了数次行业研发技术的革新以及多轮产品的迭代,其平均从业年限超过 20 年。在经验丰富的核心技术团队带领下,北京矽成不断推出行业领先的专业级芯片产品,如带有 ECC 功能的 SRAM 和带有 ECC 功能的 FLASH 目前已进入量产阶段,带有 ECC 功能的

DRAM 已进入产品送样阶段。经过长期的技术积累，北京矽成代表行业领先技术水平的专用领域存储芯片的研发成果将逐渐在未来显现，同时基于先进制程的研发能力会进一步稳固公司在芯片设计领域的行业地位。

（3）设计线条丰富，产品品质稳定

北京矽成的主要产品为集成电路存储芯片和集成电路模拟芯片，按照产品类型分为 DRAM、SRAM、FLASH 及 ANALOG，设计线条较为丰富，各类产品种类齐全，产品品质较高且能够较好满足专用领域的稳定需求。

DRAM 产品方面，北京矽成主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，类型涵盖 16M、32M、64M、128M 到 1G、2G、4G、8G、16G 等多种容量规格，能够满足工业、消费、通讯等级和车规等级产品的要求，具备在极端环境下稳定工作以及节能降耗等特点；SRAM 产品方面，北京矽成设计品类丰富，从传统的 Synch SRAM、Asynch SRAM 产品到行业前沿的高速 SRAM 产品均拥有自主研发专利，SRAM 产品面对客户在高速、低功耗等不同性能需求中均赢得客户的认可；FLASH 产品方面，北京矽成涵盖了目前全球主流的 NOR FLASH 存储芯片和 NAND FLASH 存储芯片，其中 NOR FLASH 存储芯片产品具有串口型和并口型两种设计结构，以及从 256K-1G 的多种容量规格，NAND FLASH 存储芯片主攻 1G-4G 大容量规格，FLASH 产品主要应用于汽车和工业领域；ANALOG 产品方面，主要包括功放驱动芯片、LED 驱动芯片、传感芯片等，近年来发展速度相当可观。

考虑到集成电路芯片设计领域对车规级、工业级芯片的可靠性、一致性等要求，北京矽成在不断提高产品品质的同时，也在稳定性方面着重把握、重点开发，形成了较好的市场口碑。通过与北京矽成的主要客户访谈得知，其产品退货率、瑕疵率均长期处于较低水平。北京矽成产品的高品质与稳定性系客户认可的重要方面，也为各方的长期合作、市场扩张等奠定了良好的基础。

（4）服务周期完善，需求响应高效

北京矽成发展成为汽车、工业等集成电路存储芯片专用领域的行业领先公司，与其全链条、长周期、快速响应的高品质服务息息相关。

在服务链条方面，北京矽成已建立完善的质量管理系统，分别为客户服务模

块（COP）、管理层模块（MP）和管理支持模块（SP）。其中核心模块为客户服务模块，本着以客户满意度为首的管理理念，在该模块中品质保障部门围绕从新产品立项规划、内部研发及品质验证、采购及销售策划到客户满意度反馈四个环节对产品的品质做到全范围的跟踪和监控。管理层模块和管理支持模块则是为了进一步加强客户服务环节中对产品质量的管理。由于北京矽成的终端客户主要源自汽车、工业、通讯等专用领域，在向其提供芯片产品时，经常需要和客户直接或联合经销商一起根据客户要求对芯片产品做细节上的个性化设计。凭借该种合作模式，北京矽成不仅和客户之间形成了极强的粘性和信任，同时来自于全球知名的专用领域客户对芯片产品的需求情况，一定程度上也成为专用领域存储芯片未来发展趋势，为其产品在行业内树立了标杆的形象。同时，北京矽成根据产品行业特点提供全链条、长周期的跟进与维护（部分长达 7-15 年）与全方位的技术支持，及时高效响应客户需求，为客户带来良好的服务体验。

（5）销售渠道多样，供应链网络优质

销售渠道方面，北京矽成在专用领域市场拥有多元化的客户结构，直销模式和经销商模式下带来的终端客户和代理商客户使其规避了对单一大客户的依赖风险。报告期内，北京矽成具有长期合作关系经销客户包括了 Avnet、Arrow、Hakuto、Sertek 等全球知名大型电子元器件经销商，终端客户覆盖了大陆集团、奥托立夫、西门子、松下、博世等全球知名企业，销售渠道多样，客户结构稳定。随着客户的业务发展，北京矽成也能够进一步扩大销售规模、实现市场提升。

供应链网络方面，北京矽成多年来专注于设计领域的经营历史构筑了其在行业内同供应商之间可靠而稳定的合作关系。目前其长期合作的供应商伙伴包括了力晶科技、南亚科技、中芯国际、武汉新芯等，均为在集成电路存储领域具有高品质、高良率、产能充足的晶圆代工厂。在封装和测试环节，北京矽成和南茂科技、矽格等厂商有着深厚的合作关系，在产能安排、测试品质、物流安排方面得到封装、测试厂的有力支持，满足专用领域客户及时高效、保质保量的需求。此外，北京矽成与中国大陆的供应链厂商正逐渐加强合作关系，进一步构建高效、稳定和低成本的区域供应链网络。

（九）北京矽成未来保持盈利水平稳定的具体措施

1、把握市场机遇，扩大经营规模

2018-2019 年半导体行业进入下行期，但市场机构普遍认为半导体行业在 2019 年相对疲软后有望在 2020 年实现复苏并保持繁荣。IHS 预计，2020 年全球半导体市场收入将出现反弹，增幅会达到 5.9%；WSTS 认为 2020 年全球半导体的市场规模将同比上升 5.4%，其中存储芯片上涨幅度高于其他品类；普华永道研究认为内存产品销售额仍是半导体收入的最大份额，预计 2019 年至 2022 年半导体市场销售额将在复苏后保持稳健增长，复合年均增长率约为 4.6%。与此同时，作为近年来行业增速逐年增长的半导体专用领域行业之一，半导体在汽车产业中的应用逐渐扩大，市场整体呈稳步上升趋势。IHS 预测，全球汽车半导体市场将从 2018 年的 340 亿美元增长到 2022 年的 553 亿美元，年均复合增长率达到 12.93%。

具体到中国市场，由于我国集成电路芯片长期严重依赖进口，前期集成电路产业行情受到中美贸易摩擦的冲击有所下滑，国产替代加速成为了集成电路企业发展的重要驱动力。从产业现状来看，我国集成电路产业需要从设备材料、芯片设计、制造及封测等环节全面突围。

北京矽成是面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，未来将进一步专注于汽车、工业市场，把握专用领域市场未来的发展机遇，同时进一步增加在中国市场的投入并加强合作，扩大经营规模，保障未来的盈利能力。

2、扩展销售网络，实现双向提升

销售网络方面，北京矽成目前采取直销与经销相结合的方式。在直销模式下，北京矽成与全球品牌整机厂商直接达成供货合作；在经销商模式下，北京矽成的客户大多由全球级别的代理商组成，通过代理商对接，有效了解市场需求情况及整机厂商的产品要求。报告期内，北京矽成具有合作关系的终端客户覆盖了大陆集团、奥托立夫、西门子、松下、博世等全球知名企业，客户结构具有较高稳定性。由于北京矽成的终端客户主要源自汽车、工业、通讯等专用领域，在向其提供芯片产品时，经常需要和客户直接或联合经销商一起根据客户要求对芯片产品做细节上的个性化设计。凭借该种合作模式，北京矽成不仅和客户之间形成了极

强的粘性和信任，同时来自于全球知名的专用领域客户对芯片产品的需求情况，一定程度上也成为专用领域存储芯片未来发展趋势，为其产品在行业内树立了标杆的形象。

目前存储器的需求结构正快速向着多样化转变，人工智能、物联网、大数据、5G 等将成为后续的核心增长动力。北京矽成于近期完成了新的 CRM 系统的优化，结合原有 ERP 系统，将进一步提高公司经营管理、生产管理、和客户管理的效率，实现降低成本和提高经营效率的目标。后续北京矽成也将紧密结合行业趋势，不断扩展销售网络，努力实现新产品、新客户双向提升，为持续盈利创造基础。

3、优化采购机制，抵御市场风险

市场供给方面，近年来以 DRAM 为主的存储芯片供给增速处于整体放缓的趋势。2013-2018 年上半年供给端处于产能的平台期，DRAM 价格先抑后扬；2018 年下半年开始，由于三星电子、SK 海力士等资本性支出增加，快速填补需求缺口，景气行情终结，导致 2019-2020 年成为投片量、制程水平的双重平台期，后续 2019 年将消化库存、2020 年前后 DRAM 位元供求会重新达到平衡。

经过多年的合作，北京矽成与主要的晶圆制造厂商、晶圆测试厂商、芯片封装厂商及芯片测试厂商建立起了长期而稳定的合作关系，能够保障产品及服务的稳定供应。未来北京矽成将进一步根据综合成本调整供应商区域，以抵御市场周期波动风险、稳定提高盈利能力。

4、保持技术优势，提升研发实力

北京矽成作为存储行业领先的设计公司，在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念，在产品的工艺上一直保持行业前沿。凭借行业领先的研究技术，北京矽成的产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可。截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成共有研发人员 223 人，其中核心技术人员在易失性存储领域或非易失性存储领域均有多年丰富的工作经验，经历了数次行业研发技术的革新以及多轮产品的迭代，其平均从业年限超过 20 年。在经验丰富的核心技术团队带领下，北

京矽成不断推出行业领先的专业级芯片产品，如带有 ECC 功能的 SRAM 和带有 ECC 功能的 FLASH 目前已进入量产阶段，带有 ECC 功能的 DRAM 已进入产品送样阶段。经过长期的技术积累，北京矽成代表行业领先技术水平的专用领域存储芯片的研发成果将逐渐在未来显现，同时基于先进制程的研发能力会进一步稳固公司在芯片设计领域的行业地位，有助于长期保持较高的盈利能力。

三、北京矽成的财务分析

信永中和对北京矽成编制的 2017 年、2018 年和 2019 年 1-5 月的合并财务报表及附注进行了审计，并出具了（第 XYZH/2019BJA90485 号）标准无保留意见审计报告。

如无特别说明，本节有关财务数据均为合并口径。

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产						
货币资金	111,995.17	16.87%	117,618.37	17.93%	90,870.43	15.10%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,677.18	1.01%	6,580.29	1.00%	6,160.23	1.02%
应收账款	45,119.44	6.79%	43,207.15	6.59%	38,306.08	6.36%
预付款项	8,443.85	1.27%	12,005.85	1.83%	9,371.12	1.56%
其他应收款	1.96	0.00%	1.57	0.00%	1.57	0.00%
存货	109,623.08	16.51%	104,579.33	15.94%	66,593.56	11.07%
其他流动资产	6,666.17	1.00%	8,298.99	1.27%	4,025.76	0.67%
流动资产合计	288,526.86	43.45%	292,291.55	44.56%	215,328.74	35.78%
非流动资产						
长期应收款	5,282.55	0.80%	-	-	50,261.56	8.35%

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	925.12	0.14%	920.30	0.14%	876.18	0.15%
固定资产	25,779.08	3.88%	27,243.36	4.15%	24,845.67	4.13%
在建工程	78.37	0.01%	418.89	0.06%	-	-
无形资产	67,990.58	10.24%	67,247.97	10.25%	60,726.34	10.09%
开发支出	8,917.87	1.34%	10,727.64	1.64%	7,323.18	1.22%
商誉	250,125.72	37.67%	248,820.57	37.93%	226,017.24	37.56%
递延所得税资产	7,568.69	1.14%	7,212.68	1.10%	7,586.39	1.26%
其他非流动资产	8,825.14	1.33%	1,101.73	0.17%	8,863.15	1.47%
非流动资产合计	375,493.12	56.55%	363,693.14	55.44%	386,499.70	64.22%
资产总计	664,019.98	100.00%	655,984.69	100.00%	601,828.44	100.00%

报告期各期末，北京矽成的资产总额分别为 601,828.44 万元、655,984.69 万元和 664,019.98 万元，资产总额保持稳定增长。

北京矽成作为高性能集成电路存储芯片的研发、设计和销售企业，采用 Fabless 模式运营，将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商，固定资产投入相对较低，而无形资产和开发支出等占总资产的比重相对较高。但从资产结构来看，报告期各期末，北京矽成的非流动资产总额分别为 386,499.70 万元、363,693.14 万元和 375,493.12 万元，占总资产的比重分别为 64.22%、55.44%和 56.55%，非流动资产占比较高的原因主要系北京矽成 2015 年私有化收购 ISSI 以及 2018 年收购 ISSI（Israel）和 Chiefmax（BVI）导致商誉增加以及被收购企业的无形资产、固定资产等可辨认净资产公允价值增值所致。

北京矽成流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成，非流动资产主要由长期应收款、固定资产、无形资产以及商誉构成。报告期各期末，上述七类资产合计占资产总额的比重分别为 92.65%、92.79%和 92.76%。

（1）货币资金

报告期各期末，北京矽成的货币资金分别为 90,870.43 万元、117,618.37 万元和 111,995.17 万元，占总资产的比例分别为 15.10%、17.93%和 16.87%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	9.78	10.99	10.03
银行存款	107,703.37	113,226.09	86,566.11
其他货币资金	4,282.02	4,381.29	4,294.30
合计	111,995.17	117,618.37	90,870.43
其中：存放在境外的 款项总额	99,669.17	116,913.18	88,997.33

2019年5月末，北京矽成的货币资金余额为111,995.17万元，与2018年末货币资金余额接近，变动较小。2018年末，北京矽成的货币资金余额较2017年末增加29.44%，主要原因为融资租赁的承租方力晶半导体公司（Powerchip Technology Corporation）向出租方ISSI和ICSI TW提前完成融资租赁设备的全部款项支付，当年收回较大金额的融资租赁应收款。

（2）应收账款

①应收账款基本情况

报告期各期末，北京矽成应收账款账面价值分别为38,306.08万元、43,207.15万元和45,119.44万元，主要系应收客户的销售款项，明细情况如下表所示：

单位：万元

2019.5.31					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,586.02	76.56%	-	-	34,586.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,588.93	23.44%	55.52	0.52%	10,533.41
合计	45,174.95	100.00%	55.52		45,119.44
2018.12.31					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,675.78	75.57%	-	-	32,675.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备	10,565.46	24.43%	34.09	0.32%	10,531.37

的应收账款					
合计	43,241.23	100.00%	34.09		43,207.15
2017.12.31					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,978.03	78.21%	-	-	29,978.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,352.40	21.79%	24.35	0.29%	8,328.05
合计	38,330.43	100.00%	24.35		38,306.08

2019年5月末，北京矽成应收账款账面价值较2018年末增加4.43%，变动较小；2018年末，北京矽成应收账款账面价值较2017年末增加12.79%，与同期营业收入的增幅基本一致。

②坏账准备计提政策基本情况

北京矽成的客户主要为境外大中型经销商及厂商，与其合作时间较长且信用情况良好，因此北京矽成历史上较少发生坏账损失。鉴于此，北京矽成的应收账款坏账准备政策如下：

北京矽成将期末余额达到300.00万元（含300.00万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

北京矽成根据历史经验个别认定法，将单项金额不重大的债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项以及单项金额不重大的其他应收款进行单项测试计提坏账准备。

③单项金额重大的应收账款确认标准及坏账准备计提情况

A. 境内外会计准则的相关规定

根据《〈企业会计准则第22号-金融工具确认和计量〉（2006）》第四十条规定，企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值

的，应当计提减值准备。根据《国际会计准则 39 号-金融工具的确认和计量》第五十八条规定，主体必须在每个资产负债表日评估是否存在任何减值的客观证据。如果存在任何此类证据，则要求企业进行详细的减值计算以确定是否应确认减值损失。第五十九条规定，只有在初始确认资产后发生的一项或多项事件有客观证据的情况下，金融资产或资产组合发生减值，并确认减值损失。基于上述，境内外会计准则均要求企业对任何有客观证据表明其存在减值的应收账款，应计提坏账准备，两者不存在重大差异。

B. 将 300 万元及以上的应收款项归类为单项金额重大的原因

北京矽成应收账款坏账计提政策的确定系根据其业务经营模式、市场地位、客户数量及信用情况、应收款项结构及历史回款情况等因素综合考虑谨慎确定，以准确地对应收款项进行减值测试，恰当地估计坏账准备。报告期各期末，北京矽成应收账款分类统计金额及占比情况如下：

单位：万元

年份	应收账款	金额	金额占比	客户数量	数量占比
2019.5.31	总额	45,174.95	100.00%	232	100.00%
	其中：300 万（含）以上	33,139.25	73.36%	30	12.93%
	300 万以下	12,035.71	26.64%	202	87.07%
2018.12.31	总额	43,241.23	100.00%	228	100.00%
	其中：300 万（含）以上	32,675.78	75.57%	30	13.16%
	300 万以下	10,565.46	24.43%	198	86.84%
2017.12.31	总额	38,330.43	100.00%	211	100.00%
	其中：300 万（含）以上	29,978.03	78.21%	26	12.32%
	300 万以下	8,352.40	21.79%	185	87.68%

北京矽成主要客户均为全球知名的汽车电子经销商或整机厂商，客户相对集中且较为稳定，与北京矽成形成了长期稳定的合作关系，历史期信用状况良好，主要客户形成的营业收入及应收款项占比均较高。根据历史经验统计，应收款项期末余额占比 70%以上的客户数量约为 20-30 家，而上述客户的应收款项期末余额均在 300 万元以上。因此，以 300 万元作为单项金额重大的判断标准，既具有较高的减值测试覆盖比例，又具有进行单项减值测试的实际可操作性，符合北京矽成实际的经营情况。

C. 报告期内对单项金额重大的应收款项的坏账准备计提比例为 0 的原因

北京矽成对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。报告期内，单项金额重大的应收款项的坏账准备计提比例为 0，主要原因如下：

a. 客户质量高，应收账款可回收性强

北京矽成主要经营实体 ISSI 系一家原纳斯达克上市公司，其产品主要面向专用领域市场，被广泛使用于工业级和汽车级应用。北京矽成的主要客户均为全球知名的汽车电子经销商或整机厂商，其中不乏市场认可度颇高的上市公司。北京矽成给予客户的信用期主要在 2 个月内，客户信用记录良好，能够在信用期内按时付款，应收账款可回收性强。

b. 历史回款记录良好

报告期内，截至 2019 年 5 月末，北京矽成未发生过单项金额重大的坏账损失，北京矽成应收账款回款记录良好。报告期内，北京矽成应收账款周转率分别为 6.31、7.05 和 6.33，周转天数分别为 57 天、51 天和 57 天，应收账款周转情况较为稳定。

c. 严格的应收账款内控及管理制度

北京矽成拥有严格的应收账款内部控制及管理制度，针对不同地区、性质及规模的客户，根据其财务情况、销售情况，定期进行信用风险评估，确定不同的信用额度及账期，主要客户信用期基本均控制在 2 个月之内。

d. 期后回款情况良好

报告期内，一般情况下北京矽成均能在账期之内收到款项，特殊情况超过账期的应收账款基本可以在超期后 1-2 周内收回，个别情况会在超期后 1 个月内收回。北京矽成期后回款记录整体良好。

④报告期内应收账款前五大欠款方与前五大客户存在不一致的原因

A. 报告期内北京矽成应收账款前五大欠款方和前五大客户情况

报告期各期末，北京矽成应收账款前五大欠款方及期末余额情况如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	期末余额
2019 年 5 月末	1	Avnet Europe Comm. VA	7,006.13
	2	EBV Elektronik GMBH & CO KG	4,153.74
	3	Arrow Asia Pac Ltd.	2,268.23
	4	Arrow Central Europe GmbH	1,670.23
	5	Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd	1,545.27
	合计		16,643.60
2018 年末	1	AVNET EUROPE Comm. VA (Avnet united)	4,492.86
	2	Arrow Asia Pac Ltd.	3,834.13
	3	EBV Elektronik GMBH & CO KG	3,830.09
	4	Sertek Incorporated	2,223.35
	5	Aptiv Electronics (Suzhou) Co., Ltd.	1,815.67
	合计		16,196.10
2017 年末	1	AVNET EUROPE Comm. VA (Avnet united)	5,171.27
	2	Arrow Asia Pac Ltd.	2,299.34
	3	EBV Elektronik GMBH & CO KG	2,125.69
	4	Aptivport Services,S.A	2,072.87
	5	Arrow Central Europe GmbH	1,704.13
	合计		13,373.31

报告期内，北京矽成前五大客户及对应销售金额情况如下：

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额
2019 年 1-5 月	1	Avnet	30,937.86
	2	Arrow	18,325.57
	3	Hakuto	4,435.39
	4	Sertek	4,117.37
	5	Delphi	3,587.38
	合计		61,403.57
2018 年	1	Avnet	65,854.61
	2	Arrow	49,639.22
	3	Delphi	15,399.11
	4	Sertek	12,217.41
	5	Hakuto	8,792.66

时间	序号	客户名称	销售金额
		合计	151,903.00
2017 年	1	Avnet	60,951.47
	2	Arrow	45,473.67
	3	Delphi	16,121.64
	4	Sertek	10,562.91
	5	Continental	7,336.98
		合计	140,446.67

B. 应收账款前五大和客户前五大不一致的原因

上述报告期内北京矽成的销售收入前五大客户与应收账款余额前五大客户不一致主要系统口径不同所致。根据《格式准则 26 号》规定，受同一实际控制人控制的客户，应当合并计算销售额。因此，北京矽成销售收入的前五大客户按照集团口径进行合并统计。但北京矽成对同一控制下的不同主体在合同条款及信用账期等方面有所不同，所以应收账款前五大客户则按照具体的应收账款对象单独进行统计。上述同一控制下主体的对应关系如下表所示：

序号	销售入口径客户名称	应收账款口径客户名称
1	Avnet	Avnet Europe Comm. VA
		EBV Elektronik GMBH & CO KG
2	Arrow	Arrow Asia Pac Ltd.
		Arrow Central Europe GmbH
3	Delphi	Aptivport Services,S.A
		Aptiv Electronics (Suzhou) Co., Ltd.
		Delphi Automotive PLC

(3) 存货

①存货基本情况

报告期各期末，北京矽成存货金额分别为 66,593.56 万元、104,579.33 万元和 109,623.08 万元，分别占总资产的比例为 11.07%、15.94%和 16.51%，主要由原材料、在产品和库存商品等构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	46,654.35	42.56%	40,130.42	38.37%	14,676.95	22.04%
在产品	19,008.34	17.34%	17,120.74	16.37%	17,797.19	26.73%
库存商品	43,960.40	40.10%	47,328.17	45.26%	34,119.41	51.24%
合计	109,623.08	100.00%	104,579.33	100.00%	66,593.56	100.00%

2019年5月末，北京矽成存货较2018年末增加4.82%，变动较小。2018年末，北京矽成存货较2017年末增加57.04%，主要原因为：①2017年存储芯片行业整体供给紧张，公司采购量较小，而为了满足未来发展需求，同时减小因主要供应商品圆供货紧张带来的影响，2018年北京矽成采购了较大规模的晶圆材料以备后期业务开展所需；②为减小部分供应商因技术升级及产能调整对公司业务带来的影响，北京矽成进行了提前备货；③随着主营业务的增长，订单数量增加，加工完成后的期末库存商品增加。

②2018年大量采购原材料以及报告期末原材料占比的合理性分析

A. 北京矽成2018年大量采购原材料的原因

报告期各期末，北京矽成的原材料账面价值分别为14,676.95万元、40,130.42万元和46,654.35万元；报告期内，北京矽成的存货周转率分别为2.31、1.95和1.61（2019年1-5月存货周转率以年化计算）。2018年原材料账面价值较2017年大幅增长，且存货周转率较2017年下降，主要系受整体业务规模扩大，并减小因主要供应商品圆供货紧张及部分供应商技术升级、产能调整对公司业务带来影响而提前采购所致。具体分析如下：

a. 受整体业务规模扩大的影响

北京矽成2018年营业收入较2017年增长14.54%，营业成本较2017年增长17.55%，随着业务规模的扩大，北京矽成增加了对原材料的采购量。2018年，北京矽成的晶圆代工采购金额达130,351.95万元，较2017年增长39.30%。

2018年，北京矽成已将较多DRAM和FLASH样品发送至下游客户并通过了设计认证和质量认证，因此预期未来市场销量增长潜力较大。同时，为了防止未来因供应商产能供货紧张带来的不利影响，北京矽成于2018年下半年始采购了较大规模的DRAM和FLASH等成品晶圆以备后期业务开展所需。

b. 受主要供应商产线升级的影响

半导体行业的产品生产趋势主要受消费类产品的更新和升级的影响，消费类产品具有产品生命周期短、更新迭代快的特点。为有效满足芯片在实际应用领域中不断提出的新要求，晶圆的产品工艺及技术的更新换代速度也较快。2018 年，北京矽成的主要供应商决定进行产线更新及技术升级，部分与北京矽成主要产品相关的工艺产线将停止运营。由于北京矽成所生产产品主要应用于汽车工业，具有产品品种繁杂、需长期小批量供货和应用周期长（一般 7-10 年）等特点，为减小对车规芯片在未来较长期间销售的影响，2018 年北京矽成“最终购买（last time buy）”了该等原材料。有关主要供应商产线更新及技术升级的情形及影响分析如下：

半导体行业的产品生产趋势主要受消费类产品的更新和升级的影响，消费类产品具有产品生命周期短、更新迭代快的特点。为有效满足芯片在实际消费级应用领域中不断更新的要求，主要面向消费级产品的芯片晶圆制造工艺及技术的更新换代速度也较快。因技术升级后的产品拥有更高的集成度和更低的功耗，2018 年部分 DRAM 产品的晶圆供应商决定将工艺从 38 纳米技术升级到 25 纳米，部分 FLASH 产品的晶圆供应商决定停止 90 纳米产线并聚焦 65 纳米产线。

为满足芯片在实际应用领域中不断提出的新要求，芯片设计厂商会持续进行产品研发以满足更新换代的需求，晶圆厂商亦会不断更新升级产能，并适时停止低产能利用率或陈旧产线；设计厂商和晶圆厂商之间基于行业变化趋势，互相推陈出新是集成电路行业普遍的发展路径。

北京矽成的芯片产品主要应用于汽车工业，其产品的生命周期一般为 7-10 年。供应商进行产线更新换代涉及的北京矽成芯片不涉及在销产品，对北京矽成经营业绩的影响较小。由于北京矽成和其主要的晶圆供应商之间沟通紧密，在晶圆厂决定进行技术升级的规划阶段便进行参与和配合，对于供应商即将停止的生产工艺，北京矽成也会和供应商与客户进行提前沟通和规划，预测晶圆的采购需求以适应下游客户在未来的产品需求。因此，为了满足该等产品在生命周期内存在的包括使用、保养、更换等需求，在主要供应商决定进行产线更新及技术升级前，北京矽成进行了提前购买，以满足汽车和工业市场需要保持客户未来 3-4 年对相应产品稳定供货的要求。与此同时，北京矽成也将告知下游汽车和工业客户

有关相应产品的剩余库存情况,以及北京矽成的更新及替代产品计划。综上所述,上述因供应商产线更新及技术升级对相应产品的生产周期不会产生不利影响。

由于上述与供应商产线更新升级相关的产品占北京矽成整体产品的比重较小,北京矽成已通过提前购买相关原材料的方式可以保证未来 3-4 年的销售需求,可以较好实现该部分产品的经营业绩。此外,北京矽成的研发周期为 3-5 年,在未来亦将不断推出更新升级的产品,能够有效满足市场需求,进一步提升未来的经营业绩。

B. 报告期末原材料占比的合理性分析

报告期各期末,北京矽成的原材料金额分别为 14,676.95 万元、40,130.42 万元和 46,654.35 万元,占存货的比例分别为 22.04%、38.37%和 42.56%。

a. 北京矽成原材料在存货中的占比与同行业可比公司不存在重大差异

截至 2017 年末和 2018 年末,北京矽成原材料在存货中的占比与 A 股同行业公司可比公司的对比如下表所示:

单位: 万元

可比公司	项目	2018.12.31	2017.12.31
紫光国微	原材料	19,738.27	19,684.23
	存货	78,858.79	60,054.48
	原材料/存货	25.03%	32.78%
全志科技	原材料	-	653.21
	存货	44,759.19	24,932.73
	原材料/存货	0.00%	2.62%
国科微	原材料	458.01	-
	存货	11,494.57	9,890.44
	原材料/存货	3.98%	0.00%
兆易创新	原材料	36,348.80	36,578.85
	存货	62,930.07	62,747.58
	原材料/存货	57.76%	58.30%
平均值	原材料	56,545.08	56,916.30
	存货	198,042.62	157,625.23
	原材料/存货	28.55%	36.11%
北京矽成	原材料	40,130.42	14,676.95

	存货	104,579.33	66,593.56
	原材料/存货	38.37%	22.04%

数据来源：各上市公司年报

由上表可知，截至 2017 年末，北京矽成的原材料在存货中的占比低于 A 股同行业可比公司平均水平，但截至 2018 年末高于 A 股同行业可比公司平均水平，主要系 2018 年北京矽成采购较大金额的原材料所致。整体而言，北京矽成原材料占存货的比例处于同行业可比公司的区间范围内，与其平均值不存在重大差异。

b. 北京矽成的原材料占比符合 Fabless 经营模式

同 Fabless 经营模式相一致，北京矽成主要从事芯片的设计与开发，主要生产环节由晶圆代工厂商和封装测试厂商完成。尽管北京矽成不实际从事生产，但需首先采购晶圆以便后续加工成最终商品，同时晶圆为芯片产品的主要原材料及成本构成，从财务角度而言，晶圆采购以原材料核算，并会出现一定金额的原材料库存。

c. 北京矽成的原材料采购符合晶圆供给的行业特征

因北京矽成的产品主要运用于汽车、工业领域，具有产品品种繁杂、需长期小批量供货的特点，而主要厂商占据了全球晶圆的绝大部分供给，对不同类型的晶圆采购数量有最低数量要求。在产品需求具有持续性、供应商对晶圆采购数量存在限制的情况下，北京矽成适当储备原材料有助于未来业务的有效开展。

综上所述，北京矽成的原材料在存货中的占比与同行业可比公司不存在重大差异，符合 Fabless 经营模式以及晶圆供给的行业特征，具有合理性。

C. 与“以销定产”生产模式的匹配性

a. 北京矽成储备原材料符合 Fabless 经营模式

北京矽成采用 Fabless 经营模式，主要从事芯片的设计与开发，主要生产环节由晶圆代工厂商和封装测试厂商完成。尽管北京矽成不实际从事生产，但需首先采购晶圆以便后续加工成最终商品，同时晶圆为芯片产品的主要原材料及成本构成，从财务角度而言，晶圆采购以原材料核算，报告期末会出现一定金额的原材料库存。

b. 北京矽成的原材料采购符合晶圆供给的行业特征

因北京矽成的产品主要运用于汽车、工业领域，具有产品品种繁杂、需长期小批量供货的特点，而主要厂商占据了全球晶圆的绝大部分供给，对不同类型的晶圆采购数量有最低数量要求。在产品需求具有持续性、供应商对晶圆采购数量存在限制的情况下，北京矽成适当储备原材料有助于未来业务的有效开展，符合晶圆供给的行业特征。

c. 储备原材料可保证产品生产的及时性

北京矽成的采购和生产主要通过前端和后端两个环节实现，其中前端环节分为晶圆采购及测试环节，后端环节分为芯片封装和芯片测试环节。

原材料采购集中于前端环节，其采购主要分成两类：第一类为成品晶圆，后续由北京矽成委托第三方完成晶圆测试后，再进入后端的封装、测试加工环节；第二类为直接从晶圆厂采购已经完成测试工序的晶圆，即晶圆经测试之后再进入后端的第三方封装与测试加工环节。由于多数晶圆均需经前端测试后方可进行后端封装、测试阶段，生产周期用时较长。与此同时，主要供应商可能会对单次晶圆采购量有最低数量要求，无法依照销售订单逐次小批量购买晶圆。因此，储备充足的晶圆材料，能够保证在接受客户采购订单时尽早进入后端的封装与测试，及时量化生产。

d. 储备原材料与“以销定产”模式的匹配性

北京矽成的主要产品单次订单产品需求量较小，需要公司统筹安排，长远规划，综合产品的在手订单和未来需求组织生产，才能使产品生产满足市场变化的需求。北京矽成在采购/生产环节，主要通过客户的订单和对芯片产品的未来需求预测向晶圆厂及封装测试厂进行采购。因此，在整体业务规模逐渐扩大且部分产品预测未来销量将维持相对稳定需求的前提下增加部分原材料储备，整体符合“以销定产”原则。

③报告期内各类存货的可变现净值测算依据

A. 存货跌价准备的准则规定

根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条至第十九条，资产负债表日，

存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。在日常经营活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

B. 北京矽成存货可变现净值测算依据

北京矽成按照单个存货项目计提存货跌价准备，于资产负债表日，对存货成本高于其可变现净值的存货计提跌价准备。

各类存货可变现净值测算依据如下：

对于库存商品等直接用于出售的商品存货，以该存货的预测平均销售价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的预测平均销售价格减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

C. 北京矽成存货跌价准备计提原则

北京矽成建立了良好且谨慎的存货质量控制体系，每季度末市场部对各类存货的可变现净值进行检测，对于其中库龄大于1年的在产品和库存商品、以及库龄大于2年的原材料进行重点关注，并结合市场部对存货品质及预期销售情况进行综合判断，以各项存货预测平均销售价格减去相关费用后的净值作为确定可变现净值的依据，按照可变现净值与账面存货成本孰低的原则，对于存货成本高于其可变现净值的存货逐一对单个品种存货计提跌价准备。

④报告期各期末库存商品占比的合理性分析及跌价准备计提情况

A. 报告期各期末库存商品占比的合理性分析

报告期各期末，北京矽成的库存商品价值分别为 34,119.41 万元、47,328.17 万元和 43,960.40 万元，占存货的比例分别为 51.24%、45.26%、40.10%。

a. 北京矽成库存商品在存货中的占比与同行业可比公司不存在重大差异

截至 2017 年末和 2018 年末，北京矽成库存商品在存货中的占比与 A 股同行业公司可比公司的对比如下表所示：

单位：万元

可比公司	项目	2018.12.31	2017.12.31
紫光国微	库存商品	35,779.10	24,216.22
	存货	78,858.79	60,054.48
	库存商品/存货	45.37%	40.32%
兆易创新	库存商品	20,372.61	18,338.96
	存货	62,930.07	62,747.58
	库存商品/存货	32.37%	29.23%
全志科技	库存商品	18,006.11	12,269.86
	存货	44,759.19	24,932.73
	库存商品/存货	40.23%	49.21%
国科微	库存商品	4,390.99	2,454.67
	存货	11,494.57	9,890.44
	库存商品/存货	38.20%	24.82%
平均值	库存商品	19,637.20	14,319.93
	存货	49,510.66	39,406.31
	库存商品/存货	39.66%	36.34%
北京矽成	库存商品	47,328.17	34,119.41
	存货	104,579.33	66,593.56
	库存商品/存货	45.26%	51.24%

数据来源：各上市公司年报

由上表可知，北京矽成库存商品占存货的比例稍高于同行业平均水平，但截至 2019 年 5 月末，北京矽成的库存商品占存货的比例已降低为 40.10%，与同行业平均水平接近，不存在重大差异。

b. 北京矽成生产及销售模式会增加部分库存商品

通常，北京矽成根据客户下达的销售订单委托上游厂商进行多批次生产，同一笔订单在完全加工完成并发货至客户前，将产生部分库存；另一方面，针对相同批次产品，部分客户单次下达的订单量较小，但基于晶圆采购及生产加工成本的整体控制考虑，北京矽成会提前完成同批次产品的生产以待后续销售。

同时，北京矽成亦将根据对下游需求的预测，提前进行适当备货以供业务开展需要。而部分下游客户为减少因自身账面的过多存货金额，要求北京矽成进行提前备货以满足未来至少 6-9 个月的业务需要。

此外，因主要晶圆厂商对晶圆工艺产线的升级更迭，封装、测试等工艺也将随之进行逐渐升级，北京矽成及时进行委托加工增加了相应库存商品。

综上所述，报告期各期末，北京矽成的库存商品占存货的比例逐渐下降，与同行业可比公司不存在重大差异，同时北京矽成库存商品的形成及增加亦受其生产销售模式的影响，具有合理性。

B. 库存商品已足额计提存货跌价准备

a. 北京矽成库存商品跌价准备的计提政策

资产负债表日，北京矽成按照单个存货项目计提存货跌价准备，对存货成本高于其可变现净值的存货计提跌价准备。

北京矽成建立了良好的质量控制体系，每季度末对库存商品的可变现净值进行检测，其中对于库龄大于 1 年的库存商品将进行筛选并重点关注。市场部会根据存货品质及预期销售情况，对所有库存商品进行判断，按照可变现净值与成本孰低法对单个品种计提跌价准备。公司产品主要系以销定产的生产模式，库存商品的管理和运营能力较强，减值风险相对较小。

b. 北京矽成各期末库存商品情况及报告期内销售均价情况

报告期各期末，北京矽成库存商品的库龄、金额及跌价准备计提情况如下表所示：

单位：万元

库龄	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31

	1 年以内	1 年以上	1 年以内	1 年以上	1 年以内	1 年以上
库存商品账面余额	42,976.18	6,849.37	47,204.65	5,596.34	34,778.03	6,142.79
跌价准备计提金额	1,459.34	4,405.81	1,405.18	4,067.63	1,719.35	5,082.06
库存商品账面价值	41,516.83	2,443.56	45,799.47	1,528.70	33,058.68	1,060.73
账面价值占比	94.44%	5.56%	96.77%	3.23%	96.89%	3.11%
跌价计提比例	3.40%	64.32%	2.98%	72.68%	4.94%	82.73%

由上表可知，报告期各期末，北京矽成库存商品的库龄均以 1 年之内为主，占比均达 90%以上，其跌价准备的计提比例亦较小。

报告期内，北京矽成库存商品的平均销售价格变化情况如下表所示：

单位：美元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
DRAM	2.14	1.95	1.92
SRAM	1.63	1.62	1.57
FLASH	0.24	0.21	0.13
ANALOG	0.40	0.36	0.22

由上表可知，报告期内北京矽成库存商品的平均销售价格稳中有升。结合库存商品的库龄及销售均价，北京矽成的产品销售情况良好，发生跌价准备的可能性较小，其计提跌价准备不足的风险较小。

c. 对比同行业可比公司，北京矽成计提的库存商品跌价准备充分

截至 2017 年末和 2018 年末，北京矽成库存商品计提的跌价准备与 A 股同行业可比公司的对比如下表所示：

单位：万元

可比公司	项目	2018.12.31	2017.12.31
紫光国微	库存商品跌价准备	1,054.99	0.00
	库存商品原值	36,834.09	24,216.22
	跌价计提比例	2.86%	0.00%
兆易创新	库存商品跌价准备	1,665.17	960.12
	库存商品原值	22,037.78	19,299.08
	跌价计提比例	7.56%	4.97%
全志科技	库存商品跌价准备	2,450.76	2,608.69
	库存商品原值	20,456.86	14,878.55

	跌价计提比例	11.98%	17.53%
国科微	库存商品跌价准备	0.00	0.00
	库存商品原值	4,390.99	2,454.67
	跌价计提比例	0.00%	0.00%
平均值	库存商品跌价准备	1,292.73	892.20
	库存商品原值	20,929.93	15,212.13
	跌价计提比例	6.18%	5.87%
北京矽成	库存商品跌价准备	5,472.82	6,801.41
	库存商品原值	52,800.99	40,920.82
	跌价计提比例	10.36%	16.62%

数据来源：各上市公司年报

由上表可知，北京矽成库存商品的跌价准备计提比例处于同行业可比公司的区间范围内，且高于其平均水平，表明北京矽成的跌价准备计提较为充分，预期未提足跌价准备的风险较小。

综上所述，北京矽成具有严谨的质量控制体系，主要产品销售均价未出现重大不利变化，且对比同行业公司北京矽成库存商品的跌价准备计提更为充分，预期未提足跌价准备的风险较小。

⑤北京矽成不存在主要订单合同为亏损合同的情况

A. 北京矽成报告期主要库存商品库龄及跌价准备情况

单位：万元

库龄	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	一年以内	一年以上	一年以内	一年以上	一年以内	一年以上
账面原值	42,976.18	6,849.37	47,204.65	5,596.34	34,778.03	6,142.79
跌价准备	1,459.34	4,405.81	1,405.18	4,067.63	1,719.35	5,082.06
账面净值	41,516.83	2,443.56	45,799.47	1,528.70	33,058.68	1,060.73
账面原值占比	86.25%	13.75%	89.40%	10.60%	84.99%	15.01%
跌价计提比例	3.40%	64.32%	2.98%	72.68%	4.94%	82.73%
库存商品总跌价计提比例	11.77%		10.36%		16.62%	

报告期各期末，北京矽成库存商品库龄在 1 年以内的占比区间为 84%-90%，跌价准备计提比例区间为 2%-5%；库龄 1 年以上的库存商品占比区间为

10%-16%，跌价准备计提比例区间为 64%-83%。整体而言，库存商品跌价计提比例区间为 10%-17%。

B. 北京矽成库存商品跌价准备计提比例相对较高的原因

北京矽成库存商品跌价准备计提比例相对较高主要受产品所在行业特征进行备货及谨慎的跌价准备计提方式的影响。

a. 主要产品销售周期较长，备货较为充足

北京矽成的芯片产品主要用于汽车和工业领域，其产品的生命周期相对较长，多为 7-10 年，且其产品需求具有小批量和长期供应的特点，因而库存商品库龄超 1 年的比例相较于消费类芯片企业会略高。在此背景下，为保证对产品长期稳定的供应，北京矽成需要对库存商品生产量作出相对较长区间的销售预期。由于销售周期较长，北京矽成会结合行业、市场需求等方面的情况进行适当备货。

b. 北京矽成对存货跌价准备的计提较为谨慎

北京矽成按照成本与可变现价值孰低的原则，对存货成本高于其可变现净值的存货计提跌价准备。但由于产品存在下游行业专用性的特征，北京矽成对于库龄超过一年但不存在在手订单的库存商品全额计提减值，待该等全额计提的库存商品有新的订单生成后再进行跌价转回处理，整体处理较为谨慎。

c. 报告期内不存在主要订单合同为亏损合同的情况

北京矽成的目标客户主要集中在对产品质量、稳定性和长期供货能力要求较高的大型经销商和汽车、工业等直销客户。下游客户为保证其品牌价值和长期发展，不仅仅追求低成本的单一指标，而同时考虑质量和稳定性的重要性。基于此，北京矽成与其主要下游客户建立了稳定、长期的互利共赢关系。

报告期内，北京矽成前五大客户较为稳定，向前五大客户的销售额合计占各期销售收入的比重分别为 56.87%、52.79%和 52.70%，且向前五大客户的平均销售毛利率分别为 40.06%、35.86%和 33.04%；北京矽成对主要客户的商品销售长期保持着一定的利润空间。报告期各期末，北京矽成在手订单相应的库存商品中其可变现净值低于成本的情况很少，上述亏损订单相应的存货计提的跌价准

备余额分别为 133.28 万美元，68.40 万美元和 57.13 万美元，占各期末存货的比例分别为 1.18%、0.43%和 0.34%。

⑥销售环节内控有效，不存在相关经营风险

北京矽成建立了与销售环节相关的内部控制制度体系，制定了《信用与收款管理制度》、《审批权限制度》、《收入确认制度》和《应收账款坏账计提制度》等相关内控制度，从而确保销售环节的内部控制有效的支持经营活动的有效运营，其主要控制节点、控制目标及控制过程列示如下：

项目	控制目标	控制过程
客户管理	新增客户经过适当的评审	客户关系管理人员负责对客户资信进行综合评估和管理，建立客户业务状况、财务状况、信用状况等基础信息档案，对客户进行资信状况分析。
信用审批	客户信用期的审批	在进入客户目录前，销售人员对客户整体情况进行了解，并经信用管理人员进行整体评估，设定信用期限。
订单审批	对新增的订单进行审批	销售人员需要将新接订单的内容进行填写并提交至相关人员对销售价格、交货时间及销售条款等进行审批。
商品调配	订单商品调配	运营部人员对订单商品根据库存情况进行出库或生产确认。
商品出库	出库单经恰当审批	仓储部在发货审批流程通过后，进行物料出库、包装、联系物流公司，填写销售订单发货单发货。
销售收入确认	按照收入确认原则确认收入	对符合公司收入确认条件的销售确认收入。
应收账款坏账管理	坏账准备计提经过适当的审核	财务部每月编制应收账款账龄分析表，对应收账款账龄进行分析，同时将计提坏账准备提交会计主管、市场部双重复核。
收款管理	逾期应收账款催收	销售人员定期根据账龄表对逾期的应收款进行提醒或催收。

北京矽成对上述控制明确了相关岗位、岗位职责、具体的审批流程等，且均按照制度进行了有效执行，不存在因内控导致的重大经营风险。

（4）长期应收款

①长期应收款基本情况

报告期各期末，北京矽成长期应收账款的账面价值分别为 50,261.56 万元、0.00 万元和 5,282.55 万元，均为融资租赁设备款。

2015 年，北京矽成的下属子公司 ISSI 和 ICSI TW 分别与力晶科技股份有限公司（Powerchip Technology Corporation）签订系列设备融资租赁合同。根据合同规定，该系列融资租赁的收款期为 2019 年至 2021 年。2018 年，承租方力晶

科技股份有限公司提前向出租方 ISSI 和 ICSI TW 完成融资租赁设备全部款项的支付，北京矽成的融资租赁应收款提前收回，因此 2018 年末长期应收账款金额变为零。

2018 年 9 月，ISSI 和 ICSI 与力晶科技股份有限公司新签订了信用额度及设备租赁合同。该合同约定 ISSI 和 ICSI 将向力晶科技股份有限公司提供设备融资租赁。截至 2019 年 5 月末，该合同项下的部分设备已交付力晶科技股份有限公司，报告期末的长期应收款余额为 5,282.55 万元。

②融资租赁设备的具体情况

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成向力晶科技股份有限公司提供的融资租赁设备的具体情况如下：

设备用途	设备规格型号	供应商	租赁起始日	设备成本 (原币/万元)	设备成本 (人民币/万元)
晶圆制造	EB_Asher (λ -300)	Kokusai	2019-5-31	JPY 7,620.00	459.50
晶圆制造	FD_DO (Quixace2 Q2LV)	Kokusai	2019-4-30	JPY 12,400.00	753.42
晶圆制造	FD_B-Poly (Quixace2 Q2LV)	Kokusai	2019-2-27	JPY 14,230.00	872.06
晶圆制造	EC_SN_EX_P (Flex FX)	Lam	2019-1-31	USD 460.00	3,173.63
合计					5,258.61

③融资租赁交易的合理性

北京矽成与力晶科技进行融资租赁交易，主要系北京矽成成为加强与晶圆代工工厂的合作关系，且为有效满足力晶科技在产能升级上的需求，以更好地为北京矽成确保晶圆供应价格与数量的稳定。北京矽成通过融资租赁交易与主要晶圆代工工厂进行合作系基于其经营模式、产业格局、区位优势、双方合作需要等因素综合考虑确定。

A. 北京矽成的经营模式

北京矽成采用 Fabless 经营模式，不从事具体生产，通过委托代工方式将晶圆生产、封装和测试工序委托第三方晶圆代工厂、封装厂和测试厂代工，自身专门从事集成电路存储芯片和模拟芯片的设计。在 Fabless 经营模式下，北京矽成与主要晶圆代工厂等供应商形成长期稳定的合作关系，有利于保证产能供应、

稳定采购价格，提高盈利能力，降低经营风险。

B. 晶圆代工厂的产业格局

由于晶圆加工对晶圆厂自身技术及资金规模的要求较高，北京矽成可选择的晶圆厂数量有限，产业集聚效应明显，全球晶圆厂前十名的市场占有率达 95%，其中，行业绝对龙头台湾积体电路制造股份有限公司的晶圆市场占有率约为 50%，晶圆厂供应商处于高度集中化状态。

同时，由于北京矽成的存储芯片和模拟芯片多运用于汽车、工业等专用领域，具有特定的技术要求，并需要持续性的基础设施服务，能满足北京矽成相关要求的晶圆代工厂在市场上数量较少，在行业本身集中度较高的背景下，与特定晶圆代工厂形成长期稳定的合作关系，是北京矽成能够保证持续稳定发展的重要保证。

C. 力晶科技的主要优势

力晶科技作为全球知名的晶圆代工厂，其领先的技术能力及持续的服务能力，能够为北京矽成的产品提供持续而稳定的保障。同时，力晶科技与北京矽成台湾子公司同位于台湾新竹科学园区内，在日常经营联络、产品购销运输等方面具有极佳的区位优势。

D. 融资租赁系基于双方合作需要

作为行业内重要的晶圆供应商，先进的制造设备有利于满足力晶科技进行产能升级与技术更新。力晶科技希望通过与下游客户实现更好的产业联动，以在产能升级的同时有效满足客户需求。北京矽成与力晶科技在多年的合作中已形成较为稳定的商业伙伴关系，双方在经营战略、合作模式、技术发展等方面达成了诸多共识。通过向力晶科技提供融资租赁设备，能够在有效满足力晶科技发展需求的同时，为北京矽成提供产能保障，实现双方的互利共赢。

基于上述原因，北京矽成与力晶科技签订设备融资租赁合同，可有效满足力晶科技的产能升级需求，同时可更好地保障北京矽成对晶圆产能、价格及交付时间等需求，有利于彼此互利合作，具有合理性。

（5）固定资产

报告期各期末，北京矽成的固定资产分别为 24,845.67 万元、27,243.36 万元、25,779.08 万元，由房屋建筑物、机器设备、运输设备和家具设备构成。与大多数集成电路设计企业一样，北京矽成采用 Fabless 经营模式，不从事具体生产制造，具有“轻资产”特点，其固定资产规模整体较小。报告期各期末，北京矽成的固定资产构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
一、账面原值			
房屋建筑物	19,091.26	19,068.09	16,283.45
机器设备	54,159.43	54,702.18	48,227.30
运输设备	175.94	177.58	174.91
家具设备	3,344.83	3,354.27	1,977.26
合计	76,771.46	77,302.12	66,662.91
二、累计折旧			
房屋建筑物	3,385.14	3,054.56	1,873.18
机器设备	44,369.17	43,798.01	38,066.78
运输设备	163.88	160.08	145.25
家具设备	3,074.20	3,046.11	1,732.03
合计	50,992.39	50,058.76	41,817.24
三、账面价值			
房屋建筑物	15,706.13	16,013.53	14,410.27
机器设备	9,790.26	10,904.18	10,160.52
运输设备	12.06	17.50	29.65
家具设备	270.64	308.16	245.23
合计	25,779.08	27,243.36	24,845.67

（6）无形资产

①无形资产基本情况

报告期各期末，北京矽成的无形资产金额分别为 60,726.34 万元、67,247.97 万元和 67,990.58 万元，由非专利技术、商标、技术许可使用权、专有技术、软件构成。

报告期各期末，北京矽成的无形资产构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
一、账面原值			
非专利技术	57,153.27	52,691.44	46,561.97
商标	17,937.92	17,844.32	16,988.92
技术许可使用权	16,948.86	16,688.84	14,862.31
专有技术	8,264.20	8,235.84	653.42
软件	6,354.43	6,186.29	5,267.12
合计	106,658.68	101,646.73	84,333.74
二、累计摊销			
非专利技术	24,390.01	20,987.93	13,052.11
商标	-	-	-
技术许可使用权	7,418.41	6,840.59	5,188.60
专有技术	41.07	-	-
软件	5,438.77	5,197.60	4,059.85
合计	37,288.26	33,026.12	22,300.56
三、减值准备			
技术许可使用权	1,379.84	1,372.64	1,306.84
合计	1,379.84	1,372.64	1,306.84
四、账面价值			
非专利技术	32,763.26	31,703.50	33,509.86
商标	17,937.92	17,844.32	16,988.92
技术许可使用权	8,150.61	8,475.61	8,366.86
专有技术	8,223.13	8,235.84	653.42
软件	915.65	988.69	1,207.27
合计	67,990.58	67,247.97	60,726.34

注：2016 年 12 月，北京矽成收到其技术许可方 Genusion 进入破产程序的正式书面通知，北京矽成从 Genusion 取得的技术许可使用权预计无法再带来经济利益流入，因此于 2016 年末全额计提无形资产减值准备 200 万美元，折合至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 5 月末分别为 1,306.84 万元、1,372.64 万元、1,379.84 万元。

报告期内，北京矽成无形资产规模整体保持稳定，其无形资产按成本进行初始计量，并于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不作摊销；由企业合并取得的研发中项目，在研发项目完成

开发并商业化量产后在预计使用年限内摊销。商标由于使用寿命不确定，不进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销年限	摊销方法
非专利技术	7年	直线法
专有技术	7-10年	直线法
技术许可使用权	3-15年	直线法
软件	3-5年	直线法

②非专利技术的基本情况

A. 无形资产中非专利技术类型及形成过程

无形资产中的非专利技术类型主要是北京矽成研究开发以及经营过程中形成的工艺技术。非专利技术的形成过程主要包括北京矽成自研形成，以及北京矽成并购过程中形成的非专利技术。

北京矽成自主研发形成的非专利技术主要系 DRAM 和 SRAM 产品的研发费用资本化转入无形资产的金额，主要包括研发工程师薪酬、向第三方定制 mask 光罩的费用、试产阶段付给第三方的材料和测试费等。

北京矽成并购过程中形成的非专利技术主要包括 2015 年私有化 ISSI 过程中并购标的非专利技术 6,600.00 万美元和 2018 年合并以色列子公司过程中并购标的非专利技术 142.00 万美元。

B. 非专利技术的金额及占比

报告期内，非专利技术各期末相应金额及占比情况：

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	账面价值	占比（%）	账面价值	占比（%）	账面价值	占比（%）
DRAM 产品研发费用资本化	6,681.71	20.39	3,874.43	12.22	2,324.67	6.94
SRAM 产品研发费用资本化	2,405.43	7.34	1,529.22	4.82	791.82	2.36
私有化 ISSI	7,278.66	22.22	8,098.58	25.54	9,670.62	28.86

过程中并购 标的 SRAM 非专利技术						
私有化 ISSI 过程中并购 标的 DRAM 非专利技术	11,106.13	33.89	12,340.69	38.93	14,736.18	43.98
私有化 ISSI 过程中并购 标的 FLASH 非 专利技术	3,812.63	11.64	4,242.11	13.38	5,065.56	15.12
私有化 ISSI 过程中并购 标的 ANALOG 非专利技术	693.21	2.12	771.29	2.43	921.01	2.75
合 并 ISSI(Israel) 过程中并购 标的 ANALOG 非专利技术	785.51	2.40	847.18	2.67	-	-
合计	32,763.26	100.00	31,703.50	100.00	33,509.86	100.00

a. 报告期 DRAM、SRAM 产品研发费用资本化账面价值持续大幅增长的原因及合理性

北京矽成的 DRAM 和 SRAM 等产品的研发费用资本化最终转入无形资产的非专利技术归集。报告期内，非专利技术中与 DRAM、SRAM 产品研发费用资本化相关的账面价值及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31
	账面价值	变动额	账面价值	变动额	账面价值
DRAM 产品研 发费用资本化	6,681.71	2,807.28	3,874.43	1,549.76	2,324.67
SRAM 产品研 发费用资本化	2,405.43	876.21	1,529.22	737.40	791.82

其中，DRAM 产品研发费用资本化项目转入非专利技术核算的明细如下：

期间	项目	金额（万元）
2019 年 1-5 月	K095	877.74
	K096	936.38
	N307	1,283.13

	合计	3,097.24
2018 年	K101	1,815.60
	合计	1,815.60
2017 年	K073	1,190.27
	N302	241.87
	N303	680.37
	N508	182.35
	合计	2,294.86

SRAM 产品研发费用资本化项目转入非专利技术核算的明细如下：

期间	项目	金额（万元）
2019 年 1-5 月	8177	668.67
	8179	315.00
	合计	983.66
2018 年	8175	418.96
	8178	481.98
	合计	900.93
2017 年	8169	12.69
	8171	225.23
	8176	481.27
	9090	223.06
	合计	942.25

根据企业会计准则的规定及北京矽成研发工作流程，其在产品进入指定的晶圆代工厂进行试生产时，开始进行研发费用资本化，并计入开发支出核算；在产品达到量产阶段时，视为产品已完成研发，停止研发费用资本化，并将该产品对应的开发支出转入无形资产非专利技术项目。北京矽成的产品主要应用于汽车、工业等领域，对于产品性能和技术水平的要求较高。北京矽成需持续进行研发投入，在保持产品质量的同时，维持较高的市场认可度。报告期内，随着在研阶段的 DRAM、SRAM 项目陆续达到商业化量产条件，转入无形资产非专利技术核算的项目逐年增加，进而导致非专利技术项下资本化项目的价值持续增长。

b. 报告期内研发费用资本化符合资本化条件和《企业会计准则》相关规定

(a) 《企业会计准则》中对研发费用资本化的相关规定

《企业会计准则第6号——无形资产》第七条至第九条规定了企业内部研究开发项目支出的会计处理方式：

“第七条 企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

第八条 企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

第九条 企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。”

(b) 北京矽成研发费用资本化的会计政策

北京矽成研发费用资本化的会计政策如下：

a) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

b) 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

c) 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，不满足下列条件的开发支出计入当期损益，即：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

d) 公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目开始商业化产出之日转为无形资产。

e) 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(c) 北京矽成研发项目资本化的具体流程

北京矽成研发项目工作流程分为四个阶段，分别为：立项讨论阶段、内部研发阶段、循环验证阶段及量产阶段。立项讨论阶段与内部研发阶段完成后，经过指定的晶圆代工厂试生产以及封装厂、测试厂的加工，测试部及产品部将对代工厂送来的产品样品进行循环验证。北京矽成在产品进入指定的晶圆代工厂进行试生产时，开始进行研发费用资本化，并计入开发支出核算；在产品达到量产阶段时，视为产品已完成研发，停止研发费用资本化，并将该产品对应的开发支出转入无形资产非专利技术项目。

(d) 北京矽成研发费用资本化的内部控制

北京矽成建立了对研发费用资本化以及资本化金额统计的内部控制，并系统地归集研发过程中所有阶段发生的研发费用，包括人工成本、定制光罩成本、材料与测试成本等。针对每项研发产品，项目负责人汇总每个研发人员在对应项目上的所用工时，并交由项目总工程师进行审核，确保记录工时的准确性和完整性，财务人员基于上述工时对于人工成本进行归集。同时，财务人员根据项目相关的光罩定制记录、材料采购记录、试生产产品循环测试记录，对相应项目发生的定制光罩成本、材料与测试成本进行归集。

有关资本化的具体内容和核算方面,从产品达到可送往指定的晶圆代工厂试生产时开始,北京矽成资本化的研发费用包括人工成本、定制光罩成本、材料与测试成本。人工成本即为项目研发人员在对应研发项目上所用的人工工时;定制光罩成本即为北京矽成根据产品的物理图版向第三方光罩厂定制光罩的成本;材料与测试成本即为北京矽成针对每个研发项目向供应商采购其他原材料及试生产产品循环测试过程中发生的成本。

对于判断产品是否达到可送往指定的晶圆代工厂试生产的标准,针对每项在研发产品,市场部、技术部、设计部、测试部等通过每月例行的产品规划会议共同讨论及审核评估,以判断产品是否达到公司内部的设计需求,是否在技术上具有可行性,以及北京矽成是否有完成开发并出售产品的意图。满足上述条件即认为产品已达到可送往指定的晶圆代工厂试生产的阶段,并向第三方光罩厂交付产品的物理图版,定制光罩。与此同时,项目负责人向财务部提供项目清单及相关文件,财务部根据相关文件判断每个项目是否满足企业会计准则对研发支出资本化时点等的要求,通常认为达到可送往指定的晶圆代工厂试生产的标准即满足资本化条件。

对于每项已试生产产品,市场部将样品及小额订单下的产品陆续发送给客户试用,当产品工程验证和客户要求验证均达到标准且该试生产产品的收入达到5万美元后,即认为该产品可投入商业化量产,视其已达到量产阶段。至此,产品完成研发,停止研发费用资本化。

(e) 报告期内研发费用资本化符合《企业会计准则》相关规定的具体依据

a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性

在新产品立项阶段,首先会由市场部搜集主要客户的产品要求,在规格、性能、成本和需求方面进行了解,同时综合技术发展趋势、竞争对手产品研究、未来市场供需预测等因素制作初步报告。之后在每月例行的产品规划会议中,市场部联合设计工程师根据讨论新产品的规划方向,制定新产品的产品规格和性能特征,再交由设计部门进行新产品的可行性分析,最终由设计团队负责人决定是否通过项目评审,启动项目,也即技术具备可行性,项目正式进入实施阶段。

b) 具有完成研发项目及形成成果并使用或出售的意图

在设计工程师根据项目启动时指定的产品规格及性能特征基本完成新产品的开发设计后，由技术工程师进行分析，评估在未来生产阶段最合适的代工晶圆厂。在通过技术工程师的评估环节后，市场部会对整个新产品项目做完整的投资回报分析，评估整个项目的投资回报情况。因此研发项目具有实际应用和预期经济社会效益。

c) 研发成果产生经济利益的方式

研发项目形成的研发成果通常应用于汽车、工业等领域，对产品性能和技术水平的要求较高。主要产品集成电路存储芯片以及模拟芯片在产品质量和性能上有较高的市场认可度，最终为北京矽成带来经济利益的流入。

d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持

从人员技术方面，北京矽成作为半导体集成电路的设计公司，具有专用领域领先的研发实力，在全球主要科技发达地区都有研发团队驻扎，主要分布在美国圣荷西、科罗拉多、韩国首尔、中国大陆等地区。同时，北京矽成在研发人员的培养与激励方面具有较为完善的制度支撑，高度重视研发技术人员的培养以及核心技术团队的稳定性，经验丰富的研发团队是北京矽成保持持续竞争力的主要来源。

从财务资源方面，集成电路行业一直以来都是资金密集型行业，大量的研发投入对于资金的规模都有较高的要求。在集成电路设计行业，设计厂商在制程的研发、规格的升级上需紧跟快速变化的市场要求，从而实现芯片产品的更新换代，因此需持续进行研发投入，若研发投入不足而放缓研发进展，则很可能使设计厂商失去技术和成本的优势。报告期内研发资本化项目的价值持续增长，截至 2019 年 5 月 31 日，主要产品研发超过 20 余项，形成了丰富的研发成果和技术储备。研发项目执行情况良好也证明了北京矽成具备持续的财务资源支持。

e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

财务部根据项目负责人向财务部提供的项目清单及相关文件判断每个项目是否满足企业会计准则对研发支出资本化时点等的要求，通常认为达到可送往指定的晶圆代工厂试生产的标准即满足资本化条件。对于达到资本化条件的研发项目，财务人员按研发项目的支出内容分类别归集对应到相应产品的开发支出科目

中，在达到商业化量产条件后按照相应产品的类别从开发支出转入无形资产科目，从而实现项目的规范管理和核算，保证了研发项目费用的准确归集及计量。

因此，报告期内研发费用资本化符合企业会计准则关于研发支出资本化的规定。

综上所述，报告期内北京矽成研发费用资本化符合资本化条件，与《企业会计准则》规定的内容相符。

D. 非专利技术的摊销年限及确认依据

无形资产类别	摊销年限（年）	摊销方法	确认依据
非专利技术	7	直线法	车规芯片行业产品生命周期 7-10 年

北京矽成依据车规芯片行业产品平均生命周期 7-10 年中的最短者 7 年作为非专利技术的摊销年限，分期平均摊销，并于每年年度终了对其预计使用寿命及摊销方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（7）商誉

①报告期内北京矽成商誉情况

报告期各期末，北京矽成的商誉金额分别为 226,017.24 万元、248,820.57 万元和 250,125.72 万元，占当期期末总资产的比例分别为 37.56%、37.93%和 37.67%，主要包括北京矽成于 2015 年私有化收购 ISSI 及 2018 年收购 ISSI (Israel)、Chiefmax (BVI)形成的商誉。

报告期内，北京矽成的商誉构成如下所示：

单位：万元

被投资单位名称	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
ISSI	238,642.55	237,397.31	226,017.24
ISSI (Israel)	10,291.31	10,237.61	
Chiefmax (BVI)	1,191.86	1,185.64	
合计	250,125.72	248,820.57	226,017.24

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。

收购 ISSI 的商誉主要系北京矽成于 2015 年对其完成的私有化交易，其交易对价为 78,259.10 万美元，可辨认净资产公允价值为 43,669.21 万美元，其差额 34,589.89 万美元确认为商誉。

收购 ISSI (Israel)的商誉主要系北京矽成于 2018 年对其完成收购，其交易对价为 2,524.91 万美元，可辨认净资产公允价值为 1,033.24 万美元，其差额 1,491.67 万美元确认为商誉。

收购 Chiefmax (BVI)的商誉主要系北京矽成于 2018 年对其完成收购，其交易对价为 347.42 万美元，可辨认净资产公允价值为 174.67 万美元，其差额 172.75 万美元确认为商誉。

2017 年末、2018 年末和 2019 年 5 月末，商誉的账面价值以美元金额乘以各报告期末即期汇率的金额列示。

②报告期内北京矽成的商誉减值情况

A. 资产组的划分

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的第十八条：“资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。”第二十三条：“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。”

ISSI 为北京矽成 2015 年完成私有化的标的公司，其本身业务已经经过多年的发展及调整，具有稳定的经营模式；而新购入的 Chiefmax(BVI)，其实际经营主体为武汉群茂科技有限公司，主要为研发部门，研发产品还未完全完成市场化运作；ISSI (Israel)为 2018 年并购公司，主要经营地为以色列，其主要生产产品与 ISSI 原有产品也有较大差异，还未与 ISSI 原有业务形成良好的协同作用。因此，在进行商誉减值测试时，将 ISSI、ISSI (Israel) 和 Chiefmax (BVI)划分为三个不同的资产组分别进行减值测试。

B. 减值测试方法

北京矽成在对 ISSI 完成私有化收购完成后，于每年末根据未来对收入和盈利的预期采用预期现金流量法对商誉进行减值测试。在对 ISSI（Israel）和 Chiefmax (BVI)形成的商誉进行减值测试时，由于商誉形成时间和报告期末时间间隔较短，因此采用北京矽成对其的收购交易对价作为公允价值进行减值测试。

C. 关于主要减值测试模型及参数的说明

北京矽成各报告期末根据《企业会计准则》的要求对商誉进行减值测试，资产组的可回收金额根据资产组的资产预计未来现金流量的现值确定。资产组可收回金额是基于 5 年期预测，之后采用永续的增长率，采用未来现金流量折现方法的主要假设包括：预期增长率、永续增长率、毛利率、期间费用、所得税费率及折现率。管理层采用预测期增长率为-2.98%-16.00%，永续期增长率为 2-3%，符合北京矽成当前产品市场未来发展趋势。采用的毛利率为 34.52%-36.42%，该毛利率为北京矽成管理层根据历史经验及产品市场发展的预测所确定的。采用的管理费用、销售费用和研发费用占营业收入的比重分别为 2.5%-4%，7%-9%和 8%-10%，符合北京矽成的历史情况和销售预期情况。采用的折现率为 10.00%-11.00%，该折现率为能够反映北京矽成资产组的特定风险的税前折现率。经过企业架构重组后，预计企业的所得税税率为 15%。上述关键假设均充分考虑了公司历史经营数据、公司未来运营计划及相关行业数据。

经测试，北京矽成于 2017 年末、2018 年末及 2019 年 5 月 31 日不存在商誉减值情况。

③北京矽成私有化过程中对于交易对价、可辨认净资产公允价值及商誉的计算过程及确认依据

A. 北京矽成私有化过程中交易对价的确认依据

北京矽成的实际运营实体 ISSI 原为纳斯达克上市企业，于 2015 年 12 月被北京矽成通过其全资子公司 Uphill Technology 私有化收购并退市。最终私有化收购的价格为 23 美元/股，系以二级市场的成交价格为基础，通过收购双方谈判协商确定。根据上述每股收购价格，并考虑员工既得期权费和银行手续费后，确认的最终收购成本为 78,259.10 万美元。

B. 北京矽成可辨认净资产公允价值及商誉的计算过程及确认依据

根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》，购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

北京矽成管理层对私有化当日 ISSI 的可辨认资产和负债进行了充分的考虑和判断，其可辨认的资产和负债、以及商誉的确认过程如下：

a. 可辨认的资产和负债

截至购买日，ISSI 的可辨认资产和负债情况如下：

单位：万美元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	10,441.66	10,441.66
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产	124.22	124.22
应收账款	7,376.50	7,376.50
存货	11,054.30	9,393.10
预付款项	1,918.07	1,918.07
可供出售的金融资产	2,174.97	2,174.97
固定资产	6,265.60	4,979.10
无形资产	9,300.00	-
递延所得税资产	1,355.17	1,355.17
其他非流动资产	7,838.67	7,838.67
短期负债	19.50	19.50
应付账款	5,643.53	5,643.53
应付职工薪酬	4,535.02	4,535.02
应交税费	868.50	868.50
其他流动负债	2,014.29	2,014.29
长期借款	411.13	411.13
递延所得税负债	389.56	389.56
其他非流动负债	55.64	55.64
净资产	43,911.99	31,664.29
减：少数股东权益	242.77	242.77
取得的净资产	43,669.21	31,421.51

私有化收购日，ISSI 主要评估资产的识别及评估方法情况如下：

(a) 存货识别情况

北京矽成的存货主要为原材料、在产品和库存商品，存货增值主要系考虑未实现利润所致。

(b) 固定资产识别情况

固定资产增值主要系房屋建筑物和设备等增值，该部分增值影响收购后报表期间的经营成果。固定资产的评估方法主要为市场比较法。

(c) 无形资产识别情况

可辨认无形资产增值主要系非专利技术、专有技术和商标增值，所使用的评估方法为特许权费节省法。经北京矽成管理层充分辨认，收购日的可辨认无形资产具体如下：

单位：万美元

项目	金额
非专利技术	6,600.00
其中：DRAM	3,200.00
SRAM	2,100.00
FLASH	1,100.00
ANALOG	100.00
专有技术	100.00
其中：ANALOG	100.00
商标	2,600.00
合计	9,300.00

b. 商誉

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。上述交易的合并成本为 78,259.10 万美元。截至购买日，可辨认净资产公允价值 43,669.21 万美元，合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 34,589.89 万美元确认为商誉。受汇率波动影响，报告期各期末，商誉折合为人民币的金额分别为 226,017.24 万元、248,820.57 万元和 250,125.72 万元。对于本次交易完成后形成的商誉，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》第二十三条规定，北京矽成于每年度终了进行减值测试。

综上所述，ISSI 私有化时的收购价格系以二级市场的成交价格为基础，通过收购双方谈判协商确定；私有化时的可辨认资产和负债经北京矽成管理层充分考虑和判断，已充分辨认相应的可辨认无形资产。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
应付账款	43,325.17	57.56%	41,526.26	55.91%	34,984.75	52.24%
预收款项	3,091.57	4.11%	2,662.91	3.59%	2,121.07	3.17%
应付职工薪酬	8,997.67	11.95%	10,229.37	13.77%	9,274.56	13.85%
应交税费	1,613.20	2.14%	2,679.54	3.61%	3,898.91	5.82%
其他应付款	2,419.05	3.21%	2,124.41	2.86%	2,382.13	3.56%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	163.36	0.24%
其他流动负债	44.37	0.06%	537.59	0.72%	0.00	0.00%
流动负债合计	59,491.04	79.03%	59,760.07	80.46%	52,824.79	78.88%
非流动负债：						
长期借款	-	-	-	-	2,804.26	4.19%
长期应付款	2.18	0.00%	2.23	0.00%	2.19	0.00%
长期应付职工薪酬	3,559.48	4.73%	3,357.95	4.52%	5,079.33	7.58%
预计负债	5,374.34	7.14%	4,345.70	5.85%	1,263.22	1.89%
递延所得税负债	6,847.58	9.10%	6,806.89	9.16%	4,994.85	7.46%
非流动负债合计	15,783.58	20.97%	14,512.77	19.54%	14,143.85	21.12%
负债合计	75,274.63	100.00%	74,272.84	100.00%	66,968.63	100.00%

报告期各期末，北京矽成负债总额分别为 66,968.63 万元、74,272.84 万元和 75,274.63 万元，相较于标的公司总资产规模，北京矽成负债比例较小，主要系北京矽成以 Fabless 为经营模式，其“轻资产”特性本身减少了对债务融资的需求；同时“轻资产”特性使得可用于抵押的资产较少，银行渠道的债务融资也会在一定程度上受到制约。从负债结构来看，北京矽成的负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债分别为 52,824.79 万元、59,760.07 万元和 59,491.04 万元，占负债总额的比例分别为 78.88%、80.46%和 79.03%。

北京矽成的负债主要由应付账款、应付职工薪酬、应交税费、长期应付职工薪酬、预计负债、递延所得税负债构成。报告期各期末，上述六项负债合计占负债总额的比例分别为 88.84%、92.83%、92.62%。

（1）应付账款

报告期各期末，北京矽成应付账款分别为 34,984.75 万元、41,526.26 万元和 43,325.17 万元，占负债总额的比例分别为 52.24%、55.91%和 57.56%。北京矽成的应付账款主要系北京矽成应付晶圆厂和封装测试厂的采购款。

（2）应付职工薪酬

报告期各期末，北京矽成应付职工薪酬余额分别为 9,274.56 万元、10,229.37 万元和 8,997.67 万元，占总负债的比例分别为 13.85%、13.77%和 11.95%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
短期薪酬	8,705.78	9,836.07	8,979.94
离职后福利-设定提存计划	291.89	393.30	294.62
合计	8,997.67	10,229.37	9,274.56

（3）应交税费

北京矽成的应交税费为应缴纳企业所得税、个人所得税和增值税。报告期各期末，北京矽成应交税费余额分别为 3,898.91 万元、2,679.54 万元和 1,613.20 万元，占总负债的比例分别为 5.82%、3.61%和 2.14%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
企业所得税	1,591.70	2,615.77	3,840.46
个人所得税	20.67	58.20	58.38
增值税	0.83	5.57	0.07
合计	1,613.20	2,679.54	3,898.91

2019 年 5 月末，北京矽成应交税费较 2018 年末减少 39.80%，主要系缴纳以前年度税项且本期各项税费较少所致。

2018 年末，北京矽成应交税费较 2017 年末减少 31.27%，主要系美国税改使

得 2017 年末应缴纳的企业所得税金额较大所致。

（4）长期应付职工薪酬

北京矽成设立了员工现金奖励计划，向激励员工逐年支付现金奖励，并将超过一年的应付现金奖励计入长期应付职工薪酬。报告期各期末，北京矽成长期应付职工薪酬分别为 5,079.33 万元、3,357.95 万元和 3,559.48 万元，占总负债的比例分别为 7.58%、4.52%和 4.73%。

2019 年 5 月末，北京矽成的长期应付职工薪酬较 2018 年末增加 6.00%，变动较小。2018 年末，长期应付职工薪酬较 2017 年末减少 33.89%，主要系随着员工现金奖励的逐步发放，应付金额逐渐降低所致。

（5）预计负债

①预计负债基本情况

报告期各期末，北京矽成的预计负债分别为 1,263.22 万元、4,345.70 万元和 5,374.34 万元，占负债总额的比例分别为 1.89%、5.85%和 7.14%，主要由研发费用抵扣税款及收购 ISSI (Israel)产生。2018 年末，预计负债较 2017 年末增长 244.02%，主要原因为北京矽成下属子公司 ISSI Cayman 于 2018 年收购 ISSI (Israel)，ISSI (Israel)历史时期的借款偿还事项和利润分配事项涉及被以色列税务部门征税的可能，因此以非确定性税项而列入预计负债。2019 年 5 月末，预计负债较 2018 年末增长 23.67%，主要系研发费用抵扣税款所致。

②预计负债中研发费用抵扣税款的具体情况和预计负债的依据

北京矽成的预计负债主要系根据美国及以色列税法中不确定税项（Uncertainty Tax）确认的或有负债。根据不确定税项规定，纳税申报企业需要每年将申报的所有不确定税项进行恰当评估，如果某申报税项有不低于 50%的可能性受到税务机关审查的质疑，并导致企业无法获得所申请的税务抵扣，则申报企业须量化该税项的影响并在财务报表中做出适当会计处理。

如果申报主体认为税务机关很可能会接受其纳税申报单上已采取或预期采取的具有不确定性的税务处理，则申报主体确定的所得税会计处理应当与这项处理一致。如果申报主体认为该处理不会得到税务机关的认可，则应在得出这一结

论的期间内反映所得税会计处理不确定性的影响（例如，通过确认额外的或有税金负债或适用更高的税率）。

北京矽成的预计负债主要为 ISSI 的研发费用所得税申报抵扣及 ISSI(Israel) 历史时期的利润分配、贷款偿还事项及税收优惠选择情况等形成的不确定税项，具体情况如下：

单位：万元

税务主体	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31		说明
	美元	人民币	美元	人民币	美元	人民币	
ISSI	256.30	1,768.23	193.32	1,326.82	193.32	1,263.22	研发费用扣除
ISSI(Israel)	106.52	734.91	106.52	731.08	-	-	利润分配
ISSI(Israel)	205.35	1,416.76	205.35	1,409.36	-	-	收购贷款偿还
ISSI(Israel)	210.81	1,454.44	127.99	878.44	-	-	税收优惠选择及其他
合计	778.98	5,374.34	633.19	4,345.70	193.32	1,263.22	-

A. ISSI 研发费用抵扣税款对预计负债影响的具体情况

根据美国税法对可抵扣所得税的研发费用规定，研发费用扣除的计算涉及部分估计事项和相关认定要求，其中较为关键的一项是研发工程师的工资费用的认定及核算。美国税法规定，申报研发费用抵扣的研发工程师工资费用应该按照该研发工程师在研发项目和非研发项目上耗用的真实时间为基础对其总工资费用进行划分。

北京矽成参照其聘请的税务咨询机构 Armaninal LLP 的建议，管理层判断已申报的税务抵扣研发费用中，联邦税务机关或加利福尼亚州税务机关在研发支出抵扣审查中，至少存在 50% 的可能性对 ISSI 申报的研发费用抵扣提出质疑，进而判定为不可抵扣税项。针对该等可能受到税务机关质疑而判定为不可抵扣的税项，管理层从审慎性角度考虑，对研发费用所得税抵扣额按照 50% 的比例计提预计负债。

ISSI 分别在 2017 年和 2019 年 1-5 月利用研发费用进行了所得税申报抵扣，受以上税法规定影响在当期预计负债中确认的或有负债金额分别为 193.32 万美元和 62.97 万美元。

B. ISSI(Israel)利润分配及贷款偿还对预计负债影响的具体情况

a. ISSI(Israel)的历史收购情况

2009 年，ISSI(Israel)被其母公司 Sigma Designs, Inc.通过反三角方式完成 100%股权收购。此次收购完成后，ISSI(Israel)形成了对 Sigma Designs, Inc.的收购债务，ISSI(Israel)于 2010 -2016 年将该项债务偿还完毕。

2018 年 2 月，北京矽成全资子公司 ISSI Cayman 向 Sigma Designs, Inc.收购了 ISSI(Israel)的 100%股权。

b. 以色列新税务法案情况

2018 年 1 月，以色列发布了新的税务法案，根据新法案规定，因反三角收购而形成的子公司对母公司的债务，在以后年度偿还时视同子公司向母公司进行利润分配，需按照缴纳企业所得税后的利润进行分配，而以色列原税法中并未对反三角收购形成的债务偿还进行特别规定。与此同时，无论是以色列的原税法还是新税法，向股东进行利润分配均需缴纳预提税（withholding tax）。

c. 利润分配事项情况说明

2018 年，ISSI(Israel)在被 ISSI Cayman 完成收购前实施了约 2,280 万美元的利润分配。在当期的税务申报中，ISSI(Israel)声明本次分配系对 2009-2011 年已缴纳相关企业所得税后的未分配利润进行分配，因而只缴纳了预提税。然而，ISSI(Israel)于 2009-2011 年间向其母公司偿还了部分债务。在新的税务法案下，以色列税务机关可能会认为 2009-2011 年 ISSI(Israel)偿还其股东的债务（含利息）即为对该期间税后利润的利润分配，因此 2018 年声明其利润分配是源自 2009-2011 年期间的已缴纳企业所得税后的利润，可能存在需就该部分利润分配金额缴纳企业所得税的可能性。ISSI(Israel)从谨慎角度出发，计提预计负债 106.52 万美元。

d. 贷款偿还事项情况说明

ISSI(Israel)在 2013-2016 年间偿还了母公司 8,214 万美元的债务，并按照原税法要求进行了可免税项目申报。截至 2018 年末，ISSI(Israel)已按照申报情况完成了 2013-2016 年的企业所得税缴纳，但以色列税务机关仍未完成对该期间申

报的所得税文件的审查。根据新税务法案的要求，因反三角收购形成的债务偿还应视为利润分配，需要缴纳相应的预提税。由于 2013-2016 年的税务申报尚未完成审查，以色列税务机关可能依照新税务法案对上述事项补缴预提税。ISSI(Israel)从谨慎角度出发，计提预计负债 205.35 万美元。

C. 税收优惠选择的具体情况

以色列政府为鼓励本土科技企业从事国际出口业务，为其提供了双重选择的税收优惠政策。根据税收优惠政策，凡出口企业可根据其自身经营状况选择连续两年的税收豁免或者连续八年所得税减按 10%缴纳的企业所得税税率优惠。2017 年，ISSI(Israel)在综合衡量近几年的经营情况后，选择适用连续两年（2014 年和 2015 年）所得税豁免的优惠政策对 2014 年和 2015 年符合条件的应纳税所得进行了豁免申报。然而，以色列税务审查机关可能认为 ISSI(Israel)应该从 2012 年满足可申请税收豁免条件的年份开始直接进行申报而非推迟 2 年后开始进行豁免申报，因此 ISSI(Israel)存在 2014 年和 2015 年所得税豁免申报无法获得税务机关审核通过的可能性。从谨慎考虑，ISSI(Israel)在 2018 年就上述税收优惠选择事项计提了预计负债 111.22 万美元。

2019 年 5 月，ISSI(Israel)收到了原先申报的 2014 年的税收返还 100 万美元。由于 ISSI(Israel)在 2017 年税务申报中对 2014 年和 2015 年的税项进行了补充申报，以色列税务机关可能要求 ISSI(Israel)退回部分已收到的税收返还。从谨慎考虑，ISSI(Israel)于 2019 年 5 月计提预计负债 68.02 万美元。

③ISSI(Israel)预计负债未考虑在 ISSI(Israel)评估值的合理性

截至 2018 年末，ISSI(Israel)账面的预计负债均为北京矽成对其收购前形成，于合并日将其预计负债的账面金额并入北京矽成。北京矽成于 2018 年 2 月对 ISSI(Israel)的收购对价已经将该等预计负债进行了充分考虑。本次交易的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，ISSI(Israel)的整体对价按照 ISSI Cayman 于 2018 年 2 月收购 ISSI(Israel)价格作为其评估价值，已经考虑了截至评估基准日时 ISSI(Israel)预计负债的影响。

此外，2019 年 5 月 ISSI(Israel)收到原先申报的 2014 年的税收返还 100 万美元，同时基于对 2014 年和 2015 年税项的补充申报，因税务机关可能要求其退回

部分已收到的税收返还而计提了预计负债 68.02 万美元。本次交易对 ISSI (Israel) 的评估值均未考虑上述事项，主要系其为评估基准日后的非经常性损益项目，不具有持续性。因此，未考虑上述收到的税收返还和计提的预计负债具有合理性。

（6）递延所得税负债

报告期各期末，以抵消后净额列示的递延所得税负债分别为 4,994.85 万元、6,806.89 万元和 6,847.58 万元，占负债总额的比例分别为 7.46%、9.16%和 9.10%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
固定资产折旧差异	691.40	621.21	474.20
并购重组及评估增值	2,315.81	2,403.65	1,550.61
除美国以外的子公司待分配利润	3,726.96	3,708.63	2,898.79
待摊费用	113.41	73.39	71.25
抵销后递延所得税负债余额	6,847.58	6,806.89	4,994.85

截至 2018 年末，递延所得税负债较 2017 年末增加 36.28%，主要原因为 2018 年北京矽成收购了 ISSI (Israel) 和 Chiefmax (BVI)，相关并购重组评估增值产生了较大金额的应纳税暂时性差异；同时，因台湾税务部门对企业待分配利润的预扣税比例的提升，产生部分应纳税暂时性差异。截至 2019 年 5 月末，递延所得税负债金额与 2018 年末基本一致。

（二）财务指标分析

1、偿债能力分析

报告期内，北京矽成主要偿债能力指标如下：

财务指标	2019.5.31/2019 年 1-5 月	2018.12.31/2018 年	2017.12.31/2017 年
流动比率	4.85	4.89	4.08
速动比率	3.01	3.14	2.82
资产负债率	11.34%	11.32%	11.13%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA, 万元)	14,719.93	41,117.33	30,759.44
利息保障倍数	-	631.78	169.59

注：以上指标计算公式如下：

- 1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 2、速动比率=（期末流动资产-期末存货净额）/期末流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出-利息收入
- 5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

报告期各期末，北京矽成的资产负债率分别为 11.13%、11.32%和 11.34%，资产负债率较低且保持稳定；流动比率分别为 4.08、4.89 和 4.85，速动比率分别为 2.82、3.14 和 3.01，短期偿债能力指标整体呈上升趋势。截至 2018 年 12 月 31 日，同行业可比上市公司主要偿债能力指标如下：

证券代码	公司简称	资产负债率	流动比率	速动比率
002049.SZ	紫光国微	33.62%	3.31	2.55
300458.SZ	全志科技	12.81%	7.12	5.61
300672.SZ	国科微	38.20%	1.47	1.29
603986.SH	兆易创新	33.68%	2.82	1.82
平均值		29.58%	3.68	2.81
中位值		33.65%	3.07	2.18
北京矽成		11.32%	4.89	3.14

数据来源：Wind 资讯，各上市公司 2018 年度报告

从上表可知，北京矽成的资产负债率低于同行业可比上市公司的平均值和中位值，短期偿债能力指标均高于同行业可比上市公司的平均值和中位值水平，整体偿债能力较强。

报告期内，北京矽成的息税折旧摊销前利润金额分别为 30,759.44 万元、41,117.33 万元和 14,719.93 万元，整体规模较高。此外，报告期内北京矽成银行借款较少（截至 2018 年末和 2019 年 5 月末银行借款均为零），利息支出金额较低，利息保障倍数较高，2017 年和 2018 年分别为 169.59 倍、631.78 倍；2019 年 1-5 月北京矽成无有息负债，无利息支出。因此，北京矽成的付息能力亦较强。

2、营运能力分析

报告期内，北京矽成营运能力指标如下：

财务指标	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
总资产周转率（次/年）	0.42	0.46	0.41
应收账款周转率（次/年）	6.33	7.05	6.31

存货周转率（次/年）	1.61	1.95	2.31

注：以上指标计算公式如下：

- 1、总资产周转率=2*营业收入/（期初总资产+期末总资产）
- 2、应收账款周转率=2*营业收入/（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）
- 3、存货周转率=2*营业成本/（期初存货账面余额+期末存货账面余额）
- 4、2019年1-5月的上述指标计算中，营业收入、营业成本以年化测算

报告期内，北京矽成的营运能力指标较为稳健。北京矽成的总资产周转率较为稳定，报告期各期分别为 0.41、0.46 和 0.42。2018 年，北京矽成的应收账款周转率较 2017 年上升，表明随着收入规模的增长，其营运能力稳定提升；2019 年 1-5 月，应收账款周转率有所下降，主要系行业整体趋缓，当期产生的营业收入较少，部分售后回款尚未收回所致。报告期内，北京矽成的存货周转率逐年下降，主要系为满足未来发展需求，减小因主要供应商晶圆供货紧张及部分供应商因技术升级、产能调整对公司业务带来的影响，北京矽成进行了提前采购备货，在期末形成较大金额原材料所致。

2018 年，同行业可比上市公司营运能力情况如下：

证券代码	公司简称	总资产周转率 （次/年）	应收账款周转率 （次/年）	存货周转率 （次/年）
002049.SZ	紫光国微	0.45	2.54	2.45
300458.SZ	全志科技	0.56	23.60	2.34
300672.SZ	国科微	0.29	2.07	2.18
603986.SH	兆易创新	0.83	22.70	1.96
平均值		0.53	12.73	2.23
中位值		0.51	12.62	2.26
北京矽成		0.46	7.05	1.95

数据来源：Wind 资讯，各上市公司 2018 年度报告

由上表可知，北京矽成的总资产周转率略低于同行业可比上市公司的平均值和中位值，主要系前次私有化收购 ISSI 时形成较大商誉及被收购企业固定资产、无形资产等可辨认净资产公允价值增值所致。

北京矽成的应收账款周转率高于同行业可比上市公司紫光国微和国科微，但低于全志科技和兆易创新，主要系各公司应收账款账龄和回款周期不同所致。报告期各期末，北京矽成应收账款的账龄以 30 天以内及 30-60 天为主，尚处于回款账期内。

北京矽成的存货周转率略低于同行业可比上市公司的平均值和中位值，主要系为满足未来发展需求，减小因主要供应商晶圆供货紧张及部分供应商因技术升级、产能调整对公司业务带来的影响，北京矽成于 2018 年进行了提前采购备货，在 2018 年末形成较大规模原材料所致。

（三）盈利能力分析

报告期内，北京矽成的合并利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
一、营业总收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
其中：营业收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
二、营业总成本	106,266.61	255,595.69	228,617.97
其中：营业成本	77,823.76	185,902.30	158,147.56
税金及附加	75.47	170.38	166.16
销售费用	10,281.50	23,441.25	23,001.01
管理费用	4,317.17	12,394.57	14,974.66
研发费用	14,322.51	35,041.51	31,775.06
财务费用	-553.81	-1,354.33	553.52
加：其他收益	60.14	186.70	94.61
资产减值损失	-1,259.16	-4,201.16	-5,806.44
资产处置收益	-3.64	5.30	52.20
三、营业利润	9,051.65	28,119.55	16,928.83
加：营业外收入	65.72	314.05	184.00
减：营业外支出	2.66	50.21	35.75
四、利润总额	9,114.72	28,383.39	17,077.09
减：所得税费用	1,709.14	3,881.25	11,072.06
五、净利润	7,405.58	24,502.14	6,005.03
归属于母公司股东的净利润	7,381.42	24,488.94	6,015.76
少数股东损益	24.15	13.20	-10.73

1、营业收入分析

按业务类型分类，北京矽成的营业收入结构如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

报告期内，北京矽成的营业收入源于主营业务收入，即集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售。报告期内，北京矽成主营业务收入分别为 251,206.43 万元、287,724.41 万元和 116,520.92 万元。北京矽成 2018 年的营业收入较 2017 年增长 14.54%，主要原因为：伴随着 2017 年以来集成电路市场景气度的整体提升，北京矽成主营的存储芯片和模拟芯片销售实现稳步增长，尤其是 FLASH 和 ANALOG，2018 年分别较 2017 年增长 80.21% 和 116.63%，且占主营业务收入的比重也逐年增长，具有较高的成长性。

（1）主营业务收入按产品类别分析

北京矽成主营业务收入来自于存储芯片和模拟芯片收入。北京矽成存储芯片产品包括 DRAM、SRAM 和 FLASH 三类产品，模拟芯片包括 ANALOG 产品。报告期内，存储芯片收入占主营业务收入的比重分别为 94.85%、90.26%、90.57%，是北京矽成主要的收入来源。报告期内，北京矽成按产品类别分类的主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	105,537.40	90.57%	259,691.21	90.26%	238,266.09	94.85%
DRAM	68,994.95	59.21%	168,067.42	58.41%	164,081.94	65.32%
SRAM	20,866.77	17.91%	56,407.63	19.60%	54,642.67	21.75%
FLASH	15,675.67	13.45%	35,216.17	12.24%	19,541.48	7.78%
模拟芯片	10,983.52	9.43%	28,033.20	9.74%	12,940.34	5.15%
ANALOG	10,983.52	9.43%	28,033.20	9.74%	12,940.34	5.15%
主营业务收入	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

①总体分析

报告期内，北京矽成存储芯片收入分别为 238,266.09 万元、259,691.21 万元、105,537.40 万元，占营业收入的比重分别为 94.85%、90.26%、90.57%，在收入

稳步增长的同时占比下降，主要原因为模拟芯片的收入增长迅速，已由 2017 年的 12,940.34 万元增长至 2018 年的 28,033.20 万元，模拟芯片收入占营业收入的比重由 2017 年的 5.15% 提升至 2018 年的 9.74%。

DRAM 和 SRAM 两类随机处理存储芯片贡献了北京矽成存储芯片主要的业务收入，报告期内，上述两类产品的营业收入合计分别为 218,724.61 万元、224,475.04 万元、89,861.73 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 87.07%、78.02%、77.12%。同时，FLASH 和 ANALOG 产品表现出了较高的成长性，其收入增长迅速，对北京矽成的收入贡献也逐年提升。

②DRAM 收入分析

DRAM（Dynamic Random Access Memory），即动态随机存取存储器，是目前市场上最为常见的一类系统内存芯片。DRAM 系列产品广泛应用于汽车电子、工业制造和消费类电子产品等领域。

报告期内，北京矽成 DRAM 产品销售收入分别为 164,081.94 万元、168,067.42 万元、68,994.95 万元，占报告期各期主营业务收入的比重分别为 65.32%、58.41%、59.21%，是北京矽成最主要的收入来源。北京矽成 DRAM 产品主要分为面向汽车电子、工业制造以及通讯等专用领域的 DRAM 和面向移动、电子等消费领域的 DRAM 两类产品，其中以面向专用领域的 DRAM 为最主要产品。报告期内，DRAM 产品收入明细情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
专用领域 DRAM	63,495.66	92.03%	151,735.05	90.28%	144,443.50	88.03%
消费领域 DRAM	5,499.29	7.97%	16,332.37	9.72%	19,638.44	11.97%
DRAM 合计	68,994.95	100.00%	168,067.42	100.00%	164,081.94	100.00%

依托通过多年运营所积累的技术研发优势和稳定的高质量客户群体，2018 年，北京矽成专用领域 DRAM 产品销售收入稳定增长，较 2017 年增长 5.05%，占 DRAM 产品销售收入的比重达 90.28%；2019 年 1-5 月专用领域 DRAM 实现销售收入 63,495.66 万元，占 DRAM 产品销售收入的 92.03%。消费领域 DRAM 产品占 DRAM 产品销售收入的比重较小，报告期内分别实现收入 19,638.44 万元、

16,332.37 万元、5,499.29 万元，占各期 DRAM 产品销售收入的比重分别为 11.97%、9.72%、7.97%。

③SRAM 收入分析

SRAM（Static Random Access Memory），即静态随机存取存储器，是一种具有静止存取功能的内存，不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。

报告期内，北京矽成 SRAM 产品销售收入分别为 54,642.67 万元、56,407.63 万元、20,866.77 万元，占报告期各期主营业务收入的比重分别为 21.75%、19.60%、17.91%。北京矽成 SRAM 系列产品主要应用于汽车电子、工业制造、医疗以及通讯设备等领域，SRAM 收入主要源自于普通型 SRAM 产品和高速型 SRAM 销售收入。报告期内，SRAM 产品收入明细情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
普通型 SRAM	17,794.23	85.28%	48,515.02	86.01%	46,500.66	85.10%
高速型 SRAM	3,072.54	14.72%	7,892.60	13.99%	8,142.01	14.90%
SRAM 合计	20,866.77	100.00%	56,407.63	100.00%	54,642.67	100.00%

报告期内，北京矽成普通型 SRAM 产品收入分别为 46,500.66 万元、48,515.02 万元、17,794.23 万元，为 SRAM 产品中的主要类型，占 SRAM 产品销售收入的 85.10%、86.01%、85.28%。高速型 SRAM 产品占比较小，报告期内分别实现收入 8,142.01 万元、7,892.60 万元、3,072.54 万元，占各期 SRAM 产品销售收入的比重分别为 14.90%、13.99%、14.72%。

④FLASH 收入分析

FLASH 即闪存芯片，主要包含目前全球主流的 NOR FLASH 存储芯片和 NAND FLASH 存储芯片。北京矽成 FLASH 收入主要源自于包含各类 NOR FLASH 和 NAND FLASH 等在内的存储芯片（以下简称“P-FLASH”）销售，以及与嵌入式闪存专利技术相关的使用授权（以下简称“P-Fusion”）。FLASH 主要应用于汽车电子和工业制造领域，报告期内，FLASH 收入分别为 19,541.48 万元、35,216.17 万元、15,675.67 万元，占报告期各期的主营业务收入的比重分别为 7.78%、12.24%、13.45%，对收入的贡献逐年提升。

报告期内，FLASH 收入明细情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
P-FLASH	13,332.90	85.05%	30,354.74	86.20%	14,540.32	74.41%
P-Fusion	2,342.76	14.95%	4,861.43	13.80%	5,001.16	25.59%
FLASH 合计	15,675.67	100.00%	35,216.17	100.00%	19,541.48	100.00%

2018 年，北京矽成 FLASH 销售收入较 2017 年增加 80.21%，其中，P-FLASH 实现销售收入 30,354.74 万元，较 2017 年增加 108.76%，主要是随着客户消费需求提升，用于汽车及工业领域的 P-FLASH 产品的销量及价格共同提升所致。

⑤ANALOG 收入分析

ANALOG 即模拟芯片。北京矽成的模拟芯片产品包括功放驱动芯片、LED 驱动芯片、传感芯片等多种类型的芯片，主要应用于汽车电子和消费电子领域。

报告期内，ANALOG 产品分别实现收入 12,940.34 万元、28,033.20 万元、10,983.52 万元，占报告期各期的主营业务收入的比重分别为 5.15%、9.74%、9.43%，2018 年较 2017 年增长 116.63%，主要是随着客户消费需求的提升，主要产品的销量及价格共同提升所致。

（2）主营业务收入按地区分布分析

报告期内，北京矽成主营业务收入按地区分布情况如下表：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
欧洲	34,153.84	29.31%	79,347.15	27.58%	79,336.35	31.58%
中国香港	24,306.09	20.86%	67,417.72	23.43%	58,105.53	23.13%
中国台湾	15,830.23	13.59%	42,049.79	14.61%	28,307.30	11.27%
美国	12,555.08	10.77%	32,507.11	11.30%	30,946.51	12.32%
亚太其他地区	9,117.96	7.83%	20,198.64	7.02%	18,078.61	7.20%
日本	9,113.55	7.82%	19,846.99	6.90%	15,487.07	6.17%
中国大陆	6,969.34	5.98%	17,067.71	5.93%	13,621.68	5.42%
美洲其他地区	3,228.20	2.77%	5,544.83	1.93%	1,547.50	0.62%
韩国	1,246.64	1.07%	3,744.46	1.30%	5,775.89	2.30%

合计	116,520.92	100.00%	287,724.41	100.00%	251,206.43	100.00%

北京矽成下属经营实体 ISSI 成立已逾 20 年，主要客户覆盖了美国、欧洲、日本、中国、亚太等全球主要国家和地区。报告期内，北京矽成主要收入来自于欧洲、中国香港、中国台湾、美国等地，四地营业收入合计分别为 196,695.69 万元、221,321.77 万元、86,845.24 万元，占营业收入的比重分别为 78.30%、76.92%、74.53%。上述按照地区区分的收入统计口径为客户所在地，因为各地区净利润的计量除需扣减产品成本外，还需要按照地区将销售费用、管理费用、财务费用以及资产减值损失等在各会计主体之间划分，北京矽成的会计实体并非按照国别区分设立，基于北京矽成现有的组织架构，无法按照国别统计净利润。

报告期内，北京矽成源自中国大陆的收入占比相对较低，主要是因为北京矽成主要经营实体 ISSI 在私有化完成前，是一家面向全球市场开展业务的美国纳斯达克上市公司，产品海外销售网络发达，但同期 ISSI 对中国芯片市场的开发程度有限。自前次私有化完成后，北京矽成已逐步加强了在中国大陆在内的产品、客户和渠道的拓展，报告期内中国大陆的营业收入稳步提升，2018 年较 2017 年增加 3,446.03 万元，增长 25.30%，其占整体营业收入的比重也由 2017 年的 5.42% 上升至 2018 年的 5.93%。2019 年 1-5 月，中国大陆的营业收入占整体营业收入的比重为 5.98%。

目前，中国大陆正处于消费电子产品的后普及时期，在产品差异化及消费升级等概念的带动下，新产品的出货仍将保持较高水平；中国大陆的汽车市场较全球处于更为快速发展的阶段，随着国有自主品牌整车厂的蓬勃发展以及新能源汽车的大规模普及，中国对汽车电子的需求有望持续增长；同时，随着我国工业技术的进步、自有工业品牌的发展及人工智能发展的时代背景，各类集成电路产品将迎来较大的产品需求。因此，随着北京矽成在中国大陆业务的拓展，预计中国大陆产生的收入对整体营业收入的贡献将进一步提升。

2、营业成本分析

报告期内，北京矽成按主要产品列示的主营业务成本的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年

	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	73,015.64	93.82%	173,357.53	93.25%	152,245.93	96.27%
DRAM	51,058.82	65.61%	119,984.15	64.54%	108,467.61	68.59%
SRAM	11,348.03	14.58%	30,691.33	16.51%	31,112.89	19.67%
FLASH	10,608.80	13.63%	22,682.05	12.20%	12,665.43	8.01%
模拟芯片	4,808.11	6.18%	12,544.77	6.75%	5,901.63	3.73%
ANALOG	4,808.11	6.18%	12,544.77	6.75%	5,901.63	3.73%
主营业务成本	77,823.76	100.00%	185,902.30	100.00%	158,147.56	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-
合计	77,823.76	100.00%	185,902.30	100.00%	158,147.56	100.00%

报告期内，北京矽成的营业成本均为主营业务成本，分别为 158,147.56 万元、185,902.30 万元、77,823.76 万元。随着北京矽成主营业务收入的增长，其主营业务成本同步增长。

同主营业务收入的构成情况一致，报告期内，北京矽成的主营业务成本主要源自存储芯片，报告期内，源自存储芯片的营业成本分别为 152,245.93 万元、173,357.53 万元、73,015.64 万元，占营业成本的比重分别为 96.27%、93.25%、93.82%。

3、营业毛利及毛利率分析

（1）营业毛利分析

报告期内，北京矽成按产品类别列示的主营业务毛利的构成如下表：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存储芯片	32,521.75	84.04%	86,333.68	84.79%	86,020.16	92.44%
DRAM	17,936.14	46.35%	48,083.26	47.22%	55,614.33	59.76%
SRAM	9,518.75	24.60%	25,716.30	25.26%	23,529.78	25.28%
FLASH	5,066.87	13.09%	12,534.12	12.31%	6,876.05	7.39%
模拟芯片	6,175.41	15.96%	15,488.42	15.21%	7,038.71	7.56%
ANALOG	6,175.41	15.96%	15,488.42	15.21%	7,038.71	7.56%
主营业务毛利	38,697.16	100.00%	101,822.10	100.00%	93,058.87	100.00%
其他业务毛利	-	-	-	-	-	-

合计	38,697.16	100.00%	101,822.10	100.00%	93,058.87	100.00%

报告期内，北京矽成营业毛利分别为 93,058.87 万元、101,822.10 万元、38,697.16 万元，均为主营业务毛利。存储芯片产品是北京矽成主营业务毛利的主要来源，其占报告期各期主营业务毛利的比重分别为 92.44%、84.79%、84.04%，与主营业务收入和成本的构成情况基本一致。

报告期内，DRAM 产品的毛利规模分别为 55,614.33 万元、48,083.26 万元、17,936.14 万元，其毛利占主营业务毛利的比重分别为 59.76%、47.22%、46.35%，是北京矽成毛利占比最高的产品。2018 年，DRAM 的毛利较 2017 年降低 13.54%，且占主营业务毛利的比重亦下降，主要系 DRAM 产品的晶圆采购成本增加所致。与此同时，随着 FLASH、ANALOG 产品的收入规模增长较大，其毛利水平亦大幅增长，使得 DRAM 产品的毛利占比进一步减小。

报告期内，SRAM 产品的毛利水平分别为 23,529.78 万元、25,716.30 万元、9,518.75 万元，其毛利占主营业务毛利的比重分别为 25.28%、25.26%、24.60%，较为稳定。

报告期内，FLASH 产品的毛利水平分别为 6,876.05 万元、12,534.12 万元、5,066.87 万元。伴随着客户需求及销售价格的提升，北京矽成 P-FLASH 的营业收入快速增长，相应的毛利水平也呈现快速增长趋势，2018 年较 2017 年增长 82.29%。与此同时，FLASH 产品毛利占主营业务毛利的比重亦逐年提升，报告期内占比分别为 7.39%、12.31%、13.09%。

报告期内，ANALOG 产品的毛利水平分别为 7,038.71 万元、15,488.42 万元、6,175.41 万元，其占主营业务毛利的比例分别为 7.56%、15.21%、15.96%。随着 ANALOG 产品销量及销售价格的提升，其营业收入快速增长，相应的毛利水平也呈现快速增长趋势，占主营业务毛利的比重亦逐年提升。

（2）毛利率分析

①主营业务毛利率变动分析

报告期内，北京矽成毛利率情况如下表所示：

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
存储芯片	30.82%	33.24%	36.10%

DRAM	26.00%	28.61%	33.89%
SRAM	45.62%	45.59%	43.06%
FLASH	32.32%	35.59%	35.19%
模拟芯片	56.22%	55.25%	54.39%
ANALOG	56.22%	55.25%	54.39%
主营业务毛利率	33.21%	35.39%	37.04%
综合毛利率	33.21%	35.39%	37.04%

报告期内，北京矽成的综合毛利率分别为 37.04%、35.39%、33.21%，其中，主营业务毛利率水平分别为 37.04%、35.39%、33.21%，报告期内北京矽成毛利率略有下降的原因主要为占收入比重最大的 DRAM 产品的采购成本上升而使其毛利水平下降所致。

从产品类别来看，毛利率情况主要如下：

A. DRAM 产品的毛利率由 2017 年的 33.89% 下降至 2019 年 1-5 月的 26.00%，主要系 DRAM 产品的晶圆采购价格上升，使得 DRAM 产品的整体营业成本上升所致。

B. SRAM 产品的毛利率水平较高，报告期内毛利率分别为 43.06%、45.59%、45.62%，稳中有升。SRAM 拥有较高毛利率的主要原因为 SRAM 产品在读写速度较 DRAM 等存储芯片更快，产品技术含量以及定制化设计的需求较高，在采购成本及销售需求整体稳定的情况下，毛利率保持较高水平。

C. 报告期内，FLASH 产品的毛利率分别为 35.19%、35.59%、32.32%。2019 年 1-5 月，FLASH 产品的毛利率有所下降，主要原因为 P-FLASH 的产品结构发生变化，随着更高集成性产品销售的提升，其单位成本上升。

D. 报告期内 ANALOG 系列产品的毛利率分别为 54.39%、55.25%、56.22%，毛利率水平较高且较为稳定，主要系销售价格增长所致，且其收入、成本的构成较为稳定。

②与同行业 A 股上市公司毛利率对比分析

最近两年，同行业可比上市公司毛利率情况如下：

证券代码	公司简称	2018 年	2017 年

002049.SZ	紫光国微	30.15%	33.14%
300458.SZ	全志科技	34.20%	39.12%
300672.SZ	国科微	41.66%	40.40%
603986.SH	兆易创新	38.25%	39.16%
平均值		36.06%	37.95%
中位值		36.22%	39.14%
北京矽成		35.39%	37.04%

数据来源：Wind 资讯、上市公司公告

北京矽成的毛利率水平略低于同行业可比上市公司的平均毛利率水平，主要系其与 A 股同行业可比上市公司在产品结构上存在差异所致。目前，A 股中暂无与北京矽成从事相同主营产品的上市公司。北京矽成主营 DRAM、SRAM、FLASH 存储芯片和 ANALOG 模拟芯片业务，且主要利润源自 DRAM。上述可比公司与北京矽成存在部分相同或相似的产品类别。紫光国微存在 DRAM 存储芯片业务，但占其主营业务比重较少；全志科技存在部分存储芯片业务，但占其主营业务比重亦较少；国科微存在物联网系列芯片业务，与北京矽成部分产品的下游应用相似，但占其主营业务的比重较小；兆易创新主营 FLASH 存储芯片业务。

紫光国微的主营业务涵盖 DRAM 存储芯片，2017 年和 2018 年其存储芯片的收入仅占紫光国微主营业务的 18.30%和 26.24%，且存储芯片毛利率仅为 7.10%和 7.62%。北京矽成 DRAM 产品毛利率远高于紫光国微，表明作为老牌存储芯片企业在技术研发实力、规模效应、产品议价等方面占据优势。

全志科技的存储芯片业务在 2017 年和 2018 年占其主营业务收入的比重分别为 4.12%和 10.81%，其毛利率分别为 10.87%和 7.87%。北京矽成的存储芯片毛利率远高于全志科技，与涉足存储芯片领域较晚的全志科技相比，在技术实力、规模效应、议价能力等方面均具有绝对优势。

国科微的物联网芯片业务在 2017 年和 2018 年的毛利率分别为 40.46%和 37.65%，略高于北京矽成的毛利率。由于国科微和北京矽成在具体细分产品类别上存在差异，毛利率水平存在略微差异属合理范围。

兆易创新作为国内主营 FLASH 芯片的上市公司，在 2017 年和 2018 年其存储芯片的毛利率分别为 37.61%和 37.04%。北京矽成 FLASH 产品的毛利率低于

兆易创新，一方面系因其 FLASH 产品的收入较兆易创新小，其整体规模效应不如兆易创新；另一方面前次私有化 ISSI 时形成评估增值，在报告期内产生合并对价分摊（purchase price allocation），相关分摊会降低各产品的毛利率。

整体而言，在 2018 年 DRAM 产品晶圆采购成本上升的背景下，北京矽成依然可以保持相对较高的毛利率水平，体现了其较强的规模效应、研发实力和议价能力：

一方面，北京矽成作为一家专注于高性能存储芯片的研发设计、技术支持和销售的公司，在研发方面一直秉承采用先进制程为客户开发设计产品的理念，在产品工艺上始终保持行业前沿。经过长期研发积累，北京矽成形成了相对完整的自主知识产权成果，并打造了面向专用领域存储芯片的丰富产品业务体系。

另一方面，北京矽成的产品主要面向专业领域行业，包括汽车行业、工业级医疗行业以及通讯等领域。凭借行业领先的研发技术，其产品在汽车传动系统、汽车安全系统、驾驶信息系统、信息娱乐系统中都有较强竞争力，同时在高精确度、高自动化的工业及通讯领域具有一定的市场份额，受到专业领域客户的广泛认可，并形成了长期合作的客户网络以及一定的议价能力。

③与境外同行业可比上市公司毛利率对比分析

北京矽成采用 Fabless 的经营模式，专注于芯片的研发、设计和销售，无自有生产车间进行晶圆生产，芯片封装和测试主要通过委托代工方式实现。北京矽成的主要产品按照产品类型可分为 DRAM、SRAM、FLASH 和 ANALOG，主要应用于汽车电子、工业制造、消费、通讯等领域。

2017 年和 2018 年，北京矽成与境外同行业上市公司综合毛利率情况对比如下：

证券代码	公司名称	2018 年	2017 年
2344.TW	华邦电子	37.41%	34.30%
3006.TW	晶豪科技	18.42%	19.67%
CY.O	赛普拉斯	37.50%	41.13%
MU.O	美光科技	58.87%	41.51%
平均值		38.05%	34.15%
中位值		37.46%	37.72%

北京矽成	35.39%	37.04%

注：美光科技以距每年 8 月 31 日最近的星期四结束的第 52 或 53 个星期为一财年

虽然境外同行业上市公司在经营模式、主要产品类别及应用领域等方面与北京矽成存在一定差异，但 2017 年和 2018 年，北京矽成综合毛利率与境外同行业上市公司毛利率不存在重大差异，处于合理区间，具有合理性。

4、期间费用分析

报告期内，北京矽成的期间费用及占当期营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月		2018 年		2017 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
销售费用	10,281.50	8.82%	23,441.25	8.15%	23,001.01	9.16%
管理费用	4,317.17	3.71%	12,394.57	4.31%	14,974.66	5.96%
研发费用	14,322.51	12.29%	35,041.51	12.18%	31,775.06	12.65%
财务费用	-553.81	-0.48%	-1,354.33	-0.47%	553.52	0.22%
期间费用合计	28,367.38	24.35%	69,523.00	24.16%	70,304.25	27.99%

报告期内，北京矽成的期间费用分别为 70,304.25 万元、69,523.00 万元、28,367.38 万元，占当期营业收入的比重分别为 27.99%、24.16%、24.35%，保持相对稳定。

最近两年，同行业可比上市公司期间费用率情况如下：

证券代码	公司简称	2018 年	2017 年
002049.SZ	紫光国微	18.46%	19.11%
300458.SZ	全志科技	26.23%	40.74%
300672.SZ	国科微	45.91%	47.05%
603986.SH	兆易创新	17.25%	17.71%
平均值		26.96%	31.15%
中位值		22.34%	29.93%
北京矽成		24.16%	27.99%

数据来源：Wind 资讯、上市公司公告

最近两年，北京矽成的期间费用率略低于同行业可比上市公司，但处于各公司的区间范围内，与同行业可比上市公司不存在重大差异。

（1）销售费用分析

北京矽成的销售费用主要为销售相关人员的职工薪酬、销售佣金、差旅费等。报告期内，销售费用金额分别为 23,001.01 万元、23,441.25 万元、10,281.50 万元，北京矽成的销售费用变动趋势同主营业务的经营状况保持一致，但占营业收入的比例整体略有下降，分别为 9.16%、8.15%、8.82%。北京矽成的销售费用具体如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
职工薪酬	4,809.23	11,043.82	12,053.00
销售佣金	2,239.26	4,991.52	4,426.66
差旅费	377.51	1,000.24	860.08
运费	334.67	805.07	686.96
外包服务费	278.57	399.55	264.04
销售产品样本费	241.35	532.11	293.39
广告费	220.56	226.60	155.64
股份支付	181.45	412.85	559.48
折旧与摊销	175.06	424.55	411.57
租金	104.38	544.52	501.45
其他	1,319.46	3,060.39	2,788.73
合计	10,281.50	23,441.25	23,001.01

随着营业收入的增长，2018 年北京矽成的销售费用较 2017 年仅增加 1.91%，且占营业收入的比重亦较 2017 年略有下降，主要原因为 2017 年确认了相对较多的销售人员现金奖励计入当期职工薪酬；同时，随着北京矽成激励计划的逐年授予，2018 年较 2017 年的授予比例降低，计提的股份支付费用相应减少。

（2）管理费用分析

北京矽成的管理费用主要由职工薪酬、中介机构服务费和股份支付等构成。报告期内，北京矽成管理费用金额分别为 14,974.66 万元、12,394.57 万元、4,317.17 万元，管理费用占营业收入的比例分别为 5.96%、4.31%、3.71%。北京矽成的管理费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	2,237.08	5,808.67	7,908.98

股份支付	716.36	1,689.47	2,289.47
中介服务费	460.28	2,467.97	2,637.33
折旧与摊销	282.21	716.16	726.44
维修费	239.92	592.52	542.50
租金	103.27	236.29	188.06
保险费	95.37	223.33	213.96
差旅费	87.86	290.63	250.89
办公费	85.36	224.24	158.40
其他	9.46	145.30	58.63
合计	4,317.17	12,394.57	14,974.66

2018 年，北京矽成管理费用较 2017 年减少 17.23%，且占营业收入的比重亦较 2017 年略有下降，主要原因为 2017 年确认了相比 2018 年更高的管理人员现金奖励，计入当期职工薪酬；同时，随着北京矽成激励计划的逐年授予，2018 年较 2017 年的授予比例降低，计提的股份支付费用相应减少。

（3）研发费用分析

①研发费用基本情况

北京矽成的研发费用主要由外包服务费、研发相关人员的职工薪酬、股份支付、模具费等构成。报告期内，北京矽成研发费用金额分别为 31,775.06 万元、35,041.51 万元、14,322.51 万元，研发费用占营业收入的比例分别为 12.65%、12.18%、12.29%，占比较为稳定。北京矽成的研发费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
外包服务费	5,548.26	15,127.55	11,033.14
职工薪酬	4,937.12	11,987.19	13,235.82
原材料及测试费	643.71	649.63	751.05
股份支付	639.54	1,508.29	2,043.94
授权使用费	461.31	1,081.67	659.23
折旧与摊销	446.26	796.65	648.82
专家咨询费	437.48	1,106.63	607.21
模具费	322.44	977.35	1,284.95
租金	199.21	440.03	215.64

办公费	176.11	334.22	454.43
其他	511.08	1,032.31	840.84
合计	14,322.51	35,041.51	31,775.06

2018 年，北京矽成研发费用较 2017 年增加 10.28%，主要原因为随着主营业务的开展，2018 年较 2017 年产生了更多的研发外包服务、专家咨询和授权使用等相关费用。

②研发外包的具体构成及类型、研发外包的原因、对主营业务的影响

A. 研发外包的具体构成及类型

报告期内，北京矽成的研发外包服务费分别为 11,033.14 万元、15,127.55 万元和 5,548.26 万元，主要系北京矽成在自身研发工作基础上对外采购的相关研发服务费用。

北京矽成的整体研发流程主要包括立项讨论、内部研发、循环验证、小批及大批量产等环节。产品研发的核心环节在于根据市场需求及技术变化趋势进行新产品的定义、立项及相应的内部研发工作，形成相应的研发成果；工程样片循环验证、小批及大批量产亦是新产品实现批量生产的重要保证。北京矽成外包服务主要包括部分芯片产品在工程样片循环验证、小批及大批量产阶段提供仿真、测试、设计支持、制造咨询等工作，为前期研发设计阶段提供一定的支持性服务，以及芯片需要的部分标准 IP 及设计服务。

B. 研发外包的原因

a. 北京矽成研发的主要流程

北京矽成的整体研发流程主要包括立项讨论、内部研发、循环验证、小批及大批量产等环节。产品研发的核心环节在于根据市场需求及技术变化趋势进行新产品的定义、立项及相应的内部研发工作，形成相应的研发成果；工程样片循环验证、小批及大批量产亦是新产品实现批量生产的重要保证。北京矽成外包服务主要包括部分芯片产品在工程样片循环验证、小批及大批量产阶段提供仿真、测试、设计支持、制造咨询等工作，为前期研发设计阶段提供一定的支持性服务，以及芯片需要的部分标准 IP 及设计服务。

b. 研发外包对应的主要阶段

工程样片循环验证阶段分为产品工程验证及客户要求验证。产品工程验证涉及品质测试、特征测试、可靠性测试、压力测试、失效分析、阿尔法测试和贝塔测试等一系列严格而高标准的检测；而客户要求验证则由产品工程师从产品的工作特征可靠性以及工艺稳定性能的角度出发，检测新产品是否满足客户对于芯片产品在整机组装后的工作表现。若经过产品工程验证及客户要求验证后，有任何一项未达到产品的性能和特征要求或是未能满足客户的要求，设计工程师需要对产品设计或是工艺过程做重新调整，并对物理图版做修改，对收到的新样品再次进行产品工程验证及客户要求验证直至完全满足要求。该阶段需要较多人力执行循环的较为重复性的工作，才能达到产品的性能和特征完全满足客户要求。

小批及大批量产阶段，是在上述循环验证完成之后，芯片产品进入小批量或大批量生产时，对量产环节中发现的问题继续进行相应的产品工程验证和客户要求验证。因为不论是小批量还是大批量生产，量产流程和工程样片的流程存在差异，量产制造芯片必须质量过关才能满足车规和工业级的要求。因此，在量产过程中若仍发现芯片瑕疵，或者受了客户的相关问题反馈，则须继续实行相应的循环验证，以便准确定位问题的关键并妥善解决。

c. 研发外包系综合考虑人员技术及成本

北京矽成的核心技术管理团队主要位于美国、中国大陆、以色列，芯片研发团队及人员主要分布在美国、韩国、以色列及中国大陆等地。北京矽成根据研发各阶段的工作内容，在综合考量研发人员技术水平、人力成本的基础上，将部分上述几大阶段所需的仿真、测试、设计支持及制造咨询等部分研发支持性工作外包给专业化程度较高、人工成本较低的第三方，既有助于北京矽成集中精力聚焦研发最核心的部分，又能够以相对较低的人力成本和较高的技术标准有效完成整体研发工作，兼具研发效率及研发质量，具有合理性。

C. 研发外包不会对北京矽成主营业务造成重大不利影响

北京矽成的研发外包情况系根据产品研发各阶段的工作内容，在综合考量研发的技术含金量、人员技术水平、人力成本的基础上，将部分研发支持性工作外包给专业化程度较高、人工成本较低的第三方，既有助于北京矽成集中精力聚焦研发最核心的部分，又能够以相对较低的人力成本和较高的技术标准有效完成整

体研发工作，不会对主营业务发展造成重大不利影响。

③外包服务费用占北京矽成研发费用比例较高的原因及合理性，是否会对外包机构产生重大依赖

A. 外包服务费用占研发费用比例较高的原因及合理性

报告期内，北京矽成研发外包服务费分别为 11,033.14 万元、15,127.55 万元和 5,548.26 万元，占研发费用的比例分别为 34.72%、43.17%和 38.74%，占比较高，主要原因如下：

a. 研发外包多以循环重复性阶段为主

如前文所述，北京矽成的整体研发流程主要包括立项讨论、内部研发、循环验证、小批及大批量产等环节，而产品研发的核心在于立项论证和内部研发，即根据市场需求及技术变化趋势进行新产品的定义、立项及相应的内部研发工作，形成相应的研发成果。循环验证及后续的小批及大批量产需要从事仿真、测试等较多重复性的过程后，才能达到产品的性能和特征完全满足客户要求，具有循环重复多、持续时间长的特点。由于北京矽成研发外包的内容主要包括为工程样片循环验证、小批及大批量产阶段提供仿真、测试、设计支持、制造咨询等工作，鉴于其具有持续性，相关服务费用的金额较高具有合理性。

b. 较高的研发投入是维持产品质量和市场地位的重要保障

北京矽成作为专注于面向全球专用领域的集成电路芯片设计公司，其产品在汽车行业、工业级医疗行业以及通讯、消费电子等行业具有较强的竞争力，其主要产品 SRAM、DRAM 的收入分别位居全球前二位、前八位，位居市场前列，与国际知名客户保持了良好合作关系。较强的竞争力源于北京矽成对产品品质和性能的重视与追求，也因此对产品在设计及后续各项测试等环节中做好严格有效的控制和管理，使得产品最终通过客户的不断验证，获得市场的认可。报告期内，与各项测试及研发设计支持相关的外包服务费用占比较高，存在合理性。

c. 北京矽成享有研发外包产生的专利技术

北京矽成与主要研发外包提供商签署了服务协议，北京矽成享有外包提供商在服务过程中所衍生的包括但不限于创意、技术、程序、流程、发明、发现、概

念、经验、专利及其应用、商标、图形、软件著作权等全部无形财产的所有权，因此，形成的产品技术专利均由北京矽成享有，技术水平不存在重大对外依赖的情形。

d. 本次交易的评估作价已综合考虑北京矽成的业绩

本次交易中，北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，系由交易双方参考评估结果后协商一致得出。评估机构在以收益法评估北京矽成股权价值时，已综合考虑了包括北京矽成的发展前景、收入水平、研发投入等各项指标。

综上所述，研发外包服务费用占研发费用较高系与其研发的整体流程与模式相关，将循环验证及后续的小批及大批量产相关的仿真、测试等较多重复性过程为主的部分外包；而研发外包服务费较高也进一步表明，北京矽成注重产品品质，有助于获得市场与客户的认可，塑造较强的行业竞争力；此外，研发外包提供商仅提供相关服务，技术专利均由北京矽成享有，北京矽成的技术不存在重大对外依赖。

B. 北京矽成不会对外包机构产生重大依赖

北京矽成的研发外包不会造成其对外包机构产生重大依赖，主要原因如下：

a. 北京矽成拥有自身研发团队

北京矽成高度重视研发团队的建设，对研发团队进行全球化配置以充分利用不同国家及地区业内优秀研发人员的前沿设计技术及丰富设计经验。北京矽成研发部门下设“设计工程部”、“产品测试部”、“质量管理部”及“技术发展部”四个子部门，该等部门的主要职责如下：

部门	主要职责
设计工程部	主要负责芯片产品的主体设计工作，该部门在全球范围内一共配备了三个 DRAM 设计团队、一个 SRAM 团队、三个 FLASH 设计团队和一个 ANALOG 设计团队
产品测试部	主要负责按照客户的要求以及相应标准对芯片产品进行循环验证的测试工作
质量管理部	主要负责芯片产品研发立项至小批量生产再至送达客户接收的整个过程中的操作规范/标准的制定、监督以及质量控制
技术发展部	主要负责对接与协调晶圆代工厂，对每个晶圆代工厂在芯片产品生产过程中的不同制程与生产环境等要求或标准进行协调与辅导，以满足芯成产品的生产制造要求

截至 2019 年 5 月 31 日，北京矽成共有研发人员 231 人，占员工总数的 44.59%，研发人员主要分布在美国硅谷及科罗拉多、韩国、北京、上海、厦门、武汉、以色列等地。

b. 严格管控研发流程

北京矽成一整套科学、规范的研发流程。从最初的新产品立项讨论、设计标准检验，经过客户以及工程部对产品规格和性能的循环检验，直至最后产品开始小规模生产，北京矽成缜密而严格的研发管理体系，确保了产品从设计到量产的过程中，每一个重要环节都得到有效的控制和管理，最终通过客户的不断验证，获得市场的认可。

c. 北京矽成享有研发的专利与技术成果

北京矽成与主要研发外包提供商签署了服务协议，北京矽成享有外包提供商在服务过程中所衍生的包括但不限于创意、技术、程序、流程、发明、发现、概念、经验、专利及其应用、商标、图形、软件著作权等全部无形财产的所有权，因此，形成的产品技术专利均由北京矽成享有，技术水平不存在重大对外依赖的情形。截至本报告书出具日，北京矽成及其境内外子公司共拥有 240 项注册专利和 90 项集成电路布图设计。

（4）财务费用分析

报告期内，财务费用明细如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
利息支出	-	65.08	181.38
减：利息收入	719.31	1,452.32	1,249.01
减：汇兑收益	-90.16	65.32	-1,541.13
加：其他支出	75.34	98.24	80.02
合计	-553.81	-1,354.33	553.52

报告期内，北京矽成财务费用分别为 553.52 万元、-1,354.33 万元、-553.81 万元。报告期内，北京矽成的银行存款金额较高，利息收入较高；北京矽成合并口径的银行借款较少，并于 2018 年 5 月完成了借款的偿还，利息支出较少，2019 年 1-5 月无利息支出；受汇率波动影响，2017 年汇兑损失较大。受上述因素的共

同影响，2017年北京矽成的财务费用为正数，而2018年、2019年1-5月的财务费用为负数。

报告期内，北京矽成的汇兑收益主要系其主要经营实体为境外注册的公司（主要经营地位于美国和台湾），境外经营实体及其各子公司均根据其经营所处的主要经济环境以其本国（地区）货币作为记账本位币，各实体报告期内的日常交易会受汇率波动的影响。

5、利润表其他项目分析

（1）资产减值损失

报告期内，北京矽成的资产减值损失分别为-5,806.44万元、-4,201.16万元、-1,259.16万元，其中存货跌价损失分别为-5,806.44万元、-4,192.91万元、-1,238.04万元，系主要的资产减值损失。北京矽成的存货跌价准备的变动情况如下：

单位：万元

项目	原材料	在产品	库存商品	合计
2016年12月31日	2,567.16	824.47	5,218.00	8,609.63
2017年增加额	1,006.74	-	4,799.70	5,806.44
2017年减少额	268.13	291.50	3,491.74	4,051.37
汇率折算差额	-171.86	-38.88	275.45	64.71
2017年12月31日	3,133.90	494.09	6,801.41	10,429.41
2018年增加额	557.63	-	3,665.35	4,222.98
2018年减少额	522.01	186.08	5,004.68	5,712.77
汇率折算差额	159.03	18.44	10.74	188.20
2018年12月31日	3,328.55	326.46	5,472.82	9,127.82
2019年1-5月增加额	-	-	1,238.04	1,238.04
2019年1-5月减少额	-	-	849.29	849.29
汇率折算差额	-173.58	-17.02	3.59	-187.00
2019年5月31日	3,154.97	309.44	5,865.15	9,329.56

北京矽成按照成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。北京矽成通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2018 年，北京矽成的存货跌价损失较 2017 年有所下降，主要原因系原计提跌价准备的产品实现销售，当期转销金额大于当期计提金额所致。

（2）其他收益

其他收益系北京矽成获得的政府补助。报告期内，北京矽成其他收益分别为 94.61 万元、186.70 万元、60.14 万元，均系当期计入损益的政府补助。

（3）资产处置收益

北京矽成的资产处置收益为处置固定资产的收益。报告期内，北京矽成的资产处置收益分别为 52.20 万元、5.30 万元、-3.64 万元。

（4）营业外收入和支出

报告期内，北京矽成的营业外收入分别为 184.00 万元、314.05 万元、65.72 万元，主要包括废料收入和其他收入（废旧的 IC、模具清除收入、部分赔偿收入等）。

报告期内，北京矽成的营业外支出分别为 35.75 万元、50.21 万元、2.66 万元，金额较小，主要包含罚款滞纳金、未收回押金、资产处置费等支出。

（5）所得税费用

①所得税费用基本情况

报告期内，北京矽成的所得税费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
当期所得税费用	2,105.84	2,800.79	6,356.23
递延所得税费用	-396.70	1,080.46	4,715.83
合计	1,709.14	3,881.25	11,072.06

报告期内，北京矽成合并财务报表的所得税费用分别为 11,072.06 万元、3,881.25 万元、1,709.14 万元，占当期税前利润总额的比重分别为 64.84%、13.67%、18.75%。2017 年，北京矽成的所得税费用规模较大的主要原因为：①受美国税改影响，北京矽成下属主要经营实体需对以前年度免税利润征收过渡税，同时控股国外公司取得的未分配利润也应缴纳企业所得税，由此导致对海外子公司的纳税影响较大；②美国税改后，企业所得税税率由 35%降低为 21%，由此产生期

初可抵扣暂时性差异所导致对递延所得税资产的影响；③此外，彼时美国 35% 的企业所得税率与中国的企业所得税率存在差异，ISSI 等海外经营实体在中国境内的子公司需额外缴纳 10% 的差额税收。

报告期内，按照中国境内企业法定所得税税率计算的所得税费用分别为 4,269.27 万元、7,095.85 万元、2,278.68 万元。因子公司使用不同税率、同时受美国税收改革等影响，报告期内，所得税费用调整金额分别为 6,802.79 万元、-3,214.59 万元、-569.54 万元，对北京矽成的所得税费用影响较大。会计利润调整为所得税费用的过程如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
本期合并利润总额	9,114.72	28,383.39	17,077.09
按适用税率 25% 计算的所得税费用	2,278.68	7,095.85	4,269.27
子公司适用不同税率的影响	-603.39	-5,324.45	-1,724.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5.22	8.99	362.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	118.25	109.23
调整以前期间所得税影响	-	1,251.40	1,967.32
美国税收改革对海外子公司的纳税影响	-	-	7,945.80
研发费用加计扣除的纳税影响	-34.89	-33.77	-131.56
利润分配预提所得税费用	-	-610.32	-1,775.04
子公司重组对所得税费用的影响	-	1,360.01	-
其他	63.52	15.29	49.04
所得税费用	1,709.14	3,881.25	11,072.06

②北京矽成 2017 年确认所得税对应相关科目金额的具体依据、合理性及合规性

美国参议院及众议院于美国时间 2017 年 12 月 20 日通过《减税与就业法案》，美国总统特朗普于美国时间 2017 年 12 月 22 日签署了上述法案，该法案于 2018 年 1 月开始实施。税改法案对北京矽成企业所得税费用核算的影响主要包括以下两方面：

A. 对美国企业所控制的符合条件的海外利润征收一次性“过渡税”

美国税法对所有美国公司在海外赚取的利润均征收所得税。美国税改法案签

署前，对于美国公司及其子公司在海外赚取的利润，只有在其利润以分红或投资的形式返回美国时才需要缴纳美国税法规定的企业所得税，在利润返回美国以前暂免征收企业所得税。但根据美国税改法案规定，作为由全球征税制向属地征税制的过渡性政策，对于自 1986 年至税改法案实施前，美国企业及境外子公司赚取的符合税改法案规定的未纳税利润需按照原 35% 的联邦所得税税率缴纳一次性“过渡税”。

B. 美国联邦企业所得税税率从 35% 降至 21%

根据美国税改法案的规定，美国联邦企业所得税税率从 35% 降至 21%，且从 2018 年开始，对美国企业取得的符合条件的境外股息红利实行免税。所得税税率的变化将对北京矽成当期所得税及递延所得税产生较大影响。

依据美国税改法案规定及中国企业会计准则要求，北京矽成 2017 年所得税费用明细如下：

项目	金额（万美元）	金额（万人民币）
一次性“过渡税”（1）	1,178.50	7,945.80
税率变化对递延所得税调整（2）	28.52	192.29
除美国外子公司的所得税费用（3）	566.00	3,816.12
其他	-130.84	-882.15
所得税费用合计	1,642.18	11,072.06

a. 符合美国税改法案规定条件的海外子公司需对其累计境外盈利缴纳一次性“过渡税”。美国财政部在税改法案颁布后陆续推出了实施细则及相关指引，北京矽成在核算当期所得税费用时需要确定以下两方面内容：（1）依据美国税改法案规定对符合受控境外企业的判定以及境外企业自 1986 年以来的累计应纳税利润的认定；（2）对于可用于抵消应纳税额的已纳税股利分配、净经营亏损额和其他抵扣项目的认定及计算。根据现有的美国税改法案及相关细则的规定，北京矽成的主要境外受控企业应缴纳一次性过渡税的应纳税金额为 7,600.77 万美元，可用于抵扣的以前年度已纳税利润分配抵扣额为 4,233.63 万美元。2017 年度，北京矽成因该税改事项影响确定的应纳税所得额为 3,367.14 万美元，计提的一次性“过渡税”为 1,178.50 万美元。

b. 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》规定，资产负债表日，对于当

期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照未来年度转回期间税法规定税率计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。递延所得税资产和递延所得税负债的计量，应当反映资产负债表日企业预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响，即在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，应当采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。因美国税改法案税率调整，北京矽成对美国境内以前年度已确认的递延所得税按照调整后税率进行重新计量，影响金额为 291.78 万美元。同时，依据 ISSI 对其子公司 ICSI 的利润分配在未来期间的安排，北京矽成在 2015 年确认了相应的递延所得税负债。根据 2018 年税改法案对税率的调整，ISSI 对已确认的递延所得税负债进行了重新计算，由此确认的递延所得税负债-263.27 万美元。综上所述，所得税税率调整导致的递延所得税调整金额为 28.51 万美元。

c. 除美国以外其他海外子公司按照其本国/地区税法进行所得税费用的核算。2017 年，除美国以外的海外子公司合计确认的所得税费用为 566.00 万美元，主要由其重要纳税主体 ICSI 和 ISSI Cayman 台湾分公司当期确认的所得税费用构成。2017 年 ICSI 和 ISSI Cayman 台湾分公司的所得税费用分别为 191.31 万美元和 255.08 万美元。

d. 其他事项主要系可抵扣亏损、研发费用抵扣及汇率变化等因素对所得税费用的影响。

综上所述，北京矽成所得税对应相关科目的确认和核算符合美国税改法案的相关规定，其确认依据合理、核算准确。

③主要税种及税率情况

北京矽成及重要子公司所在地主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（中国）	应纳税所得额	15%/25%

税种	计税依据	税率
企业所得税（美国）	应纳税所得额	21%/35%
企业所得税（台湾）	应纳税所得额	17%/20%
企业所得税（香港）	应纳税所得额	16.5%
企业所得税（开曼群岛）	应纳税所得额	0%
企业所得税（日本）	应纳税所得额	15%-24%
企业所得税（新加坡）	应纳税所得额	17%
企业所得税（韩国）	应纳税所得额	24.2%
企业所得税（以色列）	应纳税所得额	23%
增值税（中国）	研发服务收入、商品销售收入等	6%/13%/16%/17%
增值税（台湾）	应税收入	5%
增值税（日本）	应税收入	8%
增值税（新加坡）	应税收入	7%
增值税（韩国）	应税收入	10%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
营利事业所得税（台湾）	未分配盈余	10%

注：美国企业所得税包含联邦税和州税，联邦税按照应纳税所得额的 21%（2018 年以前按照 35%缴纳）缴纳，州税在不同州适用的税率不同；台湾地区企业所得税按照应纳税所得额的 20%缴纳（2018 年以前按照 17%缴纳）。

除上表列示的所得税税率外，北京矽成的税收优惠情况如下：

纳税主体	税收优惠	优惠期间	依据
芯成半导体（上海）有限公司	技术先进型企业所得税减按 15%税率计征	2015.1.14-2018.12.31	JF2014310150155 号技术先进型服务企业证书
矽恩微电子（厦门）有限公司	高新技术企业所得税减按 15%税率计征	2018.12.3-2021.12.2	GR201835100565 号高新技术企业证书
矽恩微电子（厦门）有限公司	技术先进型企业所得税减按 15%税率计征	2018.11.27-2021.11.26	JF20183502000004 号技术先进型服务企业证书

6、非经常性损益分析

报告期内，北京矽成非经常性损益净额明细如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年

非流动资产处置损益	-3.64	5.30	52.20
计入当期损益的政府补助	60.14	186.70	94.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63.06	263.84	148.26
小计	119.56	455.83	295.07
所得税影响额	22.17	67.28	48.86
少数股东权益影响额（税后）	-0.02	-1.08	-0.79
合计	97.37	387.47	245.43

报告期内，北京矽成的非经常性损益净额分别为 245.43 万元、387.47 万元、97.37 万元。北京矽成的非经常性损益主要系固定资产的处置收益、计入当期损益的政府补助以及营业外收支。

报告期内，北京矽成非经常性损益净额占同期净利润的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
非经常性损益总额	119.56	455.83	295.07
非经常性损益净额	97.37	387.47	245.43
归属于母公司所有者的净利润	7,381.42	24,488.94	6,015.76
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	7,284.05	24,101.47	5,770.34
非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润比例	1.32%	1.58%	4.08%

报告期内，北京矽成非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 4.08%、1.58%、1.32%，占比较小，不会对净利润的稳定性产生重大影响。

7、净利润与净利率分析

报告期内，北京矽成的净利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
净利润	7,405.58	24,502.14	6,005.03
归属于母公司所有者的净利润	7,381.42	24,488.94	6,015.76
销售净利率	6.36%	8.52%	2.39%
归属于母公司所有者的销售净利率	6.33%	8.51%	2.39%

报告期内，北京矽成合并财务报表净利润规模分别为 6,005.03 万元、24,502.14 万元、7,405.58 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 6,015.76 万元、24,488.94 万元、7,381.42 万元，销售净利率分别为 2.39%、8.52%、6.36%，归属于母公司股东的销售净利率分别为 2.39%、8.51%、6.33%。

北京矽成 2018 年净利润较 2017 年增长 18,497.11 万元，增幅为 308.03%，对净利润变动的影响因素如下表所示：

单位：万元

项目	对净利润的影响金额（减少以“-”号填列）	各项目影响金额占比
毛利	8,763.24	47.38%
所得税费用	7,190.81	38.88%
小计	15,954.05	86.25%
税金及附加	-4.22	-0.02%
销售费用	-440.24	-2.38%
管理费用	2,580.09	13.95%
研发费用	-3,266.45	-17.66%
财务费用	1,907.85	10.31%
其他收益	92.09	0.50%
资产减值损失	1,605.28	8.68%
资产处置收益	-46.90	-0.25%
营业外收入	130.05	0.70%
营业外支出	-14.46	-0.08%
小计	2,543.06	13.75%
合计	18,497.11	100.00%

由上表可知，北京矽成 2018 年较 2017 年净利润增幅较大，主要系毛利增加和所得税费用降低所致，上述两项因素对 2018 年净利润增加影响金额分别为 8,763.24 万和 7,190.81 万元，合计 15,954.05 万元，占 2018 年净利润增幅的比例达 86.25%，系 2018 年净利润增加的主要原因。

（1）2018 年营业收入增加导致毛利增加

北京矽成 2017 年和 2018 年营业收入分别为 251,206.43 万元和 287,724.41 万元，2018 年较 2017 年增加 36,517.98 万元，增幅为 14.54%。同时，北京矽成 2017 年和 2018 年毛利率分别为 37.04%和 35.39%，毛利分别为 93,058.87 万元和

101,822.11 万元。虽然 2018 年较 2017 年毛利率有所下降，但 2018 年毛利金额较 2017 年增加 8,763.24 万元。北京矽成 2018 年营业收入增加导致毛利金额增加是当年净利润增加的重要因素。伴随着行业整体景气度的提升，2018 年北京矽成营业收入上升，使得当年毛利金额较 2017 年增加 8,763.24 万元。尤其是 FLASH 和 ANALOG，受客户需求和销售均价的提升，2018 年分别实现毛利 12,534.12 万元和 15,488.42 万元，较 2017 年分别增长 82.29%和 120.05%，表现出了较高的成长性，进一步夯实了北京矽成的业绩。

（2）受美国税改因素影响，2018 年所得税费用较低

美国参议院及众议院于美国时间 2017 年 12 月 20 日通过《减税与就业法案》（以下简称“税改法案”），美国总统特朗普于美国时间 2017 年 12 月 22 日签署了上述法案，该法案于美国时间 2018 年 1 月开始实施。根据税改法案，美国联邦企业所得税率将从 35%降至 21%；同时对于自 1986 年至税改法案实施前，美国境外子公司符合税改法案规定的未纳税利润按照原 35%的税率缴纳一次性过渡税。基于上述影响，北京矽成对于截至 2017 年 12 月 31 日在美国以外的子公司未在美国纳税的利润计提相关所得税费用 7,945.80 万元，上述所得税费用为一次性过渡税，2018 年不再存在相关影响。因此，2018 年所得税费用较 2017 年减少 64.95%，进一步增厚了 2018 年的净利润水平。

综上所述，受行业复苏和产品销售的提升，以及美国税改等因素的影响，北京矽成 2018 年的收入及业绩较 2017 年有所增加，具有合理性。

8、与境外同行业公司上下游行业公司的波动趋势对比

北京矽成作为存储芯片和模拟芯片研发设计企业，其上游行业公司主要为晶圆企业和封装测试企业，下游行业公司主要为汽车、工业制造等终端企业。北京矽成境外同行业和上下游行业公司及其报告期内收入、业绩波动状况如下表所示：

公司类型	公司简称	单位	营业收入			毛利			归母净利润		
			2018 年	2017 年	波动	2018 年	2017 年	波动	2018 年	2017 年	波动
标的公司	北京矽成	亿元	28.77	25.12	14.54%	10.18	9.31	9.42%	2.45	0.60	307.08%
同行业	华邦电子	亿新台币	511.90	475.92	7.56%	191.51	163.24	17.32%	72.07	55.51	29.85%

	晶豪科技	亿新 台币	115.55	104.57	10.51%	21.29	20.57	3.51%	7.07	8.65	-18.34%
	美光科技	亿美 元	303.91	203.22	49.55%	178.91	84.36	112.08 %	141.35	50.89	177.76%
	赛普拉斯	亿美 元	24.84	23.28	6.70%	9.31	7.82	19.12%	3.55	-0.81	538.23%
	平均值		-	-	18.58%	-	-	38.01%	-	-	181.87%
	中位值		-	-	9.03%	-	-	18.22%	-	-	103.80%
上游行业	南亚科技	亿新 台币	847.22	549.18	54.27%	466.16	246.44	89.16%	393.62	402.82	-2.28%
	力晶科技	亿新 台币	499.19	463.05	7.80%	152.62	146.60	4.10%	106.91	80.80	32.31%
	南茂科技	亿新 台币	184.80	179.41	3.01%	34.30	32.37	5.96%	11.03	30.27	-63.55%
	矽格股份	亿新 台币	95.41	68.32	39.66%	26.57	18.75	41.71%	11.55	9.89	16.77%
	平均值		-	-	26.19%	-	-	35.23%	-	-	-4.19%
	中位值		-	-	23.73%	-	-	23.84%	-	-	7.24%
下游行业	Continental AG	亿欧 元	444.04	440.10	0.90%	111.05	113.75	-2.37%	28.97	29.85	-2.93%
	Delphi Technologies PLC	亿美 元	48.58	48.49	0.19%	8.97	9.68	-7.33%	3.58	2.85	25.61%
	Aptiv PLC	亿美 元	144.35	128.84	12.04%	27.29	26.14	4.40%	10.67	13.55	-21.25%
	Autoliv	亿美 元	86.78	81.37	6.65%	17.11	16.80	1.88%	1.90	4.27	-55.42%
	平均值		-	-	4.94%	-	-	-0.86%	-	-	-13.50%
	中位值		-	-	3.78%	-	-	-0.24%	-	-	-12.09%

注：美光科技以距每年8月31日最近的星期四结束的第52或53个星期为一财年

数据来源：Wind 资讯、各公司年报

受益于2016年以来集成电路市场景气度的整体提升，2018年北京矽成及境外主要同行业公司的收入和毛利均实现增长。北京矽成的收入和业绩波动与境外主要同行业上市公司的整体情况相一致。同行业公司中的晶豪科技因在2018年存在较大金额的其他利益损失和财务费用，其归母净利润较2017年有所下降。

在集成电路市场景气度提升的背景下，2017年以来芯片行业供给紧张，主要晶圆产品价格及代工价格不同程度上涨，因此，主要上游行业公司的收入和毛利在2018年均实现不同程度提升。而南亚科技在收入和毛利快速增长的同时，归母净利润出现小幅下跌，主要系其在2017年出售美光股票获得较大金额的营业外收益，而2018年同类收支很小所致；南茂科技的归母净利润出现下跌主要

因其在 2017 年处置子公司获得较大金额收益所致。

北京矽成的主要下游行业公司为国际大型的汽车及零部件制造商，其整体规模较大，发展程度较高，其收入和毛利的波动幅度较小。下游行业公司的平均利润水平下降，主要系 Delphi Technologies PLC、Aptiv PLC 和 Autoliv 分别受到税收调整、业务拆分导致的非持续性停止经营收益和反垄断罚金等非经常性因素的影响，对其当年的归母净利润影响较大。

综上所述，北京矽成的收入和业绩波动与行业发展背景相符合，与同行业公司及其上下游行业公司的整体波动趋势相符合，部分同行业公司、上下游行业公司出现反向波动系与其特定情况相关，具备合理性。

（四）现金流量分析

报告期内，北京矽成的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	14,097.02	6,312.56	22,758.33
投资活动产生的现金流量净额	-16,730.50	22,878.53	-8,337.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,433.90	-1,522.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,989.72	990.75	-5,224.76
现金及现金等价物净增加额	-5,623.20	26,747.94	7,673.79

1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
销售商品、提供劳务收到的现金	115,015.87	282,286.27	251,113.73
收到其他与经营活动有关的现金	726.76	1,452.32	458.79
经营活动现金流入小计	115,742.63	283,738.60	251,572.52
购买商品、接受劳务支付的现金	71,826.48	207,769.96	151,763.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12,604.00	30,837.59	40,654.79
支付的各项税费	3,241.43	3,367.77	5,737.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,973.70	35,450.71	30,658.19
经营活动现金流出小计	101,645.61	277,426.03	228,814.18
经营活动产生的现金流量净额	14,097.02	6,312.56	22,758.33

报告期内，北京矽成经营活动产生的现金流入主要是销售商品、提供服务收到的现金，销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入的比例为 99.96%、98.11%、98.71%，经营活动回款状况良好，营业收入增长转化为现金的能力较强。

2018 年，北京矽成经营活动产生的现金流量净额为 6,312.56 万元，较 2017 年减少 72.26%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较 2017 年增加所致。2018 年，伴随着主营业务收入的增加，北京矽成的采购支出同步增加；同时，为了满足未来发展需求，减小因主要供应商晶圆供货紧张及部分供应商因技术升级、产能调整对公司业务带来的影响，2018 年北京矽成提前采购了一定规模的晶圆材料以备后期业务开展所需。

2、投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
收回投资收到的现金	-	50,860.57	-
取得投资收益收到的现金	-	2,087.62	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41.85	333.55
投资活动现金流入小计	-	52,990.04	333.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,242.81	13,149.21	8,670.74
投资支付的现金	12,994.46		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	493.22	16,962.31	-
投资活动现金流出小计	16,730.50	30,111.51	8,670.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,730.50	22,878.53	-8,337.19

报告期内，北京矽成投资活动产生的现金流量净额分别为-8,337.19 万元、22,878.53 万元、-16,730.50 万元。2017 年，北京矽成投资活动现金呈净流出状态，主要原因为 2017 年投资活动现金流入较少，而同期因购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支出相对较大所致。2018 年，北京矽成投资活动现金为净流入，主要原因为融资租赁设备应收款提前收回，产生了 50,860.57 万元的投资收回现金。2019 年 1-5 月，北京矽成的投资活动现金为净流出，主要系支付相关设备款，该等设备为以融资租赁方式出租给力晶科技股份有限公司。

3、筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务所支付的现金	-	2,911.34	1,286.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	522.56	236.28
筹资活动现金流出小计	-	3,433.90	1,522.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,433.90	-1,522.60

报告期内，北京矽成筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,522.60 万元、-3,433.90 万元、0.00 万元，2017 年和 2018 年持续为负值，主要系报告期内无筹资活动现金流入、仅为筹资活动现金流出所致。2018 年，筹资活动产生的现金净流出较 2017 年增加 1,911.30 万元，主要系子公司 ISSI 偿还了抵押借款及相关利息所致。

四、上海承裕的财务分析

信永中和对上海承裕编制的 2017 年、2018 年和 2019 年 1-5 月的备考财务报表及附注进行了审计，并出具了（第 XYZH/2019BJA90486 号）标准无保留意见审计报告。

该备考财务报表对上海承裕于 2019 年 5 月完成的事项假设至 2017 年 1 月 1 日便已完成：上海承裕从闪胜创芯退伙，并将退伙收到的资金向上海承裕的合伙人进行收益分配。

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	31.53	0.01%	31.80	0.01%	315.35	0.10%
以公允价值	281,185.96	99.99%	281,185.96	99.99%	308,533.21	99.90%

计量且其变动计入当期损益的金融资产						
其他应收款	-	-	-	-	0.20	0.00%
其他流动资产	0.06	0.00%	0.06	0.00%	-	-
资产总计	281,217.54	100.00%	281,217.81	100.00%	308,848.76	100.00%

报告期各期末，上海承裕的资产总额分别为 308,848.76 万元、281,217.81 万元和 281,217.54 万元，主要为其持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

上海承裕将其所持有的北京矽成股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2018 年末，上海承裕以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较 2017 年末有所下降，主要系其于 2018 年转让部分北京矽成股权、且对北京矽成的估值判断降低所致。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2019.5.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应交税费	-	-	-	-	2.59	0.00%
应付利息	-	-	-	-	181.19	0.13%
其他应付款	-	-	124,553.00	100.00%	15,223.70	10.85%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	37,451.70	26.70%
长期借款	-	-	-	-	87,387.30	62.31%
负债合计	-	-	124,553.00	100.00%	140,246.48	100.00%

上海承裕的负债主要为其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上海承裕的其他应付款主要系举借并购贷款而向担保方北京亦庄国际投资发展有限公司应付的担保费、向合伙人进行的可转债筹资。截至 2017 年末，其他应付款余额系应付亦庄国投的担保费（截至 2018 年末，上海承裕完成了对并购贷款的偿还），以及向合伙人武岳峰集电、北京青禾借入的可转债（该可转债已于 2018 年偿还完毕）。截至 2018 年末，上海承裕其他应付款系向上海集岑借

入的可转债，2019 年 4 月，上海集岑以上述可转债完成了对上海承裕的债转股事项，因此，截至 2019 年 5 月末，其他应付款余额为 0。

上海承裕的一年内到期的非流动负债和长期借款均系前次私有化 ISSI 时上海承裕作为并购财团之一向中国工商银行借贷的并购贷款，上海承裕共向中国工商银行借贷了 1.95 亿美元的并购贷款，其将一年内到期的部分调整至一年内到期的非流动负债。截至 2017 年 12 月 31 日，上述并购贷款余额为 124,839.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，上海承裕已向银行还清该项并购贷款。

（二）财务指标分析

1、偿债能力分析

报告期内，上海承裕主要偿债能力指标如下：

项目	2019.5.31/ 2019 年 1-5 月	2018.12.31/ 2018 年	2017.12.31/ 2017 年
流动比率	-	2.26	5.84
速动比率	-	2.26	5.84
资产负债率	0.00%	44.29%	45.41%
息税折旧摊销前利润（万元）	-0.30	-6,817.52	27,915.29
利息保障倍数	-	-1.14	3.86

注：以上指标计算公式如下：

- 1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 2、速动比率=（期末流动资产-期末存货净额）/期末流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产*100%
- 4、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+利息支出-利息收入
- 5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出

截至 2018 年末，上海承裕的流动比率、速动比率较 2017 年末下降，主要原因因为截至 2018 年末上海承裕应付上海集岑的可转债 124,553 万元计入其他应付款。截至 2019 年 5 月末，上海承裕无负债，流动比率、速动比率的测算不适用。

截至 2017 年末和 2018 年末，上海承裕的资产负债率分别为 45.41%、44.29%，整体较为稳定；截至 2019 年 5 月末，由于上海承裕无负债，因此资产负债率为 0.00%。

2017 年和 2018 年，上海承裕的息税折旧摊销前利润分别为 27,915.29 万元和-6,817.52 万元，利息保障倍数分别为 3.86 和-1.14。2018 年息税折旧摊销前利

润和利息保障倍数均较 2017 年下降，主要原因为 2017 年末上海承裕对北京矽成的估值判断较 2017 年初增长较大，当期产生了较大金额的公允价值变动收益，而 2018 年末上海承裕对北京矽成的公允价值判断有所降低，产生了较大金额的公允价值变动损失。2019 年 1-5 月，上海承裕的息税折旧摊销前利润-0.30 万元，而当期无利息支出，因此利息保障倍数的测算不适用。

2、营运能力分析

由于上海承裕系半导体行业的投资机构，除持有北京矽成股权外，不存在其他实际经营业务，因此，上海承裕无应收账款、存货等与日常经营相关的科目余额，报告期内亦无营业收入、营业成本发生额，有关营运能力分析指标对上海承裕不适用。

（三）盈利能力分析

报告期内，上海承裕的利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
一、营业收入	-	-	-
减：税金及附加	-	10.30	0.24
管理费用	0.02	16.82	-
财务费用	0.25	5,934.72	7,181.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-11,227.58	27,911.57
投资收益（损失以“-”填列）	-	4,437.88	2.29
二、营业利润	-0.27	-12,751.53	20,731.66
加：营业外收入	-	0.06	1.96
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-0.27	-12,751.47	20,733.62
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-0.27	-12,751.47	20,733.62

1、营业收入及毛利分析

由于上海承裕系半导体行业的投资机构，除持有北京矽成股权外，不存在其他实际经营业务，未发生营业收入及营业成本，因此，营业收入及毛利的分析对

上海承裕不适用。

2、利润表其他项目分析

（1）税金及附加

报告期内，上海承裕的税金及附加分别为 2,357.27 元、102,990.90 元、0.00 元。2018 年，上海承裕的税金及附加较 2017 年增加 4,269.08%，主要系股权转让事宜产生较多印花税所致。2019 年 1-5 月，税金及附加为 0.00 元。

（2）管理费用

上海承裕的管理费用为咨询服务费、年度审计费、差旅费等。报告期内，管理费用分别为 0.00 元、168,163.00 元、241.32 元，金额较小。

（3）财务费用

上海承裕的财务费用主要系并购贷款利息支出，报告期内财务费用分别为 7,181.97 万元、5,934.72 万元、0.25 万元。随着上海承裕的并购贷款逐渐偿还，其财务费用逐年下降。截至 2018 年末，上海承裕的并购贷款已偿还完毕，2019 年 1-5 月无利息支出，其财务费用主要为手续费支出。

（4）公允价值变动损益

上海承裕的公允价值变动损益包含两部分，即所持的北京矽成股权在报告期各期末按照公允价值计量，其公允价值变动计入当期损益，同时因转让部分北京矽成股权而将对应的公允价值变动损益转入投资收益。

2017 年，上海承裕的公允价值变动收益为 27,911.57 万元，主要系当年末对北京矽成的公允价值判断较年初增加较大所致。2018 年，上海承裕的公允价值变动损失为 11,227.58 万元，主要系转让部分北京矽成股权，其对应的公允价值变动损益转入投资收益，且 2018 年末上海承裕对北京矽成的估值有所下降所致。2019 年 5 月末，上海承裕对北京矽成的持股比例及估值较 2018 年末未发生变化，因此最近一期未发生公允价值变动损益。

（5）投资收益

2017 年，上海承裕的投资收益为 2.29 万元，系银行理财产品投资收益。2018 年，上海承裕的投资收益为 4,437.88 万元，系其向 WM、AM、厦门芯华、上海

瑾矽转让所持部分北京矽成股权获得的收益。2019 年 1-5 月，上海承裕未产生投资收益。

（6）营业外收入和支出

报告期内，上海承裕的营业外收入分别为 19,602.49 元、560.00 元、0.00 元，系政府补贴和手续费返还，金额较小。报告期内，上海承裕无营业外支出。

3、净利润分析

报告期内，上海承裕的净利润分别为 20,733.62 万元、-12,751.47 万元、-0.27 万元。2018 年上海承裕的净利润为负且较 2017 年大幅降低，主要原因为 2017 年末上海承裕对北京矽成的估值判断较 2017 年初增长较大，当期产生了较大金额的公允价值变动收益，而 2018 年末上海承裕对北京矽成的公允价值判断有所降低，产生了较大金额的公允价值变动损失。

五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析

（一）本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响

上市公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应及互补效应。报告期内，上市公司致力于在中国研制自主创新 CPU 技术和产品，基于自主 CPU 技术发展了面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的两条产品线，并且已形成可持续发展的梯队化产品布局。北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，在国际市场具备较强的竞争力。

本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位。在质量管控方面，北京矽成已基于产品研发、晶圆采购、封测代工、品质验证及售后服务各环节形成了整套经营模式及管控体系，上市公司在业务性质、内部流程上相类似，在质量管控方面可以进行有效对接，从而保持长期的稳健发展。在技术研发方面，上市公

司可借鉴北京矽成多年的研发经验及团队实力，夯实其在芯片设计领域的综合研发能力，有利于更好地立足本土、着眼全球，开拓新兴的市场机会。在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。在客户及市场规模方面，本次交易完成后公司可充分利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源，增加彼此合作机会，扩展海外市场，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力。

（二）本次交易对上市公司业务的影响

1、本次交易对上市公司业务构成的影响

本次交易前，北京君正主营微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发与销售，本次交易标的公司北京矽成主营存储芯片、模拟芯片的研发与销售。

根据信永中和会计师出具的北京君正备考财务报表审阅报告，假设北京君正于 2018 年 1 月 1 日完成对北京矽成及上海承裕的合并，北京君正 2018 年、2019 年 1-5 月的主营业务收入构成及占比情况如下：

单位：万元

交易前				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
微处理器芯片	5,442.94	47.65%	14,482.46	58.16%
智能视频芯片	5,799.22	50.77%	9,948.55	39.95%
技术服务	119.19	1.04%	115.22	0.46%
其他	60.74	0.53%	354.47	1.42%
合计	11,422.08	100.00%	24,900.70	100.00%
交易后				
项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	收入	比例	收入	比例
存储芯片	105,537.40	82.49%	259,691.21	83.07%
模拟芯片	10,983.52	8.58%	28,033.20	8.97%

微处理器芯片	5,442.94	4.25%	14,482.46	4.63%
智能视频芯片	5,799.22	4.53%	9,948.55	3.18%
技术服务	119.19	0.09%	115.22	0.04%
其他	60.74	0.05%	354.47	0.11%
合计	127,943.00	100.00%	312,625.11	100.00%

本次交易完成后，北京君正将新增存储芯片和模拟芯片的研发和销售。由于北京矽成的芯片主要运用于汽车电子、工业制造、消费电子等领域，因此，本次交易既将丰富上市公司的产品类别，带动公司芯片设计整体技术水平的提升，又将为上市公司带来新领域的优质客户资源。

2、本次交易对上市公司经营发展战略的影响

上市公司坚持“创新技术、自主研发”的技术战略和“开放平台、纵横扩展”的市场战略。在技术上，公司将不断加强研发力度，持续进行技术创新，密切关注产业发展动向，及时布局产业的关键性核心技术，根据市场变化进行新产品的规划与研发。在市场上，充分发挥自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，积极寻找和拓展适合公司产品的市场领域，及时跟进新市场，抓住未来新兴产业机会，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

未来，公司将统筹安排各业务板块的发展战略，充分发挥各业务体系的协同效应，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力。上市公司业务具体发展规划如下：

（1）公司将持续加大研发投入，不断加强技术研发和技术创新能力，根据市场的需求情况持续进行相关核心技术的开发，适时展开新兴领域新技术的跟踪与研究工作，进行相应的产品设计、研发。

（2）公司将不断加强市场宣传与推广力度，深入挖掘各类市场的发展机会，结合公司产品优势与特点，在各个应用领域积极进行产品推广和客户拓展，及时跟进市场变动和客户产品的需求情况，根据市场需求情况对新产品进行规划和定义。

（3）公司将不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全

公司内部控制制度，注重人才队伍培养，努力提高公司研发工作效率、提高公司整体管理水平。

3、本次交易对上市公司业务管理模式的影响

本次交易完成后，在维持上市公司现有管理模式、决策程序及发展规划不变的前提下，公司将以符合上市公司规范运作的相关要求对标的公司进行管理，完善北京矽成的公司治理。同时，上市公司在企业文化、团队管理、业务和技术以及财务与管理体系等方面进行整合，促使上市公司与标的公司在本次交易完成后快速实现内部整合，尽快实现彼此的协同效应，保证本次重组后上市公司的盈利能力和核心竞争力得到提升。

（三）上市公司未来经营中的优势和劣势

1、未来经营中的优势

上市公司与北京矽成均在各自业务领域建立了市场竞争优势，本次交易完成后，上市公司将取得北京矽成的控制权，上市公司将基于自身及北京矽成的业务积累扩展在芯片领域的业务范围及研发设计能力，通过北京矽成与上市公司之间资源的有效整合发挥资源聚合和协同效应，进一步提升各自业务的市场竞争力，促进上市公司整体业务规模实现快速增长。

2、未来经营中的劣势

本次交易完成后，上市公司将取得北京矽成的控制权，未来从上市公司经营和资源整合的角度来看，上市公司和北京矽成仍需在公司治理结构、员工管理、财务管理、资源协调运用管理以及业务拓展等方面进行一定的融合。若整合措施使用不当或整合时间过长，可能会对上市公司的业绩产生不利影响。

（四）本次交易完成后上市公司的资产负债情况及财务安全性

1、本次交易完成后上市公司的资产负债情况

本次交易前，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资，其合计分别占报告期各期末总资产的 85.79%、85.34%和 85.78%；主要负债为应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、递延收益，其合计分别占报告期各

期末总负债的 100.00%、100.00%、97.34%；报告期各期末，上市公司的资产负债率分别为 2.76%、4.68%、4.84%。

根据信永中和出具的北京君正备考财务报表审阅报告，本次交易完成后，上市公司主要资产为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、无形资产和商誉，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总资产的 81.15%和 88.43%；主要负债为应付账款、其他应付款和递延所得税负债，其合计分别占 2018 年末和 2019 年 5 月末总负债的 88.51%和 88.89%；截至 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日，上市公司的资产负债率分别为 27.18%和 26.97%。

截至 2018 年 12 月 31 日，可比公司紫光国微、全志科技、国科微和兆易创新的平均资产负债率为 29.58%，中位数为 33.65%。由此可见，本次交易完成后，上市公司的资产负债率仍低于行业平均水平，长期偿债能力较强。

2、上市公司的财务安全性分析

根据备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司资产负债率低于行业平均水平，偿债能力较强；上市公司及标的公司不存在大额预计负债或或有负债，无短期借款、长期借款等有息债务，财务安全性较高。

同时，本次交易拟募集配套募集资金不超过 15 亿元，若能足额募集，则上市公司可利用部分募集配套资金优化上市公司的资本结构；若无法足额募集，则可能为支付现金对价及建设标的公司募投项目而新增负债，进而加大财务风险。

六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响分析

（一）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面对上市公司未来发展的影响

根据上市公司的发展规划，未来 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 仍将保持其作为独立的境外法人经营实体存续，并由其原核心管理团队继续经营管理，上市公司将在认真客观地分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，力争做到既能保持各自原有的竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。上市公司拟将采取以下措施：

1、业务整合

本次交易完成后，上市公司将整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术、客户资源和销售渠道的共享，有效降低技术开发成本和销售费用，从而进一步提升主营业务利润空间，有效增强彼此竞争力，形成上市公司与北京矽成相辅相成、相互促进的协同效应，进而增强整体的盈利能力和持续竞争力。

2、资产整合

本次交易完成后，标的公司将继续保持资产的独立性，上市公司将通过完善的管理机制和风控体系促进标的公司资产的优化配置，提高资产的使用效率。

3、财务及管理体系整合

本次交易完成后上市公司取得北京矽成及上海承裕的控制权，上市公司将在保持标的公司独立运营、核心团队稳定的基础上将其纳入整体经营管理体系和财务管理体系，实现优劣互补，提高上市公司整体的资金使用效率，实现内部资源的统一管理和优化配置。

4、人员及机构整合

北京矽成下属经营实体拥有经验丰富的经营管理团队和成熟稳定的业务团队，上市公司将努力维持其原有经营管理团队和业务团队的稳定，为管理层保留较大程度的自主经营权，以使北京矽成经营管理团队的能力得到充分发挥。

（二）交易当年和未来两年拟执行的发展计划

本次交易完成后，上市公司将把自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力。

七、本次交易对上市公司财务指标和非财务指标的影响分析

（一）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据信永中和会计师出具的北京君正备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务数据比较如下：

项目	2019年5月31日 /2019年1-5月		2018年12月31日 /2018年度	
	本次交易前	本次交易后 (备考)	本次交易前	本次交易后 (备考)
资产总额（万元）	124,785.26	920,630.99	119,798.02	909,860.44
归属于母公司股东权益 （万元）	118,743.58	671,083.71	114,192.69	661,321.91
营业收入（万元）	11,788.38	128,309.30	25,967.01	313,691.42
利润总额（万元）	3,200.68	10,063.41	1,381.76	10,108.61
归属母公司所有者的净 利润（万元）	3,183.71	8,766.68	1,351.54	8,506.51
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.1950	0.0674	0.1894

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平、每股收益均将有所提升，上市公司财务状况、盈利能力得以增强。

（二）本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的全资子公司，其未来的资本性支出计划将纳入上市公司未来的年度计划、发展规划中统筹考虑。为实现顺利整合或业务的进一步发展，可能需要新增与标的公司相关的资本性支出，上市公司将按照《公司章程》履行必要的决策和信息披露程序。

（三）本次交易职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及标的公司的职工安置方案。

（四）本次交易成本对上市公司的影响

本次交易成本主要包括与本次交易相关的税费以及聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构费用。本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，处于合理区间。

（五）本次交易预计形成的商誉金额

本次交易系北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金方式购买北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，合计交易作价 720,031.86 万元。本次收购完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权，并通过上海承裕间接持有北京矽成 40.01%股权，即直接及间接合计持有北京矽成 100%股

权。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京矽成归属于母公司可辨认净资产公允价值为 368,684.95 万元（不含北京矽成账面商誉，含北京矽成可辨认资产及负债公允价值增值部分），考虑递延所得税负债 8,203.23 万元的影响，本次重组交易之合并成本与对应享有北京矽成可辨认净资产公允价值并考虑递延所得税后之间的差额 359,550.13 万元，即为上市公司本次收购预计形成的商誉。

八、未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施

（一）汇率波动风险及应对措施

1、汇率波动风险

北京矽成的生产经营涉及全球多个国家及地区，其采购、销售等日常生产经营所使用的结算货币主要为美元及新台币，其合并财务报表的记账本位币为人民币。本次交易完成后上市公司将面临北京矽成各个子公司所在国家及地区本位币不同导致的汇率波动风险，上市公司已充分了解汇率波动对于财务数据稳定性的影响，如存在因经济环境、国家风险等导致的汇率大幅波动的情况，上市公司将可能遭受由汇率波动所带来的损失。

2、应对措施

在未来经营过程中，上市公司将通过组建汇率管控团队、强化企业内部相关人员抗汇率风险的学习机制、合理使用金融对冲工具完善汇率管控等方式，减少汇率波动风险对于财务报表稳定性的影响。

（二）税务风险及应对措施

1、税务风险

北京矽成需要在经营业务的不同国家及地区承担纳税义务，主要经营主体 ISSI、ISSI Cayman 以及 Si En Cayman 的实际税率受到管辖区域内应纳税收益结构调整、税率变化及其他税法变化、递延所得税资产和递延所得税负债变化的影响。未来，各个国家及地区的税务机构存在对管辖区内企业税收规则及其应用

做出重大变更的可能性，此类变更可能导致北京矽成的企业税负增加，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的子公司，所在经营区域的税率变化或其他税收规则变化，或对上市公司未来合并报表财务数据造成一定的影响。

2、应对措施

长期以来，北京矽成十分重视其主要资产及业务所在国家及地区的税收政策变化，在确保北京矽成合法经营且依法纳税的基础上，其内部经营团队及聘请的外部顾问对北京矽成业务流程和组织架构进行了较为合理的税务筹划，尽量减小税务风险对公司经营的影响。本次交易完成后，上市公司管理层将借助北京矽成在跨国税务筹划方面的经验，根据上市公司和北京矽成业务整合的实际需要，以及不同国家和地区税收政策的变化，进行合理的税收筹划，节约税务成本。

（三）政策风险及应对措施

1、政策风险

北京矽成的研发和销售涉及较多的国家及地区，若相关国家及地区的政治局势、经济状况出现较大波动，或不同国家及地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，则可能对北京矽成业务经营和盈利能力造成不利影响，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。此外，各个国家和地区的产业政策 and 经济贸易政策也对北京矽成的生产经营具有重要影响。诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，均会对北京矽成在相关国家及地区的经营活动和盈利能力造成不利影响。自 2018 年以来，美国政府针对中国企业出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，中美贸易摩擦加剧将在一定程度上影响北京矽成的经营活动和盈利能力，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

2、应对措施

北京矽成对业务所在地的政治局势、经济环境、贸易政策和产业政策等因素高度重视，当政治、经济局势等出现不稳定或经贸政策发生重大变化时，北京矽成将及时调整相关区域的业务规模和业务模式，尽可能的降低环境或政策变化带来的不利影响。例如，在中美贸易摩擦加剧、美国政府对进口商品加征关税

后，北京矽成积极谋划调整其全球生产和销售布局，以求降低中美贸易摩擦对其生产经营的影响。同时，经过多年经营发展，北京矽成已在全球范围构建了成熟的管理架构。北京矽成境外子公司聘请当地员工进行企业管理、生产经营、产品销售、售后服务等相关工作。北京矽成可通过聘用的当地管理层及时、准确把握所处国家或地区的政治、经济、法律法规、税收及行业政策等方面的真实情况，从而保障公司在当地做出合理的经营决策，避免决策风险。

第十章 财务会计信息

一、北京矽成最近两年及一期合并财务报告

（一）北京矽成最近两年及一期合并财务报表审计情况

信永中和对北京矽成编制的 2017 年、2018 年、2019 年 1-5 月的合并财务报表及附注进行了审计，并出具了第 XYZH/2019BJA90485 号标准无保留意见审计报告。

（二）北京矽成合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：			
货币资金	111,995.17	117,618.37	90,870.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,677.18	6,580.29	6,160.23
应收票据	-	-	-
应收账款	45,119.44	43,207.15	38,306.08
预付款项	8,443.85	12,005.85	9,371.12
其他应收款	1.96	1.57	1.57
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	109,623.08	104,579.33	66,593.56
其他流动资产	6,666.17	8,298.99	4,025.76
流动资产合计	288,526.86	292,291.55	215,328.74
非流动资产：			
长期应收款	5,282.55	-	50,261.56
长期股权投资	925.12	920.30	876.18
固定资产	25,779.08	27,243.36	24,845.67
在建工程	78.37	418.89	-
无形资产	67,990.58	67,247.97	60,726.34
开发支出	8,917.87	10,727.64	7,323.18

商誉	250,125.72	248,820.57	226,017.24
递延所得税资产	7,568.69	7,212.68	7,586.39
其他非流动资产	8,825.14	1,101.73	8,863.15
非流动资产合计	375,493.12	363,693.14	386,499.70
资产总计	664,019.98	655,984.69	601,828.44
流动负债：			
应付票据	-	-	-
应付账款	43,325.17	41,526.26	34,984.75
预收款项	3,091.57	2,662.91	2,121.07
应付职工薪酬	8,997.67	10,229.37	9,274.56
应交税费	1,613.20	2,679.54	3,898.91
其他应付款	2,419.05	2,124.41	2,382.13
其中：应付利息	65.26	64.92	70.68
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	163.36
其他流动负债	44.37	537.59	0.00
流动负债合计	59,491.04	59,760.07	52,824.79
非流动负债：			
长期借款	-	-	2,804.26
长期应付款	2.18	2.23	2.19
长期应付职工薪酬	3,559.48	3,357.95	5,079.33
预计负债	5,374.34	4,345.70	1,263.22
递延所得税负债	6,847.58	6,806.89	4,994.85
非流动负债合计	15,783.58	14,512.77	14,143.85
负债合计	75,274.63	74,272.84	66,968.63
所有者权益：			
实收资本	51,966.95	51,966.95	51,966.95
资本公积	455,253.33	455,253.33	455,253.33
其他综合收益	43,903.61	44,275.68	21,388.20
盈余公积	-	-	-
未分配利润	36,379.91	28,998.49	4,509.55
归属于母公司所有者权益合计	587,503.80	580,494.44	533,118.03
少数股东权益	1,241.55	1,217.40	1,741.78

所有者权益合计	588,745.35	581,711.84	534,859.81
负债和所有者权益总计	664,019.98	655,984.69	601,828.44

2、合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
一、营业总收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
其中：营业收入	116,520.92	287,724.41	251,206.43
二、营业总成本	106,266.61	255,595.69	228,617.97
其中：营业成本	77,823.76	185,902.30	158,147.56
税金及附加	75.47	170.38	166.16
销售费用	10,281.50	23,441.25	23,001.01
管理费用	4,317.17	12,394.57	14,974.66
研发费用	14,322.51	35,041.51	31,775.06
财务费用	-553.81	-1,354.33	553.52
其中：利息费用	-	65.08	181.38
利息收入	719.31	1,452.32	1,249.01
加：其他收益	60.14	186.70	94.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,259.16	-4,201.16	-5,806.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.64	5.30	52.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,051.65	28,119.55	16,928.83
加：营业外收入	65.72	314.05	184.00
减：营业外支出	2.66	50.21	35.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,114.72	28,383.39	17,077.09
减：所得税费用	1,709.14	3,881.25	11,072.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,405.58	24,502.14	6,005.03
归属于母公司股东的净利润	7,381.42	24,488.94	6,015.76
少数股东损益	24.15	13.20	-10.73

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	115,015.87	282,286.27	251,113.73
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	726.76	1,452.32	458.79
经营活动现金流入小计	115,742.63	283,738.60	251,572.52
购买商品、接受劳务支付的现金	71,826.48	207,769.96	151,763.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12,604.00	30,837.59	40,654.79
支付的各项税费	3,241.43	3,367.77	5,737.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,973.70	35,450.71	30,658.19
经营活动现金流出小计	101,645.61	277,426.03	228,814.18
经营活动产生的现金流量净额	14,097.02	6,312.56	22,758.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	50,860.57	-
取得投资收益收到的现金	-	2,087.62	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41.85	333.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	52,990.04	333.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,242.81	13,149.21	8,670.74
投资支付的现金	12,994.46	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	493.22	16,962.31	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	16,730.50	30,111.51	8,670.74
投资活动产生的现金流量净额	-16,730.50	22,878.53	-8,337.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款所收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务所支付的现金	-	2,911.34	1,286.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	522.56	236.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,433.90	1,522.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,433.90	-1,522.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,989.72	990.75	-5,224.76
五、现金及现金等价物净增加额	-5,623.20	26,747.94	7,673.79
加：期初现金及现金等价物余额	117,618.37	90,870.43	83,196.64
六、期末现金及现金等价物余额	111,995.17	117,618.37	90,870.43

二、上海承裕最近两年及一期合并财务报告

（一）上海承裕最近两年及一期合并财务报表审计情况

信永中和对上海承裕编制的 2017 年、2018 年、2019 年 1-5 月的备考财务报表及附注进行了审计，并出具了第 XYZH/2019BJA90486 号标准无保留意见审计报告。

（二）上海承裕合并财务报表

1、备考资产负债表

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31	2017.12.31
资产：			
货币资金	31.53	31.80	315.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	281,185.96	281,185.96	308,533.21
其他应收款	-	-	0.20
其他流动资产	0.06	0.06	-
资产总计	281,217.54	281,217.81	308,848.76
负债：			
应交税费	-	-	2.59
应付利息	-	-	181.19
其他应付款	-	124,553.00	15,223.70
一年内到期的非流动负债	-	-	37,451.70
长期借款	-	-	87,387.30
负债合计	-	124,553.00	140,246.48
合伙人权益：			

合伙人资本	230,985.50	106,432.50	105,618.50
其他综合收益	-	-	-
未分配利润	50,232.04	50,232.31	62,983.78
合伙人权益合计	281,217.54	156,664.81	168,602.28
负债和合伙人权益合计	281,217.54	281,217.81	308,848.76

2、备考利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年
一、营业收入			
减：税金及附加	-	10.30	0.24
管理费用	0.02	16.82	-
财务费用	0.25	5,934.72	7,181.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-11,227.58	27,911.57
投资收益（损失以“-”填列）	-	4,437.88	2.29
二、营业利润	-0.27	-12,751.53	20,731.66
加：营业外收入	-	0.06	1.96
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-0.27	-12,751.47	20,733.62
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-0.27	-12,751.47	20,733.62

三、上市公司最近一年及一期备考合并财务报告

（一）北京君正最近一年及一期备考合并财务报表审阅情况

信永中和对北京君正编制的 2018 年、2019 年 1-5 月的备考合并财务报表及附注进行了审阅，并出具了第 XYZH/2019BJA90477 号审阅报告。

（二）北京君正备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2019.5.31	2018.12.31
流动资产：		
货币资金	120,761.27	133,710.36

交易性金融资产	82,116.53	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,580.29
应收票据	-	-
应收账款	46,642.71	45,439.21
应收款项融资	-	-
预付款项	9,336.86	12,395.59
其他应收款	555.04	232.82
其中：应收利息	13.79	4.47
应收股利	-	-
存货	117,740.09	112,604.13
其他流动资产	7,461.40	72,961.75
流动资产合计	384,613.90	383,924.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	13,484.12
长期应收款	5,282.55	-
长期股权投资	1,109.18	1,103.91
其他权益工具投资	13,958.08	-
投资性房地产	3,120.24	3,149.42
固定资产	35,669.46	37,683.59
在建工程	3,741.74	3,932.81
无形资产	86,016.45	87,024.09
开发支出	8,917.87	10,727.64
商誉	360,855.29	359,550.13
长期待摊费用	85.23	117.59
递延所得税资产	8,276.16	7,760.21
其他非流动资产	8,984.84	1,402.77
非流动资产合计	536,017.09	525,936.29
资产总计	920,630.99	909,860.44
流动负债：		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	43,944.66	42,111.24
预收款项	3,256.38	2,871.94

应付职工薪酬	9,056.26	10,897.16
应交税费	1,718.21	3,123.68
其他应付款	164,339.77	164,102.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他流动负债	44.37	537.59
流动负债合计	222,359.65	223,644.17
非流动负债：		
长期借款	-	-
长期应付款	2.18	2.23
长期应付职工薪酬	3,559.48	3,357.95
预计负债	5,374.34	4,345.70
递延收益	4,574.63	3,283.53
递延所得税负债	12,435.44	12,687.54
非流动负债合计	25,946.07	23,676.96
负债合计	248,305.73	247,321.13
股东权益：		
归属于母公司股东权益	671,083.71	661,321.91
少数股东权益	1,241.55	1,217.40
股东权益合计	672,325.26	662,539.31
负债和股东权益总计	920,630.99	909,860.44

2、备考合并利润表

单位：万元

项目	2019 年 1-5 月	2018 年
一、营业总收入	128,309.30	313,691.42
其中：营业收入	128,309.30	313,691.42
二、营业总成本	119,681.53	302,856.53
其中：营业成本	85,005.41	209,999.58
税金及附加	206.22	610.39
销售费用	10,599.74	24,509.02
管理费用	7,895.32	20,697.51
研发费用	16,583.44	42,437.95
财务费用	-608.60	4,602.08

其中：利息费用	-	6,058.52
利息收入	744.83	1,472.75
加：其他收益	1,228.58	1,757.24
投资收益（损失以“-”号填列）	444.69	2,900.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,000.37	106.22
信用减值损失（损失以“-”填列）	-57.13	-
资产减值损失（损失以“-”填列）	-1,238.04	-5,579.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3.64	5.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,002.62	10,024.62
加：营业外收入	67.56	323.51
减：营业外支出	6.76	239.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,063.41	10,108.61
减：所得税费用	1,272.57	1,588.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,790.84	8,519.71
归属于母公司所有者的净利润	8,766.68	8,506.51
少数股东损益	24.15	13.20

第十一章 同业竞争与关联交易

一、同业竞争情况

（一）本次交易不会新增同业竞争

本次交易前，上市公司实际控制人刘强、李杰未直接或间接经营任何其他与上市公司及其下属子公司以及北京矽成经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与上市公司及其下属子公司以及北京矽成生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，因此本次交易后上市公司将不存在同业竞争情形。

（二）避免同业竞争的措施

同时，为充分保护上市公司利益，避免同业竞争，上市公司实际控制人刘强、李杰已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实际控制人。就避免同业竞争事项，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：

1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司及北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司及北京矽成不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。

2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。

3、如因其未履行本承诺而给上市公司造成损失的，其对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。”

此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将

超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将持有北京君正 5%以上股份，现就本次重组完成后减少及避免与上市公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下：

1、在本次重组业绩承诺期内，本承诺人不以任何方式直接或间接控制从事与上市公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。若发生此种行为，则本承诺人应在因此种行为所获利金额的限额内按照上市公司实际损失向上市公司支付赔偿。

“控制”是指对于一家公司或实体拥有超过百分之五十（50%）的有表决权股份，或拥有任命或选举其过半数董事的权力。

2、本承诺人于本次重组生效前已经完成（以完成相应工商变更登记为准）的投资事项及以财务投资为目的进行的投资事项，不受前述承诺限制。

3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本次交易终止；（2）本承诺人对北京君正持股比例首次低于 5%；（3）北京君正股票终止在深圳证券交易所上市。”

上述措施有利于保持上市公司独立性、保障全体股东，尤其是中小股东的利益。

二、关联交易情况

（一）本次交易构成关联交易

本次交易/本次收购完成后，发行股份购买资产交易对方中屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%），上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《创业板上市规则》，上述交易对方视同为上市公司关联方。另外，上市公司的控股股东、实际控制人之一刘强控制的企业四海君芯将认购不低于配套募集资金的 50%。

因此，本次交易构成关联交易。

（二）北京矽成在报告期的关联交易情况

1、北京矽成的关联方情况

（1）北京矽成母公司情况

截至本报告书出具日，北京矽成之全部股东为上海承裕、屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、Asia Memory 和厦门芯华，北京矽成无控股股东及实际控制人。

（2）北京矽成子公司情况

北京矽成子公司情况详见本报告书“第四章 标的资产情况/一、交易标的之北京矽成/（五）北京矽成主要下属公司情况”。

（3）其他关联方情况

北京矽成其他关联方主要包括：

关联方名称	关联方与北京矽成的关系
屹唐投资	持有北京矽成 5%以上股份的法人
华创芯原	持有北京矽成 5%以上股份的法人
上海承裕	持有北京矽成 5%以上股份的法人

2、关联交易的情况

（1）归还关联方借款

单位：万元

关联方名称	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
上海承裕	-	-	973.53
华创芯原	-	-	267.23
屹唐投资	-	496.21	-
合计	-	496.21	1,240.75

（2）归还关联方借款利息

单位：万元

关联方名称	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
上海承裕	-	-	42.90
屹唐投资	-	15.45	21.87
华创芯原	-	-	11.78

关联方名称	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
合计	-	15.45	76.55

（3）应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	2019 年 1-5 月	2018 年度	2017 年度
屹唐投资	-	-	544.26
合计	-	-	544.26

（三）上海承裕在报告期的关联交易情况**1、上海承裕的关联方情况****（1）上海承裕母公司情况**

上海承裕为有限合伙企业，其普通合伙人承裕投资情况详见本报告书“第三章 交易对方基本情况/（十三）承裕投资”。

（2）上海承裕子公司情况

上海承裕子公司情况详见本报告书“第四章 标的资产情况/二、交易标的之上海承裕/（五）上海承裕主要下属公司情况”。

（3）其他关联方情况

上海承裕其他关联方主要包括：

关联方名称	关联方与上海承裕的关系
武岳峰集电	持有上海承裕 5%以上股份的法人
上海集岑	持有上海承裕 5%以上股份的法人
北京青禾	持有上海承裕 5%以上股份的法人
仟品（上海）股权投资管理有限公司	与上海承裕受同一实际控制人控制的企业

2、关联交易情况

报告期内上海承裕关联交易情况具体如下：

（1）关联方交易**1) 对关联方借款**

单位：万元

关联方	金额	起始日	到期日	说明
上海闪胜	8,216.00	2015-11-23	2017-12-13	利率为 4.75%，已收回
上海闪胜	265.36	2016-12-23	2017-12-13	利率为 4.75%，已收回
合计	8,481.36	/	/	/

2) 与关联方签署的可转股债权投资协议

2016 年 12 月，上海承裕与武岳峰集电签订《可转股债权投资协议》约定，武岳峰集电向上海承裕提供不超过人民币 2.19 亿元的无息可转股借款。

2016 年 12 月，上海承裕与北京青禾签订《可转股债权投资协议》约定，北京青禾向上海承裕提供人民币约 2,283.06 万元的无息可转股借款。

2018 年 5 月，上海承裕与武岳峰集电、北京青禾签订《可转股债权投资协议》约定，武岳峰集电、北京青禾分别向上海承裕提供人民币约 38,380.93 万元、4,127.58 万元的可转股债权。

2018 年 11 月，上海承裕与上海集岑签订《可转换债权投资协议》约定，上海集岑向上海承裕提供不超过人民币 12.55 亿元的可转股债权。

截至本报告书出具日，武岳峰集电及北京青禾向上海承裕提供的上述借款已全部偿还完毕；此外，上海集岑已完成可转股债权项下上海承裕有限合伙人权益份额的转换及工商变更登记。

3) 其他关联方交易

单位：万元

关联方	款项性质	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应收款：				
承裕投资	代垫费用	-	-	0.20
合计	/	-	-	0.20

(2) 关联方应收应付款项

1) 应收项目

单位：万元

关联方	款项性质	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应付款：				

关联方	款项性质	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
武岳峰集电	可转债	-	-	11,370.98
仟品（上海）股权投资 管理有限公司	代垫费用	-	-	0.05
北京青禾	可转债	-	-	1,182.50
合计	/	-	-	12,553.53

2) 应付项目

单位：万元

关联方	款项性质	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他应付款：				
武岳峰集电	可转债	-	-	11,370.98
仟品（上海）股权投资 管理有限公司	代垫费用	-	-	0.05
北京青禾	可转债	-	-	1,182.50
合计	/	-	-	12,553.53

（四）本次交易完成后的关联交易情况

本次交易前，上市公司未发生与日常经营相关的重大关联交易，上市公司已制定了《关联交易决策制度》，上市公司的关联交易均需遵循公开、公平、公正的原则，均需以双方平等协商为基础，均需履行必要的决策程序，定价合理、公允。上市公司监事会、独立董事需要依据法律、法规及公司章程等的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表意见。上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险，加强上市公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易完成后，上市公司将直接持有北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额，从而直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。上市公司将不会因本次交易新增日常性关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定，进一步完善和细化关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。未来上市公司将继续严格按照《上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求，审议、披露关联交易事项，确保关联交易的价格公允、合理，维护上市公司及股东的合法权益。

（五）关于规范关联交易的承诺

为规范和减少上市公司控股股东、实际控制人和上市公司的关联交易，刘强、李杰就本次交易出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“本次重组完成后，本承诺人仍为北京君正的实际控制人。就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：

1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。

3、在持有上市公司股份期间，不利用控股股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。

4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

除非本承诺人不再作为北京君正的控股股东及实际控制人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”

此外，屹唐投资、武岳峰集电、上海集岑、华创芯原作为本次交易/本次收购后持股比例超过 5%（本次收购完成后华创芯原持有上市公司股份比例预计将超过 5%，配套融资完成后预计持股比例将低于 5%）的主要股东亦出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“作为本次重组的交易对方，本承诺人将持有上市公司 5%以上股份，就减少及规范与上市公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：

1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与北京君正及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与北京君正及其控制企业的关联交易损害北京君正及其他股东的合法权益。

3、在持有上市公司股份期间，不利用持股 5%以上股东地位影响或谋求北京君正及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与北京君正及其控制企业达成交易的优先权利。

4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。

除非本承诺人不再持有北京君正 5%以上股份，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给北京君正或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”

第十二章 风险因素

一、本次交易相关的风险

（一）交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括中国证监会核准本次交易事项；其他境内外有权机构的审批、许可或同意（如适用）。截至本报告书出具日，上述审批事项尚未完成。能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

其中，北京君正及北京矽成自愿将本次交易提交 CFIUS、台湾投审会审查。受到目前中美贸易摩擦以及大陆台湾两岸关系等政策性影响，CFIUS 及台湾投审会对于中方直接或间接收购的审查或将趋于严格。上市公司不能排除相关政府和监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动，从而延迟本次交易的交割或导致本次交易终止的风险。

综上，本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请投资者注意相关审批风险。

（二）交易调整或终止的风险

在本次交易过程中，交易各方可能需根据中国证监会等监管机构的要求不断完善交易方案，本次交易方案存在此类调整风险。若交易各方无法就监管机构审核要求进行方案调整达成一致，则本次交易存在终止的风险。同时如北京矽成供应商或客户因本次交易而调整或终止其与北京矽成的业务，则可能导致本次交易调整或终止。提请投资者注意风险。

此外，公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在本次与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，以避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止本次交易的风险。

（三）上市公司实际控制人稳定性风险

本次交易前，刘强和李杰分别直接持有北京君正 20.03%和 12.73%股份，二人作为一致行动人合计持有北京君正 32.77%股份，为北京君正的控股股东和实际控制人。在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，按照交易作价、上市公司股份发行价格、刘强控制的企业四海君芯认购配套融资的 50%测算，刘强持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 12.36%，李杰将持有北京君正 5.24%股份，刘强和李杰合计持有、实际支配北京君正股份表决权比例为 17.59%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。若相关交易对方构成一致行动关系且其合计持股比例或表决权比例高于刘强，或者刘强未能足额认购募集配套资金导致其持股比例或表决权比例低于其他交易对方，则存在上市公司实际控制人变更的风险，从而给本次交易带来不利影响。若发生上述情形，则本次交易存在调整交易方案或终止的风险。

（四）北京矽成业绩承诺不能达标的风险

根据上市公司与业绩承诺方上海承裕、屹唐投资和华创芯原签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方承诺北京矽成在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,900 万美元、6,400 万美元、7,900 万美元。

经上市公司与业绩承诺方协商一致，北京矽成业绩承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为实际净利润数。在计算实际利润数时，不考虑：1、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司 59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号）中关于盈利预测的口径一致）；2、北京矽成因实施股权激励所产生的费用；3、北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；4、配套募集资金投资项目损益。

若北京矽成在盈利补偿期间内累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数低于承诺净利润累计数的 85%，业绩承诺方应对上市公司进行补偿。

同时，业绩承诺期届满时，经减值测试，如北京矽成期末减值额>已补偿金额，则业绩承诺方应对上市公司另行补偿。

上述业绩承诺系业绩承诺方基于北京矽成目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，北京矽成经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。因此本次交易存在承诺期内北京矽成实现的实际净利润达不到承诺净利润的风险。

（五）业绩补偿及减值补偿不足的风险

根据上市公司与本次交易业绩承诺方上海承裕、屹唐投资和华创芯原签署的《盈利补偿协议》及其补充协议，双方约定若北京矽成在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数达到承诺净利润累计数的 85%及以上，则业绩承诺方无需进行补偿。同时，在计算北京矽成在业绩承诺期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的净利润数时，不考虑：1、Connectivity、LIN、CAN、MCU 及光纤通讯业务相关损益（与《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司 59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号）中关于盈利预测的口径一致）；2、北京矽成因实施股权激励所产生的费用；3、北京矽成因收购 Integrated Silicon Solution, Inc.产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销；4、配套募集资金投资项目损益。

同时，业绩承诺期届满时，经减值测试，如北京矽成期末减值额>已补偿金额，则业绩承诺方应对上市公司另行补偿。

在充分考虑业绩承诺方对北京矽成未来经营的作用、未来承担的业绩补偿责任和风险、北京矽成对上市公司的战略意义等因素的基础上，上市公司与业绩承诺方约定了业绩补偿及减值补偿的最高限额，即业绩承诺方业绩补偿及减值补偿总额以本次交易项下取得的交易对价金额为限，如有超出部分，业绩承

诺方无需进一步补偿。若北京矽成在承诺期间累计实现的净利润低于承诺净利润累计数的 85%，或业绩承诺期届满北京矽成期末减值额>已补偿金额，则各业绩承诺方在向上市公司支付其最高限额的补偿后，无须再对上市公司进行额外的股票或现金补偿。

此外，根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626 号），截至评估基准日，北京矽成 100%股权评估值为 702,791.68 万元，本次交易对应北京矽成 100%股权作价为 720,000.00 万元，较评估值增加 2.45%。本次交易存在溢价收购导致业绩补偿不足的风险。

提请投资者关注相关业绩补偿及减值补偿不足的风险。

（六）收购整合风险

在发展过程中，上市公司已建立了高效的管理体系和经营管理团队。本次交易完成后，公司的资产、业务规模和范围都将有较大幅度的增长，企业规模增长对企业经营管理提出更高的要求。

本次收购属于对同行业优质资产的整合，上市公司对于北京矽成实际经营实体所处行业的特点和发展规律有深入了解，积累了大量发展经验。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，上市公司与北京矽成实际经营实体仍需在企业文化、团队管理、销售渠道、客户资源等方面进行进一步的融合。但是，本次交易完成后，上市公司能否对北京矽成实际经营实体实施有效整合，以及本次交易能否充分发挥协同效应，均存在不确定性，进而可能影响本次收购的最终效果。

本次交易完成后，北京矽成在管理经营、销售扩展、产品研发领域等个方面将继续保持其独立性，现有的管理团队、销售组织架构、研发技术人员将不会因本次重组而发生变化。鉴于北京矽成在经历前次私有化收购后，经营业绩仍保持稳健增长的良好态势，同时继续保持与原主要客户之间的稳定合作关系和紧密联系，未影响消费者的购买意向。但是，考虑到北京矽成的主要经营活动在美国和台湾地区等地开展，主要客户亦广泛分布于欧美及亚太地区，不排除本次收购会影响部分客户消费意向，从而导致对北京矽成未来经营业绩产生不利影响的可能性。同时，考虑到全球集成电路产业竞争格局及不同国家地区

经济贸易政策，亦存在本次收购会影响部分供应商的供货意向，从而对北京矽成未来经营业绩产生不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

（七）募集配套资金不足或失败带来的资金压力风险

本次交易的现金对价为 16.16 亿元，公司拟募集配套资金不超过 15 亿元用于支付本次交易的部分现金对价、投入标的资产的项目建设。受北京矽成经营情况、财务状况变化、监管机构政策以及资本市场影响，本次募集配套资金存在募集金额不足乃至募集失败的可能。若募集配套资金不足或失败，公司将以更多自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价及项目建设，从而进一步增加资金压力。在此情形下，公司的财务风险和融资风险将进一步增加，且将提高公司的资产负债率水平，增加公司未来的偿债压力，提请投资者注意相关风险。

（八）商誉减值风险

本次交易属于非同一控制下的企业合并，上市公司对本次合并成本与评估基准日的可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。根据信永中和会计师事务所出具的上市公司备考财务报表审阅报告，假设本次重组在 2018 年 1 月 1 日完成，上市公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 5 月 31 日合并报表商誉金额分别为 359,550.13 万元和 360,855.29 万元，占备考报表总资产的比例分别为 39.52%和 39.20%，占备考报表归属于母公司股东净资产的比例分别为 54.37%和 53.77%。

本次交易完成后，在上市公司合并报表中将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。本次交易所形成的商誉在减值测试中会分摊至相关资产组，这些相关的资产组能够从企业合并的协同效应中受益，收购完成后上市公司与北京矽成具有较强的协同效应，如果未来市场环境发生不利变化，上市公司及北京矽成未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失，对上市公司商誉减值当年的业绩带来重大不利影响，亦会导致上市公司存在较大的未弥补亏损，提请广大投资者注意上述商誉减值对上市公司业绩造成不利影响的风险。

二、标的资产相关风险

（一）行业周期性风险

北京矽成的主营业务为集成电路存储芯片、模拟芯片的研发和销售，属于集成电路产业的上游环节，与集成电路生产及应用环节紧密相连。全球范围内，集成电路产业规模一直保持稳步增长趋势，随着新的技术进步导致旧技术产品逐渐淘汰，作为集成电路行业不断地追求新技术发展的特征，使产品周期时间越来越短，以此产生了集成电路行业特有的周期性波动特点，且行业周期性波动的频率要较经济周期更为频繁，在经济周期的上行或下行过程中，都可能出现相反的集成电路产业周期。在经历了多年增长周期之后，2018 年底半导体行业发展行情放缓，全球芯片销售额自 2018 年底至 2019 年初出现下降趋势。如果集成电路产业出现周期性下行的情形，则北京矽成的经营业绩可能受到负面影响，提请投资者注意行业周期性波动的风险。

（二）人才流失风险

北京矽成作为集成电路设计企业，受过专业高等教育及拥有丰富行业经验的人才队伍是促成北京矽成拥有行业领先地位的重要保障。目前，北京矽成拥有高素质的稳定管理设计团队，其产品和技术得到业内和市场的一致认可。经营管理团队和核心技术人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素，虽然北京矽成向管理团队和核心技术人员提供了较为合适的激励机制，然而随着公司未来的经营活动以及市场环境的变化，若没有跟进相适应的激励机制，则管理团队和核心技术人员在工作积极性、研发创造性等方面可能出现下降，或产生人员流失、经营运作不利、盈利水平下滑等不利影响，提请投资者注意相关风险。

（三）供应商风险

北京矽成采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，作为集成电路设计领域内通常采用的经营模式，专注于集成电路芯片的设计研发，在生产制造、封装及测试等环节采用专业的第三方企业代工模式。该模式于近十多年来在全球集成电路芯片产业中逐渐得到越来越多厂商的运用，符合集成电路产业垂直分工的特点。虽然无晶圆厂运营模式降低了企业的生产成本，使集成电路设计企业能以

轻资产的模式实现大额的销售收入，但同时也带来了在产品代工环节中因供应商的供货所产生的不确定性。目前对于集成电路设计企业而言，晶圆是产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，不同类型的集成电路芯片产品在选择合适的晶圆代工厂时范围有限，导致晶圆代工厂的产能较为集中。在行业生产旺季来临时，晶圆代工厂和封装测试厂的产能能否保障北京矽成的采购需求，存在不确定的风险。同时随着行业中晶圆代工厂和封装测试厂在不同产品中产能的切换，以及产线的升级，或带来的北京矽成采购单价的变动，若代工服务的采购单价上升，会对北京矽成的毛利率造成下滑的影响。此外，突发的自然灾害等破坏性事件时，也会影响晶圆代工和封装测试厂向北京矽成的正常供货。提请投资者注意相关风险。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。我国政府目前已通过一系列法律法规及产业政策，大力推动集成电路行业的发展。自 2000 年以来，陆续颁布了一系列政策及法律法规，拟从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持、引导风险资金的流入等角度，支持该行业企业的发展。2015 年国务院颁布的《中国制造 2025》中也明确计划 2020 年中国大陆集成电路产业内需市场自主生产制造率将达 40%，2025 年将更进一步提高至 70%，基于信息安全考虑和巨大的进口替代空间，集成电路产业将是未来 10 年国家政策重点照顾的领域。政府对集成电路产业的支持政策为我国各类型的高新科技集成电路企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响，提请投资者注意相关风险。

（五）外汇风险

北京矽成下属实际经营主体大多注册在中国大陆地区以外，日常经营活动中涉及美元、欧元、台币等货币，而且该等子公司根据其经营所处的主要经济环境以其本国或本地区货币作为记账本位币。一方面，各种汇率变动具有不确定性，汇率波动可能给北京矽成未来运营带来汇兑风险；另一方面，随着人民币日趋国

际化、市场化，人民币汇率波动幅度增大，人民币对美元等货币的汇率变化将导致北京矽成及上市公司的外币折算风险。

（六）税务风险

北京矽成主要经营实体分布在全球不同国家和地区，在不同国家和地区承担纳税义务，其主要经营主体的实际税率受到管辖区域内税率变化及其他税法变化的影响。未来，各个国家和地区的税务机构存在对管辖区内企业税收规则及其应用做出重大变更的可能性，此类变更可能导致北京矽成的税负增加，并对财务状况、经营业绩或现金流造成不利影响。

本次交易完成后，北京矽成将成为上市公司的子公司，所在经营区域的税率变化或其他税收规则变化，或对上市公司未来合并报表财务数据造成一定的影响。

（七）标的资产的估值风险

根据东洲评估出具的《北京矽成评估报告》《上海承裕评估报告》，北京矽成 100%股权、上海承裕 100%财产份额截至评估基准日的评估值分别为 70.28 亿元和 28.12 亿元，增值率分别为 21.07%和 0%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照估值的相关规定，勤勉、尽责，但由于评估和估值工作是基于一定的假设前提，如未来情况较预期发生较大变化，可能存在资产估值与实际情况不符的风险。提请投资者注意本次交易标的资产的估值风险。

（八）所在国政治经济环境和政策变化风险

北京矽成的产品研发和销售涉及较多的国家和地区，若相关国家和地区的政治局势、经济状况出现较大波动，或不同国家和地区之间出现政治摩擦、贸易纠纷，则可能对北京矽成业务经营和盈利能力造成不利影响，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

此外，各个国家和地区的产业政策和经济贸易政策也对北京矽成的生产经营具有重要影响。诸如税收优惠变化、进出口限制、反倾销和反补贴贸易调查、加征关税等情形，均会对北京矽成在相关国家和地区的经营活动和盈利能力

力造成不利影响。自 2018 年以来，美国政府针对中国企业出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，中美贸易摩擦加剧将在一定程度上影响北京矽成的经营活动和盈利能力，进而影响本次重组后上市公司的财务状况和盈利能力。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《创业板上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

（二）其他

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

第十三章 其他重要事项

一、交易完成后上市公司资金、资产占用与担保情况

本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。

二、上市公司负债情况

本次交易对上市公司负债结构的影响见“第九章管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力影响分析”之“（四）本次交易完成后上市公司的资产负债情况及财务安全性”。

三、上市公司最近十二个月内资产交易情况

截至本报告书出具日，除本次交易外，公司在最近 12 个月内无其他重大资产购买、出售等资产交易行为。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求，建立并逐步完善法人治理结构，制定了与之相关的议事规则或工作细则并予以严格执行，规范公司运作的同时加强信息披露工作。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等。

本次交易完成后，北京矽成成为北京君正的全资子公司，上市公司的业务规模得以扩大，但公司治理结构未发生重大变化。公司将依据各项法律、法规要求，继续保持合规高效的法人治理结构，进一步完善公司内部决策和管理控制制度，规范公司运作和管理，提高公司治理水平，提升经营效率和盈利能力，维护股东和广大投资者的利益。

五、公司停牌前股价存在异常波动的说明

根据中国证监会 128 号文第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影

响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”

（一）前次董事会期间上市公司股票价格波动情况

北京君正于 2018 年 11 月 9 日召开第三届第二十七次董事会，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等议案。该次董事会决议公告日前 20 个交易日的区间段（2018 年 10 月 15 日至 2018 年 11 月 9 日）公司股票价格及相关指数的涨跌幅情况如下：

日期	北京君正 (300223) (元/股)	创业板指数 (399006) (点)	半导体 (Wind) 指数 (886063) (点)
2018 年 10 月 15 日	18.18	1,250.22	1,547.65
2018 年 11 月 9 日	18.52	1,322.83	1,638.50
涨跌幅	1.87%	5.81%	5.87%

公司股价在上述期间累计涨幅为 1.87%。在剔除大盘因素后，公司股价在上述期间的累计跌幅为 3.94%；在剔除同行业板块因素后，公司股价在上述期间的累计跌幅为 4.00%。

（二）重大调整停牌前上市公司股票价格波动情况

北京君正于 2019 年 5 月 16 日召开第四届第五次董事会，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，北京君正股票（简称：北京君正，代码：300223）自 2019 年 5 月 10 日开市起停牌。

本次停牌前 20 个交易日的区间段（2019 年 4 月 9 日至 2019 年 5 月 9 日）公司股票价格及相关指数的涨跌幅情况如下：

日期	北京君正 (300223) (元/股)	创业板指数 (399006) (点)	半导体 (Wind) 指数 (886063) (点)
2019 年 4 月 9 日	29.85	1,741.17	2,277.41
2019 年 5 月 9 日	24.40	1,469.48	1,970.05
涨跌幅	-18.26%	-15.60%	-13.50%

公司股价在上述期间累计跌幅为 18.26%。在剔除大盘因素后，公司股价在

上述期间的累计跌幅为 2.65%；在剔除同行业板块因素后，公司股价在上述期间的累计跌幅为 4.76%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，北京君正股价在重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。

公司已对本次交易采取了相关保密措施，包括已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与公司签署保密协议、相关交易谈判局限于少数核心人员、相关人员签署了交易进程备忘录等。

六、相关人员买卖上市公司股票的自查情况

根据中国证监会 128 号文、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所的相关要求，上市公司自 2019 年 5 月 9 日申请股票停止交易后，立即进行本次交易内幕信息知情人登记及自查工作，并向深交所上报了内幕信息知情人名单。

按照相关规定，本次自查期间为本次重组申请股票停止交易前 6 个月至本报告书出具日，即 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 7 月 31 日。本次自查的范围包括：公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；本次收购的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及其他知情人员；本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员；以及前述所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）。

（一）自查结果

根据自查范围内人员出具的自查报告与中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，除下列情况外，自查对象在自查期间均不存在买卖北京君正股票的情形：

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量（股）	交易类型
刘将	上市公司副总经理	2018.12.06	2,700	买入
		2018.12.12	1,200	买入

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量（股）	交易类型
		2019.01.23	1,200	买入
		2019.02.13	700	买入
		2019.02.25	2,500	买入
		2019.02.26	2,800	买入
		2019.03.06	-6,500	卖出
		2019.03.06	-7,300	卖出
白洁	上市公司证券代表	2019.03.04	-6,900	卖出
		2019.03.05	5,550	行权
		2019.03.05	2,568	行权
		2019.03.06	6,280	行权
		2019.03.08	-5,300	卖出
		2019.05.21	-5,000	卖出
		2019.06.18	500	期权行权
		2019.06.19	5,500	期权行权
陈冬梅	交易对方上海瑾矽执行事务合伙人委派代表	2019.03.19	2,000	买入
		2019.03.21	1,000	买入
		2019.03.25	-1,000	卖出
		2019.03.26	1,000	买入
		2019.03.28	1,500	买入
		2019.04.02	-2,000	卖出
		2019.04.03	1,500	买入
		2019.04.10	-4,000	卖出
		2019.05.21	2,000	买入
		2019.05.23	4,000	买入
		2019.05.29	2,000	买入
		2019.05.29	-2,000	卖出
		2019.06.21	-2,000	卖出
		2019.06.27	2,000	买入
		2019.07.02	-2,000	卖出
		2019.07.08	2,000	买入
		2019.07.15	-3,000	卖出
		2019.07.17	-3,000	卖出
张文进	上市公司副总经理、董	2019.07.31	8,000	买入

姓名	身份/关联关系	交易日期	交易数量（股）	交易类型
	事会秘书张敏之配偶			
国泰君安证券股份有限公司	本次交易之独立财务顾问	2019.05.22	10,000	买入
		2019.05.23	-10,000	卖出
		2019.06.27	8,000	买入
		2019.07.04	-8,000	卖出
		2019.07.24	20,000	买入
		2019.07.30	-10,000	卖出

注：2019年3月15日，北京君正副总经理、财务总监叶飞在员工持股计划中行权 11,158 股，行权后持股 22,316 股。2019年6月19日，叶飞行权 14,878 股，行权后持股 37,194 股。除上述行权情形外，叶飞自查期间不存在买卖北京君正股票的情况。

（二）自查情况说明

自查期间，刘将、白洁、陈冬梅、张文进、国泰君安证券股份有限公司存在买卖北京君正公司股票的情况，具体情况如下：

1、根据自查报告，刘将存在买卖公司股票的行为，但其本人及其本人直系亲属不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。刘将承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

此外，截至本报告书出具日，刘将已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票行为的承诺函》，承诺如下：“自查期间，本人存在买卖北京君正股票的行为，但不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖北京君正股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。本人买卖北京君正股票时，未知悉本次重组的任何信息或情况，是本人根据证券市场信息及个人判断而进行，纯属个人投资行为，与公司本次重组不存在关联关系，亦不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

2、根据自查报告，白洁存在买卖公司股票的行为，但其本人及其本人直系亲属不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。白洁承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

此外，截至本报告书出具日，白洁已出具《关于买卖北京君正集成电路股份

有限公司股票行为的承诺函》，承诺如下：“自查期间，本人存在买卖北京君正股票的行为，系员工持股计划对应行权及卖出行为。本人买卖北京君正股票是本人根据证券市场信息及个人判断而进行，纯属个人投资行为，与公司本次重组不存在关联关系，亦不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

3、根据自查报告，陈冬梅存在买卖公司股票的行为，但其本人及其本人直系亲属不存在泄露有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。陈冬梅承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

此外，截至本报告书出具日，陈冬梅已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票行为的承诺函》，承诺如下：“自查期间，本人存在买卖北京君正股票的行为，但不存在泄露有关信息或者建议他人买卖北京君正股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。本人买卖北京君正股票时，未知悉本次重组的任何信息或情况，是本人根据证券市场信息及个人判断而进行，纯属个人投资行为，与公司本次重组不存在关联关系，亦不存在获取或利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形。”

4、根据自查报告，张文进存在买入公司股票的行为，但其本人及其本人直系亲属不存在泄露有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。张文进承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

此外，截至本报告书出具日，张文进已出具《关于买卖北京君正集成电路股份有限公司股票行为的承诺函》，承诺如下：“自查期间，本人存在买卖北京君正股票的行为，但不存在泄露有关信息或者建议他人买卖北京君正股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。本人买卖北京君正股票时，未知悉本次重组的任何信息或情况，是本人因操作不熟练导致的失误，并非本人真实买卖意愿，与公司本次重组不存在关联关系，亦不存在获取或利用本次资产重组内幕信息进行股票交易的情形。”

5、根据自查报告，国泰君安证券股份有限公司存在买卖公司股票的行为，该股票买卖行为系国泰君安证券股份有限公司自营投资业务使用自营账户买卖

北京君正股票，将其作为一揽子股票组合用于股指期货（沪深 300、上证 50、中证 500）对冲的投资行为，该投资行为是基于其投资策略执行的操作。国泰君安证券股份有限公司承诺对自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证自查报告中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。

除上述情况外，本次重组自查范围内的相关机构及人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，亦不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

七、利润分配政策与股东回报计划

（一）发行后公司股利分配政策

1、利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，每年按照当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利，分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
- （3）同股同权、同股同利的原则；
- （4）公司持有的公司股份不得参与分配利润的原则；
- （5）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的方式。

3、利润分配的期间间隔

在当年盈利的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

4、利润分配的条件及比例

（1）现金分红的条件

①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司当年可不进行现金分红；

⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（2）现金分红的比例

在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 5%，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红后，采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

5、利润分配方案应履行的审议程序及利润分配方案的实施

（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。

（3）若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未提出现金利润分配的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划。此类利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过后，公司董事会须在股东大会召开之日起两个月内完成股利的派发事项。

6、利润分配方案的研究论证程序和决策机制

（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案。

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。公司在上一会计年度实现盈利且符合现金分红条件，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，股东大会审议时应提供网络投票方式，并在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（4）董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

7、利润分配政策调整

（1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”系指以下情形：

①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，需经全体监事过半数以上表决同意。

（3）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且应当安排网络投票，网络投票需经参加网络投票的社会公众股股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

8、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

9、若存在公司股东违规占用公司资金的情形，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

（二）重组完成后股利分配计划

1、股东回报规划制定考虑因素

应着眼于公司长远和可持续发展，有利于公司全体股东利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司

股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则

充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、公司本次重组完成后股东分红回报的计划

（1）现金分红的条件

①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司当年可不进行现金分红；

⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（2）现金分红的比例

在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于

当年实现的母公司可供分配利润的 5%，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于该连续三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红后，采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

八、关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的说明

本次交易相关主体（包括上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方，交易对方，北京矽成、上海承裕及其董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

九、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见

公司聘请国泰君安、中德证券作为本次交易的独立财务顾问。根据国泰君安、中德证券出具的《独立财务顾问报告》，独立财务顾问认为：

“（一）本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《格式准则 26 号》等法律法规及规范性文件的规定。相关信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；

（二）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市；

（三）本次交易中，标的资产的定价原则公允；公司向交易对方发行股份的定价原则符合相关规定，定价方式和发行价格合理、公允，不存在损害上市公司股东利益的情形；

（四）本次交易涉及资产评估的评估假设前提合理，方法选择得当，结论公允、合理，有效地保证了交易价格的公平性；

（五）本次交易不影响上市公司的上市地位，本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经

营能力，符合上市公司及全体股东的利益；

（六）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

（七）本次交易的交易标的资产完整、权属清晰，按合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍；本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法，在交易各方履行本次交易相关协议的情况下，不存在上市公司交付现金或者发行股票后不能及时获得相应对价的情形；

（八）本次交易构成关联交易；本次交易符合上市公司战略发展方向，有利于增强上市公司未来持续盈利能力，不存在损害上市公司及非关联股东的利益的情形；

（九）交易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数情况的补偿安排切实可行、合理；

（十）本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定；本次交易中，上市公司除聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定。”

十、律师事务所对本次交易出具的结论性意见

公司聘请金杜作为本次交易的法律顾问。根据《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称为“《法律意见书》”），法律顾问认为：“本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；北京君正并已依法履行现阶段应当履行的法律程序，在取得本法律意见书第二部分“本次交易的批准和授权”所述的全部批准及授权后，本次交易的实施将不存在实质性法律障碍。”

十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务

上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《重组管理办法》等相关法律、法规的规定对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，上市公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（二）严格履行相关程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本报告书在提交董事会讨论时，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易聘请国泰君安、中德证券作为上市公司独立财务顾问出具独立财务顾问报告，聘请金杜律师出具法律意见书，聘请具有证券期货业务资格的东洲评估进行评估并出具相关报告，聘请具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所进行审计并出具相关报告。根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。

（三）网络投票安排

上市公司公布正式重组方案后，在审议本次交易的股东大会上，公司严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，切实保护了股东的合法权益。同时，公司对中小投资者投票情况单独统计并予以披露。

（四）资产定价公允性

上市公司聘请会计师、评估机构对本次交易的标的资产进行了审计、评估，标的资产的交易价格由交易各方以经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告的评估结果为基础协商确定，本次交易的定价公允、合理。

同时，公司独立董事对本次交易涉及资产评估定价的公允性发表了独立意

见。公司所聘请的独立财务顾问和法律顾问将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见。

（五）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、本次重组对上市公司预期每股收益的影响

本次重大资产重组中，上市公司拟向交易对方发行 248,650,730 股股份，不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本规模将由 248,650,730 股增加至 450,688,714 股

基于上述情况，公司测算了本次重大资产重组完成当年（假设本次重大资产重组在 2019 年 10 月完成）主要财务指标，关于测算过程的主要假设说明如下：

（1）以下假设仅为测算本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2019 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（2）假设公司于 2019 年 10 月 31 日完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），本次重大资产重组最终完成时间以中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

（3）假设宏观经济环境、集成电路芯片行业的情况没有发生重大不利变化；

（4）不考虑配套融资发行股份的数量，假设本次重大资产重组发行股份的数量合计为 248,650,730 股，未扣除本次重组相关的发行及中介费用的影响；

（5）根据业绩承诺方承诺的北京矽成净利润数据，北京矽成 2019 年净利润为 4,900 万美元（未包含 Connectivity, LIN, CAN, MCU 及光纤通讯业务相关损益、北京矽成因实施股权激励所产生的费用、北京矽成因收购 ISSI 产生的可辨认无形资产和固定资产评估增值的摊销以及配套募集资金投资项目损益），按照 2018 年 12 月 31 日人民币汇率中间价 6.8632 换算即为 33,629.68 万元，假设以该承诺业绩作为北京矽成 2019 年归属于母公司股东的净利润指标进行测算；

（6）根据上市公司 2018 年年度报告财务数据，2018 年归属于母公司股东的净利润为 1,351.54 万元，假设 2019 年预计归属于母公司股东的净利润与 2018

年持平，即为 1,351.54 万元；

（7）不考虑公司股权激励计划在 2019 年度对股份数的影响，假设公司 2019 年不存在其他公积金转增股本、股票股利分配等对股份数有影响的事项；

（8）公司经营环境未发生重大不利变化；

（9）不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响。

经测算，公司本次重大资产重组前后每股收益指标具体影响如下：

项目	2019 年	
	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)
归属母公司所有者的净利润（单位：万元）	1,351.54	6,956.49
基本每股收益（单位：元/股）	0.07	0.15
稀释每股收益（单位：元/股）	0.07	0.15

基于上述假定，本次重大资产重组完成后，不考虑配套融资的影响，上市公司 2019 年归属母公司所有者的净利润较发行前增长 5,604.95 万元，上市公司 2019 年基本每股收益 0.15 元/股，较 2019 年重组完成前的基本每股收益增加 0.08 元/股，增幅为 130.21%，重组后上市公司盈利能力有所上升。

综上，本次交易完成后，上市公司不存在重组完成当年因本次交易导致即期每股收益被摊薄的情形。

2、报告期上市公司备考报表每股收益情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司 2018 年审计报告、上市公司出具的 2019 年 1-5 月财务报表及信永中和出具的上市公司 2018 年、2019 年 1-5 月备考审阅报告，上市公司重组前后每股收益指标如下：

项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套融资)
归属母公司所有者的净利润（单位：万元）	3,183.71	8,766.68	1,351.54	8,506.51
基本每股收益（单位：元/股）	0.16	0.20	0.07	0.19

项目	2019 年 1-5 月		2018 年	
	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套 融资)	重组完成前	重组完成后 (不考虑配套 融资)
稀释每股收益(单位: 元/股)	0.16	0.20	0.07	0.19

上述重组完成后的数据基于以下假设：

(1) 本次发行股份及支付现金购买资产交易已于 2018 年 1 月 1 日实施完成。上市公司实现与北京矽成、上海承裕的企业合并的公司架构于 2018 年 1 月 1 日业已存在，并按照此架构持续经营。

(2) 未考虑发行股份购买资产过程中可能发生的交易费用支出以及所涉及的各项税费，亦未考虑本次非公开发行股份配套募集资金事项。

基于上述假定，重组完成后上市公司 2018 年、2019 年 1-5 月归属母公司所有者的净利润分别为 8,506.51 万元、8,766.68 万元，基本每股收益分别为 0.19 元/股、0.20 元/股，较重组完成前增幅较大。

3、上市公司填补摊薄即期回报并增强公司持续回报能力的具体措施

在前述假设条件下，本次重大资产重组不会摊薄上市公司即期回报。若因经营环境等的变化导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：

(1) 加强收购整合，提升盈利能力

本次交易完成后，上市公司将实现对北京矽成企业文化、研发、采购、营销和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司将通过整合力争保证对北京矽成的控制力又保持其原有的市场竞争活力，将自身管理体系、财务体系、内控体系有效贯彻至北京矽成，充分实现本次交易的预期效益。上市公司将帮助北京矽成尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。

(2) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充

分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

（3）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

（4）加强募集资金的管理和运用

本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合中介机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（5）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回

报股东的长期发展理念。

4、公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司本次重组关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（1）全体董事、高级管理人员承诺

本次重大资产重组完成后，全体公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；

2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。”

（2）公司控股股东、实际控制人承诺

公司的控股股东和实际控制人刘强、李杰先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“在持续作为公司控股股东和实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

（六）其他保护投资者权益的安排

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。本次交易完成后，公司将继续保持独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，继续规范运作。

第十四章 本次交易的有关中介机构情况

一、独立财务顾问

（一）国泰君安

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38676666

传真：021-38676666

经办人：陈泽、张杰、范宇峰、汪程聪、张蕾、寻国良、黄央、张希滕、陈浩、周润楠

（二）中德证券

名称：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 座写字楼 22 层

电话：010-59026666

传真：010-59026970

经办人：张希、肖楚男、高碧凝、阮孝莉、曲滕

二、法律顾问

名称：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：王玲

地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

电话：010-58785888

传真：010-58785566

经办人：焦福刚、章敬平、张亚楠

三、审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：叶韶勋

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大夏 A 座 8 层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

经办人：晁小燕、田娟

四、评估机构

名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

地址：上海市延安西路 889 号太平洋企业中心 19 楼

电话：021-52402166

传真：021-62252086

经办人：方明、胡屿冰

第十五章 本次交易相关各方的声明

董事声明

本公司及全体董事承诺《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

刘 强

李 杰

张 紧

冼永辉

梁云凤

王艳辉

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 11 月 6 日

监事声明

本公司及全体监事承诺《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事（签字）：

张燕祥

许志鹏

周 悦

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 11 月 6 日

高级管理人员声明

本公司及全体非董事高级管理人员承诺《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体非董事高级管理人员（签字）：

张 敏

周生雷

叶 飞

刘 将

黄 磊

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 11 月 6 日

独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

王松（代）

内核负责人：

许业荣

部门负责人：

金利成

财务顾问主办人：

陈 泽

张 杰

财务顾问协办人：

范宇峰

汪程聪

张 蕾

国泰君安证券股份有限公司

2019年11月6日

独立财务顾问声明

本公司及本公司经办人员同意《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

侯 巍

财务顾问主办人：

张 希

肖楚男

财务顾问协办人：

高碧凝

阮孝莉

曲 滕

中德证券有限责任公司

2019 年 11 月 6 日

法律顾问声明

本所及本所经办律师同意《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

王 玲

经办律师：

焦福刚

章敬平

张亚楠

北京市金杜律师事务所

2019 年 11 月 6 日

审计机构声明

本所及本所签字注册会计师同意《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本所出具的审计报告、备考审阅报告及与上述报告相关的报告内容，且所引用内容已经本所及本所签字注册会计师审阅，确认《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

叶韶勋

签字注册会计师：

晁小燕

田娟

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 11 月 6 日

评估机构声明

本公司及本公司签字资产评估师同意《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具的评估数据，且所引用评估数据已经本公司及本公司签字资产评估师审阅，确认《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

王小敏

签字资产评估师：

方明

胡屿冰

上海东洲资产评估有限公司

2019 年 11 月 6 日

第十六章 备查文件及备查地点

一、备查文件

- 1、北京君正第三届董事会二十七次会议决议、北京君正第四届董事会第五次会议决议、北京君正第四届董事会第七次会议决议；
- 2、北京君正独立董事关于本次重组的独立意见；
- 3、交易对方关于本次重组的内部决策文件；
- 4、北京君正及/或合肥君正与交易对方、标的企业签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议；
- 5、北京君正与屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原签署的《盈利补偿协议》及补充协议；
- 6、信永中和出具的北京矽成 2017 年、2018 年、2019 年 1-5 月审计报告，上海承裕 2017 年、2018 年、2019 年 1-5 月备考审计报告，上市公司 2018 年、2019 年 1-5 月备考审阅报告；
- 7、东洲评估出具的北京矽成资产评估报告、上海承裕资产评估报告；
- 8、独立财务顾问出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》；
- 10、金杜律师出具的《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》及《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》；
- 11、其它与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件；

（一）北京君正集成电路股份有限公司

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼

电话：010-56345005

传真：010-56345001

联系人：白洁

（二）国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

电话：021-38676666

传真：021-38676666

联系人：陈泽、张杰

（三）中德证券有限责任公司

联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 座写字楼 22 层

电话：010-59026666

传真：010-59026970

联系人：张希、肖楚男

三、备查网址

指定信息披露网址：深圳证券交易所 www.szse.com.cn；巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

（本页无正文，系《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之签章页）

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 11 月 6 日